證券代號：8162

微矽電子股份有限公司
MICRO SILICON ELECTRONICS CO., LTD.
公開說明書

(現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用)

一、公司名稱：微矽電子股份有限公司。

二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用。

(一)發行新股來源：現金增資發行新股。

(二)種類：記名式普通股，**每股面額新臺幣壹拾元整**。

(三)股數：現金增資發行新股 4,042,000 股。

(四)金額：新臺幣 40,420,000 元整。

(五)發行條件：

1. 本次現金增資發行新股 4,042,000 股，每股面額新臺幣 10 元，計新臺幣 40,420,000 元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣 32.41 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格每股新臺幣 40.75 元為之，惟均價高於最低承銷價格之 1.08 倍，故每股發行價格以新臺幣 35.00 元溢價發行。
2. 本次現金增資依公司法 267 條規定，保留發行新股約 15%，計 606,000 股由本公司員工認購，員工若有認購不足或放棄認購部分，則授權董事長洽特定人認購之，其餘 85%計 3,436,000 股全數委託證券承銷商對外辦理公開承銷。
3. 本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

(六)公開承銷比例：本次現金增資發行新股總數約 85%，共計 3,436,000 股。

(七)承銷及配售方式：採全數競價拍賣方式辦理承銷。

三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱公開說明書第 60 頁。

四、本次發行之相關費用：

(一)承銷費用：包含上市輔導費及承銷手續費等費用，約新台幣 500 萬元。

(二)審查費用：新台幣 50 萬元。

(三)其他費用：包含會計師公費、律師及印刷費等其他費用，約新台幣 140 萬元。

五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

七、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項：請參閱本公開說明書第 3~9 頁。

八、本公開說明書，適用於初次申請有價證券創新板上市，並計畫以現金增資發行新股委託證券承銷商辦理創新板上市前之公開銷售。

九、本公司係創新板上市公司，相關營運風險較高。

十、本次現金增資所發行之股票，為因應證券市場價格之變動，證券承銷商必要時得依規定進行安定操作。

十一、股票初次申請創新板上市案件，掛牌後首五個交易日無漲跌幅之限制，投資人應注意交易之風險。

十二、本公司係依上市審查準則第二十九條第一項之規定申請股票在創新板上市之公司，並未被要求獲利之上市條件，且所營業務具有相當之風險性，僅限符合資格之合格投資人買賣，請投資人特別注意。

十三、本公司於上市掛牌年度及其後三個會計年度內，繼續委任主辦承銷商協助本公司遵循中華民國證券法令、臺灣證券交易所章則暨公告事項及上市契約等規章規範；若上市掛牌期間發生與證券承銷商終止委任關係時，應於終止委任生效日起一個月內委任其他承銷商繼任。

十四、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw。

微矽電子股份有限公司　　編製

中　華　民　國　一　一　三　年　三　月　二　十　六　日　　刊　印

本公司申請已公開發行普通股 64,660,000 股上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」審查，同意俟股票公開銷售完畢後，列為創新板上市股票，並以 112 年 12 月 29 日臺證上二字第 1121705168 號函報金融監督管理委員會備查。

一、本次發行前實收資本額之來源： 單位：新臺幣仟元；%

實收資本之來源	金　　額	佔實收資本額比率(%)
設立股本	10,000	1.55%
現金增資	154,600	23.91%
盈餘轉增資	415,900	64.32%
資本公積轉增資	28,080	4.34%
減資	(37,480)	(5.80%)
合併增資	75,500	11.68%
合　　計	646,600	100.00%

二、公開說明書分送計畫

(一)陳列處所：依規定函送有關單位外，另陳列於本公司以供查閱。
(二)分送方式：依金融監督管理委員會證券期貨局規定之方式辦理。
(三)索取方法：請透過公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)查閱下載。

三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：

名稱：兆豐證券股份有限公司　網址：https://www.megasec.com.tw
地址：台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓　電話：(02)2327-8988
名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司　網址：http://www.entrust.com.tw
地址：台北市民生東路四段 54 號 5 樓　電話：(02) 2545-6888
名稱：富邦綜合證券股份有限公司　網址：www.fubon.com/securities/home
地址：台北市仁愛路四段 169 號 3 及 4 樓　電話：(02)8771-6888
名稱：宏遠證券股份有限公司　網址：http://www.honsec.com.tw
地址：台北市信義路四段 236 號 3 至 5 樓及 7 樓　電話：(02)2700-8899

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司　股務代理部　網址：https://www.entrust.com.tw/
地址：台北市民生東路四段 54 號 4 樓　電話：(02)2718-6425

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

事　務　所：資誠聯合會計師事務所　網址：https://www.pwc.tw/
會計師姓名：李典易會計師、白淑蒨會計師　電話：(03)578-0205
地　　址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

律師姓名：蔚中傑律師
事務所名稱：蔚中傑律師事務所　地址：台北市忠孝東路二段 118 號 6 樓
網址: www.ctlaw.com.tw　電話：(02)3322-5516

十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：王志成　代理發言人姓名：呂月雲
職稱：副總經理　職稱：財務部經理
聯絡電話：(037)587-222　聯絡電話：(037)587-222
電子郵件信箱：msec_spokesman@msec.com.tw　電子郵件信箱：msec_spokesman@msec.com.tw

十三、公司網址：http://www.msec.com.tw

微矽電子股份有限公司
產業、營運及其他重要風險

一、產業風險：市場變化快速，終端應用產品功能提升競爭激烈

近年來終端產品走向節能的趨勢，電子產業持續針對節能進行優化，對精密度及功能性之要求大幅提升，半導體製程因應此趨勢需不斷演進。

因應措施：

隨著半導體製程的不斷精進，IDM 廠商對於昂貴的廠房及設備支出逐漸無力負荷，因而將製造業務委外給專業的專業晶圓代工及封測業者，本公司具有豐富的測試及封裝經驗，並自行開發出晶圓進行正面金屬鍍膜及晶圓背面研磨與金屬鍍膜等服務，為提供客戶一站式之服務，與客戶維持長久之合作關係，客戶亦不易輕易變更合作廠商，以確保產品品質及如期交貨。

二、營運風險

(一)半導體市場景氣波動，影響公司營運

測試封裝廠屬於半導體產業供應鏈後段製程，因此仍受半導體景氣循環影響。

因應對策：

因應半導體產業市場與其技術的不斷變化，本公司持續開發新產品，與客戶建立長期的合作關係，提供客戶高附加價值之代工服務。隨高效能運算、5G、物聯網和車用電子等市場持續擴大，本公司之客戶已於各類產品進行佈局，以降低已成熟產品之市場需求力道減弱所帶來之營運風險，未來本公司持續與客戶配合，搭配本公司各項代工製程及機台改良技術，強化品質、成本、交期的優勢，以因應市場快速變化及同業之競爭。

(二)研發人員流失之風險

隨著半導體產業不斷的發展，具經驗之技術開發及研發人才的爭取日漸困難，且需要長時間培養及訓練，故具經驗之研發人才常成為他公司招攬之對象。

因應措施：

本公司透過技術人員之技術傳承、實作經驗分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術開發及研發人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的研發團隊。此外，提供良好的工作環境，並建立制度化的員工福利獎酬辦法，以增進員工之向心力。對於研發人員均要求簽訂保密合約，且對於所研發之技術做適當之資料保存，以預防研發人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。另本公司積極推動上市，藉以提高公司知名度，吸引優秀人才，並可透過發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及員工酬勞等工具，將公司經營成果與員工共享，以提高員工之向心力。

(三) 中國半導體產業之競爭風險

近年來中國半導體業力求提高自給率，並在政策上大力支持下，將成為中國半導體封測公司步入快速發展的有效驅動力，對我國半導體產業形成競爭壓力。

因應對策：

本公司以強化新產品的工程能力及提供精進之測試封裝服務能力，以品質、交期、效率與彈性的服務內容，與中國大陸廠商形成區隔，獲取更多台灣及國外客戶長期合作的機會。

三、其他重要風險

本公司其他重要風險說明及因應措施，請參閱本公開說明書「壹、二、(一)風險因素」之說明。

微矽電子股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新臺幣 646,600 仟元	公司地址：新竹縣竹東鎮沿河街395號	電話：(037)587-222

設立日期：民國76年8月11日		網址：http://www.msec.com.tw	
上市日期：不適用	上櫃日期：不適用	公開發行日期：111年 6月17日	管理股票日期：不適用
負責人：董事長　張秉堂 總經理　張秉堂		發　言　人：王志成　　職稱：副總經理 代理發言人：呂月雲　　職稱：財務部經理	
股票過戶機構 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部		電話：(02)2718-6425 地址：台北市民生東路四段54號4樓	網址https://www.entrust.com.tw
股票承銷機構： 兆豐證券股份有限公司		電話：(02)2327-8988 地址：台北市忠孝東路二段95號3樓	網址：https://www.megasec.com.tw
股票承銷機構： 華南永昌綜合證券股份有限公司		電話：(02)2545-6888 地址：台北市民生東路四段54號5樓	網址：http://www.entrust.com.tw
股票承銷機構： 富邦綜合證券股份有限公司		電話：(02)8771-6888 地址：台北市仁愛路四段169號3及4樓	網址：www.fubon.com/securities/home
股票承銷機構： 宏遠證券股份有限公司		電話：(02)2700-8899 地址：台北市信義路四段236號3至5樓及7樓	網址：http://www.honsec.com.tw
最近年度簽證會計師：資誠聯合會計師事務所 李典易會計師、白淑蒨會計師		電話：(03)578-0205 地址：台北市信義區基隆路一段333號27樓	網址：https://www.pwc.tw
複核律師： 蔚中傑律師事務所　蔚中傑律師		電話：(02)3322-5516 地址：台北市忠孝東路二段118號6樓	網址：www.ctlaw.com.tw
信用評等機構：不適用		電話：不適用	網址：不適用　地址：不適用
評等標的	發行公司：不適用	無■；有□，評等日期：不適用　評等等級：不適用	
	本次發行公司債：不適用	無■；有□，評等日期：不適用　評等等級：不適用	
董事選任日期：111年08月02日，任期：3年		監察人選任日期：成立審計委員會，故不適用。	
全體董事持股比例：26.61% (113年1月31日)		全體監察人持股比率：成立審計委員會，故不適用。	

董事、監察人及持股超過10%股東及其持股比例：（113年1月31日）

職　稱	姓　　名	持股比例	職　稱	姓　　名	持股比例
董事長	大日月投資有限公司　代表人：張秉堂	22.89%	獨立董事	張居興	—
董事	辰真投資有限公司　　代表人：張辰	1.89%	獨立董事	溫萬壽	—
董事	彭盈光	1.83%	獨立董事	彭俊豪	—
董事	張蔚誠	—	獨立董事	譚仲民	—
董事	楊式蘭	—	持股超過10%股東	大日月投資有限公司	22.89%

工廠地址：竹東廠：新竹縣竹東鎮雞林里8鄰沿河街395號 竹南廠：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰友義路230號		電話：(03)596-5770 (037)587-222
主要產品：半導體測試加工服務 市場結構：111 年度 內銷 85.74%、外銷 14.26%		參閱本文之頁次第42頁
風險事項	請詳本公開說明書公司概況之風險事項	參閱本文之頁次第3～9頁
去(111)年度	營業收入：1,226,677 仟元 稅前純益：227,209 仟元 每股稅後盈餘：2.70 元	第 71 頁

本次募集發行有價證券種類及金額	請參閱本公開說明書封面
發行條件	請參閱本公開說明書封面
募集資金用途及預計產生效益概述	請參閱本公開說明書：參、發行計畫及執行計畫
主辦證券承銷商執行過額配售及價格穩定之相關資訊	本公司已與主辦證券承銷商簽訂過額配售協議書，並協調相關事宜。
本次公開說明書刊印日期：民國113年2月26日	刊印目的：現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市用

其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄

微矽電子股份有限公司

公開說明書目錄

壹、公司概況 1

一、公司簡介 1

(一)設立日期 1

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話 1

(三)公司沿革 1

二、風險事項 3

(一)風險因素 3

(二)訴訟或非訟事件 6

(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響 6

(四)發行公司於最近一個會計年度或申請上市會計年度內，其子公司符合會計師查核簽 證財務報表規則第二條之一第二項及會計師受託查核簽證金融機構財務報表相關規定第五條規定之重要子公司標準之一者，應增列該子公司之風險事項說明 6

(五)外國發行公司應增列敘明外國發行公司註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施 7

(六)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明擁有之關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式，及因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施 7

(七)其他重要事項 9

三、公司組織 10

(一)組織系統 10

(二)關係企業圖 11

(三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管 12

(四)董事及監察人 14

(五)發起人 19

(六)最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金 20

(七)發行人之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經(學)歷、持有股份、目前兼任發行公司及其他公司之職務、與發行公司董事之關係及對發行公司實質控制情形，另外國發行公司尚應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任 25

(八)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明核心技術人員之資歷簡歷 25

四、資本及股份 26
(一)股份種類 26
(二)股本形成經過 26
(三)最近股權分散情形 26
(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 31
(五)公司股利政策及執行狀況 32
(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 32
(七)員工、董事及監察人酬勞 32
(八)公司買回本公司股份情形（已執行完畢者） 33
五、公司債（含海外公司債）辦理情形 33
六、特別股辦理情形 33
七、參與發行海外存託憑證之辦理情形 33
八、員工認股權憑證辦理情形 33
九、限制員工權利新股辦理情形 33
十、併購辦理情形 33
十一、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者 33
貳、營運概況 34
一、公司之經營 34
(一)業務內容 34
(二)市場及產銷概況 42
(三)最近二年度從業員工人數 49
(四)環保支出資訊 49
(五)勞資關係 51
(六)資訊安全管理 53
(七)有無因應景氣變動之能力 53
(八)發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之關係人間交易事項是否合理 53
(九)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列下列事項 53
二、不動產、廠房及設備、其他不動產或其使用權資產 56
(一)自有資產 56
(二)使用權資產 56
(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率 57
三、轉投資事業 57
(一)轉投資事業概況 57
(二)綜合持股比例 57
(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響 57
(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事

或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認股情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股超比例超過百分之十股東之關係及認購股數 57
四、重要契約 58
叁、發行計畫及執行情形 58
一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析 58
二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫 60
三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項 67
四、本次併購發行新股應記載事項 67
肆、財務概況 68
一、最近五年度簡明財務資料 68
(一)簡明資產負債表及綜合損益表 68
(二)影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響 73
(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見 74
(四)財務分析 75
(五)會計項目重大變動說明 81
二、財務報告應記載事項 83
(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告 83
(二)最近年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告。但不包括重要會計項目明細表 83
(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露 83
三、財務概況其他重要事項 83
(一)公司及關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司公司財務狀況之影響 83
(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露之下列資訊 83
(三)期後事項 83
(四)其他 83
四、財務狀況及經營結果檢討分析 84
(一)財務狀況 84
(二)財務績效 86
(三)現金流量 86
(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響 87
(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 87
(六)其他重要事項 87

伍、特別記載事項 88
一、內部控制制度執行狀況 88
(一)列明最近三年度會計師提出之內部控制改進建議及內部稽核發現重大缺失之改善情形 88
(二)內部控制聲明書 88
(三)委託會計師專案審查內部控制者，列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情況 88
二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告 88
三、證券承銷商評估總結意見 88
四、律師法律意見書 88
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見 88
六、前次募集與發行有價證券於申報生效（申請核准）時經金融監督管理委員會通知應自行改進事項之改進情形 88
七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項 88
八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報（請）募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形 88
九、最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容 88
十、最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形 89
十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書 89
十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書 89
十三、本國發行公司自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專案審查取具之報告書 89
十四、發行公司之公司治理運作情形 89
十五、發行公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事 89
十六、發行公司於申請上市會計年度及其上一會計年度已辦理與辦理中之大量現金增資發行新股，及是否產生相當效益之評估 89
十七、發行公司是否有與其他公司共同使用申請貸款額度 89
十八、發行公司有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人 89
十九、具有上市審查準則第六條之一所規定申請之公司者，應增列事項 89
二十、具有上市審查準則第十六條所規定之公司者，應增加揭露資訊 89

二十一、發行公司有上市審查準則補充規定第十條或第二十六條所列各款情事者，應將該非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會..... 89
二十二、本國發行公司為普通申請公司債上市者，應增列事項..... 89
二十三、充分揭露發行公司與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式..... 89
二十四、發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於申請公司股票上市後對財務報表可能之影響..... 89
二十五、依上市審查準則第四條第二項、第三項、或第二十八條之一第五項、第六項、或屬科技事業、文化創意事業申請股票初次上市，且委託證券承銷商辦理上市前公開銷 售，並保留一定比例採洽商銷售方式辦理配售者，應增列配售名單、協議認購股數、協議配售總股數、占公開銷售總股數之比例及配售股票之集保期間與賣出限制等事項..... 90
二十六、證券承銷商應就前款配售名單合理性、配售股數、占公開銷售總股數之比例、配售 股票賣出限制、繳款資力及協議事項妥適性出具評估意見..... 90
二十七、本國發行公司或外國發行公司依第十三款規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售者，本國發行公司或外國發行人及證券承銷商應出具絕無以任何方式或名目，提供直接或間接利益予洽商銷售投資人或其指定人之聲明書。該洽商銷售投資人亦應出 具絕無要求或收取發行公司或承銷商以任何方式或名目提供之直接或間接利益之聲明書..... 90
二十八、外國發行公司有上市審查準則第二十八條之七第一項第三款或三十四條第二項第二款情事者，應將有關股東權益保護之重要事項因與註冊地國法令之強制規定牴觸，致未能增訂於公司章程或組織文件之重大差異充分揭露..... 90
二十九、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明..... 90
三十、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見..... 90
三十一、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項..... 90
(一)董事會運作情形..... 90
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形..... 92
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 . 94
(四)公司如有設置薪酬委員會或提名委員會，應揭露其組成及運作情形 98
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因..... 99
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 105
(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總..... 105

(九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之之重要情形 105
三十二、其他必要補充說明事項 107
陸、重要決議、公司章程及相關法規..... 125
一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文(含章程新舊條文對照表及盈餘分配表)..... 125
(一)與本次發行有關之決議文 125
(二)公司章程及新舊條文對照表 125
(三)盈餘分配表 125
二、未來股利發放政策 125
三、未來辦理增資計劃及其對獲利能力稀釋作用之影響事項 125
四、本國發行公司或外國發行人召開股東會討論股票初次申請上市暨辦理上市前現金增資新股公開銷售，並將保留該新股之一定比例採洽商銷售方式辦理配售，應於股東會召集事由列舉並說明相關事宜，並應完整揭露股東會決議內容..... 126

附件一、 111年度合併財務報告及會計師查核報告
附件二、 111年度個體財務報告及會計師查核報告
附件三、 112年度第三季合併財務報告暨會計師核閱報告
附件四、 內部控制聲明書
附件五、 內部控制制度審查報告
附件六、 法律意見書
附件七、 誠信聲明書
附件八、 不得退還或收取承銷相關費用之聲明書
附件九、 不受理特定投標對象聲明書
附件十、 財務業務往來無非常規交易情事聲明書
附件十一、證券承銷商評估總結意見
附件十二、承銷價格計算書
附件十三、與本次發行有關之決議文
附件十四、盈餘分配表
附件十五、公司章程(含章程修正條文對照表)
附件十六、股票初次申請創新板上市證券承銷商評估報告
附件十七、創新板上市前現金增資發行新股證券承銷商評估報告

壹、公司概況

一、公司簡介

(一)設立日期

民國 76 年 8 月 11 日

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司及工廠：新竹縣竹東鎮沿河街 395 號　　電　話：(03)596-5770

工　　廠：苗栗縣竹南鎮公義里友義路 230 號　　電　話：(037)587-222

(三)公司沿革

年度	項目
民國 76 年	● 公司正式成立，設立資本額為新臺幣 10,000 仟元整。 ● 以晶圓切割業務為主。
民國 77~78 年	● 成立板上晶片封裝(Chip On Board,以下簡稱 COB)業務。 ● 盈餘轉增資 11,500 仟元，現金增資 1,000 仟元，擴充資本額為新臺幣 22,500 仟元整。
民國 79~81 年	● 成立封裝管(Tube)生產業務。 ● 購買土地約 900 坪，興建自有廠房約 500 坪。 ● 盈餘轉增資 27,517 仟元，擴充資本額為新臺幣 50,017 仟元整。 ● 成立晶粒盤(IC Tray,以下簡稱 IC Tray 盤)業務。
民國 84 年	● 盈餘轉增資 49,983 仟元，擴充資本額為新臺幣 100,000 仟元整。
民國 85 年	● 盈餘轉增資 50,000 仟元，擴充資本額為新臺幣 150,000 仟元整。
民國 86 年	● 通過 ISO 9001 認證。 ● 購買土地約 900 坪。 ● 盈餘轉增資 45,000 仟元，擴充資本額為新臺幣 195,000 仟元整。
民國 87 年	● 盈餘轉增資 156,000 仟元，現金增資 117,000 仟元，資本公積轉增資 117,000 仟元，擴充資本額為新臺幣 468,000 仟元整。 ● 成立成品測試業務。 ● 補辦股票公開發行(註 1)。
民國 88 年	● 盈餘轉增資 42,120 仟元，資本公積轉增資 28,080 仟元，員工認股權 3,550 仟元，擴充資本額為新臺幣 541,750 仟元整。 ● 建立 IC Tray 盤生產線。
民國 89 年	● 晶粒挑檢自動化設備，正式上線。 ● 盈餘轉增資 27,087.5 仟元，員工認股權 3,142.5 仟元，擴充資本額為新臺幣 571,980 仟元整。

年度	項目
民國 92 年	● 通過 ISO 14001 認證。 ● 建立 LCD 驅動 IC 晶圓成品測試生產線。 ● 建立 LCD 驅動 IC 玻璃覆晶封裝(Chip On Glass,以下簡稱 COG 封裝)生產線。
民國 93 年	● 撤銷股票公開發行(註 2)。
民國 94 年	● 竹東廠經海關核准登記為保稅工廠。
民國 96 年	● 退還股東股款 30,000 仟元，減資後資本額為新臺幣 541,750 仟元整。
民國 97 年	● 合併大力電子股份有限公司，合併後擴充資本額為新臺幣 617,480 仟元整，並取得原大力電子廠房成為微矽竹南廠，土地面積約 2,425 坪，廠房面積約 2,901 坪。
民國 98 年	● 建立 LED 晶粒測試加工生產線。
民國 100 年	● 通過 ISO/TS 16949 認證。
民國 101 年	● 通過 OHSAS 18001 認證。
民國 103 年	● 建立氮化鎵(Gallium Nitride,以下簡稱 GaN)晶圓晶片測試生產線。
民國 105 年	● 建立晶圓級晶片尺寸封裝(Wafer Level Chip Scale Package,以下簡稱 WLCSP)及裸晶切割封裝(Die Processing Service,以下簡稱 DPS)生產線。
民國 106 年	● 增建竹南廠 3 樓廠房約 555 坪。
民國 107 年	● 成立晶圓薄化(含金屬鍍膜)業務。 ● 通過 ISO/TS 16949 至 IATF 16949 的轉換認證。
民國 108 年	● 竹南廠經海關核准登記為保稅工廠。
民國 109 年	● 庫藏股減資 7,480 仟元，減少後資本額為 610,000 仟元整。 ● 通過 OHSAS 18001 至 ISO 45001 的轉換認證。 ● COB 切割生產線從竹東廠搬遷至竹南廠。
民國 111 年	● 增建竹南廠 4 樓廠房。 ● 經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准公開發行。 ● 現金增資 36,600 仟元，增資後實收資本額為 646,600 仟元。
民國 112 年	● 成立晶圓正面金屬鍍膜業務。

註 1：本公司資本額達強制股票公開發行之法令規定。

註 2：民國 91 年公司法取消強制公開發行資本額之規定，本公司民國 93 年董事會決議撤銷股票公開發行。

二、風險事項

(一)風險因素

1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1)利率變動

① 對損益之影響

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	110 年度		111 年度		112 年前三季	
	金額	佔營收淨額比率	金額	佔營收淨額比率	金額	佔營收淨額比率
利息收入	109	0.00	738	0.06	965	0.16
利息費用	9,195	0.71	9,608	0.78	6,143	0.99

資料來源：各期經會計師查核簽證之財務報告。

本公司 110 年度、111 年度及 112 年前三季之利息收入分別為 109 仟元、738 仟元及 965 仟元，佔年度營業收入淨額比率分別為 0.00%、0.06%及 0.16%；利息費用分別為 9,195 仟元、9,608 仟元及 6,143 仟元，佔年度營業收入淨額比率分別為 0.71%、0.78%及 0.99%，故利率變動對本公司之影響尚屬有限。

② 未來因應措施

隨著金融利率之變動，本公司適時調整資金運用，因應利率變動可能產生之財務風險，未來資金規劃仍以穩健原則，資金配置上安全控管，考量公司未來營運規模及獲利能力提升，除持續與金融機構保持良好往來關係，並適時爭取最適利率以降低利息支出，以因應利率變動產生之財務風險。

(2)匯率變動

① 對損益之影響

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	110 年度		111 年度		112 年前三季	
	金額	佔營收淨額比率	金額	佔營收淨額比率	金額	佔營收淨額比率
兌換淨(損)益	3,921	0.30	14,902	1.21	8,660	1.40

資料來源：各期經會計師查核簽證之財務報告。

本公司 110 年度、111 年度及 112 年前三季之兌換淨(損)益分別為 3,921 仟元、14,902 仟元及 8,660 仟元，佔年度營業收入淨額比率分別為 0.30%、1.21%及 1.40%。產生兌換淨(損)益主要係因美金匯率波動所致，兌換淨(損)益佔營收淨額比率尚不重大，110 年度、111 年度及 112 年前三季匯率變動對本公司影響尚屬有限。

② 未來因應措施

本公司持續關注國際匯市主要貨幣之走勢及經濟環境變動情形，亦於往來銀行開立外幣存款帳戶來進行外匯部位管理，密切掌握各項匯率變化與走勢，適時調整外匯資產持有部位，以降低匯率變動對損益之影響。

(3)通貨膨脹

本公司最近年度及截至公開發行說明書刊印日止之損益並未因通貨膨脹而產生重大影響，未來本公司亦隨時注意市場價格波動，若因通貨膨脹導致進銷貨受到影響，將適時調整進銷貨價格為因應，故通貨膨脹對本公司之損益並無重大之影響。

2. 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司長久以來均持續專注於經營本業，財務及資金政策亦維持一貫之保守穩健原則。並已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書保證作業程序」，作為本公司之遵循依據。

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易。

3. 未來研發計劃及預計投入之研發費用：

(1) 未來研發計畫

本公司因應市場趨勢及配合客戶產品開發，持續研發與改良製程、探針卡及治具等以提高生產良率及提供更多服務項目，未來研發計畫包含研究開發及改良高功率氮化鎵(GaN)功率元件測試技術、高功率碳化矽(SiC)功率元件測試技術、晶圓正面金屬鍍膜技術、晶圓背面研磨及金屬鍍膜技術等。本公司透過研發經費及專業技術人才的投入，持續創新及改良製程，擴大整體效益，進而提升本公司競爭優勢。

(2) 預計投入研發費用

本公司110年度、111年度及112年前三季研發費用分別為64,391仟元、69,578仟元及48,660仟元，佔營業收入淨額比率分別為4.98%、5.67%及7.84%，本公司研發經費係依新技術開發進度逐項編列，且持續投入研發資源，以符合市場之需求，以確保公司之競爭優勢。

4. 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，尚無因國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之情事，且本公司營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，不定期指派相關人員參加外訓相關課程，必要時諮詢相關專業人士或機構，以充份掌握並因應市場環境變化。故國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務不致產生重大影響。

5. 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，尚無因科技改變（包括資通安全風險）及產業變化而有影響財務業務之情事，且本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展演變，亦迅速掌握產業動態並適時調整技術開發策略及提升網路與電腦相關資安防護措施，積極擴展未來之市場應用領域，以因應科技改變及產業變化對公司之影響，並將持續更新並提升網路與電腦相關資安防護措施與設備，確保公司財務業務之安全。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，尚無因企業形象改變而有影響公司危機管理之情事，且本公司自設立以來專注於本業經營，遵守相關法令規定，致力維護公司形象，並未有因企業形象改變而造成公司營運危機之情事。本公司將持續維持優良企業形象，不斷提升產品技術品質滿足客戶需求，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，以降低企業風險之發生及對公司之影響。

7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無進行併購之計畫。惟將來若有併購計畫時，將依本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定，秉持審慎評估之態度，以確實保障公司利益及股東權益。

8. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司因應未來營運所需，於110年12月董事會通過擴充竹南廠房及產線，雖新建廠房需投入大筆資金，進而增加營運成本，但新建廠房及產線有助於穩定未來生產及經營面，預期於113年度擴廠完成後，將擴大營運規模及提升產業競爭力，並強化接單能力，對提升公司營運動能及營收均有助益，達成永續經營及不斷茁壯之目標，因此擴廠對本公司財務業務而言，其投資風險尚屬有限。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1) 進貨方面：

本公司為專業半導體測試封裝廠商，藉由機台提供客製化半導體測試封裝服務，本身並未備料生產，主要為測試封裝或晶圓薄化所需之物料，除持續與既有供應商建立良好關係外，並積極尋求及開發優良供應商，本公司採購對象中，並無對單一供應商有大量採購之情事，其比重尚屬分散，故尚無進貨集中之風險。

(2) 銷貨方面：

本公司營收主要為半導體測試封裝服務收入，本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止並無銷售單一客戶達30%以上之情事，故尚無銷售集中之風險。

10. 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，並無因股權之大量移轉或更換情事對本公司營運造成重大影響。

11. 經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無經營權改變之情事。

12. 其他重要風險及因應措施：無。

(二)訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

林〇〇前員工，原任職於製程工程部，任職期間有加班事實，但未依本公司規定填報申請加班，109年8月離職後於110年3月8日提出勞資爭議強制執行訴訟，請求本公司給付加班費137,872元，惟該員尚積欠本公司164,108元，本公司於民國110年5月3日提請訴訟，申請兩造雙方債務互為抵銷，經抵銷後該員需返還本公司26,236元，經公司考量後不向該員請求返還。今以臺灣新竹地方法院110年7月12日判決確定撤銷強制執行後結案，本案對本公司股東權益或證券價格並無重大影響。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(四)發行公司於最近一個會計年度或申請上市會計年度內，其子公司符合會計師查核簽 證財務報表規則第二條之一第二項及會計師受託查核簽證金融機構財務報表相關規定第五條規定之重要子公司標準之一者，應增列該子公司之風險事項說明

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止並無符合標準之重要子公司，故不適用。

(五)外國發行公司應增列敘明外國發行公司註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施：不適用。

(六)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明擁有之關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式，及因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施

1. 關鍵核心技術及創新經營模式

(1)關鍵核心技術：

(一)自主研發測試技術佈局之能力

本公司在民國 90 年即切入電源管理 IC 測試領域，並於民國 95 年進一步切入 MOSFET 測試領域，一路發展至今已建立深厚之技術能力，相關之測試電路、測試程式、測試介面、探針卡等皆自行研發製作，具備軟硬體技術佈局之能力。

(二)精準分析測試產品材料特性

由於第三代半導體之材料特性，導致第三代半導體晶圓在長晶、磊晶與元件製造之過程中更容易出現製程缺陷，因此，如何透過優異之測試技術，正確篩選出功能正常產品至關重要，以確保產品在終端應用時不會出現問題，也因此凸顯了第三代半導體晶圓測試之重要性。由於第三代半導體材料特性不易掌握，且高溫、高壓、高流、低電阻與低漏電等測試條件都極具挑戰，因此需要大量累積工程與量產經驗並與客戶不斷地合作驗證，才能精準測試分析產品特性，該公司具備第三代半導體材料特性分析與高壓波型分析能力，可有效提高客戶異常分析處理之時效，並提供客戶更有價值之建議。另外，第三代半導體因產品驗證時間長，測試技術門檻高，藉由與晶圓廠之協同開發，亦使該公司之研發團隊及測試部門能即時反饋客戶在晶圓測試發現之問題，並協助客戶提升製程良率。

(三)自行開發超薄晶圓載板薄化製程技術，切入半導體晶圓製程

第三代半導體材料具有高硬度、高脆性與易斷裂之特性，造成第三代半導體晶圓薄化與晶圓切割製程之高度挑戰，該公司投入晶圓研磨與晶圓切割領域迄今已有超過 36 年生產經驗，在此期間持續投入研發能量，精進製程技術，並於民國 107 年成功跨入第三代半導體晶圓薄化領域，經由自行開發之載板製程技術，大幅降低生產成本，並可提升晶圓有效使用面積，降低客戶成本，提供客戶製程所需之服務。

(2)創新營運模式：

由於第一代半導體的製程發展已相當成熟，晶圓製造良率也很高，晶圓廠較不需要持續不斷的進行製程優化，通常在廠內的實驗室就可以滿足少量工程品的測試需求，不會有大量的工程試做晶圓需要委外給測試廠做測試分析，因此晶圓廠與測試廠間主要是透過設計公司為溝通橋梁。

本公司深耕於功率半導體測試業務，具備精準分析測試產品材料特性及自

主研發測試技術佈局之能力，亦可針對產品元件特性資料進行大數據分析。因第三代半導體材料特性的原因，導致晶圓在長晶、磊晶與元件製造的過程中容易出現製程缺陷，於晶圓製造良率上，難以達到第一代半導體的水準，因此，晶圓廠需要持續不斷進行製程的優化，晶圓廠雖有內部的實驗室可以小量的收集資料，但是實驗室提供的實驗設備與人力，無法滿足試做晶圓所需之大量工程驗證之需求，且實驗室收集資料的速度緩慢，大幅影響製程優化循環週期的速度，進而影響新製程與新產品開發的速度，因而促成晶圓廠偕同測試廠共同合作，找出問題點與提供製程參數調整的方向，以提高晶圓廠製造良率。

本公司以其提供量產工廠的生產能量與速度，進行精準的測試分析，將資料反饋給晶圓廠做進一步的分析，作為晶圓製程參數調整的依據，扮演著類似晶圓廠內部實驗室的角色，由此晶圓廠可以省去購買測試設備、建置測試人力、研發測試技術所需要花費的成本與時間，專注於第三代半導體晶圓製程技術的精進，而本公司專注於第三代半導體晶圓測試技術的精進，透過雙方的密切合作成為合作夥伴，達到一加一大於二的效果。

本公司經由與晶圓廠合作之契機，打造出創新之經營模式，在此經營模式下，本公司與晶圓廠長期合作，已建立緊密的合作默契及共同的驗證標準，晶圓廠傾向於優先推薦本公司予設計公司，做為晶圓測試的合作夥伴，可有效的進行產品開發、驗證、量產，幫助設計公司快速開發驗證產品，即時打開市場，創造三贏的局面。

一般經營模式：

「晶圓廠內部實驗室」營運模式：

2.因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施

(1)半導體市場景氣波動，增加測試封裝廠之經營風險

在 IC 產業生產體系中，IC 測試封裝位於製程的後段，為 IC 出貨前必經步驟，故受半導體市場景氣波動影響甚巨，若供需情況稍有失衡，即導致晶片價格大幅波動，影響半導體測試封裝業之獲利。

因應對策:

本公司積極調配機台及縮短執行時間，並提供晶圓製造廠商及 IC 設計公司迅速且準確之服務，以吸引客戶持續下單，於產能擴產方面，係採穩健投資之方式，避免因機器設備產能不足而失去市場機會，或因設備擴充過速而造成閒置，增加經營風險。

(2)技術人才流失之風險

測試封裝為技術密集產業，隨著半導體產業不斷的發展，國內外半導體公司對人才之需求增加，故具經驗之技術人員常成為競爭對手招攬之對象，形成人才流失之風險。

因應對策:

本公司透過資深技術人員之技術傳承、實作傳承分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的技術團隊。此外，提供良好的工作環境，並建立制度化的員工福利獎酬辦法，以增進員工之向心力。對於技術人員均要求簽訂保密合約，且對相關技術做適當之資料保存，以預防人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。

(3) IC產業前景看好，將有更多競爭者加入

本公司所屬產業為半導體上下游關注的焦點，前段及後段的半導體廠商皆想跨入相關製程。

因應對策:

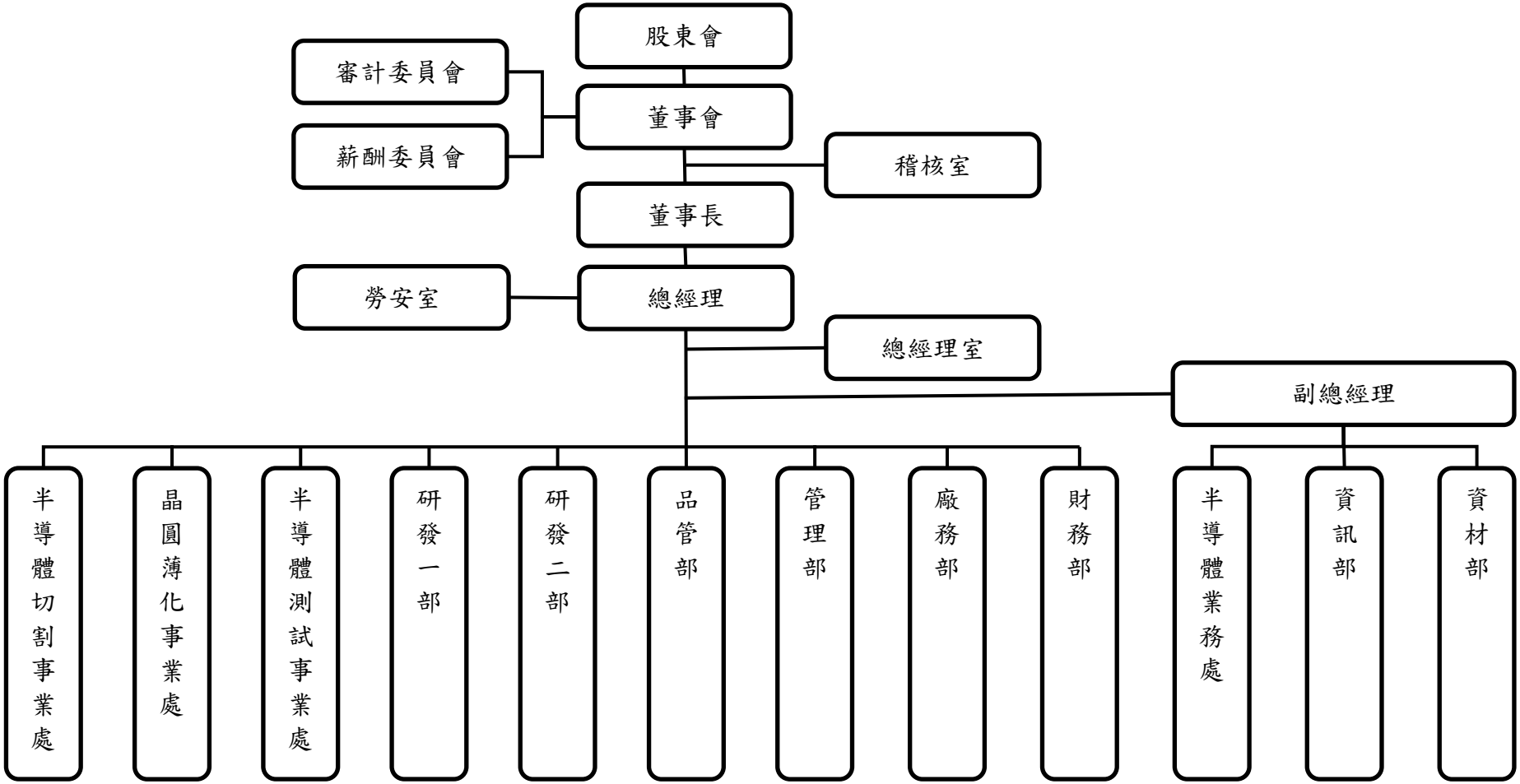
本公司之客戶多為知名半導體廠商，透過與客戶開發，建立合作默契，並可掌握終端需求調整製程技術。本公司已累積多年經驗，並提供 Total Turnkey Solution，未來將不斷提升技術，拉開與同業之市場區隔，以確保公司之競爭力。

(七)其他重要事項：無。

三、公司組織

(一)組織系統

1. 組織結構



2. 各主要部門所營業務

部門別	業　務　職　掌
總經理室	•公司營運目標及策略之擬訂 •掌理公司經營計劃 •訂定年度經營方針 •公司品質政策督導
稽核室	•負責公司內部控制制度之規劃及執行工作
半導體切割事業處	•負責半導體封裝服務、生產工程與生產效率之管理
晶圓薄化事業處	•負責晶圓薄化服務、生產工程與生產效率之管理
半導體測試事業處	•負責半導體測試服務、生產工程與生產效率之管理
研發一部 （測試）	•客戶新產品開發及評估作業 •產品測試良率/穩定性分析改善計畫之擬定與執行 •協助生產線技術提昇及測試能力改善之需求
研發二部 （封裝及晶圓薄化）	•新產品技術及導入之效益評估 •新製程研發 •製程改善
品管部	•品質活動、品質管理系統及環境管理系統之推動與查核 •進料檢驗、製程管制及產品檢驗之擬定推行分析與查核 •客戶服務與品質質量保證
管理部	•人力資源發展與管理及員工服務 •教育訓練計劃擬定、執行及成效追蹤 •採購事項管理 •總務事項管理
廠務部	•工廠之廠房設計、規劃 •廠務工程施工以及系統之運轉、維護 •生產所需之水、電與物料管線管理與維護
財務部	•會計及稅務管理 •資金管理及投資規劃 •財務風險管理 •投資人、股東與股務等之作業管理
半導體業務處	•產品銷售之規劃、拓展、銷售與承接 •市場與客戶開發
資訊部	•網路資安機制之規劃 •應用系統規劃建置與維護 •生產軟體自動化及系統連線作業 •資訊環境之建置與維護
資材部	•資材管理、進出口及保稅業務管理
勞安室	•公司工安、環安相關業務作業

(二)關係企業圖

1. 關係企業圖：無。
2. 關係企業間關係、相互持股比例、股份及實際投資金額：無。

(三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管

112 年 10 月 27 日；單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
董事長兼任總經理	張秉堂	男	中華民國	76.08.19	5,462,182	8.45	1,415,758	2.19	1,988,495	3.08	臺灣大學國際企業管理組碩士 工研院電子所封測課長 巨大電子(股)公司董事長 新能科技(股)公司董事長	大日月投資有限公司董事長 辰謙投資有限公司代表人	特別助理	張辰	父子	—	註
副總經理	王志成	男	中華民國	93.03.01	370,000	0.57	—	—	—	—	臺灣大學國際企業管理組碩士 臺灣海洋大學電機工程研究所碩士 新能科技(股)公司副總經理	—	—	—	—		—
特別助理	張　辰	男	中華民國	105.01.07	880,148	1.36	—	—	—	—	美國波士頓大學國際貿易研究所碩士 清華大學工程科學系學士	辰真投資有限公司代表人	總經理	張秉堂	父子		—
廠務部協理	曾雄亮	男	中華民國	76.08.19	3,079,582	4.76	218,935	0.34	—	—	健行科技大學電子通訊科副學士 台灣星電(股)公司技術員 工研院電子所高級技術員	—	—	—	—		—
半導體測試事業處協理	林坤田	男	中華民國	90.02.01	410,000	0.63	—	—	—	—	勤益科技大學電子科學士 信業科技(股)公司業務工程師 原僑電子(股)公司助理工程師	—	—	—	—		—

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
財務部經理	呂月雲	女	中華民國	81.12.01	40,000	0.06	—	—	—	—	中原大學會計系學士 東展興業(股)公司會計	—	—	—	—	—	—
管理部經理兼任公司治理主管	官淑惠	女	中華民國	81.06.11	5,808	0.01	—	—	—	—	南台科技大學工業工程科學士	—	—	—	—		—
稽核	黃詩萍	女	中華民國	110.01.05	1,000	0.00	—	—	—	—	聯合大學管理學碩士 前鼎光電(股)公司稽核主管 隆達電子(股)公司稽核	—	—	—	—		—

註：本公司董事長兼任總經理，主係為提升公司經營效率與決策執行力，並考量其具有產業專業知識及營運判斷之經驗，能落實經營監督與管理、提高決策能力及強化公司營運，對公司有明顯之助益。本公司為強化公司治理，已於112年06月29日股東常會進行董事改選，強化董事會之監督功能，並由四位獨立董事定期召開審計委員會及薪資報酬委員會，以有效發揮其監督職權。且本公司董事會成員大多未兼任員工或經理人，尚足以落實公司治理目標。

(四)董事及監察人

1. 董事之姓名、經（學）歷、持有股份及性質

113 年 1 月 31 日；單位：股；%

職稱	姓名	性別；年齡	國籍或註冊地	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	大日月投資有限公司	—	中華民國	88.5.31	111.8.2	3年	14,798,896	24.26	14,798,896	22.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	代表人：張秉堂	男 61~70	中華民國	76.7.25		3年	5,392,182	8.84	5,462,182	8.45	1,415,758	2.19	1,988,495	3.08	臺灣大學國際企業管理組碩士 工研院電子所封測課長 巨大電子(股)公司董事長 新能科技(股)公司董事長	本公司總經理 大日月投資有限公司董事長 辰謙投資有限公司代表人	董事代表人	張辰	父子	註1
董事	辰真投資有限公司	—	中華民國	111.8.2	111.8.2	3年	1,225,000	2.01	1,225,000	1.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	代表人：張辰	男 31~40	中華民國	107.6.27		3年	880,148	1.44	880,148	1.36	—	—	—	—	美國波士頓大學國際貿易研究所碩士 清華大學工程科學系學士	本公司研發主管 辰真投資有限公司負責人	董事長	張秉堂	父子	
董事	曾雄亮(註2)	男 61~70	中華民國	76.7.25	111.8.2	3年	3,079,582	5.05	3,079,582	4.76	218,935	0.34	—	—	健行科技大學電子通訊科副學士 台灣星電(股)公司技術員 工研院電子所高級技術員	本公司協理	—	—	—	—
董事	彭盈光	男 61~70	中華民國	88.5.31	111.8.2	3年	1,185,090	1.94	1,185,090	1.83	1,493,323	2.31	—	—	中原大學工業與工程學系學士 工研院電子所品質管理課長 台灣積體電路(股)公司品質管理副處長 微矽電子(股)公司副總經理	謙誠商務股份有限公司負責人 新竹高爾夫俱樂部(股)公司董事	—	—	—	—
董事	張蔚誠	男 61~70	中華民國	111.8.2	111.8.2	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	政治大學會計系學士 大師聯合會計師事務所 合夥會計師	大師聯合會計師事務所合夥會計師 聯華食品工業(股)公司獨立董事	—	—	—	—
董事	楊式蘭(註 3)	女 61~70	中華民國	112.6.29	112.6.29	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	中興大學企業管理系學士 中興大學企研所碩士 台灣大學財務金融研究所 大昌證券股份有限公司副總經理	大昌證券股份有限公司副總經理	—	—	—	—
獨立董事	張居興	男 61~70	中華民國	111.8.2	111.8.2	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	臺灣大學財務金融研究所碩士 中國信託商業銀行副總經理 中信票券金融公司副總經理	—	—	—	—	—
獨立董事	溫萬壽	男 61~70	中華民國	111.8.2	111.8.2	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	交通大學電子物理系學士 豐達科技(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司執行副總經理 瀚宇彩晶(股)公司執行長	豐達科技(股)公司獨立董事	—	—	—	—

職稱	姓名	性別；年齡	國籍或註冊地	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	彭俊豪	男 41~50	中華民國	111.8.2	111.8.2	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	成功大學企業研究所碩士 元大創業投資(股)公司 總經理	元大創業投資(股)公司總經理 元大壹創業投資(股)公司法人董事代表人 生華創業投資(股)公司法人董事代表人 生源創業投資(股)公司法人董事代表人 華陸創業投資(股)公司法人董事代表人	—	—	—	—
獨立董事	譚仲民 (註 3)	男 51~60	中華民國	112.6.29	112.6.29	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	國立臺灣大學商學研究所碩士 世成科技(股)公司董事 智仁科技開發(股)公司監察人 力晶科技(股)公司特別助理 力晶科技(股)公司副總經理 力晶積成電子製造(股)公司副總經理	力晶積成電子製造股份有限公司副總經理 世成科技(股)公司董事 智仁科技開發(股)公司監察人 檀雅投資有限公司董事	—	—	—	—

註1：本公司董事長兼任總經理，主係為提升公司經營效率與決策執行力，並考量其具有產業專業知識及營運判斷之經驗，能落實經營監督與管理、提高決策能力及強化公司營運，對公司有明顯之助益。本公司為強化公司治理，已於112年06月29日股東常會進行董事改選，強化董事會之監督功能，並由四位獨立董事定期召開審計委員會及薪資報酬委員會，以有效發揮其監督職權。且本公司董事會成員大多未兼任員工或經理人，尚足以落實公司治理目標。

註2：112年4月6日辭任。

註3：112年6月29日選任，任期與現任董事相同，至民國114年8月1日。

2. 法人股東之主要股東：

112年10月27日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持股比例占前十名)	持股比例
大日月投資有限公司	辰謙投資有限公司	66.66%
	張秉堂	32.00%
	張辰	0.67%
	張可人	0.67%
辰真投資有限公司	張辰	100.00%

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

112年10月27日

法人名稱	法人之主要股東(持股比例占前十名)	持股比例
辰謙投資有限公司	張辰	40.00%
	張秉堂	20.00%
	張少謙	20.00%
	洪意淳	20.00%

4. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
大日月投資有限公司代表人：張秉堂	1.現任微矽電子(股)公司董事長兼總經理，曾任巨大電子(股)公司、新能科技(股)公司董事長及工研院電子所封測課長，具有企業經營能力及半導體產業30年以上經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.張秉堂先生兼任本公司總經理。 2.張秉堂先生以大日月投資有限公司指定代表人當選董事。 3.張秉堂先生及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 4.大日月投資有限公司持有本公司已發行股份百分之五以上之法人股東，為第一大股東。 5.為本公司法人董事代表人之二親等以內親屬。 6.其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相 關獨立性要求。	—

條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
辰真投資有限公司 代表人： 張辰	1.波士頓大學國際貿易研究所畢業，現任微矽電子(股)公司研發主管，具有半導體技術應用、實務經驗及財務管理能力。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.張辰先生兼本公司特別助理。 2.張辰先生以辰真投資有限公司指定代表人當選董事。 3.張辰先生及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上。 4.為本公司法人董事代表人之二親等以內親屬。 5.其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相 關獨立性要求。	—
彭盈光	1.曾任工研院電子所品質管理課長、台灣積體電路(股)公司品質管理副處長及微矽電子(股)副總經理，具有企業經營能力、30年以上深厚產業技術及實務經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.彭盈光先生及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 2.其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。	—
張蔚誠	1.現任大師聯合會計師事務所合夥會計師，會計師專業資格及多年財會工作經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 2.其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。	1
楊式蘭	1.現任大昌證券股份有限公司副總經理，具有多年財務工作經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。	符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。	—
張居興	1.曾任中國信託商業銀行副總經理及中信票券金融公司副總經理，具有多年財務工作經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。	左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	—

條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
温萬壽	1.現任豐達科技股份有限公司獨立董事，曾任華邦電子股份有限公司執行副總經理及瀚宇彩晶股份有限公司執行長，具有多年科技產業工作經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。		1
彭俊豪	1.現任元大創業投資(股)公司 總經理，具有多年財務工作經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。		—
譚仲民	1.現任力晶積成電子製造股份有限公司副總經理，具有多年財務工作經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。		—

董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：綜觀本公司第十四屆董事會由九席董事（含四席獨立董事）組成，整體而言已具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、國際市場觀、領導及決策能力，具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域且有互補能力。本公司董事具有多元化面向、互補及落實情形，並已符合本公司之「公司治理實務守則」第 20 條載明之標準，未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須知識、技能及素養。

多元化核心 董事姓名	基本條件與價值									產業經驗及能力						專業能力	
	國籍	性別	具有員工身分	年齡				獨立董事年資		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	國際市場觀	領導及決策能力	半導體相關	財務法律專長
				31-40歲	41-50歲	51-60歲	60歲以上	3年以下	超過3年								
大日月投資有限公司代表人：張秉堂	中華民國	男	V				V	—	—	V	—	V	V	V	V	V	—
辰真投資有限公司代表人：張辰	中華民國	男	V	V				—	—	V	V	V	V	V	V	V	V
彭盈光	中華民國	男					V	—	—	V	—	V	—	V	V	V	—
張蔚誠	中華民國	男					V		V	V	V	V	V	V	V	—	V
楊式蘭	中華民國	女					V	—	—	V	V	V	V	V	V	—	V
張居興	中華民國	男					V	—	—	V	V	V	V	V	V	—	V
温萬壽	中華民國	男					V		V	V	—	V	V	V	V	V	—
彭俊豪	中華民國	男			V			—	—	V	V	V	V	V	V	—	V
譚仲民	中華民國	男				V		—	—	V	V	V	V	V	V	V	V

(2)董事會獨立性：本公司現任董事成員共九位董事，包含四位獨立董事，其中僅張秉堂董事及張辰董事為父子關係；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均未持有公司股份、亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近二年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬，且董事間未有證券交易法第 26 條之 3 第三項及第四項規定之情事。

(五)發起人：不適用。

(六)最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

111 年度；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
																本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長兼總經理	大日月投資有限公司代表人：張秉堂	397	397	—	—	4,671	4,671	160	160	5,228；3.10%	5,228；3.10%	17,872	17,872	394	394	1,320	—	1,320	—	24,814；14.74%	24,814；14.74%	—
董事	大日月投資有限公司代表人：王志成(註1)																					
董事	大日月投資有限公司代表人：林坤田(註1)																					
董事	辰謙投資有限公司代表人：張辰(註2)																					
董事	辰真投資有限公司代表人：張辰																					
董事	曾雄亮(註3)																					
董事	彭盈光																					
董事	張蔚誠																					
獨立董事	張居興																					
獨立董事	温萬壽																					
獨立董事	彭俊豪																					

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：不適用。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：大日月投資股份有限公司代表人王志成及代表人林坤田於 111 年 8 月 2 日股東臨時會董事改選後解任。

註 2：辰謙投資股份有限公司於 111 年 8 月 2 日股東臨時會董事改選後解任。

註 3：112 年 4 月 6 日辭任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董　事　姓　名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本　公　司	財務報告內所有公司	本　公　司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	大日月投資有限公司代表人：王志成、大日月投資有限公司代表人：林坤田、辰謙投資有限公司代表人：張辰、辰真投資有限公司代表人：張辰、曾雄亮、彭盈光、張蔚誠、張居興、温萬壽、彭俊豪	大日月投資有限公司代表人：王志成、大日月投資有限公司代表人：林坤田、辰謙投資有限公司代表人：張辰、辰真投資有限公司代表人：張辰、曾雄亮、彭盈光、張蔚誠、張居興、温萬壽、彭俊豪	彭盈光、張蔚誠、張居興、温萬壽、彭俊豪	彭盈光、張蔚誠、張居興、温萬壽、彭俊豪
1,000,000元(含)～2,000,000元(不含)	大日月投資有限公司代表人：張秉堂	大日月投資有限公司代表人：張秉堂	辰謙投資有限公司代表人：張辰、辰真投資有限公司代表人：張辰	辰謙投資有限公司代表人：張辰、辰真投資有限公司代表人：張辰
2,000,000元(含)～3,500,000元(不含)	—	—	大日月投資有限公司代表人：王志成	大日月投資有限公司代表人：王志成
3,500,000元(含)～5,000,000元(不含)	—	—	曾雄亮、大日月投資有限公司代表人：林坤田	曾雄亮、大日月投資有限公司代表人：林坤田
5,000,000元(含)～10,000,000元(不含)	—	—	大日月投資有限公司代表人：張秉堂	大日月投資有限公司代表人：張秉堂
10,000,000元(含)～15,000,000元(不含)	—	—	—	—
15,000,000元(含)～30,000,000元(不含)	—	—	—	—
30,000,000元(含)～50,000,000元(不含)	—	—	—	—
50,000,000元(含)～100,000,000元(不含)	—	—	—	—
100,000,000元以上	—	—	—	—
總　　計	11人	11 人	11 人	11 人

2　監察人之酬金

111年度；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		酬勞(B) (註 1)		業務執行費用(C)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
監察人	陳俊孝	—	—	216	216	—	—	216；0.13%	216；0.13%	—
監察人	張可人									

註：監察人張可人係於 111 年 04 月 22 日增選就任監察人，已於 111 年 8 月 2 日組成審計委員會代替監察人職務。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	前三項酬金總額(A+B+C)
	本　公　司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	陳俊孝、張可人	陳俊孝、張可人
1,000,000 元(含)～2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)～3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含)～5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)～10,000,000 元(不含)	—	—
10,000,000 元(含)～15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)～30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)～50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總　　計	2 人	2 人

3 總經理及副總經理之酬金

111年度；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 (%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	張秉堂	7,675	7,675	111	111	2,271	2,271	640	-	640	-	10,697；6.35%	10,697；6.35%	無
副總經理	王志成													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)～2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)～3,500,000 元(不含)	王志成 副總經理	王志成 副總經理
3,500,000 元(含)～5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)～10,000,000 元(不含)	張秉堂 總經理	張秉堂 總經理
10,000,000 元(含)～15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)～30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)～50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	2 人	2 人

4. 最近年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

111 年度；單位：新臺幣仟元

	職　　稱	姓　名	股票金額	現金金額	總　　計	總額占稅後純益之比例 (%)
經理人	董事長兼總經理	張秉堂	—	1,560	1,560	0.93%
	副總經理	王志成				
	特別助理	張　辰				
	協理	曾雄亮				
	協理	林坤田				
	經理	官淑惠				
	經理	呂月雲				

註：本表之員工酬勞係經112年03月15日董事會決議通過，經112年6月29日股東常會決議後給付。

5. 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(1) 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例：

單位：%

職稱	110年度酬金總額占稅後純益比例		111年度酬金總額占稅後純益比例	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	10.38%	10.38%	14.74%	14.74%
監察人	0.35%	0.35%	0.13%	0.13%
總經理及副總經理	3.16%	3.76%	6.35%	6.35%

(2) 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司給付董事及監察人酬金係依照公司章程之規定提撥，參考同業水準並依其績效作分配，經提交董事會核准後，經股東會同意後發放。支付總經理及副總經理之酬金依其所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之。除上述外，本公司將未來營運風險之可能性降至最低，隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀求公司永續經營與風險控管之平衡。

(七)發行人之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經(學)歷、持有股份、目前兼任發行公司及其他公司之職務、與發行公司董事之關係及對發行公司實質控制情形，另外國發行公司尚應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任：無此情形

(八)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明核心技術人員之資歷簡歷

單位：年

部門	職稱	姓名	最高學歷	主要經歷	本業年資	服務年資
研發一部主管	協理	林坤田	勤益工專電子科	信業科技(股)公司 原僑電子(股)公司	23.46	22.56
研發二部主管	特別助理	張辰	波士頓大學國際貿易	—	7.63	7.63

四、資本及股份

(一)股份種類

113年1月31日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	64,660,000	35,340,000	100,000,000	非上市(櫃)股票

(二)股本形成經過

1. 公司最近五年度及截至公開說明書刊印日止股本變動之情形

單位：仟股；新臺幣仟元

年月	發行價格（元）	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
109.02	10	80,000	800,000	61,000	610,000	庫藏股減資 7,480 仟元	無	註 1
111.05	10	100,000	1,000,000	61,000	610,000	公司章程修改額訂股本	無	註 2
111.09	45	100,000	1,000,000	64,660	646,600	現金增資 36,600 仟元	無	註 3

註1：業經中華民國109年02月04日 經授商字第10901005620號核准在案。

註2：業經中華民國111年05月30日 經授商字第11101077110號核准在案。

註3：業經中華民國111年09月05日 經授商字第11101167610號核准在案。

2. 最近年度及截至公開說明書刊印日止私募普通股之辦理情形：無。

3. 公司採總括申報方式發行新股者，應揭露預定發行總額、已發行總額及總括申報餘額等相關資訊：不適用。

(三)最近股權分散情形

1. 股東結構

112年10月27日；單位：人；股；%

股東結構 / 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計
人　　數	—	7	15	905	1	928
持 有 股 數	—	1,518,656	21,521,391	41,562,745	57,208	64,660,000
持股比例(%)	—	2.35	33.28	64.28	0.09	100.00

2. 股權分散情形

112 年 10 月 27 日；單位：人；股；%

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例(%)
1 至 999	125	40,354	0.06
1,000 至 5,000	440	984,128	1.52
5,001 至 10,000	108	855,813	1.32
10,001 至 15,000	57	692,324	1.07
15,001 至 20,000	27	491,919	0.76
20,001 至 30,000	34	838,810	1.30
30,001 至 40,000	21	734,297	1.14
40,001 至 50,000	12	572,214	0.88
50,001 至 100,000	42	2,860,286	4.42
100,001 至 200,000	23	3,140,405	4.86
200,001 至 400,000	11	2,968,860	4.59
400,001 至 600,000	6	2,920,499	4.52
600,001 至 800,000	3	1,995,810	3.09
800,001 至 1,000,000	7	6,324,448	9.78
1,000,001 以上	12	39,239,833	60.69
合計	928	64,660,000	100.00

3. 主要股東名單(股權比例達百分之五以上或占前十名之股東)

112年10月27日；單位：股；%

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
大日月投資有限公司	14,798,896	22.89%
張秉堂	5,462,182	8.45%
鄭羅玉嬌	3,380,449	5.23%
曾雄亮	3,079,582	4.76%
邵世祥	2,715,283	4.20%
邵涵琳	1,993,188	3.08%
葉秀窒	1,493,323	2.31%
張可兒	1,310,000	2.03%
兆豐證券股份有限公司	1,308,345	2.02%
辰謙投資有限公司	1,288,495	1.99%

4. 最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增

資認股之情形：

(1)董事、監察人及大股東放棄現金增資認股情形：

職　稱	姓　　名	110 年度		111 年度		113 年截至 1 月 31 日止	
		可認股數	實認股數	可認股數	實認股數	可認股數	實認股數
董事長	大日月投資有限公司	—	—	799,140	—	—	—
	代表人：張秉堂	—	—	291,178	—	—	—
董事	大日月投資有限公司(註 2)	—	—	799,140	—	—	—
	代表人：王志成	—	—	不適用	不適用	—	—
	代表人：林坤田	—	—	不適用	不適用	—	—
董事	辰謙投資有限公司(註 3)	—	—	不適用	不適用	—	—
	代表人：張辰	—	—	47,528	—	—	—
董事	辰真投資有限公司	—	—	66,150	—	—	—
	代表人：張辰	—	—	47,528	—	—	—
董事	曾雄亮(註 7)	—	—	166,297	—	—	—
董事	彭盈光	—	—	63,995	—	—	—
董事	張蔚誠(註 4)	—	—	—	—	—	—
董事	楊式蘭(註 8)	—	—	—	—	—	—
獨立董事	張居興(註 5)	—	—	—	—	—	—
獨立董事	温萬壽(註 5)	—	—	—	—	—	—
獨立董事	彭俊豪(註 5)	—	—	—	—	—	—
獨立董事	譚仲民(註 9)	—	—	—	—	—	—
監察人	陳俊孝(註 6)	—	—	不適用	不適用	—	—
監察人	張可人(註 6)	—	—	不適用	不適用	—	—
持股超過 10%股東	大日月投資有限公司	—	—	799,140	—	—	—

註 1：110 年度及 112 年度未辦理現金增資。
註 2：大日月投資股份有限公司代表人王志成及代表人林坤田於 111 年 8 月 2 日股東臨時會董事改選後解任。
註 3：辰謙投資股份有限公司於 111 年 8 月 2 日股東臨時會董事改選後解任。
註 4：張蔚誠經 111 年 8 月 2 日股東臨時會選任本公司一般董事。
註 5：張居興、温萬壽及彭俊豪經 111 年 8 月 2 日股東臨時會選任本公司獨立董事。
註 6：監察人陳俊孝及張可人經 111 年 8 月 2 日股東臨時會董事改選後，以獨立董事取代監察人。
註 7：曾雄亮於 112 年 4 月 6 日辭任。
註 8：楊式蘭經 112 年 6 月 29 日股東會選任本公司一般董事。
註 9：譚仲民經 112 年 6 月 29 日股東會選任本公司獨立董事。

(2)董事、監察人及大股東放棄現金增資洽關係人認購情形：無此情形。

5. 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人、經理人、現任技術股股東及技術、研究發展人員與百分之五以上股東股權移轉及股權質押變動情形

(1) 董事、監察人、經理人現任技術股股東及技術、研究發展人員與百分之五以上股東股權移轉及股權質押變動情形

單位：股

職稱	姓名	110年度		111年度		112年度截至刊印日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
法人董事及大股東	大日月投資有限公司	—	—	—	—	—	—
董事長兼總經理	大日月投資有限公司代表人：張秉堂	(250,000)	—	(220,000)	—	—	—
董事兼副總經理	大日月投資有限公司代表人：王志成(註1)	—	—	—	—	—	—
董事兼協理	大日月投資有限公司代表人：林坤田(註1)	—	—	—	—	—	—
法人董事	辰謙投資有限公司(註2)	—	—	—	—	—	—
董事兼特別助理	辰謙投資有限公司代表人：張辰	—	—	(1,160,000)	—	—	—
法人董事	辰真投資有限公司	—	—	1,225,000	—	—	—
董事兼特別助理	辰真投資有限公司代表人：張辰	—	—	(1,160,000)	—	—	—
董事	曾雄亮(註4)	53,701	—	—	—	—	—
董事	彭盈光	—	—	—	—	—	—
董事	張蔚誠	—	—	—	—	—	—
董事	楊式蘭(註5)	—	—	—	—	—	—
獨立董事	張居興	—	—	—	—	—	—
獨立董事	温萬壽	—	—	—	—	—	—
獨立董事	彭俊豪	—	—	—	—	—	—
獨立董事	譚仲民(註6)	—	—	—	—	—	—
監察人	陳俊孝(註3)	—	—	—	—	—	—
監察人	張可人(註3)	—	—	—	—	—	—
經理	官淑惠(註7)	—	—	(56,772)	—	5,000	—
經理	呂月雲	(30,371)	—	—	—	—	—
持股5%以上之股東	鄭羅玉嬌	—	—	(40,000)	—	—	—

註1：大日月投資股份有限公司代表人王志成及代表人林坤田於111年8月2日股東臨時會董事改選後解任。

註2：辰謙投資股份有限公司於111年8月2日股東臨時會董事改選後解任。

註3：監察人陳俊孝及張可人於111年8月2日股東臨時會董事改選後解任。

註4：曾雄亮於112年4月6日辭任。

註5：楊式蘭經112年6月29日股東會選任本公司一般董事。

註6：譚仲民經112年6月29日股東會選任本公司獨立董事。

註7：官淑惠經112年10月18日董事會委任公司治理主管。

(2) 董事、監察人、經理人、現任技術股股東及技術、研究發展人員與百分之五以上 股東股權移轉之相對人為關係人之資訊：

113年2月15日；單位：股；元

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係	股　數	交易價格
張秉堂	贈與	110.11.12	洪〇淳	本公司董事長之配偶	250,000	—
張秉堂	贈與	111.03.11	張 辰	本公司法人董事代表人及董事長之子女	65,000	—
張秉堂	贈與	111.03.11	張〇謙	本公司董事長之子女	65,000	—
張秉堂	贈與	111.03.22	洪〇淳	本公司董事長之配偶	160,000	—
張 辰	處分	111.04.29	辰真投資有限公司	本公司法人董事	1,225,000	18.39
曾雄亮	贈與	110.07.05	曾〇滋	本公司董事之子女	46,299	—
曾雄亮	取得庫藏股	110.05.24	微矽電子	本公司	119,000	25
曾雄亮	處分	110.05.20	張〇謙	本公司董事長之子女	19,000	25
官淑惠	贈與	111.05.17	張〇媛	本公司經理人之子女	5,580	—
呂月雲	贈與	110.10.28	廖〇旻	本公司經理人之子女	30,371	—

(3) 董事、監察人、經理人、現任技術股股東及技術、研究發展人員與百分之五以上 股東股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

6. 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

112年10月27日；單位：股；%

姓　名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
大日月投資股份有限公司	14,798,896	22.89	—	—	—	—	張秉堂	負責人	—
							張可兒	父女	—
							辰謙投資有限公司	負責人為同一人	—
代表人：張秉堂	5,462,182	8.45	1,415,758	2.19	1,988,495	3.08	張可兒	父女	—
							大日月投資有限公司	為其負責人	—
							辰謙投資有限公司	為其負責人	—
張秉堂	5,462,182	8.45	1,415,758	2.19	1,988,495	3.08	張可兒	父女	—
							大日月投資有限公司	為其負責人	—
							辰謙投資有限公司	為其負責人	—
鄭羅玉嬌	3,380,449	5.23	—	—	—	—	—	—	—
曾雄亮	3,079,582	4.76	218,935	0.34	—	—	—	—	—

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
邵世祥	2,715,283	4.20	—	—	—	—	邵涵琳	兄弟姊妹	—
邵涵琳	1,993,188	3.08	—	—	—	—	邵世祥	兄弟姊妹	—
葉秀窒	1,493,323	2.31	1,185,090	1.83	—	—	—	—	—
張可兒	1,310,000	2.03	—	—	—	—	張秉堂	父女	—
							大日月投資有限公司	與其負責人為父女	—
							辰謙投資有限公司	與其負責人為父女	—
兆豐證券股份有限公司	1,308,345	2.02	—	—	—	—	—	—	—
辰謙投資有限公司	1,288,495	1.99	—	—	—	—	張秉堂	負責人	—
							張可兒	負責人與其為父女	—
							大日月投資有限公司	負責人為同一人	—
							辰真投資有限公司	負責人互為父子	—
代表人：張秉堂	5,462,182	8.45	1,415,758	2.19	1,988,495	3.08	張可兒	父女	—
							大日月投資有限公司	為其負責人	—
							辰真投資有限公司	與其負責人為父子	—

(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：仟股；新臺幣元

項目＼年度			110 年	111 年度	112 年前三季
每股市價	最高		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	最低		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	平均		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
每股淨值	分配前		18.31	21.65	18.52
	分配後		16.79	20.09	尚未分配
每股盈餘	加權平均股數		60,263	62,354	64,660
	每股盈餘		4.31	2.70	(0.85)
每股股利	現金股利		1.50	1.50	—
	無償配股	盈餘配股	—	—	—
		資本公積配股	—	—	—
	累積未付股利		—	—	—
投資報酬分析	本益比		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	本利比		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	現金股利殖利率		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)

資料來源：財務資料經會計師查核簽證或核閱。

(五)公司股利政策及執行狀況

1. 本公司章程所訂之股利政策

公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，併同期初累積未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

將當年度可供分配盈餘不低於10%分派股東股息紅利，股東股息紅利之分派得以現金或股票方式為之，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之10%。分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金方式為之，並提報最近一次股東會。

2. 本年度擬（已）議股利分配之情形

本公司111年度盈餘分派案業於112年3月15日董事會決議通過，並經112年6月29日股東會通過，盈餘分派配發每股1.5元現金股利，合計新臺幣96,990仟元，並於112年8月9日發放。

(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司未配發股票股利，故不適用。

(七)員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥比例不高於3%為董事酬勞及5%至12%為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司依公司章程所定之成數估列員工、董事及監察人酬勞金額，若嗣後董事會決議實際配發金額與估列金額有差異時，則依會計估計變動處理，於董事會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司經112年3月15日董事會決議通過分派111年度員工酬勞12,218仟元及董監事酬勞4,887仟元，係採現金發放，與估列數並無重大差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司民國111年度員工酬勞均以現金發放，並無以股票分派之情事。

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果：

(1) 依公司章程規定，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥比例不高於3%為董事酬勞及5%至12%為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(2) 本公司111年度員工酬勞及董事及監察人酬勞分配如下：

①員工酬勞：12,218仟元；
②董事及監察人酬勞：4,887仟元；
上述金額全數以現金發放。

(3) 本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形於111年4月22日股東常會報告承認。

5. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

本公司110年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案，業經111年3月8日董事會決議配發員工酬勞17,430仟元及董事、監察人酬勞9,150仟元，並經111年4月22日股東會報告，全數以現金為之。董事會通過之員工酬勞及董事、監察人酬勞與110年度財務報告估列金額相符。

(八)公司買回本公司股份情形（已執行完畢者）：無。

五、公司債（含海外公司債）辦理情形：無。

六、特別股辦理情形：無。

七、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。

八、員工認股權憑證辦理情形：無。

九、限制員工權利新股辦理情形：無。

十、併購辦理情形：無。

十一、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者：無。

貳、營運概況

一、公司之經營

(一)業務內容

1. 業務範圍

(1) 業務之主要內容

- CC01080 電子零組件製造業
- F401010 國際貿易業
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(2)營業比重

單位：新臺幣仟元；%

年度 / 產品項目	110 度		111 年度		112 年前三季	
	營業收入	營業比重	營業收入	營業比重	營業收入	營業比重
半導體測試	1,005,426	77.80%	926,313	75.51%	447,669	72.14%
其他	286,953	22.20%	300,364	24.49%	172,887	27.86%
合計	1,292,379	100.00%	1,226,677	100.00%	620,556	100.00%

(3)公司目前之商品（服務）項目

本公司主要從事半導體測試(Semiconductor Testing)、半導體封裝(Semiconductor Packaging)及晶圓薄化(Wafer Thinning)等服務，為國內具有獨特競爭力之半導體專業測試與封裝服務公司。

本公司以功率元件(Power Device)與電源管理IC(Power Management Integrate Circuit,以下簡稱電源管理IC或PMIC)做為測試服務的核心產品，包含第三代半導體氮化鎵(GaN)及碳化矽(Silicon Carbide,以下簡稱 SiC)、絕緣閘極雙極性電晶體(Insulated Gate Bipolar Transistor,以下簡稱 IGBT)、金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)、二極體(Diode)、電源管理IC(PMIC)、微控制器(Microcontroller Unit,以下簡稱MCU)等，建構出以電源應用為核心的多元化產品組合，並且持續投入前瞻產品線之研發，目前提供的服務項目包含晶圓測試(CP, Circuit Probing)、成品測試(FT, Final Testing)、探針卡製造(Probe Card Manufacturing)、晶圓正面金屬鍍膜(FSM, Frontside Metallization)、晶圓晶背研磨及金屬鍍膜(BGBM, Backside Grinding and Backside Metallization)、晶圓切割(Wafer Dicing)、晶粒挑揀(Die Pick&Place)、晶粒捲帶(DieTape&Reel)等，以一貫化的整合性服務滿足客戶一次購足的需求，成為本公司爭取客戶合作並與客戶建立長期合作夥伴關係之競爭利基。

(4) 計畫開發之新商品（服務）

本公司因應市場趨勢及配合客戶產品開發，持續研發與改良製程、探針卡及治具等以提高生產良率及提供更多服務項目。未來研發計畫包含研究開發及改良高功率氮化鎵(GaN)功率元件測試技術、高功率碳化矽(SiC)功率元

件測試技術、晶圓正面金屬鍍膜技術、晶圓背面研磨及金屬鍍膜技術等。

2. 產業概況

(1) 產業概況之現況與發展

根據世界半導體貿易統計協會(WSTS)統計，2022年全球半導體市場達574,084 百萬美元，年成長3.3%。2023年由於終端市場需求仍舊低迷使得廠商營收放緩，預期2023年下半年在庫存調整接近尾聲後有望逐步復甦，然整體而言半導體市場在2023年仍會受制於市場供過於求和價格疲軟的問題，預估2023年全球半導體市場規模為515,095百萬美元，全球半導體市場年度衰退達10.3%。展望2024年，全球半導體市場預計將增長11.8%，達到575,997百萬美元。幾乎所有其他關鍵類別，包括離散元件、感測器和積體電路，預計都將呈現成長。從區域角度分析，預計所有地區到2024年都將持續增長。值得注意的是，美洲和亞太地區預計將呈現強勁的兩位數同比增長。

Fall 2020 Q4 Update CORRECTED	Amounts in US$M			Year on Year Growth in %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Americas	141,136	128,236	150,989	16.2	-9.1	17.7
Europe	53,853	57,253	61,637	12.8	6.3	7.7
Japan	48,158	48,724	52,534	10.2	1.2	7.8
Asia Pacific	330,937	280,881	310,838	-3.5	-15.1	10.7
Total World - $M	574,084	515,095	575,997	3.3	-10.3	11.8
Discrete Semiconductors	33,993	35,904	38,192	12.0	5.6	6.4
Optoelectronics	43,908	45,949	45,881	1.2	4.6	-0.1
Sensors	21782	20410	21,575	13.7	-6.3	5.7
Integrated Circuits	474,402	412,832	470,349	2.5	-13.0	13.9
Analog	88,983	83,907	88,902	20.1	-5.7	6.0
Micro	79,073	71,470	75,855	-1.4	-9.6	6.1
Logic	176,578	173,413	185,266	14	-1.8	6.8
Memory	129,767	84,041	120,326	-15.6	-35.2	43.2
Total Products - $M	574,084	515,095	575,997	3.3	-10.3	11.8

資料來源：WSTS（世界半導體貿易統計協會），2023年5月

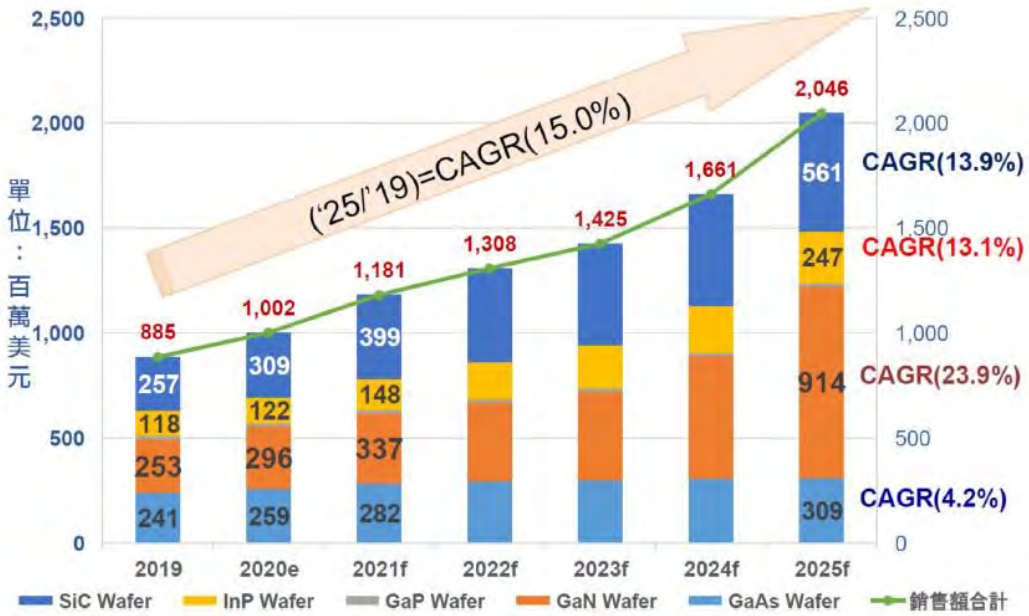
因半導體產業含括範圍廣泛，茲就本公司主要提供測試服務之功率半導體及第三代半導體之產業成長性說明如下：

①功率半導體

功率半導體主要可分為為功率元件(Power Device)與電源管理IC(PMIC)等兩大類，其中功率元件包含金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)、絕緣閘極雙極性電晶體(IGBT)、二極體(Diode)等。功率半導體應用主軸逐步由消費電子及工業控制擴展至新能源、車用電子、智慧電網及變頻家電等領域，推動MOSFET、IGBT等功率控制元件市場持續成長。依據市調機構日商環球訊息有限公司(GII)指出，2022年功率半導體市場規模達561.55億美元，預期2023~2030年功率半導體市場規模以年複合成長率15.0%的速度提升，成長至1,171.9億美元。

②第三代半導體

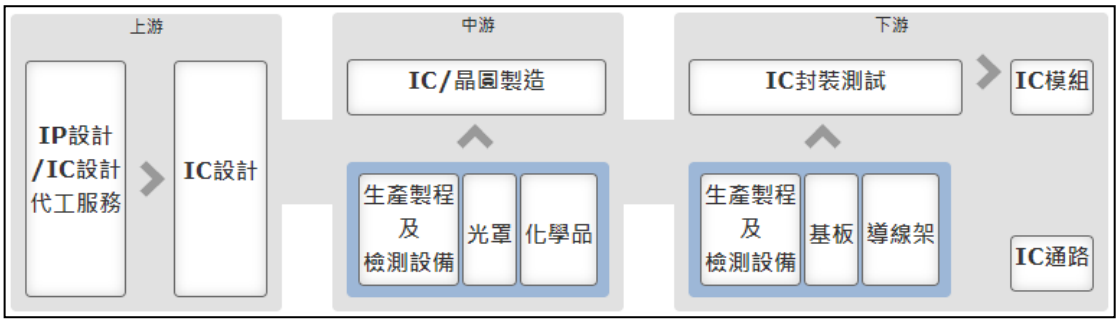
根據TrendForce的預測，第三代功率半導體產值將從2021年的9.8億美元，至2025年將成長至47.1億美元，年複合成長率達48%。目前第三代半導體材料主要為氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC），係因應高頻、高功率應用的需求，包含電動車、儲能、風電、太陽能、手機快充、筆電快充等，第三代半導體已成為全球發展的大趨勢，工研院產科所研究估計氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）的晶圓市場，氮化鎵（GaN）晶圓市場的成長於2025年達到年複合成長率23.9%，預計2025年的銷售達9.14 億美元將比2020年2.96 億美元成長三倍以上，碳化矽（SiC）晶圓市場的成長於2025年達到年複合成長率13.9%，預計2025年的銷售達5.61億美元將比2020年3.09億美元成長一倍以上。



資料來源：工研院產科國際所，2022年9月

(2) 產業上、中、下游之關聯性

台灣IC產業以特有之上下游垂直分工方式獨步全球，形成完整而緊密的產業聚落，包含IC設計、晶圓材料、設備、耗材、光罩、IC製造、IC封裝、IC測試、IC通路等產業，產業價值鏈分工精細且結構完整。國內IC上游廠商基於產業規模之擴大與發展，衡量投資效益、成本及風險因素後，已逐漸將IC後段封裝測試業務移轉予專業封測廠，且IC產品生命週期日益縮短及價格競爭激烈，更加強IC產業上、中、下游之關係，下圖為我國IC產業上、中、下游之關聯性：



資料來源：臺灣證券交易所-產業價值鏈資訊平台

(3) 產品之各種發展趨勢

①測試費用占IC整體成本比重逐漸提高

隨著IC朝向輕薄短小、低耗電及多功能整合三大趨勢發展，設計日益複雜，且測試需模擬實際使用環境，測試的複雜程度逐漸提升，相對地提升測試成本，測試費用係以測試時間計價，因此測試程式與測試環境日益重要。

②產業專業分工

由於半導體後段製程設備所需投資金額龐大，加上成本結構、製程技術與生產管理與前段製程差異甚大，使半導體大廠紛紛將封裝、測試等後段製程委外由專業的半導體封測廠進行加工。

而台灣的IC產業具有完整的垂直分工體系，不論技術、品質、價格與交期均受到肯定，因此國內外各IDM廠與IC設計公司在台灣委外從事IC封裝與測試的需求量持續增加，有利於本公司之業務成長與發展。

(4) 產品之競爭情形

隨著美國與中國大陸科技產業競爭愈發白熱化，導致中國大陸半導體產業遭到打壓，因此中國大陸以半導體自主化為目標，正積極加速發展半導體產業，並在政策上大力扶植，對我國半導體產業形成競爭壓力。

本公司在台灣深耕多年，充分利用台灣半導體產業的優勢，提供客戶專業的半導體後段加工服務，以優秀的工程技術與良好的品質，不斷提升公司的競爭優勢。

台灣半導體產業的持續蓬勃發展，同樣也讓半導體後段製程的封測產業成長茁壯，面對國內其他IC封測廠的競爭，本公司擁有完整之半導體測試設備，可提供包括氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)、MOSFET、IGBT、Diode、電源管理IC、MCU等全方位的晶圓測試與成品測試服務，同時本公司亦同步提供探針卡製造、晶圓正面金屬鍍膜、晶圓晶背研磨及金屬鍍膜、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，成為本公司爭取客戶合作並與客戶建立長期合作夥伴關係的競爭利基。

3.技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司由各專業之研發人員進行評估案件開發，以追求更高品質、更進階製程能力、製程綜合效益以及客戶和市場需求進行評估。

目前之研發項目如下：

①厚金屬(≧15um)鍍膜技術

搭配產線特殊的治具改良及製程調整，達成高均勻度之厚金屬膜之鍍膜。以往在厚金屬膜鍍膜完成後會遇到強烈的晶圓翹曲，造成後續加工困難，透過自行研發之治具，可以讓風險極小化且不需要額外高成本的設備投資，進而達到成本控制和大規模生產之優勢。

②超薄晶圓(<50um)載板技術

由於市場應用的進步，對於產品電性表現和封裝尺寸更加要求，更凸顯薄化在其重要性，透過穩定的薄化過程可以降低MOSFET之導通電阻(Rdson)，進而達到高效率之目的，但在其薄化過程中，由於晶圓厚度已低於可支撐晶圓應力的厚度，進而產生翹曲造成各站點加工困難，影響良率。透過載板的導入下，晶圓由於載板的支撐，不在再有翹曲產生，可使用既有機台自動安全執行作業，不需要額外投資昂貴設備，進而達到可量產且低成本的生產競爭優勢。

③晶圓正面金屬鍍膜(FSM)技術

由於高功率功率元件需要承受更大的電流，要求更低的功率耗損，因此必須使用銅夾封裝，以加大電流路徑，降低導通電阻，所以需要在產品正面焊墊處進行金屬鍍膜，形成焊墊與銅夾之間的焊接表面，由於需要進行圖形化的金屬鍍膜，因此製程難度相對較高，需要經過長時間的研發，以達到產品穩定生產。

④氮化鎵(GaN)雷射開槽技術

由於氮化鎵(GaN)磊晶層與基板之間存在異質結合接面，成為晶圓切割時的脆弱點，在晶圓切割時，容易在此接面造成晶粒側裂，影響產品品質，因此透過雷射開槽技術，將切割道上的氮化鎵(GaN)磊晶層移除，再進行晶圓切割，此時切割刀就不會碰觸到此接面，可有效提高晶圓切割品質。

⑤QST基板氮化鎵（GaN-on-QST）晶圓之薄化、切割、挑揀

QST有著極高的硬度，QST基板氮化鎵（GaN-on-QST）晶圓的研磨與切割，有著極大的挑戰，生產過程與傳統矽晶圓的製程有相當大的區別，需要經過長時間的研發以及和客戶間的密切合作，透過生產製程參數和材料的優化，以達到產品穩定生產。

⑥碳化矽(SiC)晶圓之薄化、切割、挑揀

碳化矽(SiC)有著極高的硬度，碳化矽(SiC)晶圓的研磨與切割，有著極大的挑戰，生產過程與傳統矽晶圓的製程有相當大的區別，需要經過長時間的研發以及和客戶間的密切合作，透過生產製程參數和材料的優化，以達到產品穩定生產。

⑦超薄晶圓測試技術

目前功率元件為追求更低的耗能，晶圓的厚度規格不斷的薄化，遠遠超過設備的初始設計技術能力，透過研發團隊持續針對客戶的產品變更投入機構的設計。

⑧更高電壓更高電流MOSFET功率元件之測試技術

高功率MOSFET的需求因工業用產品應用而大幅提高，此類產品在晶圓測試上有其先天性的測試限制，透過製程機構設計、特殊配件設計與測試電路設計可大幅度的提高可測試規格的限制，提供客戶更完整的測試服務與更優化的測試良率。

⑨更高電壓更高電流氮化鎵(GaN)功率元件之測試技術

高功率氮化鎵(GaN)的需求因工業用產品應用而大幅提高，此類產品在晶圓測試上有其先天性的測試限制，透過製程機構設計、特殊配件設計與測試電路設計可大幅度的提高可測試規格的限制，提供客戶更完整的測試服務與更優化的測試良率。

⑩更高電壓更高電流碳化矽(SiC)功率元件之測試技術

高功率碳化矽(SiC)的需求因車用產品應用而大幅提高，此類產品在晶圓測試上有其先天性的測試限制，透過製程機構設計、特殊配件設計與測試電路設計可大幅度的提高可測試規格的限制，提供客戶更完整的測試服務與更優化的測試良率。

(2)研究發展人員與其學經歷

單位：人

年度		111 年底		112 年底		113 年截至 1 月底	
		人數	比例	人數	比例	人數	比例
學歷分佈	博士	-	-	-	-	-	-
	碩士	1	2%	3	5%	3	5%
	大學(專)	48	86%	52	85%	52	85%
	高中(含)以下	7	12%	6	10%	6	10%
期末研發人員合計		56	100%	61	100%	61	100%
平均年資(年)		7.27		7.22		7.73	

(3)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
研發費用(A)	—	38,009	43,638	64,391	69,578
營業收入淨額(B)	751,454	735,748	1,022,259	1,292,379	1,226,677
佔營收淨額比率(A/B)	—	5.17	4.27	4.98	5.67

註：本公司於108年度前，營業費用未拆分推銷、管理及研究發展費用，故無研究發展費用資訊。

(4)開發成功之技術或產品

年度	研發成果	內容說明
106	● <40um 窄切割道技術開發 ● 超低阻 MOSFET 測試載台開發 ● 薄片產品之設備傳送機構研發改造 ● 墨點標記器開發與量產導入。	● 因應客戶新產品趨勢，切割道寬度逐步縮小，造成切割難度提升。透過材料和機台參數搭配，成功讓切割道較窄的產品可以成功生產，避免因此趨勢需要購置昂貴生產設備，進而提升生產優勢。 ● 功率件節能需求對於超低阻抗的產品越加追求，供應商的標準配置無法達成需求，透過自主研發套件完成升級，取得競爭優勢。 ● 薄片產品於標準設備自動傳送有高度破片的發生率，透過自主研發克服限制達成生產品質需求。 ● 墨點標記為晶圓測試後之需求，受設備機構之特性限制成本高且維修不易，自行開發全新自主設計套件全面取代。
107	● GaN on Silicon 研磨、切割、挑揀導入生產 ● GaN on Silicon 測試技術導入	● 由於產品易碎特性造成切割、研磨、挑揀容易有破損而影響良率。透過機台參數和材料搭配，導入穩定的生產，進而成功幫助客戶降低成本同時提高公司獲利。 ● 與國際一線大廠合作展開 GaN 第三代半導體的測試技術開發合作，並持續取得相關研發經驗。
108	● 蝕刻藥液開發 ● 薄片雷射刻印技術開發 ● 特殊溫控測試與高壓防治技術機構設計與研發	● 透過蝕刻藥液的研發，擺脫需要購置昂貴的藥液，進而降低生產成本。 ● 隨著產品薄化趨勢，刻印技術因此受到平整度影響，造成字體歪斜影響品質。透過治工具調整已達到穩定量產。 ● 因應客戶新材料之高壓與高溫特殊測試特性，透過自行開發之機構治具達成生產異常防範與量產能力，解決大功率產晶片測試的量產技術瓶頸。

年度	研發成果	內容說明
109	● 載板技術開發 ● 厚金屬鍍膜、切割、挑揀 ● Taiko 晶圓製程設備機構設計開發	● 產品薄化程度的要求，造成自動化產線效率下降，透過載板的技術導入，讓自動化產線生產效率提高，產品良率也獲得提升。 ● 隨著金屬層增加對於既有機台的架構已構成嚴格挑戰，目前已透過治工具調整和材料參數搭配，已成功導入量產。 ● 因應特殊晶圓加工製程，進行設備測試改機設計與量產研發，確保提早佈局特殊製程產品的代工能力。
110	● 濺鍍技術開發 ● 特殊氣流控制機構研發 ● 超薄片測試載台升級	● 車載產品需求上升，對於品質要求也更加嚴苛，透過濺鍍達到薄膜高可靠度要求，成功導入車用產品量產。 ● 特殊材料產品生產良率之改善專有技術開發。 ● 因應超薄片之規格變更，解決產品生產之製程變異的風險，變更設計。
111	● 12 吋晶圓薄化技術 ● Laser Ink 製程設計與設備開發 ● GaN 產品測試之高壓突波抑制技術開發與套件設計	● 透過治工具、材料、改機實現 12 吋超薄片生產。 ● 替代原先的晶圓 Ink 墨液標示技術，採用 Laser 技術取代，提高生產速度約四倍，並可克服 Ink 漏打、小墨跡噴濺、墨液延流等問題。 ● GaN 材料特性會造成測試過程產生高壓突波，間接造成產品的損壞，透過技術的研發與套件可完全防範與抑制突波的問題。
112	● 1200V 50A 高電壓高電流碳化矽(SiC) 功率元件測試技術 ● 高溫高壓高流特規探針卡自製技術 ● 濺鍍技術開發	● 已開發完成 1200V 高壓碳化矽(SiC) MOSFET 測試技術，測試電流可高達 50A，可有效防治高壓電弧，避免產品損壞，並得到精準的測試數據。 ● 已開發完成 175 度高溫探針卡、1700V 高壓探針卡、60A 高電流探針卡，本公司探針卡自製率高達 95%，將持續投入研發能量在特殊運用的高壓高溫高流探針卡。 ● 透過參數調整達到均勻鍍膜並達成 1000 小時之高溫高濕車規產品可靠度驗證，且透過治工具的優化達到高蹺曲（≧5mm）產品之量產。

4.長、短期業務發展計畫

(1)短期業務發展計劃

①以晶圓測試與成品測試為核心業務，並提供針卡製造、晶圓正面金屬鍍膜、晶圓晶背研磨及金屬鍍膜、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等整合性服務，滿足客戶一次購足需求。

②以功率元件與電源管理IC為核心，建構多角化的產品組合，現有產品線涵蓋氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)、MOSFET、IGBT、Diode、電源管理IC、MCU等，可有效分散風險，減少產業景氣波動造成之影響。

③ 掌握市場脈動與客戶需求方向，建立最佳化產能組合，發揮產能擴充的最大效益，與客戶共同成長。

④強化IT系統與生產自動化系統，建立更有效率且更有彈性的生產管理，滿足客戶多變的需求，快速解決客戶的問題。

(2)長期業務發展計劃

①發展晶圓正面金屬化業務。

②持續發展氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)後段製程技術與市場。

③持續發展超薄晶圓後段製程技術與市場。

④持續發展厚金屬功率元件後段製程技術與市場。

⑤配合客戶需求，提升12吋晶圓的生產比重。

(二)市場及產銷概況

1. 市場分析

(1)主要商品（服務）之銷售（提供）地區

單位：新臺幣仟元；%

年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
地區		金額	比率(%)	金額	比率(%)	金額	比率(%)
外銷	亞洲	65,456	5.09	57,702	4.70	19,483	3.14
	歐洲	1,371	0.11	3,111	0.26	2,468	0.40
	美洲	65,813	5.06	114,066	9.30	43,121	6.95
	小計	132,640	10.26	174,879	14.26	65,072	10.49
內　銷		1,159,739	89.74	1,051,798	85.74	555,484	89.51
合　計		1,292,379	100.00	1,226,677	100.00	620,556	100.00

(2)市場佔有率

依據工研院產科國際所統計2022年臺灣IC產業產值達新臺幣48,370億元，較2021年成長18.5%。其中IC設計業產值為新臺幣12,320億元，較2021年成長1.4%；IC製造業為新臺幣29,203億元，較2021年成長31.0%，其中晶圓代工為新臺幣26,847億元，較2021年成長38.3%，記憶體與其他製造為新臺幣2,356億元，較2021年衰退18.2%；IC封裝業為新臺幣4,660億元，較2021年成長7.0%；IC測試業為新臺幣2,187億元，較2021年衰退2.3%。

本公司110年及111年營業額分別為新臺幣12.92億元及12.26億元，國內之市場佔有率分別為0.20%及0.18%，目前基期尚低，隨著半導體市場需求的持續擴張，預期國內市場之佔有率將隨著半導體產業的成長而逐步提升。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

隨著新冠疫情趨於平緩，宅經濟也逐漸降溫，PC、NB、平板與網通設備的需求下降，同時，受到烏俄戰爭、高通膨等議題影響，對全球總體經濟帶來諸多變數，衝擊了全球終端市場的消費意願，也為臺灣半導體需求帶來變數。

然而因為許多創新應用，如AI、IoT、車用、HPC、低軌衛星通訊等仍在持續發展，也為臺灣半導體產業在變局當中注入成長的動能。

受總體經濟不佳，終端需求低迷，供應鏈庫存水位過高影響，全球半導體今年產值恐將衰退4.1%。產科國際所預期，台灣半導體產值也將衰退5.6%，至4.56兆元。其中，IC設計業產值恐將衰退12.3%，將是表現最差的次產業；IC製造業將衰退約3.4%，IC製造業中的記憶體產值恐將衰退26.7%，晶圓代工業則在台積電可望微幅成長支撐下，產值將僅小幅衰退1.3%；IC封裝業也將衰退3.4%；IC測試業將衰退約2.6%。

(4)競爭利基

①本公司自民國76年成立以來，深耕半導體封測產業已超過34年，經營團隊具備封測業專業背景及豐富相關經驗，擁有優秀的研發與工程專業人才，應用卓越的工程開發能力，快速解決客戶的問題，提供最佳解決方案，協助客戶產品快速的導入與量產，降低客戶成本，具備生產設備自行客製化的能力，以滿足客戶特殊製程需求，有助於公司整體競爭力的提升與公司的永續經營。

②可同時提供晶圓測試、成品測試、探針卡製造、晶圓正面金屬鍍膜、晶圓晶背研磨及金屬鍍膜、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，成為本公司爭取客戶合作並與客戶建立長期合作夥伴關係的競爭利基。

③以功率元件與電源管理IC為核心，建構多角化的產品組合，產品線涵蓋氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)、MOSFET、IGBT、Diode、電源管理IC、MCU等，可有效分散風險，減少產業景氣波動造成之影響，同時仍持續投入前瞻產品線的開發，以維持公司長期競爭力。

④民國103年即切入氮化鎵(GaN)晶圓測試領域，與國內外多家晶圓廠與IC設計公司都有合作，已累積大量產品開發經驗與量產實績，對於氮化鎵(GaN)的材料特性與元件特性，可以充分掌握，並協助客戶解決問題，快速導入

量產，技術能力深獲國內外大廠肯定。

⑤具有新產品與新製程技術的開發能力，可以充分支援客戶新世代產品的開發需求。

⑥具備治具、配件的設計與製造能力，例如自製探針卡，達到工程與量產更高的自主性及時效性，並且降低生產成本。

⑦優良的IT系統能力，設備自動化連線控制，精準掌控製程參數，有效提升生產效率，減少生產錯誤，降低人力成本，並達到與客戶之間系統對系統的資料自動化。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

①有利因素

A. 台灣的IC產業具有完整的垂直分工體系，不論技術、品質、價格與交期均受到肯定，因此國內外各IDM廠與IC設計公司在台灣委外從事IC封裝與測試的需求量持續增加，有利於本公司之業務成長與發展。

B. 本公司可同時提供晶圓測試、晶片測試、探針卡製造、晶圓正面金屬鍍膜、晶圓晶背研磨及金屬鍍膜、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，有利本公司爭取客戶合作並與客戶建立長期合作夥伴關係。

C. 本公司建構多角化的產品組合，產品線涵蓋氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)、MOSFET、IGBT、Diode、電源管理IC、MCU等，可有效分散風險，減少產業景氣波動造成之影響，同時仍持續投入前瞻產品線的開發，以維持公司長期競爭力。

D. 本公司擁有優秀的研發與工程專業人才，應用卓越的工程開發能力，快速解決客戶的問題，提供最佳解決方案，協助客戶產品快速的導入與量產，降低客戶成本，成為客戶最佳的夥伴。

②不利因素與因應對策

A. 產能利用率的波動，對於IC封測廠的獲利影響甚鉅，因此IC產業市場的景氣波動，將會增加後段封測廠之營運風險。

因應對策：持續強化品質、成本、交期的優勢，吸引客戶持續下單，同時強化與客戶的合作模式，與客戶建立長期的合作夥伴關係，使產能得到充分而穩定的利用。

B. IC封測相關設備價格高昂，資本投資金額大，折舊費用高，因此增加營

運風險。

因應對策：謹慎投資機器設備，充分掌握市場脈動與客戶需求，避免因設備產能不足而失去市場機會，也避免因設備擴充速度過快而造成設備的閒置，增加營運風險。

C. 中國大陸以半導體自主化為目標，正積極加速發展半導體產業，並在政策上大力扶植，對我國半導體產業形成競爭壓力。

因應對策：以本身的競爭優勢，強化開發新產品的工程能力，研發新技術及新產品，提升附加價值，並以更好的品質、更好的交期、更有效率與彈性的服務內容，與中國大陸廠商形成區隔，以吸引更多台灣本土客戶與國際客戶的長期合作。

2. 主要產品之重要用途及產製過程

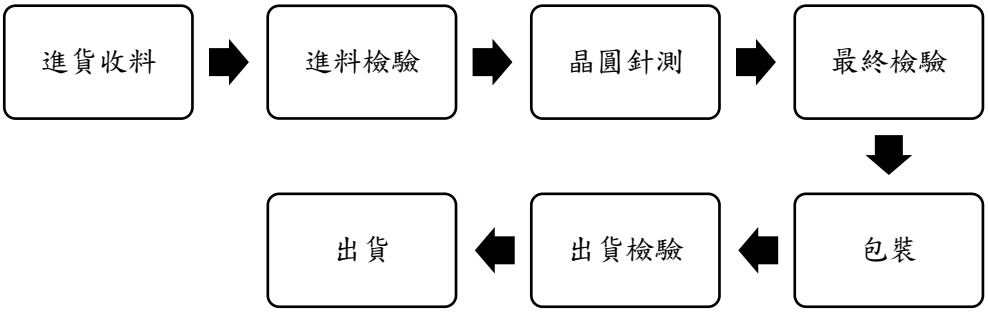
(1) 主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
半導體測試	晶圓測試：在晶圓製造完成後執行，其主要功能係在 IC 封裝前，對晶圓上之晶粒進行功能測試，以篩選出良品與不良品，測試的結果是 IC 封裝的重要依據，可以減少後續不必要的 IC 封裝及成品測試成本。同時，測試結果的數據，也是前段晶圓製程良率改善的重要參考資料。 成品測試：對封裝完成後的 IC 進行功能測試，淘汰不良品，以確保通過測試的良品可以符合客戶所要求的功能與品質。
半導體封裝	將晶圓進行研磨加工並切割成為晶粒，最後將晶粒挑揀至 IC 承載盤或捲帶，以供模組廠或系統廠使用。
晶圓薄化	主要係針對功率半導體晶圓，進行背面研磨加工與背面金屬鍍膜加工，使晶圓上之功率元件能符合客戶的產品特性規格與封裝規格。

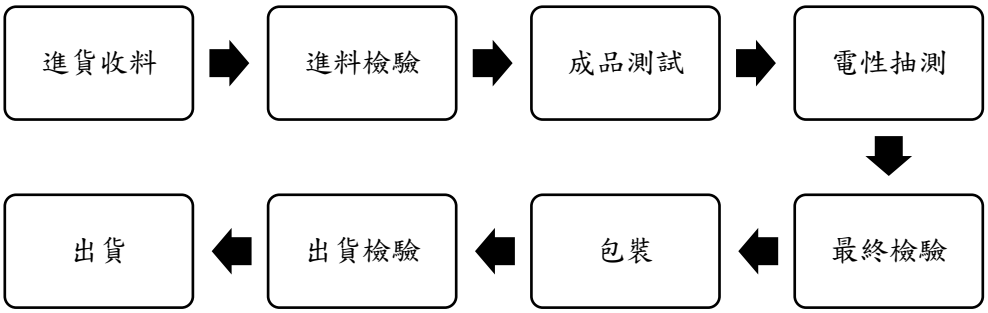
(2) 主要產品之產製過程

①半導體測試

A. 晶圓測試

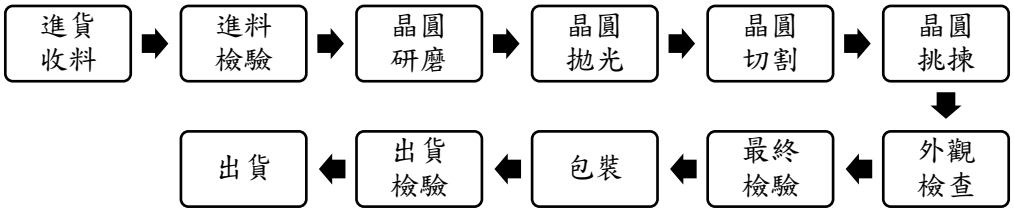


B. 成品測試

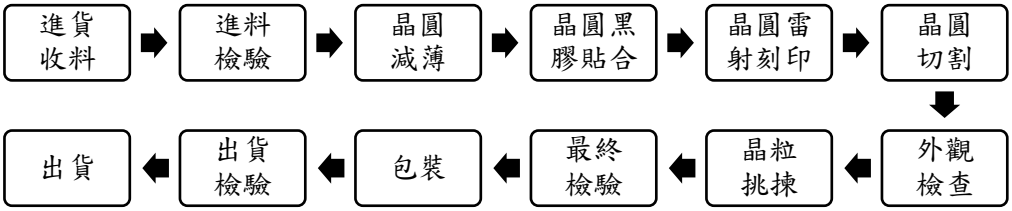


②半導體封裝

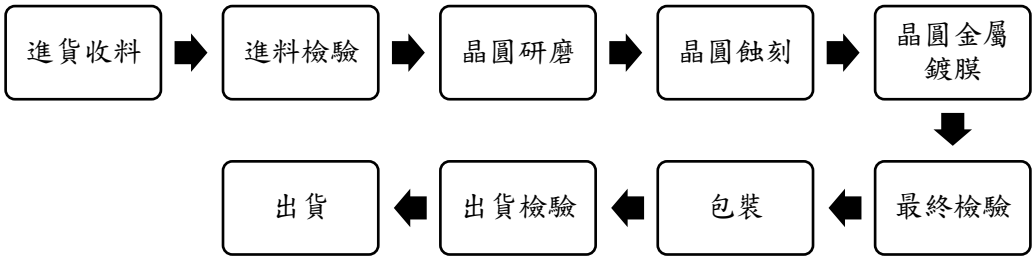
A. COB/COG



B. WLCSP-DPS



③晶圓薄化



3. 主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
銀錠	甲公司、乙公司	良好
膠帶	三井化學、辛公司	良好

4. 最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

(1) 毛利變化情形

單位：新臺幣仟元；%

年度 主要產品	110 年度				111 年度				毛利率變動率
	營業收入	營業成本	營業毛利	毛利率	營業收入	營業成本	營業毛利	毛利率	
半導體測試	1,005,426	549,905	455,521	45.31%	926,313	583,078	343,235	37.05%	(18.23%)
其他	286,953	230,690	56,263	19.61%	300,364	240,291	60,073	20.00%	1.99%
合計	1,292,379	780,595	511,784	39.60%	1,226,677	823,369	403,308	32.88%	(16.97%)

(2) 毛利變動分析

茲將最近二年度毛利率變動達20%以上之產品別說明如下：

本公司111年度毛利率較110年度變動未達20%以上，故不適用。

5. 主要進銷貨客戶名單

(1) 最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例：

單位：新臺幣仟元

項目	110 年度				111 年度				112 年前三季			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	三井化學	9,526	10.99	—	甲公司	11,364	13.40	—	三井化學	11,004	19.09	—
2	甲公司	8,879	10.24	—	三井化學	7,880	9.29	—	甲公司	4,958	8.60	—
	其他	68,279	78.77		其他	65,541	77.31		其他	41,671	72.31	
	進貨淨額	86,684	100.00		進貨淨額	84,785	100.00		進貨淨額	57,633	100.00	

變動分析：

三井化學公司及甲公司主要進貨項目為生產性物料，111年度本公司晶圓薄化營收有所成長，其製程所需之貴金屬進貨金額亦隨之增加，故對甲公司之進貨增加，112 年因交期恢復穩定，便將通用品項集中向三井化學採購，致進貨金額增加。

(2) 最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新臺幣仟元

項目	110 年度				111 年度				112 年前三季			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	B公司	177,606	13.74	—	B公司	168,177	13.71	—	A公司	103,922	16.75	—
2	A公司	120,280	9.31	—	A公司	136,241	11.11	—	B公司	58,239	9.38	—-
	其他	994,493	76.95		其他	922,259	75.18		其他	458,395	73.87	
	銷貨淨額	1,292,379	100.00		銷貨淨額	1,226,677	100.00		銷貨淨額	620,556	100.00	

變動分析：

A 公司主要從事電源管理 IC 之設計及銷售，因終端消費性電子產品需求增加，致訂單量增加，測試需求提升，最近二年度未有重大變化之情事。

6. 最近二年度生產量值表：

單位：仟個；新臺幣仟元

年度 / 主要商品	110 年度			111 年度			112 年前三季		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值	產能	產量	產值
半導體測試(註 1)	177,188	163,823	594,198	187,039	125,151	583,078	143,881	71,239	399,913
其　他(註 2)	576,285	464,629	235,724	576,350	345,408	240,291	333,270	186,343	177,383
合　　計	753,473	628,452	829,922	763,389	470,559	823,369	477,151	257,582	577,296

註 1：含晶圓測試及成品測試。
註 2：含晶圓薄化及封裝。

7. 最近二年度銷售量值表

單位：仟個；新臺幣仟元

年度 / 主要商品	110 年度				111 年度				112 年前三季			
	內　銷		外　銷		內　銷		外　銷		內　銷		外　銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值
半導體測試(註 1)	163,260	899,633	563	105,793	124,987	775,635	164	150,678	71,008	393,565	231	54,104
其　他(註 2)	438,263	260,107	26,366	26,846	333,533	276,162	11,875	24,202	184,401	161,919	1,942	10,968
合　　計	601,523	1,159,740	26,929	132,639	458,521	1,051,797	12,039	174,880	255,409	555,484	2,173	65,072

註 1：含晶圓測試及成品測試。
註 2：含晶圓薄化及封裝。

(三)最近二年度從業員工人數

單位：人

年度		111年度	112年度	113年度截至1月底
員工人數	直接人工	307	309	307
	間接人工	178	181	180
	研發人員	56	61	61
	管理人員	24	25	25
	合計	565	576	573
平均年歲（歲）		37.60	37.79	37.85
平均服務年資（年）		5.75	5.85	5.95
學歷分佈比率(%)	博士	-	-	-
	碩士	2.65%	2.78%	2.79%
	大學（專）	69.03%	69.10%	68.94%
	高中(含)以下	28.32%	28.12%	28.27%

(四)環保支出資訊

1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：

廠區	許可證名稱	有效日期	許可證字號	專責人員證書證號
竹南廠	固定污染源操作許可證	110.10.01～114.08.06	苗府環操證字第K0987-01號	環署訓證字第FA030438號
竹南廠	水污染防治許可證	111.02.22～116.02.21	苗縣環水許字第00449-04號	環署訓證字第GB230326號
竹南廠	廢棄物清理計畫書	110.10.18變更核准	府環廢字第1100069120號	註
竹東廠	廢棄物清理計畫書	110.08.26變更核准	府授環業字第1108657009號	註

註：依法令規定，資本額未達新臺幣二十億元以上無需設置專責人員

2.列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

112年9月30日 單位：新臺幣仟元

設備名稱	數量	取得日期	投資成本	未折減餘額	用途與可能產生效益
氟系廢水系統	1	108.12	3,300	825	符合廢水排放標準
酸排(水洗塔)	1	109.02	7,145	2,024	符合空污排放標準
研磨廢水系統	1	110.11	4,432	2,807	更新舊系統、產能增加

3.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：近二年無污染糾事件發生。

4.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

(1)最近二年度及截至公開說明書刊印日止因汙染環境所受之損失

縣市	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容	因應措施
苗栗縣	110.04.07	府環水字第1100022824號	水污染防治法第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條	未依規定每日確實記錄廢(汙)水(前)處理設施操作參數(加藥量)等資料	罰鍰新臺幣1萬元	罰緩已繳納，並依水汙染防治法之規定辦理

(2)未來因應對策及可能之支出

①事業廢棄物處理

A. 持續執行節能減廢政策

- 對外：將客戶來料包材再利用/回收。
- 對內：加速電子表單作業(無紙化)。
- 回收水再利用。
- 廢棄物分類/回收。

B. 一般事業廢棄物/生活廢棄物，委由合格廢棄物專責處理機構進廠清運，落實環保法令，並確認廢棄物最終處理情形。

②廢(污)水處理

A. 竹東廠產生廢汙水製程已移轉至竹南廠生產，未再產生事業廢污水。

B. 竹南廠的晶圓切割、晶圓研磨、晶圓背鍍金產生之廢污水，經廢污水處理系統，均符合環保法規水質標準，排放至廣源科技園區廢水處理系統(納管)，再由廣源廢水處理廠對外排放。

③空污處理

竹南廠在背鍍金製程作業，產生酸性氣體排放，經污染防治設備(酸性洗滌塔)處理，再排放至大氣中，酸排每年將定期檢測，確保符合環保法規之排放標準。

④廢污水紀錄處理

公司已依規定每日確實填寫紀錄，並經主管每日覆核紀錄。

5. 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：本公司遵循環保法令，已將排入自然水體之衝擊降至最低，加強人員之教育，以避免違反環保法令案件再發生，對本公司盈餘、競爭地位及資本支出無重大影響且未來二年未有重大環保資本支出情事。

(五)勞資關係

1. 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護情形：

(1) 員工福利措施

- 年度調薪、三節獎金、營運績效獎金及優渥員工分紅制度。
- 免費員工定期健康檢查、優惠眷屬團體保險方案。
- 生日禮券、三節禮券、婚喪喜慶補助金、員工旅遊補助、年終尾牙及各項員工福利活動等。
- 員工餐廳、保健室、私人哺乳室、遠道員工租屋補助及汽、機車停車位。

(2) 員工進修及訓練情形

公司提供多元化訓練課程及在職教育訓練，其中包含新進人員訓練、在職訓練課程、品質訓練課程、勞工安全衛生教育訓練、專業技能課程以及與職務相關之外訓課程，透過訓練學習以提高工作績效，並讓員工在日新月異的工作環境中，精進成為該領域的佼佼者。

(3) 退休制度與實施狀況

公司為照顧員工退休生活，促進勞資關係及增進工作效率，依法成立勞工退休準備金監督委員會，由該委員會監督本基金之儲存與動支情形，依規定按每月薪資總額4%提列退休準備金，專戶儲存於台灣銀行股份有限公司。自民國94年7月1日起依法實施勞工退休新制，適用新制之員工，按個人月提繳工資提繳6%退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

(4) 勞資協調之情形

公司依勞動基準法為遵循基準，並設置意見反應信箱及定期召開勞資會議，重視員工意見，透過溝通管道維持勞資雙方之關係和諧。

(5) 各項員工權益維護措施

公司以誠信、尊重對待員工，透過充實福利制度安定員工生活及完善的進修、訓練管道與員工建立起互信互賴之良好關係，且訂定完善的管理制度及辦法以維護同仁權益。

2. 說明最近二年度及截至公開說明書列印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計，應說明無法合理估計之事實：

(1) 勞工檢查結果

縣市	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容	因應措施
苗栗縣	110.05.26	府勞資字第1100101512號	勞動基準法第24條	未依規定給付延長工時工資	罰鍰新臺幣2萬元	罰緩已繳納，並依勞動基準法之規定辦理
苗栗縣	111.03.21	府勞資字第1110052890號	勞動基準法第24條	未依規定給付延長工時工資	罰鍰新臺幣2萬元	罰緩已繳納，並依勞動基準法之規定辦理
苗栗縣	112.05.15	勞職授字第1120202406號	職業安全衛生法第6條第一項	員工未確實使用適當之防護具	罰鍰新臺幣10萬元	罰緩已繳納，並依職業安全衛生法之規定辦理
苗栗縣	112.08.17	府勞資字第1120188078號	勞動基準法第24條	未依規定給付延長工時工資	罰鍰新臺幣2萬元	罰緩已繳納，並依勞動基準法之規定辦理

(2) 勞資糾紛

林○○前員工，原任職於製程工程部，任職期間有加班事實，但未依本公司規定填報申請加班，109年8月離職後於110年3月8日提出勞資爭議強制執行訴訟，請求本公司給付加班費137,872元，惟該員尚積欠本公司164,108元，本公司於民國110年5月3日提請訴訟，申請兩造雙方債務互為抵銷，經抵銷後該員需返還本公司26,236元，經公司考量後不向該員請求返還。今以臺灣新竹地方法院110年7月12日判決確定撤銷強制執行後結案。因應此次訴訟案，已加強宣導同仁延遲下班應確實申報於公司系統，公司系統於月底以電子郵件提醒同仁申報加班。

(六)資訊安全管理

1. 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

本公司在資安風險控管上，已訂定「電子計算機作業循環」以規範公司資訊安全，為公司建立與維護一個安全的資訊系統環境，亦已針對包含網際網路及電子郵件使用、密碼設定、軟體下載、儲存媒體、檔案備份等作業，制定相關之資通安全管理政策，並積極監控網路流量，針對異常狀立即予以處置。對於員工之教育訓練，亦不定期進行資通安全宣導，建立危機意識。

- 定期執行資訊安全宣導，提醒員工遵守資安規範。
- 建立系統資料保存安全區，主動式防止資料外洩。
- 強化網路防火牆與網路控管防治災害擴散。

2. 列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

(七)有無因應景氣變動之能力

本公司隨時注意產業相關之訊息及技術發展演變，持續與客戶維持良好關係，並於本公司經營管理會議中提出討論與訊息分享，隨著市場變化進行調整，對於景氣變動有足夠能力因應之。

(八)發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之關係人間交易事項是否合理

本公司與關係人交易，其價格及收款條件與一般交易無重大差異，亦無非常規交易，相關交易事項及說明請參閱本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(九)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列下列事項

1.市場及產銷部分，應增列產品核心技術分析暨持續發展之研究發展計畫，內容包括：

(1)產品生產開發技術之層次、來源、確保(專利權及所受法律保護狀況)與提升

A. 產品生產開發技術之層次

本公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，為國內具有獨特競爭力之半導體專業測試與封裝服務公司，擁有專業之自有技術及經驗豐富之研發團隊，透過多年來在半導體測試技術的研發、驗證及生產的經驗，已建立深厚的技術能力，相關的測試電路、測試程式、測試介面、探針卡等皆自行研發製作，本身具備設備改機的能力，以及治具及配件設計與製造的能力。並領先市場投入第三代半導體氮化鎵與碳化矽測試技術的研發，再加上與多家知名第三代半導體客戶的長期合作，成為本公司能夠成功跨入第三代半導體測試領域的契機。

本公司可同時提供晶圓測試、成品測試、探針卡製造、晶圓正面金屬鍍膜、晶圓晶背研磨及金屬鍍膜、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品生產成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，為國內極少數具備功率半導體中後段製程開發能力之公司。

B. 產品生產開發技術之來源

本公司之技術來源皆為自行研發，本公司自設立後持續提升研發能量，精進製程技術，技術範圍涵蓋晶圓測試、成品測試、探針卡製造、晶圓正面金屬鍍膜、晶圓晶背研磨及金屬鍍膜、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等製程，自市場企劃、治具開發、實驗設計、材料開發、參數調校、工程驗證、製程優化等均由本公司經營團隊及其研發團隊所完成。

C. 技術之確保與提升

本公司針對核心技術持續深化研發能力，重要研發成果均已列為公司營業秘密完善保存，嚴格控管本公司研發團隊人員之存取權限，以確保資料之完整性及機密性，藉以控管及保護本公司重要核心技術。對於技術人員均要求簽訂保密合約，且對相關技術做適當之資料保存，以預防人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。另外，本公司透過資深技術人員之技術傳承、實作傳承分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的技術團隊，藉以確保核心技術持續提升。

(2)現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究發展計劃

A. 現在主要產品之競爭優勢

本公司早在民國90年即切入電源管理IC測試領域，並於民國95年進一步切入MOSFET測試領域，一路發展至今，已建立深厚的技術能力，相關的測試電路、測試程式、測試介面、探針卡等皆自行研發製作，本身具備設備改機的能力，以及治具及配件設計與製造的能力。並領先市場投入第三代半導體氮化鎵與碳化矽測試技術的研發，再加上與多家知名第三代半導體客戶的長期合作，成為本公司能夠成功跨入第三代半導體測試領域的契機，且通過與客戶合作驗證後所產生之競爭優勢不易被其他測試廠取代。本公司投入晶圓研磨與晶圓切割領域迄今已有超過30餘年生產經驗，在此期間持續投入研發能量，精進製程技術，並於107年成功跨入第三代半導體晶圓薄化領域，已具備多項先進的技術能力。本公司可同時提供晶圓測試、成品測試、探針卡製造、晶圓正面金屬鍍膜、晶圓晶背研磨及金屬鍍膜、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，成為本公司爭取客戶合作並與客戶建立長期合作夥伴關係的競爭利基。

B. 現在主要產品之生命週期及持續發展性

本公司主要從事功率半導體的測試、封裝與晶圓薄化服務，為確保功率半導體功能、速度、公差、電力消耗及熱力發散等屬性符合訂定之標準，故不論是測試、封裝或晶圓薄化，皆屬於半導體製造中不可或缺之重要生產流程，因其製程需精通半導體元件物理、製程與電路設計，技術開發人員的養成亦須經長期之培養，再加上產品認證期長，需歷經繁瑣的調整及專用製程驗證，具有一定的進入障礙，其技術具有累積性，故其產品生命週期較其他IC產品長，且隨著半導體應用的持續發展，各項新興產業如電動車、充電樁、高效能運算、AI伺服器、資料中心、再生能源等，都需要高效能的電源轉換做後盾，預期功率半導體與第三代半導體的應用領域將會持續擴散，市場需求也將持續增加，有利該公司業務的持續發展。

C. 新產品之研究發展計劃

本公司成立迄今，持續投入研發能量，精進製程技術，未來的研究發展方向將以節能為發展核心，專注於可提升能源轉換效率的功率元件與電源管理IC，研發更加先進的半導體測試、半導體封裝與晶圓薄化製程，朝向更高電壓、更高電流、更高功率、更高溫度、更高速度、更低電阻、更薄厚度的方向發展。本公司因應市場趨勢及配合客戶產品開發，持續研發與改良製程、探針卡及治具等以提高生產良率及提供更多服務項目，未來研發計畫包含研究開發及改良高功率氮化鎵(GaN)功率元件測試技術、高功率碳化矽(SiC)功率元件測試技術、晶圓正面金屬鍍膜技術、晶圓背面研磨及金屬鍍膜技術等。本公司透過研發經費及專業技術人才的投入，持續創新及改良製程，擴大整體效益，進而提升本公司競爭優勢。

2. 如係屬生技醫療業者，應增列其核心產品之臨床實驗進度資訊：不適用。

3. 最近二年度從業員工人數部分，增列經理人、技術及研究發展人員暨其他員工之流動情形：請參詳本公開說明書貳、一、(三)最近二年度從業員工人數。

二、不動產、廠房及設備、其他不動產或其使用權資產

(一)自有資產

1. 列明取得成本達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上之不動產、廠房及設備名稱、數量、取得日期、取得成本、重估增值及未折減餘額，並揭露其使用及保險情形、設定擔保及權利受限制之其他情事：

112年9月30日；單位：新臺幣仟元

不動產廠房及設備名稱	單位	數量	取得年月	原始成本	重估增值	未折減餘額	利用狀況			保險情形	設定擔保及權利受限制之其他情勢
							本公司使用部門	出租	閒置		
土地-竹南廠	平方公尺	8,044.74	97/3	138,722	—	138,722	全公司	—	—	—	抵押擔保
房屋及建築物-竹南廠	平方公尺	12,307.39	97/3	236,079	—	172,959	全公司	—	—	已投保	抵押擔保

2. 列明閒置不動產及以投資為目的持有期間達五年以上之不動產名稱、面積、座落地點、取得日期、取得成本、重估增值、未折減餘額、公告現值或房屋評定價值、公允價值及預計未來處分或開發計畫：無。

(二)使用權資產

列明金額達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上之使用權資產租賃標的名稱、數量、租賃期間、出租人名稱、原始帳面金額、未折減餘額，並揭露其保險情形及租約之重要約定事項：無。

(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率

1. 生產工廠之使用狀況

113年1月31日

項目 工廠	建物面積	員工人數	生產商品種類	目前使用狀況
竹東廠 新竹縣竹東鎮沿河街395號	1,579.19 平方公尺	139人	半導體測試	良好
竹南廠 苗栗縣竹南鎮友義路230號	12,307.39 平方公尺	434人	半導體測試、封裝及晶圓薄化服務	良好

2. 最近二年度設備產能利用率

單位：千個；新臺幣仟元

年度 主要產品	110年度				111年度				112年前三季			
	產能	產量	產能利用率	產值	產能	產量	產能利用率	產值	產能	產量	產能利用率	產值
半導體測試(註1)	177,188	163,823	92%	594,198	187,039	125,151	67%	583,078	143,881	71,239	49%	399,913
其他(註2)	576,285	464,629	81%	235,724	576,350	345,408	60%	240,291	333,270	186,343	56%	177,383
合計	753,473	628,452	83%	829,922	763,389	470,559	62%	823,369	477,151	257,582	54%	577,296

註1：含晶圓測試及成品測試。
註2：含晶圓薄化及封裝。

三、轉投資事業

(一)轉投資事業概況：本公司考量未來長期發展且微石開發(股)公司經營餐飲業務與半導體本業歧異，於2021年12月董事會決議處分微石開發100%股權，並於該年度以新臺幣2,500仟元出售微石開發全數股權，2022年度及2023年度截至目為止本公司無轉投資事業之情事。

(二)綜合持股比例：無。

(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響：不適用。

(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認股情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股超比例超過百分之十股東之關係及認購股數：無。

四、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
廠房增建工程	富泰營造(股)公司	自建管單位開工核准日起540日曆天	擴線需求	無
土地租賃	廣源電子(股)公司	109/12/01~119/12/31	員工停車場	無
中期擔保借款	合作金庫銀行	112/05/26-114/03/31	授信合約	機器設備
中期擔保借款	合作金庫銀行	110/10/05-115/10/05	授信合約	機器設備
中期擔保借款	合作金庫銀行	108/12/04-113/12/04	授信合約	機器設備
中長期借款	第一商業銀行	112/05/11-115/03/14	授信合約	無
長期擔保借款	台北富邦商業銀行	111/05/11-118/05/11	授信合約	土地、房屋及建築物
中期擔保借款	台北富邦商業銀行	112/07/25-113/07/25	授信合約	房屋及建築物
中長期借款	華南商業銀行	112/05/18-115/03/12	授信合約	無
中期擔保借款	兆豐國際商業商銀行	112/08/07-114/08/07	授信合約	土地

叁、發行計畫及執行情形

一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析

本公司無併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債計畫之情形。而前次現金增資計畫實際完成日距申報時未逾三年者，係111年6月辦理現金增資164,700仟元，現金增資運用計畫分析如下:

（一）計劃內容

1. 主管機關核准日期及文號：民國111年6月17日證櫃新字第1110005463號。
2. 計畫所需資金總額：新台幣164,700仟元
3. 資金來源：現金增資發行普通股3,660仟股，每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣45元，募集總金額為新台幣164,700仟元。
4. 計畫項目及預計資金運用進度：

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預期完成日期	所需資金總額	預定資金運用情形
			111 年度
			第三季
償還銀行借款	111 年第三季	164,700	164,700
預計可產生之效益	本公司募集資金 164,700 仟元，全數用於償還銀行借款，以減少向銀行借款金額並降低所造成之利息負擔。此外，尚可改善本公司財務結構及提升償債能力各項指標，適度		

	減輕財務負擔，以及降低對金融機構之依存度，對本公司整體營運發展及競爭力之提升將有所助益。

5. 變更計畫內容、變更原因及變更前後效益：不適用。

6. 輸入金融監督管理委員會指定資訊申報網站之日期：不適用。

(二) 執行情形

單位：新臺幣仟元

計畫項目	執行狀況(截至 111 年第三季)			進度超前或落後之原因及改善計畫
償還銀行借款	支用金額	預定	164,700	依照預定進度完成。
		實際	164,700	
	執行進度(%)	預定	100%	
		實際	100%	

(三) 執行效益

單位：新臺幣仟元；%；倍

項目		111年前二季(增資前)	111年度(增資後)
基本財務資料	流動資產	805,924	708,320
	流動負債	592,654	433,232
	負債總額	1,070,422	1,226,677
	利息支出	4,810	9,608
	營業收入	687,128	1,226,677
	每股盈餘(元)	2.03	2.7
財務結構	負債比率	48.52	38.01
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	122.72	126.28
償債能力	流動比率	135.98	163.49
	速動比率	130.95	156.95
	利息保障倍數	36.6	24.65

註：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

本公司此次辦理辦理現金增資共募集 164,700 仟元，所募集資金已全數於 111 年第三季用以償還銀行借款，以減少向銀行借款金額並降低所造成之利息負擔。此外，尚可改善本公司財務結構及提升償債能力各項指標，適度減輕財務負擔，

以及降低對金融機構之依存度，對本公司整體營運發展及競爭力之提升將有所助益。

二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫：

(一) 資金來源

1.本次計畫所需資金總額：新臺幣 161,239 仟元。

2.資金來源：本次現金增資發行新股 4,042 仟股，每股面額新臺幣 10 元，計新臺幣 40,420 仟元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣 32.41 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，本次競價拍賣得標總金額為新台幣 140,029 仟元；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格每股新臺幣 40.75 元為之，惟均價高於最低承銷價格之 1.08 倍，故每股發行價格以新臺幣 35.00 元溢價發行。另員工認購募集資金為新臺幣 21,210 仟元，募集總金額 161,239 仟元。

3.計畫項目、預定資金運用進度

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預計資金運用進度 113 年度 第一季
充實營運資金	113 年第一季	161,239	161,239
合計		161,239	161,239

4.預計可能產生效益

本公司預計於 113 年第一季普通股股款計 161,239 仟元募集完成後，依計畫將全數用於充實營運資金，於資金到位後隨即投入支應公司營運所需之相關資金需求，除可增加長期資金穩定性外，亦可健全財務結構並降低公司營運風險，有助於提高本公司資金靈活調度之彈性及未來中長期發展，故本次現金增資效益應屬合理。

5.本次募集之資金如有不足，其籌措方法及來源：本次計畫係現金增資發行普通股，如因募集股數或每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，將減少充實營運資金之金額；惟若致募集資金增加時，將全數用以充實營運資金。

(二)本次發行公司債者，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法。如有委託經金管會核准或認可之信用評等機構評等者，並應揭露該機構名稱、評等日期及公司債信用評等結果。如附有轉換、交換或認

股權利者，並應揭露發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形與對股東權益影響：不適用。

(三)本次發行特別股者，應揭露每股面額、發行價格、發行條件對特別股股東權益影響、股權可能稀釋情形、對股東權益影響及公司法第一百五十七條所規定之事項。如附有轉換權利或認股權利者，並應揭露發行及轉換辦法或認股辦法（含轉換前原特別股未分配之股息等權利義務於強制轉換後之歸屬）：不適用。

(四)上市或上櫃公司發行未上市或未上櫃特別股者，應揭露發行目的、不擬上市或上櫃原因、對現有股東及潛在投資人權益之影響及未來有無申請上市或上櫃之計畫：不適用。

(五)股票依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第五條規定核准在證券商營業處所買賣之公司發行新股者，應說明未來上市（櫃）計畫：不適用。

(六)本次發行員工認股權憑證者，應揭露員工認股權憑證發行及認股辦法：不適用。

(七)本次發行限制員工權利新股者，應揭露限制員工權利新股之發行辦法：不適用。

(八)說明本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響。以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：

1.本次計畫之可行性評估

(1)法定程序之可行性

本公司本次辦理創新板上市前現金增資發行普通股計畫，業經本公司 111 年 6 月 24 日董事會及 111 年 8 月 2 日股東臨時會決議通過辦理初次上市前現金增資提撥公開承銷案，並於 112 年 12 月 27 日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫，且授權董事長全權處理相關增資事宜。經核閱本公司本次計畫之相關內容，均符合「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令之規定，另參閱蔚中傑律師事務所蔚中傑律師出具之法律意見書，本次計畫之相關內容符合相關法令之規定，故本次計畫於法定程序上應屬適法可行。

(2)募集資金完成之可行性

本次計畫辦理現金增資發行普通股 4,042 仟股，每股面額新臺幣 10 元，總募集資金為新臺幣 161,239 仟元。本次現金增資依公司法第 267 條規定，保留增資發行新股之 15%，計 606 仟股由員工認購，其餘之 85%計 3,436 仟股，則依「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則」第36條及「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則補充規定」第17條之1之規定，以現金增資發行新

股方式委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，並按證券交易法第 28 條之 1 規定，於 111 年 8 月 2 日股東臨時會決議原股東放棄優先認購權利，排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用。本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股採全數競價拍賣方式辦理，其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應可確保資金募集完成，故本次計畫募集完成應具可行性。

(3)資金運用計畫之可行性

本次現金增資計畫募集資金預計為新臺幣 161,239 仟元，資金運用計畫為充實營運資金，進而強化公司長期競爭力及健全財務結構，並可提升資金靈活調度之彈性，對企業經營具有正面助益，故本公司本次辦理現金增資充實營運資金之運用計畫應屬可行。

2.本次募集資金計畫之必要性

本次辦理現金增資發行新股係依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第36條規定，以現金增資發行新股方式，委託證券承銷商辦理創新板上市前公開承銷，另依「發行人募集與發行有價證券處理準則」，得不適用有關計畫必要性之規定。

3.本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能效益之合理性

(1)資金運用計劃及預計進度之合理性

本公司本次辦理現金增資發行新股係作為辦理初次創新板上市前公開承銷之用，預計募得資金總額為新臺幣 161,239 仟元，經考量本次向主管機關申報、審查時間、公開承銷期間及繳款作業等因素，預計於 113 年第一季底前可收足股款，俟資金募集完成後，隨即將本次現金增資所籌措之款項用於充實營運資金，故其資金運用計畫及預計進度應屬合理。

(2)預計可能產生效益之合理性

單位：新臺幣仟元

項目/年度		112 年第三季 (籌資前)	本次計畫執行完畢
財務結構	負債比率	42.67	39.61
償債能力	流動比率	215.38	272.45
	速動比率	206.38	263.44

資料來源：本公司112年第三季經會計師核閱之財務報告。

註：係按本公司112年第三季經會計師核閱之財務報告為基準，加計本次辦理現金增資發行新股募得資金予以設算。

本公司本次募集之資金將全數用於充實營運資金，提升中長期競爭力之外，對財務結構及償債能力改善，如上表所示，預估本次現金增資於113年第一季募集完成並挹注公司營運資金後，在財務結構方面，負債占資產比率可由增資前42.67%降至39.61%；就償債能力而言，流動比率及速動比率分別由增資前215.38%及206.38%，攀升至增資後之272.45%及263.44%，故

對本公司整體營運發展及健全財務結構等面相均有正面助益，故本次募集計畫預計可能產生效益應屬合理。

4.各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

本公司本次募資計畫係依據發行人辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款規定，以現金增資發行新股辦理初次創新板上市前之公開銷售作業，故僅就發行新股對本年度每股盈餘稀釋情形進行評估。

本公司本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股4,042,000股，預計於113年第一季募集完成，以本公司現有股本64,660,000股估算，增資後已發行股份總額將增加至68,702,000股，本次辦理現金增資發行新股占本公司增資後股數之5.88%，本公司本次辦理現金增資用以充實營運資金，其將可強化財務結構及償債能力、增加資金靈活調度之彈性及維持公司競爭力，故本次辦理現金增資發行新股對本公司每股盈餘稀釋影響應屬有限，對現有股東權益亦尚無重大影響。

5.以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：不適用。

(九)說明本次發行價格、轉換價格、交換價格或認股價格之訂定方式

請參閱本公開說明書附件「承銷價格計算書」。

(十)資金運用概算及可能產生之效益

1. 收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構（含總成本及單位成本）、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：不適用。

2. 轉投資其他公司者：不適用。

3. 充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項：

(1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：

A.公司債務逐年到期，償還計畫及預計財務負擔減輕情形：本公司 112 年 1 至 11 月債務實際償還情形請詳後附之現金收支預測表，112 年 12 月及 113 年 1 月至 12 月預估債務償還情形係依據公司資金調度政策並考量未來預計營運狀況及款項收付情形等按月編製。

B.目前營運資金狀況：請參閱後附之現金收支預測表。

C.所需之資金額度及預計運用情形。

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預計資金運用進度
			113 年度
			第一季
充實營運資金	113 年第一季	161,239	161,239

D.列示所編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表如下。

申報年度(112 年度)各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣仟元

項目＼月份	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額 1	334,482	390,562	361,585	357,810	335,543	315,643	234,518	352,717	308,074	274,992	316,742	319,654	334,482
加：非融資性收入 2													
應收帳款收現	119,366	68,669	86,055	56,024	84,249	63,064	84,206	82,973	60,774	96,354	106,291	78,000	986,025
其他應收款	10	10	10	8	10	879	11	13	11	11	11	600	1,584
合計	119,376	68,679	86,065	56,032	84,259	63,943	84,217	82,986	60,785	96,365	106,302	78,600	987,609
減：非融資性支出 3													
應付帳款付現	6,098	5,694	6,516	4,682	6,752	6,637	6,850	5,677	6,788	8,902	6,361	6,150	77,107
薪資付現	42,625	26,454	27,159	27,671	27,050	34,855	26,374	39,615	35,195	26,714	26,616	28,000	368,328
員工酬勞及董事酬勞	—	—	—	—	—	—	—	5,337	—	—	—	—	5,337
費用付現	22,613	24,691	19,194	22,976	22,962	25,499	26,485	21,613	23,522	25,887	28,046	24,850	288,338
稅捐	152	—	114	—	233	990	139	—	160	—	180	320	2,288
不動產、廠房及設備	62,698	27,932	17,904	7,789	30,923	61,803	78,146	16,103	1,788	30,297	3,352	20,000	358,735
合計	134,186	84,771	70,887	63,118	87,920	129,784	137,994	88,345	67,453	91,800	64,555	79,320	1,100,133
要求最低現金餘額 4	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
所需資金總額 5=3+4	414,186	364,771	350,887	343,118	367,920	409,784	417,994	368,345	347,453	371,800	344,555	359,320	1,380,133
融資前可供支用現金餘額(短絀)6=1+2-5	39,672	94,470	96,763	70,724	51,882	(30,198)	(99,259)	67,358	21,406	(443)	78,489	38,934	(58,042)
融資淨額 7													
短期借款	10,000	—	—	—	90,000	—	100,000	—	—	40,000	—	—	240,000
長期借款	85,000	—	—	—	—	—	87,000	173,996	—	10,000	18,300	—	374,296
支付股利	—	—	—	—	—	—	—	(96,990)	—	—	—	—	(96,990)
短期借款還款	(10,000)	—	—	—	(90,000)	—	—	(100,000)	—	—	(40,000)	—	(240,000)
長期借款還款	(14,110)	(12,885)	(18,953)	(15,181)	(16,239)	(15,284)	(15,024)	(16,290)	(26,414)	(12,815)	(17,135)	(17,000)	(197,330)
合計	70,890	(12,885)	(18,953)	(15,181)	(16,239)	(15,284)	171,976	(39,284)	(26,414)	37,185	(38,835)	(17,000)	79,976
期末現金餘額 8=1+2-3+7	390,562	361,585	357,810	335,543	315,643	234,518	352,717	308,074	274,992	316,742	319,654	301,934	301,934

未來一年度(113 年度)各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣仟元

項目＼月份	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額 1	301,934	351,247	336,365	472,118	475,488	423,702	406,244	408,358	436,272	455,386	470,400	490,614	301,934
加：非融資性收入 2													
應收帳款收現	96,564	84,069	95,000	90,536	80,000	91,842	90,000	95,000	89,000	92,000	108,000	88,000	1,100,011
其他應收款	14	14	14	14	14	700	14	14	14	14	14	700	1,540
合計	96,578	84,083	95,014	90,550	80,014	92,542	90,014	95,014	89,014	92,014	108,014	88,700	1,101,551
減：非融資性支出 3													
應付帳款付現	6,500	6,500	6,400	6,400	6,500	6,500	6,510	6,510	6,510	6,500	6,500	6,500	77,830
薪資付現	28,000	49,500	28,000	28,480	28,000	40,000	28,000	28,000	40,000	28,000	28,000	28,000	381,980
員工酬勞及董事酬勞	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
費用付現	25,465	26,465	25,800	25,800	26,000	26,000	26,090	26,090	26,090	26,000	26,000	26,000	311,800
稅捐	800	—	800	—	800	1,000	800	—	800	—	800	350	6,150
不動產、廠房及設備	20,000	50,000	43,000	60,000	54,000	50,000	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	477,000
合計	80,765	132,465	104,000	120,680	115,300	123,500	101,400	100,600	103,400	90,500	91,300	90,850	1,254,760
要求最低現金餘額 4	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
所需資金總額 5=3+4	360,765	412,465	384,000	400,680	395,300	403,500	381,400	380,600	383,400	370,500	371,300	370,850	1,534,760
融資前可供支用現金餘額(短絀)6=1+2-5	37,747	22,865	47,379	161,988	160,202	112,744	114,858	122,772	141,886	176,900	207,114	208,464	(131,275)
融資淨額 7													
短期借款	50,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000
長期借款	—	50,000	—	50,000	—	30,000	30,000	50,000	50,000	30,000	20,000	20,000	330,000
發行新股	—	—	161,239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,239
短期借款還款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長期借款還款	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(198,000)
合計	33,500	33,500	144,739	33,500	(16,500)	13,500	13,500	33,500	33,500	13,500	3,500	3,500	343,239
期末現金餘額 8=1+2-3+7	351,247	336,365	472,118	475,488	423,702	406,244	408,358	436,272	455,386	470,400	490,614	491,964	491,964

(2)就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率（或自有資產與風險性資產比率），說明償債或充實營運資金之原因：

A. 應收帳款及應付帳款政策

應收帳款收款政策方面，係考量客戶之信用情形、財務狀況及過往交易之經驗等因素而予以不同之授信條件，對一般客戶之平均授信條件約為月結30~90天。本公司編製之現金收支預測表係以上述授信條件作為應收帳款收現天數之估計基礎，故其編製基礎應尚屬合理。

應付帳款付款政策方面，係依據市場行情及與供應商過往交易之經驗等因素，其付款條件為月結30~90天左右，由於本公司與供應商長期往來合作並維持良好關係，故未來供貨來源尚不至有重大變動。本公司編製之現金收支預測表係以上述付款條件作為應付帳款付現天數之估計基礎，其編製基礎應尚屬合理。

綜上所述，本公司編製之112及113年度現金收支預測表中，應收帳款收現及應付帳款付現金額係依據112年1~11月實際收付款情形為基礎，並考量未來與客戶及廠商之估計交易情形而編製，尚無重大異常之情事。

B. 資本支出計畫

本公司預計112年度及113年度之資本支出金額預計分別為358,735仟元及477,000仟元，合計835,735仟元，主要係竹南廠房新建工程及購置生產相關之機器設備及汰舊換新等支出，本公司資本支出計畫之擬定，主要係依目前經營策略、產業狀況、市場需求等因素所擬定，其資金來源預計以銀行借款與自有資金支應，經評估編製基礎尚屬合理。

C. 財務槓桿及負債比率

單位：新臺幣仟元；%

項目	110 年度	111 年度	112 年第三季
財務槓桿度	1.03	1.04	0.92
負債比率(%)	45.36%	38.01%	42.67

財務槓桿係為衡量公司舉債經營之財務風險指標，評估利息費用變動對於營業利益之影響程度，財務槓桿度愈高表示利息費用占本公司營業利益比重越大，公司所承擔之財務風險愈大。本公司110年度、111年度及112年前三季之財務槓桿度分別為1.03倍、1.04倍及0.92倍，其數值維持相當且顯示其財務結構尚屬健全，預計未來隨營運規模穩定成長使營運資金之需求將隨之增加，本次現金增資用以償充實營運資金，可望降低營運風險，因此計畫經執行後對本公司之財務槓桿應無重大負面影響。

就負債比率而言，本公司110年度、111年度及112年第三季之負債比率分別為45.36%、38.01%及42.67%，預估本次現金增資用以充實營運資金

，將可降低負債比率，進一步強化財務結構並增加資金靈活調度之彈性，故從財務槓桿及負債比率之影響，評估本次計畫應有其屬必要性及合理性。

(3)增資計畫如用於償債，應說明原借款用途及其效益達成情形。若原借款係用以購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程，應就預計自購置該營建用地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，說明原借款原因，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益及其達成情形：不適用。

(4)現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益：

本公司本次募集計畫金額為161,239仟元，經檢視本公司112年度及113年度編製之現金收支預測表，本公司預計113年1月起至113年12月止之資本支出金額為477,000仟元，主要係本公司擴充竹南廠房及產能不足以支應生產需求而購置營運所需之機械設備等支出，資金來源係以自有資金及長期銀行借款等方式支應。預計效益主要為擴增本公司之生產規模，以配合經營策略與客戶需求，隨著本公司擴建廠房及購置機器設備，將可對未來本公司創造營業收入及獲利成長。故雖重大資本支出達本次募資金額百分之六十，惟尚有其必要性。

4. 購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益：不適用。

5. 購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響：不適用。

三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

四、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

肆、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)簡明資產負債表及綜合損益表

1. 簡明資產負債表

(1) 簡明資產負債表－國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣仟元

項目＼年度		最近五年度財務資料（註1）					
		107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度截至 9 月 30 日
流動資產		(註 2)	432,858	558,262	689,391	708,320	608,584
不動產、廠房及設備			1,013,803	1,075,519	1,282,471	1,381,256	1,433,407
無形資產			6,850	9,376	6,505	15,267	7,591
其他資產			94,789	90,646	41,540	72,680	39,302
資產總額			1,548,300	1,733,803	2,019,907	2,177,523	2,088,884
流動負債	分配前		524,724	596,094	574,334	433,232	282,558
	分配後		554,247	657,094	665,834	530,222	282,558
非流動負債			271,613	278,424	341,986	394,571	608,729
負債總額	分配前		796,337	874,518	916,320	827,803	891,287
	分配後		825,860	935,518	1,007,820	924,793	891,287
歸屬於母公司業主之權益			751,963	859,285	1,103,587	1,349,720	1,197,597
股本			617,480	610,000	610,000	646,600	646,600
資本公積			—	—	13,775	142,989	142,989
保留盈餘	分配前		216,049	292,379	479,812	560,131	408,008
	分配後		186,526	231,379	388,312	463,141	408,008
其他權益			—	—	—	—	—
庫藏股票			(81,566)	(43,094)	—	—	—
非控制權益			—	—	—	—	—
權益總額	分配前		751,963	859,285	1,103,587	1,349,720	1,197,597
	分配後		722,440	798,285	1,012,087	1,252,730	1,197,597

註 1：上開財務資料業經會計師查核簽證或核閱。

註 2：本公司自 108 年 1 月 1 日起採用國際財務報導準則。

(2) 簡明資產負債表－國際財務報導準則(個體)

單位：新臺幣仟元

項目＼年度		最近五年度財務資料（註1）				
		107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
流動資產		(註 2)	439,392	556,147	689,391	708,320
不動產、廠房及設備			1,013,653	1,075,429	1,282,471	1,381,256
無形資產			6,850	9,376	6,505	15,267
其他資產			94,718	90,575	41,540	72,680
資產總額			1,554,613	1,731,527	2,019,907	2,177,523
流動負債	分配前		521,655	592,817	574,334	433,232
	分配後		551,178	653,817	665,834	530,222
非流動負債			280,995	279,425	341,986	394,571
負債總額	分配前		802,650	872,242	916,320	827,803
	分配後		832,173	933,242	1,007,820	924,793
歸屬於母公司業主之權益			751,963	859,285	1,103,587	1,349,720
股本			617,480	610,000	610,000	646,600
資本公積			—	—	13,775	142,989
保留盈餘	分配前		216,049	292,379	479,812	560,131
	分配後		186,526	231,379	388,312	463,141
其他權益			—	—	—	—
庫藏股票			(81,566)	(43,094)	—	—
非控制權益				—	—	—
權益總額	分配前		751,963	859,285	1,103,587	1,349,720
	分配後		722,440	798,285	1,012,087	1,252,730

註 1：上開財務資料業經會計師查核簽證。

註 2：本公司自 108 年 1 月 1 日起採用國際財務報導準則。

(3)簡明資產負債表－我國企業會計準則(合併)： 107 年度未編製採我國會計準則之合併報表，並於 108 年度已採用國際財務報導準則編製合併財務報表，故不適用。

(4) 簡明資產負債表－我國企業會計準則(個體)

單位：新臺幣仟元

項目＼年度		最近五年度財務資料（註1）				
		107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
流動資產		493,605	(註 2)			
不動產、廠房及設備		1,028,835				
無形資產		—				
其他資產		118,996				
資產總額		1,641,436				
流動負債	分配前	515,714				
	分配後	545,763				
非流動負債		354,989				
其他負債		—				
負債總額	分配前	870,704				
	分配後	900,753				
股本		617,480				
資本公積		—				
保留盈餘	分配前	171,600				
	分配後	141,551				
其他權益		(18,348)				
庫藏股票		—				
權益總額	分配前	770,732				
	分配後	740,683				

註1：上開財務資料業經會計師查核簽證。

註2：本公司自108年1月1日起採用國際財務報導準則，故不適用。

2.簡明綜合損益表

(1) 簡明綜合損益表－國際財務報導準則(合併)

單位：除每股盈餘為新臺幣元外，餘為新臺幣仟元

年度 項目	最近五年度財務資料（註1）					
	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度截至 9 月 30 日
營業收入	(註 2)	735,748	1,022,259	1,292,379	1,226,677	620,556
營業毛利		149,034	322,271	511,784	403,308	43,260
營業損益		30,474	152,097	310,265	204,482	(80,100)
營業外收入及支出		(13,590)	(8,328)	12,252	22,727	13,514
稅前淨利		16,884	143,769	322,517	227,209	(66,586)
繼續營業單位本期淨利		7,386	114,747	259,823	168,338	(55,133)
本期淨利		7,386	114,747	259,823	168,338	(55,133)
本期其他綜合損益（稅後淨額）		(1,803)	42	(11,390)	3,481	—
本期綜合損益總額		5,583	114,789	248,433	171,819	(55,133)
淨利歸屬於母公司業主		7,386	114,747	259,823	168,338	(55,133)
淨利歸屬於非控制權益		—	—	—	—	—
綜合損益總額歸屬於母公司業主		5,583	114,789	248,433	171,819	(55,133)
綜合損益總額歸屬於非控制權益		—	—	—	—	—
每股盈餘		0.12	1.98	4.31	2.70	(0.85)

註 1：上開財務資料業經會計師查核簽證或核閱。

註 2：本公司自 108 年 1 月 1 日起採用國際財務報導準則。

(2) 簡明綜合損益表－國際財務報導準則(個體)

單位：除每股盈餘為新臺幣元外，餘為新臺幣仟元

年度 項目	最近五年度財務資料（註1）				
	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
營業收入	(註 2)	735,748	1,021,887	1,291,177	1,226,677
營業毛利		151,933	325,275	515,721	403,308
營業損益		30,793	152,384	311,810	204,482
營業外收入及支出		(13,909)	(8,615)	10,212	22,727
稅前淨利		16,884	143,769	322,022	227,209
繼續營業單位本期淨利		7,386	114,747	259,823	168,338
停業單位損失		—	—	—	—
本期淨利		7,386	114,747	259,823	168,338
本期其他綜合損益（稅後淨額）		(1,803)	42	(11,390)	3,481
本期綜合損益總額		5,583	114,789	248,433	171,819
每股盈餘		0.12	1.98	4.31	2.70

註 1：上開財務資料業經會計師查核簽證。
註 2：本公司自 108 年 1 月 1 日起採用國際財務報導準則。

(3)簡明綜合損益表-我國企業會計準則(合併)：107 年度未編製採我國企業會計準則之合併報表，並於 108 年度已採用國際財務報導準則編製合併財務報表，故不適用。

(4)簡明綜合損益表－我國企業會計準則(個體)

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	最近五年度財務資料(註 1)				
	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
營業收入	751,454	(註 2)			
營業毛利	122,636				
營業損益	43,572				
營業外收益及費損	15,010				
稅前淨利（淨損）	58,582				
繼續營業單位損益	42,177				
停業單位損益	—				
本期淨利（淨損）	42,177				
本期其他綜合損益	(17,908)				
本期綜合損益總額	24,269				

註1：上開財務資料業經會計師查核簽證。
註2：本公司自108年起採用國際財務報導準則，故不適用。

(二)影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響：

1.會計原則變動：無。

2.公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報表之影響：無。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

1. 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
107 年度	大師聯合會計師事務所	張蔚誠	無保留意見
108 年度	資誠聯合會計師事務所	李典易、劉倩瑜	無保留意見
109 年度	資誠聯合會計師事務所	李典易、劉倩瑜	無保留意見
110 年度	資誠聯合會計師事務所	李典易、劉倩瑜	無保留意見
111 年度	資誠聯合會計師事務所	李典易、白淑蒨	無保留意見

2. 最近五年度更換會計師之情事者，應列示公司、前任及繼任會計師對更換原因之說明：因本公司營運管理及公開發行計畫之需求，民國108年度由大師聯合會計師事務所張蔚誠會計師更換為資誠聯合會計師事務所李典易會計師及劉倩瑜會計師；因配合資誠會計師事務所內部組織調整，自111年度變更為李典易會計師及白淑蒨會計師。

(四)財務分析

1. 財務分析－國際財務報導準則(合併)

分析項目 \ 年度		最近五年度財務分析					
		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度截至9月30日
財務結構(%)	負債占資產比率	(註2)	51.43	50.43	45.36	38.01	42.67
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		100.96	105.78	112.71	126.28	126.02
償債能力(%)	流動比率		82.49	93.65	120.03	163.49	215.38
	速動比率		77.58	89.78	116.32	156.95	206.38
	利息保障倍數		2.19	13.75	31.69	19.97	(5.97)
經營能力	應收款項週轉率(次)		3.42	3.97	3.89	4.03	3.41
	平均收現日數		106.72	91.93	93.83	90.57	107
	存貨週轉率(次)		57.74	45.00	45.98	51.67	47.69
	應付款項週轉率(次)		35.64	33.49	29.66	33.94	36.09
	平均銷貨日數		6.32	8.11	7.93	7.06	7.65
	不動產、廠房及設備週轉率(次)		0.72	0.97	1.09	0.92	0.59
	總資產週轉率(次)		0.45	0.62	0.68	0.58	0.39
獲利能力	資產報酬率(%)		0.75	7.47	14.23	8.36	(3.13)
	權益報酬率(%)		0.93	14.24	26.47	13.72	(5.78)
	稅前純益占實收資本比率(%)		2.73	23.56	52.87	35.13	(20.60)
	純益率(%)		1.00	11.22	20.10	13.72	(8.88)
	每股盈餘(元)		0.12	1.98	4.31	2.70	(0.85)
現金流量	現金流量比率(%)		55.42	48.84	109.91	104.46	58.02
	現金流量允當比率		(註2)	(註2)	(註 2)	(註 2)	91.37
	現金再投資比率(%)		8.31	7.65	21.64	13.45	5.95
槓桿度	營運槓桿度		8.05	2.49	1.82	2.44	(1.80)
	財務槓桿度		1.58	1.06	1.03	1.04	0.92

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)

1. 流動比率增加，主係辦理現金增資，現金增加，同時因擴廠而舉借長期銀行借款所致。
2. 速動比率增加，主係辦理現金增資，現金增加所致。
3. 利息保障倍數減少，主係銷售客戶受產品組合影響，致營業毛利減少，稅後淨利減少。

4. 不動產、廠房及設備週轉率(次)減少，主因營收減少及廠房及設備增加所致。
5. 總資產週轉率(次)減少，主因營收減少及廠房及設備增加所致。
6. 資產報酬率減少，主係銷售客戶受產品組合影響，致營業毛利減少，稅後淨利減少及廠房及設備增加所致。
7. 權益報酬率減少，主係銷售客戶受產品組合影響，致營業毛利減少，稅後淨利減少所致。
8. 稅前純益占實收資本比率減少，主係銷售客戶受產品組合影響，致營業毛利減少，稅前淨利減少所致。
9. 純益率減少，主係銷售客戶受產品組合影響，致營業毛利減少，稅後淨利減少所致。
10. 每股盈餘減少，主因本期稅後淨利減少所致。
11. 現金再投資比率減少，係營收減少致營業活動現金流量減少及廠房及設備增加所致。
12. 營運槓桿度增加，主因營業利益減少所致。

註1：上述各年度財務資料業經會計師查核簽證或核閱。

註2：本公司自108年1月1日起採用國際財務報導準則，未有106及107年度財務資訊，故無法計算現金流量允當比率。

註3：上述各項財務比率之計算公式，列示如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)稅前純益占實收資本比率=稅前純益/實收資本

(4)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(5)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3)現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金）。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／（營業利益－利息費用）。

2. 財務分析－國際財務報導準則(個體)

分析項目＼年度		最近五年度財務分析				
		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
財務結構(%)	負債占資產比率	(註2)	51.63	50.37	45.36	38.01
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		101.90	105.88	112.71	126.28
償債能力(%)	流動比率		84.23	93.81	120.03	163.49
	速動比率		79.29	89.92	116.32	156.95
	利息保障倍數		2.19	13.75	31.65	19.97
經營能力	應收款項週轉率(次)		3.42	3.97	3.88	4.03
	平均收現日數		106.72	91.93	94.07	90.57
	存貨週轉率(次)		57.46	44.78	45.68	51.67
	應付款項週轉率(次)		36.56	34.00	29.67	33.94
	平均銷貨日數		6.35	8.15	7.99	7.06
	不動產、廠房及設備週轉率(次)		0.72	0.97	1.09	0.92
	總資產週轉率(次)		0.44	0.62	0.68	0.58
獲利能力	資產報酬率(%)		0.75	7.46	14.24	8.36
	權益報酬率(%)		0.93	14.24	26.47	13.72
	稅前純益占實收資本		2.73	23.56	52.79	35.13
	純益率(%)		1.00	11.22	20.12	13.72
	每股盈餘(元)		0.12	1.98	4.31	2.70
現金流量	現金流量比率(%)		55.87	48.99	110.76	104.46
	現金流量允當比率		(註2)	(註2)	(註 2)	(註 2)
	現金再投資比率(%)		8.31	7.63	22.21	13.45
槓桿度	營運槓桿度		7.97	2.49	1.82	2.44
	財務槓桿度		1.57	1.06	1.03	1.04

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)

1. 流動比率增加，主係辦理現金增資及因擴廠而舉借長期銀行借款致銀行存款增加。
2. 速動比率增加，主係辦理現金增資，現金增加所致。
3. 利息保障倍數減少，主係銷售客戶受產品組合影響，致營業毛利減少，稅後淨利減少。
4. 不動產、廠房及設備週轉率(次)減少，主因營收減少及廠房及設備增加所致。
5. 總資產週轉率(次)減少，主因營收減少及廠房及設備增加所致。
6. 資產報酬率減少，主係銷售客戶受產品組合影響，致營業毛利減少，稅後淨利減少及廠房及設備增加所致。
7. 權益報酬率減少，主係銷售客戶受產品組合影響，致營業毛利減少，稅後淨利減少所致。
8. 稅前純益占實收資本比率減少，主係銷售客戶受產品組合影響，致營業毛利減少，稅前淨利減少所致。
9. 純益率減少，主係銷售客戶受產品組合影響，致營業毛利減少，稅後淨利減少所致。

10. 每股盈餘減少，主因本期稅後淨利減少所致。
11. 現金再投資比率減少，主因營收減少以致營業活動現金流量減少及廠房及設備增加所致。
12. 營運槓桿度增加，主因營業利益減少所致。

註1：上述各年度財務資料業經會計師查核簽證。

註2：本公司自108年1月1日起採用國際財務報導準則，未有106及107年度財務資訊，故無法計算現金流量允當比率。

註3：上述各項財務比率之計算公式，列示如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)稅前純益占實收資本比率=稅前純益/實收資本

(4)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(5)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3)現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金）。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／（營業利益－利息費用）。

3.財務分析－我國企業會計準則(個體)

年度(註1) 分析項目(註2)			最近五年度財務分析財務分析				
			107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
財務結構(%)	負債占資產比率		53.04	(註 2)			
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		109.41				
償債能力(%)	流動比率		95.71				
	速動比率		88.69				
	利息保障倍數		5.75				
經營能力	應收款項週轉率(次)		3.31				
	平均收現日數		110.27				
	存貨週轉率(次)		26.95				
	應付款項週轉率(次)		33.63				
	平均銷貨日數		13.54				
	不動產、廠房及設備週轉率(次)		0.71				
	總資產週轉率(次)		0.47				
獲利能力	資產報酬率(%)		3.18				
	權益報酬率(%)		5.55				
	占實收資本比率(%)	營業利益	7.06				
		稅前純益	9.48				
	純益率(%)		5.61				
	每股盈餘(元)		0.68				
現金流量	現金流量比率(%)		38.40				
	現金流量允當比率(%)		98.74				
	現金再投資比率(%)		6.57				
槓桿度	營運槓桿度		5.78				
	財務槓桿度		1.32				
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達 20% 者可免分析） 本公司自 108 年起適用國際財務報導準則，故不適用。							

註1：上述各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註2：本公司自108年起適用國際財務報導準則，故108年至110年不適用。

註3：上述各項財務比率之計算公式，列示如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益淨額＋非流動負債）不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3)現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金）。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／（營業利益－利息費用）。

(五)會計項目重大變動說明

比較最近二年度資產負債表及綜合損益表之會計科目，金額變動達百分之十以上，且金額達當年度資產總額百分之一者，其變動原因說明列表如下：

1.國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	110 年度	111 年度	增(減)變動		說明
	金額	金額	金額	%	
現金及約當現金	251,427	334,482	80,355	33.03	主係辦理現金增資所致。
合約資產－流動	61,406	89,407	28,001	45.36	主係加工服務已完成，尚未出貨所致。
應收帳款淨額	346,290	246,026	(100,264)	(28.95)	主係營收減少所致。
其他非流動資產	29,647	59,376	29,729	100.28	主係預付設備款增加所致。
短期借款	80,000	—	(80,000)	(100.00)	主係現金增資償還借款所致。
其他應付款	257,760	226,405	(31,355)	(12.16)	主係應付薪資及獎金及酬勞減少所致。
所得稅負債	47,992	7,976	(40,016)	(83.38)	主係上年度應納稅額增加，致本期暫繳稅款增加所致。
長期借款	297,987	357,666	59,679	20.03	主係因應資本支出增加長期借款。
資本公積	13,775	142,989,	129,214	938.03	主係因現金增資溢價發行所致。
法定盈餘公積	49,980	81,523	31,543	63.11	主係淨利增加所致。
未分配盈餘	429,832	478,608	48,776	11.35	主係淨利增加所致。
營業毛利	511,784	403,308	(108,476)	(21.20)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
營業利益	310,265	204,482	(105,783)	(34.09)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
稅前淨利(淨損)	322,517	227,209	(95,308)	(29.55)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
本期淨利	259,823	168,338	(91,485)	(35.21)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
綜合損益總額歸屬於母公司業主	248,433	171,819	(76,614)	(30.84)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
綜合損益總額	248,433	171,819	(76,614)	(30.84)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
淨利歸屬於母公司業主	248,433	171,819	(76,614)	(30.84)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。

2.國際財務報導準則(個體)

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	110 年度	111 年度	增(減)變動		說明
	金額	金額	金額	%	
現金及約當現金	251,427	334,482	80,355	33.03	主係辦理現金增資所致。
合約資產－流動	61,406	89,407	28,001	45.360	主係加工服務已完成，尚未出貨所致。
應收帳款淨額	346,290	246,026	(100,264)	(28.95)	主係營收減少所致。
其他非流動資產	29,647	59,376	29,729	100.28	主係預付設備款增加所致。
短期借款	80,000	—	(80,000)	(100.00)	主係現金增資償還借款所致。
其他應付款	257,760	226,405	(31,355)	(12.16)	主係應付薪資及獎金及酬勞減少所致。
所得稅負債	47,992	7,976	(40,016)	(83.38)	主係上年度應納稅額增加，致本期暫繳稅款增加所致。
長期借款	297,987	357,666	59,679	20.03	主係因應資本支出增加長期借款。
資本公積	13,775	142,989,	129,214	938.03	主係因現金增資溢價發行所致。
法定盈餘公積	49,980	81,523	31,543	63.11	主係淨利增加所致。
未分配盈餘	429,832	478,608	48,776	11.35	主係淨利增加所致。
營業毛利	511,784	403,308	(108,476)	(21.20)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
營業利益	310,265	204,482	(105,783)	(34.09)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
稅前淨利(淨損)	322,517	227,209	(95,308)	(29.55)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
本期淨利	259,823	168,338	(91,485)	(35.21)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
綜合損益總額歸屬於母公司業主	248,433	171,819	(76,614)	(30.84)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
綜合損益總額	248,433	171,819	(76,614)	(30.84)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。
淨利歸屬於母公司業主	248,433	171,819	(76,614)	(30.84)	主係受產品組合影響，毛利率下降所致。

二、財務報告應記載事項

(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告

1. 111年度合併財務報告及會計師查核報告：請參閱附件一。

2. 112年第三季合併財務報告及會計師核閱報告：請參閱附件三。

(二)最近年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告。但不包括重要會計項目明細表：

1. 111年度個體財務報告及會計師查核報告：請參閱附件二。

(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：無。

三、財務概況其他重要事項

(一)公司及關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司公司財務狀況之影響：無。

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露之下列資訊：無。

(三)期後事項：無。

(四)其他：無。

四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一)財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：

合併財務報告

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	110 年度	111 年度	增（減）變動	
			金額	%
流動資產	689,391	708,320	18,929	2.75
無形資產	6,505	15,267	8,762	134.70
不動產、廠房及設備	1,282,471	1,381,256	98,785	7.70
其他資產	41,540	72,680	31,140	74.96
資產總額	2,019,907	2,177,523	157,616	7.80
流動負債	574,334	433,232	(141,102)	(24.57)
非流動負債	341,986	394,571	52,585	15.38
負債總額	916,320	827,803	(88,517)	(9.66)
股本	610,000	646,600	36,600	6.00
資本公積	13,775	142,989	129,214	938.03
保留盈餘	479,812	560,131	80,319	16.74
庫藏股票	—	—	—	—
非控制權益	—	—	—	—
權益合計	1,103,587	1,349,720	246,133	22.30

重大變動項目說明(變動比例達 20%以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者)：

1. 其他資產增加：主因預付設備款增加。

2. 流動負債減少：主因現金增資償還短期借款。

3. 資本公積增加：主因現金增資溢價發行所致。

以上重大變動項目對公司財務狀況及經營結果並無重大影響。

個體財務報告

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	110 年度	111 年度	增（減）變動	
			金額	%
流動資產	689,391	708,320	18,929	2.75
無形資產	6,505	15,267	8,762	134.70
不動產、廠房及設備	1,282,471	1,381,256	98,785	7.70
其他資產	41,540	72,680	31,140	74.96
資產總額	2,019,907	2,177,523	157,616	7.80
流動負債	574,334	433,232	(141,102)	(24.57)
非流動負債	341,986	394,571	52,585	15.38
負債總額	916,320	827,803	(88,517)	(9.66)
股本	610,000	646,600	36,600	6.00
資本公積	13,775	142,989	129,214	938.03
保留盈餘	479,812	560,131	80,319	16.74
庫藏股票	—	—	—	—
非控制權益	—	—	—	—
權益合計	1,103,587	1,349,720	246,133	22.30

重大變動項目說明(變動比例達 20%以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者)：

1. 其他資產增加：主因預付設備款增加。

2. 流動負債減少：主因現金增資償還短期借款。

3. 資本公積增加：主因現金增資溢價發行所致。

以上重大變動項目對公司財務狀況及經營結果並無重大影響。

(二)財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

1.經營結果分析

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	110 年度	111 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	1,292,379	1,226,677	(65,702)	(5.08)
營業成本	780,595	823,369	42,774	5.48
營業毛利	511,784	403,308	(108,476)	(21.20)
營業費用	201,519	198,826	(2,693)	(1.34)
營業利益	310,265	204,482	(105,783)	(34.09)
營業外收入及支出	12,252	22,727	10,475	85.50
稅前淨利	322,517	227,209	(95,308)	(29.55)
所得稅費用	62,694	58,871	(3,823)	(6.10)
本期淨利	259,823	168,338	(91,485)	(35.21)
重大變動項目說明(變動比例達 20%以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者)： 1. 營業毛利、營業利益、稅前淨利及本期淨利減少：係受產品組合影響，毛利率下降所致。 2. 營業外收入及支出收入增加：業外收入增加係因美元升值，產生外幣兌換利益所致。				

2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司主要依客戶之預估需求，考量產能規劃及過去經營績效為依據，訂定年度出貨目標。本公司產品應用層面廣泛，並持續開拓市場，注意市場動向，以擴大市場占有率，提升獲利，維持良好財務品質。

(三)現金流量

1. 最近年度現金流量變動之分析-合併財務報告

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	110 年度	111 年度	差異	
			金額	%
營業活動	530,559	452,597	(77,962)	(14.69)
投資活動	(293,546)	(430,602)	(137,056)	46.69
籌資活動	(127,155)	61,060	188,215	(148.02)
匯率影響數	—	—	—	—
淨現金流入(出)數	109,858	83,055	(26,803)	(24.40)
現金流量變動情形分析：（增減變動達 20%以上） (1)投資活動：提升產能擴充設備而增加資本支出，致投資活動現金流出增加。 (2)籌資活動：係本期現金增資，致籌資活動現金流入增加。				

2. 流動性不足之改善計畫:本公司全年(111年)現金流入大於流出且足夠支應營運所需，尚無流動性不足之虞。

3.未來一年(112年)現金流動性分析

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年來自投資活動淨現金流入(出)量	預計全年來自籌資活動淨現金流入(出)量	預計現金剩餘(不足)數額 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)	預計現金不足額之補救措施	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	投資計畫	理財計畫
334,482	217,458	(381,086)	99,126	269,980	—	—

分析說明：

（一）未來一年(112)現金流量變動分析：

營業活動：主係日常營運活動產生之現金流入。

投資活動：為營運需求增加設備等相關之資本支出。

籌資活動：增加銀行借款以支應營運資金之需求。

（二）預計現金不足額之補救措施及流動性分析：尚無現金不足之情事。

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司主因應訂單需求進行建廠及持續進行產線擴增，資金來源係以自有資金、銀行借款等方式支應，擴產計劃將配合客戶要求及訂單狀況彈性調整，目前申請之銀行借款額度及預計增資計劃，將足以支應後續資金需求，故資本支出對財務業務並無重大之影響。

(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：無。

(六)其他重要事項：無。

伍、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

(一)列明最近三年度會計師提出之內部控制改進建議及內部稽核發現重大缺失之改善情形：

1. 最近三年度會計師提出之內部控制改進建議：

年度	會計師建議事項	改善情形
109	無重大缺失	不適用
110	無重大缺失	不適用
111	無重大缺失	不適用

2. 最近三年度內部稽核發現重大缺失之改善情形：尚無重大缺失。

(二)內部控制聲明書：請參閱附件四。

(三)委託會計師專案審查內部控制者，列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情況：

1.委託會計師專案審查內部控制者，列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情況：

本公司為股票初次申請創新板上市，委託會計師專案審查內部控制，未有重大缺失事項，會計師審查意見請參閱附件五。

2.公司改善措施及缺失事項改善情形：無。

二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告：不適用。

三、證券承銷商評估總結意見：請參閱附件十一。

四、律師法律意見書：請參閱附件六。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：不適用。

六、前次募集與發行有價證券於申報生效（申請核准）時經金融監督管理委員會通知應自行改進事項之改進情形：無。

七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項：不適用。

八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報（請）募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形：不適用。

九、最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

十、最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書：請參閱附件八。

十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書：因本公司採競價拍賣方式辦理承銷，故係出具不受理特定對象投標聲明書，請參閱附件九。

十三、本國發行公司自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專案審查取具之報告書：請參閱附件四及附件五。

十四、發行公司之公司治理運作情形：請參閱本公開說明書「伍、三十二、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項」說明。

十五、發行公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具承諾日後有往來時必無非常規交易：請參閱附件十。

十六、發行公司於申請上市會計年度及其上一會計年度已辦理與辦理中之大量現金增資發行新股，及是否產生相當效益之評估：請參閱參、發行計劃及執行情形。

十七、發行公司是否有與其他公司共同使用申請貸款額度：無此情形。

十八、發行公司有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人：無此情形。

十九、具有上市審查準則第六條之一所規定申請之公司者，應增列事項：不適用。

二十、具有上市審查準則第十六條所規定之公司者，應增加揭露資訊：不適用。

二十一、發行公司有上市審查準則補充規定第十條或第二十六條所列各款情事者，應將該非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會：不適用。

二十二、本國發行公司為普通申請公司債上市者，應增列事項：不適用。

二十三、充分揭露發行公司與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式：請參閱附件十二。

二十四、發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於申請公司股票上市後對財務報表可能之影響：不適用。

二十五、依上市審查準則第四條第二項、第三項、或第二十八條之一第五項、第六項、或屬科技事業、文化創意事業申請股票初次上市，且委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，並保留一定比例採洽商銷售方式辦理配售者，應增列配售名單、協議認購股數、協議配售總股數、占公開銷售總股數之比例及配售股票之集保期間與賣出限制等事項：不適用。

二十六、證券承銷商應就前款配售名單合理性、配售股數、占公開銷售總股數之比例、配售股票賣出限制、繳款資力及協議事項妥適性出具評估意見：不適用。

二十七、本國發行公司或外國發行公司依第十三款規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售者，本國發行公司或外國發行人及證券承銷商應出具絕無以任何方式或名目，提供直接或間接利益予洽商銷售投資人或其指定人之聲明書。該洽商銷售投資人亦應出 具絕無要求或收取發行公司或承銷商以任何方式或名目提供之直接或間接利益之聲明書：不適用。

二十八、外國發行公司有上市審查準則第二十八條之七第一項第三款或三十四條第二項第二款情事者，應將有關股東權益保護之重要事項因與註冊地國法令之強制規定牴觸，致未能增訂於公司章程或組織文件之重大差異充分揭露：不適用。

二十九、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明：無。

三十、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見：不適用。

三十一、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項

(一)董事會運作情形

本公司董事會最近年度(111年度)及112年截至公開說明書刊印日止，董事會開會11次，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(註)	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	大日月投資有限公司 代表人：張秉堂	11	0	100	111/8/2 連任
董事	曾雄亮	6	0	85.71	112/4/6 辭任
董事	彭盈光	10	1	90.91	111/8/2 連任
董事	辰真投資有限公司 代表人：張辰	8	0	100	111/8/2 選任
董事	張蔚誠	7	0	87.50	111/8/2 選任
董事	楊式蘭	3	0	100	112/6/29 選任
獨立董事	張居興	8	0	100	111/8/2 選任

獨立董事	温萬壽	8	0	100	111/8/2 選任
獨立董事	彭俊豪	7	1	87.50	111/8/2 選任
獨立董事	譚仲民	3	0	100	112/6/29 選任
董事	辰謙投資有限公司 代表人：張辰	2	0	66.67	111/8/2 卸任
董事	林坤田	3	0	100	111/8/2 卸任
董事	王志成	3	0	100	111/8/2 卸任

其他應記載事項

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一)證券交易法第14 條之3 所列事項

本公司分別於111年8月2日及112年6月29日選任3席及1席獨立董事，組成審計委員會，不適用證券交易法第14條之3規定。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形

(一) 董事會日期：111/8/12

董事姓名：張居興先生、温萬壽先生、彭俊豪先生

議案內容：訂定本公司獨立董事報酬案。

應利益迴避之原因：本案關係人。

參與表決情形：張居興先生、温萬壽先生、彭俊豪先生因利益迴避，不得參與表決外，其餘出席董事無異議照案通過。

(二) 董事會日期：111/12/22

董事姓名：大日月投資有限公司代表人張秉堂先生、辰謙投資有限公司代表人張辰先生、曾雄亮先生、彭盈光先生、張蔚誠先生、張居興先生、温萬壽先生、彭俊豪先生。

議案內容：評估董事(含獨立董事)及經理人績效及報酬案。

應利益迴避之原因：本案關係人。

參與表決情形：經出席董事各別迴避不得參與表決外，其餘出席董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列下表董事會評鑑執行情形

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容

每年	111/1/1～ 111/12/31	董事會 董事成員 審計委員會 薪資報酬委員會	董事會內部自評 董事成員自評 審計委員會自評 薪資報酬委員會自評	董事會績效評估： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 董事成員績效評估： 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修、內部控制 審計委員會績效評估： 1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制 薪資報酬委員會績效評估： 1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任 5. 內部控制

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估

(一)審計委員會之設置

本公司依證券交易法第14條之4規定，於111年8月2日成立審計委員會替代監察人，審計委員會委員係由3席獨立董事擔任，均具備財務或業務等相關專業知識及經驗，並訂定「審計委員會組織規程」，審計委員會獨立行使職責之權能，以確實監督公司內部控制之有效實施與財務報表之編製。

(二)薪資報酬委員會之設置

本公司依證券交易法第14條之6規定，於111年8月2日成立薪資報酬委員會，薪資報酬委員會委員係由4席獨立董事擔任，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，依其職權審查相關議案並交由董事會決議，以健全監督功能及強化管理機能。

(三)提升資訊透明度

本公司財務資料、重大議事決議等資訊均已依相關法令規定公佈於公開資訊觀測站，供股東及利害關係人參考公司財務、業務資訊。

註：列示方式為實際出席次數/任職期間應出席次數。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1.審計委員會運作情形

111 年度及 112 年截至公開說明書刊印日止，審計委員會開會 8 次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(註)	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	張居興	8	0	100	召集人 111/8/2選任
獨立董事	温萬壽	8	0	100	111/8/2選任
獨立董事	彭俊豪	7	1	87.5	111/8/2選任
獨立董事	譚仲民	4	0	100	112/6/29選任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一) 證券交易法第14 條之5 所列事項

均經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，送交董事會決議通過，無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情形。

開會日期	議案內容
111年8月12日	a.簽證會計師輪調案。 b.111年第二季合併財務報告案。 c.公司管理辦法(印鑑管理辦法、資通安全管理辦法、核決權限辦法)案。 d.修訂內部控制相關辦法案。
111年12月22日	a.增修內部控制制度案。 b.112年度稽核計畫案。 c.評估簽證會計師獨立性與適任性案。 d.財務報告編製能力之自行評估案。 e.訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案。 f.修訂「檢舉制度」、「風險管理政策與程序」、「處理董事要求之標準作業程序」、「內部人申報管理作業辦法」、「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」、「董事會議事規範」、「防範內部交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」及「核決權限管理辦法」案。
112年3月15日	a.111 年度內部控制制度聲明書案。 b.111年度營業報告書及財務報表案。 c.111年度盈餘分派案。 d.修訂內部控制相關制度案。 e.修訂關係企業相互間財務業務相關作業規範更名為關係人相互間財務業務相關作業規範案。 f.修訂公司治理實務守則及企業社會責任實務守則更名為永續發展實務守則案。
112年8月11日	a.112 年第二季財務報告案。 b.修正取得及處分資產處理作業程序案。 c.申請股票創新板上市案。

112年10月18日	a.本公司 112 年 6 月 30 日「內部控制制度聲明書」案。 b.修正本公司 112 年預算案。 c.113 年第一季預算案。 d.本公司自行編製財務報告暨完成財務報告編制能力之自行評估案。 e.本公司擬與主辦承銷商簽訂「穩定承銷價格機制協議書」案。 f.修正本公司研發循環部分條文案。 g.申請創新板上市需要之公司治理評鑑自評報告案。 h.公司治理主管之委任案。 I.向台灣東京精密公司購入營業用生產設備案。
112年11月7日	a.112 年第三季財務報告案。
112年12月27日	a.本公司民國 113 年度營運計畫暨預算案。 b.本公司民國 113 年度稽核計畫案。 c.擬修正本公司內部控制相關辦法案。 d.簽證會計師獨立性及適任性評估案。 e.本公司擬辦理現金增資發行新股供初次申請創新板上市前公開承銷案。 f.討論與主辦證券承銷商簽訂委任契約案。

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)

(一) 本公司稽核主管均定期交付稽核報告予獨立董事審查，並列席各次審計委員會，且於會議中報告內部稽核業務，與獨立董事溝通情形良好。

(二) 本公司自111年8月2日成立審計委員會，簽證會計師分別於111年8月12日、111年12月22日、112年3月15日及112年11月7日出席審計委員會，並向審計委員會委員說明查核或核閱公司財務報表過程及相關法令修訂對公司帳務影響等情形，審計委員會委員得與會計師進行當面充分之溝通。

註：列示方式為實際出(列)席次數/任職期間應出(列)席次數。

2.監察人參與董事會運作情形資訊

本公司自111年8月2日設置審計委員會替代監察人職權，故不適用。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已符合「上市上櫃公司治理實務守則」之精神，如：股東會議事規範、董事會議事規範、審計委員會組 織規等。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程	√		由發言人或代理發言人處理，必要時委請法律顧問協助。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
序實施？				
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		依股務代理提供之股東名冊為掌握。	無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		不適用，本公司目前無關係企業。	無重大差異
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		本公司目前係依規定提供內部人相關辦法，提醒內部人依法令規定辦理。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		公司依據公司章程設置九席董事，本公司董事會成員組成具多元化，並具備執行職務所需之知識及技能。	無重大差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		√	本公司已完成設置審計委員會及薪資報酬委員會，未來將視實際需要及法令規定，設置其他功能性委員會。	無重大差異
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		本公司已訂定董事會績效評估 辦法及其評估方式，並執行績效評估結果，以及個別董事薪資報酬提報董事會。	無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		本公司截至目前有定期進行簽證會計師獨立性之評估，本公司於委任資誠聯合會計師事務所李典易、白淑蒨會計師為簽證會計師時，業已評估其獨立性（非本公司股東、 經理人或董事），故與本公司非為關係人，因之其獨立性應屬無疑。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		本公司有專責人員負責公司治理相關事務，並已設置公司治理主管，其具備公開發行公司從事法令遵循等管理工作經驗達三年以上之資歷，主要職責為提供董事及獨立董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、協助董事遵循法令，定期檢視及修訂公司治理守則及相關辦法，落實公司治理事務之推行。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		本公司設有發言人及代理發言人，相關連繫資訊均依規定公告於公開資訊觀測站，同時在公開資訊觀測站公告財務及股務相關資訊，以建立與投資人良好之溝通管道。本公司設有客服專線，以利暢通與消　費者或其他往來對象溝通管道。本公司設有駐廠醫師臨場關懷同仁狀況。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司的股務代辦係委託華南永昌綜合證券股務代理部辦理。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		本公司網址：www.msec.com.tw，並指定專責單位負責公司財務業務及公司治理資訊之蒐集及揭露。	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	√		本公司定期不定期於公開資訊觀測站及本公司網站揭露相關資訊。同時已設置發言人及代理發言人，落實發言人制度。	無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		目前公司屬於興櫃公司，依規定公告第二、四季財務報告與各月份營運情形。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	√		（一）員工權益：本公司已成立職工福利委員會及勞資委員會，並訂有相關規定，保障員工權益 。 （二）僱員關懷：本公司一向重視員工身心健康及學習發展，除定期健康檢查及員工旅遊等福利外，並辦理員工教育訓練。 （三）投資人關及利害關係人之權利：本公司依法令規定落實公司資訊公開，以保障投資人及利害關係人之權益，並善盡企業對股東之責任。 （四）供應商關係：本公司與供應商保持暢通之溝通管道，並保障其應有之合法權益。 （五）董事及監察人進修之情形：本公司董事及獨立董事將依法令規定進修證券法規等課程 （六）風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司除相關單位定期評估營運風險及因應措 施外，並建立各項標準作業執行規範，以降低可能之風險。 （七）客戶政策之執行情形：本公司已建立客訴處理機制，由專責單位針對客戶抱怨事件妥善判別問題並釐清責任歸屬，以保障顧客之權益。 （八）公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已對董事及獨立董事購買責任保險。	無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)	本公司尚未列入受評之公司，故不適用。			

(四)公司如有設置薪酬委員會或提名委員會，應揭露其組成及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身份別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事	張居興	請參閱第 17 頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊所具專業知識及獨立性情形	1. 非為公司或關係企業之受僱人或董事 2. 非為本人、配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 3. 未有與其他董事兼具有配偶或二親等以內親屬關係。 4. 未有證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。 5. 未有公司法 27 條規定以政府、法人或其他代表人當選之情事。	0	召集人
獨立董事	溫萬壽			1	
獨立董事	彭俊豪			0	
獨立董事	譚仲民			0	

2.薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期

本公司自111年8月2日設置薪酬委員會，本屆任期自111年8月2日起至同委任之董事會任期截止日。111年度及112年截至公開說明書刊印日止，薪資報酬委員會共開會5次，委員出席情形如下：

職　稱	姓　名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備　註
召集人	張居興	5	0	100	
委　員	温萬壽	5	0	100	
委　員	彭俊豪	4	1	80	
委　員	譚仲民	1	0	100	112.8.11 選任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(3)提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司未設立提名委員會，故不適用。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		√	本公司目前尚未於董事會核准「永續發展之治理架構」，惟公司已開始著手設立ESG 永續經營委員會，並將分成治理、客戶關懷、員工照護、環境永續及社會公益五個小組，並將制定公司永續策略藍圖，推動企業ESG 永續事務。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√		本公司為實現環境永續的承諾，導入環境相關之管理制度與認證，取得環境管理系統 ISO 14001 認證;並制定營運計畫與營運風險管理程序。	無重大差異
三、環境議題				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		本公司關心氣候及環保議題，為實現環境永續的承諾，導入環境相關之管理制度與認證，取得環境管理系統 ISO 14001 認證。	無重大差異
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		為達到循環再生與資源回收再利用，本公司積極致力於包材回收，產品於入庫後，將收貨之紙箱與箱內填充材料全部回收，以便出貨時優先再使用，減少新包裝材料之資源浪費，並透過優化採購管理流程提升回收率，與客戶協定包材回收再使用方案，結合上下游供應鏈之力量達到共同減廢目標。	無重大差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	√		本公司對於溫室氣體排放及氣候變遷議題的關注，積極響應全球減碳趨勢，將溫室氣體盤查納入營運管理中的重要推動事項，開始逐步推動自主性的溫室氣體盤查，藉以掌握溫室氣體排放源。	無重大差異
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		本公司設定四大環境目標「節能減碳」、「符合環保法規要求」、「減廢」、「風險管制」，規劃相對應地環境管理方案，進而達到節能、減碳、減廢及化學品管控之成效。	無重大差異
四、社會議題				
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√		本公司遵守勞基法等勞動法規，並制定各項管理辦法，保障員工權益。	無重大差異
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√		本公司在福利設計上注重員工的健康及福祉，除依法提供正式員工休假、勞工保險及全民健康保險外，也提供績效獎金、三節獎金、久任續聘獎、生日禮金及育嬰假相關福利。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√		本公司承諾提供員工一個健康友善的工作環境，以職安法為基礎，同時維護承攬商及訪客安全，提供各項安全保護措施，全面性實施危害及風險評估，做好預防改善措施，防止職業災害發生，保障所有工作者安心又舒適。	無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		本公司每年提供員工定期教育訓練，及內/外專業技能課程安排，以有效充實員工職涯技能。	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		本公司通過ISO 9001:2015品質證書，秉持著客戶至上的理念為基礎，建立國際規範、資訊透明化的核心價值經營公司，發展企業永續經營策略並達成目標	無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		本公司訂定「環境有害物質管理程序」與合格供應商簽訂HSF有害物質保證書，用以要求供應商減少或限制使用會對環境產生危害的物質，並遵守歐盟ROHS、REACH法規。	無重大差異
五、 公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		√	本公司尚未編制「永續報告書」等揭露公司非財務資訊之報告書。	本公司上市掛牌後，將依公司需要或法令規定辦理。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 本公司業已制訂「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂公司董事及受僱人均應秉持高度誠信從事公司業務等活動，不得藉由職務之便及使用公司資產謀取個人私益，與公司競爭，抑或損及公司與客戶之權益。此外，為向公司同仁宣導本公司誠信經營理念，相關規範之制訂修訂均適當於公司內部發布宣導，並將規範內容公開於公司內部網路，隨時供查閱。				

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		(一)本公司訂有「誠信經營守則作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，明示誠信經營之政策、作法，建立良善之經營管理及風險控管之機制。董事會成員與管理階層亦承諾積極落實及監督誠信經營政策之執行。	無重大差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√		(二)本公司訂有「誠信經營守則作業程序及行為指南」，規範相關作業程序，並具以實行。 本公司明訂相關獎懲規定，舉凡本公司經理人、受僱人或具有職權內 控制能力者，嚴禁直接或間接收受任何不正當利益，或做出其 他違反誠信、不法、違背受託義務之行為，以防範營私舞弊、 挪用公款、收受賄賂、洩密、圖利他人、謊報等不誠信行為。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		(三)本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。另「誠信經營守則作業程序及行為指南」，明訂與他人建立商業關係前，應先行評估往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。	無重大差異
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√		(一) 本公司依「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。	無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？		√	(二) 本公司尚未設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位。	無重大差異
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√		(三)本公司設有總經理室，可提供檢舉人檢舉的陳述管道並對檢舉人身份及內容應保密，並確實執行。	無重大差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防	√		(四)為落實誠信經營，本公司已建立完整且有效之會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，並委託會計師執行查核。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		(五)本公司已將「誠信經營守則」及「道德行為準則」等相關規章揭露於公開資訊網站，供利害關係人隨時查閱，已宣導本公司誠信經營之理念與原則。 本年度已於112年8月11日及112年10月18日對現任董事、獨立董事、經理人進行相關教育宣導，課程內容包括公司治理與證券法規、董事受託義務與商業判斷準則及企業併購的法律實務及董監法律責任。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		(一) 本公司於「誠信經營守則作業程序及行為指南」已訂定具體檢舉獎勵制度及專責人員，公司網站亦公佈申訴管道，如有發現本公司人員違反誠信行為者，可逕行檢舉。本年度未發生內外部重大檢舉之情事。	無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		(二) 本公司已訂定檢舉制度，由專責人員依規定程序處理，書面聲明對檢舉人身分及檢舉內容予以保密。若經查屬實，立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，必要時透過法律程序請求損害賠償。並將依公司相關規定辦理懲戒。本年度無此情事發生。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√		(三) 保密原則：案件承辦人調查期間及調查結束後，均嚴禁向無關者透露案情及檢舉人姓名，各級核簽主管亦須確實保密，相關 資料依機密文件方式處理及存檔，保護檢舉人不因檢舉遭受不當困擾或報復。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	√		本公司網站已揭露「誠信經營守則作業程序及行為指南」未來將逐步充實誠信經營相關推動成效。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有「誠信經營守則作業程序及行為指南」並遵循之，截至目前為止尚無差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司每年安排董事參與公司治理課程，增益其治理及監理公司各項業務之能力，期提昇公司治理成效及誠信經營之落實。				

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式

本公司已訂定「公司治理實務守則」，以落實公司治理之運作及推動，已公告於公開資訊觀測站。

(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總

無此情形。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之之重要情形：

董事進修情形如下表：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	大日月投資有限公司代表人：張秉堂	111/08/02	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		111/08/12	社團法人中華公司治理協會	公司的法令遵循與董事的監督義務	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3
		112/10/18	社團法人中華公司治理協會	企業併購的法律實務及董監法律責任	3
董	辰真投資有限	111/08/02	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
事	公司代表人：張　　辰	111/08/12	社團法人中華公司治理協會	公司的法令遵循與董事的監督義務	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3
		112/10/18	社團法人中華公司治理協會	企業併購的法律實務及董監法律責任	3
董事	曾雄亮（註）	111/08/02	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		111/08/12	社團法人中華公司治理協會	公司的法令遵循與董事的監督義務	3
董事	楊　式　蘭	112/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3
		112/10/18	社團法人中華公司治理協會	企業併購的法律實務及董監法律責任	3
董事	彭　盈　光	111/08/02	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		111/08/12	社團法人中華公司治理協會	公司的法令遵循與董事的監督義務	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3
		112/10/18	社團法人中華公司治理協會	企業併購的法律實務及董監法律責任	3
董事	張　蔚　誠	111/08/02	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		111/08/12	社團法人中華公司治理協會	公司的法令遵循與董事的監督義務	3
		111/09/21	中華民國會計師公會全國聯合會	邁向淨零排放的碳管理趨勢與因應之道	3
		111/10/06	中華民國會計師公會全國聯合會	審計準則公報第 75 號解析-辨認並評估重大不實表達風險（上）	3
		111/10/07	中華民國會計師公會全國聯合會	審計準則公報第 75 號解析-辨認並評估重大不實表達風險（下）	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3
		112/10/18	社團法人中華公司治理協會	企業併購的法律實務及董監法律責任	3
獨立董事	張　居　興	111/08/02	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		111/08/12	社團法人中華公司治理協會	公司的法令遵循與董事的監督義務	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3
		112/10/18	社團法人中華公司治理協會	企業併購的法律實務及董監法律責任	3
獨立董事	溫　萬　壽	111/6/10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3
		111/07/07	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	3
		111/08/02	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		111/08/12	社團法人中華公司治理協會	公司的法令遵循與董事的監督義務	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3
		112/10/18	社團法人中華公司治理協會	企業併購的法律實務及董監法律責任	3
獨立	彭　俊　豪	111/07/14	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢及打擊資恐之最新趨勢(含內線交易防制宣導)	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事		111/08/02	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		111/08/11	中華民國證券商業同業公會	強化金融產業之資安韌性與金融業風險管理趨勢實務	3
		111/08/12	社團法人中華公司治理協會	公司的法令遵循與董事的監督義務	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3
		112/10/18	社團法人中華公司治理協會	企業併購的法律實務及董監法律責任	3
獨立董事	譚仲民	111/7/14	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢及打擊資恐之最新趨勢(含內線交易防制宣導)	3
		111/08/02	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		111/8/11	中華民國證券商業同業公會	強化金融產業之資安韌性與金融業風險管理趨勢實務	3
		111/08/12	社團法人中華公司治理協會	公司的法令遵循與董事的監督義務	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		112/08/11	社團法人中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3
		112/10/18	社團法人中華公司治理協會	企業併購的法律實務及董監法律責任	3

註：112 年 4 月 6 日辭任。

三十二、其他必要補充說明事項：

依臺灣證券交易所股份有限公司 112 年 12 月 29 日臺證上二字第 1121705168 號函，應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項：

（一）最近二年度與截至最近期業績變化之合理性。

【公司說明】

本公司於2021~2022年度及2023年前三季之業績變化原因之合理性說明如下：

單位：新臺幣千元；%

項目＼年度	2021年度		2022年度		2022年前三季		2023年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,292,379	100.00	1,226,677	100.00	982,732	100.00	620,556	100.00
營業成本	780,595	60.40	823,369	67.12	639,125	65.04	577,296	93.03
營業毛利	511,784	39.60	403,308	32.88	343,607	34.96	43,260	6.97
營業費用	201,519	15.59	198,826	16.21	157,793	16.06	123,360	19.88
營業淨利	310,265	24.01	204,482	16.67	185,814	18.91	(80,100)	(12.91)
營業外收入及支出	12,252	0.95	22,727	1.85	25,624	2.61	13,514	2.18
稅前淨利(淨損)	322,517	24.96	227,209	18.52	211,438	21.52	(66,586)	(10.73)
所得稅費用	(62,694)	(4.85)	(58,871)	(4.80)	(55,717)	(5.67)	11,453	1.85
本期淨利(淨損)	259,823	20.10	168,338	13.72	155,721	15.85	(55,133)	(8.88)
基本每股盈餘	4.31	—	2.70	—	2.53	—	(0.85)	—

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報表

一、依主要產品別說明營業收入、營業成本、營業毛利及毛利率變化分析

(一)營業收入

本公司2021~2022年度及2023年前三季之營業收入分別為1,292,379千元、1,226,677千元及620,556千元，較前一年同期衰退率分別為(5.08)%及(36.85)%，營業收入呈下滑情形，主要隨終端應用市場需求程度、景氣循環、市場規模及銷售客戶端營運狀況等因素影響而有所不同。2022年度營業收入較2021年度減少，係2021年度受後疫情時代影響，生活型態轉變催生消費性電子產品之需求，產生較高之基期，而2022年度驅動 IC 客戶因庫存水位較高且受終端消費性電子產品等需求趨緩，致對驅動 IC 測試服務減少，營業收入下降；2023年前三季較2022年前三季減少，主要係受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨去化庫存，致營業收入較去年同期減少36.85%。

整體而言，本公司最近二年度與最近期之營收變化情形尚屬合理。

(二)營業成本及營業毛利

本公司2021~2022年度及2023年前三季之營業成本分別為780,595千元、823,369千元及577,296千元，營業毛利分別為511,784千元、403,308千元及43,260千元，毛利率分別39.60%、32.88%及6.97%。本公司2022年度營業成本較2021年度增加42,774千元，主係2022年度增添供營運使用之機器設備，致營業成本之折舊費用較去年同期增加，2022年度營業毛利較2021年度減少108,476千元，毛利率下降幅度為16.97%，主要係2022年度受到測試產品組合之影響，部分測試毛利較高之產品因其客戶受終端消費性電子等需求趨緩，致毛利率隨之下降；本公司2023年前三季營業成本較2022年前三季減少61,829千元，主係受消費性電子產品終端需求疲弱，生產性耗料及人力成本需求減少所致，2023年前三季營業毛利較2022年前三季減少300,347千元，毛利率下降幅度為80.06%，亦受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，營業收入大幅下降，機器設備持續攤提成本，致毛利率隨之下降。整體而言，本公司最近二年度與最近期之營業成本及營業毛利變化情形尚屬合理。

(三)營業費用及營業利益

本公司2021~2022年度及2023年前三季之營業費用分別為201,519千元、198,826千元及123,360千元，2022年度營業費用較2021年度減少，主係2021年提列較高之獎金、董事酬勞及員工酬勞，而2022年度本期淨利較去年同期減少91,485千元，致管理費用之獎金、董事酬勞及員工酬勞減少所致；2023年前三季之營業費用較去年同期減少34,433千元，主要係2023年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱，主要客戶存貨尚在去化，產生稅前淨損，致推銷及管理費用之獎金、董事酬勞及員工酬勞減少所致。

本公司於2021~2022年度及2023年前三季之營業利益(損失)分別為310,265千元、204,482千元及(80,100)千元，營業利益(損失)率分別為24.01%、16.67%及(12.91)%。本公司2021年度營業利益受高毛利測試服務產品需求增加，致營業利益較高，2022年度受驅動 IC 客戶庫存水位較高且受終端應消費性電子產品等需求較2021年趨緩，測試產品組合改變，致營收下滑，機器設備持續攤提成本，營業毛利亦同步減少，而營業費用較前一年度減少，但減少1.34%低於營收及毛利下滑之幅度，致整體營業利益及營業利益率亦隨之下降；2023年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致產能利用率下降，營業毛利大幅下降，營業利益及營業利益率亦隨之下降。

(四)營業外收入及支出

本公司2021~2022年度及2023年前三季之營業外收入分別為12,252千元、22,727千元及13,514千元。2022年度較2021年度增加，主要係本公司部分客戶以美元計價，進貨主要以

新臺幣付款，受到全球通貨膨脹，美國聯準會升息，美元大幅升值，產生兌換利益所致。2023年前三季較去年同期減少，亦受美元升值影響，惟2023年前三季營業收入減少，美元收款減少，致兌換利益減少9,963千元。

(五)稅前淨利及稅後淨利

本公司2021~2022年度及2023年前三季之稅前淨利分別為322,517千元、227,209千元及(66,586)千元；本期淨利則分別為259,823千元、168,338千元及(55,133)千元，稅前淨利及本期淨利逐期遞減。2022年度主要係測試產品組合影響，較高毛利之測試服務受終端需求趨緩而減少，致營業毛利及營業利益較去年同期下降，整體稅前淨利及本期淨利亦較2022年度下降；2023年前三季主要係受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，營業收入下滑，機器設備持續攤提，產能利用率下降，致營業毛利及營業利益較去年同期減少，稅前淨利及本期淨利亦較去年同期減少。

綜上分析，本公司整體獲利情形受終端消費性電子需求變動而影響，2021年至2022年度及2023年前3季之業績變化情形尚屬合理。

二、本公司未來發展性之評估

(一)具有新產品與新製程技術的開發能力，充分支援客戶新世代產品的開發需求。

本公司自1987年成立以來，深耕半導體封測產業已超過36年，經營團隊具備封測業專業背景及豐富相關經驗，擁有優秀的研發與工程專業人才，應用卓越的工程開發能力，快速解決客戶的問題，提供最佳解決方案，協助客戶產品快速的導入與量產，降低客戶成本，並具備生產設備自行客製化的能力，以滿足客戶特殊製程需求，有助於公司整體競爭力的提升與公司的永續經營。

(二)提供客戶整合性之服務，縮短客戶產品快速進入市場之時機

本公司可同時提供晶圓測試、成品測試、探針卡製造、晶圓正面金屬鍍膜、晶圓晶背研磨及金屬鍍膜、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，並使產品可快速進入市場，成為本公司爭取客戶合作並與客戶建立長期合作夥伴關係的競爭利基。

(三)持續投入前瞻性產品之測試開發，並建構多角化的產品組合

本公司以功率元件與電源管理 IC 測試封裝為核心，隨著客戶終端產品應用之多元需求，產品線涵蓋氮化鎵(以下簡稱 GaN)、碳化矽(以下簡稱 SiC)、MOSFET、IGBT、Diode 及 MCU 等，因應半導體市場對第三代半導體 GaN 及 SiC 為基材之產品需求增加，本公司亦持續投入相關之產品測試及封裝，以維持公司長期競爭力。

(四)持續開發第三代半導體市場測試應用，跨入高規格車用市場領域

本公司分別於2014年及2019年初切入 GaN 及 SiC 晶圓測試領域，其中 GaN 與國內外多家晶圓廠與 IC 設計公司都有合作，已累積大量產品開發經驗與量產實績，對於 GaN 的材料特性與元件特性，可以充分掌握，並協助客戶解決問題，快速導入量產，技術能力深獲國內外大廠肯定；隨著車用市場在驅動系統中導入 SiC 技術，未來車用市場對 SiC 之功率元件需求將持續攀升，本公司藉由與 SiC 客戶長期合作，累積開發驗證與量產經驗，並已取得國際車用大廠 Continental 之認證跨入高規格車用市場領域。

【承銷商說明】

微矽電子股份有限公司（以下簡稱該公司）主要係從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC、MOSFET 產品及以 GaN 或 SiC 為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。

一、產業概況

(一)半導體及 IC 封測產業

2021年受惠全球零接觸經濟的興起，帶動個人裝置、雲端運算及資料中心需求增加，使全球半導體市場在2021年高度成長。根據工研院產科國際所統計，在2021年半導體市場全年總銷售值達5,559億美元，較2020年成長26.2%。隨著全球人工智慧、物聯網、5G、高效能運算及車用等應用需求持續成長，帶動全球半導體市場的需求。2022年全球半導體產業市場成長3.3%，達5,741億美元。2023年上半年由於烏俄戰爭引發全球通貨膨脹，終端市場需求急速下滑使得廠商營收放緩，預期2023年下半年在庫存調整接近尾聲後有望逐步復甦，整體而言，半導體市場在2023年受制於市場供過於求及價格疲軟等因素，預估2023年全球半導體市場規模為5,151億美元，較2022年衰退10.3%。2024年受惠 AI 伺服器需求及通膨趨緩影響，全球半導體市場預計將可成長11.8%，達到5,760億美元。

封裝測試為半導體產業鏈後段的核心，對最終晶片的品質與性能至關重要，依據工研院產科國際所研究報告，全球半導體封測產業2021年因疫情反覆、居家工作與學習的趨勢不輟，帶動 PC、NB、相關物聯網及終端電子產品需求，使全球半導體封測產業市場在2021年高度成長，市場規模達396億美元，較2020年成長23.2%。隨著全球人工智慧、物聯網、5G、高效能運算及車用等應用需求持續成長，半導體供應鏈持續擴張，2022年全球半導體封測產業市場規模成長7.6%，達426億美元。2023年上半年由於烏俄戰爭引發全球通貨膨脹，終端市場需求急速下滑，諸多封測廠產能利用率較低，預期2023年下半年在庫存調整接近尾聲後有望逐步復甦，預估2023年全球半導體封測產業市場規模為362億美元，較2022年衰退15.0%。展望未來，隨著半導體產業逐步回升，加上廠商於先進封裝及異質整合的佈局，將有助於2024年半導體封測產業持續成長。

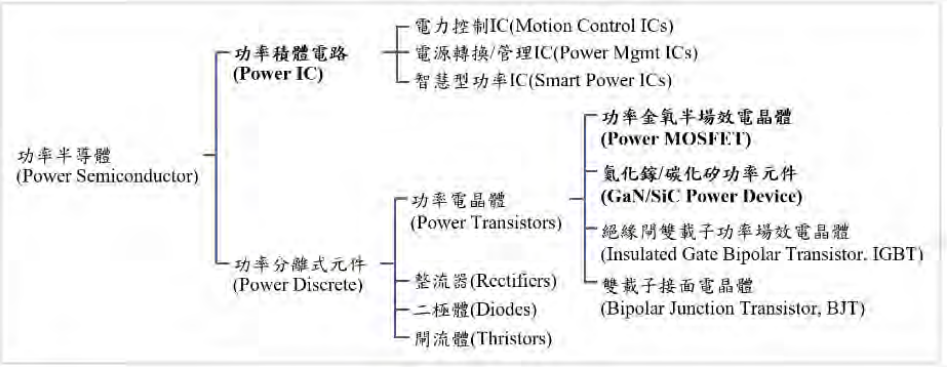
根據工研院產科國際所報告統計，2021年台灣半導體產業產值達4.08兆新台幣，較2020年成長26.7%。在全球人工智慧、高效能運算、5G、車用、物聯網等應用需求提升，加上價格提高與新建置產能逐步導入下，2022年台灣半導體產業產值達4.83兆新台幣，較2021年成長18.5%。但2023年因受通貨膨脹及終端需求減緩影響下，廠商調整庫存導致產能利用率下滑，預估2023年台灣半導體產業產值為4.56兆新台幣，較2022年衰退5.6%。

另該公司所屬半導體產業中之 IC 封測產業，依據工研院產科國際所研究報告，2021年因疫情及變種病毒持續擴散全球，遠距辦公及教學仍為多數國家的防疫方式，故消費性電子需求持續增加，致2021年台灣 IC 封測產業產值為新台幣6,384億元，較2020年成長16.28%。隨著高效能運算、5G、物聯網和車用電子等的需求暢旺，且台灣 IC 封測產業擁有全球先進封裝技術能量及多樣化產品線，在各項動能持續推升下，2022年台灣 IC 封測產業產值達新台幣6,847億元，較2021年成長7.03%。2023年受高庫存與需求下降影響，終端進行庫存及產品組合調整，預估2023年台灣 IC 封測產業產值將為新台幣5,676億元，較2022年衰退達17.10%。

(二)功率半導體產業

功率半導體係屬半導體產業之一部分，係用於電子產品之電能轉換與電路控制，是電能功率處理之核心元件，也是電源供應之重要通道。典型之功率處理包括變頻、變壓、整流、功率放大與管理，除確保設備正常運行外，還能有效節能。市場研究調查機構 BusinessWire 將功率半導體(Power Semiconductor)分為功率積體電路(Power IC)及功率分離式元件(Power Discrete)等兩大類，各占功率半導體產業市值五成。

圖一：功率半導體產品分類



資料來源:兆豐證券整理

在功率半導體領域中(詳圖一)，該公司主要係提供電源管理 IC、MOSFET 及 GaN/SiC 之第三代半導體產品之測試封裝服務，茲就電源管理 IC、MOSFET 及第三代半導體之產業現況敘述如下：

1. 電源管理 IC

電源管理 IC 是一種特定用途的集成電路，係將傳統分立於各類功能的電源管理器件整合在單顆 IC 內，藉此提高空間利用率和系統電源效率，並在有限的體積內集成更多的電源通道，提供所需的正確供電電流及電壓，並藉由控制功率元件，使電流符合終端不同階段之需求，以達到對應用產品高效率和高整合度，成為系統供電的首選。

電源管理 IC 在所有電子產品中扮演著不可或缺的關鍵性角色，其主要作為在不同的系統運作狀態下，隨時控制並保持系統內適當電流與電壓正常供給，而電源管理 IC 的優劣，將會直接影響電子產品的使用壽命。電源管理 IC 應用廣泛，舉凡工業控制、通訊產業、汽車工業、消費性電子產品、可攜式產品及電腦工業產品上皆可見其應用，而伴隨著各式電子產品高效能與低功耗之需求，加上全球 ESG 風潮興起，各國在低碳排放的共識下，以致電源管理 IC 發展更顯重要。依據市場調查機構 IC Insights 預估，全球電源管理 IC 規模從2022年至2028年的複合成長率約為7.9%。

2. MOSFET

功率元件中之功率電晶體係包含 MOSFET、GaN/SiC 功率元件(GaN/SiC Power Device)、絕緣閘雙載子功率場效電晶體(IGBT)及雙載子接面電晶體(BJT)等，MOSFET 係用於電子裝置的電能轉換與電路控制，也是弱電控制與強電運行間之橋樑，具有驅動電路較簡單、損耗低、熱阻特性佳以及頻率較高等優勢，在電子產品中被廣泛應用，成為最大宗產品，除確保設備正常運行外，還能有節能效果，為電能處理之核心器件，其應用範圍涵蓋消費性電子、家電、工業產品、通訊設備、再生能源及國防軍事等。

鑒於 MOSFET 之產品周期較長、穩定性高等特點，產品設計更著重於分析材料之物

理化學性質及製程，並進行參數調整和性能改良，以製作出符合客戶需求之客製化產品，故 MOSFET 之核心技術除結構設計外，在初期材料選擇、晶圓製程及後段測試封裝等部分皆舉足輕重，MOSFET 市場成熟且穩健，在技術水平與生產良率持續提升下，以及元件整合，使產品應用領域將逐漸拓展。隨著全球節能減碳趨勢盛行及電動車市場成長，將帶動功率元件需求增加，依據工研院產科國際所研究報告預估，全球功率元件市場規模從2022年至2025年的複合成長率約為5%。

3. 第三代半導體

第三代半導體係指功率元件之材料特性使用 GaN 與 SiC 的寬能隙(Wide Band Gap, WBG)材料製造的化合物半導體，可適用在與第一代及第二代半導體之不同領域，故並不是取代傳統半導體材料 Si(矽)及砷化鎵(GaAs)，而是因應新市場需求而發展，相較於第一代半導體材料的 Si 與第二代半導體材料的 GaAs，第三代半導體材料具有寬能隙、高熱導率、高擊穿電場及高電子遷移率等特性，可大幅提升效率、減少耗電量及縮小體積等優勢，一般而言，GaN 適用於中低功率、高頻率產品，SiC 適用於高壓高功率產品，隨著電動車、新能源、5G 及低軌衛星等市場趨勢下，未來第三代半導體已成不可或缺的重要元件。另就第三代半導體使用之 GaN 及 SiC 功率元件之產業現況分述如下：

(1)GaN

GaN 為高頻應用的主流元件，開關速度快且體積小，可以有效縮小產品尺寸，主要應用於消費性電子產品快充、5G 基地台及低軌衛星等，依據市場研究機構 TrendForce 集邦統計，隨著知名手機大廠首次採用 GaN 技術的快速充電器，將加速第三代半導體於消費市場應用的滲透率，致2022年 GaN 功率元件市場規模達1.8億美元。受惠於5G 通訊及資料中心高效能運算的推動下，從2022年至2026年的複合成長率約為65%，2026年 GaN 功率元件市場規模將達13.32億美元。

(2)SiC

SiC 為高壓高功率應用的主流元件，導熱性及耐壓性佳，可以減少電能的轉換損耗，主要應用於電動車、太陽能發電、儲能設備及充電樁等，依據 TrendForce 集邦統計，隨著碳排標準的提高，更多車廠於驅動系統中導入 SiC 技術，致2022年 SiC 功率元件市場規模達16.09億美元。受惠於新能源及電動車持續需求下，從2022年至2026年的複合成長率約為35%，2026年 SiC 功率元件市場規模將達53.28億美元。

(三)晶圓薄化產業

半導體晶圓薄化為功率元件不可或缺的重要製程，主係為晶圓進行正面金屬鍍膜(Front Side Metallization,以下簡稱 FSM)、晶圓背面研磨與金屬鍍膜(Backside Grinding and Backside Metallization, 以下簡稱 BGBM)，目前傳統晶圓厚度為700-800um，而晶圓薄化技術可使其厚度減少到甚至50um，能夠幫助降低電流通過之阻值，減少功率損耗，除了有效減少後續封裝體積外，並能減少熱能累積效應，滿足元件薄型化、高性能、節能之需求，故晶圓代工廠完成之產品需再進行晶圓薄化相關製程後，才能進行後段封裝測試處理。

半導體晶圓薄化技術的主要應用領域為消費性電子、家電、工業產品、通訊設備、再生能源及國防軍事等，受全球節能減碳趨勢盛行、電動車市場成長及物聯網、5G 等新興行業的快速發展影響下，晶圓薄化應用領域將更加廣泛。依據工研院產科國際所研究報告預估，全球功率元件市場規模從2022年至2025年的複合成長率約為5%，故預估晶圓薄化的市場規模將日益增加。

二、最近二年度及申請年度截至最近期業績變化原因及其合理性分析

(一)主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形

該公司主要營收來源區分為半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化服務。茲就該公司最近二個會計年度及最近期止主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形及原因分析說明：

營業收入變化情形：

單位：新台幣千元

年度 產品	2021年度		2022年度		2022年前三季		2023年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	1,005,426	77.80	926,313	75.51	736,002	74.89	447,669	72.14
半導體封裝	140,438	10.87	109,502	8.93	99,633	10.14	62,809	10.12
晶圓薄化	145,312	11.24	190,862	15.56	147,097	14.97	110,078	17.74
其他	1,203	0.09	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合計	1,292,379	100.00	1,226,677	100.00	982,732	100.00	620,556	100.00

資料來源：該公司提供

營業成本變化情形：

單位：新台幣千元

年度 產品	2021年度		2022年度		2022年前三季		2023年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	549,905	70.45	583,078	70.82	453,591	70.97	399,913	69.27
半導體封裝	111,953	14.34	98,581	11.97	77,015	12.05	69,951	12.12
晶圓薄化	113,598	14.55	141,710	17.21	108,519	16.98	107,431	18.61
其他	5,139	0.66	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合計	780,595	100.00	823,369	100.00	639,125	100.00	577,295	100.00

資料來源：該公司提供

營業毛利變化情形：

單位：新台幣千元

年度 產品	2021年度		2022年度		2022年前三季		2023年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	455,521	89.00	343,235	85.10	282,411	82.19	47,756	110.39
半導體封裝	28,485	5.57	10,921	2.71	22,618	6.58	(7,142)	(16.51)
晶圓薄化	31,714	6.20	49,152	12.19	38,578	11.23	2,647	6.12
其他	(3,936)	(0.77)	-	-	-	-	-	-
合計	511,784	100.00	403,308	100.00	343,607	100.00	43,261	100.00

資料來源：該公司提供

1. 半導體測試

該公司最近二個會計年度及2023年前三季半導體測試之營業收入分別為1,005,426千元、926,313千元及447,669千元，占營業收入比重分別為77.80%、75.51%及72.14%；為該公司營收占比最高之服務。半導體測試服務可區分為晶圓測試及成品測試，晶圓測試過程係透過探針與晶粒上的接點接觸，測試其電氣特性是否達設計規範要求，將不合格的晶粒標上記號，而後當晶片依晶粒為單位切割成獨立的晶粒時，標有記號的不合格晶粒會被淘汰，不再進行下一個製程，降低製造成本。成品測試過程係將切割封裝後的積體電路，透

過測試機台檢測其功能及性能是否達設計規範要求，是積體電路產製過程中重要一環，該公司檢測設備可提供類比 IC、邏輯 IC、驅動 IC 及功率元件之測試服務。2022年度主要受驅動 IC 客戶高庫存影響，致驅動 IC 測試服務需求下降，半導體測試服務需求減少，故使營收降至926,313千元，佔整體銷售金額之比重為75.51%；2023年前三季受消費性電子產品終端需求疲乏且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體測試服務減少至447,669千元，佔整體銷售金額之比重為72.14%。

在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及2023年前三季之營業成本分別為549,905千元、583,078千元及399,913千元，營業毛利分別為455,521千元、343,235千元及47,756千元，毛利率分別為45.31%、37.05%及10.67%。2022年度主要受客戶測試產品組合影響，較高毛利之驅動 IC 測試服務需求下降，使營業收入下滑，致毛利率下降至37.05%；2023年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體測試服務減少，營業收入大幅下滑，毛利隨之下滑，致毛利率下降至10.67%。

2. 半導體封裝

該公司最近二個會計年度及2023年前三季半導體封裝之營業收入分別為140,438千元、109,502千元及62,809千元，占整體營業收入比重分別為10.87%、8.93%及10.12%。半導體封裝過程係保護和固定晶粒不受粉塵、水分或外力撞擊的影響，讓積體電路能在各種環境中使用。2022年度主要受驅動 IC 客戶高庫存影響，致驅動 IC 封裝服務需求下降，半導體封裝服務減少，故使營業收入降至109,502千元，佔整體銷售金額之比重為8.93%；2023年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體封裝服務減少，故使營業收入降至62,809千元，佔整體銷售金額之比重為10.12%。

在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及2023年前三季之營業成本分別為111,953千元、98,581千元及69,951千元，營業毛利分別為28,485千元、10,921千元及(7,142)千元，毛利率分別為20.28%、9.97%及(11.37)%。2022年度主要受驅動 IC 客戶高庫存影響，致驅動 IC 封裝服務需求下降，致半導體封裝服務減少，營業收入下滑，致毛利率下降至9.97%；2023年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體封裝服務減少，營業收入下滑，毛利隨之下滑，未達規模經濟，致毛利率下降至(11.37)%。

3. 晶圓薄化

該公司最近二個會計年度及2023年前三季晶圓薄化之營業收入分別為145,312千元、190,862千元及110,078千元，占整體營業收入比重分別為11.24%、15.56%及17.74%。晶圓薄化過程係縮小積體電路體積，達到降低電阻及節能散熱之需求，2022年度該公司晶圓薄化服務通過銷售客戶品質肯定及拓展新客戶，致營業收入成長至190,862千元，佔整體銷售金額之比重為15.56%；2023年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致晶圓薄化服務減少，營業收入降至110,078千元，佔整體銷售金額之比重為17.74%。

在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及2023年前三季之營業成本分別為113,598千元、141,710千元及107,431千元，營業毛利分別為31,714千元、49,152千元及2,647千元，毛利率分別為21.82%、25.75%及6.12%。該公司於2018年度投入晶圓薄化業務，晶圓薄化製程係縮小積體電路體積，達到降低電阻及節能散熱之需求，製程品質受

到客戶肯定，近年陸續投產，致2021年度毛利率達21.82%；2022年度該公司持續擴展晶圓薄化產能，隨著客戶薄化需求成長，致毛利率提升至25.75%；2023年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致晶圓薄化服務減少，營業收入下滑，毛利隨之下滑，未達規模經濟，致毛利率下降至6.12%。

4. 其他

該公司最近二個會計年度及2023年前三季其他之營業收入分別為1,203千元、0千元及0千元，占整體營業收入比重分別為0.09%、0%及0%，在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及2023年前三季之營業成本分別為5,139千元、0千元及0千元，營業毛利分別為(3,936)千元、0千元及0千元，毛利率分別為(327.18)%、0%及0%，其他收入主要係餐飲服務收入，該公司考量未來營運規劃，於2021年12月30日處分微石開發(股)公司，故2022年度起未有其他收入。

綜上所述，該公司最近二個會計年度及2023年前三季之營業收入、營業成本及毛利，變化情形尚屬合理，並無重大異常之情事。

(二)營業費用及營業利益

單位：新臺幣千元；%

年度 項目	2021年度		2022年度		2022年前三季		2023年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
推銷費用	13,122	1.02	14,886	1.21	11,391	1.16	9,958	1.60
管理費用	123,183	9.53	105,645	8.61	91,012	9.26	63,223	10.19
研發費用	64,391	4.98	69,578	5.67	49,431	5.03	48,660	7.84
預期信用減損損失	823	0.06	8,717	0.71	5,959	0.61	1,519	0.24
營業費用	201,519	15.59	198,826	16.21	157,793	16.06	123,360	19.88
營業淨利(損失)	310,265	24.01	204,482	16.67	185,814	18.91	(80,100)	(12.91)

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報表

1. 營業費用

該公司於2021~2022年度及2023年前三季之營業費用分別為201,519千元、198,826千元及123,360千元，占各期營業收入比重分別為15.59%、16.21%及19.88%，主要包括推銷費用、管理費用及研究發展費用。

(1)推銷費用

在推銷費用方面，該公司於2021~2022年度及2023年前三季分別為13,122千元、14,886千元及9,958千元，占各期營業收入比重分別為1.02%、1.21%及1.60%，主要係業務單位人員之薪資支出、文具印刷、交際費及運雜費用等項目。

A. 2022年度及2021年度

2022年度推銷費用較2021年度增加1,764千元，增幅為13.44%，主要係調薪及疫情解封影響致薪資相關費用增加536千元及交際費增加780千元，另購置棚架及監視設備等致雜項購置增加470千元。

B. 2023年前三季及2022年前三季

2023年前三季推銷費用較2022年前三季減少1,433千元，減幅為12.58%，主要原因為2023年前三季公司受終端消費性電子產業疲弱影響，營業收入下滑致文具印刷減少1,218千元、年終獎金減少207千元及交際費減少220千元。

(2)管理費用

在管理費用方面，該公司於2021~2022年度及2023年前三季分別為123,183千元、105,645千元及63,223千元，占各期營業收入比重分別為9.53%、8.61%及10.19%，主要係管理單位人員之薪資支出、獎金、交際費、折舊費用、各項攤提、保全費、勞務費、董事酬勞及員工酬勞等項目。

A. 2022年度及2021年度

2022年度管理費用較2021年度減少17,538千元，減幅為14.24%，主要原因係本期淨利較去年同期減少91,485千元，致獎金費用減少13,666千元、董事酬勞及員工酬勞減少7,295千元所致。

B. 2023年前三季及2022年前三季

2023年前三季管理費用較2022年前二季減少27,789千元，減幅30.53%，主要原因為2023年前三季受終端消費性電子產業疲弱影響，營業收入下滑，致獎金減少11,569千元，另因稅前淨損董事酬勞與員工酬勞減少20,913千元。

(3)研究發展費用

在研究發展費用方面，該公司於2021年度、2022年度及2023年前三季分別為64,391千元、69,578千元及48,660千元，占各期營業收入比重分別為4.98%、5.67%及7.84%。研發費用主要係研發單位人員之薪資支出、獎金及折舊等項目。

A. 2022年度及2021年度

2022年度研發費用較2021年度增加5,187千元，增幅為8.06%，主要購置研發設備致折舊費用增加2,965千元所致。

B. 2023年前三季及2022年前三季

2023年前三季研發費用較2022年前三季減少771千元，減幅為1.56%，主係因2023年前三季受終端消費性電子產業疲弱影響，營業收入下滑，獎金減少1,308千元所致。

(4)預期信用減損損失

A. 2022年度及2021年度

該公司於2021年度預期信用減損損失823千元，2022年度認列合約資產預期信用減損損失8,717千元。

B. 2023年前三季及2022年前三季

該公司於2022年前三季預期信用減損損失5,959千元，2023年前三季認列合約資產預期信用減損損失1,519千元。

2. 營業利益

該公司於2021~2022年度及2023年前三季之營業利益(損失)分別為310,265千元、204,482千元及(80,100)千元，營業利益(損失)率分別為24.01%、16.67%及(12.91)%。該公司2022年度受係驅動IC客戶庫存水位較高且受終端應消費性電子產品等需求趨緩，致營收下滑及毛利減少，營業利益亦隨之下降；2023年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致產能利用率下降，營業毛利大幅下降，營業利益及營業利益率亦隨之下降。

綜上所述，該公司2021~2022年度及2023年前三季之營業費用及營業利益之變化情形，尚屬合理。

(三)營業外收支變化原因及其合理性分析

單位：新臺幣千元

年　　度		2021年度	2022年度	2022年前三季	2023年前三季
利息收入		109	738	191	965
其他收入		10,242	18,038	15,506	10,535
其他利益及損失	淨外幣兌換利益	3,921	14,902	18,623	8,660
	處分不動產、廠房及設備利益(損失)	13,259	(1,104)	(1,104)	-
	其他	(6,084)	(239)	(211)	(503)
	合計	11,096	13,559	17,308	8,157
財務成本	利息費用	(9,195)	(9,608)	(7,381)	(6,143)
合計		12,252	22,727	25,624	13,514

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報表

1. 利息收入

該公司2021年度、2022年度、2022年前三季及2023年前三季之利息收入分別為109千元、738千元、191千元及965千元，主要係2022年第三季辦理現金增資，致2022年度及2023年前三季產生較高之利息收入。

2. 其他收入

該公司2021年度、2022年度、2022年前三季及2023年前三季之其他收入分別為10,242千元、18,038千元、15,506千元及10,535千元，主要係處分列管資產及銷售客戶探針卡、包材及其他生產性材料之收入，2023年前三季較去年同期減少，主要係2022年度處分列管資產利益7,123千元。

3. 其他利益及損失

(1) 處分不動產、廠房及設備利益

主要係該公司2021年度處分機器設備認列13,259千元之處分利益。

(2) 淨外幣兌換利益(損失)

該公司2021年度、2022年度及2023年前三季之兌換利益分別為3,921千元、14,902千元及8,660千元。該公司銷貨主要以新臺幣及美元計價收款，採購多以新臺幣及日圓計價，且外幣資產大於外幣負債，故各年度之匯兌損益仍會受美元匯率波動影響。2022年度因美國通膨持續居高不下，促使聯準會大幅升息，致美元持續升值。2022年度營業收入成長，使該年度外幣資產提高，致產生兌換利益14,902千元，2023年前三季美元持續升值，惟該公司營收下滑，兌換利益亦同步減少，2023年前三季兌換利益8,660千元。

該公司銷貨報價與收款主要係以新臺幣及美金為計價貨幣，為降低匯率變動風險，採取以下措施以減少匯率變動對營收與獲利之衝擊：

A. 財務單位隨時蒐集匯率相關資訊，並與銀行保持密切聯繫，掌握匯率走勢，積極控管外幣資產及負債之淨部位，於往來銀行開立外幣存款帳戶，因應外匯資金需求保留外幣部位，以降低匯率變動之影響。

B. 向客戶進行報價時，業務單位應將匯率變動所可能產生之影響因素一併考慮，以規避匯率變動之風險。

C. 加強匯兌市場變動趨勢之研判，以降低匯率對營運之影響。

整體而言，該公司外幣資產主要來自於外幣計價之應收帳款，財務部除積極

注意外匯市場變動，並蒐集相關訊息，以掌握匯率之變化，降低匯兌變動之風險。

(3) 其他

該公司2021年度、2022年度、2022年前三季及2023年前三季之其他損失分別為6,084千元、239千元、211千元及503千元，2021年度、2022年度及2023年前三季之其他損失主要係客訴產生之賠償款，2021年度主要係二批產品錯誤刻號，產生4,604賠償款。

4. 財務成本

該公司2021年度、2022年度、2022年前三季及2023年前三季之財務成本分別為9,195千元、9,608千元、7,381千元及6,143千元，主要係銀行借款所產生之利息費用。

(四)稅前淨利(淨損)及本期淨利(淨損)

單位：新臺幣千元

項目＼年度	2021年度		2022年度		2022年前三季		2023年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
稅前淨利(淨損)	322,517	24.96	227,209	18.52	211,438	21.52	(66,586)	(10.73)
本期淨利(淨損)	259,823	20.10	168,338	13.72	155,721	15.85	(55,133)	(8.88)
期末資本額	610,000	-	646,600	-	646,600	-	646,600	-
每股盈餘	4.31	-	2.70	-	2.53	-	(0.85)	-

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報表

該公司於2021~2022年度及2023年前三季之稅前淨利(淨損)分別為322,517千元、227,209千元及(66,586)千元；本期淨利分別為259,823千元、168,338千元及(55,133)千元，該公司之稅前淨利及本期淨利與營業毛利呈相同趨勢。2021~2022年度及2023年前三季逐期減少，2022年度主要係受測試產品組合影響，較高毛利之驅動IC測試服務需求下降，致營業毛利下降；2023年前三季主要係受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致營業收入大幅下滑，機器設備持續攤提成本，致營業毛利較去年同期下降所致。

綜上所述，該公司2021~2022年度及2023年前三季業績變化應屬合理，尚無重大異常。

三、未來成長性及發展策略

該公司係從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，銷售地區係以台灣為主，其他地區則為美洲及其他亞洲地區，銷售對象為半導體設計公司，測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理IC、MOSFET產品及以GaN或SiC為基材之第三代半導體產品。測試及封裝服務的品質仰賴測試程式及機台軟硬體之配合，暨測試機台零件使用的適當性及設備參數的調整，在在考驗測試封裝人員的經驗及管理團隊長久的默契，該公司因應市場趨勢及配合客戶產品開發，因此當客戶在特定專業測試封裝廠擁有穩定的品質時，較不容易將該產品轉換至其他專業測試封裝廠生產，測試及封裝費用雖佔IC的成本比重不高，但假若發生品質問題將導致產品的全面回收，致IC設計公司既有產品更換封測廠的意願不高，另該公司專注於電源管理IC與功率元件之測試封裝，累積多年專業的產製經驗，與客戶建立長期穩定的合作關係。2023年前三季，全球遭逢通貨膨脹壓力、美國消費者物價指數上漲及聯準會為抑制通貨膨脹採取緊縮貨幣政策而持續升息等外部因素影響下，消費者因而減少非必要性消費支

出，使終端消費疲弱，抑制銷售客戶投單動能，致前二大客戶業績減少。展望未來，該公司隨著銷售客戶庫存調整接近尾聲，加上第三代半導體高頻、高壓功率元件未來市場規模逐漸擴大，半導體產業逐步回升，將有助於2024年半導體封測產業持續成長，該公司於景氣低迷時持續投入研發、建置智能化產線並擴建未來第三代半導體之產能，迎接景氣回升時之終端需求，該公司針對改善營收獲利衰退之具體措施：

(一)藉由豐富經驗及專業能力之經營團隊，支援客戶開發新世代產品

該公司經營團隊均已於業界服務多年，對產業環境變化、產品發展趨勢、生產製造及行銷業務等各方面具嫻熟經驗，可迅速掌握市場趨勢脈動，提供最佳測試封裝服務，並協助客戶新產品快速的導入與量產，對該公司現有開發具有相當助益。

(二)經由提供客戶整合性之服務，縮短客戶產品快速進入市場之時機

該公司工程技術團隊提供客戶一貫化整合性服務，可同時提供晶圓測試、成品測試、晶圓 FSM、晶圓 BGBM、晶圓切割及晶粒挑揀等服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險，並提供客戶最佳解決方案，縮短客戶產品進入市場之時機，以與客戶建立長久合作關係。

(三)持續投入前瞻性產品之測試開發，並建構多角化的產品組合

該公司之封裝測試產品線涵蓋 GaN、SiC、MOSFET、IGBT、Diode 及 MCU 等，可提供客戶多樣性的產品封裝測試需求，此外，因應半導體市場對第三代半導體 GaN 及 SiC 為基材之產品需求增加，該公司亦具備第三代半導體相關之產品測試能力，隨著客戶產品需求之成長，應可帶動該公司之長期競爭力。

(四)強化製程管理與提升產能利用率

產能利用率之高低直接影響公司獲利，而產能利用率取決於製程良率、成本及交期，該公司在半導體封測領域深耕多年，累積多年之經驗及技術能量，致力於產品品質之提升，亦深獲客戶信賴。此外該公司亦強化管理控管生產成本，在技術與先進測試技術上持續進行精進與改良，以增加產品價格之競爭力，使產能得到充分且穩定的利用。

(五)積極開發第三代半導體市場測試應用，跨入高規格車用市場領域

該公司具有多年 GaN 及 SiC 晶圓測試領域之開發經驗，其中 GaN 亦與國內外多家晶圓廠與 IC 設計公司合作開發測試，並已累積相當的銷售實績，對於 GaN 的材料特性與元件特性，可以充分掌握，未來隨著終端產品對 GaN 的需求成長，該公司可快速導入量產，帶動未來成長契機;此外，未來隨著車用市場對 SiC 之功率元件需求提升，該公司可藉由多年與 SiC 客戶長期合作，累積開發驗證與量產經驗，並藉由取得國際車用大廠之認證，取得跨入高規格車用市場領域商機，帶動未來營收成長之另一契機。

【會計師說明】

微矽公司主要營業收入來自半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，其最近兩年度及最近期之業績變化情形說明如下：

單位：新臺幣千元；%

年度 項目	2021年度		2022年度		2022年前三季		2023年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,292,379	100.00	1,226,677	100.00	982,732	100.00	620,556	100.00
營業成本	780,595	60.40	823,369	67.12	639,125	65.04	577,296	93.03
營業毛利	511,784	39.60	403,308	32.88	343,607	34.96	43,260	6.97
營業費用	201,519	15.59	198,826	16.21	157,793	16.06	123,360	19.88

項目＼年度	2021年度		2022年度		2022年前三季		2023年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業淨利	310,265	24.01	204,482	16.67	185,814	18.91	(80,100)	(12.91)
營業外收入及支出	12,252	0.95	22,727	1.85	25,624	2.61	13,514	2.18
稅前淨利(淨損)	322,517	24.96	227,209	18.52	211,438	21.52	(66,586)	(10.73)
所得稅費用	(62,694)	(4.85)	(58,871)	(4.80)	(55,717)	(5.67)	11,453	1.85
本期淨利(淨損)	259,823	20.10	168,338	13.72	155,721	15.85	(55,133)	(8.88)

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報表

一、營業收入變化原因及合理性說明

以微矽公司主要銷售客戶分析：

單位：新臺幣千元；%

主要客戶＼年度	2021年度		主要客戶＼年度	2022年度	
	金額	%		金額	%
B 公司	177,606	13.74	B 公司	168,177	13.71
A 公司	120,280	9.31	A 公司	136,241	11.11
L 公司	91,825	7.11	C 公司	80,600	6.57
C 公司	61,102	4.73	D 公司	60,076	4.90
F 公司	56,048	4.33	E 公司	57,193	4.66
其他	785,518	60.78	其他	724,390	59.05
合計	1,292,379	100.00	合計	1,226,677	100.00

資料來源：該公司提供

因受全球半導體景氣下行影響，2022 年度營業收入較 2021 年度減少，依客戶別分析主要係 2021 年度原第三大客戶-L 公司之銷貨金額由新台幣 91,825 千元減少為 25,671 千元，主係 L 公司本身自 2022 年度之第二季起營收下滑所致，依 L 公司網站資訊，其 2022 年度之營業收入較 2021 年度營業收入減少 22.3%。

單位：新臺幣千元；%

前五大客戶＼年度	2022年前三季		前五大客戶＼年度	2023年前三季	
	金額	%		金額	%
B 公司	131,720	13.40	A 公司	103,922	16.75
A 公司	114,025	11.60	B 公司	58,239	9.38
C 公司	61,761	6.28	C 公司	34,918	5.63
D 公司	47,877	4.87	D 公司	32,567	5.25
F 公司	47,789	4.86	E 公司	29,143	4.70
其他	579,560	58.97	其他	361,767	58.30
合計	982,732	100.00	合計	620,556	100.00

資料來源：該公司提供

2023 年前三季營業收入較 2022 年前三季減少，依客戶別分析主要係 2022 前三季原第一大客戶-B 公司之銷貨金額由新台幣 131,720 千元減少為 58,239 千元，第二大客戶-A 公司之銷貨金額由新台幣 114,025 千元減少為 103,922 千元，主要原因係為此兩大客戶本身營業收入皆大幅減少，經檢視公開資訊觀測站資訊，B 公司與 A 公司之公告營業收入 2023 年前三季較 2022 年前三季分別減少 56.19%及 9.01%。

綜上所述，微矽公司最近兩年度及最近期之營業收入變化尚屬合理。

二、營業成本及營業毛利變化原因及合理性說明

微矽公司係屬資本密集產業，營業成本中之折舊費用及薪資費用係主要之固定成本，於2021年度、2022年度、2022年前三季及2023年前三季，營業成本中之折舊費用金額分別為新台幣231,474千元、261,256千元、196,009千元及191,692千元，營業成本中之薪資費用金額分別為新台幣273,708千元、253,382千元、204,616千元及196,079千元。自2022下半年全球半導體景氣下行影響，微矽公司出現產能利用率下降之情形，經檢視微矽公司提供之產能利用率資訊2021年度約為83%、2022年度約為62%且2023年前三季約為54%，產能利用率持續呈現明顯下降的趨勢，但固定成本仍需攤提，故營業毛利呈現持續下滑，致2023年前三季毛利率為6.97%，下降幅度為80.06%。

綜上所述，微矽公司最近兩年度及最近期之營業成本及營業毛利變化尚屬合理。

三、營業費用及營業損益變化其合理性說明

單位：新臺幣千元；%

年度 項目	2021年度		2022年度		2022年前三季		2023年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
推銷費用	13,122	1.02	14,886	1.21	11,391	1.16	9,958	1.60
管理費用	123,183	9.53	105,645	8.61	91,012	9.26	63,223	10.19
研發費用	64,391	4.98	69,578	5.67	49,431	5.03	48,660	7.84
預期信用減損損失	823	0.06	8,717	0.71	5,959	0.61	1,519	0.24
營業費用	201,519	15.59	198,826	16.21	157,793	16.06	123,360	19.88
營業淨利(損失)	310,265	24.01	204,482	16.67	185,814	18.91	(80,100)	(12.91)

資料來源：該公司提供

2022年度營業費用較2021年度減少，2023年前三季營業費用較2022年前三季減少主係因公司營業收入減少而撙節各項開銷及獎金發放，主要係營業費用之獎金、員工酬勞及董事酬勞減少所致。

綜上所述，微矽公司最近兩年度及最近期之營業費用及營業損益變化尚屬合理。

四、營業外收入及支出變化原因及其合理性說明

單位：新臺幣千元

年　　度		2021年度	2022年度	2022年 前三季	2023年 前三季
利息收入		109	738	191	965
其他收入		10,242	18,038	15,506	10,535
其他利益及損失	淨外幣兌換利益	3,921	14,902	18,623	8,660
	處分不動產、廠房及設備利益(損失)	13,259	(1,104)	(1,104)	-
	其他	(6,084)	(239)	(211)	(503)
	合計	11,096	13,559	17,308	8,157
財務成本	利息費用	(9,195)	(9,608)	(7,381)	(6,143)
合計		12,252	22,727	25,624	13,514

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報表

(一)其他收入

微矽公司之其他收入主係出售探針卡、包材及其他生產性材料之收入，尚無異常項目。

(二)其他利益及損失

1. 淨外幣兌換利益

微矽公司外幣銷貨主要以美元計價收款，採購原物料多以新臺幣計價，部分購置機器設備係以美元計價付款，且外幣資產大於外幣負債，故2022年度較2021年度兌換利益大幅增加，主要因為台幣對美金貶值所致；2023年前三季兌換利益較2022年前三季減少，主要係受到台幣對美元之匯率波動所致。

2. 處分不動產、廠房及設備利益(損失)

微矽公司110年度因處分機器設備，產生不動產、廠房及設備利益新台幣13,259千元。

3. 其他

微矽公司110年度主要係新台幣4,604千元之客訴賠償損失所致。

(三)財務成本

微矽公司財務成本主要為銀行借款利息費用及租賃負債攤銷利息，各年度變動主要為借款利率因借款部位調整及央行升息產生之波動，無異常之變動。

綜上所述，微矽公司最近兩年度及最近期之營業外收入及支出變化尚屬合理。

（二）計畫投入鉅額資金擴建竹南廠之業務規畫、資金安排、相關效益及對公司財務業務影響之評估。

【公司說明】

一、業務規畫

本公司以節能為發展核心，專注在可以提升能源轉換效率之關鍵元件，並透過一站式服務幫助客戶達到節能減碳之目的，成為節能價值鏈最佳夥伴。隨著客戶終端產品應用之多元需求，產品線涵蓋氮化鎵、碳化矽、MOSFET、IGBT、Diode 及 MCU 等，因應半導體市場對第三代半導體氮化鎵及碳化矽為基材之產品需求增加，本公司亦持續投入相關之產品測試及封裝，以維持公司長期競爭力。為因應第三代半導體產線，既有廠房空間已不敷使用，考量未來長期經營規劃，於2021年12月17日經董事會決議通過增建竹南廠廠房計畫案。

增建廠房除擴大生產產能及提升市場競爭力，亦配合 ESG 永續發展，逐步落實減碳排之企業，在廠房設計及相關硬體設備使用綠電或設置再生能源設備、採用節能或低碳排設備、熱能回收或循環回收及規劃綠建築；機器設備方面，因部分設備係向日本採購，交期約1至1.5年，交貨後由使用單位測試、驗證與調校，經確認無異常狀況方可驗收，所需期間約半年；本次擴廠計畫之廠房預計於2024年第一季完工，產線預計於2025年建置完成並投入量產。同時申請根留臺灣企業加速投資行動方案，本次擴建廠房及購置機器設備所需資金預計分別為510,000千元及1,045,800千元。

二、資金安排

本公司於2023年3月13日取得經濟部「根留臺灣企業加速投資行動方案」核定函，主係透過行政院國家發展基金以委辦手續費（目前為年息0.5%）補助金融機構，降低對金融機構之借款利率，即本公司透過方案之借款利率較一般借款利率少0.5%，動用期間為核定函次日起三年內，自動用日起算三年享有利息補助。

資金來源依據「根留臺灣企業加速投資行動方案」，向金融機構辦理融資八成，金額約1,244,640千元，自有資金兩成，金額約311,160千元，本方案金融機構實際核准之總額度為

1,314,000千元，本公司依照工程驗收進度及機器安裝驗收進度逐一向金融機構申請動撥。

三、效益評估及對公司財務業務影響

本公司於2014年即切入 GaN 晶圓測試領域，累積豐富測試技術及經驗，然2023年因終端市場需求仍舊低迷使得營收放緩，惟預期2023下半年在下游庫存調整接近尾聲後景氣有望逐步復甦，故仍持續投入資金擴充產能。

本次除擴建廠房外，另增建應用於電源管理 IC 及功率元件（包含 MOSFET 及第三代半導體）之晶圓測試智能化生產線及晶圓薄化智能生產線，以進行整體數位化控管，提升生產品質、效率及擴大產能，晶圓測試年產能預計從1,171千片提升至1,511千片，晶圓薄化年產能預計從350千片提升至566千片，整體而言將有助於公司強化接單能力、擴大營運規模及爭取獲利契機，以提升競爭力，對公司未來營運應具正面之效益。

截至2023年前三季為止已動撥金額為260,996千元，所產生之利息費用為426千元，預估2023年所產生之利息費用為1,585千元。方案動用之額度為長期借款，將使本公司之負債比率提升，惟對於短期償債能力之影響不大。

【承銷商說明】

經參閱會計師核閱之2023年第三季財務報告並檢視該公司自有資金水位，其現金及約當現金餘額為274,992千元，來自營業活動淨現金流入為163,941千元，該公司擴廠主要資金來源係依據「根留臺灣企業加速投資行動方案」，八成係向金融機構融資支應，並已取得融資額度1,314,000千元，另兩成以自有資金支應，經評估該公司本次擴廠計畫及資金來源應屬可行。

該公司2021~2022年及2023年前三季銀行借款總額分別為534,549千元、524,442千元及720,058千元，銀行借款產生之利息費用分別為9,343千元、9,437千元及5,935千元，負債比率分別為45.36%、38.01%及42.67%，流動比率分別為120.03%、163.49%及215.38%，考量營運發展所需，該公司自2023年起透過向銀行舉債方式尋求資金來源，致借款金額及利息費用增加。2023年前三季隨竹南廠建廠各項工程進度使長期借款增加，故負債比率自38.01%上升至42.67%；流動比率隨新購置設備驗收，使應付設備款減少，以及償還一年內到期之長期負債，使流動負債減少，流動比率自163.49%上升至215.38%。如下表所示，該公司之負債比率均低於採樣公司，流動比率除2022年底均低於採樣公司外，其他期間介於採樣公司之間，且該公司各期之負債比率未達50%，流動比率皆逾100%，其財務結構及償債能力尚屬允當。

單位：%

分析項目	公司名稱	2021年底	2022年底	2023年第3季
負債比率	微矽電子	45.36	38.01	42.67
	京元電子	51.71	50.31	47.75
	矽格	51.30	48.41	48.60
	昇陽半導體	60.22	65.21	65.18
流動比率	微矽電子	120.03	163.49	215.38
	京元電子	169.14	218.06	271.27
	矽格	192.97	277.21	231.42
	昇陽半導體	106.91	163.52	155.37

資料來源：兆豐證券整理

隨著全球人工智慧、物聯網、5G、高效能運算及車用等應用需求持續成長，依據工研院產科國際所研究報告所預估，2024年全球半導體封測產業市場規模為385億美元，相較2023年將會有6.5%成長率，預期半導體產業在未來將逐步回升，該公司新建之廠房及設備預計於2024年陸續完工，將有助於該公司產能提升。在未來電子裝置對於電源效率日趨嚴格要求，及節能低碳經濟推升電源控制管理相關產品之需求下，將推動功率半導體市場之成長，顯見該公司於未來營運成長應屬可期。

【會計師說明】

微矽公司竹南廠增建工程款合約款項計311,700千元，截至2023年9月30日止已實際付款計174,750千元，主要資金來源來自微矽公司「根留臺灣企業加速投資行動方案」向金融機構取得之借款，該借款總額度為1,314,000千元，截至2023年9月30日止，已動用260,996千元。2021年12月31日、2022年12月31日及2023年9月30日銀行借款總額分別為534,549千元、524,442千元及720,058千元，2021、2022年度及2023年前三季銀行借款產生之利息費用分別為9,343千元、9,437千元及5,935千元。相關財務比率如下表：

單位：%

項目＼年度	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年9月30日
負債比率	45.36	38.01	42.67
流動比率	120.03	163.49	215.38
長期資產占不動產、廠房及設備比率	112.71	126.28	126.02

資料來源：兆豐證券整理

2023年9月30日銀行借款金額雖因擴廠而增加，其負債比率仍低於50%，流動比率也均高於100%，長期資產占不動產、廠房及設備比率也都高於100%，其財務結構及償債能力尚屬合理。

陸、重要決議、公司章程及相關法規

一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文(含章程新舊條文對照表及盈餘分配表)

(一)與本次發行有關之決議文：請參閱附件十三。

(二)公司章程及新舊條文對照表：請參閱附件十五。

(三)盈餘分配表：請參閱附件十四。

二、未來股利發放政策

公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，併同期初累積未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

將當年度可供分配盈餘不低於10%分派股東股息紅利，股東股息紅利之分派得以現金或股票方式為之，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之 10%。分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金方式為之，並提報最近一次股東會。

本公司分派股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、旰衡股利及公司長期財務規劃等，本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。股東股利總額係以前項第五款所列餘額加計期初未分配盈餘之可分配盈餘總額，以不低於10%比率擬具盈餘分配股東股息及紅利議案，其中股東現金紅利分派之比例不低於股東股利總額之 10%。

三、未來辦理增資計劃及其對獲利能力稀釋作用之影響事項

本公司預計申請創新板上市待主管機關核准後，由本公司與證券承銷商視當時市場狀況及最近期之營運情形，再經董事會決議未來何時辦理現金增資，未來現金增資發行價格之訂定，主要係考量產業未來發展前景、市場地位、公司競爭利基、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，與證券承銷商協商後共同訂定承銷價格，而實際發行價格，則待主管機關核准之，再由本公司與證券承銷商視當時市場之狀況、公司實際營運情形及未來展望議定合理之承銷價格。本公司擁有關鍵核心技術及創新營運模式，對未來營收及獲利狀況應屬可期，故本公司未來辦理現金增資對每股獲利能力之稀釋程度應尚屬有限。

四、本國發行公司或外國發行人召開股東會討論股票初次申請上市暨辦理上市前現金增資新股公開銷售，並將保留該新股之一定比例採洽商銷售方式辦理配售，應於股東會召集事由列舉並說明相關事宜，並應完整揭露股東會決議內容：不適用。

附件一

111 年度合併財務報告及會計師查核報告

微矽電子股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師查核報告
民國 111 年度及 110 年度
（股票代碼 8162）

公司地址：新竹縣竹東鎮沿河街 395 號

電　　話：037-587222

微矽電子股份有限公司及子公司

民國 111 年度及 110 年度合併財務報告暨會計師查核報告

目　　錄

項　　目	頁　　次
一、　封面	1
二、　目錄	2 ~ 3
三、　聲明書	4
四、　會計師查核報告	5 ~ 8
五、　合併資產負債表	9 ~ 10
六、　合併綜合損益表	11
七、　合併權益變動表	12
八、　合併現金流量表	13 ~ 14
九、　合併財務報表附註	15 ~ 52
（一）　公司沿革	15
（二）　通過財務報告之日期及程序	15
（三）　新發布及修訂準則及解釋之適用	15 ~ 16
（四）　重大會計政策之彙總說明遵循聲明	16 ~ 24
（五）　重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	24
（六）　重要會計項目之說明	24 ~ 41
（七）　關係人交易	42
（八）　質押之資產	43

項　　目	頁　　次

(九)　重大或有負債及未認列之合約承諾	43
(十)　重大之災害損失	43
(十一)重大之期後事項	43
(十二)其他	43 ~ 50
(十三)附註揭露事項	50 ~ 51
(十四)營運部門資訊	51 ~ 52

微矽電子股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司111年度（自111年1月1日至111年12月31日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：微矽電子股份有限公司

負 責 人：張秉堂

中華民國112年3月15日

pwc 資誠

會計師查核報告

(112)財審報字第 22003367 號

微矽電子股份有限公司　公鑒：

查核意見

微矽電子股份有限公司及子公司（以下簡稱「微矽集團」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達微矽集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與微矽集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對微矽集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F:+ 886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

微矽集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

收入認列之正確性

事項說明

有關營業收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四、(二十二)，營業收入項目請詳合併財務報告附註六、(十六)。微矽集團主要提供各種積體電路之研發與測試服務，該勞務收入係隨時間逐步移轉對勞務之控制而逐步滿足履約義務並認列收入。考量營業收入對整體財務報告有重大影響，因此本會計師將收入認列之正確性列為查核最為重要事項。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 與管理當局訪談以瞭解及評估收入認列有關會計政策，並測試相關內部控制設計及執行情形。
2. 選取樣本執行交易詳細測試並覆核合約之履約義務、價格及提供勞務之佐證資料，確認收入認列之正確性。
3. 檢視資產負債表日履約義務完成程度之評估程序及相關佐證文件，並抽核衡量履約義務完成程度之相關資料，確認收入認列之正確性。

其他事項-個體財務報告

微矽電子股份有限公司已編製民國 111 及 110 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

pwc 資誠

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估微矽集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算微矽集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

微矽集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對微矽集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使微矽集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修

pwc 資誠

正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致微矽集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對微矽集團民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

白淑蒨

金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
金管證審字第 1110349013 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 5 日

微矽電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 334,482	16	$ 251,427	13
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		6,500	-	6,500	-
1140	合約資產－流動	六(十六)	89,407	4	61,406	3
1150	應收票據淨額		974	-	1,155	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	246,026	11	346,290	17
1200	其他應收款		2,584	-	677	-
130X	存貨	六(三)	15,053	1	14,598	1
1410	預付款項		13,294	1	6,690	-
1470	其他流動資產		-	-	648	-
11XX	**流動資產合計**		708,320	33	689,391	34
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八	1,381,256	63	1,282,471	64
1755	使用權資產	六(五)	6,207	-	8,276	-
1780	無形資產	六(六)	15,267	1	6,505	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	7,097	-	3,617	-
1900	其他非流動資產	六(七)及八	59,376	3	29,647	2
15XX	**非流動資產合計**		1,469,203	67	1,330,516	66
1XXX	**資產總計**		$ 2,177,523	100	$ 2,019,907	100

（續次頁）

微矽電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(八)	$ -	-	$ 80,000	4
2130	合約負債－流動	六(十六)	5,023	-	296	-
2150	應付票據		2,555	-	23	-
2170	應付帳款		19,338	1	26,601	1
2200	其他應付款	六(九)及七	226,405	11	257,760	13
2230	本期所得稅負債		7,976	-	47,992	2
2280	租賃負債－流動		2,160	-	2,160	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)	166,776	8	156,562	8
2399	其他流動負債－其他		2,999	-	2,940	-
21XX	**流動負債合計**		433,232	20	574,334	28
	非流動負債					
2540	長期借款	六(十)	357,666	16	297,987	15
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)	906	-	615	-
2580	租賃負債－非流動		4,152	-	6,185	-
2600	其他非流動負債	六(十一)	31,847	2	37,199	2
25XX	**非流動負債合計**		394,571	18	341,986	17
2XXX	**負債總計**		827,803	38	916,320	45
	權益					
	股本	六(十三)				
3110	普通股股本		646,600	30	610,000	30
	資本公積	六(十四)				
3200	資本公積		142,989	6	13,775	1
	保留盈餘	六(十五)				
3310	法定盈餘公積		81,523	4	49,980	3
3350	未分配盈餘		478,608	22	429,832	21
3XXX	**權益總計**		1,349,720	62	1,103,587	55
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
	重大之期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 2,177,523	100	$ 2,019,907	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	項目	附註	111年度 金額	%	110年度 金額	%
4000	營業收入	六(十六)	$ 1,226,677	100	$ 1,292,379	100
5000	營業成本	六(三)(二十一)(二十二)	(823,369)	(67)	(780,595)	(60)
5900	營業毛利		403,308	33	511,784	40
	營業費用	六(二十一)(二十二)				
6100	推銷費用		(14,886)	(1)	(13,122)	(1)
6200	管理費用		(105,645)	(8)	(123,183)	(10)
6300	研究發展費用		(69,578)	(6)	(64,391)	(5)
6450	預期信用減損損失	十二(二)	(8,717)	(1)	(823)	-
6000	營業費用合計		(198,826)	(16)	(201,519)	(16)
6900	營業利益		204,482	17	310,265	24
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(十七)	738	-	109	-
7010	其他收入	六(十八)	18,038	2	10,242	1
7020	其他利益及損失	六(十九)	13,559	1	11,096	1
7050	財務成本	六(二十)	(9,608)	(1)	(9,195)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		22,727	2	12,252	1
7900	**稅前淨利**		227,209	19	322,517	25
7950	所得稅費用	六(二十三)	(58,871)	(5)	(62,694)	(5)
8200	**本期淨利**		$ 168,338	14	$ 259,823	20
	其他綜合損益					
8311	確定福利計畫之再衡量數		$ 4,351	-	($ 14,237)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(870)	-	2,847	-
8300	**其他綜合損益(淨額)**		$ 3,481	-	($ 11,390)	(1)
8500	**本期綜合損益總額**		$ 171,819	14	$ 248,433	19
	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		$ 168,338	14	$ 259,823	20
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$ 171,819	14	$ 248,433	19
	每股盈餘	六(二十四)				
9750	基本每股盈餘		$ 2.70		$ 4.31	
9850	稀釋每股盈餘		$ 2.68		$ 4.24	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	歸屬於母公司業主之權益					
		普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	庫藏股票	權益總額
110年度							
110年1月1日餘額		$ 610,000	$ -	$ 39,273	$ 253,106	($ 43,094)	$ 859,285
本期淨利		-	-	-	259,823	-	259,823
本期其他綜合損益		-	-	-	(11,390)	-	(11,390)
本期綜合損益總額		-	-	-	248,433	-	248,433
109年度盈餘指撥及分派	六(十五)						
提列法定盈餘公積		-	-	10,707	(10,707)	-	-
現金股利		-	-	-	(61,000)	-	(61,000)
庫藏股轉讓予員工	六(十三)(十四)	-	2,898	-	-	20,828	23,726
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	六(十三)(十四)	-	10,877	-	-	22,266	33,143
110年12月31日餘額		$ 610,000	$ 13,775	$ 49,980	$ 429,832	$ -	$ 1,103,587
111年度							
111年1月1日餘額		$ 610,000	$ 13,775	$ 49,980	$ 429,832	$ -	$ 1,103,587
本期淨利		-	-	-	168,338	-	168,338
本期其他綜合損益		-	-	-	3,481	-	3,481
本期綜合損益總額		-	-	-	171,819	-	171,819
110年度盈餘指撥及分派	六(十五)						
提列法定盈餘公積		-	-	31,543	(31,543)	-	-
現金股利		-	-	-	(91,500)	-	(91,500)
現金增資	六(十三)(十四)	36,600	128,100	-	-	-	164,700
股份基礎給付酬勞成本	六(十二)(十四)	-	1,114	-	-	-	1,114
111年12月31日餘額		$ 646,600	$ 142,989	$ 81,523	$ 478,608	$ -	$ 1,349,720

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111年1月1日至12月31日	110年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		$ 227,209	$ 322,517
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(四)(五)(二十一)	289,967	257,336
攤提費用	六(六)(二十一)	6,197	2,871
預期信用減損損失	十二(二)	8,717	823
利息費用	六(二十)	9,608	9,195
利息收入	六(十七)	(738)	(109)
股份基礎給付酬勞成本	六(十二)(二十二)	1,114	-
處分不動產、廠房及設備利益	六(十九)	1,104	(13,259)
處分投資利益	六(十九)	-	(1,510)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產		(36,718)	28,813
應收票據		181	822
應收帳款		100,264	(56,203)
其他應收款		(1,907)	3,428
存貨		(455)	4,752
預付款項		(6,604)	(3,009)
其他流動資產		648	(614)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		4,727	224
應付票據		2,532	22
應付帳款		(7,263)	964
其他應付款		(33,399)	20,755
其他應付款-關係人		-	(116)
其他流動負債		59	479
應計退休金負債		(1,001)	(1,022)
營運產生之現金流入		564,242	577,159
收取之利息		738	106
支付之利息		(9,437)	(9,343)
支付所得稅		(102,946)	(37,363)
營業活動之淨現金流入		452,597	530,559

(續次頁)

微矽電子股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111年1月1日至12月31日	110年1月1日至12月31日
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		$ -	($ 6,500)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		-	6,400
處分透過其他綜合損益按公允衡量之金融資產價款		-	25
處分子公司淨現金增加	六(二十五)	-	1,541
取得不動產、廠房及設備	六(二十五)	(443,504)	(312,849)
處分不動產、廠房及設備價款		28,077	18,204
取得無形資產	六(六)	(14,959)	-
存出保證金增加		(216)	(367)
投資活動之淨現金流出		(430,602)	(293,546)
籌資活動之現金流量			
短期借款舉借	六(二十六)	630,000	542,500
短期借款償還	六(二十六)	(710,000)	(700,000)
長期借款舉借	六(二十六)	260,000	216,700
長期借款償還	六(二十六)	(190,107)	(180,225)
租賃負債本金償還	六(二十六)	(2,033)	(1,999)
發放現金股利		(91,500)	(61,000)
子公司處分母公司庫藏股股票	六(十三)	-	33,143
庫藏股轉讓予員工		-	23,726
現金增資		164,700	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		61,060	(127,155)
本期現金及約當現金增加數		83,055	109,858
期初現金及約當現金餘額	六(一)	251,427	141,569
期末現金及約當現金餘額	六(一)	$ 334,482	$ 251,427

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司及子公司

合 併 財 務 報 表 附 註

民國 111 年度及 110 年度

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

一、公司沿革

微矽電子股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於中華民國 76 年 8 月 11 日設立，本公司及子公司(以下統稱「本集團」) 主要營業項目為各型積體電路之設計、加工、測試製造買賣等。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國 112 年 3 月 15 日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可並發布生效之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可並發布生效之民國 111 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「對觀念架構之索引」	民國111年1月1日
國際會計準則第16號之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	民國111年1月1日
國際會計準則第37號之修正「虧損性合約—履行合約之成本」	民國111年1月1日
2018-2020週期之年度改善	民國111年1月1日

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二)尚未採用金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 112 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」	民國112年1月1日
國際會計準則第8號之修正「會計估計之定義」	民國112年1月1日
國際會計準則第12號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	民國112年1月1日

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(三)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	待國際會計準則理事會決定
國際財務報導準則第16號之修正「售後租回中之租賃負債」	民國113年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」之修正	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號之修正「初次適用國際財務報導準則第17號及國際財務報導準則第9號—比較資訊」	民國112年1月1日
國際會計準則第1號之修正「負債之流動或非流動分類」	民國113年1月1日
國際會計準則第1號之修正「具合約條款之非流動負債」	民國113年1月1日

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

四、重大會計政策之彙總說明遵循聲明

編製本合併財務報告所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一)遵循聲明

本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱 IFRSs)編製。

(二)編製基礎

1.除下列重要項目外，本合併財務報告係按歷史成本編製：

(1)按公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。

(2)按退休基金資產減除確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。

2.編製符合 IFRSs 之財務報告需要使用一些重要會計估計，在應用本集團的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷，涉及高度判斷或複雜性之項目，或涉及合併財務報告之重大假設及估計之項目，請詳附註五說明。

(三)合併基礎

1.合併財務報告編製原則

(1)本集團將所有子公司納入合併財務報告編製之合併。子公司指受本集團控制之合併(包括結構型合併)，當本集團暴露於來自對該合併之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利，且透過對該合併之權力有能力影響該等報酬時，本集團即控制該合併。子公司自本集團取得控制之日起納入合併財務報告，於喪失控制之日起終止合併。

(2)集團內公司間之交易、餘額及未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整，與本集團採用之政策一致。

(3)損益及其他綜合損益各組成部分歸屬於母公司業主及非控制權益；綜合損益總額亦歸屬於母公司業主及非控制權益，即使因而導致非控制權益發生虧損餘額。

(4)對子公司持股之變動若未導致喪失控制(與非控制權益之交易)，係作為權益交易處理，亦即視為與業主間進行之交易。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額係直接認列為權益。

(5)當集團喪失對子公司之控制，對前子公司之剩餘投資係按公允價值重新衡量，並作為原始認列金融資產之公允價值或原始認列投資關聯企業或合資之成本，公允價值與帳面金額之差額認列為當期損益。對於先前認列於其他綜合損益與該子公司有關之所有金額，其會計處理與本集團若直接處分相關資產或負債之基礎相同，亦即如先前認列為其他綜合損益之利益或損失，於處分相關資產或負債時將被重分類為損益，則當喪失對子公司之控制時，將該利益或損失自權益重分類為損益。

2.列入合併財務報告之子公司：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比 111年12月31日	所持股權百分比 110年12月31日	說明
微矽電子股份有限公司	微石開發股份有限公司	餐飲服務	-	-	(註)

註：本集團於民國 110 年 12 月 30 日處分子公司微石開發股份有限公司100%股權。

(四)外幣換算

本集團合併財務報告所列之項目，均以營運所處主要經濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本合併財務報告係以本集團之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

外幣交易及餘額

1.外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣，換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。

2.外幣貨幣性資產及負債餘額，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之換算差額認列為當期損益。

3.外幣非貨幣性資產及負債餘額，屬透過損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列為當期損益，屬非按公允價值衡量者，則按初始交易日之歷史匯率衡量。

4.所有其他兌換損益按交易性質在損益表之其他利益及損失列報。

(五)資產負債區分流動及非流動之分類標準

1.資產符合下列條件之一者，分類為流動資產：

(1)預期將於正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗者。
(2)主要為交易目的而持有者。
(3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
(4)現金或約當現金，但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償負債受到限制者除外。

本集團將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。

2.負債符合下列條件之一者，分類為流動負債：

(1)預期將於正常營業週期中清償者。
(2)主要為交易目的而持有者。
(3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。

(4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款，可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致清償者，不影響其分類。

本集團將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

(六)約當現金

約當現金係指短期並具高度流動性之投資，該投資可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小。定期存款符合前述定義且其持有目的係為滿足營運上之短期現金承諾者，分類為約當現金。

(七)按攤銷後成本衡量之金融資產

1. 係指同時符合下列條件者：

(1)在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。

(2)該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

2. 本集團對於符合交易慣例之按攤銷後成本衡量之金融資產係採用交易日會計。

3. 本集團於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量，後續採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息收入，及認列減損損失，並於除列時，將其利益或損失認列於損益。

4. 本集團持有不符合約當現金之定期存款，因持有期間短，折現之影響不重大，係以投資金額衡量。

(八)應收帳款及票據

1. 係指依合約約定，已具無條件收取因移轉商品或勞務所換得對價金額權利之帳款及票據。

2. 屬未付息之短期應收帳款及票據，因折現之影響不大，本集團係以原始發票金額衡量。

(九)金融資產減損

本集團於每一資產負債表日，就按攤銷後成本衡量之金融資產，考量所有合理且可佐證之資訊(包括前瞻性者)後，對自原始認列後信用風險並未顯著增加者，按 12 個月預期信用損失金額衡量備抵損失；對自原始認列後信用風險已顯著增加者，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失；就不包含重大財務組成部分之應收帳款，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失。

(十)金融資產之除列

當本集團對收取來自金融資產現金流量之合約權利失效時，將除列金融資產。

(十一)存貨

存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量，成本依加權平均法決定。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法，淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(十二)不動產、廠房及設備

1. 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。
2. 後續成本只有在與該項目有關之未來經濟效益很有可能流入本集團，且該項目之成本能可靠衡量時，才包括在資產之帳面金額或認列為一項單獨資產。被重置部分之帳面金額應除列。所有其他維修費用於發生時認列為當期損益。
3. 不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式，其他按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成若屬重大，則單獨提列折舊。
4. 本集團於每一財務年度結束對各項資產之殘值、耐用年限及折舊方法進行檢視，若殘值及耐用年限之預期值與先前之估計不同時，或資產所含之未來經濟效益之預期消耗型態已有重大變動，則自變動發生日起依國際會計準則第 8 號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之會計估計變動規定處理。

   各項資產之耐用年限如下：

房屋及建築	4年 ～ 55年
機器設備	1.5年～ 6年
運輸設備	4年 ～ 6年
其他設備	2年 ～ 10年

(十三)承租人之租賃交易－使用權資產/租賃負債

1. 租賃資產於可供本集團使用之日認列為使用權資產及租賃負債。當租賃合約係屬短期租賃或低價值標的資產之租賃時，將租賃給付採直線法於租賃期間認列為費用。

2. 租賃負債於租賃開始日將尚未支付之租賃給付按本集團增額借款利率折現後之現值認列，租賃給付為固定給付，減除可收取之任何租賃誘因。後續採利息法按攤銷後成本法衡量，於租賃期間提列利息費用。當非屬合約修改造成租賃期間或租賃給付變動時，將重評估租賃負債，並將再衡量數調整使用權資產。

3. 使用權資產於租賃開始日按成本認列，成本包括：

(1)租賃負債之原始衡量金額；及

(2)於開始日或之前支付之任何租賃給付。

後續採成本模式衡量，於使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者，提列折舊費用。當租賃負債重評估時，使用權資產將調整租賃負債之任何再衡量數。

(十四)無形資產

無形資產主係電腦軟體，採直線法攤銷，攤銷年限為 3～6 年。

(十五)非金融資產減損

本集團於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減處分成本或其使用價值，兩者較高者。當以前年度已認列資產減損之情況不存在或減少時，則迴轉減損損失，惟迴轉減損損失而增加之資產帳面金額，不超過該資產若未認列減損損失情況下減除折舊或攤銷後之帳面金額。

(十六)借款

係指向銀行借入之長、短期款項。本集團於原始認列時按其公允價值減除交易成本衡量，後續就減除交易成本後之價款與贖回價值之任何差額，採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息費用於損益。

(十七)應付帳款及票據

1. 係指因賒購原物料、商品或勞務所發生之債務及因營業與非因營業而發生之應付票據。

2. 屬未付息之短期應付帳款及票據，因折現之影響不大，本集團係以原始發票金額衡量。

(十八)員工福利

1.短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量,並於相關服務提供時認列為費用。

2.退休金

(1)確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

(2)確定福利計畫

A.確定福利計畫下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算，並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算，折現率則參考資產負債表日與確定福利計畫之貨幣及期間一致之高品質公司債之市場殖利率決定；在高品質公司債無深度市場之國家，係使用政府公債(於資產負債表日)之市場殖利率。

B.確定福利計畫產生之再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益，並表達於其他權益。

3.員工酬勞及董事酬勞

員工酬勞及董事酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時,認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。另以股票發放員工酬勞者，計算股數之基礎為董事會決議日前一日收盤價。

(十九)所得稅

1.所得稅費用包含當期及遞延所得稅。除與列入其他綜合損益或直接列入權益之項目有關之所得稅分別列入其他綜合損益或直接列入權益外，所得稅係認列於損益。

2.本集團依據營運及產生應課稅所得之所在國家在資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率計算當期所得稅。管理階層就適用所得稅相關法規定期評估所得稅申報之狀況，並在適用情況下根據預期須向稅捐機關支付之稅款估列所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵之所得稅,嗣盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。

3. 遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於合併資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易（不包括企業合併）中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得(課稅損失)，則不予認列。若投資子公司及關聯企業產生之暫時性差異，本集團可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法或已實質性立法，並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率（及稅法）為準。

4. 遞延所得稅資產於暫時性差異很有可能用以抵減未來應課稅所得之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。

(二十)股本

普通股分類為權益。直接歸屬於發行新股或認股權之增額成本以扣除所得稅後之淨額於權益中列為價款減項。

(二十一)股利分配

分派予本公司股東之股利於本公司股東會決議分派股利時於財務報告認列，分派現金股利認列為負債，分派股票股利則認列為待分配股票股利，並於發行新股基準日時轉列普通股。

(二十二)收入認列

勞務收入

1. 本集團提供積體電路之研發與測試相關業務。若符合(a)隨企業之履約能使客戶同時取得及耗用企業提供之效益、(b)企業之履約創造或強化一資產且履約過程係由客戶控制該資產、(c)企業之履約並未創造對其具有其他用途之資產，且對迄今已完成履約之款項具有可執行權利之任一條件，則企業係隨時間逐步移轉對商品或勞務之控制，因而隨時間逐步滿足履約義務並認列收入。本集團提供之測試服務係符合上述(b)條件，應隨時間逐步認列收入，並以衡量履約義務完成程度認列收入。

2. 因移轉所承諾之商品或服務予客戶與客戶付款間之時間間隔未有超過一年者，因此本集團並未調整交易價格以反映貨幣時間價值。

3. 客戶依照所協議之付款時間表支付測試服務價款，當本集團已提供之服務超過客戶應付款時認列為合約資產，若客戶應付款超過本集團已提供之服務時則認列為合約負債。

(二十三)營運部門

本集團營運部門資訊與提供給主要營運決策者之內部管理報告採一致之方式報導。主要營運決策者負責分配資源予營運部門並評估其績效。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本集團編製本合併財務報告時，管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政策，並依據資產負債表日當時之情況對於未來事件之合理預期以作出會計估計及假設。所作出之重大會計估計與假設可能與實際結果存有差異，將考量歷史經驗及其他因子持續評估及調整。該等估計及假設具有導致資產及負債帳面金額於下個財務年度重大調整之風險。請詳下列對重大會計判斷、估計與假設不確定性之說明：

(一)會計政策採用之重要判斷

無。

(二)重要會計估計及假設

無。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	111年12月31日	110年12月31日
庫存現金及週轉金	$ 175	$ 305
支票存款及活期存款	334,307	251,122
合計	$ 334,482	$ 251,427

1. 本集團往來之金融機構信用品質良好，且本集團與多家金融機構往來以分散信用風險，預期發生違約之可能性甚低。

2. 本集團未有將現金及約當現金提供質押之情形。

(二)應收帳款

	111年12月31日	110年12月31日
應收帳款	$ 247,560	$ 358,557
減：備抵損失	(1,534)	(12,267)
	$ 246,026	$ 346,290

1.應收帳款之帳齡分析如下：

	111年12月31日	110年12月31日
	應收帳款	應收帳款
未逾期	$ 236,852	$ 340,296
30天內	-	4,214
31-90天	10,638	1,665
91-180天	43	1,143
181天以上	27	11,239
	$ 247,560	$ 358,557

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

2.民國111年及110年12月31日之應收帳款餘額均為為客戶合約所產生，另於民國110年1月1日客戶合約之應收款餘額為$302,354。

3.在不考慮所持有之擔保品或其他信用增強之情況下，最能代表本集團應收帳款於民國111年及110年12月31日日信用風險最大之暴險金額分別為$246,026及$346,290。

4.相關應收帳款信用風險資訊請詳附註十二、(二)。

(三)存貨

	111年12月31日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原物料	$ 17,269	($ 2,216)	$ 15,053

	110年12月31日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原物料	$ 14,598	$ -	$ 14,598

本集團當期認列為費損之存貨成本：

	111年度	110年度
已出售存貨成本	$ 82,114	$ 91,436
跌價及呆帳損失	2,216	-
	$ 84,330	$ 91,436

(四)不動產、廠房及設備

	土地	房屋及建築	機器設備	運輸設備	其他設備	未完工程及待驗設備	合計
111年1月1日							
成本	$225,914	$337,506	$1,003,982	$ 17,166	$427,620	$ 11,984	$2,024,172
累計折舊及減損	-	(112,181)	(424,396)	(10,699)	(194,425)	-	(741,701)
	$225,914	$225,325	$ 579,586	$ 6,467	$233,195	$ 11,984	$1,282,471
111年							
1月1日	$225,914	$225,325	$ 579,586	$ 6,467	$233,195	$ 11,984	$1,282,471
增添	-	-	230,264	1,665	45,704	138,231	415,864
處分	-	-	(20,939)	-	(8,242)	-	(29,181)
重分類	-	-	7,921	-	-	(7,921)	-
折舊費用	-	(6,918)	(193,102)	(2,521)	(85,357)	-	(287,898)
12月31日	$225,914	$218,407	$ 603,730	$ 5,611	$185,300	$ 142,294	$1,381,256
111年12月31日							
成本	$225,914	$337,506	$1,177,538	$ 18,831	$447,215	$ 142,294	$2,349,298
累計折舊及減損	-	(119,099)	(573,808)	(13,220)	(261,915)	-	(968,042)
	$225,914	$218,407	$ 603,730	$ 5,611	$185,300	$ 142,294	$1,381,256

	土地	房屋及建築	機器設備	運輸設備	其他設備	未完工程及待驗設備	合計
110年1月1日							
成本	$225,914	$338,979	$2,142,422	$ 20,046	$633,075	$ 5,872	$3,366,308
累計折舊及減損	-	(107,373)	(1,804,294)	(10,023)	(369,099)	-	(2,290,789)
	$225,914	$231,606	$ 338,128	$ 10,023	$263,976	$ 5,872	$1,075,519
110年							
1月1日	$225,914	$231,606	$ 338,128	$ 10,023	$263,976	$ 5,872	$1,075,519
增添	-	615	345,671	-	51,415	9,002	406,703
處分	-	-	(2,053)	-	(2,892)	-	(4,945)
重分類	-	-	53,538	-	9,853	(2,890)	60,501
折舊費用	-	(6,896)	(155,698)	(3,556)	(89,117)	-	(255,267)
合併個體減少轉出數	-	-	-	-	(40)	-	(40)
12月31日	$225,914	$225,325	$ 579,586	$ 6,467	$233,195	$ 11,984	$1,282,471
110年12月31日							
成本	$225,914	$337,506	$1,003,982	$ 17,166	$427,620	$ 11,984	$2,024,172
累計折舊及減損	-	(112,181)	(424,396)	(10,699)	(194,425)	-	(741,701)
	$225,914	$225,325	$ 579,586	$ 6,467	$233,195	$ 11,984	$1,282,471

1.不動產、廠房及設備借款成本資本化金額及利率區間：

	111年度	110年度
資本化金額	$ 2,252	$ 1,271
資本化利率區間	1.70%~2.12%	1.71%~1.78%

2.以不動產、廠房及設備提供擔保之資訊，請詳附註八之說明。

(五)租賃交易－承租人

1.本集團租賃之標的資產為停車場，租賃合約之期間通常介於 1 到 5 年。租賃合約是採個別協商並包含各種不同的條款及條件，除租賃之資產不得用作借貸擔保外，未有加諸其他之限制。本集團承租之電瓶及保管箱因租賃期間不超過 12 個月而歸屬為短期租賃合約。

2.使用權資產之帳面價值與認列之折舊費用資訊如下：

	帳面金額	
	111年12月31日	110年12月31日
停車場	$ 6,207	$ 8,276

	折舊費用	
	111年度	110年度
停車場	$ 2,069	$ 2,069

4.本集團於民國 111 年及 110 年度使用權資產之增添分別為$0 及$10,344。

5.與租賃合約有關之損益項目資訊如下：

	111年度	110年度
影響當期損益之項目		
租賃負債之利息費用	$ 126	$ 161
屬短期租賃合約之費用	45	52

6.本集團於民國 111 年及 110 年度租賃現金流出總額分別為$2,204 及$2,212。

（六）無形資產

	電腦軟體
111年1月1日	
成本	$ 14,686
累計攤銷及減損	(8,181)
	$ 6,505
111年	
1月1日	$ 6,505
增添	14,959
攤銷費用	(6,197)
12月31日	$ 15,267
111年12月31日	
成本	$ 29,645
累計攤銷及減損	(14,378)
	$ 15,267

	電腦軟體
110年1月1日	
成本	$ 36,556
累計攤銷及減損	(27,180)
	$ 9,376
110年	
1月1日	$ 9,376
攤銷費用	(2,871)
12月31日	$ 6,505
110年12月31日	
成本	$ 14,686
累計攤銷及減損	(8,181)
	$ 6,505

無形資產攤銷明細如下：

	111年度	110年度
管理費用	$ 3,145	$ 2,871
製造費用	3,052	-
	$ 6,197	$ 2,871

(七)其他非流動資產

	111年12月31日	110年12月31日
預付設備款	$ 56,365	$ 26,852
存出保證金	3,011	2,795
合計	$ 59,376	$ 29,647

(八)短期借款

民國 111 年 12 月 31 日：無。

借款性質	110年12月31日	利率區間	擔保品
銀行借款			
信用借款	$ 80,000	1.52%～1.69%	無

(九)其他應付款

	111年12月31日	110年12月31日
應付薪資及獎金	$ 43,178	$ 55,870
應付員工及董事酬勞	17,105	26,581
應付設備款	108,322	106,449
應付未休假獎金	4,074	4,664
其他	53,726	64,196
	$ 226,405	$ 257,760

(十)長期借款

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	111年12月31日
長期銀行借款				
擔保借款	自107年9月10日至118年5月11日，依議定期間及分額攤還	1.87%～2.28%	註	$ 365,443
信用借款	自109年4月27日至118年5月11日，依議定期間及分額攤還	1.85%～2.33%	無	158,999
				524,442
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(166,776)
				$ 357,666

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	110年12月31日
長期銀行借款				
擔保借款	自106年9月15日至115年10月5日，依議定期間及分額攤還	1.49%～1.80%	註	$ 429,083
信用借款	自109年4月27日至112年4月27日，依議定期間及分額攤還	1.70%～1.98%	無	25,466
				454,549
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(156,562)
				$ 297,987

註：有關長期借款擔保品價值，請詳附註八。

(十一)退休金

1.(1)本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算，15 年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。

(2)資產負債表認列之金額如下：

	111年12月31日	110年12月31日
確定福利義務現值	($ 58,403)	($ 60,574)
計畫資產公允價值	26,556	23,375
淨確定福利負債	($ 31,847)	($ 37,199)

(3)淨確定福利負債之變動如下：

	111年		
	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
1月1日	($ 60,574)	$ 23,375	($ 37,199)
利息(費用)收入	(316)	77	(239)
	(60,890)	23,452	(37,438)
再衡量數：			
計畫資產報酬(不包括包含於利息收入或費用之金額)	-	1,864	1,864
財務假設變動影響數	2,221	-	2,221
經驗調整	266	-	266
	2,487	1,864	4,351
提撥退休基金	-	1,240	1,240
12月31日	($ 58,403)	$ 26,556	($ 31,847)

	110年		
	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
1月1日	($ 45,859)	$ 21,875	($ 23,984)
利息(費用)收入	(112)	41	(71)
	(45,971)	21,916	(24,055)
再衡量數：			
計畫資產報酬(不包括包含於利息收入或費用之金額)	-	366	366
人口統計假設變動影響數	(183)	-	(183)
財務假設變動影響數	1,386	-	1,386
經驗調整	(15,806)	-	(15,806)
	(14,603)	366	(14,237)
提撥退休基金	-	1,093	1,093
12月31日	($ 60,574)	$ 23,375	($ 37,199)

(4)本公司之確定福利退休計畫基金資產，係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計畫所定委託經營項目之比例及金額範圍內，依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目（即存放國內外之金融機構，投資國內外上市、上櫃或私募之權益證券及投資國內外不動產之證券化商品等）辦理委託經營，相關運用情形係由勞工退休基金監理會進行監督。該基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益，若有不足，則經主管機關核准後由國庫補足。因本公司無權參與該基金之運作及管理，故無法依國際會計準則第 19 號第 142 段規定揭露計劃資產公允價值之分類。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日構成該基金總資產之公允價值，請詳政府公告之各年度之勞工退休基金運用報告。

(5)有關退休金之精算假設彙總如下：

	111年度	110年度
折現率	1.20%	0.65%
未來薪資增加率	3.00%	3.00%

民國 111 年及 110 年度對於未來死亡率之假設係按照台灣地區第六回經驗生命表估計。

因採用之主要精算假設變動而影響之確定福利義務現值分析如下：

	折現率		未來薪資增加率	
	增加0.25%	減少0.25%	增加0.25%	減少0.25%
111年12月31日				
對確定福利義務現值之影響	($ 958)	$ 990	$ 970	($ 943)
110年12月31日				
對確定福利義務現值之影響	($ 957)	$ 996	$ 970	($ 938)

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨退休金負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

(6)本公司於民國 112 年度預計支付予退休計畫之提撥金為$728。

(7)截至民國 111 年 12 月 31 日，該退休計畫之加權平均存續期間為 6 年。退休金支付之到期分析如下：

1-2年	$ 5,326
2-5年	34,407
5年以上	23,367
	$ 63,100

2.(1)自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 2%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

(2)民國 111 年及 110 年度，本公司依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為$13,013 及$12,233。

(十二)股份基礎給付

1.民國 111 年及 110 年度，本集團之股份基礎給付協議如下：

協議之類型	給與日	給與數量	合約期間	既得條件
現金增資保留員工認購	111年8月19日	366,000	不適用	立即既得

2.本集團於民國 111 年給與之股份基礎給付交易使用 Black-Scholes-Merton選擇權評價模式估計認股選擇權之公允價值,相關資訊如下:

協議之類型	給與日	股價	履約價格	預期波動率	預期存續期間	無風險利率	每單位公允價值
現金增資保留員工認購	111年8月19日	$44.71	$45.00	33.95%	0.2630年	1.38%	$ 3.0427

3.股份基礎給付交易產生之費用如下：

	111年度	110年度
權益交割	$ 1,114	$ -

(十三)股本

1.民國 111 年 12 月 31 日止，本公司額定資本額為$1,000,000，分為 100,000 仟股，實收資本額為$646,600，每股面額 10 元。本公司已發行股份之股款均已收訖。

本公司普通股期初與期末流通在外股數調節如下：

股數:仟股

	111年	110年
1月1日流通在外股數	61,000	58,725
現金增資	3,660	-
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	1,326
庫藏股轉讓與員工	-	949
12月31日流通在外股數	64,660	61,000

2.本公司於民國 111 年 5 月 11 日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股 3,660 仟股，除依法保留 10%供員工認股，其餘由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購,每股認購價格新台幣 45 元,現金增資基準日為民國 111 年 8 月 19 日。

3.庫藏股

(1)本公司之子公司－微石開發股份有限公司於民國 109 年 12 月 31 日持有本公司股票為 1,326 仟股，帳面金額為$22,266，每股平均帳面價值為新台幣 16.79 元。另微石公司業已於民國 110 年度出售本公司股票，出售金額為$33,143。

(2)本公司於民國 109 年度因庫藏股無償轉讓與員工，故認列之股份基礎給付酬勞成本為$22,056。本公司於民國 110 年度因庫藏股以每股新台幣 25 元轉讓與員工，故認列之股份基礎給付酬勞成本為$0。

(十四)資本公積

依公司法規定，超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積，除得用於彌補虧損外，於公司無累積虧損時，按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定，以上開資本公積撥充資本時，每年以其合計數不超過實收資本額百分之十為限。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時，不得以資本公積補充之。

	111年			
	發行溢價	庫藏股票交易	員工認股權	合計
1月1日	$ -	$ 13,775	$ -	$ 13,775
現金增資	128,100	-	-	128,100
股份基礎給付酬勞成本	-	-	1,114	1,114
12月31日	$ 128,100	$ 13,775	$ 1,114	$ 142,989

	110年
	庫藏股票交易
1月1日	$ -
庫藏股轉讓予員工	2,898
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	10,877
12月31日	$ 13,775

(十五)保留盈餘

1.依本公司章程，年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

2.法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現金外，不得使用之，惟發給新股或現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

3.民國 111 年 4 月 22 日及民國 110 年 5 月 12 日經股東會決議通過民國 110 及 109 年度之盈餘分派案如下:

	110年	109年
	金額	金額
法定盈餘公積	$ 31,543	$ 10,707
現金股利	91,500	61,000
合計	$ 123,043	$ 71,707

4.本公司民國 112 年 3 月 15 日，經董事會決議通過民國 111 年度盈餘分派案如下：

	111年	
	金額	每股股利(元)
法定盈餘公積	$ 17,182	
現金股利	96,990	$ 1.5
合計	$ 114,172	

上述民國 111 年度盈餘分派案，截至民國 112 年 3 月 15 日止，尚未經股東會決議。

(十六)營業收入

	111年度	110年度
客戶合約之收入	$ 1,226,677	$ 1,292,379

1.本集團之收入明細如下：

111年度	積體電路測試	其他	合計
外部客戶合約收入	$ 926,313	$ 300,364	$ 1,226,677
收入認列時點			
隨時間逐步認列之收入	$ 926,313	$ 300,364	$ 1,226,677

110年度	積體電路測試	其他	合計
外部客戶合約收入	$ 1,005,426	$ 286,953	$ 1,292,379
收入認列時點			
於某一時點認列之收入	$ -	$ 1,203	$ 1,203
隨時間逐步認列之收入	1,005,426	285,750	1,291,176
合計	$ 1,005,426	$ 286,953	$ 1,292,379

2.合約資產及合約負債

本集團認列客戶合約收入相關之合約資產及合約負債如下:

	111年12月31日	110年12月31日	110年1月1日
合約資產:			
合約資產-積體電路測試	$ 89,407	$ 61,406	$ 90,219
合約負債:			
合約負債-積體電路測試	$ 5,023	$ 296	$ 72

3.本集團認列之合約資產備抵損失請詳附註十二(二)。

4.期初合約負債本期認列收入:

	111年度	110年度
合約負債期初餘額		
本期認列收入		
客戶合約收入	$ 296	$ 72

(十七)利息收入

	111年度	110年度
銀行存款利息	$ 544	$ 53
按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入	194	56
	$ 738	$ 109

(十八)其他收入

	111年度	110年度
租金收入	$ 524	$ 444
其他收入－其他	17,514	9,798
	$ 18,038	$ 10,242

(十九)其他利益及損失

	111年度	110年度
處分不動產、廠房及設備利益(損失)	($ 1,104)	$ 13,259
處分投資利益	-	1,510
外幣兌換利益	14,902	3,921
什項支出	(239)	(7,594)
	$ 13,559	$ 11,096

(二十)財務成本

	111年度	110年度
利息費用	$ 9,482	$ 9,034
其他財務費用	126	161
	$ 9,608	$ 9,195

(二十一)費用性質之額外資訊

	111年度	110年度
員工福利費用	$ 429,608	$ 460,616
折舊費用	$ 289,967	$ 257,336
無形資產攤銷費用	$ 6,197	$ 2,871

(二十二)員工福利費用

	111年度	110年度
薪資費用	$ 347,770	$ 387,597
股份基礎給付酬勞成本	1,114	-
勞健保費用	35,924	33,759
退休金費用	13,245	12,304
董事酬金	4,887	9,150
其他用人費用	26,668	17,806
	$ 429,608	$ 460,616

1. 依本公司民國 110 年 6 月 25 日修正後章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不高於 3%，員工酬勞不低於 10%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補累積虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

   依本公司民國 111 年 5 月 30 日及 111 年 8 月 2 日修正後章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不高於 3%，員工酬勞不高於 12%且不低於 5%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補累積虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本公司民國 111 年及 110 年度員工酬勞估列金額分別為$12,218 及$17,430；董事酬勞估列金額分別為$4,887 及$9,150，前述金額帳列薪資費用。

3. 經董事會決議之民國 110 年度員工酬勞$17,430 及董事酬勞$9,150，與民國 110 年度財務報告認列之金額一致。

4. 本公司董事會通過之員工酬勞及董事酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(二十三)所得稅

1.所得稅費用

(1)所得稅費用組成部分:

	111年度	110年度
當期所得稅:		
當期所得產生之所得稅	$ 46,981	$ 62,490
以前年度所得稅高低估	15,949	-
當期所得稅總額	62,930	62,490
遞延所得稅:		
暫時性差異之原始產生及迴轉	(4,059)	204
所得稅費用	$ 58,871	$ 62,694

(2)與其他綜合損益相關之所得稅金額:

	111年度	110年度
確定福利義務之再衡量數	($ 870)	$ 2,847

2.所得稅費用與會計利潤關係

	111年度	110年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅	$ 45,442	$ 64,503
按稅法規定應調整之收益	(2,520)	(1,408)
暫時性差異未認列遞延所得稅資產	-	(401)
以前年度所得稅低估數	15,949	-
所得稅費用	$ 58,871	$ 62,694

3. 因暫時性差異而產生之各遞延所得稅資產或負債金額如下：

	111年			
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合淨利	12月31日
遞延所得稅資產:				
-暫時性差異：				
預期信用減損損失	$ -	$ 3,748	$ -	$ 3,748
確定福利負債	3,617	-	(870)	2,747
其他	-	602	-	602
小計	$ 3,617	$ 4,350	($ 870)	$ 7,097
-遞延所得稅負債:				
其他	($ 615)	($ 291)	$ -	($ 906)
小計	($ 615)	($ 291)	$ -	($ 906)
合計	$ 3,002	$ 4,059	($ 870)	$ 6,191

	110年			
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合淨利	12月31日
遞延所得稅資產:				
-暫時性差異：				
確定福利負債	$ 770	$ -	$ 2,847	$ 3,617
小計	$ 770	$ -	$ 2,847	$ 3,617
-遞延所得稅負債:				
其他	($ 411)	($ 204)	$ -	($ 615)
小計	($ 411)	($ 204)	$ -	($ 615)
合計	$ 359	($ 204)	$ 2,847	$ 3,002

4. 未認列為遞延所得稅資產之可減除暫時性差異：

	111年12月31日	110年12月31日
可減除暫時性差異	$ -	$ 12,060

5. 本公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至民國 109 年度。

(二十四)每股盈餘

	111年度		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘(元)
基本每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 168,338	62,354	$ 2.70
稀釋每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 168,338	62,354	
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	571	
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 168,338	62,925	$ 2.68

	110年度		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘(元)
基本每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 259,823	60,263	$ 4.31
稀釋每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 259,823	60,263	
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	973	
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 259,823	61,236	$ 4.24

(二十五)現金流量補充資訊

1.僅有部分現金支付之投資活動：

	111年度	110年度
購置不動產、廠房及設備(含重分類)	$ 415,864	$ 467,204
加：期初應付設備款	106,449	12,594
減：期末應付設備款	(108,322)	(106,449)
加：期末預付設備款	56,365	26,852
減：期初預付設備款	(26,852)	(87,352)
本期支付現金	$ 443,504	$ 312,849

2. 本公司於民國 110 年 12 月 30 日出售子公司-微石開發股份有限公司 100%股權，致本公司喪失對該子公司之控制，該交易收取之對價及子公司相關資產及負債之資訊如下：

	110年12月30日
收取對價	
現金	$ 2,500
對價總額	2,500
子公司資產及負債帳面金額	
現金	$ 959
其他應收款	437
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	233
預付款項	197
其他非流動資產	564
其他應付款	(1,265)
淨資產總額	$ 1,125

(二十六)來自籌資活動之負債之變動

	111年			
	短期借款	租賃負債	長期借款	來自籌資活動之負債總額
1月1日	$ 80,000	$ 8,345	$ 454,549	$ 542,894
籌資現金流量之變動	(80,000)	(2,033)	69,893	(12,140)
利息支付數	-	(126)	-	(126)
租賃負債之利息	-	126	-	126
12月31日	$ -	$ 6,312	$ 524,442	$ 530,754

	110年			
	短期借款	租賃負債	長期借款	來自籌資活動之負債總額
1月1日	$ 240,373	$ -	$ 418,074	$ 658,447
籌資現金流量之變動	(157,500)	(1,999)	36,475	(123,024)
利息支付數	-	(161)	-	(161)
租賃負債之利息	-	161	-	161
其他非現金之流動	-	10,344	-	10,344
合併個體減少轉出數	(2,873)	-	-	(2,873)
12月31日	$ 80,000	$ 8,345	$ 454,549	$ 542,894

七、關係人交易

(一)關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
微石開發股份有限公司(註)	其他關係人
辰謙投資有限公司	其他關係人
張少謙	其他關係人

註:本公司業已於民國 110 年 12 月 30 日處份子公司-微石開發股份有限公司 100%股權。

(二)與關係人間之重大交易事項

1.其他交易及其他應付款

	111年		110年	
	金額	期末應付	金額	期末應付
其他關係人-				
管理費用-交際費	$ 3,909	$ 278	$ -	$ -
管理費用-其他	$ 445	$ -	$ -	$ -
管理費用-租金	$ -	$ -	$ 171	$ 15

2.財產交易

處分金融資產

本公司於民國 110 年 12 月 30 處分子公司-微石開發股份有限公司 100%股權與其他關係人張少謙，處分價款為$2,500，並認列處分投資利益$1,376。

(三)主要管理階層薪酬資訊

	111年度	110年度
短期員工福利	$ 21,284	$ 25,894
退職後福利	270	370
總計	$ 21,554	$ 26,264

八、質押之資產

本公司之資產提供擔保明細如下：

資產項目	帳面價值 111年12月31日	帳面價值 110年12月31日	擔保用途
土地	$ 225,914	$ 225,914	長、短期借款
房屋及建築	218,407	225,325	長、短期借款
機器設備	213,257	135,703	長期借款
其他設備	7,049	9,223	長期借款
存出保證金	3,011	2,435	關稅保證金
	$ 667,638	$ 598,600	

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

已簽約但尚未發生之資本支出

	111年12月31日	110年12月31日
不動產、廠房及設備	$ 520,154	$ 274,971

十、重大之災害損失

無。

十一、重大之期後事項

本公司於民國 112 年 3 月 15 日經董事會決議通過盈餘分配案，請詳附註六(十五)說明。

十二、其他

(一)資本管理

本集團之資本管理目標，係為保障公司能繼續經營，維持最佳資本結構以降低資金成本，並為股東提供報酬。為了維持或調整資本結構，本集團可能會調整支付予股東之股利金額、退還資本予股東、發行新股或出售資產以降低債務。本集團利用負債資本比率以監控其資本，該比率係按債務淨額除以資本總額計算。

	111年12月31日	110年12月31日
負債總額	$ 827,803	$ 916,320
資產總額	$ 2,177,523	$ 2,019,907
負債/資產比率	38%	45%

(二)金融工具

1.金融工具之種類

	111年12月31日	110年12月31日
金融資產		
按攤銷後成本衡量之金融資產		
現金及約當現金	334,482	251,427
按攤銷後成本衡量之金融資產	6,500	6,500
應收票據	974	1,155
應收帳款	246,026	346,290
其他應收款	2,584	677
存出保證金	3,011	2,795
	$ 593,577	$ 608,844
金融負債		
按攤銷後成本衡量之金融負債		
短期借款	$ -	$ 80,000
應付票據	2,555	23
應付帳款	19,338	26,601
其他應付款	226,405	257,760
長期借款(包含一年或一營業週期內到期)	524,442	454,549
	$ 772,740	$ 818,933
租賃負債	$ 6,312	$ 8,345

2.風險管理政策

(1)本集團日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險(包括匯率風險、利率風險、及價格風險)、信用風險及流動性風險。本集團整體風險管理著重於金融市場的不可預測事項，並尋求可降低對財務狀況及財務績效之不利影響。

(2)風險管理工作由本集團財務部按照董事會核准之政策執行。本集團財務部透過與集團內各營運單位密切合作，以負責辨認、評估與規避財務風險。財務風險管理政策業經定期覆核以反映市場情形及本集團運作之變化。

3.重大財務風險之性質及程度

(1)市場風險

匯率風險

A.本集團係跨國營運，因此受多種不同貨幣所產生之匯率風險，主要為美元。相關匯率風險來自未來之商業交易及已認列之資產與負債。

B.本集團以自然避險為原則，依據各幣別資金需求及淨部位(外幣資產與負債部位之差額)依照市場外匯狀況進行避險；當發生短期不平衡時，即藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保匯率風險保持在可接受水準。

C.本集團從事之業務涉及若干非功能性貨幣(本公司之功能性貨幣為新台幣)，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊如下：

	111年12月31日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 4,649	30.71	$ 142,761
金融負債			
貨幣性項目：無。			

	110年12月31日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 6,277	27.68	$ 173,747
金融負債			
貨幣性項目：無。			

D.本集團貨幣性項目因匯率波動具重大影響於民國111年及110年度認列之全部兌換利益(含已實現及未實現)彙總金額分別為$14,902及$3,921。

E.本集團因重大匯率波動影響之外幣市場風險分析如下：

	111年度		
	敏感度分析		
	變動幅度	影響損益	影響其他綜合損益
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	$ 1,428	$ -
金融負債			
貨幣性項目：無。			

	110年度		
	敏感度分析		
	變動幅度	影響損益	影響其他綜合損益
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	$ 1,737	$ -
金融負債			
貨幣性項目：無。			

價格風險

本集團未有重大商品價格風險之暴險。

現金流量及公允價值利率風險

A.本集團之利率風險主要來自短期及長期借款。按浮動利率之借款使本集團承受現金流量利率風險，部分風險被按浮動利率持有之現金及約當現金抵銷。按固定利率之借款則使本集團承受公允價值利率風險。於民國 111 年及 110 年 12 月 31 日，本集團按浮動利率計算之借款係以新台幣計價。

B.於民國 111 年及 110 年 12 月 31 日，若新台幣借款利率增加或減少 1%，在所有其他因素維持不變之情況下，民國 111 年及 110 年度之稅後淨利將分別減少或增加$4,196 及$4,276，主要係因浮動利率借款導致利息費用增加/減少。

(2)信用風險

A.本集團之信用風險係因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而導致本集團財務損失之風險，主要來自交易對手無法清償按收款條件支付之應收帳款，及分類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

B.本集團係以公司角度建立信用風險之管理。對於往來之銀行及金融機構，設定僅有信評等級良好者，始可被接納為交易對象。依內部明定之授信政策，公司內各營運合併與每一新客戶於訂定付款及提出交貨之條款與條件前，須對其進行管理及信用風險分析。內部風險控管係透過考慮其財務狀況、過往經驗及其他因素，以評估客戶之信用品質。個別風險之限額係管理階層依內部或外部之評等而制訂，並定期監控信用額度之使用。

C.本集團採用 IFRS 9 提供前提假設，當合約款項按約定之支付條款逾期超過 90 天，視為已發生違約。

D.本集團採用 IFRS 9 提供以下之前提假設，當合約款項按約定之支付條款逾期超過 30 天，視為金融資產自原始認列後信用風險已顯著增加之依據。

E.本集團用以判定債務工具投資為信用減損之指標如下：

(A)發行人發生重大財務困難，或將進入破產或其他財務重整之可能性大增；

(B)發行人由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失；

(C)發行人延滯或不償付利息或本金；

(D)導致發行人違約有關之全國性或區域性經濟情況不利之變化。

F.本集團經追索程序後，對無法合理預期可回收金融資產之金額予以沖銷，為本集團仍會持續進行追索之法律程序以保全債權之權利。

G.本集團持有之按攤銷後成本衡量之金融資產係屬存放於銀行之定期存款及受限制之定期存款，該等銀行之信用評等均為良好，過去未發生逾期之情形，且考量整體經濟環境無重大變動，故評估發生信用損失之風險極低，對財務報表之影響金額亦不大。

H.本集團按客戶評等之特性將對客戶之應收帳款分組，採用簡化作法以準備矩陣為基礎估計預期信用損失。

I.本集團對未來前瞻性的考量調整按特定期間歷史及現時資訊所建立之損失率，以估計應收帳款備抵損失，民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之準備矩陣如下：

	應收帳款					
	未逾期	逾期 1-30天	逾期 31-90天	逾期 91-180天	逾期 181天以上	合計
111年12月31日						
預期損失率	0%	1%	14%	100%	100%	
帳面價值總額	$236,852	$ -	$10,638	$ 43	$ 27	$247,560
備抵損失	$ -	$ -	$ 1,464	$ 43	$ 27	$ 1,534
110年12月31日	未逾期	逾期 1-30天	逾期 31-90天	逾期 91-180天	逾期 181天以上	合計
預期損失率	0%	1%	24%	51%	100%	
帳面價值總額	$340,296	$ 4,214	$ 1,665	$ 1,143	$ 11,239	$358,557
備抵損失	$ -	$ 35	$ 407	$ 586	$ 11,239	$ 12,267

J.本集團採簡化作法之應收帳款及合約資產備抵損失變動表如下：

	111年		
	合約資產	應收帳款	合計
1月1日	$ -	$ 12,267	$ 12,267
提列減損損失	8,717	-	8,717
因無法收回而沖銷之款項	-	(10,733)	(10,733)
12月31日	$ 8,717	$ 1,534	$ 10,251

	110年		
	合約資產	應收帳款	合計
1月1日	$ -	$ 11,444	$ 11,444
提列減損損失	-	823	823
12月31日	$ -	$ 12,267	$ 12,267

(3)流動性風險

A.現金流量預測是由公司內各營運合併執行，並由公司財務部予以彙總。公司財務部監控公司流動資金需求之預測，確保其有足夠資金得以支應營運需要，並在任何時候維持足夠之未支用的借款承諾額度，以使公司不致違反相關之借款限額或條款，此等預測考量公司之債務融資計畫、債務條款遵循、符合內部資產負債表之財務比率目標，及外部監管法令之要求。

B.各營運合併所持有之剩餘現金，在超過營運資金之管理所需時，將轉撥回公司財務部。公司財務部則將剩餘資金投資於定存存款，其所選擇之工具具有適當之到期日或足夠流動性，以因應上述預測並提供充足之調度水位。

C.下表係本集團之非衍生金融負債，按相關到期日予以分組，非衍生金融負債係依據資產負債表日至合約到期日之剩餘期間進行分析。下表所揭露之合約現金流量金額係未折現之金額（含本金及利息）：

111年12月31日	1年內	1至5年內	5年以上
非衍生金融負債:			
應付票據	$ 2,555	$ -	$ -
應付帳款	19,338	-	-
其他應付款	226,405	-	-
租賃負債	2,160	4,320	-
長期借款(包含一年內到期)	169,868	377,051	-

110年12月31日	1年內	1至5年內	5年以上
非衍生金融負債:			
短期借款	$ 80,212	$ -	$ -
應付票據	23	-	-
應付帳款	26,601	-	-
其他應付款	257,760	-	-
租賃負債	2,160	6,480	-
長期借款(包含一年內到期)	156,896	303,439	-

(三)公允價值資訊

1.為衡量金融及非金融工具之公允價值所採用評價技術的各等級定義如下：

第一等級：企業於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。活絡市場係指有充分頻率及數量之資產或負債交易發生，以在持續基礎上提供定價資訊之市場。本集團投資之上市櫃股票投資的公允價值皆屬之。

第二等級：資產或負債直接或間接之可觀察輸入值，但包括於第一等級之報價者除外。

第三等級：資產或負債之不可觀察輸入值。

2.非以公允價值衡量之金融工具

現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之金融資產、應收票據、應收帳款、其他應收款、存出保證金、短期借款、應付票據、應付帳款、其他應付款及長期借款的帳面金額係公允價值之合理近似值。

3.以公允價值衡量之金融及非金融工具，本集團依資產及負債之性質、特性及風險及公允價值等級之基礎分類，相關資訊如下：

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日：無。

4.本集團用以衡量公允價值所使用之方法及假設說明如下：

(1)金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以合併資產負債表日可取得之市場資訊運用模型計算而得。

(2)評價模型之產出係預估之概算值，而評價技術可能無法反映本集團持有金融工具及非金融工具之所有攸關因素。因此評價模型之預估值會適當地根據額外之參數予以調整，根據本集團之公允價值評價模型管理政策及相關之控制程序，管理階層相信為允當表達合併資產負債表中金融工具及非金融工具之公允價值，評價調整係屬適當且必要。在評價過程中所使用之價格資訊及參數係經審慎評估，且適當地根據目前市場狀況調整。

5.民國 111 年及 110 年度無第一等級與第二等級間之任何移轉。

6.下表列示民國 111 年及 110 年度第三等級權益工具之變動：

	111年	110年
1月1日	$ -	$ 25
本期出售	-	(25)
12月31日	$ -	$ -

7.本集團對於公允價值歸類於第三等級之評價流程係由財務部負責進行金融工具之獨立公允價值驗證，藉獨立來源資料使評價結果貼近市場狀態，並定期覆核，以確保評價結果係屬合理。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

1.資金貸與他人：無。

2.為他人背書保證：無。

3.期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分）：無。

4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

9.從事衍生工具交易：無。

10.母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額：無。

(二)轉投資事業相關資訊

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊（不包含大陸被投資公司）：無。

(三)大陸投資資訊

1.基本資料：無。

2.直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項：無。

十四、營運部門資訊

(一)一般性資訊

本集團管理階層已依據營運決策者於制定決策所使用之報導資訊辨認應報導部門。本集團營運決策者以營運個體之角度經營業務。本集團目前著重於台灣地區之積體電路測試業務。而子公司因非積體電路測試業務相關，其業務並未納入向營運決策者提交之報告中，故未包含於應報導部門中，這些經營結果表達於「其他」欄內。

(二)部門資訊之衡量

本集團營運決策者根據合併財務報表評估營運部門之績效。營運部門之會計政策皆與附註四所述之重要會計政策彙總說明相同。

(三)部門損益、資產及負債之資訊

提供予主要營運決策者之應報導部門資訊及調節如下：

111年度	微矽電子(股)公司	其他	調整及沖銷	合併
外部收入	$ 1,226,677	$ -	$ -	$ 1,226,677
部門間收入	$ -	$ -	$ -	$ -
部門稅前淨利	$ 227,209	$ -	$ -	$ 227,209
部門資產	$ 2,177,523	$ -	$ -	$ 2,177,523
部門負債	$ 827,803	$ -	$ -	$ 827,803

110年度	微矽電子(股)公司	其他	調整及沖銷	合併
外部收入	$ 1,291,176	$ 1,203	$ -	$ 1,292,379
部門間收入	$ -	$ 4,542	($ 4,542)	$ -
部門稅前淨利	$ 322,021	$ 9,471	($ 8,975)	$ 322,517
部門資產	$ 2,019,907	$ -	$ -	$ 2,019,907
部門負債	$ 916,320	$ -	$ -	$ 916,320

(四)部門損益之調節資訊

本集團向營運決策者呈報之部門資產、負債及稅前淨利，與合併資產負債表及合併綜合損益表係採用一致之衡量方式，故無需予以調節。

(五)產品別及勞務別之資訊

請詳附註六(十六)。

(六)地區別資訊

本集團民國 111 年及 110 年度地區別資訊如下：

	111年度		110年度	
	收入	非流動資產	收入	非流動資產
台灣	$ 1,051,798	$ 1,459,095	$ 1,159,739	$ 1,324,104
亞洲	57,702	-	65,813	-
美洲	114,066	-	65,456	-
歐洲	3,111	-	1,371	-
合計	$ 1,226,677	$ 1,459,095	$ 1,292,379	$ 1,324,104

(七)重要客戶資訊

本集團民國 111 年及 110 年度重要客戶資訊如下：

	111年度	110年度
	收入	收入
乙	$ 173,976	$ 177,851
丙	134,802	123,604

台灣省會計師公會會員印鑑證明書 台省財證字第 1120260 號

會員姓名：(1) 李 典 易
(2) 白 淑 蒨

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

事務所地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

事務所電話：(02)27296666　　事務所統一編號：03932533

會員證書字號：(1) 台省會證字第 4112 號　　委託人統一編號：22579547
(2) 台省會證字第 4895 號

印鑑證明書用途：辦理　微矽電子股份有限公司　111 年度
（自民國 111 年 1 月 1 日至
111 年 12 月 31 日）財務報表之查核簽證。

簽名式（一）	李典易	存會印鑑（一）	
簽名式（二）	白淑蒨	存會印鑑（二）	

理事長：　　核對人：

中 華 民 國 112 年 2 月 14 日

附件二

111 年度個體財務報告及會計師查核報告

微矽電子股份有限公司

個體財務報告暨會計師查核報告

民國 111 年度及 110 年度

（股票代碼 8162）

公司地址：新竹縣竹東鎮沿河街 395 號

電　　話：037-587222

微矽電子股份有限公司

民國 111 年度及 110 年度個體財務報告暨會計師查核報告

目　　錄

項　　目	頁　　次
一、　封面	1
二、　目錄	2 ~ 3
三、　會計師查核報告	4 ~ 7
四、　個體資產負債表	8 ~ 9
五、　個體綜合損益表	10
六、　個體權益變動表	11
七、　個體現金流量表	12 ~ 13
八、　個體財務報表附註	14 ~ 49
（一）　公司沿革	14
（二）　通過財務報告之日期及程序	14
（三）　新發布及修訂準則及解釋之適用	14 ~ 15
（四）　重大會計政策之彙總說明遵循聲明	15 ~ 22
（五）　重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	22
（六）　重要會計項目之說明	23 ~ 40
（七）　關係人交易	40 ~ 41
（八）　質押之資產	41
（九）　重大或有負債及未認列之合約承諾	41

項　　目	頁　　次
(十)　重大之災害損失	41
(十一)重大之期後事項	41
(十二)其他	42 ~ 49
(十三)附註揭露事項	49
(十四)部門資訊	49
九、　重要會計項目明細表	50 ~ 62

pwc 資誠

會計師查核報告

(112)財審報字第 22003366 號

微矽電子股份有限公司　公鑒：

查核意見

微矽電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則，足以允當表達微矽電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與微矽電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對微矽電子股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F:+ 886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

微矽電子股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

收入認列之正確性

事項說明

有關營業收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四、(二十二)，營業收入項目請詳個體財務報告附註六、(十七)。微矽電子股份有限公司主要提供各種積體電路之研發與測試服務，該勞務收入係隨時間逐步移轉對勞務之控制而逐步滿足履約義務並認列收入。考量營業收入對整體財務報告有重大影響，因此本會計師將收入認列之正確性列為查核最為重要事項。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 與管理當局訪談以瞭解及評估收入認列有關會計政策，並測試相關內部控制設計及執行情形。
2. 選取樣本執行交易詳細測試並覆核合約之履約義務、價格及提供勞務之佐證資料，確認收入認列之正確性。
3. 檢視資產負債表日履約義務完成程度之評估程序及相關佐證文件，並抽核衡量履約義務完成程度之相關資料，確認收入認列之正確性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估微矽電子股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算微矽電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

微矽電子股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

pwc 資誠

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對微矽電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使微矽電子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致微矽電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

pwc 資誠

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於微矽電子股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報告之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對微矽電子股份有限公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

白淑蒨

金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
金管證審字第 1110349013 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 5 日

微矽電子股份有限公司
個體資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 334,482	16	$ 251,427	13
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		6,500	-	6,500	-
1140	合約資產－流動	六(十七)	89,407	4	61,406	3
1150	應收票據淨額		974	-	1,155	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	246,026	11	346,290	17
1200	其他應收款		2,584	-	677	-
130X	存貨	六(三)	15,053	1	14,598	1
1410	預付款項		13,294	1	6,690	-
1470	其他流動資產		-	-	648	-
11XX	**流動資產合計**		708,320	33	689,391	34
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八	1,381,256	63	1,282,471	64
1755	使用權資產	六(六)	6,207	-	8,276	-
1780	無形資產	六(七)	15,267	1	6,505	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	7,097	-	3,617	-
1900	其他非流動資產	六(八)及八	59,376	3	29,647	2
15XX	**非流動資產合計**		1,469,203	67	1,330,516	66
1XXX	**資產總計**		$ 2,177,523	100	$ 2,019,907	100

（續次頁）

微矽電子股份有限公司
個體資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(九)	$ -	-	$ 80,000	4
2130	合約負債－流動	六(十七)	5,023	-	296	-
2150	應付票據		2,555	-	23	-
2170	應付帳款		19,338	1	26,601	1
2200	其他應付款	六(十)及七	226,405	11	257,760	13
2230	本期所得稅負債		7,976	-	47,992	2
2280	租賃負債－流動		2,160	-	2,160	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)	166,776	8	156,562	8
2399	其他流動負債－其他		2,999	-	2,940	-
21XX	**流動負債合計**		433,232	20	574,334	28
	非流動負債					
2540	長期借款	六(十一)	357,666	16	297,987	15
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	906	-	615	-
2580	租賃負債－非流動		4,152	-	6,185	-
2600	其他非流動負債	六(十二)	31,847	2	37,199	2
25XX	**非流動負債合計**		394,571	18	341,986	17
2XXX	**負債總計**		827,803	38	916,320	45
	權益					
	股本	六(十四)				
3110	普通股股本		646,600	30	610,000	30
	資本公積	六(十五)				
3200	資本公積		142,989	6	13,775	1
	保留盈餘	六(十六)				
3310	法定盈餘公積		81,523	4	49,980	3
3350	未分配盈餘		478,608	22	429,832	21
3XXX	**權益總計**		1,349,720	62	1,103,587	55
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
	重大之期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 2,177,523	100	$ 2,019,907	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司
個體綜合損益表
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	項目	附註	111 年度 金額	%	110 年度 金額	%
4000	營業收入	六(十七)	$ 1,226,677	100	$ 1,291,177	100
5000	營業成本	六(三)(二十二)(二十三)	(823,369)	(67)	(775,456)	(60)
5900	營業毛利		403,308	33	515,721	40
	營業費用	六(二十二)(二十三)				
6100	推銷費用		(14,886)	(1)	(13,122)	(1)
6200	管理費用		(105,645)	(8)	(125,575)	(10)
6300	研究發展費用		(69,578)	(6)	(64,391)	(5)
6450	預期信用減損損失	十二(二)	(8,717)	(1)	(823)	-
6000	營業費用合計		(198,826)	(16)	(203,911)	(16)
6900	營業利益		204,482	17	311,810	24
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(十八)	738	-	105	-
7010	其他收入	六(十九)	18,038	2	10,242	1
7020	其他利益及損失	六(四)(二十)	13,559	1	10,961	1
7050	財務成本	六(二十)	(9,608)	(1)	(9,193)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	-	-	(1,903)	-
7000	營業外收入及支出合計		22,727	2	10,212	1
7900	**稅前淨利**		227,209	19	322,022	25
7950	所得稅費用	六(二十四)	(58,871)	(5)	(62,199)	(5)
8200	**本期淨利**		$ 168,338	14	$ 259,823	20
	其他綜合損益					
	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		$ 4,351	-	($ 14,237)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(870)	-	2,847	-
8300	**其他綜合損益(淨額)**		$ 3,481	-	($ 11,390)	(1)
8500	**本期綜合損益總額**		$ 171,819	14	$ 248,433	19
	基本每股盈餘	六(二十五)				
9750	基本每股盈餘		$ 2.70		$ 4.31	
	稀釋每股盈餘	六(二十五)				
9850	稀釋每股盈餘		$ 2.68		$ 4.24	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司
個體權益變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	庫藏股票	權益總額
110年度							
110年1月1日餘額		$ 610,000	$ -	$ 39,273	$ 253,106	($ 43,094)	$ 859,285
本期淨利		-	-	-	259,823	-	259,823
本期其他綜合損益		-	-	-	(11,390)	-	(11,390)
本期綜合損益總額		-	-	-	248,433	-	248,433
109年度盈餘指撥及分派	六(十六)						
提列法定盈餘公積		-	-	10,707	(10,707)	-	-
現金股利		-	-	-	(61,000)	-	(61,000)
庫藏股轉讓予員工	六(十四)(十五)	-	2,898	-	-	20,828	23,726
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	六(十四)(十五)	-	10,877	-	-	22,266	33,143
110年12月31日餘額		$ 610,000	$ 13,775	$ 49,980	$ 429,832	$ -	$ 1,103,587
111年度							
111年1月1日餘額		$ 610,000	$ 13,775	$ 49,980	$ 429,832	$ -	$ 1,103,587
本期淨利		-	-	-	168,338	-	168,338
本期其他綜合損益		-	-	-	3,481	-	3,481
本期綜合損益總額		-	-	-	171,819	-	171,819
110年度盈餘指撥及分派	六(十六)						
提列法定盈餘公積		-	-	31,543	(31,543)	-	-
現金股利		-	-	-	(91,500)	-	(91,500)
現金增資	六(十四)(十五)	36,600	128,100	-	-	-	164,700
股份基礎給付酬勞成本	六(十三)(十五)	-	1,114	-	-	-	1,114
111年12月31日餘額		$ 646,600	$ 142,989	$ 81,523	$ 478,608	$ -	$ 1,349,720

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司
個體現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111年1月1日至12月31日	110年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		$ 227,209	$ 322,022
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(五)(六)(二十二)	289,967	257,286
攤提費用	六(七)(二十二)	6,197	2,871
預期信用減損損失	十二(二)	8,717	823
利息費用	六(二十一)	9,608	9,193
利息收入	六(十八)	(738)	(105)
股份基礎給付酬勞成本	六(十三)(二十三)	1,114	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十)	1,104	(13,259)
採權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	-	1,903
處分投資利益	六(四)(二十)	-	(1,376)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產		(36,718)	28,813
應收票據		181	822
應收帳款		100,264	(56,203)
其他應收款		(1,907)	3,428
存貨		(455)	4,752
預付款項		(6,604)	(3,009)
其他流動資產		648	(614)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		4,727	224
應付票據		2,532	23
應付帳款		(7,263)	964
其他應付款		(33,399)	24,309
其他流動負債		59	479
應計退休金負債		(1,001)	(1,022)
營運產生之現金流入		564,242	582,324
收取之利息		738	102
收取之股利		-	7,116
支付之利息		(9,437)	(9,341)
支付所得稅		(102,946)	(37,363)
營業活動之淨現金流入		452,597	542,838

(續次頁)

微矽電子股份有限公司
個體現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111年1月1日至12月31日	110年1月1日至12月31日
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		$ -	($ 6,500)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		-	6,400
處分透過其他綜合損益按公允衡量之金融資產價款		-	25
採權益法之被投資公司減資退回股款	六(四)	-	22,000
處分採用權益法之投資價款		-	2,500
取得不動產、廠房及設備	六(二十六)	(443,504)	(312,849)
處分不動產、廠房及設備價款		28,077	18,204
取得無形資產	六(七)	(14,959)	-
存出保證金增加		(216)	(367)
投資活動之淨現金流出		(430,602)	(270,587)
籌資活動之現金流量			
短期借款舉借	六(二十七)	630,000	542,500
短期借款償還	六(二十七)	(710,000)	(700,000)
長期借款舉借	六(二十七)	260,000	216,700
長期借款償還	六(二十七)	(190,107)	(180,225)
租賃負債本金償還	六(二十七)	(2,033)	(1,999)
發放現金股利	六(十六)	(91,500)	(61,000)
庫藏股轉讓予員工		-	23,726
現金增資	六(十四)	164,700	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		61,060	(160,298)
本期現金及約當現金增加數		83,055	111,953
期初現金及約當現金餘額	六(一)	251,427	139,474
期末現金及約當現金餘額	六(一)	$ 334,482	$ 251,427

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司

個 體 財 務 報 表 附 註

民國 111 年度及 110 年度

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

一、公司沿革

微矽電子股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於中華民國 76 年 8 月 11 日設立，本公司主要營業項目為各型積體電路之設計、加工、測試製造買賣等。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國 112 年 3 月 15 日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可並發布生效之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可並發布生效之民國 111 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「對觀念架構之索引」	民國111年1月1日
國際會計準則第16號之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	民國111年1月1日
國際會計準則第37號之修正「虧損性合約—履行合約之成本」	民國111年1月1日
2018-2020週期之年度改善	民國111年1月1日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二)尚未採用金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 112 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」	民國112年1月1日
國際會計準則第8號之修正「會計估計之定義」	民國112年1月1日
國際會計準則第12號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	民國112年1月1日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

(三)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	待國際會計準則理事會決定
國際財務報導準則第16號之修正「售後租回中之租賃負債」	民國113年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」之修正	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號之修正「初次適用國際財務報導準則第17號及國際財務報導準則第9號—比較資訊」	民國112年1月1日
國際會計準則第1號之修正「負債之流動或非流動分類」	民國113年1月1日
國際會計準則第1號之修正「具合約條款之非流動負債」	民國113年1月1日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

四、重大會計政策之彙總說明遵循聲明

編製本個體財務報告所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一)遵循聲明

本個體財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則編製。

(二)編製基礎

1.除下列重要項目外，本個體財務報告係按歷史成本編製：

(1)按公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。

(2)按退休基金資產減除確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。

2.編製符合金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱 IFRSs)之財務報告需要使用一些重要會計估計，在應用本公司的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷，涉及高度判斷或複雜性之項目，或涉及個體財務報告之重大假設及估計之項目，請詳附註五說明。

(三)外幣換算

本公司個體財務報告所列之項目，均以營運所處主要經濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

外幣交易及餘額

1.外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣，換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。

2.外幣貨幣性資產及負債餘額，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之換算差額認列為當期損益。

3.外幣非貨幣性資產及負債餘額，屬透過損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列為當期損益，屬非按公允價值衡量者，則按初始交易日之歷史匯率衡量。

4.所有其他兌換損益按交易性質在損益表之其他利益及損失列報。

(四)資產負債區分流動及非流動之分類標準

1.資產符合下列條件之一者，分類為流動資產：

(1)預期將於正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗者。
(2)主要為交易目的而持有者。
(3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
(4)現金或約當現金，但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償負債受到限制者除外。

本公司將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。

2.負債符合下列條件之一者，分類為流動負債：

(1)預期將於正常營業週期中清償者。
(2)主要為交易目的而持有者。
(3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
(4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款，可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致清償者，不影響其分類。

本公司將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

(五)約當現金

約當現金係指短期並具高度流動性之投資，該投資可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小。定期存款符合前述定義且其持有目的係為滿足營運上之短期現金承諾者，分類為約當現金。

(六)按攤銷後成本衡量之金融資產

1.係指同時符合下列條件者：

(1)在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。

(2)該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

2.本公司對於符合交易慣例之按攤銷後成本衡量之金融資產係採用交易日會計。

3.本公司於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量，後續採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息收入，及認列減損損失，並於除列時，將其利益或損失認列於損益。

4.本公司持有不符合約當現金之定期存款，因持有期間短，折現之影響不重大，係以投資金額衡量。

(七)應收帳款及票據

1.係指依合約約定，已具無條件收取因移轉商品或勞務所換得對價金額權利之帳款及票據。

2.屬未付息之短期應收帳款及票據，因折現之影響不大，本公司係以原始發票金額衡量。

(八)金融資產減損

本公司於每一資產負債表日，就按攤銷後成本衡量之金融資產，考量所有合理且可佐證之資訊(包括前瞻性者)後，對自原始認列後信用風險並未顯著增加者，按 12 個月預期信用損失金額衡量備抵損失；對自原始認列後信用風險已顯著增加者，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失；就不包含重大財務組成部分之應收帳款，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失。

(九)金融資產之除列

當本公司對收取來自金融資產現金流量之合約權利失效時，將除列金融資產。

(十)存貨

存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量，成本依加權平均法決定。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法，淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(十一)採用權益法之投資—子公司

1. 子公司指受本公司控制之個體，當本公司暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利，且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時，本公司即控制該個體。

2. 本公司與子公司間交易所產生之未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整，與本公司採用之政策一致。

3. 本公司對子公司取得後之損益份額認列為當期損益，對其取得後之其他綜合損益份額則認列為其他綜合損益。如本公司對子公司所認列之損失份額等於或超過在該子公司之權益時，本公司繼續按持股比例認列損失。

4. 依證券發行人財務報告編製準則規定，個體財務報告當期損益及其他綜合損益應與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，個體財務報告業主權益應與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

(十二)不動產、廠房及設備

1. 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。

2. 後續成本只有在與該項目有關之未來經濟效益很有可能流入本公司，且該項目之成本能可靠衡量時，才包括在資產之帳面金額或認列為一項單獨資產。被重置部分之帳面金額應除列。所有其他維修費用於發生時認列為當期損益。

3. 不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式，其他按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成若屬重大，則單獨提列折舊。

4. 本公司於每一財務年度結束對各項資產之殘值、耐用年限及折舊方法進行檢視，若殘值及耐用年限之預期值與先前之估計不同時，或資產所含之未來經濟效益之預期消耗型態已有重大變動，則自變動發生日起依國際會計準則第 8 號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之會計估計變動規定處理。

各項資產之耐用年限如下：

房屋及建築	4年 ～ 55年
機器設備	1.5年 ～ 6年
運輸設備	4年 ～ 6年
其他設備	2年 ～ 10年

(十三)承租人之租賃交易－使用權資產/租賃負債

1. 租賃資產於可供本公司使用之日認列為使用權資產及租賃負債。當租賃合約係屬短期租賃或低價值標的資產之租賃時，將租賃給付採直線法於租賃期間認列為費用。

2. 租賃負債於租賃開始日將尚未支付之租賃給付按本公司增額借款利率折現後之現值認列，租賃給付為固定給付，減除可收取之任何租賃誘因。後續採利息法按攤銷後成本法衡量，於租賃期間提列利息費用。當非屬合約修改造成租賃期間或租賃給付變動時，將重評估租賃負債，並將再衡量數調整使用權資產。

3. 使用權資產於租賃開始日按成本認列，成本包括：

   (1)租賃負債之原始衡量金額；及

   (2)於開始日或之前支付之任何租賃給付。

   後續採成本模式衡量，於使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者，提列折舊費用。當租賃負債重評估時，使用權資產將調整租賃負債之任何再衡量數。

(十四)無形資產

無形資產主係電腦軟體，採直線法攤銷，攤銷年限為 3～6 年。

(十五)非金融資產減損

本公司於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減處分成本或其使用價值，兩者較高者。當以前年度已認列資產減損之情況不存在或減少時，則迴轉減損損失，惟迴轉減損損失而增加之資產帳面金額，不超過該資產若未認列減損損失情況下減除折舊或攤銷後之帳面金額。

(十六)借款

係指向銀行借入之長、短期款項。本公司於原始認列時按其公允價值減除交易成本衡量，後續就減除交易成本後之價款與贖回價值之任何差額，採

有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息費用於損益。

(十七)應付帳款及票據

1.係指因賒購原物料、商品或勞務所發生之債務及因營業與非因營業而發生之應付票據。

2.屬未付息之短期應付帳款及票據，因折現之影響不大，本公司係以原始發票金額衡量。

(十八)員工福利

1.短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

2.退休金

(1)確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

(2)確定福利計畫

A.確定福利計畫下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算，並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算，折現率則參考資產負債表日與確定福利計畫之貨幣及期間一致之高品質公司債之市場殖利率決定；在高品質公司債無深度市場之國家，係使用政府公債(於資產負債表日)之市場殖利率。

B.確定福利計畫產生之再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益，並表達於其他權益。

3.員工酬勞及董事酬勞

員工酬勞及董事酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。另以股票發放員工酬勞者，計算股數之基礎為董事會決議日前一日收盤價。

(十九)所得稅

1. 所得稅費用包含當期及遞延所得稅。除與列入其他綜合損益或直接列入權益之項目有關之所得稅分別列入其他綜合損益或直接列入權益外，所得稅係認列於損益。

2. 本公司依據營運及產生應課稅所得之所在國家在資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率計算當期所得稅。管理階層就適用所得稅相關法規定期評估所得稅申報之狀況，並在適用情況下根據預期須向稅捐機關支付之稅款估列所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵之所得稅，嗣盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。

3. 遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於合併資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易（不包括企業合併）中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得(課稅損失)，則不予認列。若投資子公司及關聯企業產生之暫時性差異，本公司可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法或已實質性立法，並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率（及稅法）為準。

4. 遞延所得稅資產於暫時性差異很有可能用以抵減未來應課稅所得之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。

(二十)股本

普通股分類為權益。直接歸屬於發行新股或認股權之增額成本以扣除所得稅後之淨額於權益中列為價款減項。

(二十一)股利分配

分派予本公司股東之股利於本公司股東會決議分派股利時於財務報告認列，分派現金股利認列為負債，分派股票股利則認列為待分配股票股利，並於發行新股基準日時轉列普通股。

(二十二)收入認列

勞務收入

1. 本公司提供積體電路之研發與測試相關業務。若符合(a)隨企業之履約能使客戶同時取得及耗用企業提供之效益、(b)企業之履約創造或強化一資產且履約過程係由客戶控制該資產、(c)企業之履約並未創造對其具有其他用途之資產，且對迄今已完成履約之款項具有可執行權利之任一條件，則企業係隨時間逐步移轉對商品或勞務之控制，因而隨時間逐步滿足履約義務並認列收入。本公司提供之測試服務係符合上述(b)條件，應隨時間逐步認列收入，並以衡量履約義務完成程度認列收入。客戶依照所協議之付款時間表支付測試服務價款，當本公司已提供之服務超過客戶應付款時認列為合約資產，若客戶應付款超過本公司已提供之服務時則認列為合約負債。
2. 因移轉所承諾之商品或服務予客戶與客戶付款間之時間間隔未有超過一年者，因此本公司並未調整交易價格以反映貨幣時間價值。
3. 客戶依照所協議之付款時間表支付測試服務價款，當本公司已提供之服務超過客戶應付款時認列為合約資產，若客戶應付款超過本公司已提供之服務時則認列為合約負債。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司編製本個體財務報告時，管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政策，並依據資產負債表日當時之情況對於未來事件之合理預期以作出會計估計及假設。所作出之重大會計估計與假設可能與實際結果存有差異，將考量歷史經驗及其他因子持續評估及調整。該等估計及假設具有導致資產及負債帳面金額於下個財務年度重大調整之風險。請詳下列對重大會計判斷、估計與假設不確定性之說明：

(一)會計政策採用之重要判斷

無。

(二)重要會計估計及假設

無。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	111年12月31日	110年12月31日
庫存現金及週轉金	$ 175	$ 305
支票存款及活期存款	334,307	251,122
合計	$ 334,482	$ 251,427

1. 本公司往來之金融機構信用品質良好，且本公司與多家金融機構往來以分散信用風險，預期發生違約之可能性甚低。

2. 本公司未有將現金及約當現金提供質押之情形。

(二)應收帳款

	111年12月31日	110年12月31日
應收帳款	$ 247,560	$ 358,557
減：備抵損失	(1,534)	(12,267)
	$ 246,026	$ 346,290

1. 應收帳款之帳齡分析如下：

	111年12月31日	110年12月31日
	應收帳款	應收帳款
未逾期	$ 236,852	$ 340,296
30天內	-	4,214
31-90天	10,638	1,665
91-180天	43	1,143
181天以上	27	11,239
	$ 247,560	$ 358,557

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

2. 民國 111 年及 110 年 12 月 31 之應收帳款餘額均為為客戶合約所產生，另於民國 110 年 1 月 1 日客戶合約之應收款餘額為$302,354。

3. 在不考慮所持有之擔保品或其他信用增強之情況下，最能代表本公司應收帳款於民國 111 年及 110 年 12 月 31 日信用風險最大之暴險金額分別為$246,026 及$346,290。

4. 相關應收帳款信用風險資訊請詳附註十二、(二)。

(三)存貨

	111年12月31日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原物料	$ 17,269	($ 2,216)	$ 15,053

	110年12月31日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原物料	$ 14,598	$ -	$ 14,598

本公司當期認列為費損之存貨成本：

	111年度	110年度
已出售存貨成本	$ 82,114	$ 91,436
存貨跌價及呆滯損失	2,216	-
	$ 84,330	$ 91,436

(四)採用權益法之投資

	111年12月31日	110年12月31日
子公司：		
微石開發股份有限公司	$ -	$ -

1. 民國 110 年度按權益法認列之投資損失為($1,903)。

2. 微石公司於民國 110 年 6 月辦理減資，本公司收到其減資退回股款計$22,000。另本公司於民國 110 年 12 月 30 日處分微石公司 100%股權，並認列處分投資利益$1,376(帳列”其他利益及損失”)。

(五)不動產、廠房及設備

	土地	房屋及建築	機器設備	運輸設備	其他設備	未完工程及待驗設備	合計
111年1月1日							
成本	$ 225,914	$ 337,506	$ 1,003,982	$ 17,166	$ 427,620	$ 11,984	2,024,172
累計折舊及減損	-	(112,181)	(424,396)	(10,699)	(194,425)	-	(741,701)
	$ 225,914	$ 225,325	$ 579,586	$ 6,467	$ 233,195	$ 11,984	$ 1,282,471
111年							
1月1日	$ 225,914	$ 225,325	$ 579,586	$ 6,467	$ 233,195	$ 11,984	$ 1,282,471
增添	-	-	230,264	1,665	45,704	138,231	415,864
處分	-	-	(20,939)	-	(8,242)	-	(29,181)
重分類	-	-	7,921	-	-	(7,921)	-
折舊費用	-	(6,918)	(193,102)	(2,521)	(85,357)	-	(287,898)
12月31日	$ 225,914	$ 218,407	$ 603,730	$ 5,611	$ 185,300	$ 142,294	$ 1,381,256
111年12月31日							
成本	$ 225,914	$ 337,506	$ 1,177,538	$ 18,831	$ 447,215	$ 142,294	$ 2,349,298
累計折舊及減損	-	(119,099)	(573,808)	(13,220)	(261,915)	-	(968,042)
	$ 225,914	$ 218,407	$ 603,730	$ 5,611	$ 185,300	$ 142,294	$ 1,381,256

	土地	房屋及建築	機器設備	運輸設備	其他設備	未完工程及待驗設備	合計
110年1月1日							
成本	$ 225,914	$ 338,979	$ 2,142,422	$ 20,046	$ 632,895	$ 5,872	3,366,128
累計折舊及減損	-	(107,373)	(1,804,294)	(10,023)	(369,009)	-	(2,290,699)
	$ 225,914	$ 231,606	$ 338,128	$ 10,023	$ 263,886	$ 5,872	$ 1,075,429
110年							
1月1日	$ 225,914	$ 231,606	$ 338,128	$ 10,023	$ 263,886	$ 5,872	$ 1,075,429
增添	-	615	345,671	-	51,415	9,002	406,703
處分	-	-	(2,053)	-	(2,892)	-	(4,945)
重分類	-	-	53,538	-	9,853	(2,890)	60,501
折舊費用	-	(6,896)	(155,698)	(3,556)	(89,067)	-	(255,217)
12月31日	$ 225,914	$ 225,325	$ 579,586	$ 6,467	$ 233,195	$ 11,984	$ 1,282,471
110年12月31日							
成本	$ 225,914	$ 337,506	$ 1,003,982	$ 17,166	$ 427,620	$ 11,984	$ 2,024,172
累計折舊及減損	-	(112,181)	(424,396)	(10,699)	(194,425)	-	(741,701)
	$ 225,914	$ 225,325	$ 579,586	$ 6,467	$ 233,195	$ 11,984	$ 1,282,471

1.不動產、廠房及設備借款成本資本化金額及利率區間：

	111年度	110年度
資本化金額	$ 2,252	$ 1,271
資本化利率區間	1.70%~2.12%	1.71%~1.78%

2.以不動產、廠房及設備提供擔保之資訊，請詳附註八之說明。

(六)租賃交易－承租人

1. 本公司租賃之標的資產為停車場，租賃合約之期間通常介於 1 到 5 年。租賃合約是採個別協商並包含各種不同的條款及條件，除租賃之資產不得用作借貸擔保外，未有加諸其他之限制。本公司本公司承租之電瓶及保管箱因租賃期間不超過 12 個月而歸屬為短期租賃合約。

2. 使用權資產之帳面價值與認列之折舊費用資訊如下：

	帳面金額	
	111年12月31日	110年12月31日
停車場	$ 6,207	$ 8,276

	折舊費用	
	111年度	110年度
停車場	$ 2,069	$ 2,069

4. 本公司於民國 111 年及 110 年度使用權資產之增添分別為$0 及$10,344。

5. 與租賃合約有關之損益項目資訊如下：

	111年度	110年度
影響當期損益之項目		
租賃負債之利息費用	$ 126	$ 161
屬短期租賃合約之費用	45	52

6. 本公司於民國 111 年及 110 年度租賃現金流出總額分別為$2,204 及$2,212。

（七）無形資產

	電腦軟體
111年1月1日	
成本	$ 14,686
累計攤銷及減損	(8,181)
	$ 6,505
111年	
1月1日	$ 6,505
增添	14,959
攤銷費用	(6,197)
12月31日	$ 15,267
111年12月31日	
成本	$ 29,645
累計攤銷及減損	(14,378)
	$ 15,267

	電腦軟體
110年1月1日	
成本	$ 36,556
累計攤銷及減損	(27,180)
	$ 9,376
110年	
1月1日	$ 9,376
攤銷費用	(2,871)
12月31日	$ 6,505
110年12月31日	
成本	$ 14,686
累計攤銷及減損	(8,181)
	$ 6,505

無形資產攤銷明細如下：

	111年度	110年度
管理費用	$ 3,145	$ 2,871
製造費用	3,052	-
	$ 6,197	$ 2,871

(八)其他非流動資產

	111年12月31日	110年12月31日
預付設備款	$ 56,365	$ 26,852
存出保證金	3,011	2,795
合計	$ 59,376	$ 29,647

(九)短期借款

民國 111 年 12 月 31 日：無。

借款性質	110年12月31日	利率區間	擔保品
銀行借款			
信用借款	$ 80,000	1.52%～1.69%	無

(十)其他應付款

	111年12月31日	110年12月31日
應付薪資及獎金	$ 43,178	$ 55,870
應付員工及董事酬勞	17,105	26,581
應付未休假獎金	4,074	4,664
應付設備款	108,322	106,449
其他	53,726	64,196
	$ 226,405	$ 257,760

(十一)長期借款

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	111年12月31日
長期銀行借款				
擔保借款	自107年9月10日至118年5月11日，依議定期間及分額攤還	1.87%～2.28%	註	$ 365,443
信用借款	自109年4月27日至118年5月11日，依議定期間及分額攤還	1.85%～2.33%	無	158,999
				524,442
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(166,776)
				$ 357,666

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	110年12月31日
長期銀行借款				
擔保借款	自106年9月15日至115年10月5日，依議定期間及分額攤還	1.49%～1.80%	註	$ 429,083
信用借款	自109年4月27日至112年4月27日，依議定期間及分額攤還	1.70%～1.98%	無	25,466
				454,549
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(156,562)
				$ 297,987

註：有關長期借款擔保品價值，請詳附註八。

(十二)退休金

1.(1)本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算，15 年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。

(2)資產負債表認列之金額如下：

	111年12月31日	110年12月31日
確定福利義務現值	($ 58,403)	($ 60,574)
計畫資產公允價值	26,556	23,375
淨確定福利負債	($ 31,847)	($ 37,199)

(3)淨確定福利負債之變動如下：

	111年		
	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
1月1日	($ 60,574)	$ 23,375	($ 37,199)
利息(費用)收入	(316)	77	(239)
	(60,890)	23,452	(37,438)
再衡量數：			
計畫資產報酬(不包括包含於利息收入或費用之金額)	-	1,864	1,864
財務假設變動影響數	2,221	-	2,221
經驗調整	266	-	266
	2,487	1,864	4,351
提撥退休基金	-	1,240	1,240
12月31日	($ 58,403)	$ 26,556	($ 31,847)

	110年		
	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
1月1日	($ 45,859)	$ 21,875	($ 23,984)
利息(費用)收入	(112)	41	(71)
	(45,971)	21,916	(24,055)
再衡量數：			
計畫資產報酬(不包括包含於利息收入或費用之金額)	-	366	366
人口統計假設變動影響數	(183)	-	(183)
財務假設變動影響	1,386	-	1,386
經驗調整	(15,806)	-	(15,806)
	(14,603)	366	(14,237)
提撥退休基金	-	1,093	1,093
12月31日	($ 60,574)	$ 23,375	($ 37,199)

(4)本公司之確定福利退休計畫基金資產，係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計畫所定委託經營項目之比例及金額範圍內，依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目（即存放國內外之金融機構，投資國內外上市、上櫃或私募之權益證券及投資國內外不動產之證券化商品等）辦理委託經營，相關運用情形係由勞工退休基金監理會進行監督。該基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益，若有不足，則經主管機關核准後由國庫補足。因本公司無權參與該基金之運作及管理，故無法依國際會計準則第 19 號第 142 段規定揭露計劃資產公允價值之分類。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日構成該基金總資產之公允價值，請詳政府公告之各年度之勞工退休基金運用報告。

(5)有關退休金之精算假設彙總如下：

	111年度	110年度
折現率	1.20%	0.65%
未來薪資增加率	3.00%	3.00%

民國 111 年及 110 年度對於未來死亡率之假設係按照台灣地區第六回經驗生命表估計。

因採用之主要精算假設變動而影響之確定福利義務現值分析如下：

	折現率		未來薪資增加率	
	增加0.25%	減少0.25%	增加0.25%	減少0.25%
111年12月31日				
對確定福利義務現值之影響	($ 958)	$ 990	$ 970	($ 943)
110年12月31日				
對確定福利義務現值之影響	($ 957)	$ 996	$ 970	($ 938)

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨退休金負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

(6)本公司於民國 112 年度預計支付予退休計畫之提撥金為$728。

(7)截至民國 111 年 12 月 31 日，該退休計畫之加權平均存續期間為 6 年。退休金支付之到期分析如下：

1-2年	$	5,326
2-5年		34,407
5年以上		23,367
	$	63,100

2.(1)自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司及國內子公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司及國內子公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 2%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

(2)民國 111 年及 110 年度，本公司依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為$13,013 及$12,233。

(十三)股份基礎給付

1.民國 111 年度，本公司之股份基礎給付協議如下：

協議之類型	給與日	給與數量	合約期間	既得條件
現金增資保留員工認購	111年8月19日	366,000	不適用	立即既得

2.本公司於民國 111 年給與之股份基礎給付交易使用 Black-Scholes-Merton選擇權評價模式估計認股選擇權之公允價值,相關資訊如下:

協議之類型	給與日	股價	履約價格	預期波動率	預期存續期間	無風險利率	每單位公允價值
現金增資保留員工認購	111年8月19日	$ 44.71	$45.00	33.95%	0.2630年	1.38%	$3.0427

3.股份基礎給付交易產生之費用如下：

	111年度	110年度
權益交割	$ 1,114	$ -

(十四)股本

1.民國 111 年 12 月 31 日止，本公司額定資本額為$1,000,000，分為 100,000 仟股，實收資本額為$646,600，每股面額 10 元。本公司已發行股份之股款均已收訖。

本公司普通股期初與期末流通在外股數調節如下：

股數:仟股

	111年	110年
1月1日流通在外股數	61,000	58,725
現金增資	3,660	-
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	1,326
庫藏股轉讓與員工	-	949
12月31日流通在外股數	64,660	61,000

2.本公司於民國 111 年 5 月 11 日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股 3,660 仟股，除依法保留 10%供員工認股，其餘由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購,每股認購價格新台幣 45 元,現金增資基準日為民國 111 年 8 月 19 日。

3.庫藏股

(1)本公司之子公司－微石開發股份有限公司於民國 109 年 12 月 31 日持有本公司股票為 1,326 仟股，帳面金額為$22,266，每股平均帳面價值為新台幣 16.79 元。另微石公司業已於民國 110 年度出售本公司股票，出售金額為$33,143。

(2)本公司於民國 110 年度因庫藏股以每股新台幣 25 元轉讓與員工，故認列之股份基礎給付酬勞成本為$0。

(十五)資本公積

依公司法規定，超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積，除得用於彌補虧損外，於公司無累積虧損時，按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定，以上開資本公積撥充資本時，每年以其合計數不超過實收資本額百分之十為限。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時，不得以資本公積補充之。

	111年			
	發行溢價	庫藏股票交易	員工認股權	合計
1月1日	$ -	$ 13,775	$ -	$ 13,775
現金增資	128,100	-	-	128,100
股份基礎給付酬勞成本	-	-	1,114	1,114
12月31日	$ 128,100	$ 13,775	$ 1,114	$ 142,989

	110年
	庫藏股票交易
1月1日	$ -
庫藏股轉讓予員工	2,898
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	10,877
12月31日	$ 13,775

(十六)保留盈餘

1.依本公司章程，年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

2.法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現金外，不得使用之，惟發給新股或現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

3.民國 111 年 4 月 22 日及民國 110 年 5 月 12 日經股東會決議通過民國 110 年及 109 年度之盈餘分派案如下:

	110年	109年
	金額	金額
法定盈餘公積	$ 31,543	$ 10,707
現金股利	91,500	61,000
合計	$ 123,043	$ 71,707

4.本公司民國 112 年 3 月 15 日，經董事會決議通過民國 111 年度盈餘分派案如下：

	111年	
	金額	每股股利(元)
法定盈餘公積	$ 17,182	
現金股利	96,990	$ 1.5
合計	$ 114,172	

上述民國 111 年度盈餘分派案，截至民國 112 年 3 月 15 日止，尚未經股東會決議。

(十七)營業收入

	111年度	110年度
客戶合約之收入	$ 1,226,677	$ 1,291,177

1.本公司之收入明細如下：

111年度	積體電路測試	其他	合計
外部客戶合約收入	$ 926,313	$ 300,364	$ 1,226,677
收入認列時點			
隨時間逐步認列之收入	$ 926,313	$ 300,364	$ 1,226,677

110年度	積體電路測試	其他	合計
外部客戶合約收入	$ 1,005,427	$ 285,750	$ 1,291,177
收入認列時點			
隨時間逐步認列之收入	$ 1,005,427	$ 285,750	$ 1,291,177

2.合約資產及合約負債

本公司認列客戶合約收入相關之合約資產及合約負債如下:

	111年12月31日	110年12月31日	110年1月1日
合約資產:			
合約資產-積體電路測試	$ 89,407	$ 61,406	$ 90,219
合約負債:			
合約負債-積體電路測試	$ 5,023	$ 296	$ 72

3.本公司認列之合約資產備抵損失請詳附註十二(二)。

4.期初合約負債本期認列收入

	111年度	110年度
合約負債期初餘額本期認列收入		
客戶合約收入	$ 296	$ 72

(十八)利息收入

	111年度	110年度
銀行存款利息	$ 544	$ 49
按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入	194	56
	$ 738	$ 105

(十九)其他收入

	111年度	110年度
租金收入	$ 524	$ 444
其他收入－其他	17,514	9,798
	$ 18,038	$ 10,242

(二十)其他利益及損失

	111年度	110年度
處分不動產、廠房及設備(損失)利益	($ 1,104)	$ 13,259
處分投資利益	-	1,376
外幣兌換利益	14,902	3,921
什項支出	(239)	(7,595)
	$ 13,559	$ 10,961

(二十一)財務成本

	111年度	110年度
利息費用		
銀行借款	$ 9,482	$ 9,032
租賃負債	126	161
	$ 9,608	$ 9,193

(二十二)費用性質之額外資訊

	111年度	110年度
員工福利費用	$ 429,608	$ 460,616
折舊費用	$ 289,967	$ 257,286
無形資產攤銷費用	$ 6,197	$ 2,871

(二十三)員工福利費用

	111年度	110年度
薪資費用	$ 347,770	$ 387,597
股份基礎給付酬勞成本	1,114	-
勞健保費用	35,924	33,759
退休金費用	13,245	12,304
董事酬金	4,887	9,150
其他用人費用	26,668	17,806
	$ 429,608	$ 460,616

1. 依本公司民國 110 年 6 月 25 日修正後章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不高於 3%，員工酬勞不低於 10%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補累積虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

   依本公司民國 111 年 5 月 30 日及 111 年 8 月 2 日修正後章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不高於 3%，員工酬勞不高於 12%且不低於 5%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補累積虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本公司民國 111 年及 110 年度員工酬勞估列金額分別為$12,218 及$17,430；董事酬勞估列金額分別為$4,887 及$9,150，前述金額帳列薪資費用。

3. 經董事會決議之民國 110 年度員工酬勞$17,430 及董事酬勞$9,150，與民國 110 年度財務報告認列之金額一致。

4. 本公司董事會通過之員工及董事酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(二十四)所得稅

1.所得稅費用

(1)所得稅費用組成部分:

	111年度	110年度
當期所得稅：		
當期所得產生之所得稅	$ 46,981	$ 61,995
以前年度所得稅低估	15,949	-
當期所得稅總額	62,930	61,995
遞延所得稅：		
暫時性差異之原始產生及迴轉	(4,059)	204
所得稅費用	$ 58,871	$ 62,199

(2)與其他綜合損益相關之所得稅金額:

	111年度	110年度
確定福利義務之再衡量數	($ 870)	$ 2,847

2.所得稅費用與會計利潤關係

	111年度	110年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅	$ 45,442	$ 64,404
按稅法規定應調整之收益	(2,520)	(1,804)
暫時性差異未認列遞延所得稅資產	-	(401)
以前年度所得稅低估數	15,949	-
所得稅費用	$ 58,871	$ 62,199

3.因暫時性差異而產生之各遞延所得稅資產或負債金額如下：

	111年			
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合淨利	12月31日
遞延所得稅資產:				
-暫時性差異：				
預期信用減損損失	$ -	$ 3,748	$ -	$ 3,748
確定福利負債	3,617	-	(870)	2,747
其他	-	602	-	602
小計	$ 3,617	$ 4,350	($ 870)	$ 7,097
遞延所得稅負債:				
-暫時性差異：				
其他	($ 615)	($ 291)	$ -	($ 906)
小計	($ 615)	($ 291)	$ -	($ 906)
合計	$ 3,002	$ 4,059	($ 870)	$ 6,191

	110年			
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合淨利	12月31日
遞延所得稅資產:				
-暫時性差異：				
確定福利負債	$ 770	$ -	$ 2,847	$ 3,617
小計	$ 770	$ -	$ 2,847	$ 3,617
遞延所得稅負債:				
-暫時性差異：				
其他	($ 411)	($ 204)	$ -	($ 615)
小計	($ 411)	($ 204)	$ -	($ 615)
合計	$ 359	($ 204)	$ 2,847	$ 3,002

4.未認列為遞延所得稅資產之可減除暫時性差異：

	111年12月31日	110年12月31日
可減除暫時性差異	$ -	$ 12,060

5.本公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至民國 109 年度。

(二十五)每股盈餘

	111年度		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘(元)
基本每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 168,338	62,354	$ 2.70
稀釋每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 168,338	62,354	
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	571	
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 168,338	62,925	$ 2.68

	110年度		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘(元)
基本每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 259,823	60,263	$ 4.31
稀釋每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 259,823	60,263	
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	973	
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 259,823	61,236	$ 4.24

(二十六)現金流量補充資訊

僅有部分現金支付之投資活動：

	111年度	110年度
購置不動產、廠房及設備(含重分類)	$ 415,864	$ 467,204
加：期初應付設備款	106,449	12,594
減：期末應付設備款	(108,322)	(106,449)
加：期末預付設備款	56,365	26,852
減：期初預付設備款	(26,852)	(87,352)
本期支付現金	$ 443,504	$ 312,849

(二十七)來自籌資活動之負債之變動

	111年			
	短期借款	租賃負債	長期借款	來自籌資活動之負債總額
1月1日	$ 80,000	$ 8,345	$ 454,549	$ 542,894
籌資現金流量之變動	(80,000)	(2,033)	69,893	(12,140)
利息支付數	-	(126)	-	(126)
租賃負債之利息	-	126	-	126
12月31日	$ -	$ 6,312	$ 524,442	$ 530,754

	110年			
	短期借款	租賃負債	長期借款	來自籌資活動之負債總額
1月1日	$237,500	$ -	$ 418,074	$ 655,574
籌資現金流量之變動	(157,500)	(1,999)	36,475	(123,024)
利息支付數	-	(161)	-	(161)
租賃負債之利息	-	161	-	161
其他非現金之變動	-	10,344	-	10,344
12月31日	$ 80,000	$ 8,345	$ 454,549	$ 542,894

七、關係人交易

(一)關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
微石開發股份有限公司(註)	其他關係人
辰謙投資有限公司	其他關係人
張少謙	其他關係人

註:本公司業已於民國 110 年 12 月 30 日處份子公司-微石開發股份有限公司 100%股權。

(二)與關係人間之重大交易事項

1.其他交易及其他應付款

	111年度		110年度	
	金額	期末應付	金額	期末應付
子公司-				
管理費用-交際費	$ -	$ -	$ 4,229	$ -
管理費用-其他	$ -	$ -	$ 313	$ -
其他收入	$ -	$ -	($ 465)	$ -
其他關係人-				
管理費用-交際費	$ 3,909	$ 278	$ -	$ -
管理費用-其他	$ 445	$ -	$ -	$ -

2.財產交易

處分金融資產

本公司於民國 110 年 12 月 30 處分子公司-微石開發股份有限公司 100%股權與其他關係人張少謙，處分價款為$2,500，並認列處分投資利益$1,376。

(三)主要管理階層薪酬資訊

	111年度	110年度
短期員工福利	$ 21,284	$ 25,894
退職後福利	270	370
總計	$ 21,554	$ 26,264

八、質押之資產

本公司之資產提供擔保明細如下：

資產項目	帳面價值 111年12月31日	帳面價值 110年12月31日	擔保用途
土地	$ 225,914	$ 225,914	長、短期借款
房屋及建築	218,407	225,325	長、短期借款
機器設備	213,257	135,703	長期借款
其他設備	7,049	9,223	長期借款
存出保證金	3,011	2,435	關稅保證金
	$ 667,638	$ 598,600	

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

已簽約但尚未發生之資本支出

	111年12月31日	110年12月31日
不動產、廠房及設備	$ 520,154	$ 274,971

十、重大之災害損失

無。

十一、重大之期後事項

本公司於民國 112 年 3 月 15 日經董事會決議通過盈餘分配案，請詳附註六(十六)說明。

十二、其他

(一)資本管理

本公司之資本管理目標，係為保障公司能繼續經營，維持最佳資本結構以降低資金成本，並為股東提供報酬。為了維持或調整資本結構，本公司可能會調整支付予股東之股利金額、退還資本予股東、發行新股或出售資產以降低債務。本公司利用負債資本比率以監控其資本，該比率係按債務淨額除以資本總額計算。

	111年12月31日	110年12月31日
負債總額	$ 827,803	$ 916,320
資產總額	$ 2,177,523	$ 2,019,907
負債/資產比率	38%	45%

(二)金融工具

1.金融工具之種類

	111年12月31日	110年12月31日
金融資產		
按攤銷後成本衡量之金融資產		
現金及約當現金	$ 334,482	$ 251,427
按攤銷後成本衡量之金融資產	6,500	6,500
應收票據	974	1,155
應收帳款	246,026	346,290
其他應收款	2,584	677
存出保證金	2,651	2,795
	$ 593,217	$ 608,844
金融負債		
按攤銷後成本衡量之金融負債		
短期借款	$ -	$ 80,000
應付票據	2,555	23
應付帳款	19,338	26,601
其他應付款(含關係人)	226,405	257,760
長期借款(包含一年或一營業週期內到期)	524,442	454,549
	$ 772,740	$ 818,933
租賃負債	$ 6,312	$ 8,345

2.風險管理政策

(1)本公司日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險(包括匯率風險、利率風險、及價格風險)、信用風險及流動性風險。本公司整體風險管理著重於金融市場的不可預測事項，並尋求可降低對財務狀況及財務績效之不利影響。

(2)風險管理工作由本公司財務部按照董事會核准之政策執行。本公司財務部透過與本公司內各營運單位密切合作，以負責辨認、評估與規避財務風險。財務風險管理政策業經定期覆核以反映市場情形及本公司運作之變化。

3.重大財務風險之性質及程度

(1)市場風險

匯率風險

A.本公司係跨國營運，因此受相對與本公司功能性貨幣不同的交易所產生之匯率風險，主要為美元。相關匯率風險來自未來之商業交易及已認列之資產與負債。

B.本公司以自然避險為原則，依據各幣別資金需求及淨部位(外幣資產與負債部位之差額)依照市場外匯狀況進行避險；當發生短期不平衡時，即藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保匯率風險保持在可接受水準。

C.本公司從事之業務涉及若干非功能性貨幣(本公司之功能性貨幣為新台幣)，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊如下：

	111年12月31日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 4,649	30.71	$ 142,761
金融負債			
貨幣性項目：無。			

	110年12月31日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額 (新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 6,277	27.68	$ 173,747
金融負債			
貨幣性項目：無。			

D.本公司貨幣性項目因匯率波動具重大影響於民國111年及110年度認列之全部兌換利益(含已實現及未實現)彙總金額分別為$14,902及$3,921。

E.本公司因重大匯率波動影響之外幣市場風險分析如下：

	111年度		
	敏感度分析		
	變動幅度	影響損益	影響其他綜合損益
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	$ 1,428	$ -
金融負債			
貨幣性項目：無。			

	110年度		
	敏感度分析		
	變動幅度	影響損益	影響其他綜合損益
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	$ 1,737	$ -
金融負債			
貨幣性項目：無。			

價格風險

本公司未有重大商品價格風險之暴險。

現金流量及公允價值利率風險

A.本公司之利率風險主要來自短期及長期借款。按浮動利率之借款使本公司承受現金流量利率風險，部分風險被按浮動利率持有之現金及約當現金抵銷。按固定利率之借款則使本公司承受公允價值利率風險。於民國 111 年及 110 年 12 月 31 日，本公司按浮動利率計算之借款係以新台幣計價。

B.於民國 111 年及 110 年 12 月 31 日，若新台幣借款利率增加或減少 1%，在所有其他因素維持不變之情況下，民國 111 年及 110 年度之稅後淨利將分別減少或增加$4,196 及$4,276，主要係因浮動利率借款導致利息費用增加/減少。

(2)信用風險

A.本公司之信用風險係因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而導致本公司財務損失之風險，主要來自交易對手無法清償按收款條件支付之應收帳款，及分類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

B.本公司係以公司角度建立信用風險之管理。對於往來之銀行及金融機構，設定僅有信評等級良好者，始可被接納為交易對象。依內部明定之授信政策，公司內各營運個體與每一新客戶於訂定付款及提出交貨之條款與條件前，須對其進行管理及信用風險分析。內部風險控管係透過考慮其財務狀況、過往經驗及其他因素，以評估客戶之信用品質。個別風險之限額係管理階層依內部或外部之評等而制訂，並定期監控信用額度之使用。

C.本公司採用 IFRS9 提供前提假設，當合約款項按約定之支付條款逾期超過 90 天，視為已發生違約。

D.本公司採用 IFRS9 提供以下之前提假設，當合約款項按約定之支付條款逾期超過 30 天，視為金融資產自原始認列後信用風險已顯著增加之依據。

E.本公司用以判定債務工具投資為信用減損之指標如下：

(A)發行人發生重大財務困難，或將進入破產或其他財務重整之可能性大增；

(B)發行人由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失；

(C)發行人延滯或不償付利息或本金；

(D)導致發行人違約有關之全國性或區域性經濟情況不利之變化。

F.本公司經追索程序後，對無法合理預期可回收金融資產之金額予以沖銷，為本公司仍會持續進行追索之法律程序以保全債權之權利。

G.本公司持有之按攤銷後成本衡量之金融資產係屬存放於銀行之定期存款及受限制之定期存款，該等銀行之信用評等均為良好，過去未發生逾期之情形，且考量整體經濟環境無重大變動，故評估發生信用損失之風險極低，對財務報表之影響金額亦不大。

H.本公司按客戶評等之特性將對客戶之應收帳款及合約資產分組，採用簡化作法以準備矩陣為基礎估計預期信用損失。

I.本公司對未來前瞻性的考量調整按特定期間歷史及現時資訊所建立之損失率，以估計應收帳款及合約資產備抵損失，民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之準備矩陣如下：

	未逾期	逾期 1-30天	逾期 31-90天	逾期 91-180天	逾期 181天以上	合計
111年12月31日						
預期損失率	0%	1%	14%	100%	100%	
帳面價值總額	$ 236,852	$ -	$ 10,638	$ 43	$ 27	$ 247,560
備抵損失	$ -	$ -	$ 1,464	$ 43	$ 27	$ 1,534

110年12月31日	未逾期	逾期 1-30天	逾期 31-90天	逾期 91-180天	逾期 181天以上	合計
預期損失率	0%	1%	24%	51%	100%	
帳面價值總額	$ 340,296	$ 4,214	$ 1,665	$ 1,143	$ 11,239	$ 358,557
備抵損失	$ -	$ 35	$ 407	$ 586	$ 11,239	$ 12,267

J.本公司採簡化作法之應收帳款及合約資產備抵損失變動表如下：

	111年		
	合約資產	應收帳款	合計
1月1日	$ -	$ 12,267	$ 12,267
提列減損損失	8,717	-	8,717
因無法收回而沖銷之款項	-	(10,733)	(10,733)
12月31日	$ 8,717	$ 1,534	$ 10,251

	110年		
	合約資產	應收帳款	合計
1月1日	$ -	$ 11,444	$ 11,444
提列減損損失	-	823	823
12月31日	$ -	$ 12,267	$ 12,267

(3)流動性風險

A.現金流量預測是由公司內各營運個體執行，並由公司財務部予以彙總。公司財務部監控公司流動資金需求之預測，確保其有足夠資金得以支應營運需要，並在任何時候維持足夠之未支用的借款承諾額度，以使公司不致違反相關之借款限額或條款，此等預測考量公司之債務融資計畫、債務條款遵循、符合內部資產負債表之財務比率目標，及外部監管法令之要求。

B.各營運個體所持有之剩餘現金，在超過營運資金之管理所需時，將轉撥回公司財務部。公司財務部則將剩餘資金投資於定存存款，其所選擇之工具具有適當之到期日或足夠流動性，以因應上述預測並提供充足之調度水位。

C.下表係本公司之非衍生金融負債，按相關到期日予以分組，非衍生金融負債係依據資產負債表日至合約到期日之剩餘期間進行分析。下表所揭露之合約現金流量金額係未折現之金額（含本金及利息）：

111年12月31日	1年內	1至5年內	5年以上
非衍生金融負債:			
應付票據	$ 2,555	$ -	$ -
應付帳款	19,338	-	-
其他應付款	226,405	-	-
租賃負債	2,160	4,320	-
長期借款(包含一年內到期)	169,868	377,051	-

110年12月31日	1年內	1至5年內	5年以上
非衍生金融負債:			
短期借款	$ 80,212	$ -	$ -
應付票據	23	-	-
應付帳款	26,601	-	-
其他應付款	257,760	-	-
租賃負債	2,160	6,480	-
長期借款(包含一年內到期)	156,896	303,439	-

(三)公允價值資訊

1.為衡量金融及非金融工具之公允價值所採用評價技術的各等級定義如下：

第一等級：企業於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。活絡市場係指有充分頻率及數量之資產或負債交易發生，以在持續基礎上提供定價資訊之市場。本公司投資之的公允價值皆屬之。

第二等級：資產或負債直接或間接之可觀察輸入值，但包括於第一等級之報價者除外。

第三等級：資產或負債之不可觀察輸入值。

2.非以公允價值衡量之金融工具

現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之金融資產、應收票據、應收帳款、其他應收款、存出保證金、短期借款、應付票據、應付帳款、其他應付款及長期借款的帳面金額係公允價值之合理近似值。

3.以公允價值衡量之金融及非金融工具，本公司依資產及負債之性質、特性及風險及公允價值等級之基礎分類，相關資訊如下：

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日：無。

4.本公司用以衡量公允價值所使用之方法及假設說明如下：

(1)金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以個體資產負債表日可取得之市場資訊運用模型計算而得。

(2)評價模型之產出係預估之概算值，而評價技術可能無法反映本公司持有金融工具及非金融工具之所有攸關因素。因此評價模型之預估值會適當地根據額外之參數予以調整，根據本公司之公允價值評價模型管理政策及相關之控制程序，管理階層相信為允當表達個體資產負債表中金融工具及非金融工具之公允價值，評價調整係屬適當且必要。在評價過程中所使用之價格資訊及參數係經審慎評估，且適當地根據目前市場狀況調整。

5.本公司民國 111 年及 110 年度無第一等級與第二等級間之任何移轉。

6.下表列示民國 111 年及 110 年度第三等級權益工具之變動：

	111年度	110年度
1月1日	$ -	$ 25
本期出售	-	(25)
12月31日	$ -	$ -

7.本公司對於公允價值歸類於第三等級之評價流程係由會計部負責進行金融工具之獨立公允價值驗證，藉獨立來源資料使評價結果貼近市場狀態，並定期覆核，以確保評價結果係屬合理。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

1.資金貸與他人：無。

2.為他人背書保證：無。

3.期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分）：無。

4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

9.從事衍生工具交易：無。

10.母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額：無。

(二)轉投資事業相關資訊

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊（不包含大陸被投資公司）：無。

(三)大陸投資資訊

1.基本資料：無。

十四、部門資訊

不適用。

微矽電子股份有限公司
現金及約當現金明細表
民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目	摘要			金額
現金				
零用金				$ 175
銀行存款				
活期存款				
-台幣				316,539
-外幣	USD	577,522	匯率 30.71	17,736
支票存款				32
				$ 334,482

微矽電子股份有限公司
應收帳款明細表
民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

客戶名稱	摘要	金額	備註
一般客戶：			
乙公司		$ 57,005	
丙公司		22,424	
戊公司		18,011	
己公司		15,347	
庚公司		14,960	
其他		119,813	每一零星客戶餘額均未超過本科目金額5%
		$ 247,560	
減：備抵損失		(1,534)	
		$ 246,026	

微矽電子股份有限公司

不動產、廠房及設備變動明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項　　目	期初餘額	本期增加額	本期減少額	本期移轉額	期末餘額	提供擔保或質押情形	備　註
土地	$ 225,914	$ -	$ -	$ -	$ 225,914	為長期借款之抵押	
房屋及建築	337,506	-	-	-	337,506	為長期借款之抵押	
機器設備	1,003,982	230,264	(64,629)	7,921	1,177,538	部分作為長期借款之抵押	
運輸設備	17,166	1,665	-	-	18,831	無	
其他設備	427,620	45,704	(26,109)	-	447,215	部分作為長期借款之抵押	
未完工程及待驗設備	11,984	138,231	-	(7,921)	142,294	無	
	$ 2,024,172	$ 415,864	($ 90,738)	$ -	$ 2,349,298		

微矽電子股份有限公司
不動產、廠房及設備累計折舊變動明細表
民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新台幣仟元

項目	期初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額	備註
房屋及建築	$ 112,181	$ 6,918	$ -	$ 119,099	
機器設備	424,396	193,102	(43,690)	573,808	
運輸設備	10,699	2,521	-	13,220	
其他設備	194,425	85,357	(17,867)	261,915	
	$ 741,701	$ 287,898	($ 61,557)	$ 968,042	

微矽電子股份有限公司
應付帳款明細表
民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

客戶名稱	摘要	金額	備註
一般廠商：			
H公司		$ 2,303	
B公司		1,511	
D公司		1,318	
I公司		1,200	
C公司		1,181	
G公司		1,121	
F公司		1,080	
其他		9,624	每一零星客戶餘額均未超過本科目金額5%
		$ 19,338	

微矽電子股份有限公司
長期借款明細表
民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

債權人	摘　　要	借款金額	契約期限	利　　率	抵押或擔保	備　註
信用借款						
彰化商業銀行	按月本息平均攤還	$ 778	109/04/27~112/04/27	註1	無	
台北富邦商業銀行	按月本息平均攤還	141,833	110/04/28~118/05/11	註1	無	
台灣新光商業銀行	按月本息平均攤還	16,388	111/01/18~113/01/18	註1	無	
擔保借款						
台北富邦商業銀行	按月本息平均攤還	15,818	109/10/22~114/06/01	註2	土地及房屋及建築	
台北富邦商業銀行	按月本息平均攤還	11,786	107/09/14~114/09/14	註2	土地及房屋及建築	
台北富邦商業銀行	按月本息平均攤還	15,000	109/06/01~114/06/01	註2	土地及房屋及建築	
台北富邦商業銀行	按月本息平均攤還	21,333	110/04/28~115/04/28	註2	土地及房屋及建築	
台北富邦商業銀行	按月本息平均攤還	19,643	107/09/14~114/09/14	註2	土地及房屋及建築	
台北富邦商業銀行	按月本息平均攤還	113,667	111/05/11~118/05/11	註2	土地及房屋及建築	
兆豐國際商業銀行	按季本息平均攤還	7,500	108/05/30~113/05/30	註2	土地及房屋及建築	
兆豐國際商業銀行	按季本息平均攤還	3,594	110/03/29~115/03/29	註2	機器設備	
合作金庫商業銀行	按月本息平均攤還	45,572	109/12/25~113/12/04	註2	機器設備	
合作金庫商業銀行	按月本息平均攤還	16,401	107/09/10~112/09/10	註2	機器設備	
合作金庫商業銀行	按月本息平均攤還	77,532	110/10/05~115/10/05	註2	機器設備	
彰化商業銀行	按月本息平均攤還	7,916	108/07/25~113/07/25	註2	機器設備	
彰化商業銀行	按月本息平均攤還	4,468	110/12/09~114/11/15	註2	機器設備	
彰化商業銀行	按月本息平均攤還	5,213	110/12/27~114/11/15	註2	機器設備	
		524,442				
減：一年內或一營業週期內到期之長期借款		(166,776)				
		$ 357,666				

註1：借款利率介於1.85%至2.33%。
註2：借款利率介於1.87%至2.28%。

微矽電子股份有限公司

營業收入明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目	數量	金額	備註
積體電路測試		$ 931,298	
其他		304,065	
減：銷貨折讓		(8,686)	
		$ 1,226,677	

微矽電子股份有限公司

營業成本明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目	金額
原物料	
期初原物料	$ 14,598
加：本期進料	84,785
減：期末原物料	(17,269)
轉列費用	(9,059)
原料出售成本	(220)
本期耗用原物料	72,835
直接人工	198,947
製造費用	549,371
製造成本	821,153
存貨跌價及呆滯損失	2,216
營業成本總計	$ 823,369

微矽電子股份有限公司

製造費用明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目	摘要	金額	備註
薪資費用		$ 97,174	
折舊		261,256	
電費		50,985	
雜項購置		43,406	
其他		96,550	個別費用餘額均未超過本科目金額5%
		$ 549,371	

微矽電子股份有限公司

推銷費用明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目	摘要	金額	備註
薪資費用		$ 7,186	
文具用品		3,106	
交際費		1,594	
運費		1,215	
其他		1,785	個別費用餘額均未超過本科目金額5%
		$ 14,886	

微矽電子股份有限公司

管理費用明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目	摘要	金額	備註
薪資費用		$ 43,734	
折舊		11,614	
其他		50,297	個別費用餘額均未超過本科目金額5%
		$ 105,645	

微矽電子股份有限公司

研發費用明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目	摘要	金額	備註
薪資費用		$ 43,468	
折舊		17,097	
其他		9,013	個別費用餘額均未超過本科目金額5%
		$ 69,578	

微矽電子股份有限公司

本期發生之員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總表

民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新台幣仟元

功能別 性質別	111年度			110年度		
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合計	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合計
員工福利費用						
薪資費用	$ 253,382	$ 94,388	$ 347,770	$ 273,708	$ 113,889	$ 387,597
勞健保費用	30,945	4,979	35,924	31,359	2,400	33,759
退休金費用	10,402	2,843	13,245	10,813	1,491	12,304
董事酬金	-	4,887	4,887	-	9,150	9,150
股份基礎給付酬勞成本	-	1,114	1,114	-	-	-
其他員工福利費用	23,913	2,755	26,668	15,739	2,067	17,806
折舊費用	261,256	28,711	289,967	231,474	25,812	257,286
攤銷費用	3,052	3,145	6,197	-	2,871	2,871

附註：

本年度及前一年度之員工人數分別為573人及544人，其中未兼任員工之董事人數分別為5人及0人。

台灣省會計師公會會員印鑑證明書 台省財證字第 1120260 號

會員姓名：(1) 李 典 易
(2) 白 淑 蒨

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

事務所地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

事務所電話：(02)27296666　　事務所統一編號：03932533

會員證書字號：(1) 台省會證字第 4112 號　　委託人統一編號：22579547
(2) 台省會證字第 4895 號

印鑑證明書用途：辦理　微矽電子股份有限公司　111 年度
（自民國 111 年 1 月 1 日至
111 年 12 月 31 日）財務報表之查核簽證。

簽名式（一）	李典易	存會印鑑（一）	
簽名式（二）	白淑蒨	存會印鑑（二）	

理事長：　　核對人：

中 華 民 國 112 年 2 月 14 日

附件三

112 年度第三季合併財務報告暨會計師核閱報告

微矽電子股份有限公司
財務報告暨會計師核閱報告
民國 112 年及 111 年第三季
（股票代碼 8162）

公司地址：新竹縣竹東鎮沿河街 395 號

電　　話：037-587222

微矽電子股份有限公司

民國 112 年及 111 年第三季財務報告暨會計師核閱報告

目　　錄

項　　目	頁　　次
一、　封面	1
二、　目錄	2 ~ 3
三、　會計師核閱報告書	4 ~ 5
四、　資產負債表	6 ~ 7
五、　綜合損益表	8
六、　權益變動表	9
七、　現金流量表	10
八、　財務報表附註	11 ~ 38
（一）　公司沿革	11
（二）　通過財務報告之日期及程序	11
（三）　新發布及修訂準則及解釋之適用	11 ~ 12
（四）　重大會計政策之彙總說明遵循聲明	12 ~ 13
（五）　重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	13
（六）　重要會計項目之說明	13 ~ 28
（七）　關係人交易	28 ~ 29
（八）　質押之資產	29
（九）　重大或有負債及未認列之合約承諾	30

項　　目	頁　　次

(十)　重大之災害損失	30
(十一)重大之期後事項	30
(十二)其他	30 ~ 36
(十三)附註揭露事項	37
(十四)營運部門資訊	37 ~ 38

pwc 資誠

會計師核閱報告

(112)財審報字第 23002127 號

微矽電子股份有限公司　公鑒：

前言

微矽電子股份有限公司民國 112 年及 111 年 9 月 30 日之資產負債表，民國 112 年及 111 年 7 月 1 日至 9 月 30 日、民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之綜合損益表、暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製允當表達之財務報表係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對財務報表作成結論。

範圍

本會計師係依照中華民國核閱準則 2410 號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱財務報表時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

pwc 資誠

結論

依本會計師核閱結果，並未發現上開財務報表在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製，致無法允當表達微矽電子股份有限公司民國 112 年及 111 年 9 月 30 日之財務狀況，民國 112 年及 111 年 7 月 1 日至 9 月 30 日、民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之財務績效，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之現金流量之情事。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

白淑蒨

金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
金管證審字第 1110349013 號

中 華 民 國 1 1 2 年 1 1 月 7 日

微矽電子股份有限公司

資產負債表

民國112年9月30日及民國111年12月31日、9月30日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	112年9月30日 金額	%	111年12月31日 金額	%	111年9月30日 金額	%
	流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 274,992	13	$ 334,482	16	$ 402,036	19
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		6,600	-	6,500	-	6,500	-
1140	合約資產－流動	六(十五)	56,065	3	89,407	4	88,149	4
1150	應收票據淨額		171	-	974	-	1,081	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	238,518	12	246,026	11	256,700	12
1200	其他應收款		3,230	-	2,584	-	1,958	-
1220	本期所得稅資產		3,563	-	-	-	-	-
130X	存貨	六(三)	17,229	1	15,053	1	20,280	1
1410	預付款項		8,216	-	13,294	1	11,265	-
1470	其他流動資產		-	-	-	-	174	-
11XX	**流動資產合計**		608,584	29	708,320	33	788,143	36
	非流動資產							
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八	1,433,407	69	1,381,256	63	1,311,771	61
1755	使用權資產	六(五)	4,655	-	6,207	-	6,724	-
1780	無形資產	六(六)	7,591	1	15,267	1	9,628	1
1840	遞延所得稅資產		7,097	-	7,097	-	5,991	-
1900	其他非流動資產	六(七)及八	27,550	1	59,376	3	47,920	2
15XX	**非流動資產合計**		1,480,300	71	1,469,203	67	1,382,034	64
1XXX	**資產總計**		$ 2,088,884	100	$ 2,177,523	100	$ 2,170,177	100

（續次頁）

微矽電子股份有限公司

資產負債表

民國112年9月30日及民國111年12月31日、9月30日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	112年9月30日 金額	%	111年12月31日 金額	%	111年9月30日 金額	%
	流動負債							
2130	合約負債－流動	六(十五)	$ 2,667	-	$ 5,023	-	$ 4,829	-
2150	應付票據		-	-	2,555	-	-	-
2170	應付帳款		23,313	1	19,338	1	26,943	1
2200	其他應付款	六(八)及七	104,621	5	226,405	11	179,598	9
2230	本期所得稅負債		-	-	7,976	-	2,521	-
2280	租賃負債－流動		2,095	-	2,160	-	2,060	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(九)	146,751	7	166,776	8	179,904	9
2399	其他流動負債－其他		3,111	1	2,999	-	3,039	-
21XX	**流動負債合計**		282,558	14	433,232	20	398,894	19
	非流動負債							
2540	長期借款	六(九)	573,307	27	357,666	16	394,434	18
2570	遞延所得稅負債		906	-	906	-	1,264	-
2580	租賃負債－非流動		2,669	-	4,152	-	4,764	-
2600	其他非流動負債	六(十)	31,847	2	31,847	2	37,199	2
25XX	**非流動負債合計**		608,729	29	394,571	18	437,661	20
2XXX	**負債總計**		891,287	43	827,803	38	836,555	39
	權益							
	股本	六(十二)						
3110	普通股股本		646,600	31	646,600	30	646,600	30
	資本公積	六(十三)						
3200	資本公積		142,989	7	142,989	6	142,989	6
	保留盈餘	六(十四)						
3310	法定盈餘公積		98,705	4	81,523	4	81,523	4
3350	未分配盈餘		309,303	15	478,608	22	462,510	21
3XXX	**權益總計**		1,197,597	57	1,349,720	62	1,333,622	61
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九						
3X2X	**負債及權益總計**		$ 2,088,884	100	$ 2,177,523	100	$ 2,170,177	100

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司

綜合損益表

民國112年及111年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

	項目	附註	112年7月1日至9月30日 金額	%	111年7月1日至9月30日 金額	%	112年1月1日至9月30日 金額	%	111年1月1日至9月30日 金額	%
4000	營業收入	六(十五)	$ 236,173	100	$ 295,604	100	$ 620,556	100	$ 982,732	100
5000	營業成本	六(三)								
		(二十)								
		(二十一)	(197,835)	(84)	(215,540)	(73)	(577,296)	(93)	(639,125)	(65)
5900	營業毛利		38,338	16	80,064	27	43,260	7	343,607	35
	營業費用	六(二十)								
		(二十一)								
6100	推銷費用		(3,986)	(2)	(3,951)	(1)	(9,958)	(2)	(11,391)	(1)
6200	管理費用		(21,537)	(9)	(22,250)	(8)	(63,223)	(10)	(91,012)	(9)
6300	研究發展費用		(16,739)	(7)	(15,390)	(5)	(48,660)	(8)	(49,431)	(5)
6450	預期信用減損利益(損失)	十二(二)	806	-	(2,784)	(1)	(1,519)	-	(5,959)	(1)
6000	營業費用合計		(41,456)	(18)	(44,375)	(15)	(123,360)	(20)	(157,793)	(16)
6900	營業利益(損失)		(3,118)	(2)	35,689	12	(80,100)	(13)	185,814	19
	營業外收入及支出									
7100	利息收入	六(十六)	36	-	60	-	965	-	191	-
7010	其他收入	六(十七)	4,492	2	2,266	1	10,535	2	15,506	2
7020	其他利益及損失	六(四)								
		(十八)	4,082	2	4,736	2	8,157	1	17,308	2
7050	財務成本	六(十九)	(2,274)	(1)	(2,571)	(1)	(6,143)	(1)	(7,381)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		6,336	3	4,491	2	13,514	2	25,624	3
7900	**稅前淨利(淨損)**		3,218	1	40,180	14	(66,586)	(11)	211,438	22
7950	所得稅(費用)利益	六(二十二)	-	-	(8,051)	(3)	11,453	2	(55,717)	(6)
8200	**本期淨利(淨損)**		$ 3,218	1	$ 32,129	11	($ 55,133)	(9)	$ 155,721	16
8500	**本期綜合損益總額**		$ 3,218	1	$ 32,129	11	($ 55,133)	(9)	$ 155,721	16
	基本每股盈餘(虧損)	六(二十三)								
9750	基本每股盈餘(虧損)		$ 0.05		$ 0.51		($ 0.85)		$ 2.53	
	稀釋每股盈餘(虧損)	六(二十三)								
9850	稀釋每股盈餘(虧損)		$ 0.05		$ 0.51		($ 0.85)		$ 2.50	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司

權益變動表

民國112年及111年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

	附註	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	權益總額
111年1月1日至9月30日						
111年1月1日餘額		$ 610,000	$ 13,775	$ 49,980	$ 429,832	$ 1,103,587
本期淨利		-	-	-	155,721	155,721
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-
本期綜合損益總額		-	-	-	155,721	155,721
110年度盈餘指撥及分派	六(十四)					
提列法定盈餘公積		-	-	31,543	(31,543)	-
現金股利		-	-	-	(91,500)	(91,500)
現金增資	六(十二)(十三)	36,600	128,100	-	-	164,700
股份基礎給付酬勞成本	六(十一)(十三)	-	1,114	-	-	1,114
111年9月30日餘額		$ 646,600	$ 142,989	$ 81,523	$ 462,510	$ 1,333,622
112年1月1日至9月30日						
112年1月1日餘額		$ 646,600	$ 142,989	$ 81,523	$ 478,608	$ 1,349,720
本期淨損		-	-	-	(55,133)	(55,133)
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-
本期綜合損益總額		-	-	-	(55,133)	(55,133)
111年度盈餘指撥及分派	六(十四)					
提列法定盈餘公積		-	-	17,182	(17,182)	-
現金股利		-	-	-	(96,990)	(96,990)
112年9月30日餘額		$ 646,600	$ 142,989	$ 98,705	$ 309,303	$ 1,197,597

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司

現金流量表

民國112年及111年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

	附註	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
營業活動之現金流量			
本期稅前(淨損)淨利		($ 66,586)	$ 211,438
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(四)(五)(二十)	211,524	217,906
攤提費用	六(六)(二十)	12,769	3,745
預期信用減損損失	十二(二)	1,519	5,959
利息費用	六(十九)	6,143	7,381
利息收入	六(十六)	(965)	(191)
處分不動產、廠房及設備損失	六(十八)	-	1,104
股份基礎給付酬勞成本	六(十一)(二十一)	-	1,114
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產		31,823	(32,702)
應收票據		803	74
應收帳款		7,508	89,590
其他應收款		(646)	(1,281)
存貨		(2,176)	(5,682)
預付款項		5,078	(4,575)
其他流動資產		-	473
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		(2,356)	4,533
應付票據		(2,555)	(22)
應付帳款		3,975	341
其他應付款		(36,973)	(12,282)
其他流動負債		112	99
營運產生之現金流入		168,997	487,022
收取之利息		965	191
支付之利息		(5,935)	(7,380)
支付所得稅		(86)	(102,913)
營業活動之淨現金流入		163,941	376,920
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(100)	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十四)	(315,319)	(357,123)
處分不動產、廠房及設備價款		-	26,422
取得無形資產	六(六)	(5,093)	(6,868)
存出保證金減少(增加)		3	(210)
投資活動之淨現金流出		(320,509)	(337,779)
籌資活動之現金流量			
短期借款舉借	六(二十五)	200,000	595,000
短期借款償還	六(二十五)	(200,000)	(675,000)
長期借款舉借	六(二十五)	345,996	260,000
長期借款償還	六(二十五)	(150,380)	(140,211)
租賃負債本金償還	六(二十五)	(1,548)	(1,521)
發放現金股利	六(十四)	(96,990)	(91,500)
現金增資	六(十二)(十三)	-	164,700
籌資活動之淨現金流入		97,078	111,468
本期現金及約當現金(減少)增加數		(59,490)	150,609
期初現金及約當現金餘額	六(一)	334,482	251,427
期末現金及約當現金餘額	六(一)	$ 274,992	$ 402,036

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張秉堂　　經理人：張秉堂　　會計主管：呂月雲

微矽電子股份有限公司

財 務 報 表 附 註

民國 112 年及 111 年第三季

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

一、公司沿革

微矽電子股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於中華民國 76 年 8 月 11 日設立，本公司主要營業項目為各型積體電路之設計、加工、測試製造買賣等。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國 112 年 11 月 7 日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可並發布生效之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可並發布生效之民國 112 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」	民國112年1月1日
國際會計準則第8號之修正「會計估計值之定義」	民國112年1月1日
國際會計準則第12號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	民國112年1月1日
國際會計準則第12號之修正「國際租稅變革－支柱二規則範本」	民國112年5月23日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二)尚未採用金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 113 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第16號之修正「售後租回中之租賃負債」	民國113年1月1日
國際會計準則第1號之修正「負債之流動或非流動分類」	民國113年1月1日
國際會計準則第1號之修正「具合約條款之非流動負債」	民國113年1月1日
國際會計準則第7號及國際財務報導準則第7號之修正「供應商融資安排」	民國113年1月1日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

(三)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	待國際會計準則理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」之修正	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號之修正「初次適用國際財務報導準則第17號及國際財務報導準則第9號—比較資訊」	民國112年1月1日
國際會計準則第21號之修正「缺乏可兌換性」	民國114年1月1日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

四、重大會計政策之彙總說明遵循聲明

重大會計政策除遵循聲明、編製基礎及新增部分說明如下，餘與民國 111 年度財務報表附註四相同。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一)遵循聲明

1. 本財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製。

2.本財務報告應併同 111 年度財務報告閱讀。

(二)編製基礎

1. 除按退休基金資產減除確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債，本財務報告係按歷史成本編製。

2. 編製符合金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱 IFRSs)之財務報告需要使用一些重要會計估計值，在應用本公司的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷，涉及高度判斷或複雜性之項目，或涉及財務報告之重大假設及估計之項目，請詳附註五說明。

(三)員工福利

期中期間之退休金成本係採用前一財務年度結束日依精算決定之退休金成本率，以年初至當期末為基礎計算。若該結束日後有重大市場變動及重大縮減、清償或其他重大一次性事項，則加以調整，並配合前述政策揭露相關資訊。

(四)所得稅

期中期間之所得稅費用以估計之年度平均有效稅率應用至期中期間之稅前損益計算之，並配合前述政策揭露相關資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本期無重大變動，請參閱民國 111 年度財務報表附註五。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
庫存現金及週轉金	$ 185	$ 175	$ 315
支票存款及活期存款	274,807	334,307	380,645
定期存款	-	-	21,076
合計	$ 274,992	$ 334,482	$ 402,036

1.本公司往來之金融機構信用品質良好，且本公司與多家金融機構往來以分散信用風險，預期發生違約之可能性甚低。

2.本公司未有將現金及約當現金提供質押之情形。

(二)應收帳款

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
應收帳款	$ 240,052	$ 247,560	$ 258,234
減：備抵損失	(1,534)	(1,534)	(1,534)
	$ 238,518	$ 246,026	$ 256,700

1.應收帳款之帳齡分析如下：

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
	應收帳款	應收帳款	應收帳款
未逾期	$ 239,505	$ 236,852	$ 255,569
30天內	520	-	1,103
31-90天	15	10,638	187
91-180天	12	43	1,040
181天以上	-	27	335
	$ 240,052	$ 247,560	$ 258,234

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

2.民國112年9月30日、111年12月31日及111年9月30日之應收帳款餘額均為為客戶合約所產生，另於民國111年1月1日客戶合約之應收款餘額為$358,557。

3.在不考慮所持有之擔保品或其他信用增強之情況下，最能代表本公司應收帳款於民國112年9月30日、111年12月31日及111年9月30日信用風險最大之暴險金額分別為$238,518、$246,026及$256,700。

4.相關應收帳款信用風險資訊請詳附註十二、(二)。

(三)存貨

	112年9月30日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原物料	$ 19,776	($ 2,547)	$ 17,229

	111年12月31日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原物料	$ 17,269	($ 2,216)	$ 15,053

	111年9月30日		
	成本	備抵跌價損失	帳面金額
原物料	$ 20,280	$ -	$ 20,280

本公司當期認列為費損之存貨成本：

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
已出售存貨成本	$ 20,835	$ 22,080
存貨跌價及呆滯損失	284	-
	$ 21,119	$ 22,080

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
已出售存貨成本	$ 54,354	$ 61,100
存貨跌價及呆滯損失	331	-
	$ 54,685	$ 61,100

(四)不動產、廠房及設備

	土地	房屋及建築	機器設備	運輸設備	其他設備	未完工程及待驗設備	合計
112年1月1日							
成本	$ 225,914	$ 337,506	$ 1,177,538	$ 18,831	$ 447,215	$ 142,294	$ 2,349,298
累計折舊及減損	-	(119,099)	(573,808)	(13,220)	(261,915)	-	(968,042)
	$ 225,914	$ 218,407	$ 603,730	$ 5,611	$ 185,300	$ 142,294	$ 1,381,256
112年							
1月1日	$ 225,914	$ 218,407	$ 603,730	$ 5,611	$ 185,300	$ 142,294	$ 1,381,256
增添	-	-	131,440	-	15,133	64,256	210,829
重分類	-	-	-	-	-	51,294	51,294
折舊費用	-	(5,053)	(145,482)	(2,398)	(57,039)	-	(209,972)
9月30日	$ 225,914	$ 213,354	$ 589,688	$ 3,213	$ 143,394	$ 257,844	$ 1,433,407
112年9月30日							
成本	$ 225,914	$ 337,506	$ 1,164,138	$ 16,140	$ 399,003	$ 257,844	$ 2,400,545
累計折舊及減損	-	(124,152)	(574,450)	(12,927)	(255,609)	-	(967,138)
	$ 225,914	$ 213,354	$ 589,688	$ 3,213	$ 143,394	$ 257,844	$ 1,433,407

	土地	房屋及建築	機器設備	運輸設備	其他設備	未完工程及待驗設備	合計
111年1月1日							
成本	$ 225,914	$ 337,506	$ 1,003,982	$ 17,166	$ 427,620	$ 11,984	$ 2,024,172
累計折舊及減損	-	(112,181)	(424,396)	(10,699)	(194,425)	-	(741,701)
	$ 225,914	$ 225,325	$ 579,586	$ 6,467	$ 233,195	$ 11,984	$ 1,282,471
111年							
1月1日	$ 225,914	$ 225,325	$ 579,586	$ 6,467	$ 233,195	$ 11,984	1,282,471
增添	-	-	153,570	1,665	43,399	74,546	273,180
處分	-	-	(19,284)	-	(8,242)	-	(27,526)
重分類	-	-	7,921	-	-	(7,921)	-
折舊費用	-	(5,192)	(144,119)	(1,792)	(65,251)	-	(216,354)
9月30日	$ 225,914	$ 220,133	$ 577,674	$ 6,340	$ 203,101	$ 78,609	$ 1,311,771
111年9月30日							
成本	$ 225,914	$ 337,506	$ 1,102,499	$ 18,831	$ 444,909	$ 78,609	$ 2,208,268
累計折舊及減損	-	(117,373)	(524,825)	(12,491)	(241,808)	-	(896,497)
	$ 225,914	$ 220,133	$ 577,674	$ 6,340	$ 203,101	$ 78,609	$ 1,311,771

1.不動產、廠房及設備借款成本資本化金額及利率區間：

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
資本化金額	$ 3,978	$ 1,470
資本化利率區間	2.18%~2.42%	1.70%~1.92%

2.以不動產、廠房及設備提供擔保之資訊，請詳附註八之說明。

(五)租賃交易－承租人

1.本公司租賃之標的資產為停車場等，租賃合約之期間通常介於 1 到 5 年。租賃合約是採個別協商並包含各種不同的條款及條件，除租賃之資產不得用作借貸擔保外，未有加諸其他之限制。本公司承租之電瓶及保管箱因租賃期間不超過 12 個月而歸屬為短期租賃合約。

2.使用權資產之帳面價值與認列之折舊費用資訊如下：

	帳面金額		
	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
停車場	$ 4,655	$ 6,207	$ 6,724

	折舊費用	
	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
停車場	$ 518	$ 518

	折舊費用	
	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
停車場	$ 1,552	$ 1,552

3.與租賃合約有關之損益項目資訊如下：

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
影響當期損益之項目		
租賃負債之利息費用	$ 22	$ 30
屬短期租賃合約之費用	9	14

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
影響當期損益之項目		
租賃負債之利息費用	$ 72	$ 98
屬短期租賃合約之費用	27	36

4.本公司於民國 112 年及 111 年 7 月 1 日至 9 月 30 日暨 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日度租賃現金流出總額分別為$549、$555、$1,647 及 $1,656。

（六）無形資產

	電腦軟體
112年1月1日	
成本	$ 29,645
累計攤銷及減損	(14,378)
	$ 15,267
112年	
1月1日	$ 15,267
增添	5,093
攤銷費用	(12,769)
9月30日	$ 7,591
112年9月30日	
成本	$ 34,738
累計攤銷及減損	(27,147)
	$ 7,591

	電腦軟體
111年1月1日	
成本	$ 14,686
累計攤銷及減損	(8,181)
	$ 6,505
111年	
1月1日	$ 6,505
增添	6,868
攤銷費用	(3,745)
9月30日	$ 9,628
111年9月30日	
成本	$ 21,554
累計攤銷及減損	(11,926)
	$ 9,628

無形資產攤銷明細如下：

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
管理費用	$ 2,259	$ 93
製造費用	1,684	889
	$ 3,943	$ 982

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
管理費用	$ 6,527	$ 1,924
製造費用	6,242	1,821
	$ 12,769	$ 3,745

（七）其他非流動資產

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
預付設備款	$ 24,542	$ 56,365	$ 44,914
存出保證金	3,008	3,011	3,006
合計	$ 27,550	$ 59,376	$ 47,920

（八）其他應付款

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
應付薪資及獎金	$ 34,908	$ 43,178	$ 44,439
應付設備款	23,303	108,322	40,568
應付勞健保	5,629	-	5,634
應付未休假獎金	2,842	4,074	9,565
應付員工及董事酬勞	-	17,105	20,913
其他	37,939	53,726	58,479
	$ 104,621	$ 226,405	$ 179,598

（九）長期借款

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	112年9月30日
長期銀行借款				
擔保借款	自107年9月14日至122年8月29日，依議定期間及分額攤還	1.5%～2.561%	註	$ 485,162
信用借款	自110年4月28日至119年8月15日，依議定期間及分額攤還	1.395%～2.604%	無	234,896
				720,058
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(146,751)
				$ 573,307

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	111年12月31日
長期銀行借款				
擔保借款	自107年9月10日至118年5月11日，依議定期間及分額攤還	1.87%～2.28%	註	$ 365,443
信用借款	自109年4月27日至118年5月11日，依議定期間及分額攤還	1.85%～2.33%	無	158,999
				524,442
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(166,776)
				$ 357,666

借款性質	借款期間及還款方式	利率區間	擔保品	111年9月30日
長期銀行借款				
擔保借款	自107年9月10日至115年10月5日，依議定期間及分額攤還	1.675%～2.025%	註	$ 326,806
信用借款	自109年4月27日至118年5月11日，依議定期間及分額攤還	1.85%～2.21%	無	247,532
				574,338
減：一年或一營業週期內到期之長期借款				(179,904)
				$ 394,434

註：有關長期借款擔保品價值，請詳附註八。

(十)退休金

1.(1)本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算，15 年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。

(2)民國 112 年及 111 年 7 月 1 日至 9 月 30 日暨 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，本公司依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為$276、$310、$862 及$941。

2.(1)自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司及國內子公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 2%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

(2)民國 112 年及 111 年 7 月 1 日至 9 月 30 日暨 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，本公司依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為$3,155、$3,224、$9,377 及$9,843。

(十一)股份基礎給付

1.民國 112 年 9 月 30 日，本公司之股份基礎給付協議如下：

協議之類型	給與日	給與數量	合約期間	既得條件
現金增資保留員工認購	111年8月19日	366,000	不適用	立即既得

2.本公司於民國 111 年給與之股份基礎給付交易使用 Black-Scholes-Merton 選擇權評價模式估計認股選擇權之公允價值，相關資訊如下：

協議之類型	給與日	股價	履約價格	預期波動率	預期存續期間	無風險利率	每單位公允價值
現金增資保留員工認購	111年8月19日	$ 44.71	$ 45.00	33.95%	0.2630年	1.38%	$3.0427

3.股份基礎給付交易產生之費用如下：

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
權益交割	$ -	$ 1,114

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
權益交割	$ -	$ 1,114

(十二)股本

1.民國 112 年 9 月 30 日止，本公司額定資本額為$1,000,000，分為 100,000 仟股，實收資本額為$646,600，每股面額 10 元。本公司已發行股份之股款均已收訖。

本公司普通股期初與期末流通在外股數調節如下：

股數:仟股

	112年	111年
1月1日流通在外股數	64,600	61,000
現金增資	-	3,660
9月30日流通在外股數	64,600	64,660

2. 本公司於民國 111 年 5 月 11 日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股 3,660 仟股，除依法保留 10%供員工認股，其餘由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購，每股認購價格新台幣 45 元，現金增資基準日為民國 111 年 8 月 19 日。

(十三)資本公積

依公司法規定，超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積，除得用於彌補虧損外，於公司無累積虧損時，按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定，以上開資本公積撥充資本時，每年以其合計數不超過實收資本額百分之十為限。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時，不得以資本公積補充之。

	112年			
	發行溢價	庫藏股票交易	員工認股權	合計
1月1日/9月30日	$ 128,100	$ 13,775	$ 1,114	$ 142,989

	111年			
	發行溢價	庫藏股票交易	員工認股權	合計
1月1	$ -	$ 13,775	$ -	$ 13,775
現金增資	128,100	-	-	128,100
股份基礎給付酬勞成本	-	-	1,114	1,114
9月30日	$ 128,100	$ 13,775	$ 1,114	$ 142,989

(十四)保留盈餘

1. 依本公司章程，年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

2. 法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現金外，不得使用之，惟發給新股或現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

3.民國 112 年 6 月 29 日及民國 111 年 4 月 22 日經股東會決議通過民國 111 年及 110 年度之盈餘分派案如下：

	111年	110年
	金額	金額
法定盈餘公積	$ 17,182	$ 31,543
現金股利	96,990	91,500
合計	$ 114,172	$ 123,043

(十五)營業收入

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
客戶合約之收入	$ 236,173	$ 295,604
	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
客戶合約之收入	$ 620,556	$ 982,732

1.本公司之收入明細如下：

112年7月1日至9月30日	積體電路測試	其他	合計
外部客戶合約收入	$ 169,356	$ 66,817	$ 236,173
收入認列時點			
隨時間逐步認列之收入	$ 169,356	$ 66,817	$ 236,173
111年7月1日至9月30日	**積體電路測試**	**其他**	**合計**
外部客戶合約收入	$ 224,655	$ 70,949	$ 295,604
收入認列時點			
隨時間逐步認列之收入	$ 224,655	$ 70,949	$ 295,604
112年1月1日至9月30日	**積體電路測試**	**其他**	**合計**
外部客戶合約收入	$ 447,669	$ 172,887	$ 620,556
收入認列時點			
隨時間逐步認列之收入	$ 447,669	$ 172,887	$ 620,556
111年1月1日至9月30日	**積體電路測試**	**其他**	**合計**
外部客戶合約收入	$ 747,465	$ 235,267	$ 982,732
收入認列時點			
隨時間逐步認列之收入	$ 747,465	$ 235,267	$ 982,732

2.合約資產及合約負債

本公司認列客戶合約收入相關之合約資產及合約負債如下：

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
合約資產:			
合約資產-積體電路測試	$ 56,065	$ 89,407	$ 88,149
合約負債:			
合約負債-積體電路測試	$ 2,667	$ 5,023	$ 4,829

	111年1月1日
合約資產:	
合約資產-積體電路測試	$ 61,406
合約負債:	
合約負債-積體電路測試	$ 296

3.本公司認列之合約資產備抵損失請詳附註十二(二)。

4.期初合約負債本期認列收入

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
合約負債期初餘額		
本期認列收入		
客戶合約收入	$ -	$ -
	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
合約負債期初餘額		
本期認列收入		
客戶合約收入	$ 5,008	$ 296

(十六)利息收入

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
銀行存款利息	$ 36	$ 60
	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
銀行存款利息	$ 965	$ 191

（十七）其他收入

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
租金收入	$ 128	$ 131
其他收入－其他	4,364	2,135
	$ 4,492	$ 2,266

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
租金收入	$ 392	$ 392
其他收入－其他	10,143	15,114
	$ 10,535	$ 15,506

（十八）其他利益及損失

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
處分不動產、廠房及設備損失	$ -	($ 1,769)
外幣兌換利益	4,407	6,533
什項支出	(325)	(28)
	$ 4,082	$ 4,736

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
處分不動產、廠房及設備損失	$ -	($ 1,104)
外幣兌換利益	8,660	18,623
什項支出	(503)	(211)
	$ 8,157	$ 17,308

（十九）財務成本

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
利息費用		
銀行借款	$ 2,252	$ 2,541
租賃負債	22	30
	$ 2,274	$ 2,571

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
利息費用		
銀行借款	$ 6,071	$ 7,283
租賃負債	72	98
	$ 6,143	$ 7,381

(二十)費用性質之額外資訊

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
員工福利費用	$ 111,307	$ 107,613
折舊費用	$ 66,760	$ 72,745
無形資產攤銷費用	$ 3,943	$ 982
營業成本及營業費用	$ 182,010	$ 181,340
	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
員工福利費用	$ 270,488	$ 351,989
折舊費用	$ 211,524	$ 217,906
無形資產攤銷費用	$ 12,769	$ 3,745
營業成本及營業費用	$ 494,781	$ 573,640

(二十一)員工福利費用

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
薪資費用	$ 94,347	$ 82,710
股份基礎給付酬勞成本	-	1,114
勞健保費用	8,994	8,956
退休金費用	3,431	3,534
董事酬金	(35)	717
其他用人費用	4,570	10,850
	$ 111,307	$ 107,881
	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
薪資費用	$ 220,908	$ 288,950
股份基礎給付酬勞成本	-	1,114
勞健保費用	26,450	27,373
退休金費用	10,239	10,784
董事酬金	-	4,647
其他用人費用	12,891	19,389
	$ 270,488	$ 352,257

1. 依本公司民國 110 年 6 月 25 日修正後章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不高於 3%，員工酬勞不低於 10%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補累積虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

   依本公司民國 111 年 5 月 30 日及 111 年 8 月 2 日修正後章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不高於 3%，員工酬勞不高於 12%且不低於 5%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補累積虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本公司民國 112 年 7 月 1 日至 9 月 30 日及 112 年 1 月 1 日至 9 月 30 日為營運虧損，故未估列員工酬勞及董事酬勞。

3. 本公司民國 111 年 7 月 1 日至 9 月 30 日及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日員工酬勞估列金額分別為$2,506 及$16,266；董事酬勞估列金額分別為$717 及$4,647，前述金額帳列薪資費用。

4. 經董事會決議之民國 111 年度員工酬勞$12,218 及董事酬勞$4,887，與民國 111 年度財務報告認列之金額一致。

5. 本公司董事會通過之員工及董事酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(二十二)所得稅

1. 所得稅(利益)費用

所得稅(利益)費用組成部分：

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
當期所得稅：		
當期所得產生之所得稅	$ -	$ 8,396
以前年度所得稅(高)低估	-	-
當期所得稅總額	-	8,396
遞延所得稅：		
暫時性差異之		
原始產生及迴轉	-	(345)
所得稅(利益)費用	$ -	$ 8,051

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
當期所得稅：		
當期所得產生之所得稅	$ -	$ 41,493
以前年度所得稅(高)低估	(11,453)	15,949
當期所得稅總額	(11,453)	57,442
遞延所得稅：		
暫時性差異之		
原始產生及迴轉	-	(1,725)
所得稅(利益)費用	($ 11,453)	$ 55,717

2. 本公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至民國 110 年度。

（二十三）每股盈餘（虧損）

	112年7月1日至9月30日		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘（元）
基本每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 3,218	64,660	$ 0.05

	111年7月1日至9月30日		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘（元）
基本每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 32,129	62,711	$ 0.51
稀釋每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 32,129	62,711	
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	268	
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 32,129	62,979	$ 0.51

	112年1月1日至9月30日		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股虧損（元）
基本每股虧損			
歸屬於普通股股東之本期淨損	($ 55,133)	64,660	($ 0.85)

	111年1月1日至9月30日		
	稅後金額	加權平均流通在外股數(仟股)	每股盈餘（元）
基本每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 155,721	61,576	$ 2.53
稀釋每股盈餘			
歸屬於普通股股東之本期淨利	$ 155,721	61,576	
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	627	
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	$ 155,721	62,203	$ 2.50

(二十四)現金流量補充資訊

僅有部分現金支付之投資活動：

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
購置不動產、廠房及設備（含重分類）	$ 262,123	$ 273,180
加：期初應付設備款	108,322	106,449
減：期末應付設備款	(23,303)	(40,568)
加：期末預付設備款	24,542	44,914
減：期初預付設備款	(56,365)	(26,852)
本期支付現金	$ 315,319	$ 357,123

(二十五)來自籌資活動之負債之變動

	112年		
	租賃負債	長期借款	來自籌資活動之負債總額
1月1日	$ 6,312	$ 524,442	$ 530,754
籌資現金流量之變動	(1,548)	195,616	194,068
利息支付數	(72)	-	(72)
租賃負債之利息	72	-	72
9月30日	$ 4,764	$ 720,058	$ 724,822

	111年			
	短期借款	租賃負債	長期借款	來自籌資活動之負債總額
1月1日	$ 80,000	$ 8,345	$ 454,549	$ 542,894
籌資現金流量之變動	(80,000)	(1,521)	119,789	38,268
利息支付數	-	(98)	-	(98)
租賃負債之利息	-	98	-	98
9月30日	$ -	$ 6,824	$ 574,338	$ 581,162

七、關係人交易

(一)關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
微石開發股份有限公司	其他關係人
辰謙投資有限公司	其他關係人
張少謙	其他關係人

(二)與關係人間之重大交易事項

1.應付關係人款項

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
其他應付款：			
其他關係人	$ -	$ 278	$ -

2.其他交易

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
其他關係人-		
管理費用-交際費	$ 808	$ 1,137
管理費用-其他	$ 164	$ 30

	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
其他關係人-		
管理費用-交際費	$ 1,956	$ 2,811
管理費用-其他	$ 494	$ 299

(三)主要管理階層薪酬資訊

	112年7月1日至9月30日	111年7月1日至9月30日
短期員工福利	$ 3,944	$ 4,101
退職後福利	136	234
總計	$ 4,080	$ 4,335
	112年1月1日至9月30日	111年1月1日至9月30日
短期員工福利	$ 12,431	$ 19,093
退職後福利	413	234
總計	$ 12,844	$ 19,327

八、質押之資產

本公司之資產提供擔保明細如下：

	帳面價值			
資產項目	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日	擔保用途
土地	$ 225,914	$ 225,914	$ 225,914	長、短期借款
房屋及建築	213,354	218,407	220,133	長、短期借款
機器設備	226,975	213,257	242,164	長期借款
其他設備	9,785	7,049	18,267	長期借款
存出保證金	2,648	3,011	2,645	關稅保證金
	$ 678,676	$ 667,638	$ 709,123	

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

已簽約但尚未發生之資本支出

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
不動產、廠房及設備	$ 390,011	$ 520,154	$ 500,124

十、重大之災害損失

無。

十一、重大之期後事項

無。

十二、其他

(一)資本管理

本公司之資本管理目標，係為保障公司能繼續經營，維持最佳資本結構以降低資金成本，並為股東提供報酬。為了維持或調整資本結構，本公司可能會調整支付予股東之股利金額、退還資本予股東、發行新股或出售資產以降低債務。本公司利用負債資本比率以監控其資本，該比率係按債務淨額除以資本總額計算。

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
負債總額	$ 891,287	$ 827,803	$ 836,555
資產總額	$ 2,088,884	$ 2,177,523	$ 2,170,177
負債/資產比率	43%	38%	39%

(二)金融工具

1.金融工具之種類

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
金融資產			
按攤銷後成本衡量之金融資產			
現金及約當現金	$ 274,992	$ 334,482	$ 402,036
按攤銷後成本衡量之金融資產	6,600	6,500	6,500
應收票據	171	974	1,081
應收帳款	238,518	246,026	256,700
其他應收款	3,230	2,584	1,958
存出保證金	3,008	3,011	3,006
	$ 526,519	$ 593,577	$ 671,281
金融負債			
按攤銷後成本衡量之金融負債			
應付票據	$ -	$ 2,555	$ -
應付帳款	23,313	19,338	26,943
其他應付款(含關係人)	104,621	226,405	179,598
長期借款(包含一年或一營業週期內到期)	720,058	524,442	574,338
	$ 847,992	$ 772,740	$ 780,879
租賃負債	$ 4,764	$ 6,312	$ 6,824

2.風險管理政策

(1)本公司日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險(包括匯率風險、利率風險、及價格風險)、信用風險及流動性風險。本公司整體風險管理著重於金融市場的不可預測事項，並尋求可降低對財務狀況及財務績效之不利影響。

(2)風險管理工作由本公司財務部按照董事會核准之政策執行。本公司財務部透過與本公司內各營運單位密切合作，以負責辨認、評估與規避財務風險。財務風險管理政策業經定期覆核以反映市場情形及本公司運作之變化。

3.重大財務風險之性質及程度

(1)市場風險

匯率風險

A.本公司係跨國營運，因此受相對與本公司功能性貨幣不同的交易所產生之匯率風險，主要為美元。相關匯率風險來自未來之商業交易及已認列之資產與負債。

B.本公司以自然避險為原則，依據各幣別資金需求及淨部位(外幣資產與負債部位之差額)依照市場外匯狀況進行避險；當發生短期不平衡時，即藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保匯率風險保持在可接受水準。

C.本公司從事之業務涉及若干非功能性貨幣(本公司之功能性貨幣為新台幣)，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊如下：

	112年9月30日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 4,137	32.27	$ 133,501
金融負債			
貨幣性項目：			
美金：新台幣	$ 73	32.27	$ 2,356
日圓：新台幣	64,853	0.22	14,021

	111年12月31日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 4,649	30.71	$ 142,771
金融負債			
美金：新台幣	$ 766	30.71	$ 23,524

	111年9月30日		
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	$ 5,087	31.75	$ 161,512
金融負債			
貨幣性項目：			
美金：新台幣	$ 1,278	31.75	$ 40,577

D.本公司貨幣性項目因匯率波動具重大影響於民國112年及111年7月1日至9月30日暨112年及111年1月1日至9月30日認列之全部兌換利益(含已實現及未實現)彙總金額分別為$4,407、$6,533、$8,660及$18,623。

E.本公司因重大匯率波動影響之外幣市場風險分析如下：

	112年1月1日至9月30日		
	敏感度分析		
	變動幅度	影響損益	影響其他綜合損益
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	$ 1,335	$ -
金融負債			
貨幣性項目：			
美金：新台幣	1%	$ 24	$ -
日幣：新台幣	1%	140	-

	111年1月1日至9月30日		
	敏感度分析		
	變動幅度	影響損益	影響其他綜合損益
(外幣:功能性貨幣)			
金融資產			
貨幣性項目			
美金：新台幣	1%	$ 1,615	$ -
金融負債			
貨幣性項目：無。			
美金：新台幣	1%	$ 406	$ -

價格風險

本公司未有重大商品價格風險之暴險。

現金流量及公允價值利率風險

A.本公司之利率風險主要來自短期及長期借款。按浮動利率之借款使本公司承受現金流量利率風險，部分風險被按浮動利率持有之現金及約當現金抵銷。按固定利率之借款則使本公司承受公允價值利率風險。於民國 112 年 9 月 30 日、111 年 12 月 31 日及 111 年 9 月 30 日，本公司按浮動利率計算之借款係以新台幣計價。

B.於民國 112 年及 111 年 9 月 30 日，若新台幣借款利率增加或減少 1%，在所有其他因素維持不變之情況下，民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之稅後淨利將分別減少或增加$5,760 及$3,446，主要係因浮動利率借款導致利息費用增加/減少。

(2)信用風險

A.本公司之信用風險係因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而導致本公司財務損失之風險，主要來自交易對手無法清償按收款條件支付之應收帳款，及分類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

B.本公司係以公司角度建立信用風險之管理。對於往來之銀行及金融機構，設定僅有信評等級良好者，始可被接納為交易對象。依內部明定之授信政策，公司內各營運個體與每一新客戶於訂定付款及提出交貨之條款與條件前，須對其進行管理及信用風險分析。內部風險控管係透過考慮其財務狀況、過往經驗及其他因素，以評估客戶之信用品質。個別風險之限額係管理階層依內部或外部之評等而制訂，並定期監控信用額度之使用。

C.本公司採用 IFRS9 提供前提假設，當合約款項按約定之支付條款逾期超過 90 天，視為已發生違約。

D.本公司採用 IFRS9 提供以下之前提假設，當合約款項按約定之支付條款逾期超過 30 天，視為金融資產自原始認列後信用風險已顯著增加之依據。

E.本公司用以判定債務工具投資為信用減損之指標如下：

(A)發行人發生重大財務困難，或將進入破產或其他財務重整之可能性大增；

(B)發行人由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失；

(C)發行人延滯或不償付利息或本金；

(D)導致發行人違約有關之全國性或區域性經濟情況不利之變化。

F.本公司經追索程序後，對無法合理預期可回收金融資產之金額予以沖銷，為本公司仍會持續進行追索之法律程序以保全債權之權利。

G.本公司持有之按攤銷後成本衡量之金融資產係屬存放於銀行之定期存款及受限制之定期存款，該等銀行之信用評等均為良好，過去未發生逾期之情形，且考量整體經濟環境無重大變動，故評估發生信用損失之風險極低，對財務報表之影響金額亦不大。

H.本公司按客戶評等之特性將對客戶之應收帳款及合約資產分組，採用簡化作法以準備矩陣為基礎估計預期信用損失。

I.本公司對未來前瞻性的考量調整按特定期間歷史及現時資訊所建立之損失率，以估計應收帳款及合約資產備抵損失，民國 112 年 9 月 30 日、111 年 12 月 31 日及 111 年 9 月 30 日之準備矩陣如下：

	未逾期	逾期 1-30天	逾期 31-90天	逾期 91-180天	逾期 181天以上	合計
112年9月30日						
預期損失率	0.41%	100%	100%	100%	100%	
帳面價值總額	$ 239,505	$ 520	$ 15	$ 12	$ -	$240,052
備抵損失	$ 987	$ 520	$ 15	$ 12	$ -	$ 1,534

111年12月31日	未逾期	逾期 1-30天	逾期 31-90天	逾期 91-180天	逾期 181天以上	合計
預期損失率	0%	1%	14%	100%	100%	
帳面價值總額	$ 236,852	$ -	$10,638	$ 43	$ 27	$247,560
備抵損失	$ -	$ -	$ 1,464	$ 43	$ 27	$ 1,534

111年9月30日	未逾期	逾期 1-30天	逾期 31-90天	逾期 91-180天	逾期 181天以上	合計
預期損失率	0%	0%	84.95%	100%	100%	
帳面價值總額	$ 255,569	$ 1,103	$ 187	$ 1,040	$ 335	$258,234
備抵損失	$ -	$ -	$ 159	$ 1,040	$ 335	$ 1,534

J.本公司採簡化作法之應收帳款及合約資產備抵損失變動表如下：

	112年	111年
1月1日	$ 10,251	$ 12,267
提列減損損失	1,519	5,959
因無法收回而沖銷之款項	-	(10,733)
9月30日	$ 11,770	$ 7,493

(3)流動性風險

A.現金流量預測是由公司內各營運個體執行，並由公司財務部予以彙總。公司財務部監控公司流動資金需求之預測，確保其有足夠資金得以支應營運需要，並在任何時候維持足夠之未支用的借款承諾額度，以使公司不致違反相關之借款限額或條款，此等預測考量公司之債務融資計畫、債務條款遵循、符合內部資產負債表

之財務比率目標，及外部監管法令之要求。

B.各營運個體所持有之剩餘現金，在超過營運資金之管理所需時，將轉撥回公司財務部。公司財務部則將剩餘資金投資於定存存款，其所選擇之工具具有適當之到期日或足夠流動性，以因應上述預測並提供充足之調度水位。

C.本公司未動用借款額度明細如下：

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
浮動利率			
一年內到期	$ 570,000	$ 620,000	$ 570,000
一年以上到期	1,353,004	361,625	308,962
	$ 1,923,004	$ 981,625	$ 878,962

D.下表係本公司之非衍生金融負債，按相關到期日予以分組，非衍生金融負債係依據資產負債表日至合約到期日之剩餘期間進行分析。下表所揭露之合約現金流量金額係未折現之金額（含本金及利息）：

112年9月30日	1年內	1至5年內	5年以上
非衍生金融負債:			
應付帳款	$ 23,313	$ -	$ -
其他應付款	104,621	-	-
租賃負債	2,160	2,700	-
長期借款(包含一年內到期)	162,531	638,371	-

111年12月31日	1年內	1至5年內	5年以上
非衍生金融負債:			
應付票據	$ 2,555	$ -	$ -
應付帳款	19,338	-	-
其他應付款	226,405	-	-
租賃負債	2,160	4,320	-
長期借款(包含一年內到期)	169,868	377,051	-

111年9月30日	1年內	1至5年內	5年以上
非衍生金融負債:			
應付帳款	$ 26,943	$ -	$ -
其他應付款	179,598	-	-
租賃負債	2,160	4,860	-
長期借款(包含一年內到期)	190,719	430,064	-

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

1.資金貸與他人：無。

2.為他人背書保證：無。

3.期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)：無。

4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

9.從事衍生工具交易：無。

10.母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額：無。

(二)轉投資事業相關資訊

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊（不包含大陸被投資公司)：無。

(三)大陸投資資訊

1.基本資料：無。

2.直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項：無。

十四、營運部門資訊

(一)一般性資訊

本公司僅經營單一產業，且公司營運決策者係以公司整體評估績效及分配資源，經辨認本公司為一應報導部門。

(二)部門損益、資產與負債之資訊

民國112年1月1日至9月30日	金額
來自外部客戶之收入	$ 620,556
部門(損)益（註）	($ 66,586)
部門資產	$ 2,088,884
部門負債	$ 891,287

民國111年1月1日至9月30日	金額
來自外部客戶之收入	$ 982,732
部門(損)益（註）	$ 211,438
部門資產	$ 2,170,177
部門負債	$ 836,555

註：不包含所得稅費用。

(三)部門損益之調節資訊：無。

附件四

內部控制聲明書

微矽電子股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：112年10月18日

本公司民國 112 年 1 月 1 日至民國 112 年 6 月 30 日之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、為初次申請股票上市之需要，本公司依據「處理準則」第二十五條及「臺灣證券交易所股份有限公司審查有價證券上市作業程序」第六條之規定，委託會計師專案審查上開期間與外部財務報導之可靠性及與保障資產安全(使資產不致在未經授權之情況下取得、使用或處分)有關的內部控制制度，如前項所述，其設計及執行係屬有效，並無影響財務資訊之記錄、處理、彙總及報告可靠性之重大缺失，亦無影響保障資產安全，使資產在未經授權之情況下逕行取得、使用或處分之重大缺失。

七、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

八、本聲明書業經本公司民國 112 年 10 月 18 日董事會通過，出席董事 9 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

微矽電子股份有限公司

董事長：張秉堂　　簽章

總經理：張秉堂　　簽章

附件五

內部控制制度審查報告

pwc 資誠

內部控制制度審查確信報告

資會綜字第23004851號

微矽電子股份有限公司　公鑒：

後附微矽電子股份有限公司（以下稱「微矽公司」）民國112年10月18日謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國112年6月30日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師執行合理確信審查程序竣事。

標的、標的資訊與適用基準

本確信案件之標的及標的資訊係微矽公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度於民國112年6月30日之設計及執行情形，及微矽公司於民國112年10月18日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書(以下併稱確信標的)。

用以衡量或評估上開確信標的之適用基準係「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目。

先天限制

由於任何內部控制制度均有其先天上之限制，故微矽公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

管理階層之責任

管理階層之責任係依據相關法令規章建立內部控制制度，且隨時檢討，以維持內部控制制度之設計及執行持續有效，並於評估其有效性後，據以出具內部控制制度聲明書。

會計師之責任

本會計師之責任係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」對確信標的執行必要程序以取得合理確信，並對確信標的在所有重大方面是否遵循適用基準及是否允當表達作成結論。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段333號27樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

pwc 資誠

獨立性及品質管理規範

本會計師及所隸屬會計師事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及專業上應有之注意、保密及專業行為。此外，本會計師所隸屬會計師事務所遵循品質管理準則，維持完備之品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及所適用法令相關之書面政策及程序。

所執行程序之彙總說明

本會計師係基於專業判斷規劃及執行必要程序，以獲取相關確信標的之證據。所執行之程序包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他審查程序。本會計師相信此項審查工作可對所表示之結論提供合理之依據。

確信結論

依本會計師意見，依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目判斷，微矽公司與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度於民國 112 年 6 月 30 日之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性；微矽公司於民國 112 年 10 月 18 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

強調事項段

微矽公司業已依照「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，針對取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理、關係人交易之管理、財務報表編製流程之管理及對子公司之監督與管理訂定相關作業程序。本會計師未因此而修正確信結論。

資誠聯合會計師事務所

李典易

會計師

白淑蒨

中華民國 112 年 10 月 18 日

附件六

法律意見書

律師法律意見書

微矽電子股份有限公司本次為申請股票上市，向臺灣證券交易所股份有限公司提出申請股票創新板上市交易。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依臺灣證券交易所股份有限公司「有價證券上市審查準則」、「有價證券上市審查準則補充規定」、「有價證券上市作業程序」、「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」及「公司募集與發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」等規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，微矽電子股份有限公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市，並未發現有違反法令致影響股票上市之情事。

此致

微矽電子股份有限公司

律師事務所：蔚中傑律師事務所

律師：蔚中傑

中　華　民　國　112　年　10　月　26　日

律師法律意見書

微矽電子股份有限公司（以下簡稱該公司或微矽電子）本次為辦理現金增資募集與發行普通股 4,042 仟股，每股面額 10 元，發行總面額新臺幣 40,420 仟元整，向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，該公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此致

微矽電子股份有限公司

蔚中傑律師事務所

蔚中傑律師

中　華　民　國　1　1　2　年　12　月　29　日

註：總括申報發行新股案件應就首次發行或各次追補發行之股數、面額及總金額進行填列。

附件七

誠信聲明書

本公司茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

申請人：微矽電子股份有限公司

負責人：張秉堂

中　華　民　國　　112　年　10　月　26　日

本人為微矽電子股份有限公司之法人董事暨持股百分之十以上股東，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

法人董事暨持股百分之十以上股東：大日月投資有限公司

負責人：張秉堂

中　華　民　國　　112　年　10　月　26　日

本人為微矽電子股份有限公司之董事長暨法人董事(大日月投資有限公司)代表人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董事長暨法人董事代表人：張秉堂

中　華　民　國　　112　年　10　月　26　日

本人為微矽電子股份有限公司之法人董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

法人董事：辰真投資有限公司

負責人：張辰

中　華　民　國　112 年　10 月　26 日

本人為微矽電子股份有限公司之法人董事(辰真投資有限公司)代表人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

法人董事代表人：張辰　張辰

中　華　民　國　112　年　10　月　26　日

本人為微矽電子股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

總經理：張秉堂　　特別助理：張辰

副總經理：王志成　　半導體事業處協理：林坤田

廠務部協理：曾雄亮　　財務部經理：呂月雲

管理部經理兼公司治理主管：官淑惠

中　華　民　國　　112 年　10 月　26 日

本人為微矽電子股份有限公司之董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董　事：彭盈光

彭盈光

中　華　民　國　　112　年　10　月　26　日

本人為微矽電子股份有限公司之董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董　事：張蔚誠

中　華　民　國　　112　年　10　月　26　日

本人為微矽電子股份有限公司之董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

三、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

四、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董　事：楊式蘭

楊式蘭

中　華　民　國　112 年　10 月　26 日

本人為微矽電子股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：張居興

張居興

中　華　民　國　　112 年　10 月　26 日

本人為微矽電子股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：彭俊豪　彭俊豪

中　華　民　國　112 年　10 月　26 日

本人為微矽電子股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：溫萬壽 溫萬壽

中　華　民　國　112 年　10 月　26 日

本人為微矽電子股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

三、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

四、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：譚仲民

譚 仲 民

中　華　民　國　　112 年　10 月　26 日

本人為微矽電子股份有限公司之受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

稽核主管：黃詩萍 黃詩萍

中　華　民　國　112 年　10 月　26 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷微矽電子股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

主辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

負　　責　　人：陳佩君 陳佩君 公務專用章

中　華　民　國　　112 年　10 月　26 日

7

本公司及本公司相關人員輔導並承銷微矽電子股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負　　責　　人：黃進明

中　華　民　國　　112　年　10　月　26　日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷微矽電子股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：富邦綜合證券股份有限公司

負　　責　　人：程明乾

中　華　民　國　　112　年　10　月　26　日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷微矽電子股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：宏遠證券股份有限公司

負　　責　　人：姜克勤

中　華　民　國　　112 年　　10 月　　26 日

本律師承辦微矽電子股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

律師事務所：蔚中傑律師事務所

律師：蔚中傑

中　華　民　國　　112　年　10　月　26　日

本律師承辦微矽電子股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

律師事務所：陳豪杉律師事務所

律師：陳豪杉

中　華　民　國　112　年　10　月　26　日

本會計師承辦微矽電子股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

會計師事務所：資誠聯合會計師事務所

會計師：李典易

白淑蒨

中 華 民 國 1 1 2 年 1 0 月 2 6 日

附件八

不得退還或收取承銷相關費用之聲明書

聲明書

本公司、本公司之董事及監察人、總經理、財務或會計主管以及與本公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

發行人：微矽電子股份有限公司

負責人：張秉堂

中　華　民　國　　112　年　12　月　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之法人董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事：大日月投資有限公司

負責人：張秉堂

中　華　民　國　　112　年　12　月　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之法人董事(大日月投資有限公司)代表人暨總經理，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事代表人暨總經理：張秉堂

中　華　民　國　　112　年　12　月　9　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之法人董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事：辰真投資有限公司

負責人：張辰

中　華　民　國　　112　年　12　月　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之法人董事(辰真投資有限公司)代表人，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事代表人：張辰

張辰

中　華　民　國　112　年　12　月　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事：彭盈光 彭盈光

中　華　民　國　112　年　12　月　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事：張蔚誠

中　華　民　國　112　年　12　月　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事：楊式蘭

楊式蘭

中　華　民　國　　112　年　　12　月　　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之獨立董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：張居興

張居興

中　華　民　國　　112　年　　12　月　　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之獨立董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：溫萬壽

溫萬壽

中　華　民　國　　112　年　　12　月　　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之獨立董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：彭俊豪

彭俊豪

中　華　民　國　112　年　12　月　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之獨立董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：譚仲民

譚仲民

中　華　民　國　　112　年　12　月　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之經理人/受僱人，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：張辰(特別助理)

張辰

王志成(副總經理)

王志成

林坤田(半導體事業處協理)

林坤田

曾雄亮(廠務部協理) 曾雄亮

官淑惠(管理部經理兼公司治理主管) 官淑惠

受僱人：黃詩萍(稽核主管) 黃詩萍

中　華　民　國　112　年　12　月　29　日

聲明書

本人擔任微矽電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之財務暨會計主管，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

財務暨會計主管：呂月雲

呂月雲

中　華　民　國　　112　年　12　月　29　日

聲明書

本公司受微矽電子股份有限公司（下稱微矽電子公司）委託，擔任微矽電子公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、微矽電子公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

負責人：陳佩君 陳佩君 公務專用章

日　期：112 年 12 月 29 日

聲明書

本公司受微矽電子股份有限公司（下稱微矽電子公司）委託，擔任微矽電子公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、微矽電子公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：黃進明

日　期：112 年 12 月 29 日

聲明書

本公司受微矽電子股份有限公司（下稱微矽電子公司）委託，擔任微矽電子公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、微矽電子公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：富邦綜合證券股份有限公司

負責人：程明乾

日　期：112 年 12 月 29 日

聲明書

本公司受微矽電子股份有限公司（下稱微矽電子公司）委託，擔任微矽電子公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、微矽電子公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：宏遠證券股份有限公司

負責人：姜克勤

日　期：112 年 12 月 29 日

附件九

不受理特定投標對象聲明書

聲　明　書

茲聲明本公司辦理創新板上市前現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：微矽電子股份有限公司

負責人：張秉堂

中　華　民　國　112　年　12　月　29　日

聲 明 書

茲聲明本公司主辦微矽電子股份有限公司於創新板上市前現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：兆豐證券股份有限公司

負責人：陳 佩 君

陳佩君 公務專用章

中 華 民 國 112 年 12 月 29 日

聲　明　書

茲聲明本公司協辦微矽電子股份有限公司於創新板上市前現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：黃進明

中　華　民　國　112　年　12　月　29　日

聲　明　書

茲聲明本公司協辦微矽電子股份有限公司於創新板上市前現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：富邦綜合證券股份有限公司

負責人：程明乾

中　華　民　國　112　年　12　月　29　日

聲　明　書

茲聲明本公司協辦微矽電子股份有限公司於創新板上市前現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：宏遠證券股份有限公司

負責人：姜克勤

中　華　民　國　112　年　12　月　29　日

附件十

財務業務往來無非常規交易情事聲明書

聲　明　書

本公司目前未有認定之集團企業公司，未來若有集團企業公司且有財務業務往來之情形，將依循常規辦理，而無非常規交易之情事。

特　此　聲　明

申請人：微矽電子股份有限公司

負責人：張秉堂

中　　華　　民　　國　112　年　12　月　29　日

附件十一

證券承銷商評估總結意見

承銷商總結意見

微矽電子股份有限公司本次為辦理創新板上市前現金增資發行普通股 4,042 千股，每股面額新台幣壹拾元整，合計發行總金額為新台幣 40,420 千元，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解微矽電子股份有限公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，微矽電子股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

兆豐證券股份有限公司

負責人：陳 佩 君

承銷部門主管：郝 振 邦

中 華 民 國 1 1 2 年 12 月 29 日

附件十二

承銷價格計算書

微矽電子股份有限公司
承銷價格計算書

一、承銷總股數說明

(一)已發行股份總數

微矽電子股份有限公司(以下簡稱「微矽電子」或「該公司」) 股票申請初次創新板上市時之實收資本額為新台幣 646,600 千元，每股面額新台幣 10 元整，已發行股份總數為 64,660 千股。該公司擬於股票初次申請創新板上市案經主管機關審查通過後，辦理現金增資發行新股 4,042 千股，扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，全數委託證券承銷商辦理創新板上市前公開銷售，預計股票創新板上市掛牌時已發行股數為 68,702 千股及實收資本額為 687,020 千元。

(二)承銷股數來源

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十六條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第十七之一條規定，公開發行公司初次申請股票在創新板上市時，應至少提出擬上市股份總額百分之五之股份，且不得低於八十萬股，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購及應提出主辦證券承銷商認購之股數後，依證券交易法七十一條第一項包銷有價規定，委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。

(三)過額配售

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，本證券承銷商已與該公司簽訂過額配售協議，由該公司協調其股東提出對外公開承銷股數之百分之十五之額度內，提供已發行普通股股數供本證券承銷商辦理過額配售；惟本證券承銷商得依市場需求決定過額配售數量。

(四)股權分散

該公司截至 112 年 10 月 27 日止記名股東人數為 928 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數共計 912 人，且其所持股份合計 32,086,783 股，占發行股份總額的 49.62%。已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第二十九條有關登錄創新板之股權分散標準。

(五)綜上所述

該公司依擬上市股份總額之百分之十計算應提出公開承銷之股數，全數以現金增資發行新股之方式，委託本證券承銷商辦理上市前公開銷售，該現金增資案依據「證券交易法」第二十八之一條規定，經 111 年 8 月 2 日股東臨時會通過，原股東全數放棄認購以辦理上市前公開承銷。該公司辦理現金增資發行新股 4,042 千股，扣除依公

司法規定保留百分之十五額度內予員工優先認購之 606 千股後，其餘 3,436 千股全數提撥對外公開承銷。另本證券承銷商已與該公司簽訂過額配售協議，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數之 15%為上限，提供已發行普通股股票供本證券承銷商辦理過額配售，屆時本證券承銷商與該公司再依市場需求決定實際過額配售數量。

二、承銷價格

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

1. 微矽電子基本財務資料

(1)每股淨值

112 年第三季經會計師核閱之股東權益，按期末股數計算之每股淨值如下：

說　　明	金額/股數
歸屬母公司業主之權益	1,197,597 千元
期末股數	64,660 千股
每股淨值	18.52 元/股

資料來源：112 年第三季經會計師核閱之財務報告

(2)最近兩年度經會計師查核簽證之財務資料

① 簡明資產負債表

單位：新台幣千元

項目＼年度	110 年度	111 年度	112 年第三季
流動資產	689,391	708,320	608,584
不動產、廠房及設備	1,282,471	1,381,256	1,433,407
無形資產	6,505	15,267	7,591
使用權資產	8,276	6,207	4,655
其他資產	33,264	66,473	34,647
資產總額	2,019,907	2,177,523	2,088,884
流動負債	574,334	433,232	282,558
非流動負債	341,986	394,571	608,729
負債總額	916,320	827,803	891,287
股本	610,000	646,600	646,600
資本公積	13,775	142,989	142,989
保留盈餘	479,812	560,131	408,008
股東權益合計	1,103,587	1,349,720	1,197,597

資料來源：該公司 110 及 111 年度經會計師查核簽證之財務報告與 112 年第三季經會計師核閱之財務報告

②損益表

單位：新台幣千元

項目＼年度		110 年度	111 年度	112 年前三季
營業收入淨額		1,292,379	1,226,677	620,556
營業成本		780,595	823,369	577,296
營業毛利		511,784	403,308	43,260
營業費用		201,519	198,826	123,360
營業利益(損失)		310,265	204,482	(80,100)
營業外收入及支出		12,252	22,727	13,514
稅前淨利(淨損)		322,517	227,209	(66,586)
所得稅(費用)利益		(62,694)	(58,351)	11,453
本期淨利	歸屬於母公司業主	259,823	(55,133)	(58,351)
	歸屬於非控制權益	0	0	0
	合計	259,823	(55,133)	(58,351)
其他綜合損益		(11,390)	3,481	-
本期綜合損益總額		248,433	171,819	(55,133)
每股稅後純益(虧損)(元)(註 1)		4.31	2.70	(0.85)
追溯調整後每股稅後盈餘(虧損)(元)(註 2)		3.62	2.50	(0.80)

資料來源：該公司 110 及 111 年度經會計師查核簽證之財務報告與 112 年第三季經會計師核閱之財務報告

註 1：每股稅後純益係依當年度普通股流通在外加權平均股數計算。

註 2：追溯調整後每股稅後盈餘係以擬創新板上市股數 68,702 千股計算。

2. 承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

股票價值評估的方法很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法包括市場法如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，透過已公開的資訊和整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價的調整；成本法係以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎；另收益法如現金流量折現法則是將企業未來預估創造之現金流量折現後評定企業價值。本證券承銷商依一般市場承銷

價格訂定方式，參酌該公司所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素，並參考市場法、成本法、收益法及該公司近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格。茲就各種股票價值評價方法之計算方式、優點、缺點及適用時機彙總說明如下：

項目	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
計算方式	依據公司之財務資料，計算每股帳面盈餘，並以上市櫃公司或產業性質相近的同業平均本益比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	依據公司之財務資料，計算每股帳面淨值，比較上市櫃公司或產業性質相近的同業平均股價淨值比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎，即以資產負債表帳面資產總額減去帳面負債總額，並考量資產及負債之市場價格而進行帳面價值之調整。	根據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值。
優點	1. 具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據。 2. 市場價格資料容易取得。 3. 所估算之價值與市場的股價較為接近。	1. 淨值是長期且穩定之指標。 2. 當盈餘為負數時，係另一種評估選擇。 3. 市場價格資料容易取得。	1. 資料容易取得。 2. 使用財務報表資料，較為客觀公正。	1. 符合學理上對價值的推論，能依不同變數預期來評價公司。 2. 較不會受會計原則或會計政策不同影響，且可反應企業之永續經營價值。 3. 考量企業之成長性及風險。
缺點	1. 盈餘品質易受會計方法選擇所影響。 2. 企業每股盈餘為負值或接近於零時不適用。 3. 使用歷史性財務資訊，無法反應公司未來之績效。	1. 帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2. 即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。	1. 資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2. 未考量公司經營成效之優劣。	1. 程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2. 投資者不易瞭解現金流量觀念。 3. 預測時間較長。
適用時機	適合評估風險水準、股利政策及成長率穩定的公司。	適用於評價產業成熟型及穩定型之公司。	適合評估如公營、金融事業或傳統產業類股。	1. 可取得公司詳細的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2. 企業經營穩定，無鉅額資本支出。

3. 承銷價格與國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

該公司主要從事半導體測試(Semiconductor Testing)、半導體封裝(Semiconductor Packaging)及晶圓薄化(Wafer Thinning)等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC(Power Management Integrate Circuit, 以下簡稱電源管理 IC 或 PMIC)、金氧半場效電晶體(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，以下簡稱 MOSFET)產品及以氮化鎵(Gallium Nitride, 以下簡稱 GaN)或碳化矽(Silicon Carbide, 以下簡稱 SiC)為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。綜觀台灣上市半導體測試封裝公司其業務型態、產品性質及營業項目後，採以下三家公司做為採樣公司，京元電子股份有限公司（上市股票代號：2449，以下簡稱京元電子）主要營業項目為晶片研磨切割及測試封裝業務，終端應用涵蓋資訊、通訊、辦公室自動化、汽車電子以及消費性電子等相關產品；矽格股份有限公司（上市股票代號：6257，以下簡稱矽格）主要營業項目為測試封裝業務，終端應用涵蓋高效能運算、通訊、影音、消費性電子以及車用電子等相關產品；昇陽國際半導體股份有限公司（上市股票代號：8028，以下簡稱昇陽半導體）主要營業項目為晶圓再生服務及晶圓薄化製程服務，終端應用涵蓋消費性電子、工業用電子產品及汽車等電子元件。

股票價值評估的方法很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，茲將市場上常用之股票評價方法(市場法、成本法及收益法)分述如下：

(1)市場法

① 此法假設被評價公司之價值與同一產業類似公司間存在密切關係，因此以同一產業的類似公司作為評價比較的標準，通常以已上市、櫃同業股票之本益比或股價淨值比乘上目標公司之每股稅後純益或每股淨值，計算評價目標公司之合理價格。其評價模式為：

目標公司參考價值 $=\left(\dfrac{V_b}{X_b}\right)\times X_a$

X_a = 目標公司之財務變數，如稅後每股盈餘或每股淨值等

$\left(\dfrac{V_b}{X_b}\right)$ = 採樣公司之市場乘數

(實務上慣用類似公司之本益比或股價淨值比)

② 以市場法計算之承銷參考價格如下：

A.本益比法

茲就採樣同業、上市半導體類股及上市大盤最近三個月(112 年 11 月～113 年 1 月)之本益比區間列示如下：

單位：倍

項目 月份	採樣同業			上市	
	京元電子	矽格	昇陽半導體	半導體類股	大盤
112 年 11 月	17.54	16.97	23.07	18.27	20.48
112 年 12 月	17.99	17.34	22.55	18.94	21.12
113 年 1 月	17.80	18.01	22.16	19.54	21.17
平均	17.78	17.44	22.59	18.92	20.92

資料來源：臺灣證券交易所

由上表得知，該公司之採樣同業、上市半導體類股及上市大盤最近三個月之平均本益比約介於 17.44 至 22.59 倍間，而該公司最近四季(111 年第四季~112 年第三季)經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股盈餘(0.68)元為負值，因本益比法係以盈餘為評價基礎，若盈餘為負值則無法計算出合理價值，其本益比法無法反應該公司合理價值，故不擬採用本益比法。

B.股價淨值比法

茲就採樣同業、上市半導體類股及上市大盤最近三個月(112 年 11 月～113 年 1 月)之股價淨值比區間列示如下：

單位：倍

項目 月份	採樣同業			上市	
	京元電子	矽格	昇陽半導體	半導體類股	大盤
112 年 11 月	2.72	1.77	2.70	3.79	2.05
112 年 12 月	2.79	1.81	2.64	3.93	2.12
113 年 1 月	2.76	1.88	2.59	4.05	2.12
平均	2.76	1.82	2.64	3.92	2.10

資料來源：臺灣證券交易所

由上表得知，該公司採樣同業、上市半導體類股及上市大盤最近三個月之平均股價淨值比約為 1.82~3.92 倍，若以該公司 112 年第三季之權益淨值 1,197,597 千元，依擬上市掛牌股

本 68,702 千股，追溯調整之每股淨值 17.43 元予以估算，按上述股價淨值比法計算其參考價格，其價格區間約為 31.72~68.33 元，而比較本次本證券承銷商與該公司議定承銷價格 35 元，經評估尚屬合理。

(2)成本法-淨值法

①係依照一般公認會計原則將目標公司的資產價值扣除公司之負債，以獲得目標公司之價值，實務慣用衡量資產價值的方法為帳面價值法，依此法公司之價值即資產負債表之帳面淨值。其評價模式為：

目標公司參考價格 $= \frac{A_n - D_n}{S}$

A_n =目標公司總資產帳面價值(單位：千元)

D_n =目標公司總負債帳面價值(單位：千元)

S =目標公司流通在外普通股總數(單位：千股)

②以成本法計算之承銷參考價格如下：

$P = \frac{A_n - D_n}{S}$

= (2,088,884 -891,287) ÷ 64,660

= 18.52元

依該公司 112 年第三季經會計師核閱之財務報表淨值 1,197,597 千元及上市掛牌前流通在外股數 64,660 千股計算之。

此種評價方式係以歷史成本為計算依據，無法表達資產實際經濟價值亦未考慮公司的未來獲利能力，較不具參考性，且在評定資產總額及負債總額時，尚需考慮到資產及負債之真正市價，一般而言不容易取得市價資訊，故本證券承銷商與該公司未以此方法列入承銷價格議定之依據。

(3)收益法-現金流量折現法

此法主要假設目標企業之價值為未來各期創造之現金流量折現值，基於對於公司之未來現金流量較難精確掌握，且部分評價因子亦較難取得適切之數據故可能無法評估公司應有價值。茲將收益法之基本假設及評估參數分述如下：

①模型介紹

現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method)係認為企業

價值應為未來營運可能創造淨現金流量之現值總和，其中又以自由現金流量折現模式(Free Cash Flow Model)最能反映合理之報酬率，其計算公式如下：

$P_0 = V_E / N = (V_0 - V_D) / Shares$

$$V_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^t} + \sum_{t=n+1}^{m} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^n \times (1+K2)^t} + \frac{FCFF_{m+1}}{(1+K1)^n \times (1+K2)^{m-n}(K3-G)}$$

$$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - tax\ rate_t) + Dep\&Amo_t - Capital\ Exp_t - \triangle \mathrm{NWC}_t$$

$$K_i = \frac{D}{D+E} \times K_d \times (1 - tax\ rate) + \frac{E}{D+E} \times K_e$$

$$K_e = R_f + \beta_j \times (R_m - R_f)$$

P_0 ＝每股價值

V_0 ＝企業總體價值＝$V_E + V_D$＝股東權益價值＋負債價值 (不含計入營業活動現金流量之負債)

N ＝擬上市(最大)股數 68,702 千股

$FCFF_t$ ＝第 t 期之自由現金流量

K_i ＝加權平均資金成本 i＝1,2,3

G ＝營業收入淨額成長率

n ＝3 第一階段之經營年限：112 年度~114 年度

m ＝7 第二階段之經營年限：115 年度~121 年度

$EBIT_t$ ＝第 t 期之息前稅前淨利

$tax\ rate_t$ ＝第 t 期之稅率

$Dep\&Amo_t$ ＝第 t 期之折舊與攤銷費用

$Capital\ Exp_t$＝第 t 期之資本支出

＝第 t 期之購置固定資產支出+新增長期投資支出

$\triangle \mathrm{NWC}_t$ ＝第 t 期之淨營運資金變動需求-第 t-1 期之淨營運資金

＝(第 t 期之流動資產-不附息流動負債)-(第 t-1 期之流動資產-不附息流動負債)

D/D+E ＝附息負債占附息負債及權益比

E/D+E ＝權益占付息負債及權益比＝1- D/D+E

K_d ＝附息負債資金成本率

K_e ＝權益資金成本率

R_f ＝無風險利率

R_m ＝市場平均報酬率

β_j　　＝系統風險；衡量公司風險相對於市場風險之指標

②加權平均資金成本及自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
T	t≦n,n＝3	n+1≦t≦m,m＝10	t≧m+1	依據該公司狀況分為三期間： 期間I： 112~114年度 期間II： 115~121年度 期間III：122年度後(永續經營)
D/D+E	32.721%	39.918%	47.114%	期間I： 依該公司最近兩年度及最近期之付息負債占比(付息負債+權益)平均比率計算。 期間II： 採用期間I及期間III之平均數。 期間III：進入永續經營期後，估計對資本市場與運用應與同業相近，以採樣同業京元電子、矽格及昇陽半導體最近期之付息負債占比(付息負債+權益)平均比率計算之平均數。
E/D+E	67.279%	60.082%	52.886%	
K_d	2.600%	2.275%	1.951%	期間I： 係以該公司112年第三季財務報告之最高借款利率。 期間II： 採用期間I及期間III之平均數。 期間III：係採最近十年本國銀行之各季借款平均利率計算之。
tax rate	20.00%	20.00%	20.00%	依財政部新制營利事業所得稅率20%估算。
R_f	1.396%	1.396%	1.396%	112 年 10 月 5 日證券櫃檯買賣中心公告台灣十年期以上政府公債加權平均殖利率。
R_m	6.343%	6.343%	6.343%	係採用102~111年度股票集中市場之幾何平均投資報酬率。
β_j	1.110	1.055	1	期間I： 係採用 TEJ 資料庫計算之採樣同業(京元電子、矽格及昇陽半導體)最近五年股價對集中交易市場大盤指數之風險係數，並取其平均值。 期間II： 採用期間I及期間III之平均數。 期間III：預期永續經營期之系統風險將逐步貼近市場之系統風險，故假設為1。
K_e	6.889%	6.616%	6.343%	$K_e = R_f + \beta_j \times (R_m - R_f)$。其中， R_f ：無風險報酬率； β_j ：類股與大盤走勢之相關係數； R_m：市場風險報酬率
Ki	5.313%	4.701%	4.090%	加權平均資金成本
G	2.67%	3.300%	0.000%	期間I： 係根據工研院產科國際所報告預估

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
(保守情境)				112-114年全球功率元件市場之複合年增長率為2.67%估算。 期間 II：係以國際貨幣基金預測115年之全球經濟成長率3.3%估計。 期間 III：考量永續經營，尚無法合理預估成長率，故假設成長率為0。
G (樂觀情境)	3.03%	3.300%	3.200%	期間 I： 係根據工研院產科國際所報告預估112-114年全球半導體封測市場之複合年增長率為3.03%估算。 期間 II：係以國際貨幣基金預測115年之全球經濟成長率3.3%估計。 期間 III：係以國際貨幣基金預測116年之全球經濟成長率3.2%估計。

A.保守情境

$P_0 = (V_0 - V_D) / Shares$

＝{1,849,015 千元－524,442 千元} / 68,702 千股

＝19.28 元/股

B.樂觀情境

＝{5,719,098 千元－524,442 千元} / 68,702 千股

＝ 75.61 元/股

依據上述假設及公式，該公司依收益法(現金流量折現法)之參考價格區間為 19.28 元~75.61 元。由於此法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，然因未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數亦無一致標準。在股價評價方法選擇上，考量收益法下如現金流量折現法因需推估公司未來數年之盈餘及現金流量作為評價之基礎，然而預測期間長，推估營收資料之困難度提高，不確定性風險相對高，亦不能合理評估公司應有之價值，故不擬採用此法評估。

綜上所述，本證券承銷商依一般市場承銷價格訂定方式，主要係參考市場法之股價淨值比法計算股票公開承銷之參考價格範圍，選擇採樣同業及半導體類股之股價淨值比，以作為該公司辦理股票公開承銷之參考價格訂定依據，復參酌該公司最近一個月(113 年 1 月)興櫃市場之平均成交價、該公司最近二年度之經營績效、獲利情形以及所處產業未來前景、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本證券承銷商與該公司共同議定承銷價格，與國際慣用方法比較尚無重大異常之處。

(二)申請公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

1. 該公司與上市櫃同業財務狀況

分析項目		公司名稱	110年度	111年度	112年前三季
財務結構	負債占資產比率(%)	微矽電子	45.36	38.01	42.67
		京元電子	51.71	50.31	47.75
		矽格	51.30	48.41	48.60
		昇陽半導體	60.22	65.21	65.18
		同業平均	48.10	46.60	(註)
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	微矽電子	112.71	126.28	126.02
		京元電子	134.01	139.41	145.03
		矽格	156.44	174.51	182.98
		昇陽半導體	127.04	130.89	124.41
		同業平均	207.47	195.69	(註)

資料來源：公開資訊觀測站各公司年報及經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註：截至評估報告出具日止，未有揭露季度之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」，故未揭露。

(1) 負債占資產比率

該公司最近二個會計年度及 112 年第三季底之負債占資產比率分別為 45.36%、38.01%及 42.67%。111 年度之負債占資產比率較 110 年度下降至 38.01%，主係該公司為增建廠房及新增設備之資金需求，新增長期借款 60,000 千元，但因 111 年度辦理現金增資以償還短期借款 80,000 千元，致負債總額較前一年底減少 9.66%，另資產總額因增建廠房及新增設備而成長 8%，致負債占資產比率減少。112 年前三季因增建廠房及購置機器設備及因受營收下滑之影響致應收款項淨額亦較 111 年底減少，致負債占資產比率較 111 年底上升至 42.67%。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年第三季底之負債占資產比率均低於採樣公司及同業平均，經評估尚無重大異常之情事。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司最近二個會計年度及 112 年第三季底之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 112.71%、126.28%及 126.02%。該公司於 111 年度辦理現金增資，加上持續獲利使得權益較 110 年度增

加；考量近年來之營運發展需求及因應功率元件、第三代半導體測試服務及晶圓薄化需求成長，該公司決議增建竹南廠廠房，其資金來源，除以自有資金負擔投資額的 20%，餘 80%的投資額係向金融機構辦理融資，使得長期借款較 110 年度增加。另 111 年度擴建竹南廠廠房及添購生產設備使得不動產、廠房及設備淨額較 110 年度增加 7.70%，因其增加幅度小於權益及長期負債之增加幅度，致 111 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升至 126.28%。112 年前三季相較 111 年度未有重大變動。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年第三季底之長期資金占不動產、廠房及設備比率均低於採樣公司及同業平均，然皆超過 100%，經評估尚無重大異常情事。

整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之財務結構尚屬穩健。

2.該公司與上市櫃同業獲利情形

分析項目			公司名稱	110 年度	111 年度	112 年前三季
獲利能力	資產報酬率(%)		微矽電子	14.23	8.36	(2.58)
			京元電子	8.25	10.13	5.96
			矽格	9.56	9.93	4.81
			昇陽半導體	4.81	4.72	3.59
			同業平均	11.40	11.70	(註 1)
	權益報酬率(%)		微矽電子	26.47	13.72	(4.60)
			京元電子	16.30	19.44	11.70
			矽格	18.53	18.89	9.34
			昇陽半導體	10.54	11.81	10.33
			同業平均	21.20	21.50	(註 1)
	占實收資本額比率(%)	營業利益	微矽電子	50.86	31.62	(16.52)
			京元電子	54.03	74.95	59.15
			矽格	76.10	83.78	42.77
			昇陽半導體	16.57	20.18	16.58
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 2)
		稅前純益	微矽電子	52.87	35.13	(20.60)
			京元電子	56.06	73.33	58.38
			矽格	81.02	96.91	65.03
			昇陽半導體	18.69	24.42	29.83
			同業平均	(註 1)	(註 2)	(註 2)

分析項目		公司名稱	110 年度	111 年度	112 年前三季
	純益率	微矽電子	20.10	13.72	(8.88)
		京元電子	15.50	18.98	17.98
		矽格	18.2	18.8	15.81
		昇陽半導體	9.62	10.36	12.05
		同業平均	12.00	12.80	(註 1)
	每股盈餘(元)	微矽電子	4.31	2.70	(0.85)
		京元電子	4.23	5.59	3.49
		矽格	6.25	6.68	3.23
		昇陽半導體	1.58	2.17	2.03
		同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 1)

資料來源：公開資訊觀測站各公司年報及經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註 1：「中華民國台灣地區主要行業財務比率」未揭露該項比率。

註 2：截至評估報告出具日止，未有揭露季度之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」，故未揭露。

(1) 資產報酬率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之資產報酬率分別為 14.23%、8.36%、及(2.58)%，資產報酬率呈現逐年下降之趨勢，主係 111 年度及 112 年前三季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較,該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之資產報酬率與採樣公司互有高低，經評估尚無重大異常之情事。

(2)權益報酬率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之權益報酬率分別為 26.47%、13.72%、及(4.60)%。權益報酬率呈現逐年下降趨勢，主係因 111 年度及 112 年前三季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司 110 年度之權益報酬率高於採樣公司及同業平均，111 年度之權益報酬率介於採樣公司及同業平均之間，112 年前三季該公司受產品終端需求疲弱，客戶尚在去化庫存，致營業收入及權益報酬率皆低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

(3)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業利益占實收資

本額比率分別為 50.86%、31.62%及(16.52)%，稅前純益占實收資本額比率分別為 52.87%、35.13%及(20.60)%，營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率呈現下滑之趨勢，主係因 111 年度及 112 年前三季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得營業利益及稅前純益均較前一年度減少。

經與採樣公司相較，該公司最近二個會計年度之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均介於採樣公司之間，112 年前三季低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

(4)純益率及每股盈餘

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之純益率分別為 20.10%、13.72%及(8.88)%，每股盈餘分別為 4.31 元、2.70 元及(0.85)元。純益率及每股盈餘呈現下滑之趨勢，主係受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司 110 年度之純益率優於採樣公司及同業平均，111 年度介於採樣公司及同業平均之間，112 年前三季低於採樣公司；最近二個會計年度之每股盈餘均介於採樣公司之間，112 年前三季因營收下滑，致每股盈餘低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之獲利能力應無重大異常。

3.該公司與上市、櫃同業本益比之比較情形

請詳前述二、(一)、3、1、A 之評估說明。

(三)所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本證券承銷商與該公司共同議定之承銷價格，並未委請財務專家出具意見或鑑價機構提供鑑價報告，故不適用。

(四)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

微矽電子公司於 111 年 9 月 26 日開始為興櫃股票櫃檯買賣，其申請年度最近一個月之平均股價及成交量資料列示如下：

單位：元；股

月份	平均股價	成交量
113 年 1 月 24 日~113 年 2 月 23 日	49.71	2,660,129

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

該公司於 111 年 9 月 26 日於興櫃市場掛牌，最近一個月(113 年 1 月 24 日至 113 年 2 月 23 日)之月平均股價為 49.71 元，總成交量為 2,660,129 股。另最近一個月每日成交均價介於 48.54 元至 50.85 元，每日最高及最低成交均價差異 4.76%，尚無價格波動過大之情事。經查詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「興櫃一般板公布注意股票資訊」、「興櫃一般板處置股票資訊」及「興櫃交易時間內股價異常波動達暫停交易標準之股票查詢」，該公司非為「興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第 4 條規定公告為「興櫃公布注意股票」，且無「興櫃股票買賣辦法」第 11 條之 1 規定暫停交易(啟動興櫃股票市場冷卻機制)之情事，尚無發現有重大異常之情事。

(五)證券承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本證券承銷商係依一般市場承銷價格之訂定方式，參考上市半導體股、採樣同業之股價淨值比及該公司最近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格，作為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據。再參酌該公司所處產業、最近三年度之經營績效、獲利情形、所處產業未來前景、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本證券承銷商與該公司共同議定之。

綜上考量，本證券承銷商經參酌國際慣用之股價淨值比法評量，承銷價之參考價格區間為 31.72 至 68.33 元，另參酌該公司最近一個月興櫃股票市場之成交均價為 49.71 元。該公司初次上市前現金增資案之對外募資金額以競價拍賣之方式承銷，故依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 8 條規定，應以申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為最低承銷價格之上限，故以 112 年 12 月 25 日至 113 年 2 月 5 日興櫃有成交之 30 個營業日成交均價簡單算術平均數(49.82 元)之七成為上限，訂定最低承銷價格(競價拍底標)為 32.41 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；另依同辦法第 16 條規定，承銷價格以競價拍賣各得標單之價格及其數量加權平均所得價格新臺幣 40.75 元為之，惟該均價高於本證券承銷商與該公司議定最低承銷價格之 1.08 倍，故每股承銷價格定以新臺幣 35 元溢價發行，尚屬合理。

發行公司：微矽電子股份有限公司

負 責 人：張秉堂

公司地址：新竹縣竹東鎮沿河街 395 號

中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二十六 日

（僅供微矽電子股份有限公司承銷價格計算書使用）

主辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

負 責 人：陳佩君

公司地址：台北市忠孝東路2段95號3樓

中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二十六 日

（僅供微矽電子股份有限公司承銷價格計算書使用）

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負 責 人：黃進明

公司地址：臺北市民生東路4段54號5樓

中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二十六 日

（僅供微矽電子股份有限公司承銷價格計算書使用）

協辦證券承銷商：富邦綜合證券股份有限公司

負 責 人：程明乾

公司地址：臺北市大安區仁愛路4段169號3、4樓

中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二十六 日

（僅供微矽電子股份有限公司承銷價格計算書使用）

協辦證券承銷商：宏遠證券股份有限公司

負 責 人：姜克勤

公司地址：台北市信義路四段236號3至5樓及7樓

中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二十六 日

（僅供微矽電子股份有限公司承銷價格計算書使用）

附件十三

與本次發行有關之決議文

微　矽　電　子　股　份　有　限　公　司

第十三屆第五次董事會議事錄（節錄）

時　間：民國 111 年 6 月 24 日（星期五）上午 10 點 30 分整

地　點：微矽電子股份有限公司會議室(苗栗縣竹南鎮友義路 230 號)

舉行方式：實體及視訊

https://microsiliconelecscorp.my.webex.com/microsiliconelecscorp.my-tc/j.php?MTID=me18c0312ced028f39f52a5159abd427b

出席董事：

親自出席(4 席):張秉堂董事、王志成董事、林坤田董事、曾雄亮董事

視訊出席: 彭盈光董事　請假：張辰董事

列席人員：財會主管：呂月雲、稽核主管：黃詩萍

主　席：張董事長秉堂　　記　錄：呂月雲

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、上次會議紀錄及執行情形：前次會議無追蹤及未討論事項。

二、內部稽核業務報告：(略)

三、重要財務業務報告：(略)

四、其他重要事項報告：無

參、討論事項

（一）上次會議保留之討論事項：無。

（二）本次會議討論事項：

第 一 案～第 四 案：(略)

第 五 案

案　由：辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案，敬請討論。

說　明：配合本公司辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案，提請通過。

(1)為配合股票申請上市(櫃)相關法令規定，本公司擬於上市(櫃)案經主管機關核准通過後，辦理現金增資發行新股作為初次上市前提出公開承銷之股份來源，現金增資發行股數依件當時資本額與法令規定辦理。

(2)依據公司法第 267 條規定，應保留發行新股總額 10%~15% 由本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按

發行價格認購；除保留員工認購外，其餘85%~90%之新股，擬提請股東會同意依證交法第28-1條決議原股東全數放棄優先認股權利，全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷。

(3)本次增資發行計劃之主要內容(包含發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定或因法令變更，或因客觀環境之營運需要須予以修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(4)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。

(5)依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上市(櫃)前採行承銷方式，擬提請股東會授權董事長視市場狀況決定。

(6)本案業經董事會議通過後，提報民國111年第一次股東臨時會討論。

(7)本案俟民國111年第一次股東臨時會通過，並經主管機關核准後，另行召開董事會訂定認股繳款暨增資基準日及辦理發行新股等相關事宜。

決　議：經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第 六 案～第 十一 案：(略)

肆：臨時動議：無

散會時間：10:52

微 矽 電 子 股 份 有 限 公 司

一一一年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一一年八月二日（星期二）上午十時三十分

地點：苗栗縣竹南鎮友義路 230 號（本公司會議室）

出席股數：出席股東及委託代理人所代表之股數計 48,234.234 股，佔本公司已發行股份總數 61,000,000 之 79.07%，已逾法定開會股權。

列席：張秉堂董事長、李典易會計師

主席：張秉堂　　記錄：呂月雲

壹　宣佈開會：出席股東已逾法定數額，微矽電子股份有限公司本年度股東常會正式開始。

貳、主席致詞：略

參、承認暨討論事項

第一案：(董事會提)

案　由：本公司「公司章程」修正案，提請　核議。

說　明：(1)配合公司未來營運規劃及實務運作之需求，修正本公司「公司章程」，修正對照表請(參閱附件一)。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 48,034,234 權	99.58%
反對權數： 權	
無效權數：0 權	
棄權與未投票權數： 權	

本案依原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案　由：辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案，敬請討論。

說　明：配合本公司董事會通過申請股票上市(櫃)案，辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案，提請通過。

(1)為配合股票申請上市(櫃)相關法令規定，本公司擬於上市(櫃)案經主管機關核准通過後，辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源，現金增資發行股數依送件當時資本額與法令規定辦理。

(2)依據公司法第 267 條規定，應保留發行新股總額 10%~15% 由本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購;除保留員工認購外，其餘 85%~90%之新股，擬提請股東會同意依證交法第 28-1 條決議原股東全數放棄優先認股權利，全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷。

(3)本次增資發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定或因法令變更，或因客觀環境之營運需要須予以修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(4)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。

(5)依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上市(櫃)前採行承銷方式，擬提請股東會授權董事長視市場狀況決定。

(6) 本案俟民國 111 年第一次股東臨時會通過，並經主管機關核准後，另行召開董事會訂定認股繳款暨增資基準日及辦理發行新股等相關事宜。。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 48,034,234 權	99.58%
反對權數： 權	
無效權數：0 權	
棄權與未投票權數： 權	

本案依原案表決通過。

第三案：(董事會提)

案　由：修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產管理辦法」、「股東會議事規則」案，敬請　討論。

說　明：配合公司實務運作情形，修訂本公司「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產管理辦法」、「股東會議事規則」。(參閱附件二)。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 48,034,234 權	99.58%
反對權數： 權	
無效權數：0 權	
棄權與未投票權數： 權	

本案依原案表決通過。

肆、選舉事項

第一案：(董事會提)

案　由：全面改選董事案(含獨立董事)。

說　明：(1)本屆（第十三屆）董事及監察人任期至 113 年 6 月 24 日屆滿，擬提前於 111 年

第一次股東臨時會進行全面改選董事八席（含獨立董事三席）。

(2) 依本公司修訂後之公司章程規定，選任第十四屆董事八席案(含獨立董事三席)，任期三年，並採候選人提名制度選舉，由股東就董事會審核通過之董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，三席獨立董事成立審計委員會，依證券交易法第十四條之四規定取代監察人之職權。

(3)獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

(4)為配合股東臨時會改選日期，原任董事自改選之日起提前解任，新任董事自改選之日起就任，任期自 111 年 8 月 2 日起至 114 年 8 月 1 日止。

本公司第十四屆董事（含獨立董事）名單相關資料如下：

序號	姓名	主要學經歷	備註
1	張居興	臺灣大學財務金融研究所 中國信託商業銀行 副總經理 中信票券金融公司 副總經理	獨立董事候選人
2	溫萬壽	交通大學 電子物理系 豐達科技(股)公司 獨立董事 華邦電子(股)公司 執行副總經理 瀚宇彩晶(股)公司 執行長	獨立董事候選人
3	彭俊豪	成功大學 企業研究所 元大創業投資(股)公司總經理 元大創業投資(股)公司 副總經理	獨立董事候選人
4	大日月投資有限公司 代表人：張秉堂	臺灣大學國際企業管理研究所 工研院 電子所封測課長 巨大電子(股)公司 董事長 新能科技(股)公司 董事長	董事候選人
5	辰真投資有限公司 代表人：張 辰	美國波士頓大學 國際貿易研究所 清華大學 原子科學系	董事候選人
6	曾雄亮	健行科技大學 電子通訊科 工研院 電子所高級技術員	董事候選人
7	彭盈光	中原大學 工業與工程學系 工研院 電子所品管課長 台灣積體電路(股)公司 品質管理副處長 微矽電子(股)公司 副總經理	董事候選人
8	張蔚誠	政治大學 會計系 大師聯合會計師事務所 所長	董事候選人

選舉結果：

當選別	姓名	當選權數
董事	大日月投資有限公司 代表人：張秉堂	56,609,234
董事	辰真投資有限公司 代表人：張 辰	52,809,234
董事	曾雄亮	47,659,234
董事	彭盈光	45,919,234
董事	張蔚誠	45,704,182
獨立董事	張居興	45,190,918
獨立董事	溫萬壽	45,190,918
獨立董事	彭俊豪	45,190,918

伍、其他議案

第一案：(董事會提)

案　由：解除本公司新選任董事及其代表人之競業限制案，敬請　討論。

說　明：公司法 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。本公司本屆改選後之董事包括法人及其代表人，若因業務需要同時擔任與該公司營業範圍所列同類業務公司之董事時，除董事兼任專業經理人者外，擬於不違反公司利益之範圍內，提請股東會許可並解除其餘董事競業限制。

解除本公司新任董事競業限制案－董事

董事	兼任其他公司之職務
大日月投資有限公司代表人：張秉堂	大日月投資有限公司 負責人 辰謙投資有限公司 負責人
辰真投資有限公司代表人：張 辰	辰真投資有限公司 負責人
彭盈光	謙誠商務股份有限公司 負責人 新竹高爾夫俱樂部股份有限公司 董事
張蔚誠	大師聯合會計師事務所 執業會計師 聯華食品工業股份有限公司 獨立董事

解除本公司新任董事競業限制案－獨立董事

獨立董事	兼任其他公司之職務
溫萬壽	豐達科技股份有限公司 獨立董事
彭俊豪	元大創業投資股份公司總經理 信實資本顧問有限公司 負責人 元大壹創業投資股份有限公司 法人董事代表人

	生華創業投資股份有限公司 法人董事代表人 生源創業投資股份有限公司 法人董事代表人 華陸創業投資股份有限公司 法人董事代表人

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 48,034,234 權	99.58%
反對權數： 權	
無效權數：0 權	
棄權與未投票權數： 權	

本案依原案表決通過。

陸、臨時動議：無

散會時間：10:59AM

微　矽　電　子　股　份　有　限　公　司

第十四屆第六次董事會議事錄(節錄)

時　　間：中華民國112年8月 11日（星期五）上午11 點30分整

地　　點：微矽電子股份有限公司301會議室(苗栗縣竹南鎮友義路230號)

董　　事：大日月投資有限公司代表人 張董事長秉堂、彭董事盈光、辰真投資有限公司 代表人 張董事辰、張董事蔚誠、楊董事式蘭

獨立董事：張獨立董事居興、温獨立董事萬壽、彭獨立董事俊豪 、譚獨立董事仲民

列席人員：資誠會計師:李典易會計師、吳柏賢

財會經理：呂月雲、稽核：黃詩萍

兆豐輔導券商：許哲豪。

主　席：張秉堂董事長　　記　錄：趙婷婷

壹、主席致詞：

貳、報告事項

一、上次會議紀錄及執行情形：前次會議無追蹤及未討論事項。

二、內部稽核業務報告：(略)

重要財務業務報告：(略)

三、其他重要事項報告：(略)

參、討論事項

(一) 上次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議討論事項：

第 一 案～第 二 案：(略)

第 三 案

案　由：本公司申請股票創新板上市案，敬請　討論。(審計委員會提)

說　明：1.為長期營運發展及吸引專業優秀人才，擬授權董事長於長期考量內外環境，於未來擇適當時機向台灣證券交易所股份有限公司提出股票創新板上市申請。

2.有關實際上市相關作業及時程事宜，擬授權董事長配合相關法令規定全權處裡。

3.本案經112年8月11日審計委員會審查通過，提請董事會決議。

決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議，本案照案通過。

第 四 案～第 七 案：(略)

肆：臨時動議：無

散會時間：11:50

微 矽 電 子 股 份 有 限 公 司

第十四屆第九次董事會議事錄（節錄）

時　間：中華民國 112 年 12 月 27 日（星期三）上午 11 點 14 分整

地　點：微矽電子股份有限公司 301 會議室(苗栗縣竹南鎮友義路 230 號)

出席董事：大日月投資有限公司代表人 張董事長秉堂、辰真投資有限公司代表人 張董事辰、彭董事盈光、張董事蔚誠、楊董事式蘭、張獨立董事居興、溫獨立董事萬壽、彭獨立董事俊豪、譚獨立董事仲民

列席人員：資誠事務所吳柏賢協理、兆豐輔導券商：謝淑惠協理、許哲豪襄理

副總經理：王志成、財會經理：呂月雲、稽核副理：黃詩萍、公司治理主管：官淑惠

主　席：張秉堂董事長　　記　錄：呂月雲

壹、主席致詞：

貳、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：前次會議無追蹤及未討論事項。

二、內部稽核業務報告。(略)

三、重要財務業務報告：(略)

四、其他重要事項報告：(略)

參、討論事項

（一）上次會議保留之討論事項：無上次會議保留之討論事項。

（二）本次會議預定討論事項：

案由一～案由五：(略)

案由六：本公司擬辦理現金增資發行新股供初次申請創新板上市前公開承銷案，敬請　討論。

說　明：一、依據本公司 111 年 8 月 2 日股東臨時會決議通過，為配合公司股票初次上市前辦理公開承銷之需要，業經臺灣證券交易所 112 年 12 月 26 日董事會通過，待本公司取得創新板上市核准函後，將辦理現金增資發行新股，並授權董事會全權處理本次現金增資相關事宜。

二、本次現金增資擬發行新股 4,042,000 股，每股面額為新台幣 10 元整，均為普通股，暫訂發行價格為每股新台幣 35 元，預計可募集金額為 141,470,000 元，惟實際上市之承銷價格，將視辦理公開承銷前股票市場狀況及向投資人競價拍賣結果，授權董事長依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

三、本次現金增資依公司法第 267 條規定，保留發行新股 15%計 606,000 股由員工認購，員工若認購不足或放棄之股份，授權董事長洽特定人認購之。其餘 85%現金增資發行新股 3,436,000 股，依證券交易法第 28 條之 1 規定及 111 年 8 月 2 日股東臨時會決議，現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購之權利，不受公司法第 267 條原股東按原有股份比例優先分認規定之限制，全數委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。另對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

四、本次現金增資之資金用途為充實營運資金，現金增資資金運用計畫、預計進度及效益評估說明，請詳附件六。

五、本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。

六、本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。

七、本案俟董事會決議通過，向主管機關申報生效後發行之，並授權董事長辦理訂定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

八、本案業經審計委員會 112 年 12 月 27 日審計通過，提請董事會決議。

決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議，本案照案通過。

案由七～案由十二：(略)

肆：臨時動議：無

散會時間：12/27　12:10

附件十四

盈餘分配表

微矽電子股份有限公司
盈餘分配表
民國111年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	$ 306,789,416
減：確定福利計劃之再衡量數	3,480,755
加：本年度稅後淨利	168,338,051
減：提列10%法定盈餘公積	(17,181,881)
本年度可供分配金額	461,426,341
分配項目：	
股東紅(1.5/每股)	(96,990,000)
期末未分配盈餘	$ 364,436,341

董事長：　　經理人：　　會計主管：

附件十五

公司章程(含章程修正條文對照表)

微矽電子股份有限公司章程

第一章　總　則

第 一 條：本公司依照公司法關於股份有限公司規定組織之，定名為微矽電子股份有限公司。英文名稱MICRO SILICON ELECTRONICS CO.,LTD.。

第 二 條：本公司所營事業：

CC01080 電子零組件製造業

F401010 國際貿易業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於新竹縣，且應業務活動需要，得經董事會決議及主管機關同意後，於中華民國領域內及領域外設立辦事處與分公司。

第 四 條：本公司之公告方法，依照公司法第二十八條及其他相關法令規定辦理之。

第 五 條:本公司對同業及關係企業得為保證,須依本公司規定並經董事會同意後行之，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

第 六 條：本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，所有投資總額得不受公司法第十三條之限制，惟應經董事會同意後行之。

第二章　股　份

第 七 條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億元整，分為壹億股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會依法令分次發行。前項資本總額中保留新台幣貳仟伍佰萬元，分為貳佰伍拾萬股，每股新台幣壹拾元，作為認股權憑證轉換之用。

第 八 條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經主管機關核定之發行簽證機構簽證後發行之。本公司得免印製股票，依上述規定發行之股份，惟該股份應洽證券集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。

第八條之一：本公司依法買回股份之轉讓對象、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股之發給對象及發行新股得承購股份之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式得授權董事會決議之。

第 九 條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第 十 條：本公司股東辦理股票轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，本公司股務處理作業，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。

第 三 章　股東會

第十一條：本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會，每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會依法令規定召集之。

二、股東臨時會，於必要時依法令規定召集之。

前兩項會議召集之通知，得以電子方式替代書面通知為之。

股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，議事錄分發得以公告方式為之。

第十二條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席，並行使其權力。代理人不以本公司股東為限。股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十四條：本公司股東，除有第一百七十九條情事外，每股有一表決權。

第十五條：股東會之決議，除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理出席，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股票上市(櫃)及興櫃期間，召開股東會時，應將電子方式列為股東行使表決權管道之一，以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第四章　董事及審計委員會

第十六條：本公司設董事五至九人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選均得連任。

第十六條之一：前條董事名額中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。董事(含獨立董事)其選任方式採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

董事會得依法設置功能性委員會。相關委員會之設置及職權依主管機關所訂辦法行之。

第十六條之二：本公司依證券交易法相關規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並由其中一名擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。

第十六條之三：本公司設置審計委員會後，同時廢除監察人，並負責執行公司法、證券交易法、其他法令暨本公司章程及各項辦法規定之監察人職權。

第十六條之四：本公司第一屆審計委員會依第十六條之一選任之獨立董事首次當選之日成立。自審計委員會成立之日起，本公司有關監察人之規定停止適用。已當選之監察人，其任期至本公司第一屆審計委員成立之日為止。

第十七條：本公司法人股東選任為董事時，應指派代表人行使職權，並有權隨時改派代表人，改派後之代表人以補足原任期為限。

董事缺額時，依法令規定補選，其任期以補足原任期為限。董事選任後得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，並依公司法第一百九十三條之一規定報告董事會。

第十八條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

董事長有權依董事會之決議以本公司名義代表簽署文件，並依股東會或董事會之決議代表董事會作為。

第十九條：董事會除公司法另有規定外由董事長召集之，每季至少召開一次，董事得委託其他董事代理出席董事會議，但每次應出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，每一代理受一人委託為限。董事會如以視訊會議進行時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第 廿 條：董事會之決議除公司法另有規定外，須有過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之。

第廿一條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，得以電子方式為之，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永久保存。

第廿二條：本公司董事執行業務時，不論公司營業盈虧，公司得支付報酬，其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度並參酌同業通水準議定之。公司有盈餘時，另依第廿五條之規定分配酬勞。

第五章　經理人

第廿三條：本公司經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

本公司其他職員由總經理依法任免之。

本公司設立薪資報酬委員會後，其報酬依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」相關規定辦理。

第六章　會　計

第廿四條：本公司應於每會計年度終了，由董事會編造：營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案各項表冊，於股東常會開會三十日前依法提請股東常會承認。

第廿五條：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥比例不高於3%為董事酬勞及5%至12%為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會以董事

三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

本公司無累積虧損時授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積(超過實收資本額百分之二十五之部分)及符合公司法規定之資本公積之全部或一部以發放現金方式為之，並提報最近一次股東會。

第廿六條：公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，併同期初累積未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

將當年度可供分配盈餘不低於10%分派股東股息紅利，股東股息紅利之分派得以現金或股票方式為之，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之10%。分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金方式為之，並提報最近一次股東會。

第七章　附　則

第廿七條：本公司組織規程及辦事細則另定之。

第廿八條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及相關法令之規定辦理。

第廿九條：本章程訂立於中華民國七十六年七月二十五日。

第一次修正於中華民國七十八年一月十日。

第二次修正於中華民國七十九年三月十五日。

第三次修正於中華民國八十年元月十日。

第四次修正於中華民國八十年七月二十五日。

第五次修正於中華民國八十年八月三十日。

第六次修正於中華民國八十三年九月八日。

第七次修正於中華民國八十四年三月十九日。

第八次修正於中華民國八十四年十二月十八日。

第九次修正於民國八十五年十月三十日。

第十次修正於民國八十五年十二月七日。

第十一次修正於民國八十六年二月十七日。

第十二次修正於民國八十六年六月二十五日。

第十三次修正於民國八十七年二月十日。

第十四次修正於民國八十八年四月三十日。

第十五次修正於民國八十八年五月三十一日。

第十六次修正於民國九十一年六月二十六日

第十七次修正於民國九十四年六月二十八日

第十八次修正於民國九十七年六月二十六日

第十九次修正於民國九十八年六月二十六日

第二十次修正於民國一百年六月二十一日

第二十一次修正於民國一百五年六月二十二日

第二十二次修正於民國一百六年六月二十七日

第二十三次修正於民國一百八年六月二十六日

第二十四次修正於民國一一0年六月二十五日

第二十五次修正於民國一一一年四月二十二日

第二十六次修正於民國一一一年八月二日

微矽電子股份有限公司

董事長：張秉堂

微矽電子股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

條　　次	修　　訂　　前　　條　　文	修　　訂　　後　　條　　文	修訂理由
第五條	本公司對同業及關係企業得為保證，須依本公司規定並經董事會同意後行之，~~本公司公開發行後，~~其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。	本公司對同業及關係企業得為保證，須依本公司規定並經董事會同意後行之，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。	配合本公司股票公開發行酌修文字
	原章程第七條之一： (刪除)	(刪除)	本條刪除
第八條	本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經主管機關核定之發行簽證機構簽證後發行之。本公司~~公開發行後，~~得免印製股票，依上述規定發行之股份，惟該股份應洽證券集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。	本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經主管機關核定之發行簽證機構簽證後發行之。本公司得免印製股票，依上述規定發行之股份，惟該股份應洽證券集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。	配合本公司股票公開發行酌修文字
第九條	~~股東名簿記載之變更，本公司於公開發行前，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。本公司公開發行後，~~股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。	股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，**或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內**，不得為之。	配合本公司股票公開發行酌修文字
第十條	本公司股東辦理股票轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，~~於本公司股票公開發行後，~~本公司股務處理作業，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。	本公司股東辦理股票轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，本公司股務處理作業，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。	配合本公司股票公開發行酌修文字
第十一條	本公司股東會分下列兩種： 一、股東常會，每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會依法令規定召集之。 二、股東臨時會，於必要時依法令規定召集之。 前兩項會議召集之通知，得以電子	本公司股東會分下列兩種： 一、股東常會，每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會依法令規定召集之。 二、股東臨時會，於必要時依法令規定召集之。 前兩項會議召集之通知，得以電子	配合本公司股票公開發行酌修文字

條　　次	修　　訂　　前　　條　　文	修　　訂　　後　　條　　文	修訂理由
	方式替代書面通知為之。 股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。 股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。本公司~~公開發行後，~~對於持有記名股票未滿一千股之股東，議事錄分發得以公告方式為之。	方式替代書面通知為之。 股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。 股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，議事錄分發得以公告方式為之。	
第十三條	股東因故不能出席股東會時，得出具~~公司印發之~~委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席，並行使其權力。代理人不以本公司股東為限。股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外，~~本公司公開發行後，~~悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。	股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席，並行使其權力。代理人不以本公司股東為限。股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。	配合本公司股票公開發行酌修文字
第十五條	股東會之決議，除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理出席，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。 本公司召開股東會時，~~得採~~書面或電子方式行使~~股東~~表決權，~~本公司公開發行後，以電子方式行使表決權之股東~~視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。	股東會之決議，除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理出席，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。 本公司**股票上市(櫃)及興櫃期間，**召開股東會時，**應將電子方式列為股東行使表決權管道之一，以**書面或電子方式行使表決權**之股東**，視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。	配合本公司股票公開發行酌修文字
第四章	董事及~~監察人~~	董事及**審計委員會**	配合審計委員會之設置修訂
第十六條	本公司設董事五至九人，~~監察人一至三人，~~均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選均得連任。	本公司設董事五至九人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選均得連任。	配合審計委員會之設置修訂
第十六條之一	~~本公司股票公開發行後，~~前項董事名額中~~得設置獨立董事，~~獨立董事~~名額~~不得少於~~二~~人，且不得少於董事席次五分之一。~~本公司股票公開發行後，~~董事(含獨立董事)其選任方式採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。有關	前條董事名額中獨立董事**人數**不得少於**三**人，且不得少於董事席次五分之一。董事(含獨立董事)其選任方式採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他	配合本公司股票公開發行酌修文字

條　　次	修　　訂　　前　　條　　文	修　　訂　　後　　條　　文	修訂理由
	獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。~~本公司公開發行後，~~董事會得依法設置功能性委員會。相關委員會之設置及職權依主管機關所訂辦法行之。	應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 董事會得依法設置功能性委員會。相關委員會之設置及職權依主管機關所訂辦法行之。	
第十六條之二	本公司~~於股票公開發行後，~~依證券交易法相關規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並由其中一名擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。	本公司依證券交易法相關規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並由其中一名擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。	配合本公司股票公開發行酌修文字
第十六條之四	本公司第一屆審計委員會依第十~~八~~條之一選任之獨立董事首次當選之日成立。自審計委員會成立之日起，本公司有關監察人之規定停止適用。已當選之監察人，其任期至本公司第一屆審計委員成立之日為止。	本公司第一屆審計委員會依第十六條之一選任之獨立董事首次當選之日成立。自審計委員會成立之日起，本公司有關監察人之規定停止適用。已當選之監察人，其任期至本公司第一屆審計委員成立之日為止。	配合公司實際狀況酌修文字
第十七條	本公司法人股東選任為董事~~或監察人~~時，應指派代表人行使職權，並有權隨時改派代表人，改派後之代表人以補足原任期為限。 董事~~及監察人~~缺額時，依法令規定補選，其任期以補足原任期為限。董事選任後得經董事會決議於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	本公司法人股東選任為董事時，應指派代表人行使職權，並有權隨時改派代表人，改派後之代表人以補足原任期為限。 董事缺額時，依法令規定補選，其任期以補足原任期為限。董事選任後得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，並依公司法第一百九十三條之一規定報告董事會。	配合審計委員會之設置修訂
第廿一條	~~監察人各得單獨行使監察權。除依法執行職務外，得出席董事會陳述意見，但不得參與表決。~~	董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，得以電子方式為之，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永久保存。	配合審計委員會之設置刪除監察人條文及配合公司實際狀況新增條文
第廿二條	本公司董事~~、監察人~~執行業務時，不論公司營業盈虧，公司得支付報酬，其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度並參酌同業通水準議定之。公司有盈餘時，另依第廿五條之規定分配酬勞。	本公司董事執行業務時，不論公司營業盈虧，公司得支付報酬，其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度並參酌同業通水準議定之。公司有盈餘時，另依第廿五條之規定分配酬勞。	配合審計委員會之設置修訂
第廿三條	本公司經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。	本公司經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。	酌修文字

條　　次	修　　訂　　前　　條　　文	修　　訂　　後　　條　　文	修訂理由
	本公司其他職員由總經理依法任免之。待本公司設立薪資報酬委員會後，其報酬依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」相關規定辦理。	本公司其他職員由總經理依法任免之。本公司設立薪資報酬委員會後，其報酬依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」相關規定辦理。	
第廿四條	本公司應於每~~一~~會計年度終了，由董事會編造：營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案各項表冊~~，~~於股東常會開會三十日前~~交監察人查核，並於股東常會開會十日前備置公司得由股東隨時查閱，再~~依法提請股東常會承認。	本公司應於每會計年度終了，由董事會編造：營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案各項表冊，於股東常會開會三十日前依法提請股東常會承認。	配合審計委員會之設置修訂及酌修文字
第廿五條	本公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利，應提撥比例不高於3%為董事監~~察人~~酬勞及5%至12%為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 本公司~~公開發行後，~~無虧損時授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積(超過實收資本額百分之二十五之部分)及符合公司法規定之資本公積之全部或一部以發放現金方式為之，並提報最近一次股東會。	本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥比例不高於3%為董事酬勞及 5%至 12%為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 本公司無累積虧損時授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積(超過實收資本額百分之二十五之部分)及符合公司法規定之資本公積之全部或一部以發放現金方式為之，並提報最近一次股東會。	配合本公司股票公開發行酌修文字
第廿六條	公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，併同期初累積未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 將當年度可供分配盈餘不低於 10%分派股東股息紅利，股東股息紅利之分派得以現金或股票方式為之，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之 10%。分派股利之政策，須視公司目前及未來之	公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，併同期初累積未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 將當年度可供分配盈餘不低於 10%分派股東股息紅利，股東股息紅利之分派得以現金或股票方式為之，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之 10%。分派股利之政策，須視公司目前及未來之	配合本公司股票公開發行酌修文字

條　　次	修　　訂　　前　　條　　文	修　　訂　　後　　條　　文	修訂理由
	投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。本公司~~公開發行後，~~授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金方式為之，並提報最近一次股東會。	投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金方式為之，並提報最近一次股東會。	
第廿九條	本章程訂立於中華民國七十六年七月二十五日。 第一次修正於中華民國七十八年一月十日。 第二次修正於中華民國七十九年三月十五日。 第三次修正於中華民國八十年元月十日。 第四次修正於中華民國八十年七月二十五日。 第五次修正於中華民國八十年八月三十日。 第六次修正於中華民國八十三年九月八日。 第七次修正於中華民國八十四年三月十九日。 第八次修正於中華民國八十四年十二月十八日。 第九次修正於民國八十五年十月三十日。 第十次修正於民國八十五年十二月七日。 第十一次修正於民國八十六年二月十七日。 第十二次修正於民國八十六年六月二十五日。 第十三次修正於民國八十七年二月十日。 第十四次修正於民國八十八年四月三十日。 第十五次修正於民國八十八年五月三十一日。 第十六次修正於民國九十一年六月二十六日 第十七次修正於民國九十四年六月二	本章程訂立於中華民國七十六年七月二十五日。 第一次修正於中華民國七十八年一月十日。 第二次修正於中華民國七十九年三月十五日。 第三次修正於中華民國八十年元月十日。 第四次修正於中華民國八十年七月二十五日。 第五次修正於中華民國八十年八月三十日。 第六次修正於中華民國八十三年九月八日。 第七次修正於中華民國八十四年三月十九日。 第八次修正於中華民國八十四年十二月十八日。 第九次修正於民國八十五年十月三十日。 第十次修正於民國八十五年十二月七日。 第十一次修正於民國八十六年二月十七日。 第十二次修正於民國八十六年六月二十五日。 第十三次修正於民國八十七年二月十日。 第十四次修正於民國八十八年四月三十日。 第十五次修正於民國八十八年五月三十一日。 第十六次修正於民國九十一年六月二十六日 第十七次修正於民國九十四年六月二	增列修訂日期

條　　次	修　　訂　　前　　條　　文	修　　訂　　後　　條　　文	修訂理由
	十八日 第十八次修正於民國九十七年六月二十六日 第十九次修正於民國九十八年六月二十六日 第二十次修正於民國一百年六月二十一日 第二十一次修正於民國一百五年六月二十二日 第二十二次修正於民國一百六年六月二十七日 第二十三次修正於民國一百八年六月二十六日 第二十四次修正於民國一一〇年六月二十五日 第二十五次修正於民國一一一年四月二十二日	十八日 第十八次修正於民國九十七年六月二十六日 第十九次修正於民國九十八年六月二十六日 第二十次修正於民國一百年六月二十一日 第二十一次修正於民國一百五年六月二十二日 第二十二次修正於民國一百六年六月二十七日 第二十三次修正於民國一百八年六月二十六日 第二十四次修正於民國一一〇年六月二十五日 第二十五次修正於民國一一一年四月二十二日 **第二十六次修正於民國一一一年八月二日**	

附件十六

股票初次申請創新板上市證券承銷商評估報告

微矽電子股份有限公司

股票初次申請創新板上市

證券承銷商評估報告

（稿本）

主辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

協辦證券承銷商：富邦綜合證券股份有限公司

協辦證券承銷商：宏遠證券股份有限公司

中 華 民 國 一 一 二 年 十 月 二十六日

發行人之產業、營運及其他重要風險

一、產業風險：市場變化快速，終端應用產品功能提升競爭激烈

近年來終端產品走向節能的趨勢，電子產業持續針對節能進行優化，對精密度及功能性之要求大幅提升，半導體製程因應此趨勢需不斷演進。

因應對策：

隨著半導體製程的不斷精進，IDM 廠商對於昂貴的廠房及設備支出逐漸無力負荷，因而將製造業務委外給專業的專業晶圓代工及封測業者，該公司具有豐富的測試及封裝經驗，並自行開發出晶圓進行正面金屬鍍膜及晶圓背面研磨與金屬鍍膜等服務，為提供客戶一站式之服務，與客戶維持長久之合作關係，客戶亦不易輕易變更合作廠商，以確保產品品質及如期交貨。

二、營運風險

(一)半導體市場景氣波動，影響公司營運

測試封裝廠屬於半導體產業供應鏈後段製程，因此仍受半導體景氣循環影響。

因應對策：

因應半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司持續開發新產品，與客戶建立長期的合作關係，提供客戶高附加價值之代工服務。隨高效能運算、5G、物聯網和車用電子等市場持續擴大，該公司之客戶已於各類產品進行佈局，以降低已成熟產品之市場需求力道減弱所帶來之營運風險，未來該公司持續與客戶配合，搭配該公司各項代工製程及機台改良技術，強化品質、成本及交期的優勢，以因應市場快速變化及同業之競爭。

(二)研發人員流失之風險

隨著半導體產業不斷的發展，具經驗之技術開發及研發人才的爭取日漸困難，且需要長時間培養及訓練，故具經驗之研發人才常成為他公司招攬之對象。

因應措施：

該公司透過技術人員之技術傳承、實作經驗分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術開發及研發人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的研發團隊。此外，提供良好的工作環境，並建立制度化的員工福利獎酬辦法，以增進員工之向心力。對於研發人員均要求簽訂保密合約，且對於所研發之技術做適當之資料保存，以預防研發人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。另該公司積極推動上市，藉以提高公司知名度，吸引優秀人才，並可透過發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及員工酬勞等工具，將公司經營成果與員工共享，以提高員工之向心力。

(三)中國半導體產業之競爭風險

近年來中國半導體業力求提高自給率，並在政策上大力支持下，將成為中國半導體封測公司步入快速發展的有效驅動力，對我國半導體產業形成競爭壓力。

因應措施：

該公司以強化新產品的工程能力及提供精進之測試封裝服務能力，以品質、

交期、效率與彈性的服務內容，與中國大陸廠商形成區隔，獲取更多台灣及國外客戶長期合作的機會。

三、其他重要風險

請詳承銷商評估報告「貳、二、發行公司營運風險」說明。

綜上所述，就該公司產業、營運及其他重要風險三方面，分別評估其各項風險之因應措施，該公司已具備降低風險之能力，亦已擬定因應措施，其措施尚屬穩當。

微矽電子股份有限公司
評估報告目錄

壹、評估報告總評.....7
一、承銷總股數說明.....7
二、承銷價格.....7
三、承銷風險因素.....19
四、總結.....20
貳、產業狀況及營運風險.....21
一、發行公司所屬行業營運風險.....21
二、發行公司營運風險.....30
參、業務狀況.....53
一、營業概況.....53
二、存貨概況.....68
三、最近期及最近二個會計年度之業績概況.....72
四、併購他公司尚未屆滿一完整會計年度者，評估併購之目的、效益、交易合理性等因素.....80
肆、財務狀況.....80
一、列表並說明最近期及最近二個會計年度財務比率之分析，與同類別上市公司及未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力及獲利能力.....80
二、發行公司及其各子公司（包括母子公司間交易事項）之最近期及最近二個會計年度背書保證、重大承諾及資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估其對發行公司財務狀況之影響.....92
三、列明申請年度截至最近期止擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性.....93
四、發行公司及其各子公司（包括母子公司間交易事項）之轉投資事業.....96
五、承銷商依臺灣證券交易所(股)公司「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條規定實地輔導發行公司之重要子公司者，應列示是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見.....99
六、評估發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於發行公司股票上市後對財務報表可能之影響.....99
七、公營事業申請股票上市時，其檢送之財務報告有未經會計師簽證者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見.....100
八、金融事業申請股票上市，應列明其備抵提列情形，並評估其是否足額.....100
九、承銷商應評估外國申請公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響.....100
伍、承銷商得視發行公司所營事業性質，委請在技術、業務，財務等各方面具備專業知識

及豐富經驗之專家，就發行公司目前營運狀況及未來發展，進行比較分析，並本獨立公正立場出具審查意見，俾利評估.....100
陸、法令之遵循及對本國發行公司營運影響由承銷商洽律師對本國發行公司、現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人最近三年內就下列事項出具意見後，依據其意見承銷商評估對本國發行公司營運影響及因應之道，並說明影響此次承銷之因素.....100
一、發行公司是否違反相關法令規章.....100
二、董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員是否違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務之行使.....102
三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權.....102
四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件.....102
五、重大勞資糾紛或污染環境事件.....102
柒、列明本國發行公司有無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第九條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見；或外國發行公司或其從屬公司有無同準則第二十八條之八各款所列不宜上市情事之評估意見；或申請創新板上市之發行公司有無同準則第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見。評估有無同準則第九條第一項第十一款第二目、第二十八條之八第七款第二目或第三十一條第一項第十款第二目規定情事。列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見.....103
一、列明依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見.....103
二、列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見.....103
捌、評估是否符合特定行業或組織型態公司之上市規定.....104
一、評估是否符合集團企業申請股票上市之規定.....104
二、評估是否符合「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則」第十六條規定之公司申請股票上市.....107
三、評估是否符合控股公司、金融控股公司、或其他特定組織型態公司申請上市之有關規定.....107
玖、評估發行公司是否依本公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形。評估發行公司公司治理評鑑自評報告是否允當表達其公司治理運作情形.....107
拾、對上列各項目有關證券承銷商評估報告完成日起，截至股票上市契約生效日之前一日止之期後事項，應隨時加以更新說明與評估；於股票上市用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，亦應加以更新說明與評估.....108
拾壹、以投資控股公司或金融控股公司申請股票上市者，承銷商應就被控股公司或其子公司之所營事業性質，依第四、五、六、八、九、十一及十二條等規定進行評估，出具各被控股公司或子公司之審查意見，再憑以出具綜合彙總意見.....108
拾貳、本國上市（櫃）公司之海外子公司申請其股票第一上市者，承銷商應就下列事項詳加評估說明.....108

一、評估本國上市（櫃）公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施。 108
二、本國上市（櫃）公司為降低對該海外子公司之持股比例所進行之股權分散行為，其分散對象、價格之決定方式，是否有違反相關規定或明顯不合理而損及本國上市（櫃）公司之股東權益。 108
拾參、其他補充揭露事項 108
附件一、「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之承銷商審查意見 109

壹、評估報告總評

一、承銷總股數說明

(一)微矽電子股份有限公司(以下簡稱「微矽電子」或「該公司」) 股票申請初次創新板上市時之實收資本額為新台幣 646,600 千元，每股面額新台幣 10 元整，已發行股份總數為 64,660 千股。該公司擬於股票初次申請創新板上市案經主管機關審查通過後，辦理現金增資發行新股 4,042 千股(暫定)，扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，全數委託證券承銷商辦理創新板上市前公開銷售，預計股票創新板上市掛牌時已發行股數為 68,702 千股及實收資本額為 687,020 千元。

(二)依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十六條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第十七之一條規定，公開發行公司初次申請股票在創新板上市時，應至少提出擬上市股份總額百分之五之股份，且不得低於八十萬股，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購及應提出主辦證券承銷商認購之股數後，依證券交易法七十一條第一項包銷有價規定，委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。

(三)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，本證券承銷商已與該公司簽訂過額配售協議,由該公司協調其股東提出對外公開承銷股數之百分之十五之額度內,提供已發行普通股股數供本證券承銷商辦理過額配售；惟本證券承銷商得依市場需求決定過額配售數量。

(四)該公司截至 112 年 8 月 15 日止記名股東人數為 925 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數共計 912 人，且其所持股份合計 34,081,086 股，占發行股份總額的 52.71%。已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第二十九條有關登錄創新板之股權分散標準。

(五)綜上所述，該公司依擬上市股份總額之百分之十計算應提出公開承銷之股數，全數以現金增資發行新股之方式，委託本證券承銷商辦理上市前公開銷售，該現金增資案依據「證券交易法」第二十八之一條規定，經 111 年 8 月 2 日股東臨時會通過，原股東全數放棄認購以辦理上市前公開承銷。該公司暫定辦理現金增資發行新股 4,042 千股，扣除依公司法規定保留百分之十五額度內予員工優先認購之 606 千股後，其餘 3,436 千股全數提撥對外公開承銷。另本證券承銷商已與該公司簽訂過額配售協議，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數之 15%為上限，提供已發行普通股股票供本證券承銷商辦理過額配售，屆時本證券承銷商與該公司再依市場需求決定實際過額配售數量。

二、承銷價格

(一)微矽公司基本財務資料

1. 承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

(1)每股淨值

112 年第二季經會計師核閱之股東權益，按期末股數計算之每股淨值如下：

說　　明	金額/股數
歸屬母公司業主之權益	1,194,379 千元
期末股數	64,660 千股
每股淨值	18.47 元/股

資料來源：112 年第二季經會計師核閱之財務報告

(2)最近兩年度經會計師查核簽證之財務資料

①簡明資產負債表

單位：新台幣千元

項目＼年度	110 年度	111 年度	112 年第二季
流動資產	689,391	708,320	540,913
不動產、廠房及設備	1,282,471	1,381,256	1,459,511
無形資產	6,505	15,267	11,084
使用權資產	8,276	6,207	5,172
其他資產	33,264	66,473	36,401
資產總額	2,019,907	2,177,523	2,053,081
流動負債	574,334	433,232	471,800
非流動負債	341,986	394,571	386,902
負債總額	916,320	827,803	858,702
股本	610,000	646,600	646,600
資本公積	13,775	142,989	142,989
保留盈餘	479,812	560,131	404,790
股東權益合計	1,103,587	1,349,720	1,194,379

資料來源：該公司 110 及 111 年度經會計師查核簽證之財務報告與 112 年第二季經會計師核閱之財務報告

②損益表

單位：新台幣千元

項目＼年度	110 年度	111 年度	112 年前二季
營業收入淨額	1,292,379	1,226,677	384,383
營業成本	780,595	823,369	379,461
營業毛利	511,784	403,308	4,922
營業費用	201,519	198,826	81,904
營業利益(損失)	310,265	204,482	(76,982)
營業外收入及支出	12,252	22,727	7,178

項目＼年度		110 年度	111 年度	112 年前二季
稅前淨利(淨損)		322,517	227,209	(69,804)
所得稅(費用)利益		(62,694)	(58,871)	11,453
本期淨利	歸屬於母公司業主	259,823	168,338	(58,351)
	歸屬於非控制權益	0	0	0
	合計	259,823	168,338	(58,351)
其他綜合損益		(11,390)	3,481	-
本期綜合損益總額		248,433	171,819	(58,351)
每股稅後純益(虧損)(元)(註 1)		4.31	2.70	(0.90)
追溯調整後 每股稅後盈餘(虧損)(元)(註 2)		3.62	2.50	(0.85)

資料來源：該公司 110 及 111 年度經會計師查核簽證之財務報告與 112 年第二季經會計師核閱之財務報告

註 1：每股稅後純益係依當年度普通股流通在外加權平均股數計算。

註 2：追溯調整後每股稅後盈餘係以擬創新板上市股數 68,702 千股計算。

2. 承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

股票價值評估的方法很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法包括市場法如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，透過已公開的資訊和整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價的調整；成本法係以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎；另收益法如現金流量折現法則是將企業未來預估創造之現金流量折現後評定企業價值。本證券承銷商依一般市場承銷價格訂定方式，參酌該公司所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素，並參考市場法、成本法、收益法及該公司近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格。茲就各種股票價值評價方法之計算方式、優點、缺點及適用時機彙總說明如下：

項目	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
計算方式	依據公司之財務資料，計算每股帳面盈餘，並以上市櫃公司或產業性質相近的同業平均本益比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	依據公司之財務資料，計算每股帳面淨值，比較上市櫃公司或產業性質相近的同業平均股價淨值比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎，即以資產負債表帳面資產總額減去帳面負債總額，並考量資產及負債之市場價格而進行帳面價值之調整。	根據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值。

項目	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
優點	1.具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據。 2.市場價格資料容易取得。 3.所估算之價值與市場的股價較為接近。	1.淨值是長期且穩定之指標。 2.當盈餘為負數時，係另一種評估選擇。 3.市場價格資料容易取得。	1.資料容易取得。 2.使用財務報表資料，較為客觀公正。	1.符合學理上對價值的推論，能依不同變數預期來評價公司。 2.較不會受會計原則或會計政策不同影響，且可反應企業之永續經營價值。 3.考量企業之成長性及風險。
缺點	1.盈餘品質易受會計方法選擇所影響。 2.企業每股盈餘為負值或接近於零時不適用。 3.使用歷史性財務資訊，無法反應公司未來之績效。	1.帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。	1.程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.投資者不易瞭解現金流量觀念。 3.預測時間較長。
適用時機	適合評估風險水準、股利政策及成長率穩定的公司。	適用於評價產業成熟型及穩定型之公司。	適合評估如公營、金融事業或傳統產業類股。	1.可取得公司詳細的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

3.承銷價格與國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

該公司主要從事半導體測試(Semiconductor Testing)、半導體封裝(Semiconductor Packaging)及晶圓薄化(Wafer Thinning)等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC (Power Management Integrate Circuit, 以下簡稱電源管理 IC 或 PMIC)、金氧半場效電晶體(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，以下簡稱 MOSFET)產品及以氮化鎵(Gallium Nitride, 以下簡稱 GaN)或碳化矽(Silicon Carbide, 以下簡稱 SiC)為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。綜觀台灣上市半導體測試封裝公司其業務型態、產品性質及營業項目後，採以下三家公司做為採樣公司，京元電子股份有限公司（上市股票代號：2449，以下簡稱京元電子）主要營業項目為晶片研磨切割及測試封裝業務，終端應用涵蓋資訊、通訊、辦公室自動化、汽車電子以及消費性電子等相關產品；矽格股份有限公司（上市股票代號：6257，以下簡稱矽格）主要營業項目為測試封裝業務，終端應用涵蓋高效能運算、通訊、影音、消費性電子以及車用電子等相關產品；昇陽國際半導體股份有限公司（上市股票代號：8028，以下簡稱昇陽半導體）主要營業項目為晶圓再生服務及晶圓薄化製程服務，終端應用涵蓋消費性電子、工業用電子產品及汽車等電子元件。

股票價值評估的方法很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，茲將市場上常用之股票評價方法(市場法、成本法及收益法)分述如下：

(1)市場法

① 此法假設被評價公司之價值與同一產業類似公司間存在密切關係，因此以同一產業的類似公司作為評價比較的標準，通常以已上市、櫃同業股票之本益比或股價淨值比乘上目標公司之每股稅後純益或每股淨值，計算評價目標公司之合理價格。其評價模式為：

目標公司參考價值 $=\left(\dfrac{V_b}{X_b}\right)\times X_a$

X_a =目標公司之財務變數，如稅後每股盈餘或每股淨值等

$\left(\dfrac{V_b}{X_b}\right)$ =採樣公司之市場乘數

(實務上慣用類似公司之本益比或股價淨值比)

② 以市場法計算之承銷參考價格如下：

A. 本益比法

茲就採樣同業、上市半導體類股及上市大盤最近三個月(112 年 7 月～112 年 9 月)之本益比區間列示如下：

單位：倍

項目 月份	採樣同業			上　　市	
	京元電	矽格	昇陽半導體	半導體類股	大盤
112 年 7 月	12.43	9.91	29.19	14.18	16.80
112 年 8 月	16.38	13.39	23.86	15.11	18.09
112 年 9 月	16.20	13.32	22.25	14.61	17.79
平均	15.00	12.21	25.10	14.63	17.56

資料來源：臺灣證券交易所

由上表得知，該公司之採樣同業、上市半導體類股及上市大盤最近三個月之平均本益比約介於 12.21 至 25.10 倍間，而該公司最近四季(111 年第三季~112 年第二季)經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股盈餘(0.21)元為負值，因本益比法係以盈餘為評價基礎，若盈餘為負值則無法計算出合理價值，其本益比法無法反應該公司合理價值，故不擬採用本益比法。

B. 股價淨值比法

茲就採樣同業、上市半導體類股及上市大盤最近三個月(112 年 7 月～112 年 9 月)之股價淨值比區間列示如下：

單位：倍

項目 月份	採樣同業			上　　市	
	京元電	矽格	昇陽半導體	半導體類股	大盤
112 年 7 月	2.03	1.61	3.05	3.83	2.08
112 年 8 月	2.67	1.69	2.96	3.65	2.03
112 年 9 月	2.65	1.68	2.76	3.53	2.00
平均	2.45	1.66	2.92	3.67	2.04

資料來源：臺灣證券交易所

由上表得知，該公司採樣同業、上市半導體類股及上市大盤最近三個月之平均股價淨值比約為 1.66~3.67 倍，若以該公司 112 年第二季之權益淨值 1,194,379 千元，依擬上市掛牌股本 68,702 千股，追溯調整之每股淨值 17.38 元予以估算，按上述股價淨值比法計算其參考價格，其價格區間約為 28.85~63.78 元，而比較本次本證券承銷商與該公司議定暫定承銷價格 35 元，經評估尚屬合理。

(2)成本法-淨值法

①係依照一般公認會計原則將目標公司的資產價值扣除公司之負債，以獲得目標公司之價值，實務慣用衡量資產價值的方法為帳面價值法，依此法公司之價值即資產負債表之帳面淨值。其評價模式為：

目標公司參考價格 $= \dfrac{A_n - D_n}{S}$

A_n =目標公司總資產帳面價值(單位：千元)

D_n =目標公司總負債帳面價值(單位：千元)

S =目標公司流通在外普通股總數(單位：千股)

②以成本法計算之承銷參考價格如下：

$$P = \frac{A_n - D_n}{S}$$

= (2,053,081 - 858,702) ÷ 64,660

= 18.47元

依該公司 112 年第二季經會計師核閱之財務報表淨值 1,194,379 千元及上市掛牌前流通在外股數 64,660 千股計算之。

此種評價方式係以歷史成本為計算依據，無法表達資產實際經濟價值亦未考慮公司的未來獲利能力，較不具參考性，且在評定資產總額及負債總額時，尚需考慮到資產及負債之真正市價，一般而言不容易取得市價資訊，故本證券承銷商與該公司未以此方法列入承銷價格議定之依據。

(3)收益法-現金流量折現法

此法主要假設目標企業之價值為未來各期創造之現金流量折現值，基於對於公司之未來現金流量較難精確掌握，且部分評價因子亦較難取得適切之數據故可能無法評估公司應有價值。茲將收益法之基本假設及評估參數分述如下：

①模型介紹

現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method)係認為企業價值應為未來營運可能創造淨現金流量之現值總和，其中又以自由現金流量折現模式(Free Cash Flow Model)最能反映合理之報酬率，其計算公式如下：

$P0 = V_E / N = (V0 - V_D) / Shares$

$$V_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^t} + \sum_{t=n+1}^{m} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^n \times (1+K2)^t} + \frac{FCFF_{m+1}}{(1+K1)^n \times (1+K2)^{m-n}(K3-G)}$$

$$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - tax\ rate_t) + Dep\&Amo_t - Capital\ Exp_t - \triangle \mathrm{NWC}_t$$

$$K_i = \frac{D}{D+E} \times K_d \times (1 - tax\ rate) + \frac{E}{D+E} \times K_e$$

$$K_e = R_f + \beta_j \times (R_m - R_f)$$

P_0	＝每股價值
V_0	＝企業總體價值＝$\mathrm{V}_E + V_D$＝股東權益價值＋負債價值(不含計入營業活動現金流量之負債)
N	＝擬上市(最大)股數 68,702 千股
FCFF_t	＝第 t 期之自由現金流量
K_i	＝加權平均資金成本 i＝1,2,3
G	＝營業收入淨額成長率
n	＝5　第一階段之經營年限：112 年度~116 年度
m	＝10 第二階段之經營年限：117 年度~121 年度
$EBIT_t$	＝第 t 期之息前稅前淨利
$tax\ rate_t$	＝第 t 期之稅率
$Dep\&Amo_t$	＝第 t 期之折舊與攤銷費用
$Capital\ Exp_t$	＝第 t 期之資本支出 ＝第 t 期之購置固定資產支出+新增長期投資支出
$\triangle\ \mathrm{NWC}_t$	＝第 t 期之淨營運資金變動需求-第 t-1 期之淨營運資金 ＝(第 t 期之流動資產-不附息流動負債)-(第 t-1 期之流動資產-不附息流動負債)
D/D+E	＝附息負債占附息負債及權益比
E/D+E	＝權益占付息負債及權益比＝1- D/D+E
K_d	＝附息負債資金成本率
K_e	＝權益資金成本率
R_f	＝無風險利率
R_m	＝市場平均報酬率

β_j ＝系統風險；衡量公司風險相對於市場風險之指標

②加權平均資金成本及自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間Ⅰ	期間Ⅱ	期間Ⅲ	基本假設說明
T	t≦n,n＝5	n+1≦t≦m,m＝10	t≧m+1	依據該公司狀況分為三期間： 期間Ⅰ：112~116年度 期間Ⅱ：117~121年度 期間Ⅲ：122年度後(永續經營)
D/D+E	30.272%	37.577%	44.882%	期間Ⅰ：依該公司最近兩年度及最近期之付息負債占比(付息負債+權益)平均比率計算。 期間Ⅱ：採用期間Ⅰ及期間Ⅲ之平均數。 期間Ⅲ：進入永續經營期後，估計對資本市場與運用應與同業相近，以採樣同業京元電、矽格及昇陽半導體最近期之付息負債占比(付息負債+權益)平均比率計算之平均數。
E/D+E	69.728%	62.423%	55.118%	
K_d	2.600%	2.275%	1.951%	期間Ⅰ：係以該公司112年第二季財務報告之最高借款利率。 期間Ⅱ：採用期間Ⅰ及期間Ⅲ之平均數。 期間Ⅲ：係採最近十年本國銀行之各季借款平均利率計算之。
tax rate	20.00%	20.00%	20.00%	依財政部新制營利事業所得稅率20%估算。
R_f	1.396%	1.396%	1.396%	112 年 10 月 5 日證券櫃檯買賣中心公告台灣十年期以上政府公債加權平均殖利率。
R_m	6.343%	6.343%	6.343%	係採用102~111年度股票集中市場之幾何平均投資報酬率。
β_j	1.141	1.071	1	期間Ⅰ：係採用 TEJ 資料庫計算之採樣同業(京元電、矽格及昇陽半導體)最近五年股價對集中交易市場大盤指數之風險係數，並取其平均值。 期間Ⅱ：採用期間Ⅰ及期間Ⅲ之平均數。 期間Ⅲ：預期永續經營期之系統風險將逐步貼近市場之系統風險，故假設為1。
K_e	7.042%	6.693%	6.343%	$K_e = R_f + \beta_j \times (R_m - R_f)$。其中， R_f ：無風險報酬率； β_j ：類股與大盤走勢之相關係數； R_m：市場風險報酬率
Ki	5.379%	4.784%	4.199%	加權平均資金成本
G (保守情境)	公司預算	3.200%	0.000%	期間Ⅰ：參考公司預算。 期間Ⅱ：係以國際貨幣基金預測116年之全球經濟成長率3.2%估計。 期間Ⅲ：考量永續經營，尚無法合理預估成長率，故假設成長率為0。
G (樂觀情境)	公司預算	3.200%	3.200%	期間Ⅰ：參考公司預算。 期間Ⅱ：係以國際貨幣基金預測116年之全球經濟成長率3.2%估計。 期間Ⅲ：係以國際貨幣基金預測116年之全球經濟成長率3.2%估計。

A. 保守情境

P0＝(V0－VD) / Shares

＝{2,636,473 千元－524,442 千元} / 68,702 千股

＝30.74 元/股

B. 樂觀情境

＝{6,088,693－524,442 千元} / 68,702 千股

＝ 80.99 元/股

依據上述假設及公式，該公司依收益法(現金流量折現法)之參考價格區間為 30.74 元~80.99 元。由於此法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，然因未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數亦無一致標準。在股價評價方法選擇上，考量收益法下如現金流量折現法因需推估公司未來數年之盈餘及現金流量作為評價之基礎，然而預測期間長，推估營收資料之困難度提高，不確定性風險相對高，亦不能合理評估公司應有之價值，故不擬採用此法評估。

綜上所述，本證券承銷商依一般市場承銷價格訂定方式，主要係參考市場法之股價淨值比法計算股票公開承銷之參考價格範圍，選擇採樣同業及半導體類股之股價淨值比，以作為該公司辦理股票公開承銷之參考價格訂定依據，復參酌該公司最近一個月(112 年 9 月)興櫃市場之平均成交價、該公司最近二年度之經營績效、獲利情形以及所處產業未來前景、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本證券承銷商與該公司共同議定承銷價格，與國際慣用方法比較尚無重大異常之處。

(二) 申請公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

1. 該公司與上市櫃同業財務狀況

分析項目		公司名稱	110年度	111年度	112年前二季
財務結構	負債占資產比率(%)	微矽電子	45.36	38.01	41.83
		京元電子	51.71	50.31	49.56
		矽格	51.30	48.41	52.08
		昇陽半導體	60.22	65.21	66.73
		同業平均	48.10	46.60	(註 2)
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	微矽電子	112.71	126.28	108.34
		京元電子	128.13	133.53	132.20
		矽格	156.44	174.51	176.13
		昇陽半導體	127.04	130.89	117.15
		同業平均	207.47	195.69	(註 2)

資料來源：公開資訊觀測站各公司年報及經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註：截至評估報告出具日止，未有揭露季度之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」，故未揭露。

(1) 負債占資產比率

該公司最近二個會計年度及 112 年第二季底之負債占資產比率分別為 45.36%、38.01%及 41.83%。111 年度之負債占資產比率較 110 年度下降至 38.01%，主係該公司為增建廠房及新增設備之資金需求，新增長期借款 60,000 千元，但因 111 年度辦理現金增資償還短期借款，致負債總額較前一年底減少 9.66%，另資產總額因增建廠房及新增設備而成長 8%，致負債占資產比率減少。112 年前二季因增建廠房及購置機器設備等之其他應付款較 111 年底增加 47,336 千元，及因受營收下滑之影響致現金及應收款項淨額亦較 111 年底減少，致負債占資產比率較 111 年度上升至 41.83%。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年第二季底之負債占資產比率均低於採樣公司及同業平均，經評估尚無重大異常之情事。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司最近二個會計年度及 112 年第二季底之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 112.71%、126.28%及 108.34%。該公司於 111 年辦理現金增資，加上持續獲利使得權益較 110 年度增加；考量近年來之營運發展需求及因應功率元件、第三代半導體測試服務及晶圓薄化需求成長，該公司決議增建竹南廠廠房，其資金來源，除以自有資金負擔投資額的 20%，餘 80%的投資額係向金融機構辦理融資，使得長期借款較 110 年度增加。另 111 年度擴建竹南廠廠房及添購生產設備使得不動產、廠房及設備淨額較 110 年度增加 7.70%，因其增加幅度小於權益及長期負債之增加幅度，致 111 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升至 126.28%。112 年前二季因持續添購測試機及增建工程陸續完工，不動產、廠房及設備淨額較 111 年度增加 5.67%，其成長幅度高於權益及長期負債之增加幅度，致長期資金占不動產、廠房及設備比率下降至 108.34%。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年第二季底之長期資金占不動產、廠房及設備比率均低於採樣公司及同業平均，然皆超過 100%，經評估尚無重大異常情事。

整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之財務結構尚屬穩健。

2. 該公司與上市櫃同業獲利情形

分析項目		公司名稱	110 年度	111 年度	112 年前二季
獲利能力	資產報酬率(%)	微矽電子	14.23	8.36	(5.21)
		京元電子	8.25	10.13	8.50
		矽格	9.56	9.93	5.54
		昇陽半導體	4.81	4.72	4.95
		同業平均	11.40	11.70	(註 2)

分析項目			公司名稱	110 年度	111 年度	112 年前二季
	權益報酬率(%)		微矽電子	26.47	13.72	(9.17)
			京元電子	16.30	19.44	15.41
			矽格	18.53	18.89	10.03
			昇陽半導體	10.54	11.81	13.19
			同業平均	21.20	21.50	(註 2)
	占實收資本額比率(%)	營業利益	微矽電子	50.86	31.62	(23.81)
			京元電子	54.03	74.95	55.22
			矽格	76.10	83.78	36.36
			昇陽半導體	16.57	20.18	22.29
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 2)
		稅前純益	微矽電子	52.87	35.13	(21.59)
			京元電子	56.06	73.33	54.46
			矽格	81.02	96.91	50.47
			昇陽半導體	18.69	24.42	30.43
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 2)
	純益率		微矽電子	20.10	13.72	(15.18)
			京元電子	15.50	18.98	17.68
			矽格	18.2	18.8	12.92
			昇陽半導體	9.62	10.36	10.88
			同業平均	12.00	12.80	(註 2)
	每股盈餘(元)		微矽電子	4.31	2.70	(0.90)
			京元電子	4.23	5.59	2.24
			矽格	6.25	6.68	1.62
			昇陽半導體	1.58	2.17	1.27
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 2)

資料來源：公開資訊觀測站各公司年報及經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註 1：「中華民國台灣地區主要行業財務比率」未揭露該項比率。

註 2：截至評估報告出具日止，未有揭露季度之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」，故未揭露。

(1) 資產報酬率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之資產報酬率分別為 14.23%、8.36%、及(5.21)%，資產報酬率呈現逐年下降之趨勢，主係 111 年度及 112 年前二季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之資產報酬率與採樣公司互有高低，經評估尚無重大異常之情事。

(2)權益報酬率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之權益報酬率分別為 26.47%、13.72%、及(9.17)%。權益報酬率呈現逐年下降趨勢，主係因 111 年度及 112 年前二季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司 110 年度之權益報酬率高於採樣公司及同業平均，111 年度之權益報酬率介於採樣公司及同業平均之間，112 年前二季該公司受產品終端需求疲弱，客戶尚在去化庫存，致營業收入及權益報酬率皆低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

(3)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業利益占實收資本額比率分別為 50.86%、31.62%及(23.81)%，稅前純益占實收資本額比率分別為 52.87%、35.13%及(21.59)%，營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率呈現下滑之趨勢，主係因 111 年度及 112 年前二季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得營業利益及稅前純益均較前一年度減少。

經與採樣公司相較，該公司最近二個會計年度之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均介於採樣公司之間，112 年前二季低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

(4)純益率及每股盈餘

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之純益率分別為 20.10%、13.72%及(15.18)%，每股盈餘分別為 4.31 元、2.70 元及(0.90)元。純益率及每股盈餘呈現下滑之趨勢，主係受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司 110 年度之純益率優於採樣公司及同業平均，111 年度介於採樣公司及同業平均之間，112 年前二季低於採樣公司；最近二個會計年度之每股盈餘均介於採樣公司之間，112 年前二季因營收下滑，致每股盈餘低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之獲利能力應無重大異常。

3. 該公司與上市、櫃同業本益比之比較情形

請詳本評估報告「壹、評估報告總評、二、(一)」之評估說明。

(三)所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本證券承銷商與該公司共同議定之承銷價格，並未委請財務專家出具意見或鑑價機構提供鑑價報告，故不適用。

(四)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

微矽電子公司於 111 年 9 月 26 日開始為興櫃股票櫃檯買賣，其申請年度

最近一個月之平均股價及成交量資料列示如下：

單位：元；股

月份	平均股價	成交量
112 年 9 月	40.01	783,720

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

(五)證券承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

綜上所述，本證券承銷商經參酌國際慣用之股價淨值比法計算之該公司承銷價格參考區間為 28.85~63.78 元，另該公司最近一個月興櫃市場交易之平均股價為 40.01 元，再參照該公司經營績效、獲利情形、未來產業前景等條件後，本證券承銷商與該公司共同議訂承銷價格暫訂為每股新台幣 35 元，應尚屬合理。本證券承銷商將俟未來該公司創新板上市申請案奉主管機關核准後，於辦理公開承銷前，依該公司實際營運情形，當時股票市場狀況及辦理詢價圈購或競價拍賣結果，與該公司另行議定合理之承銷價格。

三、承銷風險因素

茲將本次承銷相關風險列示說明如下：

(一)股價變化過鉅

為使本次訂定預計承銷價格時，能充分反映公司真實價值，本證券承銷商已依據國際間慣用之市場法計算承銷價格參考區間，再參酌上市同業公司狀況及該公司興櫃市場價格，以確實表達承銷價格之合理性。

該公司本次暫定之承銷價格，已考量該公司未來經營績效、同業狀況及發行市場現況等因素後而予以調整，因此，本次承銷價格應尚能合理反映該公司之市場價值，且辦理公開承銷時，將針對市場對案件承銷價格的接受條件及認購情形進行調查，作為調整承銷價格之參考依據。另本證券承銷商亦已依「中華民國證券商商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」規定，擬定穩定價格策略，期能降低股價變化過鉅之風險。

(二)穩定價格策略

1. 過額配售機制

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，本證券承銷商已與該公司簽訂「過額配售協議書」，與該公司協調其股東提出對外公開銷售股數 15%為上限，提供已發行普通股股票供本證券承銷商辦理過額配售，並將過額配售取得之款項作為執行穩定掛牌後價格操作之資金，於創新板上市買賣日起五個交易日採無升降幅度限制時，若公司股價出現異於大盤或同業表現而有跌破承銷價時，主辦承銷商得運用此資金執行穩定價格操作。

2. 特定股東集保

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，本證券承銷商已與該公司簽訂特定股東股權集保之承諾書，願送存所持有股票至臺灣集中保管結算所股份有限公司集保，於掛牌日起三個月內不得賣出，以維持承銷價格穩定。

(三)本次承銷之相關費用及承銷手續費率

該公司本次辦理公開承銷所需之費用主要包括公開說明書印製費用、報紙公告、相關承銷書件印製費用、會計師及律師之勞務費以及承銷手續費等；而承銷手續費將參考未來辦理公開銷售時之市場行情議定，惟依國際財務報導準則實務指引(IFRS Manual of Accounting)及參酌 IAS32 第 37 段之說明，企業於發行或取得本身之權益工具時，通常會發生各種成本，此權益交易之交易成本應按扣除所有相關所得稅利益後之淨額作權益之減項處理，但以直接可歸屬該權益交易之可避免增額成本為限，而本次承銷手續費係可直接歸屬於該權益交易之可避免增額成本，故對該公司之獲利狀況並無重大影響。

(四)新股承銷導致股本膨脹稀釋獲利

該公司為申請股票初次創新板上市，預估將辦理現金增資發行新股 4,042 仟股(暫訂)，占發行前股數 64,660 仟股之 6.25%，然考量該公司未來業績與獲利之成長動能，本證券承銷商與該公司訂定承銷價格時業已考量此次發行新股之稀釋效果，對該公司獲利之稀釋影響尚屬有限。

綜上分析，該公司已依法令規定計算應提出公開承銷股數，並全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理創新板上市前公開銷售，經評估本次新股承銷之相關費用對其獲利之稀釋程度有限，股本膨脹對該公司獲利之稀釋效果亦已於本次議定承銷價格時納入考量，另本證券承銷商已針對承銷價格擬定穩定價格策略，整體而言，其承銷風險應屬有限。

四、總結

(一)本證券承銷商經評估該公司之產業、財務及業務狀況後，綜合說明該公司營運風險、財務風險及潛在風險如下：

1. 半導體市場景氣波動，影響公司營運

測試封裝廠屬於半導體產業供應鏈後段製程，因此仍受半導體景氣循環影響。

<u>因應對策：</u>

因應半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司持續開發新產品，與客戶建立長期的合作關係，提供客戶高附加價值之代工服務。隨高效能運算、5G、物聯網和車用電子等市場持續擴大，該公司之客戶已於各類產品進行佈局，以降低已成熟產品之市場需求力道減弱所帶來之營運風險，未來該公司持續與客戶配合，搭配該公司各項代工製程及機台改良技術，強化品質、成本及交期的優勢，以因應市場快速變化及同業之競爭。

2. 研發人員流失之風險

隨著半導體產業不斷的發展，具經驗之技術開發及研發人才的爭取日漸困難，且需要長時間培養及訓練，故具經驗之研發人才常成為他公司招攬之對象。

<u>因應對策：</u>

該公司透過技術人員之技術傳承、實作經驗分享、個案探討及內部教育

訓練等，建立技術開發及研發人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的研發團隊。此外，提供良好的工作環境，並建立制度化的員工福利獎酬辦法，以增進員工之向心力。對於研發人員均要求簽訂保密合約，且對於所研發之技術做適當之資料保存，以預防研發人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。另該公司積極推動上市，藉以提高公司知名度，吸引優秀人才，並可透過發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及員工酬勞等工具，將公司經營成果與員工共享，以提高員工之向心力。

3. 中國半導體產業之競爭風險

近年來中國半導體業力求提高自給率，並在政策上大力支持下，將成為中國半導體封測公司步入快速發展的有效驅動力，對我國半導體產業形成競爭壓力。

因應對策：

該公司以強化新產品的工程能力及提供精進之測試封裝服務能力，以品質、交期、效率與彈性的服務內容，與中國大陸廠商形成區隔，獲取更多台灣及國外客戶長期合作的機會。

(二)承銷商總結評估說明外國發行公司申請股票第一上市案件之風險事項時，並應列示其註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並評估說明外國發行公司所採行因應措施之適當性

該公司為本國申請公司，故不適用本項評估。

(三)依據對發行公司整體評估之結果，作為是否推薦發行公司於創新板上市之依據

本證券承銷商基於輔導期間對該公司之產業狀況、營運風險、業務及財務狀況綜合評估，並就不宜上市標準進行查核，認為該公司已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」所規定之上市標準，且其產業未來前景尚屬樂觀，故本證券承銷商推薦該公司申請股票於創新板上市。

貳、產業狀況及營運風險

一、發行公司所屬行業營運風險

(一)產業現況

該公司主要係從事半導體測試(Semiconductor Testing)、半導體封裝(Semiconductor Packaging)及晶圓薄化(Wafer Thinning)等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC(Power Management Integrate Circuit, 以下簡稱電源管理 IC 或 PMIC)、金氧半場效電晶體(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，以下簡稱 MOSFET)產品及以氮化鎵(Gallium Nitride, 以下簡稱 GaN)或碳化矽(Silicon Carbide, 以下簡稱 SiC)為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。以下就該公司所屬之半導體及 IC 封測產業、功率半導體及晶圓薄化之產業概況及所屬行業營運風險分

述如下:

1. 半導體及 IC 封測產業

半導體晶片為現今大多數科技產品之核心，從智慧手機、電腦、家電、醫療設備、通訊、能源及工業自動化等無所不在，近年來隨著半導體產業持續發展與先進製程的不斷突破，加上通訊、車用、物聯網、工業電腦及伺服器等運算效能需求大幅增加，開創半導體產業的新契機，2021 年受惠全球零接觸經濟的興起，帶動個人裝置、雲端運算及資料中心需求增加，使全球半導體市場在 2021 年高度成長。根據工研院產科國際所統計(詳圖一)，在 2021 年半導體市場全年總銷售值達 5,559 億美元，較 2020 年成長 26.2%。隨著全球人工智慧、物聯網、5G、高效能運算及車用等應用需求持續成長，帶動全球半導體市場的需求。2022 年全球半導體產業市場成長 3.3%，達 5,741 億美元。2023 年上半年由於烏俄戰爭引發全球通貨膨脹，終端市場需求急速下滑使得廠商營收放緩，預期 2023 年下半年在庫存調整接近尾聲後有望逐步復甦，整體而言，半導體市場在 2023 年受制於市場供過於求及價格疲軟等因素，預估 2023 年全球半導體市場規模為 5,151 億美元，較 2022 年衰退 10.3%。2024 年受惠 AI 伺服器需求及通膨趨緩影響，全球半導體市場預計將可成長 11.8%，達到 5,760 億美元。

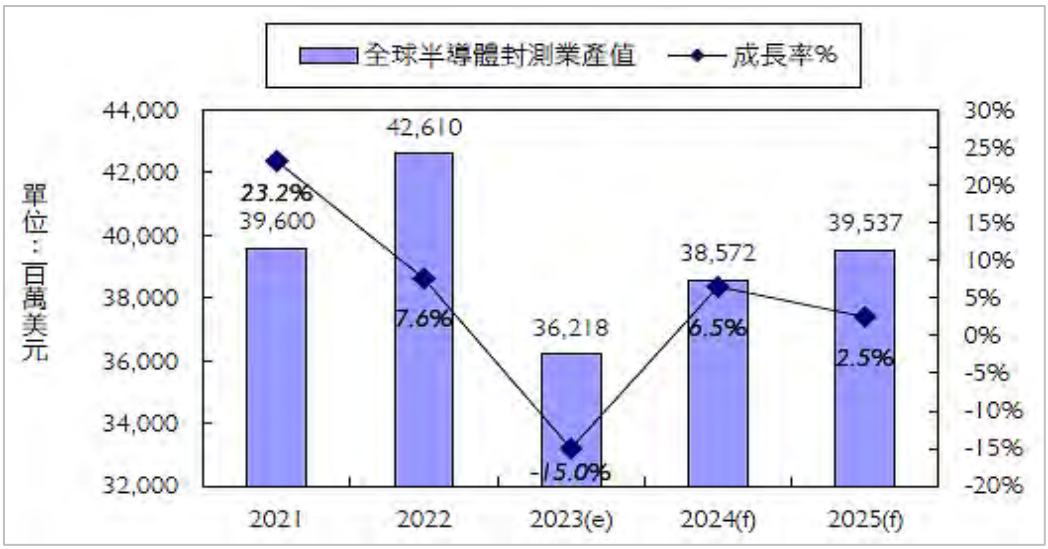
圖一：全球半導體市場規模

資料來源：工研院產科國際所 2023/6

封裝測試為半導體產業鏈後段的核心，對最終晶片的品質與性能至關重要，依據工研院產科國際所(詳圖二)研究報告，全球半導體封測產業 2021 年因疫情反覆、居家工作與學習的趨勢不輟，帶動 PC、NB、相關物聯網及終端電子產品需求，使全球半導體封測產業市場在 2021 年高度成長，市場規模達 396 億美元，較 2020 年成長 23.2%。隨著全球人工智慧、物聯網、5G、高效能運算及車用等應用需求持續成長，半導體供應鏈持續擴張，2022 年全球半導體封測產業市場規模成長 7.6%，達 426 億美元。2023 年上半年由於烏俄戰爭引發全球通貨膨脹，終端市場需求急速下滑，諸多封測廠產能利用

率較低，預期 2023 年下半年在庫存調整接近尾聲後有望逐步復甦，預估 2023 年全球半導體封測產業市場規模為 362 億美元，較 2022 年衰退 15.0%。展望未來，隨著半導體產業逐步回升，加上廠商於先進封裝及異質整合的佈局，將有助於 2024 年半導體封測產業持續成長。

圖二：全球半導體封測產業市場規模



資料來源：工研院產科國際所 2023/5

台灣半導體產業從上游至下游，以專業分工及群聚效益獨步全球，在部分國家因疫情停工及美中貿易戰影響，台灣半導體廠因全球市佔率高及產品線廣泛而獲轉單效應，根據工研院產科國際所報告(詳圖三)統計，2021 年台灣半導體產業產值達 4.08 兆新台幣，較 2020 年成長 26.7%。在全球人工智慧、高效能運算、5G、車用、物聯網等應用需求提升，加上價格提高與新建置產能逐步導入下，2022 年台灣半導體產業產值達 4.83 兆新台幣，較 2021 年成長 18.5%。但 2023 年因受通貨膨脹及終端需求減緩影響下，廠商調整庫存導致產能利用率下滑，預估 2023 年台灣半導體產業產值為 4.56 兆新台幣，較 2022 年衰退 5.6%。

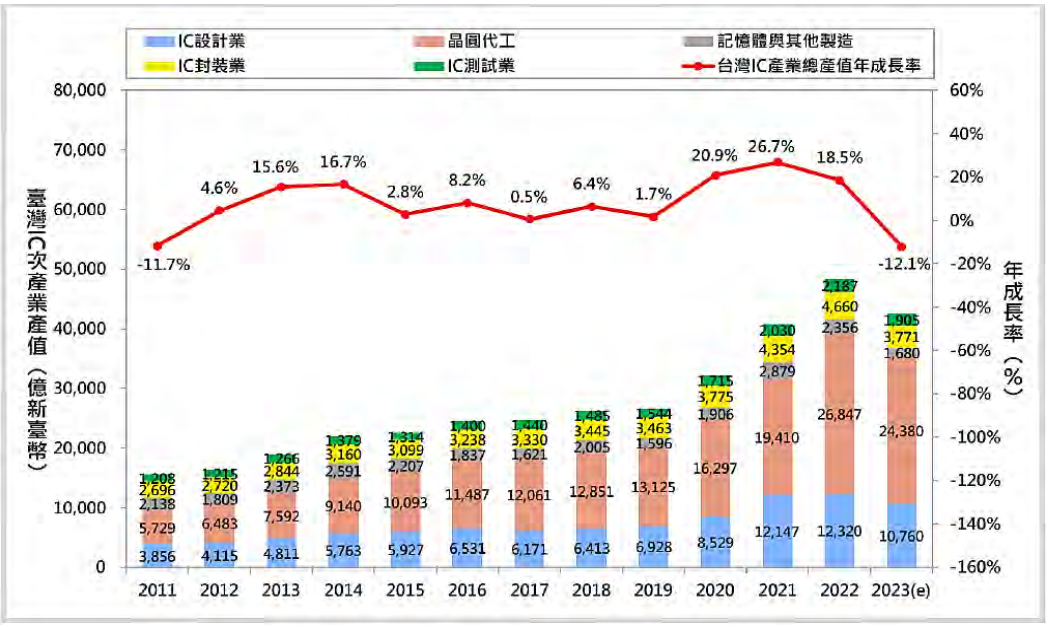
圖三：台灣半導體產業產值成長趨勢

億新臺幣	2019	2019 成長率	2020	2020 成長率	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023 (e)	2023 (e) 成長率
IC產業產值	26,656	1.7%	32,222	20.9%	40,820	26.7%	48,370	18.5%	45,643	-5.6%
IC設計業	6,928	8.0%	8,529	23.1%	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,800	-12.3%
IC製造業	14,721	-0.9%	18,203	23.7%	22,289	22.4%	29,203	31.0%	28,213	-3.4%
晶圓代工	13,125	2.1%	16,297	2.1%	19,410	19.1%	26,847	38.3%	26,486	-1.3%
記憶體與其他製造	1,596	-20.4%	1,906	19.4%	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,727	-26.7%
IC封裝業	3,463	0.5%	3,775	9.0%	4,354	15.3%	4,660	7.0%	4,500	-3.4%
IC測試業	1,544	4.0%	1,715	11.1%	2,030	18.4%	2,187	7.7%	2,130	-2.6%
IC產品產值	8,524	1.3%	10,435	22.4%	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,527	-14.6%

資料來源：工研院產科國際所 2023/3

另該公司所屬半導體產業中之 IC 封測產業，依據工研院產科國際所(詳圖四)研究報告，2021 年因疫情及變種病毒持續擴散全球，遠距辦公及教學仍為多數國家的防疫方式，故消費性電子需求持續增加，致 2021 年台灣 IC 封測產業產值為新台幣 6,384 億元，較 2020 年成長 16.28%。隨著高效能運算、5G、物聯網和車用電子等的需求暢旺，且台灣 IC 封測產業擁有全球先進封裝技術能量及多樣化產品線，在各項動能持續推升下，2022 年台灣 IC 封測產業產值達新台幣 6,847 億元，較 2021 年成長 7.03%。2023 年受高庫存與需求下降影響，終端進行庫存及產品組合調整，預估 2023 年台灣 IC 封測產業產值將為新台幣 5,676 億元，較 2022 年衰退達 17.10%。

圖四：台灣 IC 封測產業產值



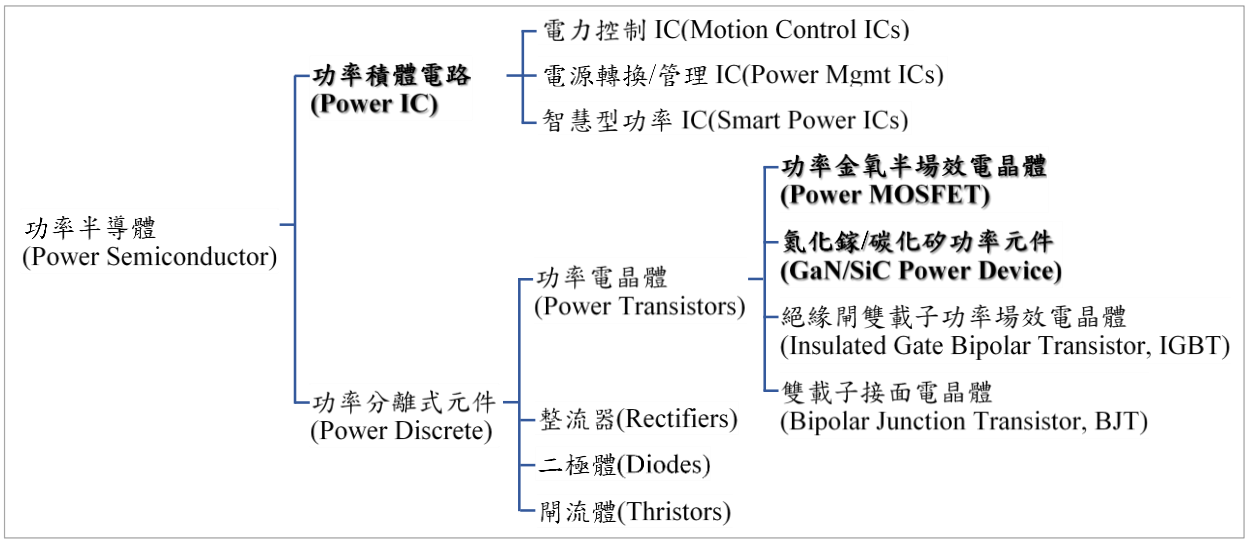
資料來源：工研院產科國際所 2023/5

2. 功率半導體產業

功率半導體係屬半導體產業之一部分，係用於電子產品之電能轉換與電路控制，是電能功率處理之核心元件，也是電源供應之重要通道。典型之功率處理包括變頻、變壓、整流、功率放大與管理，除確保設備正常運行外，

還能有效節能。市場研究調查機構 BusinessWire 將功率半導體(Power Semiconductor)分為功率積體電路(Power IC)及功率分離式元件(Power Discrete)等兩大類，各占功率半導體產業市值五成。

圖五：功率半導體產品分類



資料來源:兆豐證券整理

在功率半導體領域中(詳圖五)，該公司主要係提供電源管理 IC、MOSFET 及 GaN/SiC 之第三代半導體產品之測試封裝服務，茲就電源管理 IC、MOSFET 及第三代半導體之產業現況敘述如下：

(1) 電源管理 IC

電源管理 IC 是一種特定用途的集成電路，係將傳統分立於各類功能的電源管理器件整合在單顆 IC 內，藉此提高空間利用率和系統電源效率，並在有限的體積內集成更多的電源通道，提供所需的正確供電電流及電壓，並藉由控制功率元件，使電流符合終端不同階段之需求，以達到對應用產品高效率和高整合度，成為系統供電的首選。

電源管理 IC 在所有電子產品中扮演著不可或缺的關鍵性角色，其主要作為在不同的系統運作狀態下，隨時控制並保持系統內適當電流與電壓正常供給，而電源管理 IC 的優劣，將會直接影響電子產品的使用壽命。電源管理 IC 應用廣泛，舉凡工業控制、通訊產業、汽車工業、消費性電子產品、可攜式產品及電腦工業產品上皆可見其應用，而伴隨著各式電子產品高效能與低功耗之需求，加上全球 ESG 風潮興起，各國在低碳排放的共識下，以致電源管理 IC 發展更顯重要。依據市場調查機構 IC Insights(詳圖六)預估，全球電源管理 IC 規模從 2022 年至 2028 年的複合成長率約為 7.9%。

圖六：全球電源管理 IC 市場預估

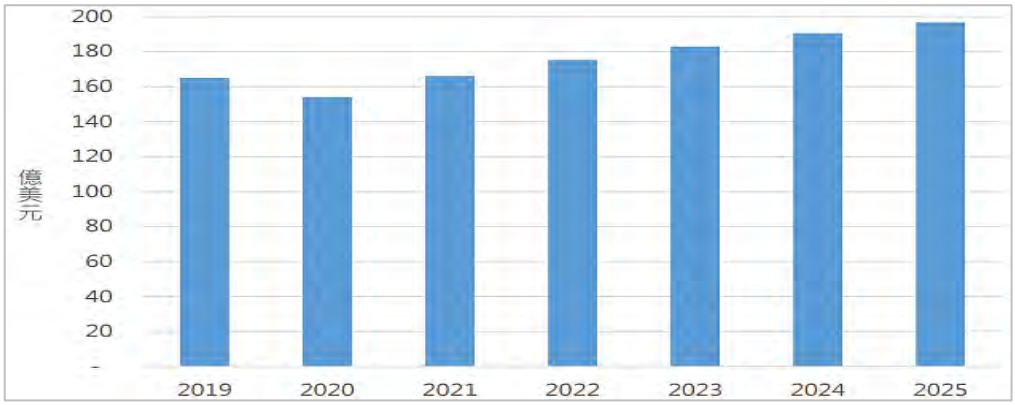
資料來源：IC Insights 2023/3

(2)MOSFET

功率元件中之功率電晶體係包含 MOSFET、氮化鎵/碳化矽功率元件(GaN/SiC Power Device)、絕緣閘雙載子功率場效電晶體(IGBT)及雙載子接面電晶體(BJT)等，MOSFET 係用於電子裝置的電能轉換與電路控制，也是弱電控制與強電運行間之橋樑，具有驅動電路較簡單、損耗低、熱阻特性佳以及頻率較高等優勢，在電子產品中被廣泛應用，成為最大宗產品，除確保設備正常運行外，還能有節能效果，為電能處理之核心器件，其應用範圍涵蓋消費性電子、家電、工業產品、通訊設備、再生能源及國防軍事等。

鑒於 MOSFET 之產品周期較長、穩定性高等特點，產品設計更著重於分析材料之物理化學性質及製程，並進行參數調整和性能改良，以製作出符合客戶需求之客製化產品，故 MOSFET 之核心技術除結構設計外，在初期材料選擇、晶圓製程及後段測試封裝等部分皆舉足輕重，MOSFET 市場成熟且穩健，在技術水平與生產良率持續提升下，以及元件整合，使產品應用領域將逐漸拓展。隨著全球節能減碳趨勢盛行及電動車市場成長，將帶動功率元件需求增加，依據工研院產科國際所(詳圖七)研究報告預估，全球功率元件市場規模從 2022 年至 2025 年的複合成長率約為 5%。

圖七：全球功率元件市場規模



資料來源：工研院產科國際所 2022/10

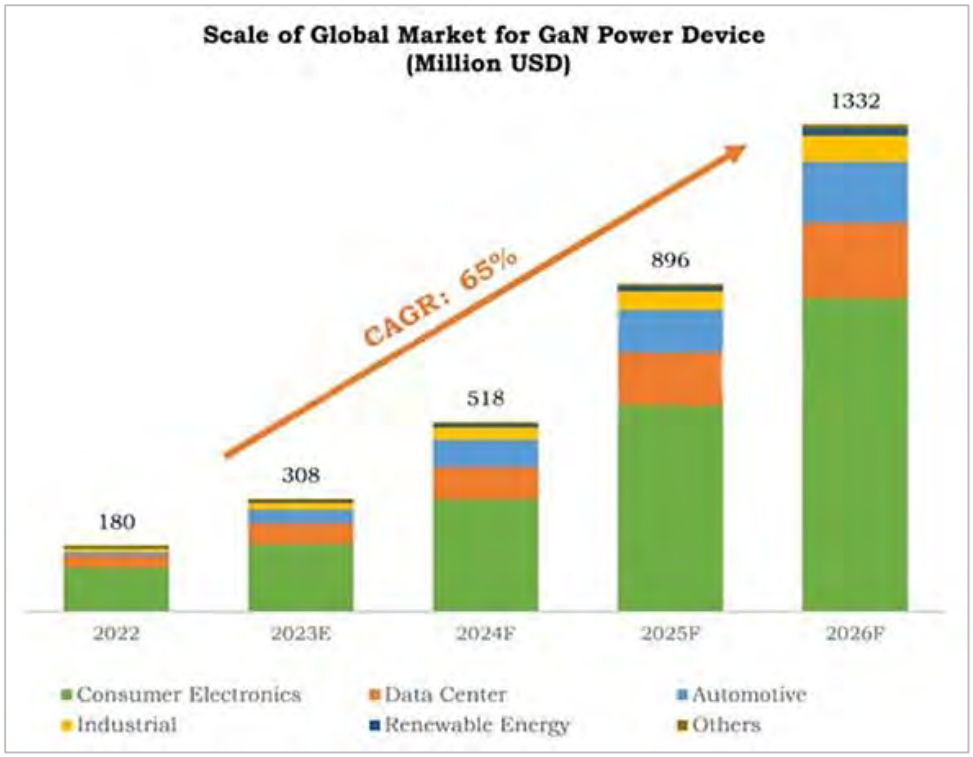
(3) 第三代半導體

第三代半導體係指功率元件之材料特性使用 GaN 與 SiC 的寬能隙(Wide Band Gap, WBG)材料製造的化合物半導體，可適用在與第一代及第二代半導體之不同領域，故並不是取代傳統半導體材料 Si(矽)及砷化鎵(GaAs)，而是因應新市場需求而發展，相較於第一代半導體材料的 Si 與第二代半導體材料的 GaAs，第三代半導體材料具有寬能隙、高熱導率、高擊穿電場及高電子遷移率等特性，可大幅提升效率、減少耗電量及縮小體積等優勢，一般而言，GaN 適用於中低功率、高頻率產品，SiC 適用於高壓高功率產品，隨著電動車、新能源、5G 及低軌衛星等市場趨勢下，未來第三代半導體已成不可或缺的重要元件。另就第三代半導體使用之 GaN 及 SiC 功率元件之產業現況分述如下:

A. GaN

GaN 為高頻應用的主流元件，開關速度快且體積小，可以有效縮小產品尺寸，主要應用於消費性電子產品快充、5G 基地台及低軌衛星等，依據市場研究機構 TrendForce 集邦(詳圖八)統計，隨著知名手機大廠首次採用 GaN 技術的快速充電器，將加速第三代半導體於消費市場應用的滲透率，致 2022 年 GaN 功率元件市場規模達 1.8 億美元。受惠於 5G 通訊及資料中心高效能運算的推動下，從 2022 年至 2026 年的複合成長率約為 65%，2026 年 GaN 功率元件市場規模將達 13.32 億美元。

圖八：GaN 功率元件市場規模



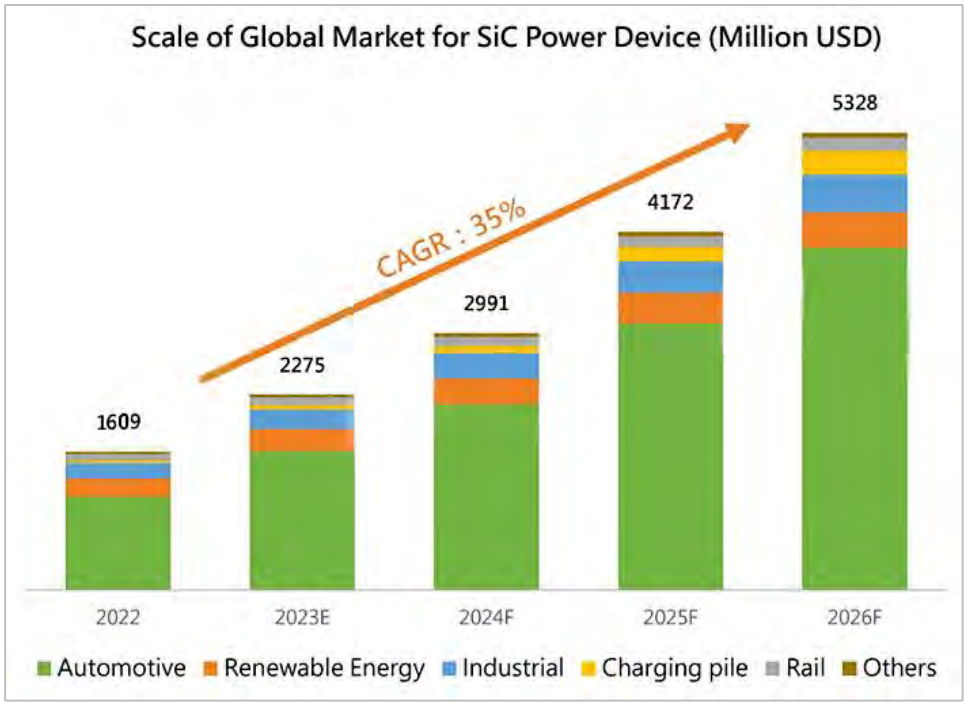
資料來源：TrendForce 2023/7

B. SiC

SiC 為高壓高功率應用的主流元件，導熱性及耐壓性佳，可以減少

電能的轉換損耗，主要應用於電動車、太陽能發電、儲能設備及充電樁等，依據 TrendForce 集邦(詳圖九)統計，隨著碳排標準的提高，更多車廠於驅動系統中導入 SiC 技術，致 2022 年 SiC 功率元件市場規模達 16.09 億美元。受惠於新能源及電動車持續需求下，從 2022 年至 2026 年的複合成長率約為 35%，2026 年 SiC 功率元件市場規模將達 53.28 億美元。

圖九：SiC 功率元件市場規模



資料來源：TrendForce 2023/7

3. 晶圓薄化產業

半導體晶圓薄化為功率元件不可或缺的重要製程，主係為晶圓進行正面金屬鍍膜(Front Side Metallization,以下簡稱 FSM)、晶圓背面研磨與金屬鍍膜(Backside Grinding and Backside Metallization,以下簡稱 BGBM)，目前傳統晶圓厚度為 700-800um，而晶圓薄化技術可使其厚度減少到甚至 50um，能夠幫助降低電流通過之阻值，減少功率損耗，除了有效減少後續封裝體積外，並能減少熱能累積效應，滿足元件薄型化、高性能、節能之需求，故晶圓代工廠完成之產品需再進行晶圓薄化相關製程後，才能進行後段封裝測試處理。

半導體晶圓薄化技術的主要應用領域為消費性電子、家電、工業產品、通訊設備、再生能源及國防軍事等，受全球節能減碳趨勢盛行、電動車市場成長及物聯網、5G 等新興行業的快速發展影響下，晶圓薄化應用領域將更加廣泛。依據工研院產科國際所(詳圖七)研究報告預估，全球功率元件市場規模從 2022 年至 2025 年的複合成長率約為 5%，故預估晶圓薄化的市場規模將日益增加。

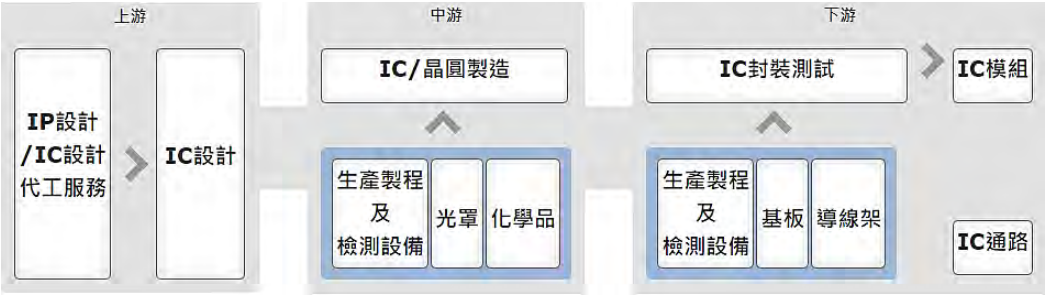
(二)行業營運風險

1. 景氣循環

該公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，係屬 IC 產業鏈的後段製程，半導體產品經由前段 IC 設計及晶圓製造後，即進入 IC 測試與封裝或晶圓薄化階段之後段製程，該公司所提供服務之產能需求與其終端產品之產業景氣息息相關。該公司主要客戶多為國內外上市櫃之 IC 設計公司，其終端應用層面廣泛，隨著半導體製程之演進，終端產品於功能及效能不斷提升，加上電源管理 IC、MOSFET 及第三代半導體市場規模預期將逐年提高之情況下，應可有效降低成熟產品之市場需求力道減緩所帶來之營運風險，且該公司建置多角化的產品組合，可有效分散景氣風險，整體而言，該公司半導體服務受景氣循環影響所面臨之營運風險應屬有限。

2. 行業上中下游變化

該公司係屬於半導體產業下游之 IC 封裝測試公司，主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，當 IC 設計公司電路設計完成，則交給中游之 IC 製造公司以電路轉換生產成晶片，最後再由下游之 IC 封裝及測試廠將製造完成之 IC 晶片進一步封裝及測試而完成最終之 IC 成品，成品再經銷售管道售予組裝代工廠商裝配生產成為最終產品，故每一生產環節皆有個別廠商投入而形成一專業分工體系。茲將該行業上、中、下游之關聯性列示如下圖：



資料來源：台灣證券交易所-產業價值鏈資訊平台

3. 行業未來發展

(1) 終端產品節能的趨勢，晶圓薄化製程逐獲重視

由於終端產品走向節能的趨勢，電子產業持續針對節能進行優化，晶圓薄化製程除了將晶圓製造後其厚度減薄，亦可幫助降低電流通過之阻值，減少功耗所產生過熱之情形，有助於提升電源轉換效率、產品品質及產品性能，且大幅度節約電能、降低能源消耗，因此晶圓薄化後之半導體產品特性優異，為提升產品競爭力之重要技術之一。

(2) 第三代半導體的高階的測試封裝解決方案需求提高

近幾年，受到電動車、新能源、5G 通訊、資料中心及低軌衛星等應用驅動及全球節能減碳趨勢盛行下，科技產品對於高頻、高效能運算及高速充電的需求上升，矽與砷化鎵由於自身的性能限制已經無法滿足現狀，故具有寬能隙的第三代半導體，如 GaN 及 SiC，便逐漸滲透高階應用市場，由於第三代半導體產品高頻率、高電壓、高電流、高功率、高硬度的特性，需要開發更多高階的測試及封裝解決方案，以滿足產品規格演進的需求，確保產品在長時間高負載下能夠穩定運行。

(3)半導體專業分工化使測試封裝需求提高

半導體業多以全球化專業分工模式進行,降低人力及其它層面的成本達到公司最大利益，IC 生產步驟已由 IDM 完全獨立包辦，逐步轉變為個別公司專業分工之合作模式，由專業 IC 設計公司、晶圓代工廠以及封裝測試業者形成一條緊密的 IC 產業鏈。隨著半導體製程的不斷精進，IDM 廠商因而將製造業務委外給專業的專業晶圓代工及封測業者,故垂直專業分工為主的 IC 設計業、晶圓製造與 IC 封測業產值比重逐漸提高，商機也越來越大。

4. 產品可替代性

近年來終端產品對精密度及功能性之要求大幅提升，半導體製程因應此趨勢不斷演進，並隨著國際知名半導體大廠紛紛轉為輕晶圓廠或無晶圓廠之營運模式，促使半導體產業專業分工精細，衍生出半導體封裝測試之商機，而該公司具有豐富的測試及封裝經驗，並自行開發出晶圓 FSM 及 BGBM 等服務，為提供客戶一站式之服務，與客戶維持長久之合作關係，客戶亦不易輕易變更合作廠商，以確保產品品質及如期交貨，故目前尚未有產品可替代之風險。

二、發行公司營運風險

(一)業務之營運風險

1. 市場未來供需情形

近期的半導體需求走向，已邁入 3 奈米的研發世代，半導體在製程的難度也陡然提升，IC 封測技術也變得日益重要。隨著半導體技術不斷發展，電晶體之架構持續推陳出新，使功率消耗和用電量成為很大的挑戰，同時晶片產生的大量熱能也會影響熱效率，因此需要在封裝測試中進行更多與更完整的測試。另因應終端產品走向節能的趨勢,電子產業持續針對節能進行優化,晶圓薄化製程除了可以有效減少晶片厚度以外，亦可幫助降低電流通過之阻值，減少功耗所產生過熱之情形，有助於提升電源轉換效率、產品品質及產品性能，且大幅度節約電能、降低能源消耗，實現半導體元件性能全面提升之目標，預期對於這些需求將持續成長。而該公司持續研發及改良製程，近幾年投入資本支出擴建廠房及添購設備，逐步建立產線，搭配卓越的工程開發能力，提供客戶更趨完整的測試、封裝與薄化服務。

由於電動車、新能源、5G 通訊、資料中心及低軌衛星等新興應用趨勢下，再加上既有電子產品對節能的需求也同步攀升，電子設備產品電能的消耗，節能減碳呼聲日增月益，因第三代半導體材料可在高頻、高壓及高溫運作環境中，擁有優異的功率轉換效率，且減少發熱與耗電問題，達到省電及延長裝置壽命的目標，故第三代半導體材料的導入將為未來廠商致力的目標。而該公司持續專注於 GaN 與 SiC 測試技術的研發，再加上與多家知名第三代半導體客戶的長期合作，將成為該公司能夠成功跨入第三代半導體測試領域的契機。

(二)該公司之市場占有率及同業間之地位

1. 市場佔有率

依據工研院產科國際所顯示(詳圖三)，我國 111 年度 IC 封測產值為新台幣 6,847 億元，該公司 111 年度營收為 12.26 億元，佔國內 IC 測試產值約為 0.18%。

2. 與同業上市公司或知名公司比較及其在同業間之地位

單位:新台幣千元

公司名稱	111 年度					
	營收淨額	成長率	資本額	稅後淨利	稅後淨利率	每股盈餘(註)
微矽電子	1,226,677	(5.09)%	646,600	168,338	13.72%	2.70
京元電子	36,781,996	8.95%	12,227,451	6,982,090	18.98%	5.49
矽格	18,694,345	12.07%	4,567,410	3,513,949	18.80%	6.68
昇陽半導體	3,138,053	18.36%	1,526,280	325,251	10.36%	2.06

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。
註：每股盈餘為基本每股盈餘

該公司主要係從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC、MOSFET 產品及以 GaN 或 SiC 為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。綜觀台灣上市半導體測試封裝公司其業務型態、產品性質及營業項目後，採以下三家公司做為採樣公司，京元電子股份有限公司（上市股票代號：2449，以下簡稱京元電子）主要營業項目為晶片研磨切割及測試封裝業務，終端應用涵蓋資訊、通訊、辦公室自動化、汽車電子以及消費性電子等相關產品；矽格股份有限公司（上市股票代號：6257，以下簡稱矽格）主要營業項目為測試封裝業務，終端應用涵蓋高效能運算、通訊、影音、消費性電子以及車用電子等相關產品；昇陽國際半導體股份有限公司（上市股票代號：8028，以下簡稱昇陽半導體）主要營業項目為晶圓再生服務及晶圓薄化製程服務，終端應用涵蓋消費性電子、工業用電子產品及汽車等電子元件。

該公司與採樣公司相較，主係各公司之產品服務組合及終端市場略有不同，營收淨額與成長率低於採樣公司，而稅後淨利率及每股盈餘與採樣公司相較互有高低。該公司成立至今多年不斷耕耘本業之發展，另積極進行廠房擴建以因應第三代半導體市場之高速成長需求。

3. 影響該公司未來發展之有利、不利因素及其相關因應對策

該公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，茲就其未來發展之有利與不利因素說明如下：

(1) 有利因素

① 國內半導體專業分工完整

台灣半導體產業體系分工完整，隨著 5G、高效能運算、物聯網等

趨勢擴大及製程技術的快速演進，晶圓代工廠、測試廠與封裝廠，各自不斷進行擴產及提高生產技術，持續強化 IC 製造國際競爭力之領先優勢，藉由晶圓代工廠、測試廠與封裝廠日趨專業與經濟規模，能提供專業 IC 設計公司先進的技術與製程、彈性靈活的生產調度、世界級的服務品質與快速的應變能力等優質之後勤支援，可提供高品質且具有國際競爭力的產品，對未來發展將是一大利基。

② 產品終端應用市場未來將持續成長

該公司產品終端應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件，112 年度雖消費性電子產品相關市場成長放緩，惟需求仍是最高，而手持式行動裝置等消費性電子產品不斷追求輕、薄、短、小及低功耗之特性，故對晶圓之特殊製程要求越來越多;隨著 5G、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件快速發展及全球低碳排放的共識下，而第三代半導體材料具有寬能隙、高熱導率、高擊穿電場、高電子遷移率等特性，可大幅提升效率、減少耗電量及縮小體積，故依據市場研究機構集邦圖八及圖九，預期未來將被廣泛應用。

③ 客戶導向之服務策略

該公司除在產品品質、交期、良率均能滿足客戶之需求外，多年來持續因應客戶新產品測試封裝之需求，精進測試封裝研發技術及測試機台改機設計之優化，建構多角化的產品組合，可同時提供晶圓測試、成品測試、探針卡製造、晶圓 FSM、晶圓 BGBM、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，降低產品來回運送成本與風險、縮短交期，並與 IC 設計公司維持良好互動關係，隨時掌握市場脈動與客戶共同成長。

④ 產業進入障礙較高

測試封裝的品質仰賴測試程式及機台軟硬體之配合，暨測試機台零件使用的適當性及設備參數的調整，在在考驗測試封裝人員的經驗及管理團隊長久的默契，該公司因應市場趨勢及配合客戶產品開發，因此當客戶在特定專業測試封裝廠擁有穩定的品質時，較不容易將該產品轉換至其他專業測試封裝廠生產，測試及封裝費用雖佔 IC 的成本比重不高，但假若發生品質問題將導致產品的全面回收，致 IC 設計公司既有產品更換封測廠的意願不高，另該公司專注於電源管理 IC 與功率元件之測試封裝，累積多年的專業的產製經驗，與客戶建立長期的合作關係，對於後來才加入 IC 封測市場之同業更具競爭利基。

(2) 不利因素及因應對策

① 半導體市場景氣波動，影響公司營運

測試封裝廠屬於半導體產業供應鏈後段製程，因此仍受半導體景氣循環影響。

<u>因應對策：</u>

因應半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司持續研發，與客

戶建立長期的合作關係，提供客戶高附加價值之代工服務。隨高效能運算、5G、物聯網和車用電子等市場持續擴大，該公司之客戶已於各類產品進行佈局，以降低已成熟產品之市場需求力道減弱所帶來之營運風險，未來該公司持續與客戶配合，搭配該公司各項代工製程及機台改良技術，強化品質、成本、交期的優勢，以因應市場快速變化及同業之競爭。

②研發人員流失之風險

隨著半導體產業不斷的發展，具經驗之技術開發及研發人才的爭取日漸困難，且需要長時間培養及訓練，故具經驗之研發人才常成為他公司招攬之對象。

因應對策：

該公司透過技術人員之技術傳承、實作經驗分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術開發及研發人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的研發團隊。此外，提供良好的工作環境，並建立制度化的員工福利措施，以增進員工之向心力。對於研發人員均要求簽訂保密合約，且對於所研發之技術做適當之資料保存，以預防研發人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。另該公司積極推動上市，藉以提高公司知名度，吸引優秀人才，並可透過發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及員工酬勞等工具，將公司經營成果與員工共享，以提高員工之向心力。

③中國半導體產業之競爭風險

近年來中國半導體業力求提高自給率，並在政策上大力支持下，將成為中國半導體封測公司步入快速發展的有效驅動力，對我國半導體產業形成競爭壓力。

因應對策：

該公司以強化新產品的研究發展計畫及提供精進之測試封裝服務能力，以品質、交期、效率與彈性的服務內容，與中國大陸廠商形成區隔，獲取更多台灣及國外客戶長期合作的機會。

4. 公司競爭利基

(1)擁有豐富經驗及專業能力之經營團隊

該公司經營團隊均已於業界服務多年，對產業環境變化、產品發展趨勢、生產製造及行銷業務等各方面具嫻熟經驗，可迅速掌握市場趨勢脈動，提供最佳測試封裝服務，並協助客戶新產品快速的導入與量產，對該公司現有開發具有相當助益。

(2)優秀的研發團隊，提升市場競爭力

該公司熟悉材料與元件特性，搭配專業的研發團隊，並以累積多年之經驗，除可自行開發探針卡及製程技術外，該公司與國內晶圓代工廠有共同開發合作，亦可提前在新產品應用在技術上佈局，為客戶建立新型態之供應鏈及價值鏈服務，並致力於提高產品良率及降低成本，深得半導體客

戶認可，為該公司未來市場競爭的優勢之一。

(3)與客戶建立長期的合作關係

該公司工程技術團隊提供客戶一貫化整合性服務,可同時提供晶圓測試、成品測試、晶圓 FSM、晶圓 BGBM、晶圓切割及晶粒挑揀等服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險，並提供客戶最佳解決方案，保持良好的合作默契，與客戶建立長久合作關係。

(4)強化製程管理與提升產能利用率

產能利用率之高低直接影響公司獲利，而產能利用率取決於製程良率、成本及交期，該公司在半導體封測領域深耕多年，累積多年之經驗及技術能量，致力於產品品質之提升，亦深獲客戶信賴。此外該公司亦強化管理控管生產成本，在技術與先進測試技術上持續進行精進與改良，以增加產品價格之競爭力，使產能得到充分且穩定的利用。

(5)產線自動化

除了製程技術外，該公司擁有優良的 IT 系統能力，除了維持原有的高品質測試封裝服務之外，還可進一步提高生產效率與降低人力成本，於大量生產之下客戶端將有競價的空間，也更有助於業務推展。

(二) 技術能力、研發及專利權之營運風險

1. 取得技術專家之評估意見佐證

本證券承銷商與該公司並未委請技術專家就該公司之技術研發能力出具意見或報告，故不適用。

2. 研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，以了解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對申請公司之營運風險。

(1)研發部門之沿革及組織

該公司自民國 76 年成立以來，深耕半導體封測產業多年，研發團隊具備測試及封裝產業專業背景及豐富相關經驗，擁有優秀的研發專業人才，茲將各研發單位之工作職掌列示如下:

部　　門	工作內容
研發一部 (測試)	• 客戶新產品開發及評估作業 • 產品測試良率/穩定性分析改善計畫之擬定與執行 • 協助生產線技術提昇及測試能力改善之需求
研發二部 (封裝及晶圓薄化)	• 新產品技術及導入之效益評估 • 新製程研發 • 製程改善

(2) 分析研發部門人員之人數、學經歷、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對申請公司之營運風險

單位：人數、%

年　　度		110 年度	111 年度	112 年 9 月 30 日
員工人數	期初人數	50	60	56
	本期新進	12	3	2
	本期離職	0	7	4
	退休及資遣	2	0	0
	部門轉調	0	0	4
	期末人數	60	56	58
平均服務年資		6.24	7.27	7.61
離職率(%)(註)		3.23	11.11	6.45
學歷分布	博　　士	0	0	0
	碩　　士	1	1	3
	大　　專	51	48	49
	高中(職)以下	8	7	6
合計		60	56	58

資料來源：該公司提供

註：離職率=離職人數（含資遣及退休人員）/（期末人數+離職人數）

該公司最近二個會計年度及 112 年 9 月 30 日止之研發人員分別為 60 人、56 人及 58 人，平均服務年資分別為 6.24 年、7.27 年及 7.61 年，多為相關系所畢業或具有相關產業經驗，並專注於積體電路相關製程之改良及研發，顯示該公司對研發人員之重視。

在研發人員流動情形方面，該公司最近二會計年度及 112 年 9 月 30 日止，離職率分別為 3.23%、11.11%及 6.45%，離職人員為基層研發人員，其離職原因主要為個人生涯規劃。該公司訂有研發管理相關內部控制作業，以保護公司產品研發成果及生產技術，並落實交接制度，以利經驗傳承及工作銜接，故研發人員流動對該公司核心研發人力、研發部門之運作及公司營運尚不致產生重大之影響。

(3)最近二個會計年度及申請年度截至最近期止研發費用占營業收入之情形

單位：新台幣千元

項目＼年度	110 年度	111 年度	112 年前二季
研發費用(A)	64,391	69,578	31,921
營業收入淨額(B)	1,292,379	1,226,677	384,383
占營業收入淨額比率(A)/(B)	4.98%	5.67%	8.30%

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之研發費用分別為 64,391 千元、69,578 千元及 31,921 千元，研發費用占營業收入比率分別為 4.98%、5.67%及 8.30%。該公司研發費用主要係隨研發人員薪資、獎金及研發設備折舊增減而變化，其中 111 年度較 110 年度增加係因該公司隨營運之發

展，添購設備進行新產品之開發並對現有產線優化以提升效能所致；112 年前二季受全球整體經濟環境不穩定、終端市場需求趨緩，且半導體庫存較高影響，致營業收入減少，使研發費用佔比提高，經評估其變動情形尚屬合理。最近二個會計年度及 112 年前二季研發費用之變動情形尚無重大異常之情事。

(4) 重要研究成果

該公司致力於新產品之研發，並針對市場需求進行設計與研究，持續深耕自有核心技術。茲將該公司最近三年度之重要研發成果及相關內容列示如下：

年度	研發成果	內容說明
109	● 載板技術開發	● 產品薄化程度的要求，造成自動化產線效率下降，透過載板的技術導入，讓自動化產線生產效率提高，產品良率也獲得提升。
	● 厚金屬鍍膜、切割、挑揀	● 隨著金屬層增加對於既有機台的架構已構成嚴格挑戰，目前已透過治工具調整和材料參數搭配，已成功導入量產。
	● Taiko 晶片製程設備機構設計開發	● 因應特殊晶片加工製程，進行設備測試改機設計與量產研發，確保提早佈局特殊製程產品的代工能力。
110	● 濺鍍技術開發	● 車載產品需求上升，對於品質要求也更加嚴苛，透過濺鍍達到薄膜高可靠度要求，成功導入車用產品量產。
	● 特殊氣流控制機構研發	● 特殊材料產品生產良率之改善專有技術開發。
	● 超薄片測試載台升級	● 因應超薄片之規格變更，解決產品生產之製程變異的風險，變更設計。
111	● 12 吋晶片薄化技術	● 透過治工具、材料、改機實現 12 吋超薄片生產。
	● Laser Ink 製程設計與設備開發	● 替代原先的晶圓 Ink 墨液標示技術，採用 Laser 技術取代，提高生產速度約四倍，並可克服 Ink 漏打、小墨跡噴濺、墨液延流等問題。
	● GaN 產品測試之高壓突波抑制技術開發與套件設計	● GaN 材料特性會造成測試過程產生高壓突波，間接造成產品的損壞，透過技術的研發與套件可完全防範與抑制突波的問題。
112 年前二季	● 高溫高壓高電流特規探針卡自製技術	● 已開發完成 175 度高溫探針卡、1700V 高壓探針卡、60A 高電流探針卡，探針卡自製率高達 95%，將持續投入研發能量在特殊運用的高壓高溫高電流探針卡。

年度	研發成果	內容說明
	● 1200V 50A 高電壓高電流碳化矽(SiC)功率元件測試技術 ● 濺鍍技術開發	● 已開發完成 1200V 高壓碳化矽(SiC) MOSFET 測試技術，測試電流可高達 50A，可有效防治高壓電弧，避免產品損壞，並得到精準的測試數據。 ● 透過參數調整達到均勻鍍膜並達成 1000 小時之高溫高濕車規產品可靠度驗證，且透過治具的優化達到高翹曲（≧5mm）產品之量產。

資料來源：該公司提供

3. 技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司主要技術來源係來自研發團隊之專業以及經驗累積之結果，持續與產業上下游進行交流，以了解客戶需求之產品進行研發及設計。截至目前為止，並未有向外部取得技術來源及支付技術報酬金或權利金之情事。

4. 未來研發計畫暨研發工作未來發展方向

該公司計畫為提升良率及降低成本，並隨時注意 IC 產業發展趨勢，朝向高附加價值產品發展，持續研發關鍵性技術，尋求國內外晶圓製造及半導體設計之上下游合作，以搶得市場發展先機。以下為未來研發工作發展方向說明：

研發項目	主要內容及功能	應用產品
晶圓正面金屬化製程	搭配產品封裝改善產品阻值	MOSFET
12 吋晶圓濺鍍技術	將濺鍍技術從原本 8 吋擴大到 12 吋	MOSFET
碳化矽(SiC)產品之晶圓薄化製程	硬脆材料薄化技術	SiC
50um 超薄晶圓之晶圓切割、晶粒挑揀	特殊參數設定和材料使用搭配來實現超薄晶圓穩定生產	MOSFET
晶圓之超厚金屬鍍膜技術	降低產品導通電阻，並改善散熱	MOSFET
厚金屬功率元件之晶圓切割、晶粒挑揀	特殊參數設定和材料使用搭配來實現超薄晶圓穩定生產	MOSFET
高翹曲晶圓之雷射刻印	特殊治具設計讓製程能力提升。	MOSFET
超薄晶圓測試技術	生產技術能力升級	節能低功耗元件
厚金屬鍍膜高翹曲晶圓測試技術	生產技術能力升級	節能低功耗元件
3KV 高壓/高電流功率元件測試技術	除與設備商合作開發對應測試設備外，內部需進行搭配設備的改機與抗高壓研發	第三代半導體 GaN/SiC 中高功率應用需求(車用)
高功率氮化鎵(GaN)功率元件測試技術	測試與驗證方法的開發。	5G 通訊/快充/車用
氮化鎵(GaN)RF 元件測	測試與驗證方法的開發。	5G 通訊/車用

研發項目	主要內容及功能	應用產品
試技術		
碳化矽(SiC)功率元件測試技術	除與設備商合作開發對應測試設備外，內部需進行搭配設備的改機與抗高壓研發	車用快速充電
雷射 In 刻印技術	使用雷射進行晶圓異常品標記，取代現行油墨打印方式，改善材料與加工過程的異常與生產效率提升	晶圓異常品標記
高溫高壓特規探針卡自製技術	高壓高溫製程電弧抑制與漏電抑制的測試方法設計與製作技術	GaN/SiC 特殊材料、車用產品

5. 目前已登記或取得專利權、商標權及著作權之情形，有無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事，暨因應措施是否合理有效

截至評估報告出具日止，該公司無取得或申請中之專利權及著作權，已註冊商標權共計 1 件。經查閱該公司往來文件及參閱經陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司最近二個會計年度及申請年度截至目前為止尚無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事。茲就該公司商標權列示如下：

該公司截至目前為止，已取得之商標權共 1 件，並無涉及違反商標權之情事，該公司商標權之註冊內容及權利期間列示如下：

項次	名　　稱	申請國	商標註冊號	權利期間	
				起	訖
01	silicon 及 U 設計圖 μSilicon	中華民國	02060521	109/05/16	119/05/15

資料來源：該公司提供。

6. 屬科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，應說明其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計畫、預計生產時程及成本、市場定位、需求及未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

該公司非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，故不適用。

7. 屬科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，取得參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近三個會計年度及申請年度內股權轉移變化暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形等，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響，及其因應措施

該公司非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，故不適用。

8. 以創新板上市者，就其創新特點及營運模式，因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施

(1) 關鍵核心技術：

該公司早在民國 90 年即切入電源管理 IC 測試領域，並於民國 95 年進一步切入 MOSFET 測試領域，一路發展至今，已建立深厚的技術能力，相關的測試電路、測試程式、測試介面、探針卡等皆自行研發製作，本身具備設備改機的能力，以及治具及配件設計與製造的能力。還具備多項先進的技術能力，包含高壓產品多顆共測技術、50um 超薄晶圓測試技術、高翹曲晶圓測試技術、高壓探針卡製作技術、高電流探針卡製作技術、高壓測試技術、高壓測試電弧防治技術、高壓測試突波抑制技術、高電流測試技術、1mΩ 以下超低導通電阻測試技術、175°C 高溫測試技術、-55°C 低溫測試技術、Taiko 晶圓測試技術、Support Ring 晶圓測試技術、12 吋 MOSFET 測試技術、切割後 on frame 晶圓測試技術、晶圓雷射切斷電壓調整技術、晶圓雷射標記技術等。

第三代半導體與 MOSFET 同屬功率元件，該公司以 MOSFET 測試方面深厚的技術能力為基礎，領先市場投入第三代半導體氮化鎵與碳化矽測試技術的研發，再加上與多家知名第三代半導體客戶的長期合作，成為該公司能夠成功跨入第三代半導體測試領域的契機。

由於第三代半導體材料特性的原因，導致第三代半導體晶圓在長晶、磊晶與元件製造的過程中更容易出現製程缺陷，因此，如何透過優異的測試技術，正確的篩選出功能正常的產品至關重要，以確保產品在終端應用時不會出現問題，也因此凸顯了第三代半導體晶圓測試的重要性。由於第三代半導體材料特性不易掌握，且高溫、高壓、高流、低電阻與低漏電等測試條件都極具挑戰，因此需要大量累積工程與量產經驗並與客戶不斷地合作驗證，才能精準的測試分析產品特性，並提供客戶更有價值的建議，該公司具備第三代半導體材料特性分析與高壓波型分析能力，可有效提高客戶異常分析處理的時效，第三代半導體因產品的驗證時間長，測試技術門檻高，藉由與晶圓廠之協同開發，亦使該公司之研發團隊及測試部門能即時的反饋客戶在晶圓測試發現之問題，並協助客戶提升製程的良率。

第三代半導體材料具有高硬度、高脆性與易斷裂的特性，造成第三代半導體晶圓薄化與晶圓切割製程的高度挑戰，該公司投入晶圓研磨與晶圓切割領域迄今已有超過 30 餘年生產經驗，在此期間持續投入研發能量，精進製程技術，並於 107 年成功跨入第三代半導體晶圓薄化領域，已具備多項先進的技術能力，包含晶圓正面圖形化金屬鍍膜技術、無光罩雷射曝光顯影技術、晶圓薄化載板製程技術、晶圓背面厚金屬鍍膜技術、厚金屬鍍膜晶圓雷射切割技術、晶圓雷射開槽切割技術、12 吋晶圓薄化與切割技術、50um 超薄晶圓薄化與切割技術、矽基板氮化鎵(GaN-on-Si)晶圓薄化與切割技術、QST 基板氮化鎵(GaN-on-QST)晶圓薄化與切割技術、碳

化矽晶圓薄化與切割技術、40um 超窄切割道晶圓切割技術、Taiko 晶圓切割技術等。

(2)創新能力及創新營運模式：

功率元件因其產品特性與封裝應用緣故，需要晶圓薄化製程(晶圓正面金屬鍍膜、晶圓背面研磨及金屬鍍膜)，以達到低導通電阻、低功耗與節能的要求，晶圓正面金屬鍍膜、晶圓背面研磨及金屬鍍膜所需之金屬濺鍍、光阻塗佈、曝光、顯影、蝕刻、光阻去除、晶背研磨、金屬蒸鍍等製程，生產型態與半導體後段測試封裝有所不同，較為接近半導體前段晶圓製造的生產型態，可以視為功率半導體的中段製程，串聯半導體前段晶圓製造與半導體後段測試封裝。有別於其他半導體測試封裝廠，該公司已從半導體後段製程跨入半導體中段製程，提供功率半導體從中段到後段的一貫化整合性服務，讓客戶可以一站購足，幫助客戶有效縮短交期、提高良率、降低成本。

該公司因應市場趨勢及配合客戶產品開發需求，本身具備設備改機的能力，以及治具及配件設計與製造的能力。例如自行設計改機，以達到超薄晶圓處理、高蹺曲晶圓處理、高壓電弧防治、超低導通電阻量測、高溫測試、高精準溫控等，另外，廠內還可自製探針卡，達到工程測試與量產測試更高的自主性及時效性，可以更快速精準的將工程驗證與量產的結果回饋給客戶，加速客戶產品開發的速度，並且降低生產成本，創造客戶與該公司的雙贏。

該公司透過關鍵核心技術、創新能力及創新營運模式，經過長時間的研發以及與客戶合作驗證下，已成為第三代半導體 IC 設計公司、IDM 廠與晶圓廠的最佳合作伙伴，且通過與客戶合作驗證後所產生之競爭優勢不易被其他測試封裝廠取代，因此該公司亦積極進行廠房擴建以因應第三代半導體市場之高速成長需求。以下就可能導致風險暨所採行之因應措施分述如下：

A. 半導體市場景氣波動，增加測試封裝廠之經營風險

在 IC 產業生產體系中，IC 測試封裝位於製程的後段，為 IC 出貨前必經步驟，故受半導體市場景氣波動影響甚巨，若供需情況稍有失衡，即導致晶片價格大幅波動，影響半導體測試封裝業之獲利。

因應對策:

該公司積極調配機台及縮短執行時間，並提供晶圓製造廠商及 IC 設計公司迅速且準確之服務，以吸引客戶持續下單，於產能擴產方面，係採穩健投資之方式，避免因機器設備產能不足而失去市場機會，或因設備擴充過速而造成閒置，增加經營風險。

B. 技術人才流失之風險

測試封裝為技術密集產業，隨著半導體產業不斷的發展，國內外半導體公司對人才之需求增加，故具經驗之技術人員常成為競爭對手招攬之對象，形成人才流失之風險。

因應對策:

該公司透過資深技術人員之技術傳承、實作傳承分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的技術團隊。此外，提供良好的工作環境，並建立制度化的員工福利獎酬辦法，以增進員工之向心力。對於技術人員均要求簽訂保密合約，且對相關技術做適當之資料保存，以預防人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。

C. IC 產業前景看好，將有更多競爭者加入

該公司所屬產業為半導體上下游關注的焦點，前段及後段的半導體廠商皆想跨入相關製程。

因應對策:

該公司之客戶多為知名半導體廠商，透過與客戶開發，建立合作默契，並可掌握終端需求調整製程技術。該公司已累積多年經驗，並提供一站式測試封裝服務，未來將不斷提升技術，拉開與同業之市場區隔，以確保公司之競爭力。

9. 以創新板上市者，就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施加以評估

(1) 產品生產開發技術之層次、來源、確保(專利權及所受法律保護狀況與提升

A. 產品生產開發技術之層次

該公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，為國內具有獨特競爭力之半導體專業測試封裝公司，擁有專業及經驗豐富之研發團隊，透過多年來在半導體測試技術的研發、驗證及生產的經驗，已建立測試電路、測試程式、測試介面、探針卡等深厚的製作技術能力，此外亦具備設備改機、治具及配件設計與製造的能力。並投入第三代半導體 GaN 與 SiC 測試技術研發多年，再加上與多家知名第三代半導體客戶的長期合作，成為該公司能夠成功跨入三代半導體測試領域的契機。

該公司可同時提供晶圓測試、成品測試、探針卡製造、晶圓 FSM、晶圓 BGBM、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品生產成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，具備功率半導體中後段製程開發能力之公司。

B. 產品生產開發技術之來源

該公司之技術來源皆為自行研發，該公司自設立後持續提升研發能量，持續精進晶圓測試、晶片測試、探針卡製造、晶圓 FSM、晶圓

BGBM、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等製程，自市場企劃、治具開發、實驗設計、材料開發、參數調校、工程驗證、製程優化等均由該公司經營團隊及其研發團隊所完成。

C. 技術之確保與提升

該公司針對核心技術持續深化研發能力，重要研發成果均已列為公司營業秘密完善保存，嚴格控管該公司研發團隊人員之存取權限，以確保資料之完整性及機密性，藉以控管及保護該公司重要核心技術。對於技術人員均要求簽訂保密合約，且對相關技術做適當之資料保存，以預防人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。另外，該公司透過資深技術人員之技術傳承、實作傳承分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的技術團隊，藉以確保核心技術持續提升。

(2) 現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究發展計劃

A. 現在主要產品之競爭優勢

該公司在 90 年即切入電源管理 IC 測試領域，並於 95 年進一步切入 MOSFET 測試領域，一路發展至今，已建立深厚的技術能力，相關的測試電路、測試程式、測試介面、探針卡等皆自行研發製作，本身具備設備改機的能力，以及治具及配件設計與製造的能力。並投入第三代半導體 GaN 與 SiC 測試技術的研發多年，再加上與多家知名第三代半導體客戶的長期合作，成為該公司能夠成功跨入第三代半導體測試領域的契機，且通過與客戶合作驗證後所產生之競爭優勢不易被其他測試廠取代。該公司投入晶圓研磨與晶圓切割領域迄今已有超過 30 餘年生產經驗，在此期間持續投入研發能量，精進製程技術，並於 107 年成功跨入第三代半導體晶圓薄化領域，已具備多項先進的技術能力。該公司可同時提供晶圓測試、晶片測試、探針卡製造、晶圓 FSM、晶圓 BGBM、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，成為該公司爭取客戶合作並與客戶建立長期合作夥伴關係的競爭利基。

B. 現在主要產品之生命週期及持續發展性

該公司主要從事功率半導體的測試、封裝與晶圓薄化服務，為確保功率半導體功能、速度、公差、電力消耗及熱力發散等屬性符合訂定之標準，故不論是測試、封裝或晶圓薄化，皆屬於半導體製造中不可或缺之重要生產流程，因其製程需精通半導體元件物理、製程與電路設計，技術開發人員的養成亦須經長期之培養，再加上產品認證期長，需歷經繁瑣的調整及專用製程驗證，具有一定的進入障礙，其技術具有累積性，故其產品生命週期較其他 IC 產品長，且隨著半導體應

用的持續發展，各項新興產業如電動車、充電樁、高效能運算、AI 伺服器、資料中心、再生能源等，都需要高效能的電源轉換做後盾，預期功率半導體與第三代半導體的應用領域將會持續擴散，市場需求也將持續增加，有利該公司業務的持續發展。

C. 新產品之研究發展計劃

該公司成立迄今，持續投入研發能量，精進製程技術，未來的研究發展方向將以節能為發展核心，專注於可提升能源轉換效率的功率元件與電源管理 IC，研發更加先進的半導體測試、半導體封裝與晶圓薄化製程，朝向更高電壓、電流、功率、溫度、速度及更低電阻與更薄厚度的方向發展。該公司因應市場趨勢及配合客戶產品開發，持續研發與改良測試技術、探針卡及治具等以提高生產良率及提供更多服務項目，未來研發計畫包含研究開發及改良高功率 GaN 功率元件測試技術、高功率 SiC 功率元件測試技術、晶圓 FSM 技術、晶圓 BGBM 技術等。該公司透過研發經費及專業技術人才的投入，持續創新及改良製程，擴大整體效益，進而提升該公司競爭優勢。

(3) 新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

A. 新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性

新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
厚金屬(≧15um)鍍膜技術	113年	鋰電池保護電路MOSFET功率元件	搭配產線特殊的治具改良及製程調整，達成高均勻度之厚金屬膜之鍍膜。以往在厚金屬膜鍍膜完成後會遇到強烈的晶片翹曲，造成後續加工困難，透過自行研發之治具，可以讓風險極小化且不需要額外高成本的設備投資，進而達到成本控制和大規模生產之優勢。
超薄晶圓(<50um)載板技術	113年	低功耗MOSFET功率元件	由於市場應用的進步，對於產品電性表現和封裝尺寸更加要求，更凸顯薄化之重要性，透過穩定的薄化過程可以降低MOSFET之導通電阻，進而達到高效率之目的，但在其薄化過程中，由於晶片厚度已低於可支撐晶片應力的厚度，進而產生翹曲造成各站點加工困難，影響良率。透過載板的導入下，晶片由於載板的支撐，不再有翹曲產生，可使用既有機台自動安全執行作業，不需要額外投資昂貴設備，進而達到可量產且低成本的生產競爭優勢。
晶圓正面金屬鍍膜(FSM)技術	113年	高功率MOSFET、GaN、SiC功率元件	由於高功率功率元件需要承受更大的電流，要求更低的功率耗損，因此必須使用銅夾封裝，以加大電流路徑，降低導通電阻，所以需要在產品正面焊墊處進行金屬鍍膜，形成焊墊與銅

新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
			夾之間的焊接表面，由於需要進行圖形化的金屬鍍膜，因此製程難度相對較高，需要經過長時間的研發，以達到產品穩定生產。
GaN雷射開槽技術	113年	GaN功率元件	由於GaN磊晶層與基板之間存在異質結合接面，成為晶圓切割時的脆弱點，在晶圓切割時，容易在此接面造成晶粒側裂，影響產品品質，因此透過雷射開槽技術，將切割道上的GaN磊晶層移除，再進行晶圓切割，此時切割刀就不會碰觸到此接面，可有效提高晶圓切割品質。
QST基板氮化鎵(GaN-on-QST)晶圓之薄化、切割、挑揀	113年	GaN功率元件	QST有著極高的硬度，QST基板氮化鎵（GaN-on-QST）晶圓的研磨與切割，有著極大的挑戰，生產過程與傳統矽晶圓的製程有相當大的區別，需要經過長時間的研發以及和客戶間的密切合作，透過生產製程參數和材料的優化，以達到產品穩定生產。
SiC晶圓之薄化、切割、挑揀	113年	SiC功率元件	SiC有著極高的硬度，SiC晶圓的研磨與切割，有著極大的挑戰，生產過程與傳統矽晶圓的製程有相當大的區別，需要經過長時間的研發以及和客戶間的密切合作，透過生產製程參數和材料的優化，以達到產品穩定生產。
超薄晶圓測試技術	113年	低功耗MOSFET功率元件	目前功率元件為追求更低的耗能，晶片的厚度規格不斷的薄化，遠遠超過設備的初始設計技術能力，透過研發團隊持續針對客戶的產品變更投入機構的設計。
更高電壓更高電流MOSFET功率元件之測試技術	113年	高功率MOSFET功率元件	高功率MOSFET的需求因工業用產品應用而大幅提高，此類產品在晶圓測試上有其先天性的測試限制，透過製程機構設計、特殊配件設計與測試電路設計可大幅度的提高可測試規格的限制，提供客戶更完整的測試服務與更優化的測試良率。
更高電壓更高電流GaN功率元件之測試技術	113年	高功率GaN功率元件	高功率GaN的需求因工業用產品應用而大幅提高，此類產品在晶圓測試上有其先天性的測試限制，透過製程機構設計、特殊配件設計與測試電路設計可大幅度的提高可測試規格的限制，提供客戶更完整的測試服務與更優化的測試良率。
更高電壓更高電流SiC功率元件之測試技術	113年	高功率SiC功率元件	高功率SiC的需求因車用產品應用而大幅提高，此類產品在晶圓測試上有其先天性的測試限制，透過製程機構設計、特殊配件設計與測試電路設計可大幅度的提高可測試規格的限

新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
			制,提供客戶更完整的測試服務與更優化的測試良率。

資料來源:該公司提供

該公司所研發之測試及晶圓薄化技術,主要係因應客戶產品需求,或因第三代半導體市場材料特性而需開發之相關技術,故隨著半導體市場之成長,預期新開發之技術,將為該公司營收帶來挹注。

B. 研究發展之內部控制暨保全措施

該公司已於內部控制制度中研發循環訂有相關作業予以規範,包括客戶需求收集、客戶需求評估、製程開發與驗證、試生產及量產,以利研發循環之執行,並確保公司研發作業品質及管理落實,研發工作均已建立文件保存及管理制度,以提升後續之產品品質及縮短研發時間,有效達成研發的延續。

在研究發展之保全措施方面,除限制員工的權限,控制員工對技術文件和資料的訪問和使用權限,研發人員均要求簽訂保密合約,確保機密信息不被洩露,且對於所研發之技術做適當之資料保存,以預防研發人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。

10. 以創新板上市者,其參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷(工作經驗、教育背景及職位年資)、持股比例、最近二個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形,並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

(1) 參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東,以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例、實際投入經營之時間與情形

112年8月15日;單位:人;股;%

職　稱	姓　名	最高學歷	主要經歷	職位年資	持股比例
董事長	大日月投資有限公司	—	—	—	22.89%
	張秉堂	臺灣大學國際企業管理系碩士	工研院電子所/封測課長 巨大電子(股)公司/董事長 新能科技(股)公司/董事長	36	8.45%
董事	辰真投資有限公司	—	—	—	1.89%
	張辰	美國波士頓大學國際貿易系碩士	—	5	1.36%

職　　稱	姓　　名	最高學歷	主要經歷	職位年資	持股比例
董事	彭盈光	中原大學工業與工程學系學士	工研院電子所/品質管理課長 台灣積體電路(股)公司/品質管理副處長 謙誠商務股份有限公司/負責人 新竹高爾夫俱樂部(股)公司/董事	24	1.83%
董事	張蔚誠	政治大學會計系學士	大師聯合會計師事務所/合夥會計師 聯華食品工業(股)公司/獨立董事	2	—
董事	楊式蘭	臺灣大學財務金融所碩士	大昌證券股份有限公司/副總經理	0.3	—
獨立董事	張居興	臺灣大學財務金融所碩士	中國信託商業銀行/副總經理 中信票券金融公司/副總經理	2	—
獨立董事	溫萬壽	交通大學電子物理系學士	豐達科技(股)公司/獨立董事 華邦電子(股)公司/執行副總經理 瀚宇彩晶(股)公司/執行長	2	—
獨立董事	彭俊豪	成功大學企業管理系碩士	元大創業投資(股)公司/總經理 元大壹創業投資(股)公司/法人董事代表人 生華創業投資(股)公司/法人董事代表人 生源創業投資(股)公司/法人董事代表人 華陸創業投資(股)公司/法人董事代表人	2	—
獨立董事	譚仲民	臺灣大學商學碩士	力晶積成電子製造股份有限公司/副總經理 世成科技(股)公司/董事 智仁科技開發(股)公司/監察人 檀雅投資有限公司/董事	0.3	—
副總	王志成	臺灣大學國際企業管理系碩士 臺灣海洋大學電機工程所碩士	新能科技(股)公司/副總經理	20	0.57%
協理	曾雄亮	健行科技大學電子通訊系副學士	台灣星電(股)公司/技術員 工研院電子所/高級技術員	36	4.76%
協理	林坤田	勤益科技大學電子學系學士	信業科技(股)公司/業務工程師 原僑電子(股)公司/助理工程師	23	0.63%
持股 5%以上之股東	鄭羅玉嬌	— (註)	— (註)	— (註)	5.23%

資料來源：該公司提供
註：未參與公司之經營決策。

(2) 參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術開發經理人等，最近二個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形

單位：仟股

職　　稱	姓名	109年底	110年底		111年底		112年截至8月15日止	
		期末股數	增(減)股數	股數	增(減)股數	股數	增(減)股數	股數
董事長	大日月投資有限公司	14,798,896	-	-	-	-	-	-
	張秉堂	5,932,182	(250,000)	5,682,182	(220,000)	5,462,182	-	-
董事	辰謙投資有限公司(註)	1,288,495	-	-	-	-	-	-
	張辰	2,040,148	-	-	(1,160,000)	880,148	-	-

職　　稱	姓名	109年底	110年底		111年底		112年截至8月15日止	
		期末股數	增(減)股數	股數	增(減)股數	股數	增(減)股數	股數
董事	辰真投資有限公司	-	-	-	1,225,000	1,225,000	-	-
	張辰	2,040,148	-	-	(1,160,000)	880,148	-	-
董事	彭盈光	1,185,090	-	-	-	-	-	-
董事	張蔚誠	-	-	-	-	-	-	-
董事	楊式蘭	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	張居興	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	溫萬壽	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	彭俊豪	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	譚仲民	-	-	-	-	-	-	-
副總	王志成	370,000	-	-	-	-	-	-
協理	曾雄亮	3,025,881	53,701	3,079,582	-	-	-	-
協理	林坤田	410,000-	-	-	-	-	-	-
持股5%以上之股東	鄭羅玉嬌	3,420,449	-	-	(40,000)	3,380,449	-	-

資料來源:該公司提供

註：辰謙投資股份有限公司於111年8月2日股東臨時會董事改選後解任。

(3) 參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等，未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

該公司董事具備業務發展所需之產業或財務經驗，可透過董事會運作對該公司經營策略提供合適建議，並無單一董事或集團控制該公司財務業務運作。而該公司之核心團隊累積多年產品開發及技術經驗，並非由單一人所完全掌握或任一獨立人員之成就，故無技術集中於特定人士之情事，因此即便上述董事或經理人未來不繼續參與公司經營，然因公司重大決策與營運方針係由董事會決議，致使公司之治理仍能有效實施；另針對研發工作之延續，該公司訂有文件保存及管理制度，使各項研發技術得以保留於公司內部，為日後追蹤與改善之依據；此外，該公司透過技術人員之技術傳承、實作經驗分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術開發及研發人員培育機制。此外，提供良好的工作環境，並建立制度化的員工福利獎酬辦法，以吸引優秀人才加入公司團隊，強化研發人員開發實力。該公司更持續加強員工之向心力，應能有效降低上述人員異動對公司財務業務之影響。

11. 以創新板上市者，屬生技醫療業者，應就其核心產品之臨床試驗進度加以評估

該公司非屬生技醫療業者創新板上市者，故不適用此項評估。

(三)人力資源之營運風險

1. 員工總人數、離職人數、遣散或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資

單位：人；年；歲

人數/年度		110 年度	111 年度	112 年 9 月 30 日
期初員工人數		545	564	565
本期新進人數		175	201	101
離職人員	經理人	—	—	—
	一般員工	47	78	46
	直接員工	99	113	55
	合計	146	191	101
資遣及退休人數		5	9	5
其他(註 1)		(5)	—	—
期末員工人數		564	565	560
離職率(%)(註 2)		21.67	26.14	15.28
平均年齡		37.47	37.60	37.59
平均年資		5.59	5.75	5.84
員工結構	經理人	6	6	6
	一般員工	258	258	249
	直接員工	300	307	305
學歷分布比率(%)	博士	—	—	—
	碩士	2.46	2.65	3.04
	大專(專)	62.92	69.03	67.68
	高中(含)以下	34.62	28.32	29.28

資料來源：該公司提供

註 1： 該公司於民國 110 年 12 月 30 日處分子公司微石開發股份有限公司 100%股權，致人員減少。

註 2： 離職率=離職人數（含資遣、退休及其他人員）/（期末人數+離職人數）

該公司及最近二個會計年度及 112 年截至 9 月 30 日之員工人數分別為 564 人、565 人及 560 人，該公司主要係從事晶圓及積體電路之半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，故以生產線之作業員工占該公司員工比重較高，最近二個會計年度及 112 年截至 9 月 30 日之員工人數變動主要係產線作業人員，因個人因素、適應不良或於聘任後未滿三個月即離職等原因，而一般員工多為個人職涯規劃或家庭因素考量離職，員工離職皆需事前提出，工作均有相關人員承接，對該公司之營運應無重大影響。最近二個會計年度及 112 年截至 9 月 30 日之員工人數無明顯差異，主要係該公司能適時補足人力需求。

最近二個會計年度及 112 年截至 9 月 30 日之員工平均年齡為 37.47 歲

至 37.60 歲，顯示該公司員工主要係為青壯年階層，平均年資則為 5.59 年至 5.84 年，工作年資尚屬穩健，對公司營運尚無重大影響。

員工學歷分布方面，最近二個會計年度及 112 年截至 9 月 30 日大學(專)以上學歷之員工占全體公司員工比重分別 65.38%、71.68%及 70.72%，顯示員工平均受教育素質良好，應有助於強化該公司之競爭力與業務成長力。

2. 離職率之變化情形

單位：人

年度 人數	110 年度			111 年度			112 年 9 月 30 日		
	期末人數	離職人數	離職率%	期末人數	離職人數	離職率%	期末人數	離職人數	離職率%
經理人	6	—	—	6	—	—	6	—	—
一般員工	258	56	17.83	252	85	25.22	249	49	16.44
直接員工	300	100	25.00	307	115	27.25	305	57	15.75
合計	564	156	21.67	565	200	26.14	560	106	15.92

資料來源：該公司提供

註：離職率＝離職人數(包含資遣、退休及其他人數)／(期末人數＋離職人數)

該公司及最近二個會計年度及 112 年截至 9 月 30 日之離職人數分別為 156 人、200 人及 106 人，離職率分別為 21.67%、26.14%及 15.92%，皆為一般員工及直接員工離職，無經理人離職之情形，離職原因除外籍員工之合約聘雇期滿外，其他員工多為適應不良、個人職涯規劃或家庭因素考量，該等人員為基層員工，任用門檻低、替代性高且較易招募，故不致產生人力斷層，另該公司約 25%係為外籍員工，該部分人員皆係透過人力仲介公司聘僱，如有合約到期未續聘之員工缺額，將再新招募外籍員工，藉以維持穩定人力需求。綜上所述，該公司人力資源變化尚屬合理，且皆依各年度離職人數補足所需之人力，故不致對該公司之營運產生重大之影響。

(四)各主要產品之成本分析

1. 最近期及最近二個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素比率變化對發行公司營運之風險

單位：新台幣千元

項目 年度		110 年度		111 年度		112 年前二季	
		金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	直接原料	21,534	3.91	17,648	3.03	7,257	2.74
	直接人工	155,556	28.19	152,490	26.15	63,023	23.79
	製造費用	374,659	67.90	412,940	70.82	194,581	73.47
	小計	551,749	100.00	583,078	100.00	264,861	100.00
半導體封裝	直接原料	29,695	26.97	22,100	22.42	9,762	21.68
	直接人工	26,132	23.73	24,653	25.01	13,083	29.05
	製造費用	54,282	49.30	51,828	52.57	22,184	49.27
	小計	110,109	100.00	98,581	100.00	45,029	100.00

項目 \ 年度		110 年度		111 年度		112 年前二季	
		金額	%	金額	%	金額	%
晶圓薄化	直接原料	30,516	26.86	35,303	24.92	14,982	21.54
	直接人工	16,571	14.59	21,804	15.39	9,825	14.12
	製造費用	66,511	58.55	84,570	59.69	44,764	64.34
	小計	113,598	100.00	141,677	100.00	69,571	100.00
其他	直接原料	2,176	42.34	-	-	-	-
	直接人工	2,963	57.66	-	-	-	-
	製造費用	-	-	-	-	-	-
	小計	5,139	100.00	-	-	-	-
合計	直接原料	83,921	10.75	75,051	9.12	32,001	8.43
	直接人工	201,222	25.78	198,947	24.16	85,931	22.65
	製造費用	495,452	63.47	549,338	66.72	261,529	68.92
	小計	780,595	100.00	823,336	100.00	379,461	100.00

資料來源：該公司提供

該公司為半導體專業測試與封裝服務廠商，提供半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，茲就該公司 110~111 年度及 112 年前二季各成本要素之比率變化分析如下：

(1) 半導體測試

係將晶圓上之晶粒或封裝完成後的 IC 進行功能測試。原料為測試所需之膠帶、彎針及各式耗材等，直接人工為產線人員，製造費用主要為測試機台之折舊、維修、零組件及備品等費用。110~111 年度及 112 年前二季直接原料佔成本比重分別為 3.91%、3.03%及 2.74%，直接人工佔成本比重分別為 28.19%、26.15%及 23.79%，製造費用佔成本比重分別為 67.90%、70.82%及 73.47%半導體測試係以針測機及測試機為主，其設備相關之折舊、維修及備品金額較高，故成本要素以製造費用為重，其次為直接人工，最低為直接原料。其變動主要係受客戶產品所需之測試種類差異所致，各成本要素比率並無重大變化。

(2) 半導體封裝

係將晶圓進行研磨加工並切割成為晶粒，經挑揀後封裝出貨。原料為產線所需之膠帶、切割刀片及各式耗材等，直接人工為產線人員，製造費用主要為切割機台之折舊、維修、零組件及備品等費用。110~111 年度及 112 年前二季直接原料佔成本比重分別為 26.97%、22.42%及 21.68%，直接人工佔成本比重分別為 23.73%、25.01%及 29.05%，製造費用佔成本比重分別為 49.30%、52.57%及 49.27%。半導體封裝所用之切割機及挑揀機，其設備相關之折舊、維修及備品金額較高，故成本要素以製造費用為重，直接人工及直接原料則為約當，其變動主要係受客戶產品所需之規格差異所致，各成本要素比率並無重大變化。

(3) 晶圓薄化

係將晶圓進行正面金屬鍍膜、晶圓背面研磨與金屬鍍膜加工。原料為生產所需之貴金屬、膠帶及各式耗材等，直接人工為產線人員，製造費用主要為各式機台之折舊、維修、零組件及備品等費用。110~111 年度及 112 年前二季直接原料佔成本比重分別為 26.86%、24.92%及 21.54%，直接人工佔成本比重分別為 14.59%、15.39%及 14.12%，製造費用佔成本比重分別為 58.55%、59.69%及 64.34%。晶圓薄化所用之研磨機、蝕刻機及蒸(濺)鍍機等，其設備相關之折舊、維修及備品金額較高，故成本要素以製造費用為重，直接原料則因金屬鍍膜所用之貴金屬單價較高而列其次，最低為直接人工。其變動主要係受客戶產品所需之規格差異所致，各成本要素比率並無重大變化。

(4) 其他

主要係子公司微石開發股份有限公司，為提供餐飲服務。其成本由直接原料及直接人工組成，110 年度直接原料佔成本比重為 42.34%，直接人工佔成本比重為 57.66%，各成本要素比率並無重大變化。該公司已於 110 年 12 月 30 日處分子公司 100%股權，故 111 年度及 112 年前二季無其他成本之情形。

綜上所述，該公司 110~111 年度及 112 年前二季主要產品之成本結構尚無重大異常情事。

2. 符合「有價證券上市審查準則」第十六條規定之公司申請股票上市者，取得當(鄰)地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例(如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等)，以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，發行公司與地主之分配比率是否合理。

該公司並無「有價證券上市審查準則」第十六條規定之營建收入，故不適用。

(五) 匯率變動情形

1. 最近期及最近二個會計年度兌換損益占營業利益之比率

單位：新台幣千元；%

項目＼年度	110 年度	111 年度	112 年前二季
兌換利益(損失)(A)	3,921	14,902	4,253
營業收入淨額(B)	1,292,379	1,226,677	384,383
營業利益(C)	310,265	204,482	(76,982)
兌換利益(損失)占營業收入淨額比例(A)/(B)	0.30	1.21	1.11
兌換利益(損失)占營業利益比例(A)/(C)	1.26	7.29	(5.52)

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

2. 最近期及最近二個會計年度內外銷、內外購比率

(1)最近期及最近二個會計年度內外銷比率

單位：新台幣千元；%

項目＼年度		110 年度		111 年度		112 年前二季	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率
內銷	新臺幣	781,459	60.47	700,274	57.08	238,792	62.12
	美元	378,280	29.27	351,524	28.66	102,724	26.73
外銷	美元	132,640	10.26	174,879	14.26	42,867	11.15
合　　計		1,292,379	100.00	1,226,677	100.00	384,383	100.00

資料來源：該公司提供

(2)最近期及最近二個會計年度內外購比率

單位：新台幣千元；%

項目＼年度		110 年度		111 年度		112 年前二季	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率
內購	新臺幣	83,167	95.94	81,171	95.74	35,354	98.34
	美元	-	-	34	0.04	-	-
	日幣	232	0.27	137	0.16	-	-
外購	美元	2,532	2.92	3,149	3.71	536	1.49
	日幣	753	0.87	294	0.35	60	0.17
合　　計		86,684	100.00	84,785	100.00	35,950	100.00

資料來源：該公司提供

該公司 110~111 年度及 112 年前二季之兌換利益(損失)分別為 3,921 千元、14,902 千元及 4,253 千元，占各該年度營業收入比率分別為 0.30%、1.21%及 1.11%，占營業利益比例分別為 1.26%、7.29%及(5.52)%。

該公司係從事半導體測試服務、半導體封裝及晶圓薄化服務，其服務對象為國內 IC 設計業，以內銷為主，惟部分客戶在營運考量下以美元計價，其外幣計價金額占各年度營業收入比率分別為 39.53%、42.92%及 37.88%。採購方面，因採購之原物料為生產性耗材，主要係向國內供應商採購，故以外幣計價金額僅占各年度進貨淨額比率分別為 4.06%、4.26%及 1.66%，交易幣別有美元及日幣，另該公司依擴廠計畫購置機器設備，其交易幣別主要為美元。

該公司外幣計價銷貨以美元為主，外幣計價採購亦多以美元計價，故可藉由資產負債部位達部分避險效果以減少匯率波動所造成之影響，惟仍存在差額之匯率風險，因此美元匯率變動對該公司之獲利有一定程度之影響。110~111 年度及 112 年前二季美元兌新臺幣匯率呈現震盪走勢，又受美國聯準會加速緊縮政策及升息，致使該公司產生兌換利益。

綜上所述，該公司兌換損益主要係受美元匯率波動的影響，惟兌換損益占營業收入及營業利益之比重並不大，對營業收入及營業利益尚無重大之影

響。

3. 因應匯率變動之具體措施

該公司對於匯率變動風險所採取之具體因應措施如下：

(1)財務單位與往來銀行維持密切聯繫,掌握匯率變動的相關訊息以研判未來匯率之走勢，進行外幣部位管理。

(2)於適當時機透過外幣存款帳戶換匯轉存至台幣存款帳戶。

(3)向客戶報價時，業務單位應考量因匯率變動而可能產生之影響因素，以降低匯率波動對公司的獲利之影響。

綜上所述，該公司針對匯率波動風險業已採取避險措施，以降低匯率波動對獲利之影響，其因應措施尚屬允當。

參、業務狀況

一、營業概況

(一)最近期及最近二個會計年度主要銷售對象及供應商(年度前十名或占年度營業收入淨額或進貨淨額百分之五以上者)之變化分析－應列明最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行公司之銷售政策；最近期及最近二個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析最近期及最近二個會計年度主要供應商之變化情形

1. 最近期及最近二個會計年度主要銷售對象(年度前十名或占年度營業收入淨額百分之五以上者)之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行公司之銷售政策

(1)最近二個會計年度及申請年度截至最近期止主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位：新台幣千元

排名	110 年度				111 年度				112 年前二季			
	客戶名稱	金　額	%	與發行人之關係	客戶名稱	金　額	%	與發行人之關係	客戶名稱	金　額	%	與發行人之關係
1	B 公司	177,606	13.74	無	B 公司	168,177	13.71	無	A 公司	51,257	13.34	無
2	A 公司	120,280	9.31	無	A 公司	136,241	11.11	無	B 公司	37,951	9.87	無
3	J 公司	91,825	7.11	無	D 公司	80,600	6.57	無	C 公司	21,616	5.62	無
4	D 公司	61,102	4.73	無	C 公司	60,076	4.90	無	D 公司	20,073	5.22	無
5	F 公司	56,048	4.33	無	E 公司	57,193	4.66	無	E 公司	18,790	4.89	無
6	G 公司	54,907	4.25	無	F 公司	54,768	4.46	無	F 公司	18,350	4.77	無
7	I 公司	54,422	4.21	無	G 公司	49,560	4.04	無	G 公司	15,060	3.92	無
8	C 公司	46,201	3.57	無	I 公司	47,365	3.86	無	H 公司	14,206	3.70	無
9	H 公司	45,855	3.55	無	H 公司	36,653	2.99	無	I 公司	14,099	3.67	無
10	L 公司	41,751	3.23	無	K 公司	34,571	2.82	無	J 公司	12,179	3.17	無
	小計	749,997	58.03	—	小計	725,204	59.12	—	小計	223,581	58.17	—
	其他	542,382	41.97	—	其他	501,473	40.88	—	其他	160,802	41.83	—
	合計	1,292,379	100.00	—	合計	1,226,677	100.00	—	合計	384,383	100.00	—

資料來源：該公司提供

(2)主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理

該公司為半導體專業測試與封裝服務廠商，提供半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務。

該公司主要銷售地區係以台灣為主，其他地區則為美洲及其他亞洲地區，主要銷售對象為半導體設計公司，最近二個會計年度及 112 年前二季之營業收入淨額分別為 1,292,379 千元、1,226,677 千元及 384,383 千元，各年度前十大銷售客戶之銷售金額合計占當年度營業收入淨額比重則分別為 58.03%、59.12%及 58.17%，茲就該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之前十大銷售對象變化情形分析如下：

①A 公司

A 公司成立於 85 年，位於新竹市，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事電源管理的類比暨混合訊號積體電路設計、測試、生產及行銷等業務，主要產品為電源管理 IC，應用於筆記型電腦、伺服器、面板、電視、手機、馬達等。該公司自 94 年起與 A 公司業務往來，主要提供半導體測試及封裝服務，最近二個會計年度及 112 年前二季對 A 公司之銷售淨額分別為 120,280 千元、136,241 千元及 51,257 千元，占營業收入比重分別為 9.31%、11.11%及 13.34%。最近二個會計年度及 112 年前二季均為該公司前二大銷售客戶之一。111 年度較 110 年度成長，主要係 A 公司商用筆記型電腦及伺服器終端需求強勁，帶動對電源管理 IC 測試及封裝需求成長。112 年前二季該公司對 A 公司之銷售較去年同期減少，主要係受 A 公司商用筆記型電腦等終端需求趨緩且存貨尚在去化之影響，致對該公司電源管理 IC 測試及封裝服務需求下降。

②B 公司

B 公司成立於 94 年，位於新竹縣，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事功率積體電路及功率元件設計業務，主要產品為電源管理 IC 及功率元件，應用於個人電腦、筆記型電腦及基地台等產品。該公司自 95 年起與 B 公司業務往來，主要提供半導體測試及封裝服務，最近二個會計年度及 112 年前二季對 B 公司之銷售淨額分別為 177,606 千元、168,177 千元及 37,951 千元，占營業收入比重分別為 13.74%、13.71%及 9.87%，最近二個會計年度及 112 年前二季均為該公司前二大銷售客戶之一。111 年度較 110 年度對 B 公司銷售微幅減少，主要係 111 下半年度 B 公司調整庫存存貨，致對電源管理 IC 及 MOSFET 測試及封裝服務需求下降。112 年前二季較去年同期減少，因個人電腦及筆記型電腦終端需求趨緩及客戶持續調整庫存，致對該公司電源管理 IC 及 MOSFET 測試及封裝服務需求下降。

③C 公司

C 公司成立於 96 年，位於新竹縣，為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司，從事功率元件及積體電路之設計、開發、製造及銷

售業務，主要產品為 MOSFET，應用於筆記型電腦、行動電話、可攜式產品及節能家電與工業控制等。該公司自 98 年起與 C 公司業務往來，提供半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化服務，最近二個會計年度及 112 年前二季對 C 公司之銷售淨額分別為 46,201 千元、60,076 千元及 21,616 千元，占營業收入比重分別為 3.57%、4.90%及 5.62%，最近二個會計年度及 112 年前二季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年度較 110 年度成長，主係功率元件應用於筆記型電腦、節能家電及工業控制需求強勁，致功率元件測試封裝及晶圓薄化需求增加。112 年前二季較去年同期減少，主要係受筆記型電腦及節能家電終端需求趨緩，致功率元件測試及晶圓薄化服務需求下降。

④D 公司

D 公司成立於 87 年，位於新北市，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事電源管理之功率元件及類比 IC 設計業務，主要產品為電源管理之功率元件，應用於電腦主機板、筆記型電腦、平板電腦、液晶顯示器、車用電子及車充等電源裝置。該公司自 95 年起與 D 公司業務往來，提供半導體測試與封裝服務及晶圓薄化服務，最近二個會計年度及 112 年前二季對 D 公司之銷售淨額分別為 61,102 千元、80,600 千元及 20,073 千元，占營業收入比重分別為 4.73%、6.57%及 5.22%，最近二個會計年度及 112 年前二季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年度因對 D 公司提供之晶圓薄化服務需求較前一年度增加，致整體營收較前期增加。112 年前二季較去年同期減少，主要係受筆記型電腦終端需求趨緩，致 D 公司對該公司之功率元件測試、封裝及晶圓薄化服務需求下降。

⑤E 公司

E 公司成立於 102 年，登記於愛爾蘭 Dublin，總部位於美國 El Segundo，為美國那斯達克股票交易所掛牌交易之上市公司，從事 GaN 功率半導體設計及銷售業務，是全球 GaN 電源晶片的技術領導廠商，主要產品為 GaN 之電源管理 IC，應用於手機快充、筆記型電腦快充、消費性電子產品、資料中心及電動車等。該公司自 104 年起與 E 公司業務往來，提供半導體測試服務，111 年度及 112 年前二季對 E 公司之銷售淨額分別為 57,193 千元及 18,790 千元，占營業收入比重分別為 4.66%及 4.89%，111 年度及 112 年前二季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年度因 GaN 應用於手機及筆記型電腦快充產品等市占率逐漸提高，致半導體測試服務需求增加，並於該年度成為該公司前十大銷售客戶之一。112 年前二季較去年同期減少，受筆記型電腦終端需求趨緩，存貨尚在去化影響，致 GaN 之電源管理 IC 測試服務需求下降。

⑥F 公司

F 公司成立於 83 年，位於新竹市，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事觸控積體電路、微控制器及特定用途積體電路之研發、

設計及銷售業務，主要產品為觸控晶片及微控制器，應用於主機板、筆記型電腦、平板電腦、大小家電、安全系統、通訊週邊等泛 PC 產品及其週邊電源裝置。該公司自 88 年起與 F 公司業務往來，提供半導體測試及封裝服務，最近二個會計年度及 112 年前二季對 F 公司之銷售淨額分別為 56,048 千元、54,768 千元及 18,350 千元，占營業收入比重分別為 4.33%、4.46%及 4.77%，最近二個會計年度及 112 年前二季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年度較 110 年度減少，主要係 F 公司調整庫存，致對該公司觸控晶片及微控制器測試封裝服務需求下降。112 年前二季較去年同期減少，係受筆記型電腦終端需求趨緩，致 F 公司對該公司觸控晶片及微控制器測試服務需求下降。

⑦G 公司

G 公司成立於 88 年，位於台北市，為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司，從事行動顯示器驅動 IC 產品之設計與銷售，主要產品為顯示器驅動 IC，應用於工控儀器、醫療儀器、車用市場、行動裝置及電子紙等多項領域。該公司自 91 年起與 G 公司業務往來，提供半導體測試及封裝服務，最近二個會計年度及 112 年前二季對 G 公司之銷售淨額分別為 54,907 千元、49,560 千元及 15,060 千元，占營業收入比重分別為 4.25%、4.04%及 3.92%，最近二個會計年度及 112 年前二季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年度較 110 年度減少，主要係 G 公司調整庫存，致對該公司驅動 IC 測試需求下降。112 年前二季較去年同期減少，受顯示器驅動 IC 終端需求趨緩，致驅動 IC 測試服務需求下降。

⑧H 公司

H 公司成立於 91 年，位於新北市，曾為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司，103 年與美商公司進行合併，並於合併後下櫃。H 公司從事類比 IC 設計及銷售業務，主要產品為光源感測 IC，應用於通訊科技、行動電話、智慧型手機、手持式產品、數位相機、筆記型電腦、桌上型電腦、LED 背光模組、辦公室自動化產品、家電產品及汽車電子等。該公司自 94 年起與 H 公司業務往來，提供半導體測試及封裝服務，最近二個會計年度及 112 年前二季對 H 公司之銷售淨額分別為 45,855 千元、36,653 千元及 14,206 千元，占營業收入比重分別為 3.55%、2.99%及 3.70%，最近二個會計年度及 112 年前二季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年度較 110 年度減少，主要係受 H 公司調整庫存影響，致對該公司光源感測 IC 測試封裝服務需求下降。112 年前二季較去年同期減少，受終端筆記型電腦、個人電腦及穿戴裝置需求疲乏，致 H 公司對該公司之測試封裝服務需求下降。

⑨I 公司

I 公司成立於 87 年，位於新竹縣，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事功率元件研究、設計及銷售業務，主要產品為 MOSFET，

應用於個人電腦、筆記型電腦、電源供應器及家用產品電源應用等。該公司自 102 年起與 I 公司業務往來，提供半導體測試服務及晶圓薄化服務，最近二個會計年度及 112 年前二季對 I 公司之銷售淨額分別為 54,422 千元、47,365 千元及 14,099 千元，占營業收入比重分別為 4.21%、3.86%及 3.67%，最近二個會計年度及 112 年前二季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年度較 110 年度減少，主要係 I 公司調整庫存之影響，致對該公司功率元件測試封裝服務需求下降。112 年前二季受筆記型電腦及電源供應器終端需求趨緩，致對 I 公司之測試及晶圓薄化服務銷售較去年同期減少。

⑩J 公司

J 公司成立於 90 年，位於台南市，為納斯達克證券交易所掛牌交易之上市公司，從事驅動 IC 與時序控制 IC 之設計業務，主要產品為驅動 IC，應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。該公司自 98 年起與 J 公司業務往來，提供半導體測試及封裝服務，110 年度及 112 年前二季對 J 公司之銷售淨額分別為 91,825 千元及 12,179 千元，占營業收入比重分別為 7.11%3.17%，110 年度及 112 年前二季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年度因受 J 公司驅動 IC 產品組合之影響，致對 J 公司驅動 IC 測試服務減少，J 公司並於 111 年度退出該公司前十大客戶之列。112 年前二季對 J 公司之驅動 IC 測試服務較去年同期增加，主要係 J 公司調整產品線致對該公司之測試服務需求增加，另因該公司對其他前十大客戶之銷售金額下滑，致 J 公司進入前十大客戶之列。

⑪K 公司

K 公司成立於 97 年，位於加拿大，從事 GaN 功率半導體設計及銷售業務，主要產品為 GaN 功率元件，應用於資料中心、無線充電、消費性充電器、變壓器、電動車電池模組等。該公司自 108 年起與 K 公司業務往來，提供半導體測試服務及晶圓薄化服務，111 年度對 K 公司之銷售淨額為 34,571 千元，占營業收入比重 2.82%。因受 GaN 應用於快充產品及電源供應器等市占率逐漸提高，致半導體測試服務需求增加，K 公司並於該年度進入前十大銷售客戶之列。112 年前二季因受客戶自身營運之影響減少對該公司之測試服務需求，並退出前十大客戶之列。

⑫L 公司

L 公司成立於 98 年，位於新竹縣，為臺灣證券交易所掛牌交易上市公司之孫公司，從事類比 IC 及驅動 IC 等設計及銷售業務，主要產品為電源管理 IC，應用於手機、筆記型電腦、平板電腦、電視等裝置。該公司自 100 年起與 L 公司業務往來，提供半導體測試服務，110 年度對 L 公司之銷售淨額為 41,751 千元，占營業收入比重 3.23%，並於該

年度成為該公司之第十大銷售客戶。111 年度因 L 公司自身營運之影響減少對該公司電源管理 IC 測試服務需求，並退出該公司前十大銷售客戶之列。

(3)是否有銷售集中之風險

該公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務。該公司最近二個會計年度及 112 年前二季來自前十大銷售客戶之銷售金額占該年度營業收入之比重分別為 58.03%、59.12%及 58.17%，若以各年度第一大銷售客戶銷售金額占該年度營業收入之比重分別為 13.74%、13.71%及 13.34%，單一客戶之銷售比重皆未達 30%，尚無銷售集中風險之情形。

(4)該公司之銷售政策

該公司深耕半導體產業逾 30 年，多年來不斷地提升測試技術與拓展客源，於測試服務品質已獲得客戶之肯定與信賴，該公司之銷售政策如下：

①提升半導體測試技術，與客戶長期穩定合作

不斷提升高溫、高壓、大電流等測試項目之服務及品質，即時處理之技術支援與回應客戶品質問題，取得客戶之信賴，因此該公司之客戶多為長期合作之夥伴，藉由與客戶不斷開發新產品，協助客戶解決新產品測試技術問題，提高客戶之滿意度，維持密切合作並創造雙贏局面。

②以整合性服務，掌握市場先機

該公司提供完整之半導體封測整合性服務，能提供客戶不同製程，一次購足之需求，且具備自製及維修探針卡之技術，縮短製造及維修探針卡交期，即時滿足客戶需求，提供客戶快速回應市場之彈性，掌握市場先機，確保客戶之競爭力。

2. 最近期及最近二個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析最近期及最近二個會計年度主要之變化情形

(1)最近二個會計年度及最近期主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新台幣千元

排名	110 年度				111 年度				112 年前二季			
	名　　稱	金　額	比例%	與發行人之關係	名　　稱	金　額	比例%	與發行人之關係	名　　稱	金　額	比例%	與發行人之關係
1	三井化學	9,526	10.99	無	甲公司	11,364	13.40%	無	三井化學	8,072	22.45%	無
2	甲公司	8,879	10.24	無	三井化學	7,880	9.29%	無	甲公司	2,842	7.91%	無
3	丙公司	4,358	5.03	無	乙公司	5,476	6.46%	無	乙公司	2,608	7.25%	無
4	戊公司	4,283	4.94	無	丙公司	4,539	5.35%	無	迪思科高	2,177	6.06%	無
5	庚公司	4,245	4.90	無	原津工業	4,289	5.06%	無	原津工業	1,655	4.60%	無
6	原津工業	4,058	4.68	無	己公司	3,886	4.58%	無	丙公司	1,331	3.70%	無
7	己公司	3,737	4.31	無	辛公司	3,661	4.32%	無	丁公司	1,284	3.57%	無
8	迪思科高	3,665	4.23	無	丁公司	3,643	4.30%	無	戊公司	1,194	3.32%	無
9	乙公司	3,386	3.91	無	迪思科高	3,469	4.09%	無	己公司	1,055	2.94%	無
10	壬公司	2,621	3.02	無	庚公司	2,982	3.52%	無	庚公司	1,039	2.89%	無
	其他	37,926	43.75	—	其他	33,596	39.63%	—	其他	12,693	35.31%	—
	進貨淨額	86,684	100.00	—	進貨淨額	84,785	100.00%	—	進貨淨額	35,950	100.00%	—

資料來源：該公司提供。

(2)發行公司最近期及最近二個會計年度主要供應商之變化情形

該公司為半導體專業測試封裝服務廠商，其主要營業項目為提供半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務。茲就該公司最近二個會計年度及112年前二季主要供應商變化情形及其變動原因說明如下：

①膠帶

A.台灣三井化學股份有限公司

(以下簡稱三井化學；網址：tw.mitsuichemicals.com)

三井化學成立於90年，位於台北市，其母公司為東京證券交易所掛牌上市之公司日商三井化學株式會社(股票代號：4183)，主要業務為半導體材料、液晶材料、太陽能電池材料、手機材料及其他機能製品之銷售，該公司自109年開始與三井化學業務往來，主要向其採購晶圓背面研磨保護膠帶。最近二個會計年度及112年前二季進貨淨額分別為9,526千元、7,880千元及8,072千元，占各年度進貨淨額比重分別為10.99%、9.29%及22.45%，皆位於前十大供應商之列。111年度進貨金額較110年度降低至7,880千元，主要係該公司在交期考量下調整採購策略，將部分品項轉向其他供應商採購所致；112年前二季進貨金額達8,072千元，主要係因交期恢復穩定，故增加向三井化學採購，致進貨金額增加，其變動原因尚屬合理。

B.辛公司

辛公司成立於69年，位於台中市，主要業務為半導體製程膠帶及機能性膠膜之製造及銷售，該公司自110年開始與辛公司業務往來，主要向其採購晶圓研磨膠帶及熱解膠帶。111年度進貨淨額為3,661千元，占該年度進貨淨額比重為4.32%。該公司基於交期及地緣性之考量下，於110年開始與辛公司合作，隨著該公司晶圓薄化服務市場拓展有成，故對辛公司之進貨金額增加，並於111年度居第六大供應商之列；112年前二季因該公司調整採購策略而將部份品項轉向其他供應商採購，故辛公司未列入前十大供應商之列，其變動原因尚屬合理。

②貴金屬

A.甲公司

甲公司成立於89年，位於高雄市，為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司，主要業務為金屬靶材製造與銷售，該公司自109年開始與甲公司業務往來，主要向其採購鎳錠、銀錠及銀靶料。最近二個會計年度及112年前二季進貨淨額分別為8,879千元、11,364千元及2,842千元，占各年度進貨淨額比重分別為10.24%、13.40%及7.91%，皆位於前十大供應商之列。110年度及111年度之進貨金額逐年增加，主要係該公司近年來積極拓展晶圓薄化服務市場，晶圓薄化營收有所成長，其製程所需之貴金屬進貨金額亦隨之增加；112年前二季則受終端消費性電子需求降低，晶圓薄化服務減

少，亦使製程所需之貴金屬進貨金額減少，其變動原因尚屬合理。

B. 乙公司

乙公司成立於 92 年，位於新竹縣，主要業務為高科技材料及設備之銷售，該公司自 108 年開始與乙公司業務往來，主要向其採購銀錠。最近二個會計年度及 112 年前二季進貨淨額分別為 3,386 千元、5,476 千元及 2,608 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 3.91%、6.46%及 7.25%，皆位於前十大供應商之列。111 年度進貨金額增加至 5,476 千元，主要係因該公司積極拓展晶圓薄化服務市場，使晶圓薄化營收成長，其製程所需之貴金屬採購金額亦隨之增加；112 年前二季則受終端消費性電子需求降低，晶圓薄化服務減少，故減少對乙公司貴金屬之採購，其變動原因尚屬合理。

③耗材

A. 迪思科高科技股份有限公司

(以下簡稱迪思科高；網址：www.disco.co.jp)

迪思科高成立於 96 年，位於新北市，其母公司為東京證券交易所掛牌上市之公司日商 DISCO Corportion(股票代號：6146)，主要業務為精密研磨切割設備之製造及銷售。該公司自 101 年開始與迪思科高業務往來，主要向其採購切割刀片，係屬切割設備所用之耗材。最近二個會計年度及 112 年前二季進貨淨額分別為 3,665 千元、3,469 千元及 2,177 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 4.23%、4.09%及 6.06%，皆位於前十大供應商之列。進貨金額隨客戶對產品需求而增減，其變動原因尚屬合理。

B. 原津工業股份有限公司(以下簡稱原津工業；網址：無)

原津工業成立於 77 年，位於新北市，主要業務為各類塑膠產品及零件之製造及銷售，該公司自 85 年開始與原津工業業務往來，主要向其採購晶粒盤。最近二個會計年度及 112 年前二季進貨淨額分別為 4,058 千元、4,289 千元及 1,655 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 4.68%、5.06%及 4.60%，皆位於前十大供應商之列。因係由客戶所指定之供應商，其增減變動主要係隨客戶對產品需求而增減，其變動原因尚屬合理。

C. 丙公司

丙公司成立於 103 年，位於新北市，主要業務為無塵室耗材之銷售，該公司自 103 年開始與丙公司業務往來，主要向其採購無塵衣、無塵影印紙、無塵擦拭紙等，係屬產線所用之耗材。最近二個會計年度及 112 年前二季進貨淨額分別為 4,358 千元、4,539 千元及 1,331 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 5.03%、5.35%及 3.70%，皆位於前十大供應商之列。110 及 111 年度進貨金額約當，進貨比重亦無重大變動；112 年前二季受終端消費性電子產品需求降低，對測試及封裝服務需求下滑，致進貨金額減少，其變動原因尚屬合理。

D. 丁公司

丁公司成立於 85 年，位於新北市，主要業務為半導體防護材料之製造及銷售，該公司自 93 年開始與丁公司業務往來，主要向其採購晶圓間隔片，係屬產品包裝所用之耗材。111 年度及 112 年前二季向丁公司進貨淨額分別為 3,643 千元及 1,284 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 4.30%及 3.57%，並列入該公司前十大供應商之列。係屬產品包裝所用之耗材，111 年度因產線所需，致對丁公司之採購增加，並進入前十大供應商之列，112 年前二季受終端消費性電子產品需求降低，致進貨金額減少，其變動原因尚屬合理。

E. 戊公司

戊公司成立於 82 年，公司位於台中市，為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司，主要業務為代理銷售半導體、光電及綠色能源產業所需之原材料、零組件及其設備。該公司自 93 年開始與戊公司業務往來，主要向其採購晶粒盤。110 年度及 112 年前二季進貨淨額分別為 4,283 千元及 1,194 千元，占各該年度進貨淨額比重分別為 4.94%及 3.32%，位於前十大供應商之列。111 年度因客戶減少晶圓切割封裝服務，故該年度對戊公司之進貨金額減少，並退出前十大供應商之列，112 年前二季隨客戶晶圓切割封裝服務增加，故增加對戊公司之進貨，並進入該公司前十大供應商之列，其變動原因尚屬合理。

F. 己公司

己公司成立於 77 年，位於新竹市，主要業務為建材五金之銷售，該公司自 88 年開始與己公司業務往來，主要向其採購抗靜電 EPE 海綿及晶圓盒，係屬產品包裝所用之耗材。最近二個會計年度及 112 年前二季進貨淨額分別為 3,737 千元、3,886 千元及 1,055 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 4.31%、4.58%及 2.94%，皆位於前十大供應商之列。110 及 111 年度進貨金額及比重尚無重大變動；112 年前二季受終端消費性電子產品需求降低，致進貨金額減少，其變動原因尚屬合理。

G. 庚公司

庚公司成立於 90 年，位於高雄市，主要業務為半導體包裝材料之製造及銷售。該公司自 103 年開始與庚公司業務往來，主要向其採購載帶及上封帶，係屬產品包裝所用之耗材。最近二個會計年度及 112 年前二季進貨淨額分別為 4,245 千元、2,982 千元及 1,039 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 4.90%、3.52%及 2.89%，皆位於前十大供應商之列。進貨金額隨客戶對產品需求而增減，其變動原因尚屬合理。

H. 壬公司

壬公司成立於 108 年，公司位於新竹縣，主要業務為代理銷售

半導體測試耗材、零件及加工組件等。該公司自 109 年開始與壬公司業務往來，主要向其採購鋨鎢彎針，用以製作探針卡，鋨鎢彎針係屬晶圓測試所需之耗材，其進貨金額隨客戶對產品需求而增減。110 年度進貨淨額為 2,621 千元，占該年度進貨淨額比重為 3.02%，位於第十大供應商，111 年度對壬公司之進貨與前一年度相當，惟受其他供應商之採購金額增加，致壬公司退出前十大供應商之列，其變動原因尚屬合理。

(3)供貨來源穩定性之評估

該公司係以半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化為主，故對原物料需求較低，且我國 IC 產業上中下游分工精細且結構完整，原物料之取得尚屬充裕，而該公司亦與供應商保持良好且穩定之合作關係，尚無貨源短缺或中斷之情事發生。最近二個會計年度及 112 年前二季前十大供應商進貨金額占各該年度進貨淨額比重分別為 56.25%、60.37%及 64.69%，各期間對第一大供應商之進貨比重皆未逾 30%以上，尚無進貨集中之情形，其供貨來源尚屬穩定。

(4)進貨政策

該公司係依據訂單、生產排程及業務所預估銷售量綜合評估之，並透過定期產銷會議來調節產品供需之平衡;其原物料採購係考量供應商品質穩定性、產能狀況及價格等，經採購部門詢比議後進行採購，截至目前為止，尚無發生供貨中斷之情事。

(二)最近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性、備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

單位：新台幣千元

年度＼項目		110 年度		111 年度		112 年前二季
		個體	合併	個體	合併	
營業收入淨額	微矽電子	1,291,177	1,292,379	1,226,677	1,226,677	384,383
	京元電子	25,820,727	33,759,389	27,619,107	36,781,996	15,931,760
	矽格	10,364,704	16,681,264	10,590,172	18,694,345	7,332,778
	昇陽半導體	2,656,741	2,651,386	3,138,053	3,138,053	1,786,333
應收款項總額	微矽電子	359,712	359,712	248,534	248,534	204,309
	京元電子	6,018,925	7,951,178	5,294,652	7,156,681	7,056,138
	矽格	2,343,687	3,920,652	2,259,658	3,889,990	3,629,383
	昇陽半導體	463,466	463,466	414,177	414,177	456,912
備抵呆帳	微矽電子	12,267	12,267	1,534	1,534	1,534
	京元電子	25,158	26,286	13,107	14,238	14,213
	矽格	—	47,708	—	53,282	927
	昇陽半導體	—	—	—	—	—
應收款項淨額	微矽電子	347,445	347,445	247,000	247,000	202,775
	京元電子	5,993,767	7,924,892	5,281,545	7,142,443	7,041,925

年度	項目	110 年度		111 年度		112 年前二季
		個體	合併	個體	合併	
	矽　　格	2,343,687	3,872,944	2,259,658	3,831,425	3,628,456
	昇陽半導體	463,466	463,466	414,177	414177	456,912
備抵呆帳占應收款項總額比例(%)	微矽電子	3.41	3.41	0.62	0.62	0.75
	京元電子	0.42	0.33	0.25	0.20	0.20
	矽　　格	—	1.22	—	1.37	0.03
	昇陽半導體	—	—	—	—	—
應收款項週轉率(次)	微矽電子	3.88	3.89	4.03	4.03	3.39
	京元電子	4.82	4.94	4.88	5.04	4.48
	矽　　格	4.42	4.58	4.60	4.79	3.90
	昇陽半導體	5.74	5.73	7.15	7.15	8.20
應收款項收款天數	微矽電子	94	94	91	91	107
	京元電子	76	74	75	72	81
	矽　　格	83	80	79	76	93
	昇陽半導體	64	64	51	51	45

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告
註：112 年第二季未出具個體財務報告。

1. 應收款項變動之合理性

(1)個體財務報告

該公司最近二個會計年度個體營業收入淨額分別為 1,291,177 千元及 1,226,677 千元，期末應收款項總額分別為 359,712 千元及 248,534 千元。該公司 111 年底應收款項較 110 年底減少，主係 111 年受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務需求減少，另因 111 年第四季營業收入較去年同期減少 68,236 千元，故 111 年底之應收款項亦較 110 年底減少。

該公司最近二個會計年度個體應收款項週轉率及應收款項週轉天數分別為 3.88 次、4.03 次及 94 天、91 天。該公司 111 年度應收款項週轉率較 110 年度上升，主係 111 年受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務需求減少及 111 年第四季營業收入較去年同期減少 68,236 千元，減少幅度 21.86%，期末應收款項亦隨之下降，惟營業收入減少比率小於平均應收款項減少比率，致 111 年度應收款項週轉率及週轉天數較 110 年度上升。

(2)合併財務報告

該公司 110 年度編製合併財務報告之主體包括該公司及微石開發股份有限公司(以下簡稱微石)，因該公司於 110 年 12 月 30 日處分微石 100% 股權，故 111 年度及 112 年第二季編制主體僅該公司。該公司最近二個會計年度及 112 年度前二季之合併營業收入淨額分別為 1,292,379 千元、1,226,667 千元及 384,383 千元，期末應收款項總額分別為 359,712 千元、

248,534 千元及 204,309 千元，該公司 111 年底應收款項較 110 年底減少，主係 111 年受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務需求減少，且 111 年第四季營業收入較去年同期減少 68,236 千元，期末應收款項亦隨之下降；112 年第二季底應收款項較 111 年底減少，主係 112 年前二季受消費性電子終端需求趨緩及客戶調整庫存影響，112 年前二季營業收入較去年同期減少 302,745 千元，第二季之營業收入亦較 111 年第四季減少，使 112 年第二季底之應收款項較 111 年底減少。

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之合併應收款項週轉率及應收款項週轉天數分別為 3.89 次、4.03 次、3.39 次及 94 天、91 天、107 天，應收款項週轉率主要係隨該公司營收變化而變動，該公司 111 年度應收款項週轉率較 110 年度上升，主係 111 年受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務需求減少，營業收入下降，應收款項亦隨之減少，加上應收款項收款情形良好，期末應收款項金額下降，營業收入減少比率小於平均應收款項減少比率所致；112 年前二季應收款項週轉率較 111 年度下降，主係 112 年前二季受消費性電子終端需求趨緩及客戶調整庫存影響，112 年前二季營業收入較去年同期減少 302,745 千元，減少幅度 44.06%，營業收入減少，應收款項亦隨之下降，減少幅度 17.79%，因營業收入減少比率大於平均應收帳款減少比率，使應收款項收回天數較 111 年度增加。

綜上所述，該公司最近二個會計年度及 112 年第二季底之應收款項係隨營業收入而產生變化，且應收款項收款天數雖較長於授信天數，但經評估，該公司應收款項變化情形尚屬合理，尚無重大異常之情事。

2. 應收款項備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估

(1) 備抵損失提列政策

該公司依據國際財務報導準則第九號「金融工具」(IFRS9)訂定該公司之應收款項評價辦法，採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收票據及應收帳款(含關係人)係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊，包括總體經濟及相關產業資訊。

該公司考量個別客戶歷史違約狀態，將所有應收帳款及應收票據按不同帳齡逾期區間分組如下：

1	2	3	4	5
未逾期	逾期1-30天	逾期31-90天	逾期91-180天	逾期>181天

資料來源：該公司提供。

(2) 應收款項備抵損失提列之適足性

該公司最近二個會計年度及 112 年度前二季在個體財務報告及合併財務報告之備抵損失提列金額為均為 12,267 千元、1,534 千元及 1,534 千元，占應收款項總額之比例皆 3.41%、0.62%及 0.75%，111 年度備抵損失

提列金額較 110 年度減少 10,733 千元，主要係該公司於 101 年 12 月至 102 年 1 月銷售予晶鴻光電科技(股)公司(以下簡稱晶鴻)累積 10,733 千元應收款項未收回，至 111 年度晶鴻仍未支付款項且於同年申請停業，該公司並於 111 年度沖銷該筆 10,733 千元之帳款，致備抵損失下降，除上述事件外，該公司最近二年度及 112 年前二季均未曾發生重大帳款未能收回之情事，該公司業已依其提列政策估列備抵金額，故其備抵呆帳提列尚屬適足。

(3)應收款項收回之可能性

個別財務報告

單位：新台幣千元

項　　目	112 年 06 月 30 日	截至 112 年 9 月 30 日之收回情形	
		收回金額	期後收款比率(%)
應收票據	165	165	100.00
應收帳款	204,144	184,722	90.49
合計	204,309	184,887	90.49

資料來源：該公司提供

該公司 112 年 6 月底應收款項總額為 204,309 千元，截至 112 年 9 月 30 日止應收款項為已收回金額為 184,887 千元，收回比率為 90.49%，未收回金額為 19,422 千元，未收回比率為 9.51%，其中逾期未收回為 356 千元，占未收回金額之比率 1.83%，逾期未收回款項主要係客戶入帳時間差產生，故應收款項收回情況尚無異常。

3. 與同業比較

(1)個體財務報告

經與採樣同業比較，在應收款項週轉率及收款天數方面，110 年度及 111 年度之應收款項週轉率皆低於採樣同業，主要係各公司之營業屬性及銷售客群組成有所差異，該公司授信條件為月結 30 至 90 天，客戶於月結到期之次月付款，致應收款項收款天數較收款條件為高。111 年度受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務下降，營業收入減少，應收款項亦隨之減少，加上應收款項收款情形良好，期末應收款項金額下降，營業收入減少比率小於平均應收帳款減少比率，致應收款項週轉率上升，在備抵呆帳占應收款項總額比率方面，110 年度高於採樣同業，係 101 年至 102 年與銷售客戶晶鴻之交易，至 104 年 10,733 仟元應收款項未收回，故該公司於 104 年度向法院申請對晶鴻之假扣押及提列 100%減損損失，至 111 年度晶鴻仍未支付款項且於該年度申請停業，故該公司於 111 年度沖銷該筆帳款，整體而言，除前述事件外，該公司最近二個會計年度及 112 年第二季皆依其應收帳款評價辦法評估，其備抵呆帳之提列尚無不足之虞，應收款項週轉率與採樣公司相較亦無重大異常之情事。

(2)合併財務報告

經與採樣同業比較，在應收款項週轉率及收款天數方面，110 年度、

111 年度及 112 前二季之應收款項週轉率皆低於採樣同業，主要係各公司之營業屬性及銷售客群組成有所差異，該公司授信條件為月結 30 至 90 天，客戶於月結到期之次月付款，致應收款項收款天數較收款條件為高。112 年前二季受消費性電子終端需求趨緩及客戶調整庫存影響，營業收入減少，應收帳款亦隨之減少，營業收入減少幅度大於應收帳款減少幅度，致應收款項週轉率下降，在備抵呆帳占應收款項總額比率方面，110 年度高於採樣同業，係 101 年至 102 年與銷售客戶晶鴻之交易，至 104 年 10,733 仟元應收款項未收回，故該公司於 104 年度向法院申請對晶鴻之假扣押及提列 100%減損損失，至 111 年度晶鴻仍未支付款項且於該年度申請停業，故該公司於 111 年度沖銷該筆帳款，整體而言，除前述事件外，歷年來應收款項收款狀況良好，期後收款情形亦屬良好，最近二個會計年度及最近期皆依其應收帳款評價辦法評估，其備抵呆帳之提列尚無不足之虞，應收款項週轉率與採樣公司相較亦無重大異常之情事。

經上述評估，該公司於最近二個會計年度及 112 年前二季之個體及合併應收款項變動之合理性、備抵呆帳提列之適足性及收回可能性，與採樣公司相較亦無重大異常之情事。

二、存貨概況

(一)最近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告及個體財務報告存貨淨額變動之合理性、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估。

該公司為半導體專業測試與封裝服務廠商，提供半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務。其製程包含晶圓針測、電性抽測、晶圓研磨、晶圓切割、晶圓蝕刻、晶圓金屬鍍膜等加工製程，存貨主要為製程所需之生產性物料，如貴金屬、膠帶、晶粒盤及其他耗材等，並無在製品、製成品及商品。110 年度及 111 年度財務報告編製主體包含該公司及其子公司微石開發，微石開發為餐飲服務，帳上並無存貨，故存貨主要來自於該公司；另微石開發於 110 年 12 月 30 日完成處分，故 112 年第二季為個別財務報告，並無出具個體財務報告。

1.存貨淨額變動情形

單位：新台幣千元

年度 項目	110年度		111年度		112年前二季
	個體	合併	個體	合併	
營業收入淨額	1,291,177	1,292,379	1,226,677	1,226,677	384,383
營業成本	775,456	780,595	823,369	823,369	379,461
原物料	14,598	14,598	17,269	17,269	19,219
期末存貨總額	14,598	14,598	17,269	17,269	19,219
備抵存貨跌價及呆滯損失	-	-	(2,216)	(2,216)	(2,264)
期末存貨淨額	14,598	14,598	15,053	15,053	16,955
存貨週轉率(次)	45.68	45.99	51.68	51.68	41.60
存貨週轉天數(天)	8	8	7	7	9

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告及該公司提供。

(1)個體財務報告

110 年底及 111 年底之期末存貨淨額分別為 14,598 千元及 15,053 千元，111 年度主要係因積極拓展晶圓薄化服務市場，其製程所需之貴金屬亦隨之增加，使期末存貨總額上升至 15,053 千元。在存貨週轉率方面，該公司 110 年底及 111 年底之存貨週轉率分別為 45.68 次及 51.68 次，存貨週轉天數分別為 8 天及 7 天。基於產業特性，其存貨占營業成本比例甚低，故存貨周轉率高及週轉天數短，111 年下半年起受終端市場需求變化趨緩致客戶調整減少產品測試封裝服務之影響，營業收入及存貨平均值皆較 111 年度減少，其減少幅度分別為 5.00%及 6.13%，惟晶圓薄化製程所需之貴金屬成本較高，致整體營業成本增加 6.18%，故存貨週轉率微幅上升至 51.68 次。其存貨周轉率及天數約當，尚無重大差異之情形。

(2)合併財務報告

110 年底、111 年底及 112 年 6 月底之期末存貨淨額分別為 14,598 千元、15,053 千元及 16,955 千元，111 年度主要係因積極拓展晶圓薄化服務市場，其製程所需之貴金屬亦隨之增加，使期末存貨總額上升至 15,053 千元；112 年前二季主要係因膠帶供貨交期較長，為建立安全庫存致期末存貨總額上升至 19,219 千元。在存貨週轉率方面，該公司 110 年底、111 年底及 112 年 6 月底存貨週轉率分別為 45.99 次、51.68 次及 41.60 次，存貨週轉天數分別為 8 天、7 天及 9 天。基於產業特性，其存貨占營業成本比例甚低，故存貨周轉率高及週轉天數短，111 年下半年起受終端市場需求變化趨緩致客戶調整減少產品測試封裝服務之影響，營業收入及存貨平均值皆較 111 年度減少，其減少幅度分別為 5.08%及 6.13%，惟晶圓薄化製程所需之貴金屬成本較高，致整體營業成本增加 5.48%，故存貨週轉率微幅上升至 51.68 次；112 年前二季消費性電子終端需求仍趨緩，致營業收入及營業成本皆下降，存貨週轉率下降至 41.60 次，存貨週轉天數增加至

9 天。各期間之存貨周轉率及天數約當，尚無重大差異之情形。

綜上所述，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季存貨淨額及存貨週轉率之變化，主要係隨營業收入而變化，考量公司產品銷售情形及產業特性，其存貨淨額變動情形尚屬合理。

2. 存貨去化情形

單位：新台幣千元

項　　目	112 年 6 月底存貨金額	截至 112 年 9 月 30 日存貨去化情形		112 年 9 月 30 日餘額
		金額	比率	
原物料	19,219	10,929	56.87%	8,290
在製品	—	—	—	—
製成品	—	—	—	—
商品存貨	—	—	—	—
合計	19,219	10,929	56.87%	8,290

資料來源：該公司提供。

該公司 112 年 6 月底存貨總額為 19,219 千元，均為原物料存貨，截至 112 年 9 月 30 日之存貨去化金額為 10,929 千元，去化比率約為 56.87%，未去化金額為 8,290 千元，未去化比率為 43.13%，未去化之部分包含製程所需之膠帶，金額為 915 千元，主要係因 111 年供貨交期較長，為建立安全庫存所致；以及切割機台所需之刀片，金額為 2,467 千元，主要係因最低採購數量，且因應產品所需而有不同規格，故去化較緩慢；其餘則為生產所需之各式包材及無塵相關耗材，其金額約 2,931 千元，其庫齡雖長但仍可使用，基於穩健原則，該公司已依照存貨呆滯及跌價損失提列政策，針對二年以上的存貨 100%提列呆滯損失。綜上所述，該公司原物料去化情形尚無重大異常之情事。

3. 備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估

(1)備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列政策

存貨係以實際成本為入帳基礎，成本計價採加權平均法，存貨之後續評價係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較之，淨變現價值係指在正常營業下之估計售價減除估計完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

其存貨呆滯損失提列比率列示如下：

庫齡天數	1-360 日	361-720 日	721 日以上
提列比率	0%	50%	100%

資料來源：該公司提供。

該公司基於行業特性及產品生命週期考量，其存貨跌價及呆滯損失提列政策以存貨庫齡 721 天以上者，即提列 100%呆滯損失，其備抵存貨跌

價及呆滯損失介於採樣公司間。整體而言，該公司之備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策應無重大異常情事。

(2)備抵存貨跌價與呆滯損失提列之適足性評估

單位：新台幣千元

項目＼年度	110 年底	111 年底	112 年 6 月底
備抵存貨跌價及呆滯損失	—	2,216	2,264
期末存貨總額	14,598	17,269	19,219
備抵存貨跌價及呆滯損失比率	—	12.83%	11.78%

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司 110 年度之存貨主要為製程所需之生產性物料，如膠帶、晶粒盤及其他耗材等，並無提列備抵存貨跌價及呆滯損失，隨晶圓薄化市場拓展有成，其製程所需之貴金屬亦隨之增加，該公司自 111 年度起依據存貨呆滯及跌價損失提列政策提列之。

111 年度及 112 年 6 月底之備抵存貨跌價及呆滯損失金額分別為 2,216 千元及 2,264 千元，占期末存貨總額之比率分別為 12.83%及 11.78%，112 年 6 月底備抵存貨跌價及呆滯損失與 111 年度約當，存貨總額則因備料增加而較 111 年底增加至 19,219 千元，使備抵存貨跌價及呆滯損失比率微幅下降至 11.78%，各期提列備抵存貨跌價及呆滯損失金額係依上述政策予以評估提列之。

整體而言，該公司之備抵存貨跌價及呆滯損失政策尚無重大異常，其備抵存貨跌價及呆滯提列之適足性尚屬合理。

4. 與同業比較評估

單位：新台幣千元

項目＼年度		110 年度		111 年度		112 年前二季
		個體	合併	個體	合併	
營業成本	微矽電子	775,456	780,595	823,369	823,369	379,461
	京元電子	18,476,736	23,407,322	18,093,056	23,709,003	10,691,495
	矽格	6,668,505	11,732,806	7,090,077	13,165,811	5,791,273
	昇陽半導體	1,990,099	1,984,744	2,306,263	2,306,263	1,328,115
期末存貨總額	微矽電子	14,598	14,598	17,269	17,269	19,219
	京元電子	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)
	矽格	102,338	313,367	156,801	380,230	415,868
	昇陽半導體	210,452	210,452	317,625	317,625	316,969
備抵存貨跌價及呆滯損失	微矽電子	-	-	2,216	2,216	2,264
	京元電子	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)
	矽格	630	9,289	902	28,306	31,752
	昇陽半導體	44,793	44,793	58,826	58,826	69,737

項目	年度	110 年度		111 年度		112 年前二季
		個體	合併	個體	合併	
期末存貨淨額	微矽電子	14,598	14,598	15,053	15,053	16,955
	京元電子	1,029,780	1,371,473	1,119,883	1,368,626	1,198,514
	矽格	101,708	304,078	155,899	351,924	384,116
	昇陽半導體	165,659	165,659	258,799	258,799	247,232
備抵存貨跌價及呆滯損失占存貨總額比率(%)	微矽電子	-	-	12.83	12.83	11.78
	京元電子	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)
	矽格	0.62	2.96	0.58	7.44	7.64
	昇陽半導體	21.28	21.28	18.52	18.52	22.00
存貨週轉率(次)	微矽電子	45.68	45.99	51.68	51.68	41.60
	京元電子	18.79	18.56	15.99	16.59	16.66
	矽格	67.52	46.08	54.72	37.96	31.47
	昇陽半導體	10.18	7.00	8.73	8.73	10.50
存貨週轉天數(天)	微矽電子	8	8	7	7	9
	京元電子	19	20	23	22	22
	矽格	5	8	7	10	12
	昇陽半導體	36	52	42	42	35

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告及公開資訊觀測站。
註1：採樣公司之財務報告或公開資訊觀測站未揭露之。

該公司 110 年度並無提列備抵存貨跌價及呆滯損失，111 年度之個體備抵存貨跌價及呆滯損失為 2,216 千元，佔期末存貨總額之比率為 12.83%；合併備抵存貨跌價及呆滯損失為 2,216 千元，佔期末存貨總額之比率為 12.83%。112 年前二季備抵存貨跌價及呆滯損失為 2,264 千元，佔期末存貨總額之比率為 11.78%。經與採樣公司相較，各期間之備抵存貨跌價及呆滯損失佔期末存貨總額之比率皆介於採樣公司之間，尚無重大異常之情事。

該公司 110 年度及 111 年度之個體存貨週轉率分別為 45.68 次及 51.68 次，存貨週轉天數分別為 8 天及 7 天；合併存貨週轉率分別為 45.99 次及 51.68 次，存貨週轉天數分別為 8 天及 7 天；112 年前二季存貨週轉率為 41.60 次，存貨週轉天數為 9 天。經與採樣公司相較，該公司存貨週轉率及存貨週轉天數除 110 年度個體介於採樣公司之間，餘均與矽格公司相當或優於採樣公司，尚無重大異常情事。

整體而言，該公司業已依據存貨呆滯及跌價損失提列政策提列之，經評估其提列金額及存貨週轉率與採樣公司相較尚無重大異常情事。

三、最近期及最近二個會計年度之業績概況

(一)列表並說明發行公司最近期及最近二個會計年度營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形

單位：新台幣千元；%

分析項目	年度 公司名稱	110 年度	111 年度		111 年前二季	112 年前二季	
		金額	金額	成長率	金額	金額	成長率
營業收入	微矽電子	1,292,379	1,226,677	(5.08)	687,128	384,383	(44.06)
	京元電子	33,759,389	36,781,996	8.95	18,912,098	15,931,760	(15.76)
	矽格	16,681,264	18,694,345	12.07	9,773,831	7,332,778	(24.98)
	昇陽半導體	2,651,386	3,138,053	18.36	1,457,104	1,786,333	22.59
營業毛利	微矽電子	511,784	403,308	(21.20)	263,543	4,922	(98.13)
	京元電子	10,352,067	13,072,993	26.28	6,931,383	5,240,265	(24.40)
	矽格	4,948,458	5,528,534	11.72	3,087,943	1,541,505	(50.08)
	昇陽半導體	666,642	831,790	24.77	394,183	458,218	16.24
營業利益	微矽電子	310,265	204,482	(34.09)	150,125	(76,982)	(151.28)
	京元電子	6,606,516	9,164,830	38.72	5,001,287	3,376,166	(32.49)
	矽格	3,440,397	3,826,682	11.23	2,240,581	830,296	(62.94)
	昇陽半導體	232,554	307,991	32.44	136,526	170,088	24.58

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司主要係從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC、MOSFET 產品及以 GaN 或 SiC 為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。綜觀台灣上市半導體測試封裝公司其業務型態、產品性質及營業項目後，採以下三家公司做為採樣公司，京元電子股份有限公司（上市股票代號：2449，以下簡稱京元電子）主要營業項目為晶片研磨切割及測試封裝業務，終端應用涵蓋資訊、通訊、辦公室自動化、汽車電子以及消費性電子等相關產品；矽格股份有限公司（上市股票代號：6257，以下簡稱矽格）主要營業項目為測試封裝業務，終端應用涵蓋高速運算、通訊、影音、消費性電子以及車用電子等相關產品；昇陽國際半導體股份有限公司（上市股票代號：8028，以下簡稱昇陽半導體）主要營業項目為晶圓再生服務及晶圓薄化服務，終端應用涵蓋消費性電子、工業用電子產品及汽車等電子元件。茲就該公司與採樣公司之營業收入、營業毛利及營業淨利變化情形比較說明如下：

1. 營業收入

單位：新台幣千元；%

分析項目	年度 公司名稱	110 年度	111 年度		111 年前二季	112 年前二季	
		金額	金額	成長率	金額	金額	成長率
營業收入	微矽電子	1,292,379	1,226,677	(5.08)	687,128	384,383	(44.06)
	京元電子	33,759,389	36,781,996	8.95	18,912,098	15,931,760	(15.76)
	矽格	16,681,264	18,694,345	12.07	9,773,831	7,332,778	(24.98)
	昇陽半導體	2,651,386	3,138,053	18.36	1,457,104	1,786,333	22.59

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業收入分別為 1,292,379 千元、1,226,677 千元及 384,383 千元，較前一年同期衰退率分別為(5.08)%及(44.06)%，營業收入呈下滑情形，主要隨終端應用市場需求程度、景氣循環、市場規模及銷售客戶端營運狀況等因素影響而有所不同。111 年度營業收入較 110 年度減少，主要係驅動 IC 客戶因庫存水位較高且受終端消費性電子產品等需求趨緩，致對驅動 IC 測試服務減少，營業收入下降；112 年前二季較 111 年前二季減少，主要係受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨去化庫存，致該公司測試營業收入下降。

與同業公司相較，該公司最近二個會計年度及 112 年度前二季之營業收入變動趨勢，以營業收入成長率而言，111 年度呈負成長，採樣公司皆為正成長，主係各公司之產品服務組合及終端市場略有不同，該公司因驅動 IC 客戶受終端應用消費性電子產品等需求趨緩，致對該公司驅動 IC 測試服務減少，使該公司營業收入較前一年度下滑，其他同業除消費性電子產品受影響外，尚有網路通訊、記憶體及高效能運算等需求支撐；112 年前二季成長率均低於採樣公司，主係該公司銷售客戶終端需求集中於消費性電子產業，受消費性電子產品終端需求疲弱，客戶尚在去化庫存，致對該公司之測試服務需求減少，採樣公司除京元電子及矽格亦受消費性電子產品終端需求影響外，網路通訊、記憶體及高效能運算等亦進入庫存調整，另昇陽半導體則受惠於先進製程需求，再生晶圓服務需求大幅增加，雖晶圓薄化業務亦受消費性電子需求趨緩及客戶庫存調整而下降，但 112 年前二季之營業收入仍較去年同期成長。整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業收入變化情形與採樣公司相較尚屬合理。

2. 營業毛利

單位：新台幣千元；%

公司名稱	110 年度		111 年度		111 年前二季		112 年前二季	
	金額	毛利率	金額	毛利率	金額	毛利率	金額	毛利率
微矽電子	511,784	39.60	403,308	32.88	263,543	38.35	4,922	1.28
京元電子	10,352,067	30.66	13,072,993	35.54	6,931,383	36.65	5,240,265	32.89
矽格	4,948,458	29.66	5,528,534	29.57	3,087,943	31.59	1,541,505	21.02
昇陽半導體	666,642	25.14	831,790	26.51	394,183	27.05	458,218	25.65

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業毛利分別為 511,784 千元、403,308 千元及 4,922 千元，毛利率分別 39.60%、32.88%及 1.28%。該公司 111 年度營業毛利較 110 年度減少 108,476 千元，毛利率下降幅度為 16.97%，主要係受到測試產品組合之影響，部分測試毛利較高之產品因其客戶受終端消費性電子等需求趨緩，致毛利率隨之下降；該公司 112 年前二季營業毛利較 111 年前二季減少 258,621 千元，毛利率下降幅度為 96.66%，主係受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，營業收入大幅下降，機器設備持續攤提成本，致毛利率隨之下降。

與同業公司相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業毛利

率，110 年度優於所有採樣公司，111 年度則僅次於京元電子，優於矽格及昇陽半導體，112 年前二季因營業收入減少，機器設備持續攤提成本，致毛利率大幅減少，採樣公司京元電子及矽格亦受消費性電子產品終端需求疲弱影響，但因具規模經濟致毛利率減少比率低於該公司，另昇陽半導體受先進製程需求上升，毛利率未有大幅變動。整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業毛利及營業毛利率變動情形與採樣公司相較尚屬合理，尚無重大異常之情事。

3. 營業利益

單位：新台幣千元；%

公司名稱	110 年度		111 年度		111 年前二季		112 年前二季	
	金額	營業利益率	金額	營業利益率	金額	營業利益率	金額	營業利益率
微矽電子	310,265	24.01	204,482	16.67	150,125	21.85	(76,982)	(20.02)
京元電子	6,606,516	19.57	9,164,830	24.92	5,001,287	26.44	3,376,166	21.19
矽格	3,440,397	20.62	3,826,682	20.47	2,240,581	22.92	830,296	11.32
昇陽半導體	232,554	8.77	307,991	9.81	136,526	9.37	170,088	9.52

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業利益(損失)分別為 310,265 千元、204,482 千元及(76,982)千元，營業利益(損失)率分別為 24.01%、16.67%及(20.02)%。該公司 111 年度受係驅動 IC 客戶庫存水位較高且受終端應消費性電子產品等需求趨緩，致營收下滑及毛利減少，營業利益亦隨之下降；112 年前二季受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致產能利用率下降，營業毛利大幅下降，營業利益及營業利益率亦隨之下降。

與同業公司相較，111 年度僅次於京元電子及矽格，112 年前二季受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體測試及封裝服務減少，營業收入大幅下滑，營業利益亦同步下降，致低於採樣公司。整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業利益及營業利益率變動尚無重大異常之情事。

(二) 列表並說明最近期及最近三個會計年度以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

1. 營業收入變化情形

單位：新台幣千元

年度 / 產品	110 年度		111 年度		111 年前二季		112 年前二季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	1,005,426	77.80	926,313	75.51	522,810	76.09	278,313	72.41
半導體封裝	140,438	10.87	109,502	8.93	68,524	9.97	37,909	9.86
晶圓薄化	145,312	11.24	190,862	15.56	95,794	13.94	68,161	17.73
其他	1,203	0.09	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合計	1,292,379	100.00	1,226,677	100.00	687,128	100.00	384,383	100.00

資料來源：該公司提供

2. 營業成本變化情形

單位：新台幣千元

年度 產品	110 年度		111 年度		111 年前二季		112 年前二季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	549,905	70.45	583,078	70.82	301,668	71.22	264,861	69.80
半導體封裝	111,953	14.34	98,581	11.97	51,578	12.18	45,029	11.87
晶圓薄化	113,598	14.55	141,710	17.21	70,339	16.60	69,571	18.33
其他	5,139	0.66	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合計	780,595	100.00	823,369	100.00	423,585	100.00	379,461	100.00

資料來源：該公司提供

3. 營業毛利變化情形

單位：新台幣千元

年度 產品	110 年度		111 年度		111 年前二季		112 年前二季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	455,521	89.00	343,235	85.10	221,142	83.91	13,452	273.30
半導體封裝	28,485	5.57	10,921	2.71	16,946	6.43	(7,120)	(144.65)
晶圓薄化	31,714	6.20	49,152	12.19	25,455	9.66	(1,410)	(28.65)
其他	(3,936)	(0.77)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合計	511,784	100.00	403,308	100.00	263,543	100.00	4,922	100.00

資料來源：該公司提供

4. 主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形

該公司主要營收來源區分為半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化服務。茲就該公司最近二個會計年度及最近期止主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形及原因分析說明：

(1) 半導體測試

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季半導體測試之營業收入分別為 1,005,426 千元、926,313 千元及 278,313 千元，占營業收入比重分別為 77.80%、75.51%及 72.41%；為該公司營收占比最高之服務。半導體測試服務可區分為晶圓測試及成品測試，晶圓測試過程係透過探針與晶粒上的接點接觸，測試其電氣特性是否達設計規範要求，將不合格的晶粒標上記號，而後當晶片依晶粒為單位切割成獨立的晶粒時，標有記號的不合格晶粒會被淘汰，不再進行下一個製程，降低製造成本。成品測試過程係將切割封裝後的積體電路，透過測試機台檢測其功能及性能是否達設計規範要求，是積體電路產製過程中重要一環，該公司檢測設備可提供類比 IC、邏輯 IC、驅動 IC 及功率元件之測試服務。111 年度主要受驅動 IC 客戶高庫存影響，致驅動 IC 測試服務需求下降，半導體測試服務需求減少，故使營收降至 926,313 千元，佔整體銷售金額之比重為 75.51%；112 年前二季受消費性電子產品終端需求疲乏且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體測試服務減少至 278,313 千元，佔整體銷售金額之比重為

72.41%。

在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業成本分別為 549,905 千元、583,078 千元及 264,861 千元，營業毛利分別為 455,521 千元、343,235 千元及 13,452 千元，毛利率分別為 45.31%、37.05%及 4.83%。111 年度主要受客戶產品組合影響，較高毛利之 IC 測試服務需求下降，使營業收入下滑，致毛利率下降至 37.05%；112 年前二季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體測試服務減少，營業收入大幅下滑，毛利隨之下滑，致毛利率下降至 4.83%。

(2) 半導體封裝

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季半導體封裝之營業收入分別為 140,438 千元、109,502 千元及 37,909 千元，占整體營業收入比重分別為 10.87%、8.93%及 9.86%。半導體封裝過程係保護和固定晶粒不受粉塵、水分或外力撞擊的影響，讓積體電路能在各種環境中使用。111 年度主要受驅動 IC 客戶高庫存影響，致驅動 IC 封裝服務需求下降，半導體封裝服務減少，故使營業收入降至 109,502 千元，佔整體銷售金額之比重為 8.93%；112 年前二季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體封裝服務減少，故使營業收入降至 37,909 千元，佔整體銷售金額之比重為 9.86%。

在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業成本分別為 111,953 千元、98,581 千元及 45,029 千元，營業毛利分別為 28,485 千元、10,921 千元及(7,120)千元，毛利率分別為 20.28%、9.97%及(18.78)%。111 年度主要受驅動 IC 客戶高庫存影響，致驅動 IC 封裝服務需求下降，致半導體封裝服務減少，營業收入下滑，致毛利率下降至 9.97%；112 年前二季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體封裝服務減少，營業收入下滑，毛利隨之下滑，未達規模經濟，致毛利率下降至(18.78)%。

(3) 晶圓薄化

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季晶圓薄化之營業收入分別為 145,312 千元、190,862 千元及 68,161 千元，占整體營業收入比重分別為 11.24%、15.56%及 17.73%。晶圓薄化過程係縮小積體電路體積，達到降低電阻及節能散熱之需求，111 年度該公司晶圓薄化服務通過銷售客戶品質肯定及拓展新客戶，致營業收入成長至 190,862 千元，佔整體銷售金額之比重為 15.56%；112 年前二季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致晶圓薄化服務減少，營業收入降至 68,161 千元，佔整體銷售金額之比重為 17.73%。

在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業成本分別為 113,598 千元、141,710 千元及 69,751 千元，營業毛利分別為 31,714 千元、49,152 千元及(1,410)千元，毛利率分別為

21.82%、25.75%及(2.07)%。該公司於 107 年度投入晶圓薄化業務，晶圓薄化製程係縮小積體電路體積，達到降低電阻及節能散熱之需求，製程品質受到客戶肯定，近年陸續投產，致 110 年度毛利率達 21.82%；111 年度該公司持續擴展晶圓薄化產能，隨著客戶薄化需求成長，致毛利率提升至 25.75%；112 年前二季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致晶圓薄化服務減少，營業收入下滑，毛利隨之下滑，未達規模經濟，致毛利率下降至(2.07)%。

(4) 其他

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季其他之營業收入分別為 1,203 千元、0 千元及 0 千元，占整體營業收入比重分別為 0.09%、0%及 0%，在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業成本分別為 5,139 千元、0 千元及 0 千元，營業毛利分別為(3,936)千元、0 千元及 0 千元，毛利率分別為(327.18)%、0%及 0%，其他收入主要係餐飲服務收入，該公司考量未來營運規劃，於 110 年 12 月 30 日處分微石開發(股)公司，故 111 年度起未有其他收入。

(三) 最近期及最近三個會計年度營業收入或毛利率變動達 20%以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

單位：新台幣千元；%

項目＼年度	110 年度	111 年度		111 年前二季	112 年前二季	
	金額	金額	變動率	金額	金額	變動率
營業收入	1,292,379	1,226,677	(5.08)	687,128	384,383	(44.06)
毛利率	39.60	32.88	(16.97)	38.35	1.28	(96.66)

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告

依上表所示，該公司 112 年前二季營業收入及毛利率變動達 20%以上，故就上述期間依主要產品別進行價量變動分析。

單位：新台幣千元；%

主要產品	分析項目	111 年前二季及 112 年前二季	說明
半導體測試	(一)營業收入差異分析		銷貨收入：減少 244,497 千元。 1. 數量差異不利 179,948 千元，係受終端市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，致 112 年前二季測試服務數量較 111 年前二季減少，產生不利之數量差異。 2. 價格差異不利 98,427 千元及組合差異有利 33,878 千元，係受終端市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，故調降售價，致產生價格不利差異。
	P(Q'-Q)	(179,948)	
	Q(P'-P)	(98,427)	
	(P'-P)(Q'-Q)	33,878	
	P'Q'-PQ	(244,497)	
	(二)銷貨成本差異分析		銷貨成本：減少 36,807 千元。 1. 數量差異有利 103,832 千元，係受終端

主要產品	分析項目	111 年前二季及 112 年前二季	說　　明
	P(Q'-Q)	(103,832)	市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，致 112 年前二季測試服務數量較 111 年前二季減少，銷貨成本亦隨之減少，產生有利之數量差異。 2. 價格差異不利 102,203 千元及組合差異有利 35,178 千元，主要係終端市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，致 112 年前二季測試服務數量較 111 年前二季減少，致平均單位成本上升，產生不利之價格差異。
	Q(P'-P)	102,203	
	(P'-P)(Q'-Q)	(35,178)	
	P'Q'-PQ	(36,807)	
	(三)毛利變動金額	(207,690)	毛利差異：112 年前二季較 111 年前二季減少 207,690 千元。
半導體封裝	(一)營業收入差異分析		銷貨收入：減少 30,615 千元。 1. 數量差異不利 29,846 千元，係受終端市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，致 112 年前二季封裝服務數量較 111 年前二季減少，產生不利之數量差異。 2. 價格差異不利 1,362 千元及組合差異有利 593 千元，係受終端市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，產能利用率下降，致平均售價下降，產生價格不利差異。
	P(Q'-Q)	(29,846)	
	Q(P'-P)	(1,362)	
	(P'-P)(Q'-Q)	593	
	P'Q'-PQ	(30,615)	
	(二)銷貨成本差異分析		銷貨成本：減少 6,549 千元。 1. 數量差異有利 22,465 千元，係受終端市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，致 112 年前二季封裝服務數量較 111 年前二季減少，銷貨成本亦隨之減少，產生有利之數量差異。 2. 價格差異不利 28,198 千元及組合有利差異 12,282 千元，主要係終端市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，致 112 年前二季封裝服務數量較 111 年前二季減少，致平均單位成本上升，產生不利之價格差異。
	P(Q'-Q)	(22,465)	
	Q(P'-P)	28,198	
	(P'-P)(Q'-Q)	(12,282)	
	P'Q'-PQ	(6,549)	
	(三)毛利變動金額	(24,066)	毛利差異：綜上所述 112 年前二季毛利較 111 年前二季減少 24,066 千元。
晶圓薄化	(一)營業收入差異分析		銷貨收入：減少 27,633 千元。 1. 數量差異不利 31,012 千元，係受終端市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，致 112 年前二季晶圓薄化服務數量較 111 年前二季減少，產生不利之數量差異。 2. 價格差異有利 4,997 千元及組合差異不利 1,618 千元，係受晶圓薄化成本提升，調整晶圓薄化售價，產生價格有利差異。
	P(Q'-Q)	(31,012)	
	Q(P'-P)	4,997	
	(P'-P)(Q'-Q)	(1,618)	
	P'Q'-PQ	(27,633)	

主要產品	分析項目	111 年前二季及 112 年前二季	說　　明
	(二)銷貨成本差異分析		銷貨成本：減少 769 千元。 1. 數量差異有利 22,772 千元，係受終端市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，致 112 年前二季晶圓薄化服務數量較 111 年前二季減少，銷貨成本亦隨之減少，產生有利之數量差異。 2. 價格差異不利 32,537 千元及組合差異有利 10,534 千元，主要係終端市場需求疲乏且客戶存貨尚在去化，致 112 年前二季晶圓薄化服務數量較 111 年前二季減少，致平均單位成本上升，產生不利之價格差異。
	P(Q'-Q)	(22,772)	
	Q(P'-P)	32,537	
	(P'-P)(Q'-Q)	(10,534)	
	P'Q'-PQ	(769)	
	(三)毛利變動金額	(26,864)	毛利差異：綜上所述 112 年前二季毛利較 111 年前二季減少 26,864 千元。

資料來源：該公司提供；兆豐證券整理

註：P'及 Q'為最近年度單價及數量；P 及 Q 為上一年度單價及數量

四、併購他公司尚未屆滿一完整會計年度者，評估併購之目的、效益、交易合理性等因素

該公司並無併購他公司尚未屆滿一完整會計年度之情事，故不適用本項評估。

肆、財務狀況

一、列表並說明最近期及最近二個會計年度財務比率之分析，與同類別上市公司及未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力及獲利能力

(一)選擇採樣公司之理由

該公司主要係從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC、MOSFET 產品及以 GaN 或 SiC 為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。綜觀台灣上市半導體測試封裝公司其業務型態、產品性質及營業項目後，採以下三家公司做為採樣公司，京元電子股份有限公司（上市股票代號：2449，以下簡稱京元電子）主要營業項目為晶片研磨切割及測試封裝業務，終端應用涵蓋資訊、通訊、辦公室自動化、汽車電子以及消費性電子等相關產品；矽格股份有限公司（上市股票代號：6257，以下簡稱矽格）主要營業項目為測試封裝業務，終端應用涵蓋高速運算、通訊、影音、消費性電子以及車用電子等相關產品；昇陽國際半導體股份有限公司（上市股票代號：8028，以下簡稱昇陽半導體）主要營業項目為晶圓再生服務及晶圓薄化服務，終端應用涵蓋消費性電子、工業用電子產品及汽車等電子元件。同業方面之參考資料，係採用財團法人金融聯合徵信中心出版之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」之「電子零組件製造業」資料，作為同業平均之比較數據。

(二)最近期及最近二個會計年度財務比率分析與同業比較

分析項目		公司別	110 年度	111 年度	112 年前二季
財務結構	負債占資產比率(%)	微矽電子	45.36	38.01	41.83
		京元電子	51.71	50.31	49.56
		矽格	51.30	48.41	52.08
		昇陽半導體	60.22	65.21	66.73
		同業平均	48.10	46.60	(註 2)
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	微矽電子	112.71	126.28	108.34
		京元電子	128.13	133.53	132.20
		矽格	156.44	174.51	176.13
		昇陽半導體	127.04	130.89	117.15
		同業平均	207.47	195.69	(註 2)
償債能力	流動比率(%)	微矽電子	120.03	163.49	114.65
		京元電子	169.14	218.06	161.58
		矽格	192.97	277.21	209.00
		昇陽半導體	106.91	163.52	120.20
		同業平均	175.80	181.80	(註 2)
	速動比率(%)	微矽電子	116.32	156.95	108.68
		京元電子	153.91	201.13	145.71
		矽格	179.33	261.11	198.94
		昇陽半導體	96.25	141.75	105.40
		同業平均	137.60	138.50	(註 2)
	利息保障倍數(倍)	微矽電子	31.69	19.97	(9.87)
		京元電子	20.96	17.15	10.27
		矽格	23.17	21.90	9.79
		昇陽半導體	13.54	13.17	10.36
		同業平均	4,026.10	3,024.40	(註 2)
經營能力	應收款項週轉率(次)	微矽電子	3.89	4.03	3.39
		京元電子	4.94	5.04	4.49
		矽格	4.58	4.79	3.93
		昇陽半導體	5.73	7.15	8.20
		同業平均	5.70	5.90	(註 2)
	平均收現天數(天)	微矽電子	94	91	107
		京元電子	74	72	81
		矽格	80	76	93
		昇陽半導體	64	51	45
		同業平均	64	62	(註 2)

分析項目			公司別	110 年度	111 年度	112 年前二季
	存貨週轉率(次)		微矽電子	45.99	51.68	41.60
			京元電子	18.56	16.59	16.66
			矽格	46.08	37.96	31.47
			昇陽半導體	7.00	8.73	10.50
			同業平均	6.40	5.60	(註 2)
	平均銷貨天數(天)		微矽電子	8	7	9
			京元電子	20	22	22
			矽格	8	10	12
			昇陽半導體	52	42	35
			同業平均	57	65	(註 2)
	不動產、廠房及設備週轉率(次)		微矽電子	1.09	0.92	0.54
			京元電子	0.80	0.80	0.70
			矽格	1.01	1.02	0.84
			昇陽半導體	0.82	0.68	0.62
			同業平均	2.90	2.70	(註 2)
	總資產週轉率(次)		微矽電子	0.68	0.58	0.36
			京元電子	0.51	0.50	0.44
			矽格	0.50	0.50	0.39
			昇陽半導體	0.46	0.42	0.41
			同業平均	0.90	0.80	(註 2)
獲利能力	資產報酬率(%)		微矽電子	14.23	8.36	(5.21)
			京元電子	8.25	10.13	3.86
			矽格	9.56	9.93	2.49
			昇陽半導體	4.81	4.72	2.24
			同業平均	11.40	11.70	(註 2)
	權益報酬率(%)		微矽電子	26.47	13.72	(9.17)
			京元電子	16.30	19.44	7.71
			矽格	18.53	18.89	5.02
			昇陽半導體	10.54	11.81	6.59
			同業平均	21.20	21.50	(註 2)
	占實收資本額比率(%)	營業利益	微矽電子	50.86	31.62	(23.81)
			京元電子	54.03	74.95	(註 3)
			矽格	76.10	83.78	(註 3)
			昇陽半導體	16.57	20.18	(註 3)
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 2)
		稅	微矽電子	52.87	35.13	(21.59)

分析項目			公司別	110 年度	111 年度	112 年前二季
		前純益	京元電子	56.06	73.33	(註 3)
			矽格	81.02	96.91	(註 3)
			昇陽半導體	18.69	24.42	(註 3)
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 2)
	純益率(%)		微矽電子	20.10	13.72	(15.18)
			京元電子	15.50	18.98	17.68
			矽格	18.2	18.8	12.92
			昇陽半導體	9.62	10.36	10.88
			同業平均	12.00	12.80	(註 2)
	每股盈餘(元)		微矽電子	4.31	2.70	(0.90)
			京元電子	4.23	5.59	2.24
			矽格	6.25	6.68	1.62
			昇陽半導體	1.58	2.17	1.27
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 2)
現金流量	現金流量比率(%)		微矽電子	109.91	104.46	33.59
			京元電子	123.14	185.76	53.42
			矽格	92.79	139.45	32.73
			昇陽半導體	39.67	61.79	14.65
			同業平均	30.30	40.40	(註 2)
	現金流量允當比率(%)		微矽電子	109.90	103.22	99.91
			京元電子	87.72	93.64	(註 3)
			矽格	83.46	91.46	(註 3)
			昇陽半導體	55.09	41.83	(註 3)
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 2)
	現金再投資比率(%)		微矽電子	21.64	13.45	6.44
			京元電子	7.86	10.19	(註 3)
			矽格	12.27	11.69	(註 3)
			昇陽半導體	6.10	6.60	(註 3)
			同業平均	8.40	10.30	(註 2)

資料來源：公開資訊觀測站各公司年報及經會計師查核簽證或核閱之財務報告；同業資料取自兆豐整理資料、公開資訊觀測站及財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」，行業類別為「電子零組件製造業」之財務比率。

註 1：「中華民國台灣地區主要行業財務比率」未揭露該項比率。

註 2：截至評估報告出具日止，未有揭露季度之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」，故未揭露。

註 3：「公開資訊觀測站」未揭露該項比率。

各項財務分析比率之計算公式，列式如下：

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額

2. 償債能力*

(1) 流動比率＝流動資產／流動負債

(2) 速動比率＝(流動資產－存貨－預付費用)／流動負債

(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

(2) 平均收現天數＝365／應收款項週轉率

(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額

(4) 平均銷貨日數＝365／存貨週轉率

(5) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額

(6) 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額

(2) 權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額

(3) 營業利益占實收資本額比率＝營業利益／期末實收資本額

(4) 稅前純益占實收資本額比率＝稅前純益／期末實收資本額

(5) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額

(6) 每股盈餘＝(歸屬於母公司業主之損益－特別股股利)／加權平均已發行股數

5. 現金流量*

(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債

(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3) 現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)

(三) 財務比率變動分析及與同業之比較分析說明

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率

該公司最近二個會計年度及 112 年第二季底之負債占資產比率分別為 45.36%、38.01%及 41.83%。111 年度之負債占資產比率較 110 年度下降至 38.01%，主係該公司為增建廠房及新增設備之資金需求，新增長期借款 60,000 千元，但因 111 年度辦理現金增資償還短期借款，致負債總額較前一年底減少 9.66%，另資產總額因增建廠房及新增設備而成長 8%，

致負債占資產比率減少。112 年前二季因增建廠房及購置機器設備等之其他應付款較 111 年底增加 47,336 千元，及因受營收下滑之影響致現金及應收款項淨額亦較 111 年底減少，致負債占資產比率較 111 年度上升至 41.83%。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年第二季底之負債占資產比率均低於採樣公司及同業平均，經評估尚無重大異常之情事。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司最近二個會計年度及 112 年第二季底之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 112.71%、126.28%及 108.34%。該公司於 111 年辦理現金增資，加上持續獲利使得權益較 110 年度增加；考量近年來之營運發展需求及因應功率元件、第三代半導體測試服務及晶圓薄化需求成長，該公司決議增建竹南廠廠房，其資金來源，除以自有資金負擔投資額的 20%，餘 80%的投資額係向金融機構辦理融資，使得長期借款較 110 年度增加。另 111 年度擴建竹南廠廠房及添購生產設備使得不動產、廠房及設備淨額較 110 年度增加 7.70%，因其增加幅度小於權益及長期負債之增加幅度，致 111 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升至 126.28%。112 年前二季因持續添購測試機及增建工程陸續完工，不動產、廠房及設備淨額較 111 年度增加 5.67%，其成長幅度高於權益及長期負債之增加幅度，致長期資金占不動產、廠房及設備比率下降至 108.34%。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年第二季底之長期資金占不動產、廠房及設備比率均低於採樣公司及同業平均，然皆超過 100%，經評估尚無重大異常情事。

整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之財務結構尚屬穩健。

2. 償債能力

(1)流動比率及速動比率

該公司最近二個會計年度及 112 年第二季底之流動比率分別為 120.03%、163.49%及 114.65%；速動比率分別為 116.32%、156.95%及 108.68%，111 年度之流動比率及速動比率較 110 年度增加，主係該公司於 111 年第三季為充實營運資金而辦理現金增資，使流動資產增加 2.75%，另該公司為降低升息所帶來之利息負擔而償還短期借款 80,000 千元，使流動負債下降 24.57%所致。112 年第二季底之流動比率及速動比率均較 111 年度下降，主係受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，依完工比例認列之合約資產減少 26,638 千元，流動資產下降所致。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司 110 年度之流動比率介於採樣公司及同業平均之間，111 年度及 112 年第二季底之流動比率均低於採樣公司及同業平均，110 年度、111 年度及 112 年第二季底之速動比率均介於採樣公司及同業平均之間，整體而言，該公司最近二個會計年度及 112

年第二季底之流動比率均高於 100%，且與同業相較，經評估尚無重大異常情事。

(2)利息保障倍數

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之利息保障倍數分別為 31.69 倍、19.97 倍及(9.87)倍，呈現下滑之趨勢，主係 111 年度及 112 年前二季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務,該公司之營業收入減少，稅前淨利亦隨之減少，112 年前二季因虧損，致利息保障倍數產生負數之情事。

經與採樣公司及同業平均相較,該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之利息保障倍數均與採樣公司及同業互有高低,經評估尚無重大異常之情事。

綜上所述,該公司流動比率、速動比率及利息保障倍數等指標尚屬健全,顯示該公司償債能力尚屬允當。

3.經營能力

(1)應收帳款週轉率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之合併應收款項週轉率及應收款項週轉天數分別為 3.89 次、4.03 次、3.39 次及 94 天、91 天、107 天，應收款項週轉率主要係隨該公司營收變化而變動，該公司 111 年度應收款項週轉率較 110 年度上升，主係 111 年受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務需求減少，營業收入下降，應收款項亦隨之減少，加上應收款項收款情形良好，期末應收款項金額下降，營業收入減少比率小於平均應收款項減少比率所致；112 年前二季應收款項週轉率較 111 年度下降，主係 112 年前二季受消費性電子終端需求趨緩及客戶調整庫存影響，112 年前二季營業收入較去年同期減少 302,745 千元，減少幅度 44.06%，營業收入減少，應收款項亦隨之下降，減少幅度 17.79%，因營業收入減少比率大於平均應收帳款減少比率，使應收款項收回天數較 111 年度增加。

經與採樣公司及同業平均相較,該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之應收帳款週轉率皆低於採樣公司及同業平均,經評估尚無重大異常之情事。

(2)存貨週轉率

該公司 110 年底、111 年底及 112 年 6 月底存貨週轉率分別為 45.99 次、51.68 次及 41.60 次，存貨週轉天數分別為 8 天、7 天及 9 天。基於產業特性,其存貨占營業成本比例甚低,故存貨周轉率高及週轉天數短,111 年下半年起受終端市場需求變化趨緩致客戶調整減少產品測試封裝服務之影響，營業收入及存貨平均值皆較 111 年度減少，其減少幅度分別為 5.08%及 6.13%，惟晶圓薄化製程所需之貴金屬成本較高，致整體營業成本增加 5.48%，故存貨週轉率微幅上升至 51.68 次；112 年前二季消費性電子終端需求仍趨緩，致營業收入及營業成本皆下降，存貨週轉率下降至

41.60 次，存貨週轉天數增加至 9 天。各期間之存貨周轉率及天數約當，尚無重大差異之情形。

經與採樣公司及同業平均相較,該公司存貨週轉率及存貨週轉天數皆優於採樣公司及同業平均，尚無重大異常情事。

(3)不動產、廠房及設備週轉率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 1.09 次、0.92 次及 0.54 次。不動產、廠房及設備週轉率呈現逐年下降之趨勢，主係該公司於 111 年度開始投入增建竹南廠廠房計畫案，又 111 年度及 112 年前二季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得營業收入減少，故不動產、廠房及設備週轉率呈現逐年下降之情形。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度之不動產、廠房及設備週轉率均介於採樣公司及同業平均之間，112 年前二季因該公司持續擴充產能增加設備之購置，以致低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

(4)總資產週轉率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之總資產週轉率分別為 0.68 次、0.58 次及 0.36 次。總資產週轉率呈現逐年下降之趨勢，111 年度之總資產週轉率較 110 年度下降，主係該公司於 111 年度開始投入增建竹南廠廠房計畫案，致總資產金額增加，且受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得營業收入減少，致總資產週轉率下降。112 年前二季因償還部分長期借款，致總資產金額減少，惟營業收入之減少幅度大於總資產減少幅度，致總資產週轉率下降至 0.36 次。

經與採樣公司及同業平均相較,該公司最近二個會計年度之總資產週轉率均介於採樣公司及同業平均之間，112 年前二季總資產週轉率低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之經營能力應無重大異常。

4.獲利能力

(1)資產報酬率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之資產報酬率分別為 14.23%、8.36%、及(5.21)%，資產報酬率呈現逐年下降之趨勢，主係 111 年度及 112 年前二季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司 110 年度及 111 年度之資產報酬率均介於採樣公司及同業平均之間，112 年前二季低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

(2)權益報酬率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之權益報酬率分別為

26.47%、13.72%、及(9.17)%。權益報酬率呈現逐年下降趨勢，主係因 111 年度及 112 年前二季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司 110 年度之權益報酬率高於採樣公司及同業平均，111 年度之權益報酬率介於採樣公司及同業平均之間，112 年前二季低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

(3)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之營業利益占實收資本額比率分別為 50.86%、31.62%及(23.81)%，稅前純益占實收資本額比率分別為 52.87%、35.13%及(21.59)%，營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率呈現下滑之趨勢，主係因 111 年度及 112 年前二季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得營業利益及稅前純益均較前一年度減少。

經與採樣公司相較，該公司最近二個會計年度之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均介於採樣公司之間，經評估尚無重大異常之情事。

(4)純益率及每股盈餘

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之純益率分別為 20.10%、13.72%及(15.18)%，每股盈餘分別為 4.31 元、2.70 元及(0.90)元。純益率及每股盈餘呈現下滑之趨勢，主係受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之純益率與採樣公司及同業互有高低；最近二個會計年度之每股盈餘均介於採樣公司之間，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之獲利能力應無重大異常。

5. 現金流量

(1)現金流量比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之現金流量比率分別為 109.91%、104.46%及 33.59%。現金流量比率呈現下滑之趨勢，111 年度及 112 年前二季之現金流量比率分別較前一年度及去年同期減少，主係受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，111 年度及 112 年前二季之稅後淨利分別較前一年度及去年同期減少所致。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之現金流量比率均介於採樣公司與同業平均之間，經評估尚無重大異常之情事。

(2)現金流量允當比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之現金流量允當比率分別為 109.90%、103.22%及 99.91%。此係衡量公司由營業活動所產生之現金，

是否足以應付公司的業務成長以及支付現金股利之所需。現金流量比率呈現下滑之趨勢，111 年度及 112 年前二季之現金流量允當比率均較前期下降，主係該公司於 111 年度開始投入增建竹南廠廠房計畫案，包括擴建生產線及購置測試機器設備，使資本支出不斷擴張，且 111 年度現金股利發放金額亦較過去年度增加所致。

經與採樣公司相較，該公司最近二個會計年度之現金流量允當比率均高於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

(3)現金再投資比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之現金再投資比率分別為 21.64%、13.45%及 6.44%。111 年度之現金再投資比率較 110 年度下降，主係受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得營業收入下滑，亦致營業活動之淨現金流入減少約 77,962 千元，加上竹南廠廠房增建工程開始投入，不動產、廠房及設備總額增加 325,126 千元所致。112 年前二季之現金再投資比率較 111 年度下降，主係終端消費性需求仍持續低迷，使獲利能力仍較 111 年度下滑，致營業活動之淨現金流入較去年同期減少 37.88%。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度之現金再投資比率均大於採樣公司及同業平均，經評估尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司最近二個會計年度及 112 年前二季之各項現金流量各項指標變化情形，尚屬合理，與採樣公司及同業平均比較，經評估尚無重大異常之情事。

(四)依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第四條第二項或第三項或第二十八條之一第五項或第六項或科技事業或文化創意事業申請股票上市者，應另列明其最近一個會計年度及最近期財務報告歸屬於母公司業主之權益，暨評估其申請上市年度及未來一年度歸屬於母公司業主之權益繼續達實收資本額三分之二以上之可能性。

該公司非以「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第四條第二項或第三項或第二十八條之一第五項或第六項或科技事業或文化創意事業申請股票上市，故不適用。

(五)若屬申請創新板上市者，應另列明申請上市月份至預計掛牌後 12 個月之各月份現金收支預測表，暨評估其是否符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第二十九條第一項第三款之規定。

依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第二十九條第一項第三款之規定，申請公司市值達新臺幣十億元以上，最近四季財務報告所示之營業收入合計不低於新臺幣一億元，且需證明有足供上市掛牌後十二個月之營運資金。

微矽電子公司申請上市月份至預計掛牌月份之各月份現金收支預測表

單位：新臺幣千元

項目＼月份	112/10 (申請時)	112/11	112/12	113/01	113/02	113/03	113/04	113/05 (掛牌時)
期初現金餘額 1	274,992	271,552	280,745	285,948	300,105	280,768	291,198	335,375
加：非融資性收入 2								
應收帳款收現	79,742	78,930	76,910	91,736	79,866	76,197	77,700	78,000
其他應收款	13	13	600	14	14	14	14	14
合計	79,755	78,943	77,510	91,750	79,880	76,211	77,714	78,014
減：非融資性支出 3								
應付帳款付現	7,500	6,200	6,150	6,150	6,100	6,100	7,500	6,150
薪資付現	28,000	28,000	28,000	28,500	51,000	28,500	28,980	28,500
費用付現	15,000	24,800	24,850	25,265	25,265	25,500	25,550	23,000
稅捐	—	800	320	800	—	800	—	24,430
不動產、廠房及設備	30,000	26,000	20,000	54,000	54,000	43,000	60,000	54,000
合計	80,500	85,800	79,320	114,715	136,365	103,900	122,030	136,080
要求最低現金餘額 4	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
所需資金總額 5=3+4	340,500	345,800	339,320	374,715	396,365	363,900	382,030	396,080
融資前可供支用現金餘額(短絀)6=1+2-5	14,247	4,695	18,935	2,983	(16,380)	(6,921)	(13,118)	17,309
融資淨額 7								
短期借款	—	30,000	20,000	50,000	—	—	—	—
長期借款	10,000	—	—	—	50,000	50,000	100,000	—
短期借款還款	—	—	—	—	—	—	—	(100,000)
長期借款還款	(12,695)	(13,950)	(12,987)	(12,878)	(12,852)	(11,881)	(11,507)	(12,360)
發行新股	—	—	—	—	—	—	—	141,470
合計	(2,695)	16,050	7,013	37,122	37,148	38,119	88,493	29,110
期末現金餘額 8=1+2-3+7	271,552	280,745	285,948	300,105	280,768	291,198	335,375	306,419

公司申請上市月份至預計掛牌月份之各月份現金收支預測表

單位：新臺幣千元

項目＼月份	113/06	113/07	113/08	113/09	113/10	113/11	113/12	114/01	114/02	114/3	114/4	114/5
期初現金餘額 1	306,419	304,156	304,955	328,129	326,520	339,137	340,154	348,776	342,944	340,063	368,553	369,267
加：非融資性收入 2 應收帳款收現	87,250	83,500	85,000	83,000	85,000	83,500	80,000	79,000	80,000	82,500	84,500	85,000
其他應收款	700	14	14	14	14	14	700	14	14	14	14	14
合計	87,950	83,514	85,014	83,014	85,014	83,514	80,700	79,014	80,014	82,514	84,514	85,014
減：非融資性支出 3 應付帳款付現	6,150	6,150	6,100	6,100	7,500	6,150	6,150	6,100	6,100	6,150	6,500	6,150
薪資付現	28,500	28,500	28,500	40,250	28,500	28,500	28,500	51,000	29,000	29,000	29,500	41,000
員工酬勞及董事酬勞	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
費用付現	23,000	25,950	26,000	25,950	25,000	25,850	25,000	25,000	25,850	25,850	25,850	25,850
稅捐	1,000	800	—	20,800	—	800	350	800	—	800	—	4,000
不動產、廠房及設備	50,000	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	12,413	12,413	12,413	12,413	12,413
合計	108,650	101,400	100,600	123,100	91,000	91,300	90,000	95,313	73,363	74,213	74,263	89,413
要求最低現金餘額 4	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
所需資金總額 5=3+4	388,650	381,400	380,600	403,100	371,000	371,300	370,000	375,313	353,363	354,213	354,263	369,413
融資前可供支用現金餘額(短絀)6=1+2-5	5,719	6,270	9,369	8,043	40,534	51,351	50,854	52,477	69,595	68,364	98,804	84,868
融資淨額 7 短期借款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長期借款	30,000	30,000	50,000	50,000	30,000	20,000	30,000	20,000	—	30,000	—	30,000
短期借款還款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長期借款還款	(11,563)	(11,315)	(11,240)	(11,523)	(11,397)	(11,197)	(12,078)	(9,533)	(9,532)	(9,811)	(9,537)	(9,540)
發行新股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	18,437	18,685	38,760	38,477	18,603	8,803	17,922	10,467	(9,532)	20,189	(9,537)	20,460
期末現金餘額 8=1+2-3+7	304,156	304,955	328,129	326,520	339,137	340,154	348,776	342,944	340,063	368,553	369,267	385,328

該公司申請上市時之股數為 64,660 千股，每股暫定承銷價為 35 元，推估申請創新板上市時之市值為 22.63 億元，已符合市值達新臺幣 10 億元以上之規定；另最近四季營業收入為 923,932 千元，亦符合營業收入不低於新臺幣一億元之規定。該公司申請股票創新板上市，營收與市值已符合上市審查準則第二十九條第一項第三款第一目之規定。

該公司自 113 年 6 月(預計掛牌次月)至 114 年 5 月(掛牌後十二個月)之現金收支預測表，該公司預計於掛牌後十二個月內之非融資收入及支出分別 999,790 千元及 1,112,615 千元，其編製預估數係依據 112 年前二季之實際營運情形，並考量未來預計之產銷情形、收付款政策、用人費用、利息支出及資本支出等因素編製而成，經檢視其編製底稿，尚屬合理。另該公司預計 113 年 5 月掛牌，掛牌當月現金增加金額係依據本次上市之暫定承銷價 35 元及掛牌前預計現增股數 4,042 千股，故預計募資金額為 141,470 千元，掛牌後之期末現金及約當現金為 306,419 千元，掛牌後 12 個月(113 年 6 月~114 年 5 月)之非融資性收入為 999,790 千元、因營運所需之融資金額為 191,734 千元，合計金額為 1,497,943 千元，占掛牌後 12 個月之非融資性支出 1,112,615 千元的 134.63%。經評估，該公司已符合法規規定，未有重大異常之情事。

二、發行公司及其各子公司（包括母子公司間交易事項）之最近期及最近二個會計年度背書保證、重大承諾及資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估其對發行公司財務狀況之影響

(一) 背書保證情形

該公司依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂有「背書保證作業程序」作為其為他人背書或提供保證之依據，並經董事會通過及提報股東會同意後實施。經檢視該公司最近二個會計年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及截至目前為止之董事會與股東會議事錄、背書保證備查簿、公開資訊觀測站公告等資料等，該公司並無為他人背書保證之情事。

(二) 重大承諾情形

經查閱該公司最近二個會計年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及檢視重大合約，其承諾事項主要係擴建廠房及採購機器設備之合約，係為配合營運活動及未來業務發展所產生，其性質及餘額並無重大異常之情事，對該公司財務狀況並無重大不利之影響。

單位：新台幣千元

項目/年度	112 年 6 月 30 日	111 年 12 月 31 日	110 年 12 月 31 日
已簽約但尚未發生之資本支出	583,928	520,154	274,971

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(三) 資金貸與他人情形

該公司依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂有「資金貸與他人作業程序」作為其資金貸與他人之依據，並經董事會通過及提報股東會

同意後實施。經檢視該公司最近二個會計年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及截至目前為止之董事會與股東會議事錄，並查詢公開資訊觀測站，該公司並無為他人資金貸與之情事。

(四)衍生性商品交易情形

該公司依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定「取得或處分資產處理程序」中訂有「衍生性金融商品之作業程序」，作為從事衍生性商品交易之依據，並經董事會通過及提報股東會同意後實施。經檢視該公司最近二個會計年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及截至目前為止之董事會與股東會議事錄，該公司並無從事衍生性商品交易之情事。

(五)重大資產交易情形

該公司依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂有「取得或處分資產處理程序」作為該公司從事相關交易之依據，並經董事會通過及提報股東會同意後實施。經參閱該公司最近二個會計年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及截至目前為止之董事會與股東會議事錄，並查詢公開資訊觀測站之重大訊息，該公司並無之重大資產交易情形。

三、列明申請年度截至最近期止擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性

該公司主要業務範圍包含半導體測試服務、半導體封裝服務及晶圓薄化，為專業之半導體後段製程服務公司。另外，該公司以「節能」為發展核心，專注在可以提升能源轉換效率的關鍵元件，包括電源管理 IC 及功率元件等功率半導體。該公司亦同步提供探針卡製造、晶圓研磨、晶圓金屬鍍膜、晶圓切割、晶粒挑揀等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，成為該公司爭取客戶合作並與客戶建立長期合作夥伴關係的競爭利基，並藉由所提供的服務，幫助終端客戶達到「節能減碳」的目的，成為「節能價值鏈的重要夥伴」。

功率半導體應用於所有的電子產品，其特性及使用會影響系統整體的電源轉換效率，隨著電子產品能效規範的提升要求，其重要性持續增加。另就其產品設計而言，雖然積體電路的發展可將許多分離式元件整合在一個積體電路上，但由於技術、成本及散熱等因素，功率半導體將無法完全被取代。功率半導體產業雖有受總體經濟、消費性終端需求及供應鏈庫存水位的短期波動影響，惟長期發展與成長動能仍屬可期。該公司竹南廠與竹東廠之空間主要供存放機器設備、部分存貨及管理部辦公室使用，已無多餘空間可擴充產能。考量近年來之營運發展需求及未來整體長期經營規劃，故該公司於 110 年 12 月 17 日董事會決議通過增建竹南廠廠房計畫案。茲將該公司本次增建廠房之計畫內容、資金來源、工作進度、預計效益及其計畫可行性評估敘明如下：

(一)計畫內容

地點	擴廠計畫內容	用途
廣源科技園區 友義路230號	擴建廠房	滿足辦公及擴產之空間需求。新廠房除供辦公區域所需外，增建2條智能化生產線藉由「製

		造執行系統」進行整體控管及數位化管理，針對設備的狀態與貨批的生產流程進行智慧化控管，以提升生產品質及生產效率。
	購買機器設備	因應未來晶圓薄化及功率半導體測試服務需求成長。

該公司於 111 年 4 月動工進行竹南廠增建工程，參見該公司已發包之工程承攬合約內容，預期擴建之總坪數為 3,668 坪，除了 1 樓及 2 樓規劃擴建車道及辦公室外，3 樓及 4 樓均規劃擴建作業廠房供擺放測試之機器設備及建置智能化生產線。另，本次廠房擴建工程，該公司選擇採用「綠建築設計」落實減少碳排放，以響應政府之『臺灣 2050 淨零排放』政策。

(二) 資金來源

單位：新臺幣千元

計畫項目	預計所需資金	資金來源		資金運用進度			
		自有資金	銀行融資	111 年度(實際)	112 年度(預計)	113 年度(預計)	114 年度(預計)
擴建廠房	510,000	102,000	408,000	237,450	135,600	136,950	-
購買機器設備	1,045,800	209,160	836,640	38,000	318,200	540,640	148,960
合計	1,555,800	311,160	1,244,640	275,450	453,800	677,590	148,960

資料來源：該公司提供。

該公司本次擴廠計畫之資金來源，以自有資金負擔投資額的 20%，餘 80%的投資額依據「根留臺灣企業加速投資行動方案」計畫，向金融機構辦理融資。於興建廠房方面，其主要工程包含廠房主體結構、無塵室及消防等工程，預估整體廠房興建工程總價 510,000 仟元。其中 102,000 仟元為自有資金外，餘 408,000 仟元則向金融機構辦理融資為支應；另機器設備採買價金約 1,045,800 仟元，其中 209,160 仟元為自有資金完成購置外，餘 836,640 仟元則向金融機構辦理融資為支應。

(三) 工作進度

計畫項目	內　　容	截至評估查核日止(實際進度)	未完預計完成日		
			112年下半年度	113年度	114年度
擴建廠房	廠房主體工程	完成第五期工程-外牆RC結構完成	將依工程合約約定進度施工	預計驗收竣工	已完工
	無塵室新建工程	完成第二期工程			
	消防工程	尚未進行			
購買機器設備	智能針測機	已採購50%之機台	陸續向供應商下單採購		
	其他設備	後續依客戶訂單需求導入			

本次擴廠工作進度，依該公司之擴建廠房計畫，其主體工程業於 111 年 3 月間經詢比議價後發包予建築承攬商後即開始動工，工程施作預估約為一年，截至

評估日止依工程合約施工進度已至第五期工程，同時亦完成無塵室第二期工程，預期新廠房整體擴建工程將於 113 年第一季竣工，屆時除將部分產線設備遷移至擴建區域外，亦將添購置智能針測機、智能測試機及其他設備，用以投入功率元件及電源管理 IC 之晶圓測試及晶圓薄化作業。

(四)預計效益

本次擴廠計畫所購買之機器設備於 112 年陸續投入資金後進行採購，部分機器設備先安置於舊廠區生產線以從事生產，至 113 年度新建廠房竣工，待生產線安排、安裝、試車及驗收即可陸續投入生產。其資金運用進度係配合產能規劃、設備下訂、安裝、試車及付款流程等予以擬定，應屬合理。

該公司以提供提升電子產品省電效能之關鍵元件為其測試服務之核心產品，省電效能之關鍵元件主要包括電源管理IC與功率元件。另外，隨著電動車、新能源、5G 及低軌衛星等市場趨勢下，未來第三代半導體已成不可或缺的重要元件，其具備高熱導率、高擊穿電場、高電子遷移率等特性，可大幅提升效率、減少耗電量及縮小體積等優勢。該公司於 103 年度即切入 GaN 晶圓測試領域，累積豐富測試技術及經驗。雖然 112 年度終端市場需求仍舊低迷使得該公司營收放緩，但該公司預期 112 年度下半年在庫存調整接近尾聲後景氣有望逐步復甦，故該公司計畫擴建 2 條智能化生產線，購置應用於電源管理 IC、功率元件及晶圓鍍膜之製程設備，以擴大生產產能，並提升產品品質及生產效率，將有助於該公司強化接單能力、擴大營運規模及爭取獲利契機，以提升產業競爭力，對該公司未來營運應具正面之效益。

(五)可行性評估

1. 廠房擴建及機器設備取得

經檢閱該公司之董事會議事錄、廠房興建工程承攬合約書、無塵室建置工程合約、消防工程合約及相關付款帳冊憑證等資料，查悉該公司業於 110 年 12 月 17 日提請董事會決議通過將廠房興建工程發包予建築承攬商，並於 111 年初開始進行工程施作，截至評估日止，廠房主體工程施作進行至第五期工程-外牆 RC 結構完成，並完成無塵室第二期工程，故該公司本次興建廠房之建設確實已屬可行。

2. 資金來源

依前開所述，該公司本次擴廠計畫所需資金總計約為 1,555,800 千元，其中廠房及設備購置款項主係向金融機構融資 1,244,640 千元為支應外，其餘款項 311,160 千元以自有資金支付。而未來尚須支付之廠房興建工程款項及採購機器設備款項之款項，則依承攬工程合約的施工及工程驗收進度，與機器下單、交運、安裝驗收進度以金融機構融資資金支付。

經參見會計師核閱之 112 年第二季財務報告，檢視該公司自有資金水位，其 112 年 6 月 30 日之現金及約當現金餘額為 234,518 千元及 112 年前二季來自營業活動淨現金流入為 158,467 千元，另從該公司 112 年 6 月 30 日之負債占資產比率、流動比率及速動比率分別為 41.83%、114.65%及 108.68%，其財務結構及償債能力尚屬健全。在未來電子裝置對於電源效率日趨嚴格及

節能低碳經濟推升電源控制管理相關產品之需求下，將推動功率半導體市場的成長，顯見該公司於未來營運成長應屬可期，另該公司擴廠主要之資金來源係以銀行借款支應，且已取得銀行之融資額度，故經評估該公司本次擴廠計畫之資金來源應屬可行。

綜上所述，相關該公司本次擴廠之計畫，經評估其決策過程、資金來源、工作進度及預計效益等尚屬合理，其擴廠計畫應屬必要且具可行性。

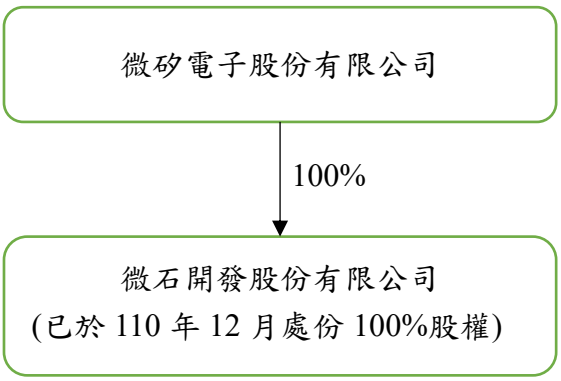
四、發行公司及其各子公司（包括母子公司間交易事項）之轉投資事業

(一)列明申請年度截至最近期財務報告止轉投資事業概況並評估重要轉投資事業（持股比例達百分之二十以上或帳面金額或原始投資金額達新台幣五千萬元以上）最近期及最近一個會計年度之營運及獲利情形、最近期及最近二個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、股利分配情形（海外轉投資事業一併列明獲利匯回金額)，若有利用發行公司資源及技術之情形，其給付對價或技術報酬金之合理性，若截至最近一期，轉投資事業發生營運或財務週轉困難情事，並應評估對發行公司之影響。

1.轉投資事業概況

(1)轉投資事業架構圖

112 年 06 月 30 日



資料來源：該公司提供

(2)重要轉投資事業概況

直接轉投資事業

單位：新台幣千元；千股

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	原始投資年度	評價方法	原始投資			112年6月30日				
					金額	股數	持股比例	帳面金額	股數	持股比例	每股面額(元)	股權淨值
微石開發(股)公司	餐飲服務業	台灣	77	權益法	23,000	2,300	100%	該公司已於 110 年 12 月 30 日處分微石開發(股)公司 100%股權。				

資料來源：該公司提供及經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司截至 112 年 06 月 30 日止，未有採權益法之長期股權投資，未有違反公司法第十三條投資總額不得超過實收股本之百分之四十之規定，且該公司已於公司章程第六條載明：「本公司轉投資他公司而為有限責任

股東時，所有投資總額得不受公司法第十三條之限制，惟應經董事會同意後行之」，故尚無違反公司法第十三條規定之情事。

單位：新台幣千元；千股

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	評價方法	處分前累計投資狀況			處分日期	處分方式
				金額	股數	持股比例		
微石開發(股)公司	餐飲服務業	台灣	權益法	1,000	100	100%	110 年 12 月 30 日	出售持股

資料來源：該公司提供及經會計師查核之財務報告。

2. 重要轉投資事業投資過程

該公司最近期及最近二個會計年度，直接或間接持股比例達百分之二十以上或帳面金額或原始投資金額達新台幣五千萬元以上之轉投資事業為微石開發(股)公司(以下簡稱微石開發)，茲將該公司轉投資微石開發之投資過程說明如下：

該公司於 77 年 8 月以新台幣 200 千元取得以積體電路之晶片目檢業務為主之金立電子(股)公司(微石開發之前身)40%股權，該公司並與金立電子(股)公司相互配合，共同爭取半導體檢測業務，以擴大營運接單量能，91 年 4 月金立電子(股)公司經經濟部核准變更為晶立科技(股)公司，後因 91 年積體電路之晶片目檢業務市場需求減少，遂進行企業轉型，於 92 年 6 月經經濟部核准變更為芽米(股)公司，轉型為餐飲服務業，另於 96 年 12 月更名為微石開發。

該公司為持有微石開發 40%股權之創始股東，歷經增資、減資及股權交易，至 105 年度向其他股東及董事長之轉投資公司等以每股 12 元購入微石開發其餘 842 仟股，使微石開發成為該公司 100%持有之子公司。該公司考量未來長期發展且微石開發經營餐飲業務與半導體本業歧異，經 110 年 12 月董事會決議出售微石開發 100%股權，該公司參酌元衡財金科技股份有限公司依據資產法計算所出具之金融資產公允價值評估報告，於 110 年 12 月以新台幣 2,500 仟元處份微石開發全數股權，經核閱相關文件，其投資目的及投資過程尚屬合理。

3. 重要轉投資事業股權變動情形

該公司持有轉投資公司股權變動(原始投資金額)情形如下：

單位：新台幣千元；千股

轉投資事業名稱	原始投資				增(減)變化情形					112 年 06 月 30 日		
	年度	股數	金額	持股(%)	年度	變動原因	股數	金額	持股(%)	股數	帳面金額	持股(%)
微石開發(股)公司	77	200	2,000	40.00	83	盈餘轉增資	200	2,000	40.00	—	—	—
					85	盈餘轉增資	400	4,000	40.00			
					87	現金增資	540	5,400	26.80			
					88	購入股權	200	2,000	30.80			
					89	購入股權	23	230	31.26			
					91	購入股權	729	7,290	45.84			
					94	出售股權	100	1,000	43.84			
					98	減資	920	9,206	43.86			
					105	減資	614	6,138	43.87			
						購入股權	842	8,424	100.00			
					109	現金增資	800	8,000	100.00			
					110	減資	2,200	22,000	100.00			
						出售股權	100	1,000	—			

資料來源：該公司提供。

該公司於微石開發成立時即持股 40%，歷經盈餘轉增資、現金增資、減資彌補虧損及股權交易，持有股數及持股比例因而異動。於 105 年度該公司向微石開發之其他股東以每股 12 元購買 842,400 股後，微石開發即成為該公司 100%持有之子公司。109 年度微石開發為改善財務結構增資 8,000 千元，110 年度考量未來未有資金需求及擴充營運計畫，經微石開發 110 年 4 月 15 日董事會決議通過後辦理減資 2,200 千股並退還股款 22,000 千元。該公司考量未來發展，且微石開發經營業務與該公司歧異，經 110 年 12 月董事會決議處份微石開發 100%股權，認列處分利益 1,376 千元，截至 110 年 12 月底，該公司已無持有微石開發之股權。

4. 對轉投資事業之管理政策

該公司目前並無轉投資事業，惟該公司亦訂有「子公司之監督與管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「集團企業、特定公司關係人交易往來作業辦法」等作業程序，作為對轉投資事業經營管理明確依循方針及具體作業規範。

5. 重要轉投資事業最近年度及申請年度截至最近期止營運情形及獲利能力

該公司已於 110 年 12 月 30 日出售微石開發 100%股權，111 年度及 112 年度截至最近期止未有其他轉投資事業。

6. 最近期及最近二個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、股利分配情形(海外轉投資事業一併列明獲利匯回金額)

單位：新台幣千元

被投資事業	投資損益			股利分配			獲利匯回		
	110 年度	111 年度	112 年前二季	110 年度	111 年度	112 年前二季	110 年度	111 年度	112 年前二季
微石開發	(1,903)	註		7,116	註		—	註	

資料來源：該公司提供；經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註：微石開發(股)公司已於 110 年 12 月 30 日處分，未有轉投資事業。

微石開發之業務為餐飲服務，110 年度受二級警戒防疫規定影響，外食聚餐及商業交流活動大幅減少，致微石開發營業虧損。110 年度微石開發處份持有微矽電子股票 1,326 千股，出售金額為 33,143 千元並認列處分投資利益 10,877 千元，致當年度為稅後淨利 8,975 千元，經 110 年 7 月 2 日微石開發董事會決議後，於 110 年度發放股利 7,116 千元，又該公司並無海外轉投資事業，並無獲利匯回情事。

7. 轉投資事業給付發行公司對價或技術報酬金之情事

該公司並無轉投資事業給付其對價或技術報酬金之情事，故不適用本項評估。

8. 截至最近一期，轉投資事業發生營運或財務週轉困難情事，並應評估其對發行人之影響。

該公司截至 112 年 06 月 30 日止，並無轉投資事業，故不適用本項評估。

(二) 已赴或擬赴大陸地區從事投資者，應敘明其投資情況與最近期及最近二個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、獲利匯回金額，並評估其對發行人財務狀況之影響。

該公司最近期及最近二個會計年度並無已赴或擬赴大陸地區從事投資之情事，故不適用本項評估。

(三) 申請年度截至最近期財務報告止尚未完成之投資案，其預估總投資金額占最近一個會計年度實收資本額百分之二十以上，或逾新台幣五億元者，應就下列事項詳加評估說明。

該公司申請年度截至評估報告出具日止，該公司並無尚未完成之投資案，故不適用本項評估。

五、承銷商依臺灣證券交易所(股)公司「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條規定實地輔導發行公司之重要子公司者，應列示是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見

該公司申請上市會計年度或最近一個會計年度並無符合「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條及「會計師查核簽證財務報表規則」第二條之一第二項規定之重要子公司，故不適用本項評估。

六、評估發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於發行公司股票上市後對財務報表可能之影響

該公司目前並無已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，故不適用。

七、公營事業申請股票上市時，其檢送之財務報告有未經會計師簽證者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見

該公司非屬公營事業申請股票上市，故不適用本項評估。

八、金融事業申請股票上市，應列明其備抵提列情形，並評估其是否足額

該公司非屬金融事業申請股票上市，故不適用本項評估。

九、承銷商應評估外國申請公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響

該公司非屬外國公司申請股票上市，故不適用本項評估。

伍、承銷商得視發行公司所營事業性質，委請在技術、業務，財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行公司目前營運狀況及未來發展，進行比較分析，並本獨立公正立場出具審查意見，俾利評估

本證券承銷商無委請專家出具審查意見書之情事，故不適用本項評估。

陸、法令之遵循及對本國發行公司營運影響由承銷商洽律師對本國發行公司、現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人最近三年內就下列事項出具意見後，依據其意見承銷商評估對本國發行公司營運影響及因應之道，並說明影響此次承銷之因素

由承銷商洽律師對本國發行公司、現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人最近三年內就下列事項出具意見後，依據其意見承銷商評估對本國發行公司營運影響及因應之道，並說明影響此次承銷之因素：

一、發行公司是否違反相關法令規章

(一)發行公司所屬行業之目的事業中央主管機關及影響該行業之重要法律與相關規章

經查閱該公司董事會議事錄、股東會議事錄、與主管機關往來函文等有關文件資料，取得該公司出具之聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司尚無違反目的事業中央主管機關及影響該行業之重要法律與相關規章之情事。

(二)發行公司依公開發行公司資訊公開相關法令應公開之資訊，評估是否依其法令辦理

該公司辦理公開發行並自 111 年 6 月 17 日申報生效，經查閱該公司與主管機關往來函文，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司自公開發行後尚依公開發行公司資訊公開相關法令辦理，定期或不定期向主管機關辦理應公告申報事項，尚無重大異常之情事。

(三)其他法令規章

經查閱該公司與主管機關往來函文，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，截至評估報告出具日止，該公司最近三年度及申請年度截

至評估報告出具日止，除有下列裁罰情事外，尚無違反其他法令規章之重大情事。相關說明如下：

原因及過程	對公司財務業務之影響
該公司之竹南鎮公義里友義路 230 號廠於 110 年 1 月 8 日經苗栗縣政府環境保護局人員稽查，發現有未依規定每日確實紀錄廢(汙)水(前)處理設施操作參數(加藥量)等資料，違反水汙染防治法第 18 條及第 1 項及水汙染防治措施及檢測申報管理辦法第 16 條規定，而於 110 年 4 月 13 日依水汙染防治法第 46 條規定處以罰鍰新台幣 10,000 元整。	該公司已於 110 年 4 月 20 日繳納完畢，罰鍰金額佔 109 年度營收比重不高，且其後該公司亦未再遭苗栗縣政府以相同事由裁罰或命改善，故對該公司之整體營運應無重大影響。
該公司之原員工林○○主張有應給付未給付之加班費而申請勞資爭議調解，經社團法人苗栗縣勞資關係協會於民國 109 年 8 月 31 日調解成立，林○○持調解會議記錄向苗栗地院聲請准予強制執行，經苗栗地院於 109 年 9 月 4 日以 109 年度勞執字第 8 號勞資爭議事件裁定准予強制執行；該公司提起債務人異議之訴，主張林○○前向該公司借款，尚積欠 16 萬 4,108 元未清償，並有林○○開立之本票作為借款之清償擔保，然林○○並未依約清償，故以上述本票債權與林○○之勞資爭議調解債權 13 萬 7,872 元為抵銷，請求撤銷強制執行程序，於 110 年 7 月 12 日經臺灣新竹地方法院以 110 年度竹簡字第 210 號民事判決勝訴，該強制執行程序已遭判決撤銷確定	該公司勝訴並已以本票債權抵銷林○○之強制執行債權，且訴訟標的金額不高，故對該公司之整體營運應無重大影響。
該公司之原員工林○○主張有應給付未給付之加班費，經苗栗縣政府實施勞動條件檢查，認定該公司有未依法給付加班費之情形，違反勞動基準法第 24 條規定，而於 110 年 5 月 26 日依同法第 79 條第 1 項第 1 款規定處以罰鍰新台幣 20,000 元整。	該公司已於 110 年 6 月 16 日繳納完畢，罰鍰金額不高，對該公司之整體營運應無重大影響。
該公司竹南廠經勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心於 110 年 9 月 2 日及 110 年 10 月 5 日派員實施電子零組件製造業勞動條件專案檢查，認定該公司於計算勞工華尤莉加班費費時有未依法定標準計算之情形，違反勞動基準法第 24 條規定，苗栗縣政府於 111 年 3 月 21 日依同法第 79 條第 1 項第 1 款規定處以罰鍰新台幣 20,000 元整。	該公司已於 111 年 4 月 1 日繳納完畢，本件罰鍰金額不高，對該公司之整體營運應無重大影響。
該公司竹南廠對於從事硝酸搬運作業之勞工，未依特定化學物質危害預防標準第 50 條規定，使其確實使用適當之防護具，於 112	該公司已於 112 年 5 月 30 日繳納完畢，該筆罰鍰金額相較該公司之營收比例不高，且

原因及過程	對公司財務業務之影響
年 4 月 16 日勞工喬司夫於從倉庫運送桶裝硝酸時，發生硝酸桶前傾破裂噴濺意外，致勞工喬司夫受有右上肢及下肢 1 至 2 度燒燙傷之職業災害，違反職業安全衛生法第 6 條第 1 項規定，勞動部職業安全衛生署依同法第 43 條第 2 款規定處罰鍰新台幣 10 萬元。	其後該公司已完成改善，亦未再遭以相同事由裁罰，故對該公司之整體營運應無重大影響。
該公司竹南廠經勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心於 112 年 6 月 7 日派員實施外籍移工勞動條件專案檢查，認定該公司於計算勞工賽隆加班費費時有未依法定標準計算之情形，違反勞動基準法第 24 條規定，苗栗縣政府於 112 年 8 月 17 日依同法第 79 條第 1 項規定處以罰鍰新台幣 20,000 元整。	該公司已於 112 年 8 月 22 日繳納完畢，本件罰鍰金額不高，對該公司之整體營運應無重大影響。

二、董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員是否違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務之行使

經參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並取得上述人員之聲明書、財團法人金融聯合徵信中心綜合信用報告及第一類票據信用資料查覆單、無欠稅證明文件，除下述案件外，該公司董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員並無違反相關法令，致有違誠信原則或影響職務行使之情事。

三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權

經參閱陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並取得該公司之聲明書及查閱最近三年度及 112 年第二季之財務報告、最近三年度及申請年度截至評估報告出具日止之股東會議事錄、董事會議事錄及主管機關往來函文，該公司尚無違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權等情事。

四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，且查閱該公司最近三年度及申請年度截至評估報告出具日止之董事會、股東會議事錄、公開說明書、年報、該公司與主管機關往來函文及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取得該公司出具之聲明書，該公司目前並無繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，且無足以影響公司財務業務正常營運之情形，其結果應不致對於該公司股東權益或證券價格有重大不利之影響。

五、重大勞資糾紛或污染環境事件

經取得陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並函詢勞動部、勞工保險局、中央健保局、另查閱該公司與主管機關往來函文，截至評估報告出具日止，該公司尚無重大勞資糾紛或污染環境事件。

綜上所述，該公司及申請時之董事、持股百分之十以上股東、總經歷及實質負責人在法令遵循方面尚無發生對該公司之營運產生重大不利影響之情事。

柒、列明本國發行公司有無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第九條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見；或外國發行公司或其從屬公司有無同準則第二十八條之八各款所列不宜上市情事之評估意見；或申請創新板上市之發行公司有無同準則第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見。評估有無同準則第九條第一項第十一款第二目、第二十八條之八第七款第二目或第三十一條第一項第十款第二目規定情事。列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見。

一、列明依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見

該公司並無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市之情事，請詳附件一。

二、列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見

該公司於 111 年 8 月 2 日股東臨時會全面改選董事，選任張居興、温萬壽及彭俊豪擔任獨立董事，並於同日董事會決議委任上述三席獨立董事為第一屆薪資報酬委員會委員，另於 112 年 6 月 29 日股東常會增選譚仲民獨立董事，並於 112 年 8 月 11 日董事會決議增選譚仲民為薪資報酬委員會委員。茲就該公司本屆獨立董事及薪資報酬委員會成員之專業資格、職權行使及相關事項評估如下：

(一)獨立董事

經檢視該公司四席獨立董事之學經歷資料，其資格條件均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條及第 3 條規定，茲就三席獨立董事之資格條件評估說明如下：

1. 獨立董事張居興為臺灣大學財務金融研究所碩士，曾任職於中國信託商業銀行副總經理及中信票券金融公司副總經理等，任職期間自 68 年 10 月至 95 年 6 月，現已退休，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
2. 獨立董事温萬壽畢業於交通大學電子物理學系學士，於 86 年至 107 年曾任職瀚宇彩晶(股)公司執行長及華邦電子(股)公司執行副總，目前擔任豐達科技(股)公司獨立董事，任職期間自 109 年迄今，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
3. 獨立董事彭俊豪為成功大學企業研究所碩士，任職於元大創業投資(股)公司副總經理，任職期間自 97 年 1 月至 111 年 5 月，現為元大創業投資(股)公司總經理，任職期間自 111 年 5 月迄今，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
4. 獨立董事譚仲民為臺灣大學商學研究所系碩士，現為力晶積成電子製造(股)公司副總經理，任職期間自 93 年 3 月迄今，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

另經查閱該公司董事會議事錄並實地列席參與該公司董事會運作，獨立董事亦依其各自專業領域及經驗提供董事會客觀之建議，尚無重大異常之情事，

其職權行使等相關事項皆已依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關法令規定辦理。

(二)薪資報酬委員會

該公司於 111 年 8 月 2 日股東臨時會全面改選董事，選任張居興、溫萬壽及彭俊豪擔任獨立董事，並於同日董事會決議委任上述三席獨立董事為第一屆薪資報酬委員會委員，另於 112 年 6 月 29 日股東常會增選譚仲民獨立董事，並於 112 年 8 月 11 日董事會決議增選譚仲民為薪資報酬委員會委員。經檢視該公司薪資報酬委員會成員之學經歷資料，其資格條件均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第 5 條及第 6 條相關規定。

經查閱該公司薪資報酬委員會之會議事錄，其討論並提交董事會之建議事項均依相關程序及法令進行，尚無重大異常之情事，且其職權行使等相關事項皆已依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及相關法令規定辦理。

綜上所述，該公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項均依我國證券法令規定辦理。

捌、評估是否符合特定行業或組織型態公司之上市規定

一、評估是否符合集團企業申請股票上市之規定

(一)依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定第六條之規定，「集團企業」係指於申請上市會計年度及其最近一個會計年度內，與申請公司彼此間具有控制或從屬關係之企業整體。其具體認定標準及逐項評估如下：

1.具有下列各款情事之一者，即認為其彼此間具有控制或從屬關係

集團企業認定標準	符合認定公司	說　　明
1.屬於母公司及其所有子公司關係者。	該公司並無符合本項標準之情事。	1.經參閱該公司最近期之股東名冊，並檢視111年度及112年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並未有持股超過50%之法人股東，或對該公司具有重大控制力之他公司，故該公司尚無母公司。 2.經參閱該公司111年度及112年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司申請上市會計年度及其最近一個會計年度內並未有直接及間接持股達50%以上之子公司。
2.申請公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者；或他公司直接或間接控制申請公司之人事、財務或業務經營者。所稱直接或間接控制其人事、財務或業務經營係指符合下		

集團企業認定標準	符合認定公司	說　　明
列情事之一者：		
A.取得對方過半數之董事席位者。	該公司並無符合本項標準之情事。	1.取得該公司最近期經濟部變更登記表，並查閱該公司111年度及112年截至目前為止之董事名單，並無他公司取得該公司過半數董事席位。 2.經查閱該公司111年度及112年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並無取得他公司過半數董事席次之情事。
B.指派人員獲聘為對方總經理者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經檢視該公司111年度及112年截至目前為止董事會議事錄，其總經理係由該公司董事會委任，非為他公司指派之情事；該公司亦未指派他人擔任對方總經理之情事。
C.依合資經營契約規定擁有對方經營權者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經檢視該公司111年度及112年截至目前為止之董事會議事錄及重要合約內容，尚無發現該公司有依合資經營契約而擁有對方經營權或他公司擁有該公司之情事。
D.為對方資金融通金額達對方總資產之三分之一以上者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經檢視該公司111年度及112年截至目前為止之董事會議事錄、111年度及112年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，尚無發現該公司有資金融通金額達對方總資產三分之一以上之情事；另亦無他公司為該公司資金融通金額達到該公司總資產三分之一以上之情事。
E.為對方背書保證金額達對方總資產之三分之一以上者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經檢視該公司111年度及112年截至目前為止之董事會議事錄、111年度及112年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並未發現有為對方背書保證金額達對方總資產之三分之一以上之情事。另並未有他公司為該公司背書保證金額達到該公司總資產三分之一以上之情事。
3.申請公司與他公司相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本總額三分之一以上者，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經核閱該公司最近期之股東名冊及111年度及112年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並無與他公司相互投資各達對方有表決權股份總數或資本總額三分之一以上，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營之情事。

2.申請公司與他公司間有下列各款情事之一者，即認為其彼此間具有控制或從屬關係。但申請公司檢具相關事證，證明無控制或從屬關係者，不在此限：

集團企業認定標準	符合認定公司	說　　明
1.申請公司與他公司之董事、監察人及總經理合計有半數以上相同者。其計算方式係包括該等	該公司並無符合本項標準之情事。	該公司共有九席董事(含四位獨立董事)及董事長兼總經理，經取得該公司之董事及總經理二親等親屬名單轉投資聲明書，並無發現與他公司有半數以上之董事、監察人及總經理與該公司相

集團企業認定標準	符合認定公司	說　　明
人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。		同之情事。
2. 申請公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額，均有半數以上為相同之股東持有或出資者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經查閱該公司最近期之股東名冊及董事之轉投資事業明細表，並無發現該公司與他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額，均有半數以上為相同之股東持有或出資者。
3. 對申請公司採權益法評價之他投資公司與其之關係人總計持有申請公司超過半數之已發行有表決權股份者；或申請公司與其關係人總計持有申請公司採權益法評價之他投資公司超過半數之已發行有表決權股份者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經查閱該公司111年度及112年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，及最近期之股東名冊，對該公司採權益法評價之他投資公司為大日月投資有限公司（持股比例22.89%），另加計與其之關係人所持有該公司之股份，並未超過半數之已發行有表決權股份；另該公司111年度及112年截至目前為止，並未有採權益法評價之他投資公司與其關係人總計持有他公司超過半數之已發行有表決權股份者。

綜上所述，該公司無符合集團企業認定標準之公司。

(二) 集團企業中之本國發行公司申請股票上市者不宜上市認定標準

依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第三十二條之規定，集團企業中之發行公司申請股票上市，除公營事業外，雖合於上市審查準則有關規定，但不能符合下列各款情事者，應不同意其股票上市：

1. 申請公司與同屬集團企業公司之主要業務或主要商品，無相互競爭之情形。但申請公司具獨立經營決策能力者，不在此限。

該公司無集團企業，故不適用本項評估。

2. 申請公司與同屬集團企業公司間有財務業務往來或交易者，除各應就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，並經董事會通過外，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具書面，承諾日後有往來時必無非常規交易之情事。

該公司已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「集團企業、特定公司關係人交易往來辦法」，以規範與集團企業間財務暨業務往來事宜，並經董事會決議通過。此外，該公司截至評估報告出具日止並無集團企業，故無與集團企業交易往來之情事。爾後該公司與集團企業間有財務、業務往來者，將依「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「集團企業、特定公司關係人交易往來辦法」相關規定辦理，以避免非常規交易之情事。

3. 其財務業務狀況及前述之作業辦法應無重大異常情事。

前述該公司之「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「集團企業、特定公司關係人交易往來辦法」係依據主管機關相關規定及該公司之營運狀

況訂定，尚無發現有重大異常情事。

4. 其對於銷售予集團企業公司之產品，應具有獨立行銷之開發潛力。

該公司無集團企業，故不適用本項評估。

5. 申請上市時，最近期及最近一個會計年度來自集團企業公司之進貨金額未超過百分之七十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因者，得不適用之。

該公司無集團企業，故不適用本項評估。

6. 申請上市時，最近期及最近一個會計年度來自集團企業公司之營業收入或營業利益金額未超過百分之五十；或利用集團企業公司提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額未超過百分之五十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因者，得不適用之。

該公司無集團企業，故不適用本項評估。

綜上所述，該公司尚無違反「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則及補充規定」中有關集團企業申請上市之規定。

(三) 申請時屬於母子公司關係之子公司申請其股票上市，除公營事業外，雖合於「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則」有關規定，但不能符合下列各款情事者，應不同意其股票上市：

該公司非屬於母子公司關係之子公司申請其股票上市，故不適用本項評估。

(四) 集團企業評估結論

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」，所列各項具體認定標準逐項評估後，該公司應無違反集團企業申請股票上市規定之情事。

二、評估是否符合「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則」第十六條規定之公司申請股票上市

該公司非屬建設公司，故不適用本項之評估。

三、評估是否符合控股公司、金融控股公司、或其他特定組織型態公司申請上市之有關規定

該公司非屬控股公司、金融控股公司、或其他特定組織型態公司，故不適用本項之評估。

玖、評估發行公司是否依本公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形。評估發行公司公司治理評鑑自評報告是否允當表達其公司治理運作情形

一、評估發行公司是否依臺灣證券交易所股份有限公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形

該公司已訂定「永續發展實務守則」，為健全企業永續發展之管理，進行與公司營運相關之風險管理或策略。另檢視該公司出具之初次申請有價證券上市公開說明書，已依照臺灣證券交易所股份有限公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形。

二、評估發行公司公司治理評鑑自評報告是否允當表達其公司治理運作情形

經檢視該公司出具之公司治理評鑑自評報告，該公司已依「112 年度公司治理評鑑指標」進行自我評估，包括維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等四大面向，經本證券承銷商逐條核閱該公司各評鑑指標之自我評估結果，該公司之公司治理評鑑自評報告業已敘明其目前實際運作情形，並符合相關法規制定，確實遵循辦理。綜上所述，該公司之公司治理評鑑自評報告尚足以允當表達其公司治理目前運作情形。

拾、對上列各項目有關證券承銷商評估報告完成日起，截至股票上市契約生效日之前一日止之期後事項，應隨時加以更新說明與評估；於股票上市用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，亦應加以更新說明與評估

截至評估報告出具日止，該公司尚無期後事項。

拾壹、以投資控股公司或金融控股公司申請股票上市者，承銷商應就被控股公司或其子公司之所營事業性質，依第四、五、六、八、九、十一及十二條等規定進行評估，出具各被控股公司或子公司之審查意見，再憑以出具綜合彙總意見

該公司非屬投資控股公司或金融控股公司申請股票上市，故不適用本項評估。

拾貳、本國上市（櫃）公司之海外子公司申請其股票第一上市者，承銷商應就下列事項詳加評估說明

一、評估本國上市（櫃）公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施。

該公司非屬本國上市(櫃)公司之海外子公司申請股票第一上市，故不適用本項評估。

二、本國上市（櫃）公司為降低對該海外子公司之持股比例所進行之股權分散行為，其分散對象、價格之決定方式，是否有違反相關規定或明顯不合理而損及本國上市（櫃）公司之股東權益。

該公司非屬本國上市(櫃)公司之海外子公司申請股票第一上市，故不適用本項評估。

拾參、其他補充揭露事項

無。

附件一、「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之承銷商審查意見

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
一、遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款、第二款所列情事，或其行為有虛偽不實或違法情事，足以影響其上市後之證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。			
(一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產。	(一)經查閱該公司最近二個會計年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，最近二個會計年度及 112 年截至目前為止之董事會議事錄、股東會議事錄、勞務費明細帳、收發文紀錄、取得該公司聲明書、查詢司法院法學資料檢索系統及參閱陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並未發現該公司有訴訟或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞。	是	
(二)發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。	(二)經查閱該公司最近二個會計年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，1 最近二個會計年度及 112 年截至目前為止之董事會議事錄、股東會議事錄、存續之重要契約，向財團法人金融聯合徵信中心查詢該公司之企業綜合信用資訊、第一類票據信用資料查覆單及取得該公司所出具之聲明書，並參閱陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，截至評估報告出具日止，該公司並無遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。		
(三)發行該有價證券之公司之行為有虛偽不實或違法情事，足以影響其上市後之證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。	(三)經查該公司最近二個會計年度及 112 年截至目前為止董事會議事錄、股東會議事錄、主管機關往來函文及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取得該公司所出具之聲明書及陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並未發現該公司有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
	綜上所述，該公司最近二個會計年度及112 年截至目前為止並無證券交易法第一百五十六條第一項第一款、第二款所列情事，或其行為有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。		
二、財務或業務未能與他人獨立劃分者。 (一)資金來源過度集中於非金融機構者。 (二)申請公司與他人簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之虞者。 (三)與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分者。但母子公司間共用貸款額度，不在此限。 (四)申請上市時，最近期或最近一個會計年度來自非屬集團企業公司之關係人之進貨金額超過百分之七十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成者，得不適用之。 (五)申請上市時，最近期或最近一個會計年度來自非屬集團企業公司之關係人之營業收入或營業利益金額超過百分之五十；或利用前揭關係人提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額超過百分之五十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成，且前開比率未超過百分之七十者，得不適用之。	(一)經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、借款合約、相關帳冊及取得該公司之聲明書，並無向非金融機構借款，故無資金來源過度集中於非金融機構之情事。 (二)經查閱該公司存續有效之重要契約及該公司聲明書，未發現有與他人簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，而有致生不利影響之虞者。 (三)經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、借款合約、董事會議事錄及該公司之聲明書，並無與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分之情事。 (四)經查閱該公司 111 年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及進貨明細，該公司並無來自非屬集團企業公司之關係人之進貨金額超過百分之七十之情事。 (五)經查閱該公司 111 年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、銷貨明細表，該公司並無來自非屬集團企業公司之關係人之營業收入或營業利益金額超過百分之五十，故該公司無左列情事。另該公司技術來源係自行研發，故未有利用前揭關係人提供之關鍵性技術或資產所生之營業收入金額超過百分之五十之情事。 綜上評估，該公司並無財務或業務未能與他人獨立劃分之情事。	是	

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
三、有足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛或污染環境情事，尚未改善者。		是	
(一)所規定「足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛」，係指下列情事之一：	(一)重大勞資糾紛之相關評估結果如下:		
1.發生重大勞資爭議者。	1.經訪談該公司主要管理階層人員，並查閱最近二個會計年度及申請年度截至目前為止之收發文紀錄、勞資會議紀錄、工作規則、營業外支出明細帳、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、該公司之聲明書，函詢新竹縣勞工局及苗栗縣勞工局，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書及搜尋司法院裁判書查詢系統等，該公司最近二個會計年度及申請上市年度有下列一件勞資爭議，相關評估結果如下: (1)林○○前員工原任職於該公司製程工程部，任職期間有加班事實，但未依該公司規定填報申請加班，致人事部門無法得知該員有加班之情事，而無計算支付加班費。該員於 109 年 8 月離職後於 110 年 3 月 8 日提出勞資爭議強制執行訴訟，請求該公司給付加班費 137,872 元，惟該員向該公司借支尚積欠 164,108 元未還，該公司於民國 110 年 5 月 3 日提請訴訟，申請兩造雙方債務互為抵銷，經抵銷後該員需返還該公司 26,236 元，經公司考量後不向該員請求返還，以臺灣新竹地方法院 110 年 7 月 12 日判決確定撤銷強制執行後結案。另該公司於 110 年 5 月 26 日接獲苗栗縣政府來函，該公司違反勞動基準法第 24 條相關規定，此事件因苗栗縣政府於 110 年 2 月 22 日派員前往該公司實施勞動條件檢查，檢查結果發現該公司員工林○○107 年 3 月 13 日至 109 年 8 月 14 日任職期間有違反勞基法第 24 條加班費給付之規定，該公司已於 110 年 6 月 16 日繳清就違反事項被裁處之 2 萬元罰鍰。截至目前為止，該公司尚未因同樣事件而有調解及後續訴訟情事，故評估對財務及業務應無重大影響。		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
	(2)該公司於111年3月21日接獲苗栗縣政府來函，該公司違反勞動基準法第24條相關規定，此事件因勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心於110年10月5日派員前往該公司實施勞動條件檢查，檢查結果發現該公司員工華○○110年5月份薪資、員工華○○110年6月份薪資及員工邱○○於110年6月份薪資有違反勞基法第24條加班費給付之規定，該公司已於111年4月1日繳清就違反事項被裁處之2萬元罰鍰，評估對財務及業務應無重大影響。 (3)該公司於112年8月17日接獲苗栗縣政府來函，該公司違反勞動基準法第24條相關規定，此事件因勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心於112年5月17日派員前往該公司實施勞動條件檢查，因故未能完成檢查，改由該公司派員攜資料於112年6月17日至該中心受檢，檢查結果發現該公司員工賽○112年3月份及4月份薪資有違反勞基法第24條加班費給付之規定，該公司已於112年8月22日繳清就違反事項被裁處之2萬元罰鍰，評估對財務及業務應無重大影響。 除上述事件外，該公司並無發生重大勞資爭議且足以影響公司財務業務正常營運之情事。另核閱公司勞資會議申報紀錄及召開資料、主管機關來函，該公司皆依規定辦理並定期召開勞資會議。		
2.因安全衛生設施不良而發生重大職業災害；或違反職業安全衛生法被處以部分或全部停工者；或設置危險性機械、設備未檢查合格者。但經申請由檢查機構複查合格者，不在此限。	2.經查閱該公司110~111年度及112年度截至目前為止之收發文紀錄、營業外支出明細帳及經會計師查核簽證或核閱之財務報告及取得公司聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司勞工喬○○於112年4月16日從事硝酸搬運作業時，不慎發生潑濺意外，因未確實配戴必要之防護具而受傷，致違反職業安全衛生法第6條第1項及同法第43條第2款之規定，該公司於112年5月17日收到勞動部安全衛生署來函處以新臺幣10萬元罰鍰。該公司更換並設計適切之運		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
	送設備、持續進行全廠教育訓練及強化安全宣導，於每班開工前於電視牆循環播放安全守則，要求同仁依照標準作業程序及配戴必要之安全防護設備執行相關作業。 上述事件罰鍰金額新臺幣十萬元，尚無對該公司財務業務有重大影響。除上述情事外，該公司 110~111 年度及 112 年度截至目前為止，尚無因安全衛生設施不良而發生重大職業災害，或違反勞工安全衛生法被處以部份或全部停工，或設置危險性機械、設備未檢查合格之情事。		
3. 積欠勞工保險保費及滯納金，經依法追訴仍未繳納者。	3. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至目前為止之收發文紀錄、相關會計科目明細帳及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，抽核該公司勞健保費用繳納情形及取得該公司聲明書，並函詢勞工保險局及衛生福利部中央健康保險署，該公司並無積欠勞工保險費、健保費及滯納金之情事。		
(二)所規定「足以影響財務業務正常營運之重大污染環境」，係指公司或其事業活動相關場廠有下列情事之一：	(二) 重大環境污染情事之相關評估結果如下：		
1. 依法令應取得污染設置、操作或排放許可證而未取得者。	1. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至目前為止之收發文紀錄、取具固定污染源設置許可證及水污染防治許可證，函詢新竹縣政府及苗栗縣政府環境保護局回函及取得該公司聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司並無依法應取得污染設置、操作或排放許可證而未取得之情事。		
2. 曾因環境污染，於申請上市會計年度或最近二會計年度，各該年度經環保機關按日連續處罰者或經限期改善，而未完成改善者。	2. 經訪談該公司主要管理階層人員，查閱該公司最近二會計年度及 112 年度截至目前為止之收發文紀錄、業外支出明細帳及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，函詢新竹縣政府及苗栗縣政府環境保護局回函，及取得該公司聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司於 110 年 4 月 7 日接獲苗栗縣政府來函，該公司因違反水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 16 條及水污染防治法第 18 條相關規定，就違反之事項裁處 1 萬元罰		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
	鍰，此事件因苗栗縣政府派員於 110 年 1 月 8 日至該公司竹南廠查核，因未每日確實記錄廢汙水處理設施操作參數，該公司已於 110 年 4 月 20 日繳清罰鍰，經抽核該公司污染防治設備之正常運轉紀錄，未發現有未確實記錄每日操作參數之情事，且截至目前為止，未有發生相同或類似之情事，評估對該公司整體營運並無產生重大之影響。 上述環境污染事件非屬重大環境污染之情事，且經檢視上述事件罰鍰金額因占 110 年度經會計師查核簽證財務報告之營業收入比例甚低，且已改善完畢，尚無對該公司財務業務有重大影響，除上述情事外，該公司 110~111 年度及 112 年度截至目前為止，尚無因環境污染而遭環保機關按日連續處罰或經限期改善，而未完成改善之情事。		
3.有公害糾紛事件而無有效污染設備，或未能提供污染防治設備之正常運轉及定期檢修紀錄者。	3. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至目前為止之收發文紀錄、取具污染防治設備之正常運轉紀錄，函詢苗栗縣政府及新竹縣政府環境保護局回函，及取得該公司聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，尚無發現該公司有公害糾紛事件而無有效污染防治設備，或未能提供污染防治設備之正常運轉及定期檢修紀錄之情事。		
4.有環境污染情事，經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證者。	4. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至目前為止之收發文紀錄、搜尋該公司相關新聞報導，函詢苗栗縣政府及新竹縣政府環境保護局回函，及取得該公司聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司並未有環境污染情事，而經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證之情事。		
5.廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於處理過程中造成環境重大污染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病者。	5.經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至目前為止之收發文紀錄、搜尋該公司相關新聞報導，函詢新竹縣政府及苗栗縣政府環境保護局回函，及取得該公司聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司 110~111 年度及 112 年度截至目前為止，尚無因廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於處理過程中		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
	造成環境重大污染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病者。		
6.經中央主管機關指定公告之事業，其土地因污染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址者。	6. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至目前為止之收發文紀錄、搜尋該公司相關新聞報導，函詢苗栗縣政府及新竹縣政府環境保護局回函，及取得該公司聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，尚未發現該公司有經中央主管機關指定公告之事業，其土地因污染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址之情事。		
7. 法人有製造、加工或輸入偽禁環境用藥情事，其負責人經判刑確定者。	7. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至目前為止之收發文紀錄、搜尋該公司相關新聞報導，取得苗栗縣政府及新竹縣政府環境保護局回函，及取得該公司聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，尚未發現該公司有因製造、加工、或輸入偽禁環境用藥情事，其負責人經判刑確定之情事。		
(三)所規定「尚未改善者」，係指在本公司受理其股票上市申請案之日以後仍有上開情事者。	(三)綜上所述，該公司並無足以影響財務業務正常營運之重大環境汙染而尚未改善之情事。		
(四)但前(二)第 2 款之重大環境污染情事，以其已委託經環保機關認可之檢測機構，進行檢測及提出檢測結果報告書，並據以向環保機關申報污染改善完成報告書，於申報後三個月內未再續遭處罰者，作為是否改善之認定標準。	(四)綜上所述，該公司並無足以影響財務業務正常營運之重大環境汙染而尚未改善之情事。		
四、經發現有重大非常規交易，尚未改善者。		是	
(一)所規定「重大非常規交易」，係指申請公司有下列各款情事之一者，但公營事業依審計法規辦理者，不在此限：	(一)重大非常規交易		
1. 進銷貨交易之目的、價格及條件，或其交易之發生，或其交易之實質與形式，或其交易之處理程序，與一般正常交易顯不相當或顯欠合理者。	1. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並抽核該公司與前十大進銷貨對象之交易及收付款情形，尚無發現該公司交易之目的、價格及條件，或其交易之發生，或其交易之實質與形式，或其交易之處理程序，與一般正常交易顯不相當或顯欠合理者。		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
2. 依主管機關訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，應行公告及申報之取得或處分資產交易行為，未能合理證明其內部決定過程之合法性，或其交易之必要性，或其有關報表揭露之充分性，暨價格與款項收付情形之合理性者。	2. 取得或處分資產處理之評估 (1) 該公司已依主管機關訂頒之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂定「取得或處分資產處理程序」，並經董事會決議通過後，提報股東會同意，其作業內容及程序符合相關法令之規定。 (2) 經查閱該公司最近二個會計年度及112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、股東會議事錄、財產目錄、公告資訊及抽核相關文件等，該公司自 111 年 6 月 17 日經核准公開發行後，並無「公開發行公司取得或處分資產處理程序」需辦理公告及申報之重大資產交易。		
3. 以簽約日為計算基準，其最近五年內買賣不動產有下列情形之一者： (1) 向關係人購買不動產，其按主管機關所訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條所列方法，評估不動產成本結果，均較實際交易價格為低，且未符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十七條規定者。 (2) 出售不動產予關係人，其按主管機關所訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條所列方法，評估不動產成本結果，均較實際交易價格為高者。 (3) 向關係人買賣不動產，收付款條件明顯異於一般交易，而未有適當理由者。 (4) 申請公司所買賣土地與關係人於相近時期買賣鄰近土地，價格有明顯差異而未有適當理由者。	3. 經查閱該公司最近五年度及112 年度第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、財產目錄及重大契約等，該公司最近五年內並無向關係人或非關係人購買或出售不動產之情事。另該公司最近五年度及申請年度並無銷貨或租賃不動產予關係人所產生之營業收入，逾年度營業收入百分之二十之情事。		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
(5)最近五個會計年度末一季銷貨或租賃不動產予關係人所產生之營業收入，逾年度營業收入百分之二十，而未有適當理由者。 (6)向非關係人買賣不動產，有其他資料顯示買賣不動產交易明顯異於一般交易而無適當理由者。			
4. 非因公司間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人者。	4. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及相關明細帳，並查詢公開資訊觀測站，該公司並無非因公司間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人之情事。		
5. 前項第三款關於向關係人買賣不動產之規定，對於最近五年內其交易對象之前手或前前手有關係人身分時，亦應比照適用之。但買賣不動產之交易，其交易對象簽約取得時間，至本次交易簽約日止超過五年者，可免適用之。	5. 經參閱該公司董事會議事錄、財產目錄、明細帳等帳冊及該公司最近五年度及申請年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司最近五年內，未有向關係人買賣不動產之情事，故不適用左列事項之查核。		
6. 申請公司有第一項所定情事，致獲得利益者，經將所獲得利益予以扣除設算後，其獲利能力仍應符合上市條件。	6. 該公司並無重大非常規交易，故不適用。		
(二)所規定「尚未改善」，其改善之認定，係指符合下列各款情事之一者： 1. 因非常規交易而致申請公司以外之人獲得利益者，該獲得利益之人已將所得利益歸還應得之人者。 2. 該非常規交易行為經檢調或司法單位確定無犯罪情事。 3. 該非常規交易已恢復原狀者。	(二)該公司並無重大非常規交易尚未改善，故不適用。 綜上評估，該公司並無重大非常規交易迄申請時尚未改善之情事。		
五、有迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度，或不依有關法令及國際財務報告準則編製財務報告等情事，情節重大者。		是	

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
(一)所規定「不依有關法令及國際財務報告準則編製財務報告」,係指有下列情事之一者:	(一)有無「不依有關法令及國際財務報告準則編製財務報告」之評估：		
1. 財務報告未依有關法令及國際財務報告準則編製，經會計師出具否定意見或無法表示意見之查核報告書者，或經會計師出具保留意見之查核報告書而影響財務報告之允當表達者。	1. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告,該公司財務報告均依有關法令及國際財務報告準則編製,並無經會計師出具否定意見或無法表示意見之查核報告書,或經會計師出具保留意見之查核報告書而影響財務報告之允當表達之情事。		
2. 財務報告經主管機關函示應改進而未改進者。	2. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第二季之經會計師查核簽證或核閱之財務報告及與主管機關之往來文件,該公司之財務報告並無經主管機關函示應改進而未改進之情事。		
3. 簽證會計師查核工作底稿，經臺灣證券交易所股份有限公司調閱後，發現有重大缺失，致無法確認財務報告是否允當表達者。	3. 經借閱 110~111 年度及 112 年第二季會計師查核之工作底稿,並未發現有經臺灣證券交易所股份有限公司調閱後,發現有重大缺失,致無法確認財務報告是否允當表達之情事。		
(二)所規定「迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度」,指有下列情事之一者:	(二)有無「迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度」之評估：		
1. 在申請上市年度未依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則或內部控制相關法令規定，建立健全書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度。	1. 經核閱該公司之書面會計制度、內部控制制度及內部稽核制度，該公司已依「證券發行人財務報告編製準則」建立其書面會計制度,另其內部控制制度及內部稽核制度亦已依該公司管理及業務發展所需制定,並經該公司董事會通過。		
2. 經臺灣證券交易所股份有限公司實地查核，發現未依書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度合理運作者。	2. 該公司已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，建立書面內部控制制度及內部稽核制度,且經查閱該公司 110~111 年度經會計師出具之內部控制建議書,尚未發現有重大缺失之情形。另該公司業依規定委請會計師就其內部控制制度之設計與實際運作情形進行專案審查，並於 112 年 10 月 18 日取得會計師出具無保留意見之內部控制制度專案審查報告,其表示該公司於 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日之內部控制制度及內部稽核制度應已健全建立並有效執行。		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
	綜上所述，該公司並無未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度，或不依有關法令及國際財務報告準則編製財務報告等情節重大之情事。		
六、所營事業嚴重衰退者 (一)所規定「嚴重衰退」，係指有下列情事之一者，但申請股票上市公司最近一個會計年度之營業利益及稅前淨利占股本比率不低於百分之十二者，不適用之：	該公司 111 年度之營業利益及稅前淨利分別為 204,482 仟元及 227,209 仟元，股本為 646,600 仟元，營業利益及稅前淨利佔股本比率分別為 31.62%及 35.14%，皆不低於百分之十二，故不適用本項之評估，該公司尚無所營事業嚴重衰退之情事。	是	

單位：新台幣千元：%

分析項目	年度 公司別	109度	110年度		111年度		111年前二季	112年前二季	
		金額	金額	成長率	金額	成長率	金額	金額	成長率
營業收入	微矽電子	1,022,259	1,292,379	26.42	1,226,677	(5.08)	687,128	384,383	(44.06)
	京元電子	28,959,304	33,759,389	16.58	36,781,996	8.95	18,912,098	15,931,760	(15.76)
	矽格	12,428,549	16,681,264	34.22	18,694,345	12.07	9,773,831	7,332,778	(24.98)
	昇陽半導體	2,267,585	2,651,386	16.93	3,138,053	18.36	1,457,104	1,786,333	22.59
營業利益	微矽電子	152,097	310,265	103.99	204,482	(34.09)	150,125	(76,982)	(151.28)
	京元電子	4,650,711	6,606,516	42.05	9,164,830	38.72	5,001,287	3,376,166	(32.49)
	矽格	2,338,745	3,440,397	47.10	3,826,682	11.23	2,240,581	830,296	(62.94)
	昇陽半導體	147,514	232,554	57.65	307,991	32.44	136,526	170,088	24.58
稅前淨利	微矽電子	143,769	322,517	124.33	227,209	(29.55)	171,258	(69,804)	(140.76)
	京元電子	3,637,140	6,855,247	88.48	8,966,026	30.79	5,002,042	3,329,811	(33.43)
	矽格	2,278,576	3,662,812	60.75	4,426,459	20.85	2,619,569	1,152,657	(56.00)
	昇陽半導體	156,655	262,369	67.48	372,659	42.04	180,189	232,255	28.90

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

1. 最近一個會計年度或申請上市會計年度之營業收入及營業利益與同業比較，顯有重大衰退者。	1. 該公司 111 年度及 112 年前二季之營業收入分別為 1,226,677 仟元及 384,383 仟元，營業淨利(損)分別為 204,482 仟元及(76,982)仟元，111 年度營業收入及營業利益較前一年度成長(5.08)%及(34.09)%，112 年前二季營業收入及營業利益較前一年同期減少(44.06)%及(151.28)%，惟該公司 111 年度之營業利益及稅前淨利佔股本比率，均高於百分之十二，故不適用左列之評估。		
2. 最近一個會計年度或申請上市會計年度之稅前淨利與同業比較，顯有重大衰退者。	2. 該公司 111 年度及 112 年前二季之稅前淨利(損)分別為 227,209 仟元(69,804)仟元，分別較前一年度及前一年同期成長(29.55)%及(140.76)%，惟該公司 111 年度之營業利益及稅前淨利佔股本比率，均高於百分之十二，故不適用左列之評估。		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
3. 最近三個會計年度之營業收入及營業利益，均連續呈現負成長情形者。	3. 該公司 109～111 年度營業收入分別為 1,022,259 仟元、1,292,379 仟元及 1,226,677 仟元，成長率分別為 26.42%及(5.08)%；營業利益分別為 152,097 仟元、310,265 仟元及 204,482 仟元，成長率分別為 103.99%及(34.09)%，並無連續呈現負成長情形。		
4. 最近三個會計年度之稅前淨利，連續呈現負成長情形者。	4. 該公司 109～111 年度稅前淨利分別為 143,769 仟元 322,517 仟元及 227,209 仟元，成長比率分別為 124.33%及(29.55)%，並無連續呈現負成長情形。		
5. 產品或技術已過時，而未有改善計畫者。	5. 該公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，客戶終端產品主要應用於消費性電子產品、通訊、工業及汽車等電子元件，尚無產品或技術已過時，而未有改善計畫之情事。		
(二)前項規定，對於最近一個會計年度之營業利益及稅前淨利占股本比率不低於百分之十二者，不適用之。 (三)第一項第一、二款所規定「同業比較」，證券承銷商應評估說明所採樣同業之合理性。 (四)第一項第三、四款之規定，對於已有具體改善計畫並產生效益者，不適用之。 (五)依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定第三十二條第三項：經申請有價證券在創新板上市、創新板第一上市者提出合理性說明後，得不準用之。			
七、申請公司或其現任董事、總經理或實質負責人於最近三年內有違反誠信原則之行為者。 (一)公司部分：	(一)公司部分	是	
1. 所開立之支票存款戶經票據交換所公告為拒絕往來戶，或因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入紀錄未經清償贖回註記者。	1. 經取得該公司財團法人金融聯合徵信中心之信用報告、第一類票據信用資料查覆單、陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書及該公司出具之聲明書，該公司並無因所開立之支票存款戶經票據交換所公告為拒絕往來戶，或因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入紀錄未經清償贖回註記之情事。		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
2. 向金融機構貸款有逾期還款之情形者。但還款完畢已逾三年者，不在此限。	2. 經取得財團法人金融聯合徵信中心之信用報告及該公司出具之聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司並無向金融機構貸款有逾期還款之情事。		
3. 違反勞動基準法被處以刑罰確定者，但最近二年內經檢查機構複查已改善者，不在此限。	3. 經查閱該公司與主管機關往來函文及取得該公司出具之聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司並無違反勞動基準法被處以刑罰確定且尚未改善之情事。		
4. 違反稅捐稽徵法經判決有罪確定者。	4. 經查閱該公司與主管機關往來函文、取得國稅局及稅捐稽徵機關出具之納稅義務人違章欠稅查復表、該公司出具之聲明書及查詢司法院法學資料檢索系統，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司並無違反稅捐稽徵法經判決有罪確定之情事。		
5. 違反申請上市時所出具聲明書之聲明事項者。	5. 經參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無違反申請上市時所出具聲明書之聲明事項之情事。		
6. 有其他重大虛偽不實、違反法令或喪失公司債信情事，而有損害公司利益、股東權益或公眾利益者。	6. 經查閱該公司與主管機關往來函文、取得該公司出具之聲明書及查詢司法院法學資料檢索系統，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司並未有其他重大虛偽不實、違反法令或喪失公司債信情事，而有損害公司利益、股東權益或公眾利益者。		
(二)董事、總經理或實質負責人部分：	(二)董事、總經理或實質負責人部分		
1. 同前款第(一)之 1、2、3、4 及 5 目。但屬向金融機構貸款逾期還款者，倘逾期還款情節非屬重大或有合理事由者，不在此限。	1. 經取得該公司現任董事及總經理出具之聲明書、財團法人金融聯合徵信中心之信用報告、國稅局及稅捐稽徵機關出具之納稅義務人違章欠稅查復表及第一類票據信用資料查覆單，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司董事及總經理最近三年內並無前開(一)第 1 至第 5 目所列情事。		
2. 犯公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、商業會計法、票券金融管理法等商事法規定之罪，或犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等罪，經法院判決有期徒刑以上之	2. 經參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書、查詢司法院法學資料檢索系統並取得該公司董事及總經理出具之聲明書，該公司董事及總經理最近三年內並未有犯公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、商業會計法、票券金融管		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
罪者。	理法等商事法規定之罪，或犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。		
3. 有經營其他公司涉及惡性倒閉或重大違反公司治理原則等不良行為者。	3. 經參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並取得該公司董事及總經理出具之聲明書及查詢司法院法學資料檢索系統，該公司董事及總經理並未有經營其他公司涉及惡性倒閉或重大違反公司治理原則等不良行為之情事。		
4. 有其他重大違反法令或誠實信用原則之行為者。	4. 經參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並取得該公司董事及總經理出具之聲明書，該公司董事及總經理並未有其他重大違反法令或誠實信用原則之行為。 綜上評估，該公司或其董事及總經理於最近三年內，尚無違反誠信原則之行為。		
八、申請公司之董事會成員少於五人或為單一性別，獨立董事人數少於三人或少於董事席次三分之一；其董事會有無法獨立執行其職務；或未依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會者。另所選任獨立董事其中至少一人須為會計或財務專業人士。但本國發行公司申請股票上市前，其股票未登錄為興櫃股票櫃檯買賣者，經承諾至遲於股票上市買賣前完成獨立董事之選任及功能性委員會之設置者，不在此限。	該公司目前設有九席董事，包括四席獨立董事。九席董事分別為：大日月投資有限公司(代表人：張秉堂)、彭盈光、楊式蘭、辰真投資有限公司(代表人：張辰)、張蔚誠、張居興(獨立董事)、温萬壽(獨立董事)、彭俊豪(獨立董事)及譚仲民(獨立董事)，業已符合董事會成員至少五席，且獨立董事不得少於三席或少於董事席次三分之一之規定，其中董事楊式蘭為女性董事，獨立董事張居興係會計或財務專業人士，亦符合左列之規定。另該公司係依證券交易法第十四條之四規定，由四席獨立董事組成審計委員會。該公司業依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會，並委任四席獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。	是	
(一)擔任申請公司獨立董事，有不符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之要件者：	(一)依「公開發行獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定，茲就該四席獨立董事之專業資格及任職要件評估如下：		
1. 擔任申請公司之獨立董事，應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：	1. 經取得該公司獨立董事張居興、温萬壽、彭俊豪及譚仲民之學歷及工作經歷資料，均具有五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，茲分別評估如下：		
(1)商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。	(1)獨立董事張居興畢業於臺灣大學財務金融系碩士，曾任職於中國信託商業銀行副總經理及中信票券金融公司副總經理等，任職期間自 68 年 10 月至 95 年 6 月，具備 5 年以上		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
	商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		
(2)法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。	(2)獨立董事溫萬壽畢業於交通大學電子物理系學士，曾擔任華邦電子股份有限公司之執行副總及瀚宇彩晶股份有限公司之執行長，任職期間自 86 年 5 月至 107 年 11 月，現為豐達科技股份有限公司獨立董事，任職期間自 109 年 6 月迄今，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		
(3)具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	(3)獨立董事彭俊豪畢業於成功大學企業管理系碩士，曾擔任東安投資股份有限公司之經理，現任元大創業投資股份有限公司之總經理，任職期間自 89 年 1 月迄今，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 (4)獨立董事譚仲民畢業於臺灣大學商學研究所碩士，現為力晶積成電子製造(股)公司之副總經理，任職期間自 93 年 3 月迄今，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		
2. 有下列情事之一者，不得充任獨立董事，其已充任者，當然解任： (1)有公司法第三十條各款情事之一。 (2)依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。 (3)違反本辦法所定獨立董事之資格。	2. 經查閱該公司最近期之變更登記事項卡、查詢司法院法學資料檢索系統，並取得該公司獨立董事出具之聲明書、財團法人金融聯合徵信中心之信用報告、第一類票據信用資料查覆單，該公司四席獨立董事並無公司法第三十條各款情事之一，亦非以公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選，或違反「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所定獨立董事資格之情事。		
3. 申請公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間無下列情事之一： (1)公司或其關係企業之受僱人。	3. 獨立性資格之判斷： (1)經核對獨立董事之任職資料，並取具獨立董事之聲明書、學經歷聲明書，且經查閱該公司員工名冊，該公司獨立董事選任前二年及任職期間非為該公司或其關係企業之受僱人。		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
(2)公司或其關係企業之董事、監察人。	(2)經核對獨立董事之任職資料，並取具獨立董事之聲明書、學經歷聲明書，該公司獨立董事選任前二年及任職期間非為該公司或其關係企業之董事或監察人。		
(3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	(3)經核閱該公司之股東名冊，並取具獨立董事出具之聲明書、親屬表及轉投資明細表，該公司獨立董事選任前二年及任職期間並無本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。		
(4)第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	(4)經取得獨立董事出具之聲明書、親屬表、轉投資明細表、該公司股東名冊及董事名單，該公司之獨立董事並無左列情事。		
(5)直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	(5)經取得獨立董事出具之聲明書、工作經歷相關資料及轉投資明細表，並取得直接持有該公司已發行股份總數百分之五、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東董監名單，該公司獨立董事於選任前二年及任職期間非為直接持有該公司已發行股份總數百分之五、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。		
(6)公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。	(6)經取得該公司股東名冊、董事名單、獨立董事出具之聲明書及轉投資明細表，該公司並無董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之情事。		
(7)公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	(7)經查閱該公司之董事長兼總經理或相當職務者兼任其他公司情形，檢視該等兼任公司於經濟部商業司登記之董監事名單，公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶為大日月投資有限公司及意可投資有限公司，經核對獨立董事任職之任職資料及其所出具之聲明書，該公司之獨立董事於委任前二年及任職期間非為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
(8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。	(8)經查核，大日月投資有限公司持有該公司已發行股份總數22.89%，為該公司之特定公司。經取得大日月投資有限公司之董事及監察人名單、該公司獨立董事出具之聲明書、轉投資明細表及工作經歷相關資料，該公司獨立董事於選任前二年及任職期間，非為大日月投資有限公司之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。		
(9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。	(9)經取具獨立董事之學經歷聲明書、任職資料及聲明書，並檢視該公司之勞務費明細帳，該公司獨立董事選任前二年及任職期間,除經111年8月2日及112年8月11日董事會委任為薪資報酬委員會成員外，非為該公司或其關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。		
4. 申請公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。	4. 經取得該公司獨立董事出具之聲明書、轉投資明細表及工作經歷相關資料,該公司獨立董事並無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。		
5. 申請公司之獨立董事選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。	5. 經檢視該公司之公司章程及股東會議紀錄,已載明獨立董事之選舉採候選人提名制,且該公司四名獨立董事分別於111年6月24日及112年3月15日董事會提名通過,並經111年8月2日股東臨時會及112年6月29日股東常會依候選人提名制度選任之。		
(二)擔任申請公司獨立董事者，未於該公司輔導期間進修法律、財務或會計專業知識每年達三小時以上且取得「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」第六條第一、二、四款訂定之進修體系所出具之相關證明文件。	(二)經取得相關證明文件，該公司獨立董事已於輔導期間進修法律、財務或會計專業知識每年達三小時以上，且取得「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」第六條第一、二、四款訂定之進修體系所出具之相關證明文件。		

項　　目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
(三)申請公司之董事彼此間有超過半數之席次，具有下列關係之一： 1.配偶。 2.二親等以內之親屬。 3.同一法人之代表人。 前項(三)之規定，對於政府或法人為股東，以政府或法人身分當選為董事，而指派代表行使職務之自然人；暨由其代表人當選為董事之代表人，亦適用之。 董事間有超過半數之席次具有(三)3.之關係，經目的事業主管機關核准者，不適用之。	(三)經取具該公司董事出具之聲明書、親屬表及轉投資明細表等資料，該公司九席董事之間僅張秉堂與張辰二席法人董事代表人具有二親等關係，其餘董事彼此間均無具有配偶、二親等以內親屬或同一法人代表人之關係，占全體董事席次未達半數，故該公司董事彼此間並未有超過半數之席次具有配偶、二親等以內親屬或同一法人代表人之關係。 綜上評估，該公司未有董事會無法獨立執行其職務之情事。		
九、申請公司於申請上市會計年度及其最近一個會計年度已登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票，於掛牌日起，其現任董事及持股超過其發行股份總額百分之十之股東有未於興櫃股票市場而買賣申請公司發行之股票情事者。但因辦理本準則第十一條之承銷事宜或有其他正當事由者，不在此限。	該公司自 111 年 9 月 26 日登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票，經取得該公司內部人股權轉讓明細表，並查詢公開資訊觀測站董事股權異動資料，尚無發現其現任董事及持股超過百分之十之股東，有未於興櫃股票市場買賣該公司股票之情事。	是	
十、申請公司之股份為上市（櫃）公司持有且合於下列條件之一者，該上市（櫃）公司最近三年內為降低對申請公司之持股比例所進行之股權移轉，未採公司原有股東優先認購或其他不損害公司股東權益方式： (一)申請公司係屬上市（櫃）公司進行分割後受讓營業或財產之既存或新設公司。 (二)申請公司係屬上市（櫃）公司子公司，於申請上市前三年內，上市（櫃）公司降低對申請公司直接或間接持股比例累積達百分之二十以上。	該公司非屬上市(櫃)公司進行分割後受讓營業或財產之既存或新設公司，故不適用本項評估。	是	
十一、其他因事業範圍、性質或特殊情況，而不宜上市之情事。	該公司尚無其他因事業範圍、性質或特殊情況，而有不宜上市之情事。	是	

主辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

評估人員簽章：謝淑惠

彭淑美

張筠梧

梁奕凱

鄒佳容

許哲豪

李昱德

單位主管簽章：康禹吉

負責人簽章：陳佩君

中　華　民　國　一　一　二　年　十　月　二十六　日

（本頁僅供微矽電子股份有限公司股票初次申請創新板上市推薦證券承銷商評估報告使用）

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

評估人員簽章：郭錦輝

單位主管簽章：陳玟妤

負責人簽章：黃進明

中　華　民　國　一　一　二　年　十　月　二十六　日

（本頁僅供微矽電子股份有限公司股票初次申請創新板上市推薦證券承銷商評估報告使用）

協辦證券承銷商：富邦綜合證券股份有限公司

評估人員簽章：李珈芳

單位主管簽章：吳春敏

負責人簽章：程明乾

中　華　民　國　一　一　二　年　十　月　二十六　日

（本頁僅供微矽電子股份有限公司股票初次申請創新板上市推薦證券承銷商評估報告使用）

協辦證券承銷商：宏遠證券股份有限公司

評估人員簽章：張惠雯

單位主管簽章：吳儲仰

負責人簽章：姜克勤

中　華　民　國　一　一　二　年　十　月　二十六　日

（本頁僅供微矽電子股份有限公司股票初次申請創新板上市推薦證券承銷商評估報告使用）

附件十七

創新板上市前現金增資發行新股證券承銷商評估報告

微矽電子股份有限公司

一一二年度現金增資發行新股

證券承銷商評估報告

主辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

中 華 民 國 １１２ 年 １２ 月 ２８ 日 編 製

評估報告目錄

壹、承銷商總結意見.....1
貳、評估報告內容摘要.....2
一、產業概況.....2
二、發行人之競爭地位.....11
三、營運風險.....15
四、最近期及最近二個會計年度募集與發行有價證券籌資效益.....39
參、業務財務狀況.....39
一、業務狀況.....39
二、財務狀況.....71
肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....91
一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改善計畫.....91
二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益.....91
三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響...91
四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近二個會計年度有無財務週轉困難情事.....93
五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開.....93
伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....94
一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項性質依附表九之一中所列事項詳與評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行.....94
二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事.....94
二之一、總括申報發行新股案件者，是否符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十九條之一及十九之二所列情事.....107
三、是否符合中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定.....107
四、法令之遵循及對公司營運影響.....120
五、說明發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內是否曾受法務部律師懲戒委員會懲戒，且是否與發行公司、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有財務會計準則公報第六號規定之關係人關係或其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者.....125

陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論 126
一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有合理性 126
一之一、總括申報發行新股案件者，應另就下列事項提供評估說明 128
二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估 128
三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性 129
三之一、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性 136
四、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應評估其可行性與合理性 136
五、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響 136
六、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式者，應評估事項 136
七、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性 138
陸之一、是否確實依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項 138
柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論 138
捌、就本次公司債發行(及轉換)辦法之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論 138
玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論 138
拾、就本次發行公司債債權確保情形(列明有無擔保、擔保品種類與價值等)蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果 138
拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論 138
拾貳、就本次附認股權公司債、分離型認股權公司債射算理論價值之各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論 138
拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論 139
拾肆、於公開說明書刊印日期，如有重大期後事項，亦應查明本要點各相關事項並加以更新說明與評估 139

壹、承銷商總結意見

微矽電子股份有限公司本次為辦理創新板上市前現金增資發行普通股 4,042 千股，每股面額新台幣壹拾元整，合計發行總金額為新台幣 141,470 千元，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解微矽電子股份有限公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，微矽電子股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

兆豐證券股份有限公司

負責人：陳佩君

承銷部門主管：郝振邦

中華民國　　年　　月　　日

貳、評估報告內容摘要

該公司主要係從事半導體測試(Semiconductor Testing)、半導體封裝(Semiconductor Packaging)及晶圓薄化(Wafer Thinning)等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC(Power Management Integrate Circuit, 以下簡稱電源管理 IC 或 PMIC)、金氧半場效電晶體(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，以下簡稱 MOSFET)產品及以氮化鎵(Gallium Nitride, 以下簡稱 GaN)或碳化矽(Silicon Carbide, 以下簡稱 SiC)為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。

本承銷商依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，蒐集發行人所屬行業之產業報導等資料，並了解公司之財務業務狀況，說明其產業概況、發行人之競爭地位及營運風險、最近期及最近二個會計年度募集與發行有價證券籌資效益如下：

一、產業概況

(一)產業現況

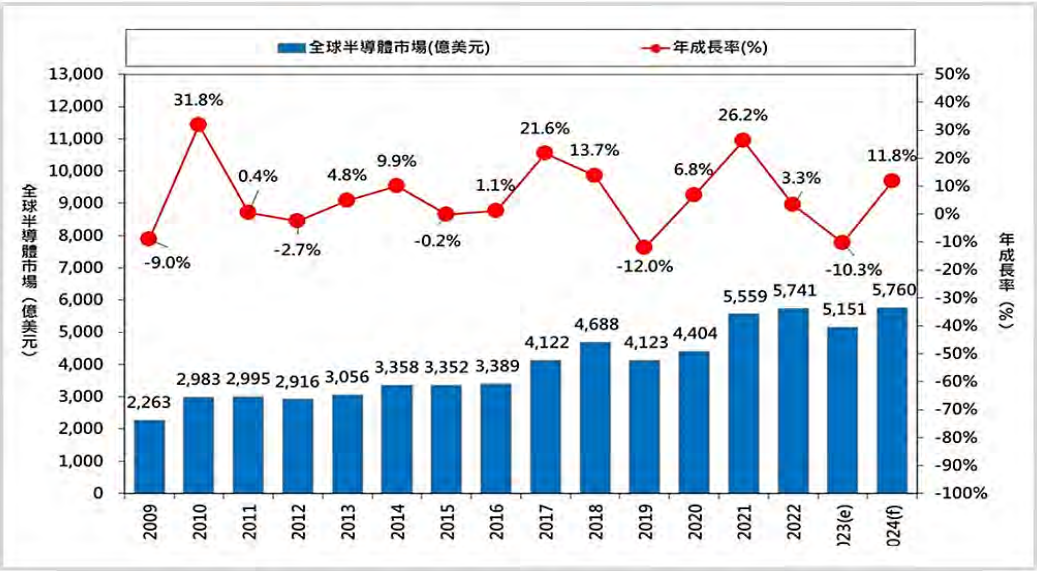
該公司主要係從事半導體測試(Semiconductor Testing)、半導體封裝(Semiconductor Packaging)及晶圓薄化(Wafer Thinning)等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC(Power Management Integrate Circuit,以下簡稱電源管理 IC 或 PMIC)、金氧半場效電晶體(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，以下簡稱 MOSFET)產品及以氮化鎵(Gallium Nitride, 以下簡稱 GaN)或碳化矽(Silicon Carbide, 以下簡稱 SiC)為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。以下就該公司所屬之半導體及 IC 封測產業、功率半導體及晶圓薄化之產業概況及所屬行業營運風險分述如下：

1.半導體及 IC 封測產業

半導體晶片為現今大多數科技產品之核心，從智慧手機、電腦、

家電、醫療設備、通訊、能源及工業自動化等無所不在，近年來隨著半導體產業持續發展與先進製程的不斷突破，加上通訊、車用、物聯網、工業電腦及伺服器等運算效能需求大幅增加，開創半導體產業的新契機，2021 年受惠全球零接觸經濟的興起，帶動個人裝置、雲端運算及資料中心需求增加，使全球半導體市場在 2021 年高度成長。根據工研院產科國際所統計(詳圖一)，在 2021 年半導體市場全年總銷售值達 5,559 億美元，較 2020 年成長 26.2%。隨著全球人工智慧、物聯網、5G、高效能運算及車用等應用需求持續成長，帶動全球半導體市場的需求。2022 年全球半導體產業市場成長 3.3%，達 5,741 億美元。2023 年上半年由於烏俄戰爭引發全球通貨膨脹，終端市場需求急速下滑使得廠商營收放緩，預期 2023 年下半年在庫存調整接近尾聲後有望逐步復甦，整體而言，半導體市場在 2023 年受制於市場供過於求及價格疲軟等因素，預估 2023 年全球半導體市場規模為 5,151 億美元，較 2022 年衰退 10.3%。2024 年受惠 AI 伺服器需求及通膨趨緩影響，全球半導體市場預計將可成長 11.8%，達到 5,760 億美元。

圖一：全球半導體市場規模

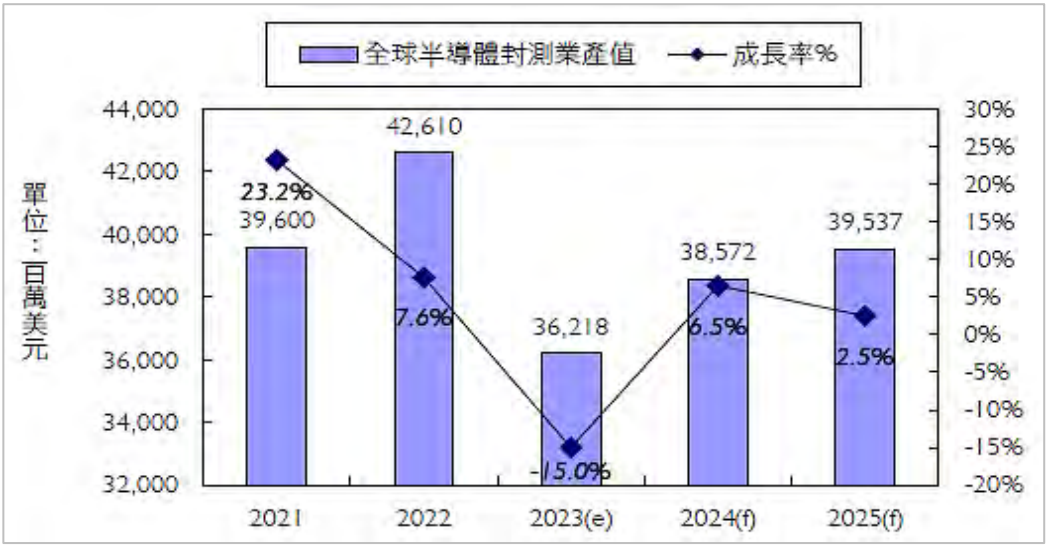


資料來源：工研院產科國際所 2023/6

封裝測試為半導體產業鏈後段的核心，對最終晶片的品質與性能至關重要，依據工研院產科國際所(詳圖二)研究報告，全球半導體封測產業 2021 年因疫情反覆、居家工作與學習的趨勢不輟，帶動 PC、NB、相關物聯網及終端電子產品需求，使全球半導體封測產業市場在 2021

年高度成長，市場規模達 396 億美元，較 2020 年成長 23.2%。隨著全球人工智慧、物聯網、5G、高效能運算及車用等應用需求持續成長，半導體供應鏈持續擴張，2022 年全球半導體封測產業市場規模成長 7.6%，達 426 億美元。2023 年上半年由於烏俄戰爭引發全球通貨膨脹，終端市場需求急速下滑，諸多封測廠產能利用率較低，預期 2023 年下半年在庫存調整接近尾聲後有望逐步復甦，預估 2023 年全球半導體封測產業市場規模為 362 億美元，較 2022 年衰退 15.0%。展望未來，隨著半導體產業逐步回升，加上廠商於先進封裝及異質整合的佈局，將有助於 2024 年半導體封測產業持續成長。

圖二：全球半導體封測產業市場規模



資料來源：工研院產科國際所 2023/5

台灣半導體產業從上游至下游，以專業分工及群聚效益獨步全球，在部分國家因疫情停工及美中貿易戰影響，台灣半導體廠因全球市佔率高及產品線廣泛而獲轉單效應，根據工研院產科國際所報告(詳圖三)統計，2021 年台灣半導體產業產值達 4.08 兆新台幣，較 2020 年成長 26.7%。在全球人工智慧、高效能運算、5G、車用、物聯網等應用需求提升，加上價格提高與新建置產能逐步導入下，2022 年台灣半導體產業產值達 4.83 兆新台幣，較 2021 年成長 18.5%。但 2023 年因受通貨膨脹及終端需求減緩影響下，廠商調整庫存導致產能利用率下滑，預估 2023 年台灣半導體產業產值為 4.56 兆新台幣，較 2022 年衰退 5.6%。

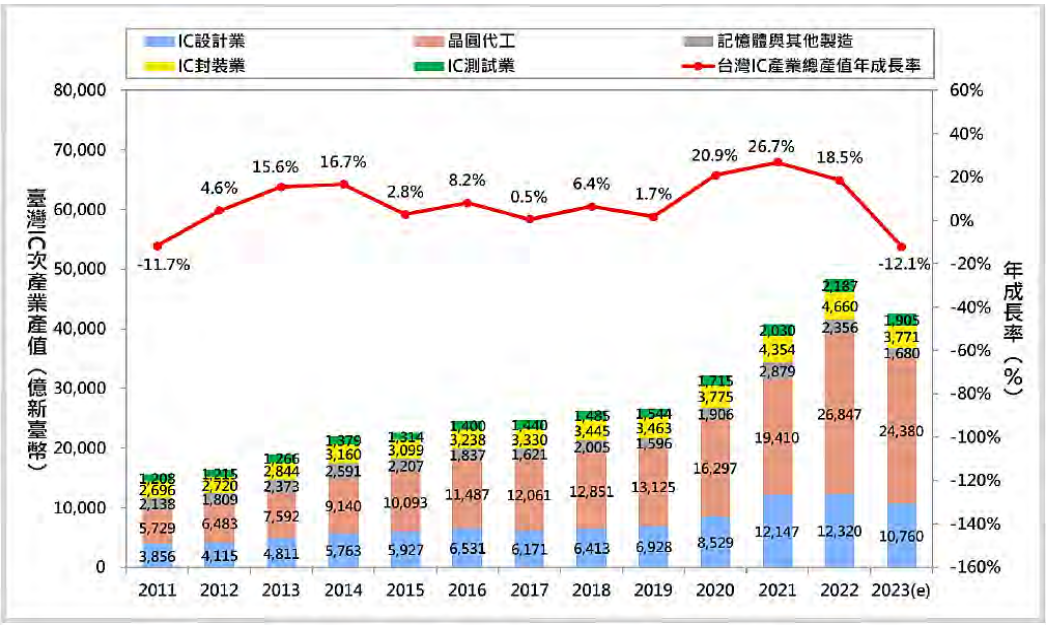
圖三：台灣半導體產業產值成長趨勢

億新臺幣	2019	2019 成長率	2020	2020 成長率	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023 (e)	2023 (e) 成長率
IC產業產值	26,656	1.7%	32,222	20.9%	40,820	26.7%	48,370	18.5%	45,643	-5.6%
IC設計業	6,928	8.0%	8,529	23.1%	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,800	-12.3%
IC製造業	14,721	-0.9%	18,203	23.7%	22,289	22.4%	29,203	31.0%	28,213	-3.4%
晶圓代工	13,125	2.1%	16,297	2.1%	19,410	19.1%	26,847	38.3%	26,486	-1.3%
記憶體與其他製造	1,596	-20.4%	1,906	19.4%	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,727	-26.7%
IC封裝業	3,463	0.5%	3,775	9.0%	4,354	15.3%	4,660	7.0%	4,500	-3.4%
IC測試業	1,544	4.0%	1,715	11.1%	2,030	18.4%	2,187	7.7%	2,130	-2.6%
IC產品產值	8,524	1.3%	10,435	22.4%	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,527	-14.6%

資料來源：工研院產科國際所 2023/3

另該公司所屬半導體產業中之 IC 封測產業，依據工研院產科國際所(詳圖四)研究報告，2021 年因疫情及變種病毒持續擴散全球，遠距辦公及教學仍為多數國家的防疫方式，故消費性電子需求持續增加，致 2021 年台灣 IC 封測產業產值為新台幣 6,384 億元，較 2020 年成長 16.28%。隨著高效能運算、5G、物聯網和車用電子等的需求暢旺，且台灣 IC 封測產業擁有全球先進封裝技術能量及多樣化產品線，在各項動能持續推升下，2022 年台灣 IC 封測產業產值達新台幣 6,847 億元，較 2021 年成長 7.03%。2023 年受高庫存與需求下降影響，終端進行庫存及產品組合調整，預估 2023 年台灣 IC 封測產業產值將為新台幣 5,676 億元，較 2022 年衰退達 17.10%。

圖四：台灣 IC 封測產業產值

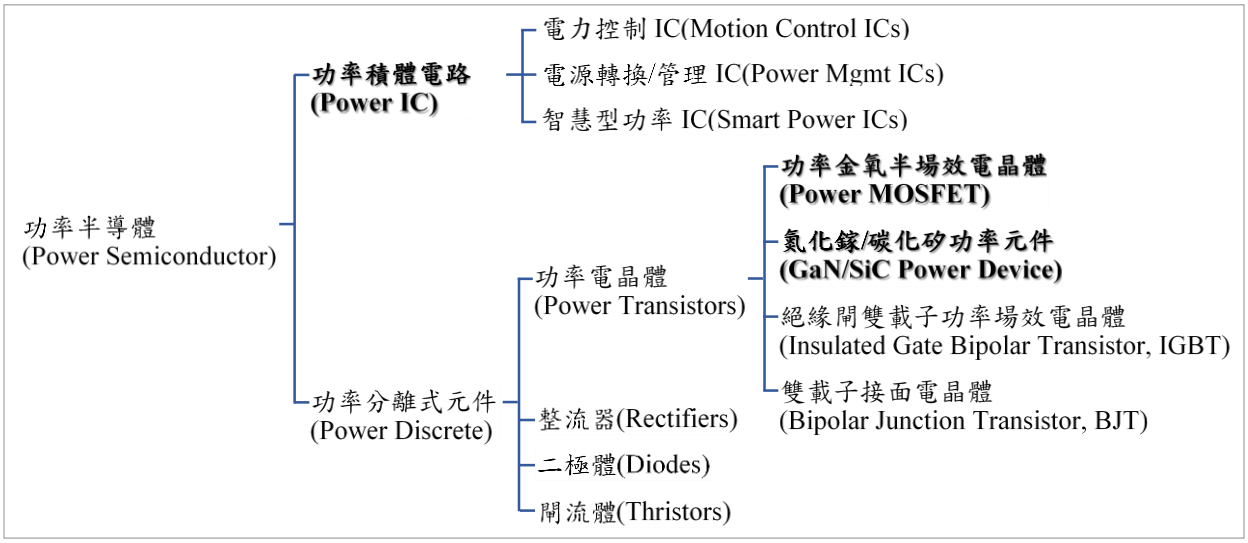


資料來源：工研院產科國際所 2023/5

2.功率半導體產業

功率半導體係屬半導體產業之一部分，係用於電子產品之電能轉換與電路控制，是電能功率處理之核心元件，也是電源供應之重要通道。典型之功率處理包括變頻、變壓、整流、功率放大與管理，除確保設備正常運行外，還能有效節能。市場研究調查機構 BusinessWire 將功率半導體(Power Semiconductor)分為功率積體電路(Power IC)及功率分離式元件(Power Discrete)等兩大類，各占功率半導體產業市值五成。

圖五：功率半導體產品分類



資料來源:兆豐證券整理

在功率半導體領域中(詳圖五)，該公司主要係提供電源管理 IC、MOSFET 及 GaN/SiC 之第三代半導體產品之測試封裝服務，茲就電源管理 IC、MOSFET 及第三代半導體之產業現況敘述如下：

(1)電源管理 IC

電源管理 IC 是一種特定用途的集成電路，係將傳統分立於各類功能的電源管理器件整合在單顆 IC 內，藉此提高空間利用率和系統電源效率，並在有限的體積內集成更多的電源通道，提供所需的正確供電電流及電壓，並藉由控制功率元件，使電流符合終端不同階段之需求，以達到對應用產品高效率和高整合度，成為系統供電的首選。

電源管理IC在所有電子產品中扮演著不可或缺的關鍵性角色，其主要作為在不同的系統運作狀態下，隨時控制並保持系統內適當電流與電壓正常供給，而電源管理 IC 的優劣，將會直接影響電子產品的使用壽命。電源管理 IC 應用廣泛，舉凡工業控制、通訊產業、汽車工業、消費性電子產品、可攜式產品及電腦工業產品上皆可見其應用，而伴隨著各式電子產品高效能與低功耗之需求，加上全球 ESG 風潮興起，各國在低碳排放的共識下，以致電源管理 IC 發展更顯重要。依據市場調查機構 IC Insights(詳圖六)預估，全球電源管理 IC 規模從 2022 年至 2028 年的複合成長率約為 7.9%。

圖六：全球電源管理 IC 市場預估

資料來源：IC Insights 2023/3

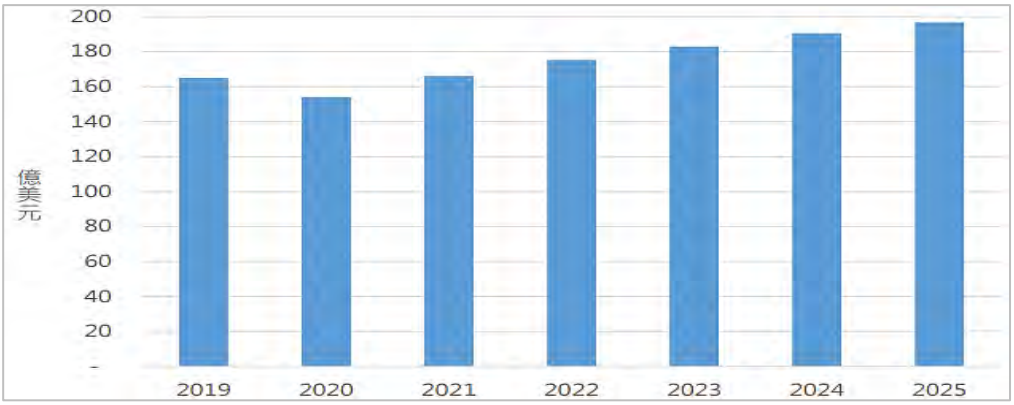
(2)MOSFET

功率元件中之功率電晶體係包含 MOSFET、氮化鎵/碳化矽功率元件(GaN/SiC Power Device)、絕緣閘雙載子功率場效電晶體(IGBT)及雙載子接面電晶體(BJT)等，MOSFET 係用於電子裝置的電能轉換與電路控制，也是弱電控制與強電運行間之橋樑，具有驅動電路較簡單、損耗低、熱阻特性佳以及頻率較高等優勢，在電子產品中被廣泛應用，成為最大宗產品，除確保設備正常運行外，還能有節能效果，為電能處理之核心器件，其應用範圍涵蓋消費性電子、家電、工業產品、通訊設備、再生能源及國防軍事等。

鑒於 MOSFET 之產品周期較長、穩定性高等特點，產品設計更著重於分析材料之物理化學性質及製程，並進行參數調整和性能改良，以製作出符合客戶需求之客製化產品，故 MOSFET 之核心

技術除結構設計外，在初期材料選擇、晶圓製程及後段測試封裝等部分皆舉足輕重，MOSFET 市場成熟且穩健，在技術水平與生產良率持續提升下，以及元件整合，使產品應用領域將逐漸拓展。隨著全球節能減碳趨勢盛行及電動車市場成長，將帶動功率元件需求增加，依據工研院產科國際所(詳圖七)研究報告預估，全球功率元件市場規模從 2022 年至 2025 年的複合成長率約為 5%。

圖七：全球功率元件市場規模



資料來源：工研院產科國際所 2022/10

(3)第三代半導體

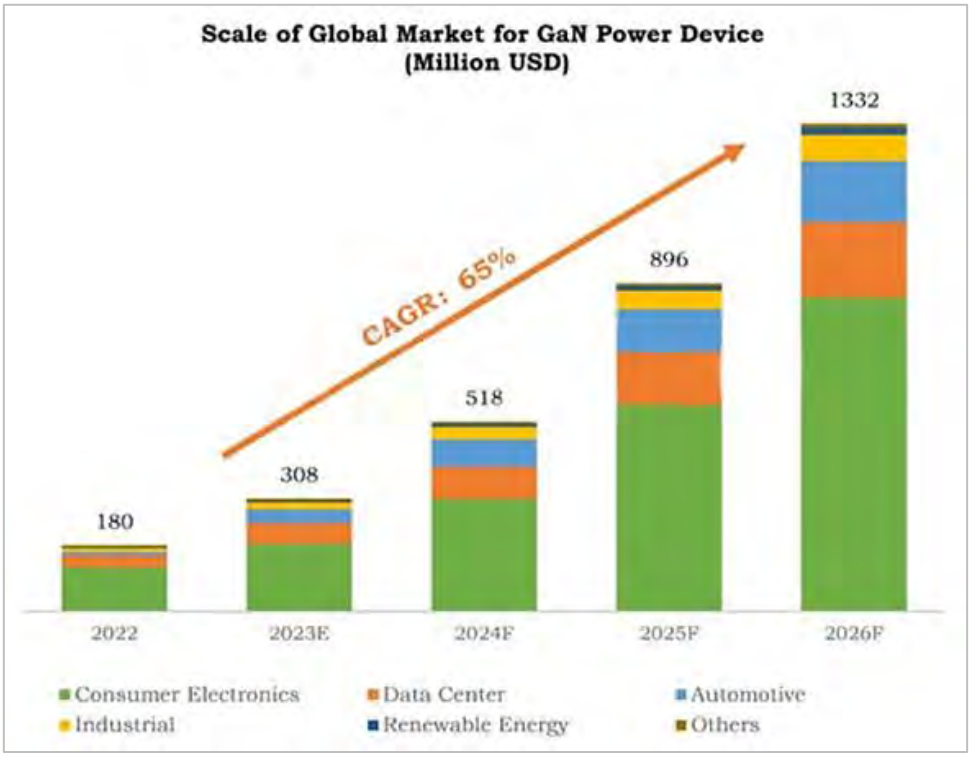
第三代半導體係指功率元件之材料特性使用 GaN 與 SiC 的寬能隙(Wide Band Gap, WBG)材料製造的化合物半導體，可適用在與第一代及第二代半導體之不同領域，故並不是取代傳統半導體材料 Si(矽)及砷化鎵(GaAs)，而是因應新市場需求而發展，相較於第一代半導體材料的 Si 與第二代半導體材料的 GaAs，第三代半導體材料具有寬能隙、高熱導率、高擊穿電場及高電子遷移率等特性，可大幅提升效率、減少耗電量及縮小體積等優勢，一般而言，GaN 適用於中低功率、高頻率產品，SiC 適用於高壓高功率產品，隨著電動車、新能源、5G 及低軌衛星等市場趨勢下，未來第三代半導體已成不可或缺的重要元件。另就第三代半導體使用之 GaN 及 SiC 功率元件之產業現況分述如下：

A.GaN

GaN 為高頻應用的主流元件，開關速度快且體積小，可以有

效縮小產品尺寸，主要應用於消費性電子產品快充、5G 基地台及低軌衛星等，依據市場研究機構 TrendForce 集邦(詳圖八)統計，隨著知名手機大廠首次採用 GaN 技術的快速充電器，將加速第三代半導體於消費市場應用的滲透率，致 2022 年 GaN 功率元件市場規模達 1.8 億美元。受惠於 5G 通訊及資料中心高效能運算的推動下，從 2022 年至 2026 年的複合成長率約為 65%，2026 年 GaN 功率元件市場規模將達 13.32 億美元。

圖八：GaN 功率元件市場規模

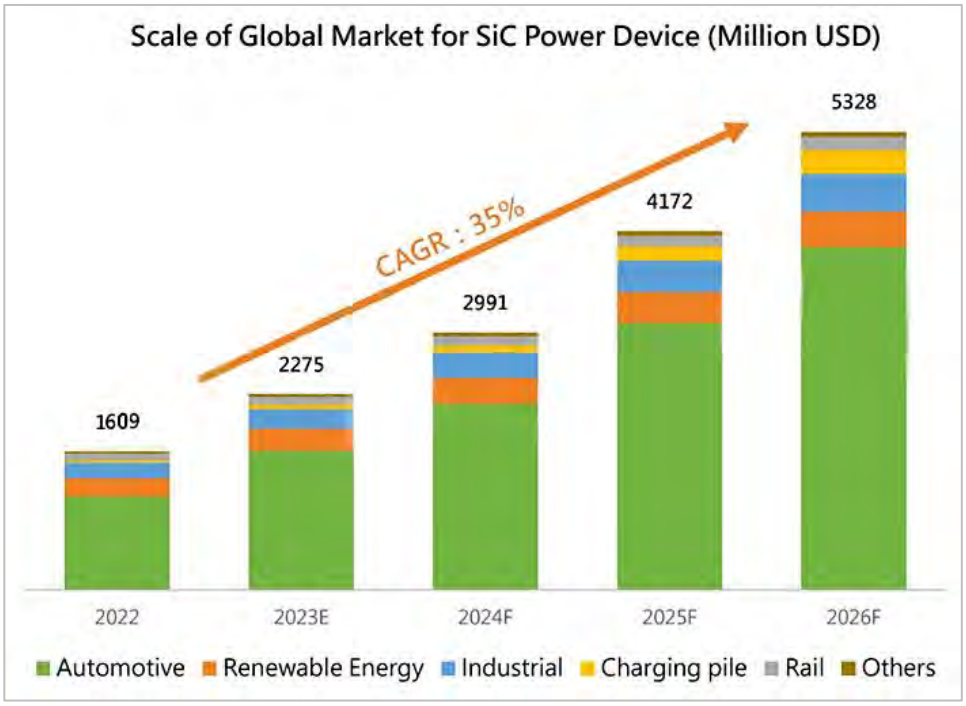


資料來源：TrendForce 2023/7

B.SiC

SiC 為高壓高功率應用的主流元件，導熱性及耐壓性佳，可以減少電能的轉換損耗，主要應用於電動車、太陽能發電、儲能設備及充電樁等，依據 TrendForce 集邦(詳圖九)統計，隨著碳排標準的提高，更多車廠於驅動系統中導入 SiC 技術，致 2022 年 SiC 功率元件市場規模達 16.09 億美元。受惠於新能源及電動車持續需求下，從 2022 年至 2026 年的複合成長率約為 35%，2026 年 SiC 功率元件市場規模將達 53.28 億美元。

圖九：SiC 功率元件市場規模



資料來源：TrendForce 2023/7

3.晶圓薄化產業

半導體晶圓薄化為功率元件不可或缺的重要製程，主係為晶圓進行正面金屬鍍膜(Front Side Metallization,以下簡稱 FSM)、晶圓背面研磨與金屬鍍膜(Backside Grinding and Backside Metallization,以下簡稱 BGBM)，目前傳統晶圓厚度為 700-800um，而晶圓薄化技術可使其厚度減少到甚至 50um，能夠幫助降低電流通過之阻值，減少功率損耗，除了有效減少後續封裝體積外，並能減少熱能累積效應，滿足元件薄型化、高性能、節能之需求，故晶圓代工廠完成之產品需再進行晶圓薄化相關製程後，才能進行後段封裝測試處理。

半導體晶圓薄化技術的主要應用領域為消費性電子、家電、工業產品、通訊設備、再生能源及國防軍事等，受全球節能減碳趨勢盛行、電動車市場成長及物聯網、5G 等新興行業的快速發展影響下，晶圓薄化應用領域將更加廣泛。依據工研院產科國際所(詳圖七)研究報告預估，全球功率元件市場規模從 2022 年至 2025 年的複合成長率約為 5%，故預估晶圓薄化的市場規模將日益增加。

二、發行人之競爭地位

(一)未來發展之有利與不利因素

該公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，茲就其未來發展之有利與不利因素說明如下：

1.有利因素

(1)國內半導體專業分工完整

台灣半導體產業體系分工完整，隨著 5G、高效能運算、物聯網等趨勢擴大及製程技術的快速演進，晶圓代工廠、測試廠與封裝廠，各自不斷進行擴產及提高生產技術，持續強化 IC 製造國際競爭力之領先優勢，藉由晶圓代工廠、測試廠與封裝廠日趨專業與經濟規模，能提供專業 IC 設計公司先進的技術與製程、彈性靈活的生產調度、世界級的服務品質與快速的應變能力等優質之後勤支援，可提供高品質且具有國際競爭力的產品，對未來發展將是一大利基。

(2)產品終端應用市場未來將持續成長

該公司產品終端應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件，112 年度雖消費性電子產品相關市場成長放緩，惟需求仍是最高，而手持式行動裝置等消費性電子產品不斷追求輕、薄、短、小及低功耗之特性，故對晶圓之特殊製程要求越來越多;隨著 5G、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件快速發展及全球低碳排放的共識下，而第三代半導體材料具有寬能隙、高熱導率、高擊穿電場、高電子遷移率等特性，可大幅提升效率、減少耗電量及縮小體積，故依據市場研究機構集邦圖八及圖九，預期未來將被廣泛應用。

(3)客戶導向之服務策略

該公司除在產品品質、交期、良率均能滿足客戶之需求外，多年來持續因應客戶新產品測試封裝之需求，精進測試封裝研發技術及測試機台改機設計之優化，建構多角化的產品組合，可同時提供晶圓測試、成品測試、探針卡製造、晶圓 FSM、晶圓 BGBM、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，降低產品來回運送成本與風險、縮短交期，並與 IC 設計公司維持良好互動關係，隨時掌握市場脈動與客戶共同成長。

(4)產業進入障礙較高

測試封裝的品質仰賴測試程式及機台軟硬體之配合，暨測試機台零件使用的適當性及設備參數的調整，在在考驗測試封裝人員的

經驗及管理團隊長久的默契，該公司因應市場趨勢及配合客戶產品開發，因此當客戶在特定專業測試封裝廠擁有穩定的品質時，較不容易將該產品轉換至其他專業測試封裝廠生產，測試及封裝費用雖佔 IC 的成本比重不高，但假若發生品質問題將導致產品的全面回收，致 IC 設計公司既有產品更換封測廠的意願不高，另該公司專注於電源管理 IC 與功率元件之測試封裝，累積多年的專業的產製經驗，與客戶建立長期的合作關係，對於後來才加入 IC 封測市場之同業更具競爭利基。

2.不利因素及因應對策

(1)半導體市場景氣波動，影響公司營運

測試封裝廠屬於半導體產業供應鏈後段製程，因此仍受半導體景氣循環影響。

因應對策：

因應半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司持續研發，與客戶建立長期的合作關係，提供客戶高附加價值之代工服務。隨高效能運算、5G、物聯網和車用電子等市場持續擴大，該公司之客戶已於各類產品進行佈局，以降低已成熟產品之市場需求力道減弱所帶來之營運風險，未來該公司持續與客戶配合，搭配該公司各項代工製程及機台改良技術，強化品質、成本、交期的優勢，以因應市場快速變化及同業之競爭。

(2)研發人員流失之風險

隨著半導體產業不斷的發展，具經驗之技術開發及研發人才的爭取日漸困難，且需要長時間培養及訓練，故具經驗之研發人才常成為他公司招攬之對象。

因應對策：

該公司透過技術人員之技術傳承、實作經驗分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術開發及研發人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的研發團隊。此外，提供良好的工作環境，並建立制度化的員工福利措施，以增進員工之向心力。對於研發人員均要求簽訂保密合約，且對於所研發之技術做適當之資料保存，以預防研發人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。另該公司積極推動上市，藉以提高公司知名度，吸引優秀人才，並可透過發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及員工酬勞等工具，將公司經營成果與員工共享，以提高員工之向心力。

(3)中國半導體產業之競爭風險

近年來中國半導體業力求提高自給率，並在政策上大力支持下，將成為中國半導體封測公司步入快速發展的有效驅動力，對我國半導體產業形成競爭壓力。

因應對策：

該公司以強化新產品的研究發展計畫及提供精進之測試封裝服務能力，以品質、交期、效率與彈性的服務內容，與中國大陸廠商形成區隔，獲取更多台灣及國外客戶長期合作的機會。

3.市場占有率

依據工研院產科國際所顯示(詳圖三)，我國 111 年度 IC 封測產值為新台幣 6,847 億元，該公司 111 年度營收為 12.26 億元，佔國內 IC 測試產值約為 0.18%。與同業上市公司或知名公司比較及其在同業間之地位如下：

單位:新台幣千元

公司名稱	111 年度					
	營收淨額	成長率	資本額	稅後淨利	稅後淨利率	每股盈餘(註)
微矽電子	1,226,677	(5.09)%	646,600	168,338	13.72%	2.70
京元電子	36,781,996	8.95%	12,227,451	6,982,090	18.98%	5.49
矽格	18,694,345	12.07%	4,567,410	3,513,949	18.80%	6.68
昇陽半導體	3,138,053	18.36%	1,526,280	325,251	10.36%	2.06

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：每股盈餘為基本每股盈餘

該公司主要係從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC、MOSFET 產品及以 GaN 或 SiC 為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。綜觀台灣上市半導體測試封裝公司其業務型態、產品性質及營業項目後，採以下三家公司做為採樣公司，京元電子股份有限公司（上市股票代號：2449，以下簡稱京元電子）主要營業項目為晶片研磨切割及測試封裝業務，終端應用涵蓋資訊、通訊、辦公室自動化、汽車電子以及消費性電子等相關產品；矽格股份有限公司（上市股票代號：6257，以下簡稱矽格）主要營業項目為測試封裝業務，終端應用涵蓋高效能運算、通訊、影音、消費性電子以及車用電子等相關產品；昇陽國際半導體股份有限公司（上市股票代號：8028，以下簡

稱昇陽半導體）主要營業項目為晶圓再生服務及晶圓薄化製程服務，終端應用涵蓋消費性電子、工業用電子產品及汽車等電子元件。

該公司與採樣公司相較，主係各公司之產品服務組合及終端市場略有不同，營收淨額與成長率低於採樣公司，而稅後淨利率及每股盈餘與採樣公司相較互有高低。該公司成立至今多年不斷耕耘本業之發展，另積極進行廠房擴建以因應第三代半導體市場之高速成長需求。

(二)公司競爭利基

1.擁有豐富經驗及專業能力之經營團隊

該公司經營團隊均已於業界服務多年，對產業環境變化、產品發展趨勢、生產製造及行銷業務等各方面具嫻熟經驗，可迅速掌握市場趨勢脈動，提供最佳測試封裝服務，並協助客戶新產品快速的導入與量產，對該公司現有開發具有相當助益。

2.優秀的研發團隊，提升市場競爭力

該公司熟悉材料與元件特性，搭配專業的研發團隊，並以累積多年之經驗，除可自行開發探針卡及製程技術外，該公司與國內晶圓代工廠有共同開發合作，亦可提前在新產品應用在技術上佈局，為客戶建立新型態之供應鏈及價值鏈服務，並致力於提高產品良率及降低成本，深得半導體客戶認可，為該公司未來市場競爭的優勢之一。

3.與客戶建立長期的合作關係

該公司工程技術團隊提供客戶一貫化整合性服務，可同時提供晶圓測試、成品測試、晶圓 FSM、晶圓 BGBM、晶圓切割及晶粒挑揀等服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險，並提供客戶最佳解決方案，保持良好的合作默契，與客戶建立長久合作關係。

4.強化製程管理與提升產能利用率

產能利用率之高低直接影響公司獲利，而產能利用率取決於製程良率、成本及交期，該公司在半導體封測領域深耕多年，累積多年之經驗及技術能量，致力於產品品質之提升，亦深獲客戶信賴。此外該公司亦強化管理控管生產成本,在技術與先進測試技術上持續進行精進與改良,以增加產品價格之競爭力，使產能得到充分且穩定的利用。

5.產線自動化

除了製程技術外，該公司擁有優良的 IT 系統能力，除了維持原有的高品質測試封裝服務之外，還可進一步提高生產效率與降低人力成本，於大量生產之下客戶端將有競價的空間，也更有助於業務推展。

三、營運風險

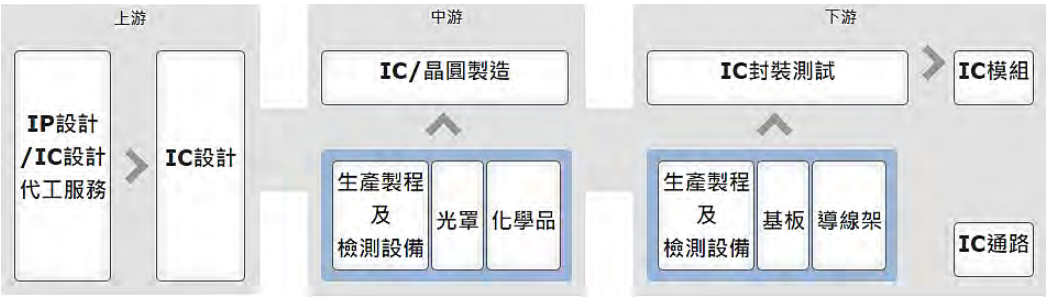
(一)行業營運風險

1.景氣循環

該公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，係屬 IC 產業鏈的後段製程，半導體產品經由前段 IC 設計及晶圓製造後，即進入 IC 測試與封裝或晶圓薄化階段之後段製程，該公司所提供服務之產能需求與其終端產品之產業景氣息息相關。該公司主要客戶多為國內外上市櫃之 IC 設計公司，其終端應用層面廣泛，隨著半導體製程之演進，終端產品於功能及效能不斷提升，加上電源管理 IC、MOSFET 及第三代半導體市場規模預期將逐年提高之情況下，應可有效降低成熟產品之市場需求力道減緩所帶來之營運風險，且該公司建置多角化的產品組合，可有效分散景氣風險，整體而言，該公司半導體服務受景氣循環影響所面臨之營運風險應屬有限。

2.行業上中下游變化

該公司係屬於半導體產業下游之 IC 封裝測試公司，主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，當 IC 設計公司電路設計完成，則交給中游之 IC 製造公司以電路轉換生產成晶片，最後再由下游之 IC 封裝及測試廠將製造完成之 IC 晶片進一步封裝及測試而完成最終之 IC 成品，成品再經銷售管道售予組裝代工廠商裝配生產成為最終產品，故每一生產環節皆有個別廠商投入而形成一專業分工體系。茲將該行業上、中、下游之關聯性列示如下圖：



資料來源：台灣證券交易所-產業價值鏈資訊平台

3. 行業未來發展

(1)終端產品節能的趨勢，晶圓薄化製程逐獲重視

由於終端產品走向節能的趨勢，電子產業持續針對節能進行優化，晶圓薄化製程除了將晶圓製造後其厚度減薄，亦可幫助降低電流通過之阻值，減少功耗所產生過熱之情形，有助於提升電源轉換效率、產品品質及產品性能，且大幅度節約電能、降低能源消耗，因此晶圓薄化後之半導體產品特性優異，為提升產品競爭力之重要技術之一。

(2)第三代半導體的高階的測試封裝解決方案需求提高

近幾年，受到電動車、新能源、5G 通訊、資料中心及低軌衛星等應用驅動及全球節能減碳趨勢盛行下，科技產品對於高頻、高效能運算及高速充電的需求上升，矽與砷化鎵由於自身的性能限制已經無法滿足現狀，故具有寬能隙的第三代半導體，如 GaN 及 SiC，便逐漸滲透高階應用市場，由於第三代半導體產品高頻率、高電壓、高電流、高功率、高硬度的特性，需要開發更多高階的測試及封裝解決方案，以滿足產品規格演進的需求，確保產品在長時間高負載下能夠穩定運行。

(3)半導體專業分工化使測試封裝需求提高

半導體業多以全球化專業分工模式進行，降低人力及其它層面的成本達到公司最大利益，IC 生產步驟已由 IDM 完全獨立包辦，逐步轉變為個別公司專業分工之合作模式，由專業 IC 設計公司、晶圓代工廠以及封裝測試業者形成一條緊密的 IC 產業鏈。隨著半導體製程的不斷精進，IDM 廠商因而將製造業務委外給專業的專業晶圓代工及封測業者，故垂直專業分工為主的 IC 設計業、晶圓製造與 IC 封測業產值比重逐漸提高，商機也越來越大。

4. 產品可替代性

近年來終端產品對精密度及功能性之要求大幅提升，半導體製程因應此趨勢不斷演進，並隨著國際知名半導體大廠紛紛轉為輕晶圓廠或無晶圓廠之營運模式，促使半導體產業專業分工精細，衍生出半導體封裝測試之商機，而該公司具有豐富的測試及封裝經驗，並自行開發出晶圓 FSM 及 BGBM 等服務，為提供客戶一站式之服務，與客戶維持長久之合作關係，客戶亦不易輕易變更合作廠商，以確保產品品質及如期交貨，故目前尚未有產品可替代之風險。

(二)業務之營運風險

1.市場未來供需情形

近期的半導體需求走向，已邁入 3 奈米的研發世代，半導體在製程的難度也陡然提升，IC 封測技術也變得日益重要。隨著半導體技術不斷發展，電晶體之架構持續推陳出新，使功率消耗和用電量成為很大的挑戰，同時晶片產生的大量熱能也會影響熱效率，因此需要在封裝測試中進行更多與更完整的測試。另因應終端產品走向節能的趨勢，電子產業持續針對節能進行優化，晶圓薄化製程除了可以有效減少晶片厚度以外，亦可幫助降低電流通過之阻值，減少功耗所產生過熱之情形，有助於提升電源轉換效率、產品品質及產品性能，且大幅度節約電能、降低能源消耗，實現半導體元件性能全面提升之目標，預期對於這些需求將持續成長。而該公司持續研發及改良製程，近幾年投入資本支出擴建廠房及添購設備，逐步建立產線，搭配卓越的工程開發能力，提供客戶更趨完整的測試、封裝與薄化服務。

由於電動車、新能源、5G 通訊、資料中心及低軌衛星等新興應用趨勢下，再加上既有電子產品對節能的需求也同步攀升，電子設備產品電能的消耗，節能減碳呼聲日增月益，因第三代半導體材料可在高頻、高壓及高溫運作環境中，擁有優異的功率轉換效率，且減少發熱與耗電問題，達到省電及延長裝置壽命的目標，故第三代半導體材料的導入將為未來廠商致力的目標。而該公司持續專注於 GaN 與 SiC 測試技術的研發，再加上與多家知名第三代半導體客戶的長期合作，將成為該公司能夠成功跨入第三代半導體測試領域的契機。

(三) 技術能力、研發及專利權之營運風險

1. 取得技術專家之評估意見佐證

本證券承銷商與該公司並未委請技術專家就該公司之技術研發能力出具意見或報告，故不適用。

2. 研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，以了解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對申請公司之營運風險。

(1)研發部門之沿革及組織

該公司自民國 76 年成立以來，深耕半導體封測產業多年，研發團隊具備測試及封裝產業專業背景及豐富相關經驗，擁有優秀的研發專業人才，茲將各研發單位之工作職掌列示如下：

部門	工作內容
研發一部 (測試)	• 客戶新產品開發及評估作業 • 產品測試良率/穩定性分析改善計畫之擬定與執行 • 協助生產線技術提昇及測試能力改善之需求
研發二部 (封裝及晶圓薄化)	• 新產品技術及導入之效益評估 • 新製程研發 • 製程改善

(2)分析研發部門人員之人數、學經歷、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對申請公司之營運風險

單位：人數、%

年度		110 年度	111 年度	112 年 12 月 14 日
員工人數	期初人數	50	60	56
	本期新進	12	3	2
	本期離職	0	7	4
	退休及資遣	2	0	0
	部門轉調	0	0	4
	期末人數	60	56	58
平均服務年資		6.24	7.27	7.82
離職率(%)(註)		3.23	11.11	6.45
學歷分布	博士	0	0	0
	碩士	1	1	3
	大專	51	48	49
	高中(職)以下	8	7	6
合計		60	56	58

資料來源：該公司提供

註：離職率=離職人數（含資遣及退休人員）/（期末人數+離職人數）

該公司最近二個會計年度及 112 年 12 月 14 日止之研發人員分別為 60 人、56 人及 58 人，平均服務年資分別為 6.24 年、7.27 年及 7.82 年，多為相關系所畢業或具有相關產業經驗，並專注於積體電路相關製程之改良及研發，顯示該公司對研發人員之重視。

在研發人員流動情形方面，該公司最近二會計年度及 112 年 12 月 14 日止，離職率分別為 3.23%、11.11%及 6.45%，離職人員為基層研發人員，其離職原因主要為個人生涯規劃。該公司訂有研發管理相關內部控制作業，以保護公司產品研發成果及生產技術，並落實交接制度，以利經驗傳承及工作銜接，故研發人員流動對該公司核心研發人力、研發部門之運作及公司營運尚不致產生重大之影響。

(3)最近二年度及申請年度截至最近期止研發費用占營業收入之情形

單位：新台幣千元

項目＼年度	110 年度	111 年度	112 年前三季
研發費用(A)	64,391	69,578	48,660
營業收入淨額(B)	1,292,379	1,226,677	620,556
占營業收入淨額比率(A)/(B)	4.98%	5.67%	7.84%

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之研發費用分別為 64,391 千元、69,578 千元及 48,660 千元，研發費用占營業收入比率分別為 4.98%、5.67%及 7.84%。該公司研發費用主要係隨研發人員薪資、獎金及研發設備折舊增減而變化，其中 111 年度較 110 年度增加係因該公司隨營運之發展，添購設備進行新產品之開發並對現有產線優化以提升效能所致；112 年前三季受全球整體經濟環境不穩定、終端市場需求趨緩，且半導體庫存較高影響，致營業收入減少，使研發費用佔比提高，經評估其變動情形尚屬合理。最近二個會計年度及112年前三季研發費用之變動情形尚無重大異常之情事。

(4)研究成果

該公司致力於新產品之研發，並針對市場需求進行設計與研究，持續深耕自有核心技術。茲將該公司最近三年度之重要研發成果及相關內容列示如下：

年度	研發成果	內容說明
109	● 載板技術開發	● 產品薄化程度的要求，造成自動化產線效率下降，透過載板的技術導入，讓自動化產線生產效率提高，產品良率也獲得提升。
	● 厚金屬鍍膜、切割、挑揀	● 隨著金屬層增加對於既有機台的架構已構成嚴格挑戰，目前已透過治工具調整和材料參數搭配，已成功導入量產。
	● Taiko 晶片製程設備機構設計開發	● 因應特殊晶片加工製程，進行設備測試改機設計與量產研發，確保提早佈局特殊製程產品的代工能力。
110	● 濺鍍技術開發	● 車載產品需求上升，對於品質要求也更加嚴苛，透過濺鍍達到薄膜高可靠度要求，成功導入車用產品量產。
	● 特殊氣流控制機構研發	● 特殊材料產品生產良率之改善專有技術開發。
	● 超薄片測試載台升級	● 因應超薄片之規格變更，解決產品生產之製程變異的風險，變更設計。
111	● 12 吋晶片薄化技術	● 透過治工具、材料、改機實現 12 吋超薄片生產。
	● Laser Ink 製程設計與設備開發	● 替代原先的晶圓 Ink 墨液標示技術，採用 Laser 技術取代，提高生產速度約四倍，並可克服 Ink 漏打、小墨跡噴濺、墨液延流等問題。
	● GaN 產品測試之高壓突波抑制技術開發與套件設計	● GaN 材料特性會造成測試過程產生高壓突波，間接造成產品的損壞，透過技術的研發與套件可完全防範與抑制突波的問題。
112 年前三季	● 高溫高壓高電流特規探針卡自製技術	● 已開發完成 175 度高溫探針卡、1700V 高壓探針卡、60A 高電流探針卡，探針卡自製率高達 95%，將持續投入研發能量在特殊運用的高壓高溫高電流探針卡。
	● 1200V 50A 高電壓高電流碳化矽(SiC)功率元件測試技術	● 已開發完成 1200V 高壓碳化矽(SiC) MOSFET 測試技術，測試電流可高達 50A，可有效防治高壓電弧，避免產品損壞，並得到精準的測試數據。
	● 濺鍍技術開發	● 透過參數調整達到均勻鍍膜並達成 1000 小時之高溫高濕車規產品可靠度驗證，且透過治具的優化達到高翹曲（≧5mm）產品之量產。

資料來源：該公司提供

(5)技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司主要技術來源係來自研發團隊之專業以及經驗累積之結

果，持續與產業上下游進行交流，以了解客戶需求之產品進行研發及設計。截至目前為止，並未有向外部取得技術來源及支付技術報酬金或權利金之情事。

(6)未來研發計畫暨研發工作未來發展方向

該公司計畫為提升良率及降低成本，並隨時注意 IC 產業發展趨勢，朝向高附加價值產品發展，持續研發關鍵性技術，尋求國內外晶圓製造及半導體設計之上下游合作，以搶得市場發展先機。以下為未來研發工作發展方向說明：

研發項目	主要內容及功能	應用產品
晶圓正面金屬化製程	搭配產品封裝改善產品阻值	MOSFET
12 吋晶圓濺鍍技術	將濺鍍技術從原本 8 吋擴大到 12 吋	MOSFET
碳化矽(SiC)產品之晶圓薄化製程	硬脆材料薄化技術	SiC
50um 超薄晶圓之晶圓切割、晶粒挑揀	特殊參數設定和材料使用搭配來實現超薄晶圓穩定生產	MOSFET
晶圓之超厚金屬鍍膜技術	降低產品導通電阻，並改善散熱	MOSFET
厚金屬功率元件之晶圓切割、晶粒挑揀	特殊參數設定和材料使用搭配來實現超薄晶圓穩定生產	MOSFET
高翹曲晶圓之雷射刻印	特殊治具設計讓製程能力提升。	MOSFET
超薄晶圓測試技術	生產技術能力升級	節能低功耗元件
厚金屬鍍膜高翹曲晶圓測試技術	生產技術能力升級	節能低功耗元件
3KV 高壓/高電流功率元件測試技術	除與設備商合作開發對應測試設備外，內部需進行搭配設備的改機與抗高壓研發	第三代半導體 GaN/SiC 中高功率應用需求(車用)
高功率氮化鎵(GaN)功率元件測試技術	測試與驗證方法的開發。	5G 通訊/快充/車用
氮化鎵(GaN)RF 元件測試技術	測試與驗證方法的開發。	5G 通訊/車用
碳化矽(SiC)功率元件測試技術	除與設備商合作開發對應測試設備外，內部需進行搭配設備的改機與抗高壓研發	車用快速充電
雷射 In 刻印技術	使用雷射進行晶圓異常品標記，取代現行油墨打印方式，改善材料與加工過程的異常與生產效率提升	晶圓異常品標記
高溫高壓特規探針卡自製技術	高壓高溫製程電弧抑制與漏電抑制的測試方法設計與製作技術	GaN/SiC 特殊材料、車用產品

3. 取得重要技術合作契約，就其內容評估對申請公司營運之風險

截至目前為止，該公司尚未簽訂重要技術合作契約。

4. 目前已登記或取得專利權、商標權及著作權之情形，有無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事，暨因應措施是否合理有效

該公司截至目前為止，已取得之商標權共 1 件，並無涉及違反商標權之情事，該公司商標權之註冊內容及權利期間列示如下：

項次	名稱	申請國	商標註冊號	權利期間	
				起	訖
01	silicon 及 U 設計圖	中華民國	02060521	109/05/16	119/05/15

資料來源：該公司提供

5. 屬科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，應說明其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計畫、預計生產時程及成本、市場定位、需求及未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

該公司非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，故不適用。

6. 屬科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，取得參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近三個會計年度及申請年度內股權轉移變化暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形等，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響，及其因應措施

該公司非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，故不適用。

7.屬科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，取得參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近三個會計年度及申請年度內股權轉移變化暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形等，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響，及其因應措施

該公司非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，故不適用。

8. 以創新板上市者，就其創新特點及營運模式，因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施

(1)關鍵核心技術：

(一)自主研發測試技術佈局之能力

該公司在民國 90 年即切入電源管理 IC 測試領域，並於民國 95 年進一步切入 MOSFET 測試領域，一路發展至今已建立深厚之技術能力，相關之測試電路、測試程式、測試介面、探針卡等皆自行研發製作，具備軟硬體技術佈局之能力。

(二)精準分析測試產品材料特性

由於第三代半導體之材料特性，導致第三代半導體晶圓在長晶、磊晶與元件製造之過程中更容易出現製程缺陷，因此，如何透過優異之測試技術，正確篩選出功能正常產品至關重要，以確保產品在終端應用時不會出現問題，也因此凸顯了第三代半導體晶圓測試之重要性。由於第三代半導體材料特性不易掌握，且高溫、高壓、高流、低電阻與低漏電等測試條件都極具挑戰，因此需要大量累積工程與量產經驗並與客戶不斷地合作驗證，才能精準測試分析產品特性，該公司具備第三代半導體材料特性分析與高壓波型分析能力，可有效提高客戶異常分析處理之時效，並提供客戶更有價值之建議。另外，第三代半導體因產品驗證時間長，測試技術門檻高，藉由與晶圓廠之協同開發，亦使該公司之研發團隊及測試部門能即時反饋客戶在晶圓測試發現之問題，並協助客戶提升製程良率。

(三)自行開發超薄晶圓載板薄化製程技術，切入半導體晶圓製程

第三代半導體材料具有高硬度、高脆性與易斷裂之特性，造成第三代半導體晶圓薄化與晶圓切割製程之高度挑戰，該公司投入晶圓研磨與晶圓切割領域迄今已有超過 36 年生產經驗，在此期間持續投入研發能量，精進製程技術，並於民國 107 年成功跨入第三代半導體晶圓薄化領域，經由自行開發之載板製程技術，大幅降低生產成本，並可提升晶圓有效使用面積，降低客戶成本，提供客戶製程所需之服務。

(2)創新能力及創新營運模式：

由於第一代半導體的製程發展已相當成熟，晶圓製造良率也很高，晶圓廠較不需要持續不斷的進行製程優化，通常在廠內的實驗室就可以滿足少量工程品的測試需求，不會有大量的工程試做晶圓

需要委外給測試廠做測試分析，因此晶圓廠與測試廠間主要是透過設計公司為溝通橋梁。

該公司深耕於功率半導體測試業務，具備精準分析測試產品材料特性及自主研發測試技術佈局之能力，亦可針對產品元件特性資料進行大數據分析。因第三代半導體材料特性的原因，導致晶圓在長晶、磊晶與元件製造的過程中容易出現製程缺陷，於晶圓製造良率上，難以達到第一代半導體的水準，因此，晶圓廠需要持續不斷進行製程的優化，晶圓廠雖有內部的實驗室可以小量的收集資料，但是實驗室提供的實驗設備與人力，無法滿足試做晶圓所需之大量工程驗證之需求，且實驗室收集資料的速度緩慢，大幅影響製程優化循環週期的速度，進而影響新製程與新產品開發的速度，因而促成晶圓廠偕同測試廠共同合作，找出問題點與提供製程參數調整的方向，以提高晶圓廠製造良率。

該公司以其提供量產工廠的生產能量與速度，進行精準的測試分析，將資料反饋給晶圓廠做進一步的分析，作為晶圓製程參數調整的依據，扮演著類似晶圓廠內部實驗室的角色，由此晶圓廠可以省去購買測試設備、建置測試人力、研發測試技術所需要花費的成本與時間，專注於第三代半導體晶圓製程技術的精進，而該公司專注於第三代半導體晶圓測試技術的精進，透過雙方的密切合作成為合作夥伴，達到一加一大於二的效果。

該公司經由與晶圓廠合作之契機，打造出創新之經營模式，在此經營模式下，該公司與晶圓廠長期合作，已建立緊密的合作默契及共同的驗證標準，晶圓廠傾向於優先推薦該公司予設計公司，做為晶圓測試的合作夥伴，可有效的進行產品開發、驗證、量產，幫助設計公司快速開發驗證產品，即時打開市場，創造三贏的局面。

一般半導體測試廠經營模式(第一代矽成熟製程)：

「晶圓廠內部實驗室」營運模式：

(3)因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施：

A.半導體市場景氣波動，增加測試封裝廠之經營風險

在 IC 產業生產體系中，IC 測試封裝位於製程的後段，為 IC 出貨前必經步驟，故受半導體市場景氣波動影響甚巨，若供需情況稍有失衡，即導致晶片價格大幅波動，影響半導體測試封裝業之獲利。

因應對策：

該公司積極調配機台及縮短執行時間，並提供晶圓製造廠商及 IC 設計公司迅速且準確之服務，以吸引客戶持續下單，於產能擴產方面，係採穩健投資之方式，避免因機器設備產能不足而失去市場機會，或因設備擴充過速而造成閒置，增加經營風險。

B.技術人才流失之風險

測試封裝為技術密集產業，隨著半導體產業不斷的發展，國內外半導體公司對人才之需求增加，故具經驗之技術人員常成為競爭對手招攬之對象，形成人才流失之風險。

因應對策：

該公司透過資深技術人員之技術傳承、實作傳承分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的技術團隊。此外，提供良好的工作環境，並建立制度化的員工福利獎酬辦法，以增進員

工之向心力。對於技術人員均要求簽訂保密合約，且對相關技術做適當之資料保存，以預防人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。

C.IC 產業前景看好，將有更多競爭者加入

該公司所屬產業為半導體上下游關注的焦點，前段及後段的半導體廠商皆想跨入相關製程。

因應對策：

該公司之客戶多為知名半導體廠商，透過與客戶開發，建立合作默契，並可掌握終端需求調整製程技術。該公司已累積多年經驗，並提供一站式測試封裝服務，未來將不斷提升技術，拉開與同業之市場區隔，以確保公司之競爭力。

9.以創新板上市者，就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施加以評估

(1)產品生產開發技術之層次、來源、確保專利權及所受法律保護狀況與提升

A.產品生產開發技術之層次

該公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，為國內具有獨特競爭力之半導體專業測試封裝公司，擁有專業及經驗豐富之研發團隊，透過多年來在半導體測試技術的研發、驗證及生產的經驗，已建立測試電路、測試程式、測試介面、探針卡等深厚的製作技術能力，此外亦具備設備改機、治具及配件設計與製造的能力。並投入第三代半導體 GaN 與 SiC 測試技術研發多年，再加上與多家知名第三代半導體客戶的長期合作，成為該公司能夠成功跨入三代半導體測試領域的契機。

該公司可同時提供晶圓測試、成品測試、探針卡製造、晶圓 FSM、晶圓 BGBM、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品生產成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，具備功率半導體中後段製程開發能力之公司。

B.產品生產開發技術之來源

該公司之技術來源皆為自行研發，該公司自設立後持續提升研發能量，持續精進晶圓測試、晶片測試、探針卡製造、晶圓 FSM、

晶圓 BGBM、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等製程，自市場企劃、治具開發、實驗設計、材料開發、參數調校、工程驗證、製程優化等均由該公司經營團隊及其研發團隊所完成。

C.技術之確保與提升

該公司針對核心技術持續深化研發能力，重要研發成果均已列為公司營業秘密完善保存，嚴格控管該公司研發團隊人員之存取權限，以確保資料之完整性及機密性，藉以控管及保護該公司重要核心技術。對於技術人員均要求簽訂保密合約，且對相關技術做適當之資料保存，以預防人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。另外，該公司透過資深技術人員之技術傳承、實作傳承分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術人員培育機制，降低人員異動之衝擊，同時積極延攬優秀人才，進而建構堅強的技術團隊，藉以確保核心技術持續提升。

(2)現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究發展計劃

A.現在主要產品之競爭優勢

該公司在 90 年即切入電源管理 IC 測試領域，並於 95 年進一步切入 MOSFET 測試領域，一路發展至今，已建立深厚的技術能力，相關的測試電路、測試程式、測試介面、探針卡等皆自行研發製作，本身具備設備改機的能力，以及治具及配件設計與製造的能力。並投入第三代半導體 GaN 與 SiC 測試技術的研發多年，再加上與多家知名第三代半導體客戶的長期合作，成為該公司能夠成功跨入第三代半導體測試領域的契機，且通過與客戶合作驗證後所產生之競爭優勢不易被其他測試廠取代。該公司投入晶圓研磨與晶圓切割領域迄今已有超過 30 餘年生產經驗，在此期間持續投入研發能量，精進製程技術，並於 107 年成功跨入第三代半導體晶圓薄化領域，已具備多項先進的技術能力。該公司可同時提供晶圓測試、晶片測試、探針卡製造、晶圓 FSM、晶圓 BGBM、晶圓切割、晶粒挑揀、晶粒捲帶等一貫化整合性服務，滿足客戶一次購足之需求，以降低產品來回運送之成本與風險、縮短交期，並降低客戶委外的複雜度與管理成本，成為該公司爭取客戶合作並與客戶建立長期合作夥伴關係的競爭利基。

B.現在主要產品之生命週期及持續發展性

該公司主要從事功率半導體的測試、封裝與晶圓薄化服務，為確保功率半導體功能、速度、公差、電力消耗及熱力發散等屬性符

合訂定之標準，故不論是測試、封裝或晶圓薄化，皆屬於半導體製造中不可或缺之重要生產流程，因其製程需精通半導體元件物理、製程與電路設計，技術開發人員的養成亦須經長期之培養，再加上產品認證期長，需歷經繁瑣的調整及專用製程驗證，具有一定的進入障礙，其技術具有累積性，故其產品生命週期較其他 IC 產品長，且隨著半導體應用的持續發展，各項新興產業如電動車、充電樁、高效能運算、AI 伺服器、資料中心、再生能源等，都需要高效能的電源轉換做後盾，預期功率半導體與第三代半導體的應用領域將會持續擴散，市場需求也將持續增加，有利該公司業務的持續發展。

C.新產品之研究發展計劃

該公司成立迄今，持續投入研發能量，精進製程技術，未來的研究發展方向將以節能為發展核心，專注於可提升能源轉換效率的功率元件與電源管理 IC，研發更加先進的半導體測試、半導體封裝與晶圓薄化製程，朝向更高電壓、電流、功率、溫度、速度及更低電阻與更薄厚度的方向發展。該公司因應市場趨勢及配合客戶產品開發，持續研發與改良測試技術、探針卡及治具等以提高生產良率及提供更多服務項目，未來研發計畫包含研究開發及改良高功率 GaN 功率元件測試技術、高功率 SiC 功率元件測試技術、晶圓 FSM 技術、晶圓 BGBM 技術等。該公司透過研發經費及專業技術人才的投入，持續創新及改良製程，擴大整體效益，進而提升該公司競爭優勢。

(3)新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

A.新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性

新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
厚金屬(≧15um)鍍膜技術	113年	鋰電池保護電路MOSFET功率元件	搭配產線特殊的治具改良及製程調整，達成高均勻度之厚金屬膜之鍍膜。以往在厚金屬膜鍍膜完成後會遇到強烈的晶片翹曲，造成後續加工困難，透過自行研發之治具，可以讓風險極小化且不需要額外高成本的設備投資，進而達到成本控制和大規模生產之優勢。
超薄晶圓(<50um)載板技術	113年	低功耗MOSFET功率元件	由於市場應用的進步，對於產品電性表現和封裝尺寸更加要求，更凸顯薄化之重要性，透過

新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
			穩定的薄化過程可以降低MOSFET之導通電阻，進而達到高效率之目的，但在其薄化過程中，由於晶片厚度已低於可支撐晶片應力的厚度，進而產生翹曲造成各站點加工困難，影響良率。透過載板的導入下，晶片由於載板的支撐，不再有翹曲產生，可使用既有機台自動安全執行作業，不需要額外投資昂貴設備，進而達到可量產且低成本的生產競爭優勢。
晶圓正面金屬鍍膜(FSM)技術	113年	高功率MOSFET、GaN、SiC功率元件	由於高功率功率元件需要承受更大的電流，要求更低的功率耗損，因此必須使用銅夾封裝，以加大電流路徑，降低導通電阻，所以需要在產品正面焊墊處進行金屬鍍膜，形成焊墊與銅夾之間的焊接表面，由於需要進行圖形化的金屬鍍膜，因此製程難度相對較高，需要經過長時間的研發，以達到產品穩定生產。
GaN雷射開槽技術	113年	GaN功率元件	由於GaN磊晶層與基板之間存在異質結合接面，成為晶圓切割時的脆弱點，在晶圓切割時，容易在此接面造成晶粒側裂，影響產品品質，因此透過雷射開槽技術，將切割道上的GaN磊晶層移除，再進行晶圓切割，此時切割刀就不會碰觸到此接面，可有效提高晶圓切割品質。
QST基板氮化鎵(GaN-on-QST)晶圓之薄化、切割、挑揀	113年	GaN功率元件	QST有著極高的硬度，QST基板氮化鎵（GaN-on-QST）晶圓的研磨與切割，有著極大的挑戰，生產過程與傳統矽晶圓的製程有相當大的區別，需要經過長時間的研發以及和客戶間的密切合作，透過生產製程參數和材料的優化，以達到產品穩定生產。
SiC晶圓之薄化、切割、挑揀	113年	SiC功率元件	SiC有著極高的硬度，SiC晶圓的研磨與切割，有著極大的挑戰，生產過程與傳統矽晶圓的製程有相當大的區別，需要經過長時間的研發以及和客戶間的密切合作，透過生產製程參數和材料的優化，以達到產品穩定生產。
超薄晶圓測試技術	113年	低功耗MOSFET功率元件	目前功率元件為追求更低的耗能，晶片的厚度規格不斷的薄化，遠遠超過設備的初始設計技術能力，透過研發團隊持續針對客戶的產品變更投入機構的設計。
更高電壓更高電流MOSFET功率元件	113年	高功率MOSFET	高功率MOSFET的需求因工業用產品應用而大幅提高，此類產品在晶圓測試上有其先天性

新產品	預計生產時程	市場定位	需求與未來營收效益預測達成可能性
之測試技術		功率元件	的測試限制，透過製程機構設計、特殊配件設計與測試電路設計可大幅度的提高可測試規格的限制，提供客戶更完整的測試服務與更優化的測試良率。
更高電壓更高電流GaN功率元件之測試技術	113年	高功率GaN功率元件	高功率GaN的需求因工業用產品應用而大幅提高，此類產品在晶圓測試上有其先天性的測試限制，透過製程機構設計、特殊配件設計與測試電路設計可大幅度的提高可測試規格的限制，提供客戶更完整的測試服務與更優化的測試良率。
更高電壓更高電流SiC功率元件之測試技術	113年	高功率SiC功率元件	高功率SiC的需求因車用產品應用而大幅提高，此類產品在晶圓測試上有其先天性的測試限制，透過製程機構設計、特殊配件設計與測試電路設計可大幅度的提高可測試規格的限制，提供客戶更完整的測試服務與更優化的測試良率。

資料來源：該公司提供

該公司所研發之測試及晶圓薄化技術，主要係因應客戶產品需求，或因第三代半導體市場材料特性而需開發之相關技術，故隨著半導體市場之成長，預期新開發之技術，將為該公司營收帶來挹注。

B.研究發展之內部控制暨保全措施

該公司已於內部控制制度中研發循環訂有相關作業予以規範，包括客戶需求收集、客戶需求評估、製程開發與驗證、試生產及量產，以利研發循環之執行，並確保公司研發作業品質及管理落實，研發工作均已建立文件保存及管理制度，以提升後續之產品品質及縮短研發時間，有效達成研發的延續。

在研究發展之保全措施方面，除限制員工的權限，控制員工對技術文件和資料的訪問和使用權限，研發人員均要求簽訂保密合約，確保機密信息不被洩露，且對於所研發之技術做適當之資料保存，以預防研發人員流動時造成公司之技術無法延續以及產生技術外流之風險。

10.以創新板上市者，其參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經

理人等之資歷(工作經驗、教育背景及職位年資)、持股比例、最近二個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

(1)參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例、實際投入經營之時間與情形

112 年 11 月 30 日；單位：人；股；%

職　　稱	姓　　名	最高學歷	主要經歷	職位年資	持股比例
董事長	大日月投資有限公司	—	—	—	22.89%
	張秉堂	臺灣大學國際企業管理系碩士	工研院電子所/封測課長 巨大電子(股)公司/董事長 新能科技(股)公司/董事長	36	8.45%
董事	辰真投資有限公司	—	—	—	1.89%
	張辰	美國波士頓大學國際貿易系碩士	—	5	1.36%
董事	彭盈光	中原大學工業與工程學系學士	工研院電子所/品質管理課長 台灣積體電路(股)公司/品質管理副處長 謙誠商務股份有限公司/負責人 新竹高爾夫俱樂部(股)公司/董事	24	1.83%
董事	張蔚誠	政治大學會計系學士	大師聯合會計師事務所/合夥會計師 聯華食品工業(股)公司/獨立董事	2	—
董事	楊式蘭	臺灣大學財務金融所碩士	大昌證券股份有限公司/副總經理	0.3	—
獨立董事	張居興	臺灣大學財務金融所碩士	中國信託商業銀行/副總經理 中信票券金融公司/副總經理	2	—
獨立董事	溫萬壽	交通大學電子物理系學士	豐達科技(股)公司/獨立董事 華邦電子(股)公司/執行副總經理 瀚宇彩晶(股)公司/執行長	2	—
獨立董事	彭俊豪	成功大學企業管理系碩士	元大創業投資(股)公司/總經理 元大壹創業投資(股)公司/法人董事代表人 生華創業投資(股)公司/法人董事代表人 生源創業投資(股)公司/法人董事代表人 華陸創業投資(股)公司/法人董事代表人	2	—
獨立董事	譚仲民	臺灣大學商學碩士	力晶積成電子製造股份有限公司/副總經理 世成科技(股)公司/董事 智仁科技開發(股)公司/監察人 檀雅投資有限公司/董事	0.3	—
副總	王志成	臺灣大學國際企業管理系碩士 臺灣海洋大學電機工程所碩士	新能科技(股)公司/副總經理	20	0.57%
協理	曾雄亮	健行科技大學電子通訊系副學士	台灣星電(股)公司/技術員 工研院電子所/高級技術員	36	4.76%

職　　稱	姓　　名	最高學歷	主要經歷	職位年資	持股比例
協理	林坤田	勤益科技大學電子學系學士	信業科技(股)公司/業務工程師 原僑電子(股)公司/助理工程師	23	0.63%
持股 5%以上之股東	鄭羅玉嬌	— (註)	— (註)	— (註)	5.23%

資料來源：該公司提供。

註：未參與公司之經營決策。

(2)參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術開發經理人等，最近二個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形

單位：仟股

職　　稱	姓名	109年底	110年底		111年底		112年截至11月30日止	
		期末股數	增(減)股數	股數	增(減)股數	股數	增(減)股數	股數
董事長	大日月投資有限公司	14,798,896	-	-	-	-	-	-
	張秉堂	5,932,182	(250,000)	5,682,182	(220,000)	5,462,182	-	-
董事	辰謙投資有限公司(註)	1,288,495	-	-	-	-	-	-
	張辰	2,040,148	-	-	(1,160,000)	880,148	-	-
董事	辰真投資有限公司	-	-	-	1,225,000	1,225,000	-	-
	張辰	2,040,148	-	-	(1,160,000)	880,148	-	-
董事	彭盈光	1,185,090	-	-	-	-	-	-
董事	張蔚誠	-	-	-	-	-	-	-
董事	楊式蘭	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	張居興	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	溫萬壽	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	彭俊豪	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	譚仲民	-	-	-	-	-	-	-
副總	王志成	370,000	-	-	-	-	-	-
協理	曾雄亮	3,025,881	53,701	3,079,582	-	-	-	-
協理	林坤田	410,000-	-	-	-	-	-	-
持股5%以上之股東	鄭羅玉嬌	3,420,449	-	-	(40,000)	3,380,449	-	-

資料來源：該公司提供。

註：辰謙投資股份有限公司於 111 年 8 月 2 日股東臨時會董事改選後解任。

(3)參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等，未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

該公司董事具備業務發展所需之產業或財務經驗，可透過董事會運作對該公司經營策略提供合適建議，並無單一董事或集團控制

該公司財務業務運作。而該公司之核心團隊累積多年產品開發及技術經驗，並非由單一人所完全掌握或任一獨立人員之成就，故無技術集中於特定人士之情事，因此即便上述董事或經理人未來不繼續參與公司經營，然因公司重大決策與營運方針係由董事會決議，致使公司之治理仍能有效實施；另針對研發工作之延續，該公司訂有文件保存及管理制度，使各項研發技術得以保留於公司內部，為日後追蹤與改善之依據；此外，該公司透過技術人員之技術傳承、實作經驗分享、個案探討及內部教育訓練等，建立技術開發及研發人員培育機制。此外，提供良好的工作環境，並建立制度化的員工福利獎酬辦法，以吸引優秀人才加入公司團隊，強化研發人員開發實力。該公司更持續加強員工之向心力，應能有效降低上述人員異動對公司財務業務之影響。

11. 以創新板上市者，屬生技醫療業者，應就其核心產品之臨床試驗進度加以評估

該公司非屬生技醫療業者創新板上市者，故不適用此項評估。

(四)人力資源之營運風險

1. 員工總人數、離職人數、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資

單位：人；年；歲

人數/年度		110 年度	111 年度	112 年 12 月 14 日
期初員工人數		545	564	565
本期新進人數		175	201	129
本期離職人數		146	191	115
資遣及退休人數		5	9	5
其他(註 1)		(5)	-	-
期末員工人數		564	565	574
平均年齡		37.47	37.60	37.77
平均年資		5.59	5.75	5.85
員工結構	經理人	6	6	6
	一般員工	258	258	257
	直接員工	300	307	311
學歷	博士	-	-	-
	碩士	2.46	2.65	2.79

分布	大學(專)	62.92	69.03	68.99
	高中(含)以下	34.62	28.32	28.22

資料來源：該公司提供

註 1：該公司於民國 110 年 12 月 30 日處分子公司微石開發股份有限公司 100%股權，致人員減少。

該公司及最近二個會計年度及 112 年截至 12 月 14 日之員工人數分別為 564 人、565 人及 574 人，該公司主要係從事晶圓及積體電路之半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，故以生產線之作業員工占該公司員工比重較高，最近二個會計年度及 112 年截至 12 月 14 日之員工人數變動主要係產線作業人員，因個人因素、適應不良或於聘任後未滿三個月即離職等原因，而一般員工多為個人職涯規劃或家庭因素考量離職，員工離職皆需事前提出，工作均有相關人員承接，對該公司之營運應無重大影響。最近二個會計年度及 112 年截至 12 月 14 日之員工人數無明顯差異，主要係該公司能適時補足人力需求。

最近二個會計年度及 112 年截至 12 月 14 日之員工平均年齡為 37.47 歲至 37.77 歲，顯示該公司員工主要係為青壯年階層，平均年資則為 5.59 年至 5.85 年，工作年資尚屬穩健，對公司營運尚無重大影響。

員工學歷分布方面，最近二個會計年度及 112 年截至 12 月 14 日大學(專)以上學歷之員工占全體公司員工比重分別 65.38%、71.68%及 71.78%，顯示員工平均受教育素質良好，應有助於強化該公司之競爭力與業務成長力。

2. 離職率之變化情形

單位：人

年度 人數	110 年度			111 年度			112 年 12 月 14 日		
	期末人數	離職人數	離職率%	期末人數	離職人數	離職率%	期末人數	離職人數	離職率%
經理人	6	-	-	6	-	-	6	-	-
一般員工	258	56	17.83	252	85	25.22	257	52	16.83
直接員工	300	100	25.00	307	115	27.25	311	63	16.84
合計	564	156	21.67	565	200	26.14	574	115	16.69

資料來源：該公司提供

註：離職率＝離職人數(包含資遣、退休及其他人數)／(期末人數＋離職人數)

該公司及最近二個會計年度及 112 年截至 12 月 14 日之離職人數分別為 156 人、200 人及 115 人，離職率分別為 21.67%、26.14%及 16.69%，

皆為一般員工及直接員工離職，無經理人離職之情形，離職原因除外籍員工之合約聘雇期滿外，其他員工多為適應不良、個人職涯規劃或家庭因素考量，該等人員為基層員工，任用門檻低、替代性高且較易招募，故不致產生人力斷層，另該公司約 25%係為外籍員工，該部分人員皆係透過人力仲介公司聘僱，如有合約到期未續聘之員工缺額，將再新招募外籍員工，藉以維持穩定人力需求。綜上所述，該公司人力資源變化尚屬合理，且皆依各年度離職人數補足所需之人力，故不致對該公司之營運產生重大之影響。

(五)各主要產品之成本分析

1.最近期及最近二個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素比率變化對發行公司營運之風險

單位：新台幣千元

項目 \ 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	直接原料	21,534	3.91	17,648	3.03	10,531	2.63
	直接人工	155,556	28.19	152,490	26.15	95,278	23.82
	製造費用	374,659	67.90	412,940	70.82	294,104	73.55
	小計	551,749	100.00	583,078	100.00	399,913	100.00
半導體封裝	直接原料	29,695	26.97	22,100	22.42	15,937	22.78
	直接人工	26,132	23.73	24,653	25.01	20,007	28.60
	製造費用	54,282	49.30	51,828	52.57	34,007	48.62
	小計	110,109	100.00	98,581	100.00	69,951	100.00
晶圓薄化	直接原料	30,516	26.86	35,303	24.92	24,681	22.97
	直接人工	16,571	14.59	21,804	15.39	14,686	13.67
	製造費用	66,511	58.55	84,570	59.69	68,064	63.36
	小計	113,598	100.00	141,677	100.00	107,431	100.00
其他	直接原料	2,176	42.34	-	-	-	-
	直接人工	2,963	57.66	-	-	-	-
	製造費用	-	-	-	-	-	-
	小計	5,139	100.00	-	-	-	-
合計	直接原料	83,921	10.75	75,051	9.12	51,149	8.86
	直接人工	201,222	25.78	198,947	24.16	129,971	22.51
	製造費用	495,452	63.47	549,338	66.72	396,175	68.63
	小計	780,595	100.00	823,336	100.00	577,295	100.00

資料來源：該公司提供

該公司為半導體專業測試與封裝服務廠商，提供半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，茲就該公司 110~111 年度及 112 年前三季各成本要素之比率變化分析如下：

(1)半導體測試

係將晶圓上之晶粒或封裝完成後的 IC 進行功能測試。原料為測試所需之膠帶、彎針及各式耗材等，直接人工為產線人員，製造費用主要為測試機台之折舊、維修、零組件及備品等費用。110~111 年度及 112 年前三季直接原料佔成本比重分別為 3.91%、3.03%及 2.63%，直接人工佔成本比重分別為 28.19%、26.15%及 23.82%，製造費用佔成本比重分別為 67.90%、70.82%及 73.55%半導體測試係以針測機及測試機為主，其設備相關之折舊、維修及備品金額較高，故成本要素以製造費用為重，其次為直接人工，最低為直接原料。其變動主要係受客戶產品所需之測試種類差異所致，各成本要素比率並無重大變化。

(2)半導體封裝

係將晶圓進行研磨加工並切割成為晶粒，經挑揀後封裝出貨。原料為產線所需之膠帶、切割刀片及各式耗材等，直接人工為產線人員，製造費用主要為切割機台之折舊、維修、零組件及備品等費用。110~111 年度及 112 年前三季直接原料佔成本比重分別為 26.97%、22.42%及 22.78%，直接人工佔成本比重分別為 23.73%、25.01%及 28.60%，製造費用佔成本比重分別為 49.30%、52.57%及 48.62%。半導體封裝所用之切割機及挑揀機，其設備相關之折舊、維修及備品金額較高，故成本要素以製造費用為重，直接人工及直接原料則為約當，其變動主要係受客戶產品所需之規格差異所致，各成本要素比率並無重大變化。

(3)晶圓薄化

係將晶圓進行正面金屬鍍膜、晶圓背面研磨與金屬鍍膜加工。原料為生產所需之貴金屬、膠帶及各式耗材等，直接人工為產線人員，製造費用主要為各式機台之折舊、維修、零組件及備品等費用。110~111 年度及 112 年前三季直接原料佔成本比重分別為 26.86%、24.92%及 22.97%，直接人工佔成本比重分別為 14.59%、15.39%及

13.67%，製造費用佔成本比重分別為 58.55%、59.69%及 63.36%。晶圓薄化所用之研磨機、蝕刻機及蒸（濺）鍍機等，其設備相關之折舊、維修及備品金額較高，故成本要素以製造費用為重，直接原料則因金屬鍍膜所用之貴金屬單價較高而列其次，最低為直接人工。其變動主要係受客戶產品所需之規格差異所致，各成本要素比率並無重大變化。

(4)其他

主要係子公司微石開發股份有限公司，為提供餐飲服務。其成本由直接原料及直接人工組成，110 年度直接原料佔成本比重為 42.34%，直接人工佔成本比重為 57.66%，各成本要素比率並無重大變化。該公司已於 110 年 12 月 30 日處分子公司 100%股權，故 111 年度及 112 年前三季無其他成本之情形。

綜上所述，該公司 110~111 年度及 112 年前三季主要產品之成本結構尚無重大異常情事。

2.建設公司申報募集與發行案件者，取得當(鄰)地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例(如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等)，以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，公司與地主之分配比率是否合理。

該公司非屬建設公司，故不適用本項評估。

(六)匯率變動情形

1.最近期及最近二個會計年度兌換損益占營業利益之比例分析

單位：新台幣千元；%

項目＼年度	110 年度	111 年度	112 年前三季
兌換利益(損失)(A)	3,921	14,902	8,660
營業收入淨額(B)	1,292,379	1,226,677	620,556
營業利益(C)	310,265	204,482	(80,100)
兌換利益(損失)占營業收入淨額比例(A)/(B)	0.30	1.21	1.40
兌換利益(損失)占營業利益比例(A)/(C)	1.26	7.29	(10.81)

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

2.最近期及最近二個會計年度內外銷、內外購比率

(1)最近期及最近二個會計年度內外銷比率

單位：新台幣千元；%

項目＼年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率
內銷	新臺幣	781,459	60.47	700,274	57.08	393,483	63.41
	美元	378,280	29.27	351,524	28.66	162,799	26.23
外銷	美元	132,640	10.26	174,879	14.26	64,274	10.36
合計		1,292,379	100.00	1,226,677	100.00	620,556	100.00

資料來源：該公司提供

(2)最近期及最近二個會計年度內外購比率

單位：新台幣千元；%

項目＼年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率
內購	新臺幣	83,167	95.94	81,171	95.74	56,653	98.30
	美元	-	-	34	0.04	-	-
	日幣	232	0.27	137	0.16	-	-
外購	美元	2,532	2.92	3,149	3.71	920	1.60
	日幣	753	0.87	294	0.35	60	0.10
合計		86,684	100.00	84,785	100.00	57,633	100.00

資料來源：該公司提供

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之兌換利益(損失)分別為 3,921 千元、14,902 千元及 8,660 千元，占各該年度營業收入比率分別為 0.30%、1.21%及 1.40%，占營業利益比例分別為 1.26%、7.29%及(10.81)%。

該公司係從事半導體測試服務、半導體封裝及晶圓薄化服務，其服務對象為國內 IC 設計業，以內銷為主，惟部分客戶在營運考量下以美元計價，其外幣計價金額占各年度營業收入比率分別為 39.53%、42.92%及 36.59%。採購方面，因採購之原物料為生產性耗材，主要係向國內供應商採購，故以外幣計價金額僅占各年度進貨淨額比率分別為 4.06%、4.26%及 1.70%，交易幣別有美元及日幣，另該公司依擴廠計畫購置機器設備，其交易幣別主要為美元。

該公司外幣計價銷貨以美元為主，外幣計價採購亦多以美元計價，故

可藉由資產負債部位達部分避險效果以減少匯率波動所造成之影響，惟仍存在差額之匯率風險，因此美元匯率變動對該公司之獲利有一定程度之影響。110~111 年度及 112 年前三季美元兌新臺幣匯率呈現震盪走勢，又受美國聯準會加速緊縮政策及升息，致使該公司產生兌換利益。

綜上所述，該公司兌換損益主要係受美元匯率波動的影響，惟兌換損益占營業收入及營業利益之比重並不大，對營業收入及營業利益尚無重大之影響。

3.發行公司之避險措施

(1)財務單位與往來銀行維持密切聯繫，掌握匯率變動的相關訊息以研判未來匯率之走勢，進行外幣部位管理。

(2)於適當時機透過外幣存款帳戶換匯轉存至台幣存款帳戶。

(3)向客戶報價時，業務單位應考量因匯率變動而可能產生之影響因素，以降低匯率波動對公司的獲利之影響。

綜上所述，該公司針對匯率波動風險業已採取避險措施，以降低匯率波動對獲利之影響，其因應措施尚屬允當。

四、最近期及最近二個會計年度募集與發行有價證券籌資效益

請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形」之說明。

參、業務財務狀況

一、 業務狀況

(一)最近期及最近二個會計年度財務報告主要銷售對象及供應商(年度前十名或占年度營業收入淨額或進貨淨額百分之五以上者)之變化分析－應列明最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行公司之銷售政策；最近期及最近二個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析最近期及最近二個會計年度主要供應商之變化情形

1. 最近期及最近二個會計年度主要銷售對象(年度前十名或占年度營業收入淨額百分之五以上者)之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行公司之銷售政策

(1)最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位：新台幣千元

排名	110 年度				111 年度				112 年前三季			
	客戶名稱	金額	%	與發行人之關係	客戶名稱	金額	%	與發行人之關係	客戶名稱	金額	%	與發行人之關係
1	B 公司	177,606	13.74	無	B 公司	168,177	13.71	無	A 公司	103,922	16.75	無
2	A 公司	120,280	9.31	無	A 公司	136,241	11.11	無	B 公司	58,239	9.38	無
3	L 公司	91,825	7.11	無	C 公司	80,600	6.57	無	C 公司	34,918	5.63	無
4	C 公司	61,102	4.73	無	D 公司	60,076	4.90	無	D 公司	32,567	5.25	無
5	F 公司	56,048	4.33	無	E 公司	57,193	4.66	無	E 公司	29,143	4.70	無
6	H 公司	54,907	4.25	無	F 公司	54,768	4.46	無	F 公司	28,448	4.58	無
7	I 公司	54,422	4.21	無	H 公司	49,560	4.04	無	G 公司	22,527	3.63	無
8	D 公司	46,201	3.57	無	I 公司	47,365	3.86	無	H 公司	21,520	3.47	無
9	G 公司	45,855	3.55	無	G 公司	36,653	2.99	無	I 公司	20,931	3.37	無
10	M 公司	41,751	3.23	無	K 公司	34,571	2.82	無	J 公司	19,726	3.18	無
	小計	749,997	58.03	—	小計	725,204	59.12	—	小計	371,941	59.94	—
	其他	542,382	41.97	—	其他	501,473	40.88	—	其他	248,615	40.06	—
	合計	1,292,379	100.00	—	合計	1,226,677	100.00	—	合計	620,556	100.00	—

資料來源：該公司提供

(2)主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理

該公司為半導體專業測試與封裝服務廠商，提供半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務。主要銷售地區係以台灣為主，其他地區則為美洲及其他亞洲地區，主要銷售對象為半導體設計公司，最近二個會計年度及 112 年前三季之營業收入淨額分別為 1,292,379 千元、1,226,677 千元及 620,556 千元，各年度前十大銷售客戶之銷售金額合計占當年度營業收入淨額比重則分別為 58.03%、59.12%及 59.94%，茲就該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之前十大銷售對象變化情形分析如下：

①A 公司

A 公司成立於 85 年，位於新竹市，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事電源管理的類比暨混合訊號積體電路設計、測試、生產及行銷等業務，主要產品為電源管理 IC，應用於筆記型電腦、伺服器、面板、電視、手機、馬達等。該公司自 94 年起與 A 公司業務往來，主要提供半導體測試及封裝服務，最近二個會計年度及 112 年前三季對 A 公司之銷售淨額分別為 120,280 千元、136,241 千元及 103,922 千元，占營業收入比重分別為 9.31%、11.11%及 16.75%。最近二個會計年度及 112 年前三季均為該公司前二大銷售客戶之一。111 年較 110 年成長，主要係 A 公司商用筆記型電腦及伺服器終端需求強勁，帶動對電源管理 IC 測試及封裝需求成長。112 年前三季該公司對 A 公司之銷售較去年同期減少，主要係上半年受 A 公司商用筆記型電腦等終端需求趨緩且存貨尚在去化之影響，致對該公司電源管理 IC 測試及封裝服務需求下降。

②B 公司

B 公司成立於 94 年，位於新竹縣，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事功率積體電路及功率元件設計業務，主要產品為電源管理 IC 及功率元件，應用於個人電腦、筆記型電腦及基地台等產品。該公司自 95 年起與 B 公司業務往來，主要提供半導體測試及封裝服務，最近二個會計年度及 112 年前三季對 B 公司之銷售淨額分別為 177,606 千元、168,177 千元及 58,239 千元，占營業收入比重分別為 13.74%、13.71%及 9.38%，最近二個會計年度及 112 年前三季均為該公司前二大銷售客戶之一。111 年較 110 年對 B 公司銷售微幅減少，主要係 111 下半年 B 公司

調整庫存存貨，致對電源管理 IC 及 MOSFET 測試及封裝服務需求下降。112 年前三季較去年同期減少，因個人電腦及筆記型電腦終端需求趨緩及客戶持續調整庫存，致對該公司電源管理 IC 及 MOSFET 測試及封裝服務需求下降。

③C 公司

C 公司成立於 87 年，位於新北市，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事電源管理之功率元件及類比 IC 設計業務，主要產品為電源管理之功率元件，應用於電腦主機板、筆記型電腦、平板電腦、液晶顯示器、車用電子及車充等電源裝置。該公司自 95 年起與 C 公司業務往來，提供半導體測試與封裝服務及晶圓薄化服務，最近二個會計年度及 112 年前三季對 C 公司之銷售淨額分別為 61,102 千元、80,600 千元及 34,918 千元，占營業收入比重分別為 4.73%、6.57%及 5.63%，最近二個會計年度及 112 年前三季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年因對 C 公司提供之晶圓薄化服務需求較前一年度增加，致整體營收較前期增加。112 年前三季較去年同期減少，主要係受筆記型電腦終端需求趨緩，致 C 公司對該公司之功率元件測試、封裝及晶圓薄化服務需求下降。

④D 公司

D 公司成立於 96 年，位於新竹縣，為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司（股票代號：6693），從事功率元件及積體電路之設計、開發、製造及銷售業務，主要產品為 MOSFET，應用於筆記型電腦、行動電話、可攜式產品及節能家電與工業控制等。該公司自 98 年起與 D 公司業務往來，提供半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化服務，最近二個會計年度及 112 年前三季對 D 公司之銷售淨額分別為 46,201 千元、60,076 千元及 32,567 千元，占營業收入比重分別為 3.57%、4.90%及 5.25%，最近二個會計年度及 112 年前三季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年較 110 年成長，主係功率元件應用於筆記型電腦、節能家電及工業控制需求強勁，致功率元件測試封裝及晶圓薄化需求增加。112 年前三季較去年同期減少，主要係受筆記型電腦及節能家電終端需求趨緩，致功率元件測試及晶圓薄化服務需求下降。

⑤E 公司

E 公司成立於 102 年，登記於愛爾蘭 Dublin，總部位於美國

El Segundo，為美國那斯達克股票交易所掛牌交易之上市公司，從事 GaN 功率半導體設計及銷售業務，是全球 GaN 電源晶片的技術領導廠商，主要產品為 GaN 之電源管理 IC，應用於手機快充、筆記型電腦快充、消費性電子產品、資料中心及電動車等。該公司自 104 年起與 E 公司業務往來，提供半導體測試服務，111 年及 112 年前三季對 E 公司之銷售淨額分別為 57,193 千元及 29,143 千元，占營業收入比重分別為 4.66%及 4.70%，111 年及 112 年前三季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年因 GaN 應用於手機及筆記型電腦快充產品等市占率逐漸提高，致半導體測試服務需求增加，並於該年度成為該公司前十大銷售客戶之一。112 年前三季較去年同期減少，受筆記型電腦終端需求趨緩，存貨尚在去化影響，致 GaN 之電源管理 IC 測試服務需求下降。

⑥F 公司

F 公司成立於 83 年，位於新竹市，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事觸控積體電路、微控制器及特定用途積體電路之研發、設計及銷售業務，主要產品為觸控晶片及微控制器，應用於主機板、筆記型電腦、平板電腦、大小家電、安全系統、通訊週邊等泛 PC 產品及其週邊電源裝置。該公司自 88 年起與 F 公司業務往來，提供半導體測試及封裝服務，最近二個會計年度及 112 年前三季對 F 公司之銷售淨額分別為 56,048 千元、54,768 千元及 28,448 千元，占營業收入比重分別為 4.33%、4.46%及 4.58%，最近二個會計年度及 112 年前三季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年較 110 年減少，主要係 F 公司調整庫存，致對該公司觸控晶片及微控制器測試封裝服務需求下降。112 年前三季較去年同期減少，係受筆記型電腦終端需求趨緩，致 F 公司對該公司觸控晶片及微控制器測試服務需求下降。

⑦G 公司

G 公司成立於 91 年，位於新北市，曾為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司，103 年與美商公司進行合併，並於合併後下櫃。G 公司從事類比 IC 設計及銷售業務，主要產品為光源感測 IC，應用於通訊科技、行動電話、智慧型手機、手持式產品、數位相機、筆記型電腦、桌上型電腦、LED 背光模組、辦公室自動化產品、家電產品及汽車電子等。該公司自 94 年起與 G 公司業務往來，提供半導體測試及封裝服務，最近二個會計年度及 112 年前三季對 G 公司之銷售淨額分別為 45,855 千元、

36,653 千元及 22,527 千元，占營業收入比重分別為 3.55%、2.99%及 3.63%，最近二個會計年度及 112 年前三季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年較 110 年減少，主要係受 G 公司調整庫存影響，致對該公司光源感測 IC 測試封裝服務需求下降。112 年前三季較去年同期減少，受終端筆記型電腦、個人電腦及穿戴裝置需求疲乏，致 G 公司對該公司之測試封裝服務需求下降。

⑧H 公司

H 公司成立於 88 年，位於台北市，為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司，從事行動顯示器驅動 IC 產品之設計與銷售，主要產品為顯示器驅動 IC，應用於工控儀器、醫療儀器、車用市場、行動裝置及電子紙等多項領域。該公司自 91 年起與 H 公司業務往來，提供半導體測試及封裝服務，最近二個會計年度及 112 年前三季對 H 公司之銷售淨額分別為 54,907 千元、49,560 千元及 21,520 千元，占營業收入比重分別為 4.25%、4.04%及 3.47%，最近二個會計年度及 112 年前三季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年較 110 年減少，主要係 H 公司調整庫存，致對該公司驅動 IC 測試需求下降。112 年前三季較去年同期減少，受顯示器驅動 IC 終端需求趨緩，致驅動 IC 測試服務需求下降。

⑨I 公司

I 公司成立於 87 年，位於新竹縣，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事功率元件研究、設計及銷售業務，主要產品為 MOSFET，應用於個人電腦、筆記型電腦、電源供應器及家用產品電源應用等。該公司自 102 年起與 I 公司業務往來，提供半導體測試服務及晶圓薄化服務，最近二個會計年度及 112 年前三季對 I 公司之銷售淨額分別為 54,422 千元、47,365 千元及 20,931 千元，占營業收入比重分別為 4.21%、3.86%及 3.37%，最近二個會計年度及 112 年前三季均為該公司之前十大銷售客戶之一。111 年較 110 年減少，主要係 I 公司調整庫存之影響，致對該公司功率元件測試封裝服務需求下降。112 年前三季受筆記型電腦及電源供應器終端需求趨緩，致對 I 公司之測試及晶圓薄化服務銷售較去年同期減少。

⑩J 公司

J 公司成立於 81 年，位於新竹縣，為臺灣證券交易所掛牌交易之上市公司，從事顯示器驅動晶片之設計與銷售，主要產品為

驅動 IC，應用於人工智慧物聯網(AIoT)、工控、車載類等。該公司自 96 年起與 J 公司業務往來，提供半導體測試及封裝服務，112 年前三季對 J 公司之銷售淨額為 19,726 千元，占營業收入比重為 3.18%，主要係 J 公司終端需求提升致對該公司之測試服務需求增加，另因該公司對其他前十大客戶之銷售金額下滑，致 J 公司進入前十大客戶之列。

⑪ K 公司

K 公司成立於 97 年，位於加拿大，從事 GaN 功率半導體設計及銷售業務，主要產品為 GaN 功率元件，應用於資料中心、無線充電、消費性充電器、變壓器、電動車電池模組等。該公司自 108 年起與 K 公司業務往來，提供半導體測試服務及晶圓薄化服務，111 年對 K 公司之銷售淨額為 34,571 千元，占營業收入比重 2.82%。因受 GaN 應用於快充產品及電源供應器等市占率逐漸提高，致半導體測試服務需求增加，K 公司並於該年度進入前十大銷售客戶之列。112 年前三季因受客戶自身營運之影響減少對該公司之測試服務需求，並退出前十大客戶之列。

⑫ L 公司

L 公司成立於 90 年，位於台南市，為納斯達克證券交易所掛牌交易之上市公司，從事驅動 IC 與時序控制 IC 之設計業務，主要產品為驅動 IC，應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。該公司自 98 年起與 L 公司業務往來，提供半導體測試及封裝服務，110 年對 L 公司之銷售淨額為 91,825 千元，占營業收入比重為 7.11%。111 年起因受 L 公司驅動 IC 產品組合之影響，致對 L 公司驅動 IC 測試服務減少而未列入前十大銷售客戶。

⑬ M 公司

M 公司成立於 98 年，位於新竹縣，為臺灣證券交易所掛牌交易上市公司之孫公司，從事類比 IC 及驅動 IC 等設計及銷售業務，主要產品為電源管理 IC，應用於手機、筆記型電腦、平板電腦、電視等裝置。該公司自 100 年起與 M 公司業務往來，提供半導體測試服務，110 年對 M 公司之銷售淨額為 41,751 千元，占營業收入比重 3.23%，並於該年度成為該公司之第十大銷售客戶。111 年因 M 公司自身營運之影響減少對該公司電源管理 IC 測試

服務需求，並退出前十大銷售客戶之列。

(3)是否有銷售集中之風險

該公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務。該公司最近二個會計年度及 112 年前三季來自前十大銷售客戶之銷售金額占該年度營業收入之比重分別為 58.03%、59.12%及 59.94%，若以各年度第一大銷售客戶銷售金額占該年度營業收入之比重分別為 13.74%、13.71%及 16.75%，單一客戶之銷售比重皆未達 30%，尚無銷售集中風險之情形。

(4)該公司之銷售政策

該公司深耕半導體產業逾 30 年，多年來不斷地提升測試技術與拓展客源，於測試服務品質已獲得客戶之肯定與信賴，該公司之銷售政策如下：

①提升半導體測試技術，與客戶長期穩定合作

不斷提升高溫、高壓、大電流等測試項目之服務及品質，即時處理之技術支援與回應客戶品質問題，取得客戶之信賴，因此該公司之客戶多為長期合作之夥伴，藉由與客戶不斷開發新產品，協助客戶解決新產品測試技術問題，提高客戶之滿意度，維持密切合作並創造雙贏局面。

②以整合性服務，掌握市場先機

該公司提供完整之半導體封測整合性服務，能提供客戶不同製程，一次購足之需求，且具備自製及維修探針卡之技術，縮短製造及維修探針卡交期，即時滿足客戶需求，提供客戶快速回應市場之彈性，掌握市場先機，確保客戶之競爭力。

2.最近期及最近二個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析最近期及最近二個會計年度主要之變化情形

(1)最近二個年度及最近期主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新台幣千元

排名	110 年度				111 年度				112 年前三季			
	名稱	金額	比例%	與發行人之關係	名稱	金額	比例%	與發行人之關係	名稱	金額	比例%	與發行人之關係
1	三井化學	9,526	10.99	無	甲公司	11,364	13.40%	無	三井化學	11,004	19.09	無
2	甲公司	8,879	10.24	無	三井化學	7,880	9.29%	無	甲公司	4,958	8.60	無
3	丁公司	4,358	5.03	無	乙公司	5,476	6.46%	無	迪思科高	4,384	7.61	無
4	丙公司	4,283	4.94	無	丁公司	4,539	5.35%	無	乙公司	4,258	7.39	無
5	壬公司	4,245	4.90	無	原津工業	4,289	5.06%	無	原津工業	2,417	4.19	無
6	原津工業	4,058	4.68	無	戊公司	3,886	4.58%	無	丙公司	1,965	3.41	無
7	戊公司	3,737	4.31	無	辛公司	3,661	4.32%	無	丁公司	1,933	3.35	無
8	迪思科高	3,665	4.23	無	己公司	3,643	4.30%	無	戊公司	1,790	3.11	無
9	乙公司	3,386	3.91	無	迪思科高	3,469	4.09%	無	己公司	1,789	3.10	無
10	癸公司	2,621	3.02	無	壬公司	2,982	3.52%	無	庚公司	1,775	3.08	無
	其他	37,926	43.75	—	其他	33,596	39.63%	—	其他	21,360	37.07	—
	進貨淨額	86,684	100.00	—	進貨淨額	84,785	100.00%	—	進貨淨額	57,633	100.00	—

資料來源：該公司提供

(2)發行公司最近期及最近二個會計年度主要供應商之變化情形

該公司為半導體專業測試封裝服務廠商，其主要營業項目為提供半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務。茲就該公司最近二個會計年度及 112 年前三季主要供應商變化情形及其變動原因說明如下：

①膠帶

A.台灣三井化學股份有限公司

(以下簡稱三井化學；網址：tw.mitsuichemicals.com)

三井化學成立於 90 年，位於台北市，其母公司為東京證券交易所掛牌上市之公司日商三井化學株式會社(股票代號：4183)，主要業務為半導體材料、液晶材料、太陽能電池材料、手機材料及其他機能製品之銷售，該公司自 109 年開始與三井化學業務往來，主要向其採購晶圓背面研磨保護膠帶。最近二個會計年度及 112 年前三季進貨淨額分別為 9,526 千元、7,880 千元及 11,004 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 10.99%、9.29%及 19.09%，皆位於前十大供應商之列。111 年進貨金額較 110 年降低至 7,880 千元，主要係該公司在交期考量下調整採購策略，將部分品項轉向其他供應商採購所致；112 年前三季進貨金額達 11,004 千元，主要係因交期恢復穩定，故增加向三井化學採購，致進貨金額增加，其變動原因尚屬合理。

B.庚公司

庚公司成立於 89 年，位於高雄市，其母公司為東京證券交易所掛牌上市之公司日，主要業務為半導體相關材料及機台設備之生產及銷售。該公司自 94 年開始與庚公司業務往來，主要向其採購晶圓切割膠帶。112 年前三季進貨淨額為 1,775 千元，占該年度進貨淨額比重為 3.08%，位於第十大供應商。112 年前三季對庚公司之進貨與前兩年度約當，惟受其他供應商之採購金額增減影響，使庚公司於 112 年前三季進入前十大供應商之列，其變動原因尚屬合理。

C.辛公司

辛公司成立於 69 年，位於台中市，主要業務為半導體製程膠帶及機能性膠膜之製造及銷售，該公司自 110 年開始與辛公司業務往來，主要向其採購晶圓研磨膠帶及熱解膠帶。111 年

進貨淨額為 3,661 千元，占該年度進貨淨額比重為 4.32%。該公司基於交期及地緣性之考量下,於 110 年開始與辛公司合作，隨著該公司晶圓薄化服務市場拓展有成，故對辛公司之進貨金額增加，並於 111 年居第六大供應商之列；112 年前三季因該公司調整採購策略而將部份品項轉向其他供應商採購，故好加未列入前十大供應商之列，其變動原因尚屬合理。

② 貴金屬

A. 甲公司

甲公司成立於 89 年，位於高雄市，為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司，主要業務為金屬靶材製造與銷售，該公司自 109 年開始與甲公司業務往來，主要向其採購鎳錠、銀錠及銀靶料。最近二個會計年度及 112 年前三季進貨淨額分別為 8,879 千元、11,364 千元及 4,958 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 10.24%、13.40%及 8.60%，皆位於前十大供應商之列。110 年及 111 年之進貨金額逐年增加，主要係該公司近年來積極拓展晶圓薄化服務市場，晶圓薄化營收有所成長，其製程所需之貴金屬進貨金額亦隨之增加；112 年前三季則受終端消費性電子需求降低，晶圓薄化服務減少，亦使製程所需之貴金屬進貨金額減少，其變動原因尚屬合理。

B.乙公司

乙公司成立於 92 年，位於新竹縣，主要業務為高科技材料及設備之銷售，該公司自 108 年開始與乙公司業務往來，主要向其採購銀錠。最近二個會計年度及 112 年前三季進貨淨額分別為 3,386 千元、5,476 千元及 4,258 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 3.91%、6.46%及 7.25%，皆位於前十大供應商之列。111 年進貨金額增加至 5,476 千元，主要係因該公司積極拓展晶圓薄化服務市場，使晶圓薄化營收成長，其製程所需之貴金屬採購金額亦隨之增加；112 年前三季則受終端消費性電子需求降低，晶圓薄化服務減少，故減少對乙公司貴金屬之採購，其變動原因尚屬合理。

③耗材

A.迪思科高科技股份有限公司

(以下簡稱迪思科高；網址：www.disco.co.jp)

迪思科高成立於 96 年，位於新北市，其母公司為東京證

券交易所掛牌上市之公司日商 DISCO Corportion(股票代號：6146)，主要業務為精密研磨切割設備之製造及銷售。該公司自 101 年開始與迪思科高業務往來，主要向其採購切割刀片，係屬切割設備所用之耗材。最近二個會計年度及 112 年前三季進貨淨額分別為 3,665 千元、3,469 千元及 4,384 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 4.23%、4.09%及 7.61%，皆位於前十大供應商之列。進貨金額隨客戶對產品需求而增減，其變動原因尚屬合理。

B.原津工業股份有限公司(以下簡稱原津工業；網址：無)

原津工業成立於 77 年，位於新北市，主要業務為各類塑膠產品及零件之製造及銷售，該公司自 85 年開始與原津工業業務往來，主要向其採購晶粒盤。最近二個會計年度及 112 年前三季進貨淨額分別為 4,058 千元、4,289 千元及 2,417 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 4.68%、5.06%及 4.19%，皆位於前十大供應商之列。因係由客戶所指定之供應商，其增減變動主要係隨客戶對產品需求而增減，其變動原因尚屬合理。

C.丙公司

丙公司成立於 82 年，公司位於台中市，為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司，主要業務為代理銷售半導體、光電及綠色能源產業所需之原材料、零組件及其設備。該公司自 93 年開始與丙公司業務往來，主要向其採購晶粒盤。110 年及 112 年前三季進貨淨額分別為 4,283 千元及 1,965 千元，占各該年度進貨淨額比重分別為 4.94%及 3.41%，位於前十大供應商之列。111 年因客戶減少晶圓切割封裝服務，故該年度對利機之進貨金額減少，並退出前十大供應商之列，112 年前三季隨客戶晶圓切割封裝服務增加，故增加對丙公司之進貨，並進入該公司前十大供應商之列，其變動原因尚屬合理。

D.丁公司

丁公司成立於 103 年，位於新北市，主要業務為無塵室耗材之銷售，該公司自 103 年開始與丁公司業務往來，主要向其採購無塵衣、無塵影印紙、無塵擦拭紙等，係屬產線所用之耗材。最近二個會計年度及 112 年前三季進貨淨額分別為 4,358 千元、4,539 千元及 1,933 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 5.03%、5.35%及 3.35%，皆位於前十大供應商之列。110 及 111

年進貨金額約當，進貨比重亦無重大變動；112 年前三季受終端消費性電子產品需求降低，對測試及封裝服務需求下滑，致進貨金額減少，其變動原因尚屬合理。

E.戊公司

戊公司成立於 77 年，位於新竹市，主要業務為建材五金之銷售，該公司自 88 年開始與戊公司業務往來，主要向其採購抗靜電 EPE 海綿及晶圓盒，係屬產品包裝所用之耗材。最近二個會計年度及 112 年前三季進貨淨額分別為 3,737 千元、3,886 千元及 1,790 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 4.31%、4.58%及 3.11%，皆位於前十大供應商之列。110 及 111 年進貨金額及比重尚無重大變動；112 年前三季受終端消費性電子產品需求降低，致進貨金額減少，其變動原因尚屬合理。

F.己公司

己公司成立於 85 年，位於新北市，主要業務為半導體防護材料之製造及銷售，該公司自 93 年開始與己公司業務往來，主要向其採購晶圓間隔片，係屬產品包裝所用之耗材。111 年及 112 年前三季向己公司進貨淨額分別為 3,643 千元及 1,789 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 4.30%及 3.10%，並列入該公司前十大供應商之列。係屬產品包裝所用之耗材，111 年因產線所需，致對己公司之採購增加，並進入前十大供應商之列，112 年前三季受終端消費性電子產品需求降低，致進貨金額減少，其變動原因尚屬合理。

G.壬公司

壬公司成立於 90 年，位於高雄市，主要業務為半導體包裝材料之製造及銷售。該公司自 103 年開始與壬公司業務往來，主要向其採購載帶及上封帶，係屬產品包裝所用之耗材。最近二個會計年度進貨淨額分別為 4,245 千元及 2,982 千元，占各年度進貨淨額比重分別為 4.90%及 3.52%，皆位於前十大供應商之列，進貨金額隨客戶對產品需求而增減；112 年前三季對壬公司之進貨與前一年度約當，惟受其他供應商之採購金額增減影響，致壬公司退出前十大供應商之列，其變動原因尚屬合理。

H.癸公司

癸公司成立於 108 年，公司位於新竹縣，主要業務為代理

銷售半導體測試耗材、零件及加工組件等。該公司自 109 年開始與癸公司業務往來，主要向其採購鋨鎢彎針，用以製作探針卡，鋨鎢彎針係屬晶圓測試所需之耗材，其進貨金額隨客戶對產品需求而增減。110 年進貨淨額為 2,621 千元，占該年度進貨淨額比重為 3.02%，位於第十大供應商，111 年對癸公司之進貨與前一年度相當，惟受其他供應商之採購金額增加，致癸公司退出前十大供應商之列，其變動原因尚屬合理。

(3)供貨來源穩定性之評估

該公司係以半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化為主，故對原物料需求較低，且我國 IC 產業上中下游分工精細且結構完整，原物料之取得尚屬充裕，而該公司亦與供應商保持良好且穩定之合作關係，尚無貨源短缺或中斷之情事發生。最近二個會計年度及 112 年前三季前十大供應商進貨金額占各該年度進貨淨額比重分別為 56.25%、60.37%及 62.93%，各期間對第一大供應商之進貨比重皆未逾 30%以上，尚無進貨集中之情形，其供貨來源尚屬穩定。

(4)進貨政策

該公司係依據訂單、生產排程及業務所預估銷售量綜合評估之，並透過定期產銷會議來調節產品供需之平衡；其原物料採購係考量供應商品質穩定性、產能狀況及價格等，經採購部門詢比議後進行採購，截至目前為止，尚無發生供貨中斷之情事。

(二)最近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性、備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

單位：新台幣千元

項目 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季
		個體	合併	個體	合併	
營業收入淨額	微矽電子	1,291,177	1,292,379	1,226,677	1,226,677	620,566
	京元電子	25,820,727	33,759,389	27,619,107	36,781,996	24,525,468
	矽格	10,364,704	16,681,264	10,590,172	18,694,345	11,465,932
	昇陽半導體	2,656,741	2,651,386	3,138,053	3,138,053	2,573,994
應收款項總額	微矽電子	359,712	359,712	248,534	248,534	240,223
	京元電子	6,018,925	7,951,178	5,294,652	7,156,681	7,647,812
	矽格	2,343,687	3,920,652	2,259,658	3,889,990	4,140,968
	昇陽半導體	463,466	463,466	414,177	414,177	372,120

年度 \ 項目		110 年度		111 年度		112 年前三季
		個體	合併	個體	合併	
備抵呆帳	微矽電子	12,267	12,267	1,534	1,534	1,534
	京元電子	25,158	26,286	13,107	14,238	22,898
	矽格	—	47,708	—	53,282	14,400
	昇陽半導體	—	—	—	—	—
應收款項淨額	微矽電子	347,445	347,445	247,000	247,000	238,689
	京元電子	5,993,767	7,924,892	5,281,545	7,142,443	7,624,914
	矽格	2,343,687	3,872,944	2,259,658	3,831,425	4,126,568
	昇陽半導體	463,466	463,466	414,177	414177	372,120
備抵呆帳占應收款項總額比例(%)	微矽電子	3.41	3.41	0.62	0.62	0.64
	京元電子	0.42	0.33	0.25	0.20	0.29
	矽格	—	1.22	—	1.37	0.35
	昇陽半導體	—	—	—	—	—
應收款項週轉率(次)	微矽電子	3.88	3.89	4.03	4.03	3.41
	京元電子	4.82	4.94	4.88	5.04	4.43
	矽格	4.42	4.58	4.60	4.79	3.84
	昇陽半導體	5.74	5.73	7.15	7.15	8.73
應收款項收款天數	微矽電子	94	94	91	91	107
	京元電子	76	74	75	72	82
	矽格	83	80	79	76	95
	昇陽半導體	64	64	51	51	42

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

註：112 年第三季未出具個體財務報告。

1.應收款項變動之合理性

(1)個體財務報告

該公司最近二個會計年度個體營業收入淨額分別為 1,291,177 千元及 1,226,677 千元，期末應收款項總額分別為 359,712 千元及 248,534 千元。該公司 111 年底應收款項較 110 年底減少，主係 111 年受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務需求減少，另因 111 年第四季營業收入較去年同期減少 68,236 千元，故 111 年底之應收款項亦較 110 年底減少。

該公司最近二個會計年度個體應收款項週轉率及應收款項週轉天數分別為 3.88 次、4.03 次及 94 天、91 天。該公司 111 年度應收款項週轉率較 110 年度上升，主係 111 年受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務需求減少及 111 年第四季營業收入較去年同期減少

68,236 千元，減少幅度 21.86%，期末應收款項亦隨之下降，惟營業收入減少比率小於平均應收款項減少比率，致 111 年度應收款項週轉率及週轉天數較 110 年度上升。

(2)合併財務報告

該公司 110 年度編製合併財務報告之主體包括該公司及微石開發股份有限公司(以下簡稱微石)，因該公司於 110 年 12 月 30 日處分微石 100%股權，故 111 年度及 112 年第三季編制主體僅該公司。該公司最近二個會計年度及 112 年度前三季之合併營業收入淨額分別為 1,292,379 千元、1,226,667 千元及 620,556 千元，期末應收款項總額分別為 359,712 千元、248,534 千元及 2402,223 千元，該公司 111 年底應收款項較 110 年底減少，主係 111 年受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務需求減少，且 111 年第四季營業收入較去年同期減少 68,236 千元，期末應收款項亦隨之下降；112 年第三季底應收款項較 111 年底減少，主係 112 年前三季受消費性電子終端需求趨緩及客戶調整庫存影響，112 年前三季營業收入較去年同期減少 362,176 千元，第三季之營業收入亦較 111 年第四季減少，使 112 年第三季底之應收款項較 111 年底減少。

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之合併應收款項週轉率及應收款項週轉天數分別為 3.89 次、4.03 次、3.41 次及 94 天、91 天、107 天，應收款項週轉率主要係隨該公司營收變化而變動，該公司 111 年度應收款項週轉率較 110 年度上升，主係 111 年受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務需求減少，營業收入下降，應收款項亦隨之減少，加上應收款項收款情形良好，期末應收款項金額下降，營業收入減少比率小於平均應收款項減少比率所致；112 年前三季應收款項週轉率較 111 年度下降，主係 112 年前三季受消費性電子終端需求趨緩及客戶調整庫存影響，112 年前三季營業收入較去年同期減少 362,176 千元，減少幅度 36.85%，營業收入減少，應收款項亦隨之下降，減少幅度 3.34%，因營業收入減少比率大於平均應收帳款減少比率，使應收款項收回天數較 111 年度增加。

綜上所述，該公司最近二個會計年度及 112 年第三季底之應收款項係隨營業收入而產生變化，且應收款項收款天數雖較長於授信天數，但經評估，該公司應收款項變化情形尚屬合理，尚無重大異常之情事。

2. 應收款項備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估

(1)備抵損失提列政策

該公司依據國際財務報導準則第九號「金融工具」(IFRS9)訂定該公司之應收款項評價辦法，採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收票據及應收帳款(含關係人)係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊，包括總體經濟及相關產業資訊。

該公司考量個別客戶歷史違約狀態，將所有應收帳款及應收票據按不同帳齡逾期區間分組如下：

1	2	3	4	5
未逾期	逾期1-30天	逾期31-90天	逾期91-180天	逾期>181天

資料來源：該公司提供。

(2)應收款項備抵損失提列之適足性

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季在個體財務報告及合併財務報告之備抵損失提列金額為均為 12,267 千元、1,534 千元及 1,534 千元，占應收款項總額之比例皆 3.41%、0.62%及 0.64%，111 年度備抵損失提列金額較 110 年度減少 10,733 千元，主要係該公司於 101 年 12 月至 102 年 1 月銷售予晶鴻光電科技(股)公司(以下簡稱晶鴻)累積 10,733 千元應收款項未收回，至 111 年度晶鴻仍未支付款項且於同年申請停業，該公司並於 111 年度沖銷該筆 10,733 千元之帳款，致備抵損失下降，除上述事件外，該公司最近二年度及 112 年前三季均未曾發生重大帳款未能收回之情事，該公司業已依其提列政策估列備抵金額，故其備抵呆帳提列尚屬適足。

(3)應收款項收回之可能性

單位：新台幣千元

項目	112.09.30 金額	截至 112.11.30 收回情形		截至 112.11.30 未收回情形	
		金額	%	金額	%
應收票據	171	171	100.00	-	-
應收帳款	240,052	193,516	80.61	46,536	19.39
合計	240,223	193,687	80.63	46,536	19.37

資料來源：該公司提供

該公司 112 年 9 月底應收款項總額為 240,223 千元，截至 112 年 11 月 30 日止應收款項為已收回金額為 193,687 千元，收回比率為 80.63%，未收回金額為 46,536 千元，未收回比率為 19.37%，其中逾期未收回為 3,276 千元，占未收回金額之比率 7.04%，逾期未

收回款項主要係客戶入帳時間差產生，故應收款項收回情況尚無異常。

3.與同業比較

(1)個體財務報告

經與採樣同業比較，在應收款項週轉率及收款天數方面，110 年度及 111 年度之應收款項週轉率皆低於採樣同業，主要係各公司之營業屬性及銷售客群組成有所差異，該公司授信條件為月結 30 至 90 天，客戶於月結到期之次月付款，致應收款項收款天數較收款條件為高。111 年度受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務下降，營業收入減少，應收款項亦隨之減少，加上應收款項收款情形良好，期末應收款項金額下降，營業收入減少比率小於平均應收帳款減少比率，致應收款項週轉率上升，在備抵呆帳占應收款項總額比率方面，110 年度高於採樣同業，係 101 年至 102 年與銷售客戶晶鴻之交易，至 104 年 10,733 仟元應收款項未收回，故該公司於 104 年度向法院申請對晶鴻之假扣押及提列 100%減損損失，至 111 年度晶鴻仍未支付款項且於該年度申請停業，故該公司於 111 年度沖銷該筆帳款，整體而言，除前述事件外，該公司最近二個會計年度皆依其應收帳款評價辦法評估，其備抵呆帳之提列尚無不足之虞，應收款項週轉率與採樣公司相較亦無重大異常之情事。

(2)合併財務報告

經與採樣同業比較，在應收款項週轉率及收款天數方面，110 年度、111 年度及 112 前三季之應收款項週轉率皆低於採樣同業，主要係各公司之營業屬性及銷售客群組成有所差異，該公司授信條件為月結 30 至 90 天，客戶於月結到期之次月付款，致應收款項收款天數較收款條件為高。112 年前三季受消費性電子終端需求趨緩及客戶調整庫存影響，營業收入減少，應收帳款亦隨之減少，營業收入減少幅度大於應收帳款減少幅度，致應收款項週轉率下降，在備抵呆帳占應收款項總額比率方面，110 年度高於採樣同業，係 101 年至 102 年與銷售客戶晶鴻之交易，至 104 年 10,733 仟元應收款項未收回，故該公司於 104 年度向法院申請對晶鴻之假扣押及提列 100%減損損失，至 111 年度晶鴻仍未支付款項且於該年度申請停業，故該公司於 111 年度沖銷該筆帳款，整體而言，除前述事件外，歷年來應收款項收款狀況良好，期後收款情形亦屬良好，最近二個會計年度及最近期皆依其應收帳款評價辦法評估，其備抵呆帳之提列尚無不足之虞，應收款項週轉率與採樣公司相較亦無重大異常之情事。

經上述評估，該公司於最近二個會計年度及 112 年前三季之個體及合併應收款項變動之合理性、備抵呆帳提列之適足性及收回可能性，與採樣公司相較亦無重大異常之情事。

(三) 最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告存貨淨額變動之合理性、母子公司備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估。

該公司為半導體專業測試與封裝服務廠商，提供半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務。其製程包含晶圓針測、電性抽測、晶圓研磨、晶圓切割、晶圓蝕刻、晶圓金屬鍍膜等加工製程，存貨主要為製程所需之生產性物料，如貴金屬、膠帶、晶粒盤及其他耗材等，並無在製品、製成品及商品。110 年度及 111 年度財務報告編製主體包含該公司及其子公司微石開發，微石開發為餐飲服務，帳上並無存貨，故存貨主要來自於該公司；另微石開發於 110 年 12 月 30 日完成處分，故 112 年第三季為個別財務報告，並無出具個體財務報告。

1.存貨淨額變動情形

單位：新台幣千元

項目＼年度	110年度		111年度		112年前三季
	個體	合併	個體	合併	
營業收入淨額	1,291,177	1,292,379	1,226,677	1,226,677	620,556
營業成本	775,456	780,595	823,369	823,369	577,296
原物料	14,598	14,598	17,269	17,269	19,776
期末存貨總額	14,598	14,598	17,269	17,269	19,776
備抵存貨跌價及呆滯損失	-	-	(2,216)	(2,216)	(2,547)
期末存貨淨額	14,598	14,598	15,053	15,053	17,229
存貨週轉率(次)	45.68	45.99	51.68	51.68	47.69
存貨週轉天數(天)	8	8	7	7	8

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告及該公司提供。

(1)個體財務報告

110 年底及 111 年底之期末存貨淨額分別為 14,598 千元及 15,053 千元，111 年度主要係因積極拓展晶圓薄化服務市場，其製程所需之貴金屬亦隨之增加，使期末存貨總額上升至 15,053 千元。在存貨週轉率方面，該公司 110 年底及 111 年底之存貨週轉率分別為 45.68 次及 51.68 次，存貨週轉天數分別為 8 天及 7 天。基於產業特性，其存貨占營業成本比例甚低，故存貨周轉率高及週轉天數短，111 年下半年

起受終端市場需求變化趨緩致客戶調整減少產品測試封裝服務之影響，營業收入及存貨平均值皆較 111 年度減少，其減少幅度分別為 5.00%及 6.13%，惟晶圓薄化製程所需之貴金屬成本較高，致整體營業成本增加 6.18%，故存貨週轉率微幅上升至 51.68 次。其存貨周轉率及天數約當，尚無重大差異之情形。

(2)合併財務報告

110 年底、111 年底及 112 年 9 月底之期末存貨淨額分別為 14,598 千元、15,053 千元及 17,229 千元，111 年度主要係因積極拓展晶圓薄化服務市場，其製程所需之貴金屬亦隨之增加，使期末存貨總額上升至 15,053 千元；112 年前三季主要係因膠帶供貨交期較長，為建立安全庫存致期末存貨總額上升至 19,776 千元。在存貨週轉率方面，該公司 110 年底、111 年底及 112 年 9 月底存貨週轉率分別為 45.99 次、51.68 次及 47.90 次，存貨週轉天數分別為 8 天、7 天及 8 天。基於產業特性，其存貨占營業成本比例甚低，故存貨周轉率高及週轉天數短，111 年下半年起受終端市場需求變化趨緩致客戶調整減少產品測試封裝服務之影響，營業收入及存貨平均值皆較 111 年度減少，其減少幅度分別為 5.08%及 6.13%，惟晶圓薄化製程所需之貴金屬成本較高，致整體營業成本增加 5.48%，故存貨週轉率微幅上升至 51.68 次；112 年前三季消費性電子終端需求仍趨緩，致營業收入及營業成本皆下降，存貨週轉率下降至 47.69 次，存貨週轉天數增加至 8 天。各期間之存貨周轉率及天數約當，尚無重大差異之情形。

綜上所述，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季存貨淨額及存貨週轉率之變化，主要係隨營業收入而變化，考量公司產品銷售情形及產業特性，其存貨淨額變動情形尚屬合理。

2. 備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估

(1)備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列政策

存貨係以實際成本為入帳基礎，成本計價採加權平均法，存貨之後續評價係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較之，淨變現價值係指在正常營業下之估計售價減除估計完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

其存貨呆滯損失提列比率列示如下：

庫齡天數	1-360 日	361-720 日	721 日以上
提列比率	0%	50%	100%

資料來源：該公司提供。

該公司基於行業特性及產品生命週期考量，其存貨跌價及呆滯損失提列政策以存貨庫齡 721 天以上者，即提列 100%呆滯損失，其備抵存貨跌價及呆滯損失介於採樣公司間。整體而言，該公司之備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策應無重大異常情事。

(2)備抵存貨跌價與呆滯損失提列之適足性評估

單位：新台幣千元

項目＼年度	110 年底	111 年底	112 年 9 月底
備抵存貨跌價及呆滯損失	—	2,216	2,547
期末存貨總額	14,598	17,269	19,776
備抵存貨跌價及呆滯損失比率	—	12.83%	12.88%

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司 110 年度之存貨主要為製程所需之生產性物料，如膠帶、晶粒盤及其他耗材等，並無提列備抵存貨跌價及呆滯損失，隨晶圓薄化市場拓展有成，其製程所需之貴金屬亦隨之增加，該公司自 111 年度起依據存貨呆滯及跌價損失提列政策提列之。

111 年度及 112 年 9 月底之備抵存貨跌價及呆滯損失金額分別為 2,216 千元及 2,547 千元，占期末存貨總額之比率分別為 12.83%及 12.88%，112 年 9 月底備抵存貨跌價及呆滯損失與 111 年度約當，存貨總額則因備料增加而較 111 年底增加至 19,776 千元，使備抵存貨跌價及呆滯損失比率為 12.88%，各期提列備抵存貨跌價及呆滯損失金額係依上述政策予以評估提列之。

整體而言，該公司之備抵存貨跌價及呆滯損失政策尚無重大異常，其備抵存貨跌價及呆滯提列之適足性尚屬合理。

3. 與同業比較評估

單位：新台幣千元

項目＼年度		110 年度		111 年度		112 年前三季
		個體	合併	個體	合併	
營業成本	微矽電子	775,456	780,595	823,369	823,369	577,296
	京元電子	18,476,736	23,407,322	18,093,056	23,709,003	16,223,332
	矽格	6,668,505	11,732,806	7,090,077	13,165,811	8,863,312
	昇陽半導體	1,990,099	1,984,744	2,306,263	2,306,263	1,963,159
期末存貨總額	微矽電子	14,598	14,598	17,269	17,269	19,776
	京元電子	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)
	矽格	102,338	313,367	156,801	380,230	431,103

項目	年度	110 年度		111 年度		112 年前三季
		個體	合併	個體	合併	
	昇陽半導體	210,452	210,452	317,625	317,625	311,146
備抵存貨跌價及呆滯損失	微矽電子	-	-	2,216	2,216	2,547
	京元電子	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)
	矽格	630	9,289	902	28,306	32,797
	昇陽半導體	44,793	44,793	58,826	58,826	74,302
期末存貨淨額	微矽電子	14,598	14,598	15,053	15,053	17,229
	京元電子	1,029,780	1,371,473	1,119,883	1,368,626	1,154,451
	矽格	101,708	304,078	155,899	351,924	398,306
	昇陽半導體	165,659	165,659	258,799	258,799	236,844
備抵存貨跌價及呆滯損失占存貨總額比率(%)	微矽電子	-	-	12.83	12.83	12.88
	京元電子	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)	(註 1)
	矽格	0.62	2.96	0.58	7.44	7.61
	昇陽半導體	21.28	21.28	18.52	18.52	23.88
存貨週轉率(次)	微矽電子	45.68	45.99	51.68	51.68	47.69
	京元電子	18.79	18.56	15.99	16.59	17.15
	矽格	67.52	46.08	54.72	37.96	31.50
	昇陽半導體	10.18	7.00	8.73	8.73	10.56
存貨週轉天數(天)	微矽電子	8	8	7	7	8
	京元電子	19	20	23	22	22
	矽格	5	8	7	10	12
	昇陽半導體	36	52	42	42	35

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告及公開資訊觀測站。
註1：採樣公司之財務報告或公開資訊觀測站未揭露之。

該公司 110 年度並無提列備抵存貨跌價及呆滯損失，111 年度之個體備抵存貨跌價及呆滯損失為 2,216 千元，佔期末存貨總額之比率為 12.83%；合併備抵存貨跌價及呆滯損失為 2,216 千元，佔期末存貨總額之比率為 12.83%。112 年前三季備抵存貨跌價及呆滯損失為 2,547 千元，佔期末存貨總額之比率為 12.88%。經與採樣公司相較，各期間之備抵存貨跌價及呆滯損失佔期末存貨總額之比率皆介於採樣公司之間，尚無重大異常之情事。

該公司 110 年度及 111 年度之個體存貨週轉率分別為 45.68 次及 51.68 次，存貨週轉天數分別為 8 天及 7 天；合併存貨週轉率分別為 45.99 次及 51.68 次，存貨週轉天數分別為 8 天及 7 天；112 年前三季存貨週轉率為 47.69 次，存貨週轉天數為 8 天。經與採樣公司相較，該公

司存貨週轉率及存貨週轉天數除 110 年度個體介於採樣公司之間，餘均與矽格公司相當或優於採樣公司，尚無重大異常情事。

整體而言，該公司業已依據存貨呆滯及跌價損失提列政策提列之，經評估其提列金額及存貨週轉率與採樣公司相較尚無重大異常情事。

(四)發行人最近期及最近二個會計年度財務報告之業績概況

1.列表並說明最近期及最近二個會計年度財務報告營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形

單位：新台幣千元；%

分析項目	年度／公司	110 年度	111 年度		111 年前三季	112 年前三季	
		金額	金額	成長率	金額	金額	成長率
營業收入	微矽電子	1,292,379	1,226,677	(5.08)	982,732	620,556	(36.85)
	京元電子	33,759,389	36,781,996	8.95	27,932,433	24,525,468	(12.19)
	矽格	16,681,264	18,694,345	12.07	14,557,736	11,465,932	(21.24)
	昇陽半導體	2,651,386	3,138,053	18.36	2,281,153	2,573,994	12.84
營業毛利	微矽電子	511,784	403,308	(21.20)	343,607	43,260	(87.41)
	京元電子	10,352,067	13,072,993	26.28	10,041,725	8,302,136	(17.32)
	矽格	4,948,458	5,528,534	11.72	4,423,023	2,602,620	(41.16)
	昇陽半導體	666,642	831,790	24.77	618,248	610,835	(1.20)
營業利益	微矽電子	310,265	204,482	(34.09)	185,814	(80,100)	(143.11)
	京元電子	6,606,516	9,164,830	38.72	7,137,505	5,424,221	(24.00)
	矽格	3,440,397	3,826,682	11.23	3,105,746	1,464,985	(52.83)
	昇陽半導體	232,554	307,991	32.44	222,017	189,754	(14.53)

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司主要係從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC、MOSFET 產品及以 GaN 或 SiC 為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。綜觀台灣上市半導體測試封裝公司其業務型態、產品性質及營業項目後，採以下三家公司做為採樣公司，京元電子股份有限公司（上市股票代號：2449，以下簡稱京元電子）主要營業項目為晶片研磨切割及測試封裝業務，終端應用涵蓋資訊、通訊、辦公室自動化、汽車電子以及消費性電子等相關產品；矽格股份有限公司（上市股票代號：6257，以下簡稱矽格）主要營業項目為測試封裝業務，終端應用涵蓋高速運算、通訊、影音、消費性電子以及車用電子等相關產品；昇陽國際半導體股份有限公司（上市股票代號：8028，以下簡稱昇陽半導體）主要營業項目為晶圓再生服務及晶圓薄化

服務，終端應用涵蓋消費性電子、工業用電子產品及汽車等電子元件。茲就該公司與採樣公司之營業收入、營業毛利及營業淨利變化情形比較說明如下：

(1)營業收入

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業收入分別為 1,292,379 千元、1,226,677 千元及 620,556 千元，較前一年同期衰退率分別為(5.08)%及(36.85)%，營業收入呈下滑情形，主要隨終端應用市場需求程度、景氣循環、市場規模及銷售客戶端營運狀況等因素影響而有所不同。111 年度營業收入較 110 年度減少，主要係驅動 IC 客戶因庫存水位較高且受終端消費性電子產品等需求趨緩，致對驅動 IC 測試服務減少，營業收入下降；112 年前三季較 111 年前三季減少，主要係受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨去化庫存，致該公司測試營業收入下降。

與同業公司相較，該公司最近二個會計年度及 112 年度前三季之營業收入變動趨勢，以營業收入成長率而言，111 年度呈負成長，採樣公司皆為正成長，主係各公司之產品服務組合及終端市場略有不同，該公司因驅動 IC 客戶受終端應用消費性電子產品等需求趨緩，致對該公司驅動 IC 測試服務減少，使該公司營業收入較前一年度下滑，其他同業除消費性電子產品受影響外，尚有網路通訊、記憶體及高效能運算等需求支撐；112 年前三季成長率均低於採樣公司，主係該公司銷售客戶終端需求集中於消費性電子產業，受消費性電子產品終端需求疲弱，客戶尚在去化庫存，致對該公司之測試服務需求減少，採樣公司除京元電子及矽格亦受消費性電子產品終端需求影響外，網路通訊、記憶體及高效能運算等亦進入庫存調整，另昇陽半導體則受惠於先進製程需求，再生晶圓服務需求大幅增加，雖晶圓薄化業務亦受消費性電子需求趨緩及客戶庫存調整而下降，但 112 年前三季之營業收入仍較去年同期成長。整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業收入變化情形與採樣公司相較尚屬合理。

(2)營業毛利

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業毛利分別為 511,784 千元、403,308 千元及 43,260 千元，毛利率分別 39.60%、32.88%及 6.97%。該公司 111 年度營業毛利較 110 年度減少 108,476 千元，毛利率下降幅度為 16.97%，主要係受到測試產品組合之影響，部分測試毛利較高之產品因其客戶受終端消費性電子等需求趨緩，

致毛利率隨之下降；該公司 112 年前三季營業毛利較 111 年前三季減少 300,347 千元，毛利率下降幅度為 80.06%，主係受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，營業收入大幅下降，機器設備持續攤提成本，致毛利率隨之下降。

與同業公司相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業毛利率，110 年度優於所有採樣公司，111 年度則僅次於京元電子，優於矽格及昇陽半導體，112 年前三季因營業收入減少，機器設備持續攤提成本，致毛利率大幅減少，採樣公司京元電子及矽格亦受消費性電子產品終端需求疲弱影響，但因具規模經濟致毛利率減少比率低於該公司，另昇陽半導體受先進製程需求上升，毛利率未有大幅變動。整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業毛利及營業毛利率變動情形與採樣公司相較尚屬合理，尚無重大異常之情事。

(3)營業利益

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業利益(損失)分別為 310,265 千元、204,482 千元及(80,100)千元，營業利益(損失)率分別為 24.01%、16.67%及(12.91)%。該公司 111 年度受係驅動 IC 客戶庫存水位較高且受終端應消費性電子產品等需求趨緩，致營收下滑及毛利減少，營業利益亦隨之下降；112 年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致產能利用率下降，營業毛利大幅下降，營業利益及營業利益率亦隨之下降。

與同業公司相較，111 年度僅次於京元電子及矽格，112 年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體測試及封裝服務減少，營業收入大幅下滑，營業利益亦同步下降，致低於採樣公司。整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業利益及營業利益率變動尚無重大異常之情事。

2.列表並說明最近期及最近二個會計年度財務報告以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

(1)營業收入變化情形

單位：新台幣千元

年度 產品	110 年度		111 年度		111 年前三季		112 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	1,005,426	77.80	926,313	75.51	736,002	74.89	447,669	72.14
半導體封裝	140,438	10.87	109,502	8.93	99,633	10.14	62,809	10.12

晶圓薄化	145,312	11.24	190,862	15.56	147,097	14.97	110,078	17.74
其他	1,203	0.09	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合計	1,292,379	100.00	1,226,677	100.00	982,732	100.00	620,556	100.00

資料來源：該公司提供

(2)營業成本變化情形

單位：新台幣千元

年度 產品	110 年度		111 年度		111 年前三季		112 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	549,905	70.45	583,078	70.82	453,591	70.97	399,913	69.27
半導體封裝	111,953	14.34	98,581	11.97	77,015	12.05	69,951	12.12
晶圓薄化	113,598	14.55	141,710	17.21	108,519	16.98	107,431	18.61
其他	5,139	0.66	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合計	780,595	100.00	823,369	100.00	639,125	100.00	577,295	100.00

資料來源：該公司提供

(3)營業毛利變化情形

單位：新台幣千元

年度 產品	110 年度		111 年度		111 年前三季		112 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
半導體測試	455,521	89.00	343,235	85.10	282,411	82.19	47,756	110.39
半導體封裝	28,485	5.57	10,921	2.71	22,618	6.58	(7,142)	(16.51)
晶圓薄化	31,714	6.20	49,152	12.19	38,578	11.23	2,647	6.12
其他	(3,936)	(0.77)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合計	511,784	100.00	403,308	100.00	343,607	100.00	43,261	100.00

資料來源：該公司提供

(4)主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形

該公司主要營收來源區分為半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化服務。茲就該公司最近二個會計年度及最近期止主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形及原因分析說明：

①半導體測試

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季半導體測試之營業收入分別為 1,005,426 千元、926,313 千元及 447,669 千元，占營業收入比重分別為 77.80%、75.51%及 72.14%；為該公司營收占比最高之服務。半導體測試服務可區分為晶圓測試及成品測試，晶圓測試過程係透過探針與晶粒上的接點接觸，測試其電氣特性是否達設計規範要求，將不合格的晶粒標上記號，而後當晶片依晶粒為單位切割成獨立的晶粒時，標有

記號的不合格晶粒會被淘汰，不再進行下一個製程，以降低製造成本。成品測試過程係將切割封裝後的積體電路，透過測試機台檢測其功能及性能是否達設計規範要求，是積體電路產製過程中重要一環，該公司檢測設備可提供類比 IC、邏輯 IC、驅動 IC 及功率元件之測試服務。111 年度主要受驅動 IC 客戶高庫存影響，致驅動 IC 測試服務需求下降，半導體測試服務需求減少，故使營收降至 926,313 千元，佔整體銷售金額之比重為 75.51%；112 年前三季受消費性電子產品終端需求疲乏且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體測試服務減少至 447,669 千元，佔整體銷售金額之比重為 72.14%。

在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業成本分別為 549,905 千元、583,078 千元及 399,913 千元，營業毛利分別為 455,521 千元、343,235 千元及 47,756 千元，毛利率分別為 45.31%、37.05%及 10.67%。111 年度主要受客戶產品組合影響，較高毛利之 IC 測試服務需求下降，使營業收入下滑，致毛利率下降至 37.05%；112 年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體測試服務減少，營業收入大幅下滑，毛利隨之下滑，致毛利率下降至 10.67%。

②半導體封裝

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季半導體封裝之營業收入分別為 140,438 千元、109,502 千元及 62,809 千元，占整體營業收入比重分別為 10.87%、8.93%及 10.12%。半導體封裝過程係保護和固定晶粒不受粉塵、水分或外力撞擊的影響，讓積體電路能在各種環境中使用。111 年度主要受驅動 IC 客戶高庫存影響，致驅動 IC 封裝服務需求下降，半導體封裝服務減少，故使營業收入降至 109,502 千元，佔整體銷售金額之比重為 8.93%；112 年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體封裝服務減少，故使營業收入降至 62,809 千元，佔整體銷售金額之比重為 10.12%。

在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業成本分別為 111,953 千元、98,581 千元及 69,951 千元，營業毛利分別為 28,485 千元、10,921 千元及(7,142)千元，毛利率分別為 20.28%、9.97%及(11.37)%。111 年度主要受驅動 IC 客戶高庫存影響，致驅動 IC 封裝服務需求下降，致半導體封裝服務減少，營業收入下滑，致毛利率下降至 9.97%；112 年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致半導體封裝服務減少，營業收

入下滑，毛利隨之下滑，未達規模經濟，致毛利率下降至(11.37)%。

③晶圓薄化

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季晶圓薄化之營業收入分別為 145,312 千元、190,862 千元及 110,078 千元，占整體營業收入比重分別為 11.24%、15.56%及 17.74%。晶圓薄化過程係縮小積體電路體積，達到降低電阻及節能散熱之需求，111 年度該公司晶圓薄化服務通過銷售客戶品質肯定及拓展新客戶，致營業收入成長至 190,862 千元，佔整體銷售金額之比重為 15.56%；112 年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致晶圓薄化服務減少，營業收入降至 110,078 千元，佔整體銷售金額之比重為 17.74%。

在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業成本分別為 113,598 千元、141,710 千元及 107,431 千元，營業毛利分別為 31,714 千元、49,152 千元及 2,647 千元，毛利率分別為 21.82%、25.75%及 6.12%。該公司於 107 年度投入晶圓薄化業務，晶圓薄化製程係縮小積體電路體積，達到降低電阻及節能散熱之需求，製程品質受到客戶肯定，近年陸續投產，致 110 年度毛利率達 21.82%；111 年度該公司持續擴展晶圓薄化產能，隨著客戶薄化需求成長，致毛利率提升至 25.75%；112 年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致晶圓薄化服務減少，營業收入下滑，毛利隨之下滑，未達規模經濟，致毛利率下降至 6.12%。

④其他

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季其他之營業收入分別為 1,203 千元、0 千元及 0 千元，占整體營業收入比重分別為 0.09%、0%及 0%，在營業成本及營業毛利變化方面，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業成本分別為 5,139 千元、0 千元及 0 千元，營業毛利分別為(3,936)千元、0 千元及 0 千元，毛利率分別為(327.18)%、0%及 0%，其他收入主要係餐飲服務收入，該公司考量未來營運規劃，於 110 年 12 月 30 日處分微石開發(股)公司，故 111 年度起未有其他收入。

3. 最近期及最近二個會計年度財務報告營業收入或毛利率變動達 20%以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

單位：新台幣千元；%

項目＼年度	110 年度	111 年度		111 年前三季	112 年前三季	
	金額	金額	變動率	金額	金額	變動率
營業收入	1,292,379	1,226,677	(5.08)	982,732	620,556	(36.85)

毛　　利　　率	39.60	32.88	(16.97)	34.96	6.97	(80.06)

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告

依上表所示，該公司 112 年前三季營業收入及毛利率變動達 20%以上，故就上述期間依主要產品別進行價量變動分析。

單位：新台幣千元；%

主要產品	分析項目	111 年前三季及 112 年前三季	說明
半導體測試	(一)營業收入差異分析		銷貨收入：減少 288,333 千元。 1.數量差異不利 210,625 千元，係受終端市場需求疲乏且消費性電子客戶存貨尚在去化，致 112 年前三季測試服務數量較 111 年前三季減少，產生不利之數量差異。 2.價格差異不利 108,861 千元及組合差異有利 31,153 千元，112 年前三季受終端市場需求疲乏且消費性電子客戶存貨尚在去化，致單價下滑，另單價較高之電源管理 IC 占比提升，致產生價格不利差異及組合有利差異。
	P(Q'-Q)	(210,625)	
	Q(P'-P)	(108,861)	
	(P'-P)(Q'-Q)	31,153	
	P'Q'-PQ	(288,333)	
	(二)銷貨成本差異分析		銷貨成本：減少 53,678 千元。 1.數量差異有利 129,807 千元，係受終端市場需求疲乏且消費性電子客戶存貨尚在去化，致 112 年前三季測試服務數量較 111 年前三季減少，銷貨成本亦隨之減少，產生有利之數量差異。 2.價格差異不利 106,649 千元及組合差異有利 30,520 千元，主要係終端市場需求疲乏且消費性電子客戶存貨尚在去化，致 112 年前三季測試服務數量較 111 年前三季減少，致平均單位成本上升，單位成本較低之電源管理 IC 測試占比提升，產生不利之價格差異及組合有利差異。
	P(Q'-Q)	(129,807)	
	Q(P'-P)	106,649	
	(P'-P)(Q'-Q)	(30,520)	
	P'Q'-PQ	(53,678)	
	(三)毛利變動金額	(234,655)	毛利差異：112 年前三季較 111 年前三季減少 234,655 千元。
半導體封裝	(一)營業收入差異分析		銷貨收入：減少 36,824 千元。 1.數量差異不利 35,965 千元，係受終端市場需求疲乏且消費性電子客戶存貨尚在去化，致 112 年前三季封裝服務數量較 111 年前三季減少，產生不利之數量差異。 2.價格差異不利 1,344 千元及組合差異有利 485 千元，係受終端市場需求疲乏且消費性
	P(Q'-Q)	(35,965)	
	Q(P'-P)	(1,344)	
	(P'-P)(Q'-Q)	485	
	P'Q'-PQ	(36,824)	

主要產品	分析項目	111 年前三季及 112 年前三季	說明
			電子客戶存貨尚在去化，致平均售價下降，產生價格不利差異。
	(二)銷貨成本差異分析		銷貨成本：減少 7,064 千元。 1. 數量差異有利 27,801 千元，係受終端市場需求疲乏且消費性電子客戶存貨尚在去化，致 112 年前三季封裝服務數量較 111 年前三季減少，銷貨成本亦隨之減少，產生有利之數量差異。 2. 價格差異不利 32,451 千元及組合有利差異 11,714 千元，主要係終端市場需求疲乏且消費性電子客戶存貨尚在去化，致 112 年前三季封裝服務數量較 111 年前三季減少，致平均單位成本上升，產生不利之價格差異。
	P(Q'-Q)	(27,801)	
	Q(P'-P)	32,451	
	(P'-P)(Q'-Q)	(11,714)	
	P'Q'-PQ	(7,064)	
	(三)毛利變動金額	(29,760)	毛利差異：綜上所述 112 年前三季毛利較 111 年前三季減少 29,760 千元。
晶圓薄化	(一)營業收入差異分析		銷貨收入：減少 37,019 千元。 1.數量差異不利 42,637 千元，係受終端市場需求疲乏，致 112 年前三季晶圓薄化服務數量較 111 年前三季減少，產生不利之數量差異。 2. 價格差異有利 7,911 千元及組合差異不利 2,293 千元，係晶圓薄化數量減少，單價未有重大變動下，產生價格有利差異。
	P(Q'-Q)	(42,637)	
	Q(P'-P)	7,911	
	(P'-P)(Q'-Q)	(2,293)	
	P'Q'-PQ	(37,019)	
	(二)銷貨成本差異分析		銷貨成本：減少 1,088 千元。 1.數量差異有利 31,454 千元，係受終端市場需求疲乏且消費性電子客戶存貨尚在去化，致 112 年前三季晶圓薄化服務數量較 111 年前三季減少，銷貨成本亦隨之減少，產生有利之數量差異。 2. 價格差異不利 42,761 千元及組合差異有利 12,395 千元，主要係終端市場需求疲乏且消費性電子客戶存貨尚在去化，致 112 年前三季晶圓薄化服務數量較 111 年前三季減少，致平均單位成本上升，產生不利之價格差異。
	P(Q'-Q)	(31,454)	
	Q(P'-P)	42,761	
	(P'-P)(Q'-Q)	(12,395)	
	P'Q'-PQ	(1,088)	
	(三)毛利變動金額	(35,931)	毛利差異：綜上所述 112 年前三季毛利較 111 年前三季減少 35,931 千元。

資料來源：該公司提供；兆豐證券整理

註：P'及 Q'為最近年度單價及數量；P 及 Q 為上一年度單價及數量

(五)最近二個會計年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司（包括母子公司間交易事項）與關係人交易之評估

1. 與關係人間業務交易往來情形，以評估其有無涉及非常規交易情事，如屬銷貨予關係人者，則再評估授信政策、交易條件、款項收回、所售產品關係人後續投入生產或再銷售之情形及其合理性，如未符一般交易常規，其差異之原因及合理性。

(1)關係人名稱及關係

關係人	與該公司之關係
微石開發股份有限公司	其他關係人
辰謙投資有限公司	其他關係人
張少謙	其他關係人

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。
註：於 110 年 12 月 30 日處分子公司-微石開發股份有限公司 100%股權。

(2)合併財務報告關係人交易

①其他交易及其他應付款

單位：新台幣千元

項目	對象	110 年度	111 年度	112 年第三季
管理費用-交際費	微石開發(股)公司	-	3,909	1,956
期末應付交際費	微石開發(股)公司	-	278	-
管理費用-其他	微石開發(股)公司	-	445	494
管理費用-租金	辰謙投資有限公司	171	-	-
期末應付租金	辰謙投資有限公司	15	-	-

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

管理費用-交際費及管理費用-其他主要係微石開發(股)公司提供該公司餐飲服務之相關費用，占營業收入約 0.35%~0.39%，比例不高，經抽核相關憑證，尚無重大異常情事；管理費用-租金主要係辰謙投資有限公司提供微石開發(股)公司營業場所之相關費用，其交易尚屬合理，經抽核相關憑證，尚無重大異常情事。

②財產交易

該公司於 110 年 12 月 30 日處分子公司－微石開發(股)公司 100%股權與其他關係人張少謙，處分價款為 2,500 千元，並認列處分投資利益 1,376 千元，經抽核相關憑證，尚無重大異常情事。

(3)個體財務報告關係人交易

①其他交易及其他應付款

單位：新台幣千元

項目	對象	110 年度	111 年度
管理費用-交際費	微石開發(股)公司	4,229	3,909
期末應付交際費	微石開發(股)公司	-	278
管理費用-其他	微石開發(股)公司	313	445
其他收入	微石開發(股)公司	(465)	-

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

管理費用-交際費及管理費用-其他主要係微石開發(股)公司提供該公司餐飲服務之相關費用，占營業收入比例不高，經抽核相關憑證，尚無重大異常情事；其他收入係因該公司代採購設備所致，經抽核相關憑證，尚無重大異常情事。

②財產交易

該公司於 110 年 12 月 30 日處分子公司－微石開發(股)公司 100%股權與其他關係人張少謙，處分價款為 2,500 千元，並認列處分投資利益 1,376 千元，經抽核相關憑證，尚無重大異常情事。

2. 發行人與同屬關係企業公司之主要業務或產品(指最近二個會計年度均佔該年度總營業收入百分之三十以上者)，有無互相競爭情形：

該公司並無同屬關係企業公司，故不適用本項評估。

二、財務狀況

(一)發行人最近期及最近二個會計年度經會計師核閱或查核簽證財務報告之損益狀況及財務比率，並作變動分析與同業比較

1. 選擇採樣公司之理由

該公司主要係從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC、MOSFET 產品及以 GaN 或 SiC 為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。綜觀台灣上市半導體測試封裝公司其業務型態、產品性質及營業項目後，採以下三家公司做為採樣公司，京元電子股份有限公司（上市股票代號：2449，以下簡稱京元電子）主要營業項目為晶片研磨切割及測試封裝業務，終端應用涵蓋資訊、通訊、辦公室自動化、汽車電子以及消費性電子等相關產品；矽格股份有限公司（上市股票代號：6257，以下簡稱矽格）主要營業項目為測試封裝業務，終端應用涵蓋高速運算、通訊、影音、消費性電子以及車用電子等相關產品；昇陽國際半導體股份有限公司（上市股票代號：8028，以下簡稱昇陽半導體）主要營業項目為晶圓再生服務及晶圓薄化服務，終端應用涵蓋消費性電子、工業用電子產品及汽車等電子元件。同業方面之參考資料，係採用財團法人金融聯合徵信中心出版之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」之「電子零組件製造業」資料，作為同業平均之比較數據。

2.最近期及最近二個會計年度經會計師核閱或查核簽證財務報告之損益狀況

單位：新台幣千元；%

分析項目	年度 / 公司	110 年度	111 年度			111 年前三季	112 年前三季		
		金額	金額	變動金額(註 1)	變動比率(註 2)	金額	金額	變動金額(註 1)	變動比率(註 2)
營業收入	微矽電子	1,292,379	1,226,677	(65,702)	(5.08)	982,732	620,556	(362,176)	(36.85)
	京元電子	33,759,389	36,781,996	3,022,607	8.95	27,932,433	24,525,468	(3,406,965)	(12.20)
	矽格	16,681,264	18,694,345	2,013,081	12.07	14,557,736	11,465,932	(3,091,804)	(21.24)
	昇陽半導體	2,651,386	3,138,053	486,667	18.36	2,281,153	2,573,994	292,841	12.84
營業成本	微矽電子	780,595	823,369	42,774	5.48	639,125	577,296	(61,829)	(9.67)
	京元電子	23,407,322	23,709,003	301,681	1.29	17,890,708	16,223,332	(1,667,376)	(9.32)
	矽格	11,732,806	13,165,811	1,433,005	12.21	10,134,713	8,863,312	(1,271,401)	(12.55)
	昇陽半導體	1,990,099	2,306,263	316,164	15.89	1,662,905	1,963,159	300,254	18.06
營業毛利	微矽電子	511,784	403,308	(108,476)	(21.20)	343,607	43,260	(300,347)	(87.41)
	京元電子	10,352,067	13,072,993	2,720,926	26.28	10,041,725	8,302,136	(1,739,589)	(17.32)
	矽格	4,948,458	5,528,534	580,076	11.72	4,423,023	2,602,620	(1,820,403)	(41.16)
	昇陽半導體	666,642	831,790	165,148	24.77	618,248	610,835	(7,413)	(1.20)
營業費用	微矽電子	201,519	198,826	(2,693)	(1.34)	157,793	123,360	(34,433)	(21.82)
	京元電子	3,745,551	3,908,163	162,612	(4.34)	2,904,220	2,877,915	(26,305)	(0.91)
	矽格	1,508,061	1,701,852	193,791	12.85	1,317,277	1,137,635	(179,642)	(13.64)
	昇陽半導體	434,313	523,799	89,486	20.60	396,231	421,081	24,850	6.27
營業(損)益	微矽電子	310,265	204,482	(105,783)	(34.09)	185,814	(80,100)	(265,914)	(143.11)
	京元電子	6,606,516	9,164,830	2,558,314	38.72	7,137,505	5,424,221	(1,713,284)	(24.00)
	矽格	3,440,397	3,826,682	386,285	11.23	3,105,746	1,464,985	(1,640,761)	(52.83)
	昇陽半導體	232,329	307,991	75,662	32.57	222,017	189,754	(32,263)	(14.53)
營業外收入及支出	微矽電子	12,252	22,727	10,475	85.50	25,624	13,514	(12,110)	(47.26)
	京元電子	248,731	(198,804)	(447,535)	(179.93)	155,663	70,522	(85,141)	(54.70)
	矽格	222,415	599,777	377,362	169.67	910,345	762,670	(147,675)	(16.22)

分析項目	年度 公司	110 年度	111 年度			111 年前三季	112 年前三季		
		金額	金額	變動金額(註 1)	變動比率(註 2)	金額	金額	變動金額(註 1)	變動比率(註 2)
	昇陽半導體	10,520	64,668	54,148	514.71	95,636	151,739	56,103	58.66
本期淨利(損)	微矽電子	259,823	168,338	(91,485)	(35.21)	155,721	(55,133)	(210,854)	(135.40)
	京元電子	5,234,242	6,982,090	1,747,848	33.39	5,448,270	4,408,621	(1,039,649)	(19.08)
	矽格	3,036,248	3,513,949	477,701	15.73	3,199,222	1,812,497	(1,386,725)	(43.35)
	昇陽半導體	235,654	325,251	89,597	38.02	282,746	310,233	27,487	9.72
本期其他綜合損益	微矽電子	(11,390)	3,481	14,871	130.56	155,721	(55,133)	(210,854)	(135.40)
	京元電子	1,595,123	(1,320,936)	(2,916,059)	(182.81)	(1,451,737)	1,156,240	2,607,977	179.65
	矽格	373,562	(75,630)	(449,192)	(120.25)	(75,998)	482,252	558,250	734.56
	昇陽半導體	(1,653)	4,561	6,214	375.92	282,746	310,233	27,487	9.72
本期綜合損益總額	微矽電子	248,433	171,819	(76,614)	(30.84)	155,721	(55,133)	(210,854)	(135.40)
	京元電子	6,829,365	5,661,154	(1,168,211)	(17.11)	3,996,533	5,564,861	1,568,328	39.24
	矽格	3,409,810	3,438,319	28,509	0.84	3,123,224	2,294,749	(828,475)	(26.53)
	昇陽半導體	234,001	329,812	95,811	40.94	282,746	310,233	27,487	9.72

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註 1：較前一年度相同期間之增減金額。

註 2：較前一年度相同期間之增減比率。

(1)營業收入、營業成本及營業毛利

請參閱本評估報告參、一、(四)業績概況之說明。

(2)營業費用、其他收益及(費損)及營業利益

單位：新台幣千元；%

項目＼年度	110 年度		111 年度		112 年前三季	
	金額	占營收比率	金額	占營收比率	金額	占營收比率
推銷費用	13,122	1.02	14,886	1.21	9,958	1.60
管理費用	123,183	9.53	105,645	8.61	63,223	10.19
研究發展費用	64,391	4.98	69,578	5.67	48,660	7.84
預期信用減損損失	823	0.06	8,717	0.71	1,519	0.24
營業費用合計	201,519	15.59	198,826	16.21	123,360	19.88
其他收益及(費損)	-	-	-	-	-	-
營業利益	310,265	24.01	204,482	16.67	80,100	12.91

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

①營業費用

該公司最近 110~111 年度及 112 年前三季營業費用分別為 201,519 千元、198,826 千元及 123,360 千元，營業費用率分別為 15.59%、16.21%及 19.88%，茲就各費用類別之變化原因說明如下：

A.推銷費用

在推銷費用方面，該公司於 110~111 年度及 112 年前三季分別為 13,122 千元、14,886 千元及 9,958 千元，占各期營業收入比重分別為 1.02%、1.21%及 1.60%，主要係業務單位人員之薪資支出、文具印刷、交際費及運雜費用等項目。111 年度推銷費用較 110 年度增加 1,764 千元，增幅為 13.44%，主要係調薪及疫情解封影響致薪資相關費用及交際費增加，另購置棚架及監視設備等致雜項購置增加所致。112 年前三季受終端消費性電子產業疲弱影響，營業收入下滑致文具印刷、年終獎金及交際費減少。

B.管理費用

該公司 110~111 年度及 112 年前三季管理費用分別為 123,183 千元、105,645 千元及 63,223 千元，占各期營業收入比重分別為 9.53%、8.61%及 10.19%，主要係管理單位人員之薪資支出、獎金、交際費、折舊費用、各項攤提、保全費、勞務費、董事酬勞及員工酬勞等項目。111 年度管理費用較 110 年度減少

17,538 千元，減幅為 14.24%，主要原因係本期淨利較去年同期減少 91,485 千元，獎金、董事酬勞及員工酬勞減少所致。112 年前三季受終端消費性電子產業疲弱影響，營業收入下滑，致獎金減少，另因稅前淨損致董事酬勞與員工酬勞減少。

C.研究發展費用

該公司 110~111 年度及 112 年前三季研究發展費用分別為 64,391 千元、69,578 千元及 48,660 千元，占各期營業收入比重分別為 4.98%、5.67%及 7.84%。研發費用主要係研發單位人員之薪資支出、獎金及折舊等項目。111 年度研發費用較 110 年度增加 5,187 千元，增幅為 8.06%，主要購置研發設備致折舊費用增加所致。112 年前三季受終端消費性電子產業疲弱影響，營業收入下滑，獎金減少所致。

D.預期信用減損損失

該公司 110~111 年度及 112 年前三季預期信用減損損失分別為 823 千元、8,717 千元及 1,519 千元，占營收淨額比率分別為 0.06%、0.71%及 0.24%。主要係依該公司應收款項備抵損失提列政策，按預期信用損失率評估之備抵損失，以及認列合約資產預期信用減損損失，經評估尚無重大異常情事。

②營業利益

該公司 110~111 年度及 112 年前三季營業利益分別為 310,265 千元、204,482 千元及(80,100)千元，營業利益(損失)率分別為 24.01%、16.67%及(12.91)%。該公司 111 年度受係驅動 IC 客戶庫存水位較高且受終端應消費性電子產品等需求趨緩，致營收下滑及毛利減少，營業利益亦隨之下降；112 年前三季受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致產能利用率下降，營業毛利大幅下降，營業利益及營業利益率亦隨之下降。

綜上所述，該公司 110~111 年度及 112 年前三季之營業費用及營業利益之變化情形，尚屬合理。

(3)營業外收入及支出

單位：新台幣千元

項目＼年度	110 年度	111 年度	112 年前三季
利息收入	109	738	965
其他收入	10,242	18,038	10,535

其他利益及損失	處分不動產、廠房及設備利益(損失)	13,259	(1,104)	-
	處分投資利益	1,510	-	-
	外幣兌換利益	3,921	14,902	8,660
	什項支出	(7,594)	(239)	(503)
財務成本		9,195	9,608	6,143
營業外收入及支出合計		12,252	22,727	13,514
營業外收入及支出占營業收入淨額比率(%)		0.95	1.85	2.18

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告

①利息收入

該公司 110~111 年度及 112 年前三季利息收入金額分別為 109 千元、738 千元、191 千元及 965 千元，主要係 111 年第三季辦理現金增資所致。

②其他收入

該公司 110~111 年度及 112 年前三季其他收入金額分別為 10,242 千元、18,038 千元及 10,535 千元，主要係銷售客戶探針卡、包材及其他生產性材料之收入。

③其他利益及損失

A.處分不動產、廠房及設備利益(損失)

該公司 110~111 年度處分不動產、廠房及設備利益分別為 13,259 千元及(1,104)千元，主要係該公司處分機器設備之利益或損失，經評估尚無重大異常之情事。

B.處分投資利益

該公司 110 年度處分投資利益 1,510 千元，主要係該公司處分微石開發(股)公司所致，經評估尚無重大異常之情事。

C.外幣兌換利益(損失)

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之兌換利益分別為 3,921 千元、14,902 千元及 8,660 千元。該公司銷貨主要以新臺幣及美元計價收款，採購多以新臺幣及日圓計價，且外幣資產大於外幣負債，故各年度之匯兌損益受美元匯率波動影響，經評估尚無重大異常之情事。

D.什項支出

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之什項支出分別為 6,084 千元、239 千元及 503 千元，主要係客訴產生之賠償款，經

評估尚無重大異常之情事。

④財務成本

該公司 110~111 年度及 112 年前三季財務成本分別為 9,195 千元、9,608 千元及 6,143 千元，主要係銀行借款所產生之利息費用。

(4)本期淨利、本期其他綜合損益及本期綜合損益總額

單位：新台幣千元；%

項目＼年度	110 年度	111 年度	112 年前三季
本期淨利(損)	259,823	168,338	(55,133)
本期淨利占營收淨額比率	20.10	13.72	(8.88)
本期其他綜合損益	(11,390)	3,481	-
本期綜合損益總額	248,433	171,819	(55,133)

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司 110~111 年度及 112 年前三季本期淨利(損)分別為 259,823 千元、168,338 千元及(55,133)千元，占營收淨額比率分別為 20.10%、13.72%及(8.88)%，而本期其他綜合損益分別為(11,390)千元、3,481 千元及 0 千元；本期綜合損益總額分別為 248,433 千元、171,819 千元及(55,133)千元。111 年度主要係受測試產品組合影響，較高毛利之驅動 IC 測試服務需求下降，致本期損益下降；112 年前三季主要係受消費性電子產品終端需求疲弱且消費性電子產業客戶存貨尚在去化，致營業收入大幅下滑，機器設備持續攤提成本，致本期損益下降。

綜上所述，該公司 110~111 年度及 112 年前三季之損益變動情形尚屬合理，與採樣同業相較尚無重大異常之情事。

3. 最近期及最近二個會計年度之財務比率分析

分析項目		公司名稱	110 年度	111 年度	112 年前三季
財務結構	負債占資產比率(%)	微矽電子	45.36	38.01	42.67
		京元電子	51.71	50.31	47.75
		矽格	51.30	48.41	48.60
		昇陽半導體	60.22	65.21	65.18
		同業平均	48.10	46.60	(註 1)
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	微矽電子	112.71	126.28	126.02
		京元電子	128.13	133.53	145.03
		矽格	156.44	174.51	182.98
		昇陽半導體	127.04	130.89	124.41
		同業平均	207.47	195.69	(註 1)
償債能力	流動比率(%)	微矽電子	120.03	163.49	215.38
		京元電子	169.14	218.06	271.27
		矽格	192.97	277.21	231.42
		昇陽半導體	106.91	163.52	155.37
		同業平均	175.80	181.80	(註 1)
	速動比率(%)	微矽電子	116.32	156.95	206.38
		京元電子	153.91	201.13	252.18
		矽格	179.33	261.11	216.76
		昇陽半導體	96.25	141.75	137.18
		同業平均	137.60	138.50	(註 1)
	利息保障倍數(次)	微矽電子	31.69	19.97	(5.97)
		京元電子	20.96	17.15	11.27
		矽格	23.17	21.90	12.43
		昇陽半導體	13.54	13.17	8.89
		同業平均	4,026.10	3,024.40	(註 1))
經營能力	應收款項週轉率(次)	微矽電子	3.89	4.03	3.41
		京元電子	4.94	5.04	4.43
		矽格	4.58	4.79	3.84
		昇陽半導體	5.73	7.15	8.73
		同業平均	5.70	5.90	(註 1)
	存貨週轉率(次)	微矽電子	45.99	51.68	47.69
		京元電子	18.56	16.59	17.15
		矽格	46.08	37.96	31.50
		昇陽半導體	7.00	8.73	10.56
		同業平均	6.40	5.60	(註 1)
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	微矽電子	1.09	0.92	0.59
		京元電子	0.80	0.80	0.72
		矽格	1.01	1.02	0.89
		昇陽半導體	0.82	0.68	1.07

分析項目			公司名稱	110 年度	111 年度	112 年前三季
			同業平均	2.90	2.70	(註 1)
	總資產週轉率(次)		微矽電子	0.68	0.58	0.39
			京元電子	0.51	0.50	0.44
			矽格	0.50	0.50	0.41
			昇陽半導體	0.46	0.42	0.40
			同業平均	0.90	0.80	(註 1)
獲利能力	資產報酬率(%)		微矽電子	14.23	8.36	(3.13)
			京元電子	8.25	10.13	5.96
			矽格	9.56	9.93	4.81
			昇陽半導體	4.81	4.72	3.59
			同業平均	11.40	11.70	(註 1)
	權益報酬率(%)		微矽電子	26.47	13.72	(5.78)
			京元電子	16.30	19.44	11.70
			矽格	18.53	18.89	9.34
			昇陽半導體	10.54	11.81	10.33
			同業平均	21.20	21.50	(註 1)
	占實收資本額比率(%)	營業利益	微矽電子	50.86	31.62	(16.52)
			京元電子	54.03	74.95	59.15
			矽格	76.10	83.78	42.77
			昇陽半導體	16.57	20.18	16.58
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 1)
		稅前純益	微矽電子	52.87	35.13	(20.60)
			京元電子	56.06	73.33	58.38
			矽格	81.02	96.91	65.03
			昇陽半導體	18.69	24.42	29.83
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 1)
	純益率		微矽電子	20.10	13.72	(8.88)
			京元電子	15.50	18.98	17.98
			矽格	18.2	18.8	15.81
			昇陽半導體	9.62	10.36	12.05
			同業平均	12.00	12.80	(註 1)
	每股盈餘(元)		微矽電子	4.31	2.70	(0.85)
			京元電子	4.23	5.59	3.49
			矽格	6.25	6.68	3.23
			昇陽半導體	1.58	2.17	2.03
			同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 1)
現金流量	現金流量比率		微矽電子	109.91	104.46	58.02
			京元電子	123.14	185.76	137.21
			矽格	92.79	139.45	62.00
			昇陽半導體	39.67	61.79	35.83
			同業平均	30.30	40.40	(註 1)

分析項目		公司名稱	110 年度	111 年度	112 年前三季
	現金流量允當比率	微矽電子	109.90	103.22	91.37
		京元電子	87.72	93.64	100.47
		矽格	83.46	91.46	93.45
		昇陽半導體	55.09	41.83	40.85
		同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 1)
	現金再投資比率	微矽電子	21.64	13.45	5.95
		京元電子	7.86	10.19	4.24
		矽格	12.27	11.69	5.63
		昇陽半導體	6.10	6.60	2.23
		同業平均	8.40	10.30	(註 1)
槓桿度	營運槓桿度	微矽電子	1.82	2.44	(1.80)
		京元電子	2.39	2.01	2.26
		矽格	3.68	4.26	5.89
		昇陽半導體	8.00	6.98	8.64
		同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 1)
	財務槓桿度	微矽電子	1.03	1.04	0.92
		京元電子	1.05	1.06	1.10
		矽格	1.04	1.06	1.15
		昇陽半導體	1.10	1.11	1.29
		同業平均	(註 1)	(註 1)	(註 1)

資料來源：各公司年報、兆豐整理、經會計師查核簽證或核閱之財務報告及公開資訊觀測站；財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」，行業類別為「電子零組件製造業」之財務比率。

註 1：財團法人金融聯合徵信中心未出具季度之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」或未提供該等項目之比率。

財務比率計算公式如下：

1. 財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額

2. 償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出

3. 經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額

(3)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額

(4)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額

4. 獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額

(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額

(3)營業利益占實收資本額比率=營業利益/實收資本額

(4)稅前純益占實收資本額比率=稅前純益/實收資本額

(5)純益率=稅後損益/銷貨淨額

(6)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

4.財務比率變動分析及與同業之比較分析說明

(1)財務結構

①負債占資產比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之負債占資產比率分別為 45.36%、38.01%及 42.67%。111 年負債占資產比率較 110 年下降，主要係因 110 年獲利較前一年度大幅提升，致本期所得稅負債增加至 47,992 千元，而 111 年獲利持續穩定，本期所得稅金額降低至 7,976 千元，使流動負債減少，另考量營運發展所需而融資增建竹南廠廠房及增添設備，致資產總額及負債皆上升，惟負債總額減少幅度較大，故負債佔資產比率降低至 38.01%。112 年前三季隨竹南廠建廠各項工程進度使長期借款持續增加，故負債佔資產比率上升至 41.67%。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之負債占資產比率均介於採樣公司及同業平均，經評估尚無重大異常之情事。

②長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之長期資金占固定資產比率分別為 112.72%、126.28%及 126.02%。111 年度之長期資金占固定資產比率較 110 年度上升，主要係因 111 年獲利情形良好，加上辦理現金增資，使權益增加，另考量營運發展所需而增建竹南廠廠房及設備，使長期借款及固定資產亦隨之增加，整體而長期資金較去年同期增加 20.66%，固定資產較去年同期增加 7.70%，故 111 年長期資金占固定資產比率上升至 126.28%。112 年前三季因產生本期淨損，恰逢發放 111 現金股利，使權益下降，另隨竹南廠建廠各項工程進度及設備驗收，使長期借款及固定資產持續增加，惟長期資金及固定資產變動比率約當，故 112 年前三季長期資金占固定資產比率相較 111 年未有重大變動。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之長期資金占固定資產比率均低於採樣公司及同業平均，然皆超過 100%，經評估尚無重大異常情事。

整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之財務結構尚屬穩健。

(2)償債能力

①流動比率及速動比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之流動比率分別為 120.03%、163.49%及 215.38%；速動比率分別為 116.32%、156.95%及 206.38%，111 年之流動比率及速動比率較 110 年增加，主要係因償還短期借款 80,000 千元以及本期所得稅金額降低至 7,976 千元，流動負債減少 24.57%所致。112 年前三季之流動比率及速動比率均較 111 年增加，主要係隨竹南廠建廠所需之設備驗收，使應付設備款減少，以及本期產生淨損故未估列應付員工及董事酬勞，流動負債大幅減少 34.78%所致。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之流動比率及速動比率均介於採樣公司及同業平均。其流動比率及速動比率均高於 100%，短期償債能力尚無重大異常，經評估尚無重大異常情事。

②利息保障倍數

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之利息保障倍數分別為 31.69 倍、19.97 倍及(5.97)倍，呈現下滑之趨勢，主要係受終端市場需求趨緩，致營業收入減少，稅前淨利亦隨之減少，112 年前三季

因虧損，致利息保障倍數產生負數。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度之利息保障倍數介於採樣公司及同業，112 年前三季則低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

(3)經營能力

①應收帳款週轉率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季底之應收款項週轉率為 3.89 次、4.03 次及 3.41 次，應收款項週轉率主要係隨營收變化而變動，111 年度應收款項週轉率較 110 年度上升，主係 111 年受主要驅動 IC 客戶產品組合影響，驅動 IC 測試服務需求減少，營業收入下降，應收款項亦隨之減少，加上應收款項收款情形良好，期末應收款項金額下降，營業收入減少比率小於平均應收款項減少比率所致；112 年前三季應收款項週轉率較 111 年度下降，主係 112 年前三季受消費性電子終端需求趨緩及客戶調整庫存影響，112 年前三季營業收入較去年同期減少 362,176 千元，減少幅度 36.85%，營業收入減少，應收款項亦隨之下降，減少幅度 3.36%，因營業收入減少比率大於平均應收帳款減少比率，使應收款項收周轉率較 111 年度降低。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之應收帳款週轉率雖低於同業平均但介於採樣公司之間，經評估尚無重大異常之情事。

② 存貨週轉率

該公司 110 年底、111 年底及 112 年前三季底存貨週轉率分別為 45.99 次、51.68 次及 47.69 次。基於產業特性，其存貨占營業成本比例甚低，故存貨周轉率高及週轉天數短，111 年下半年起受終端市場需求變化趨緩致客戶調整減少產品測試封裝服務之影響，營業收入及存貨平均值皆較 111 年度減少，其減少幅度分別為 5.08%及 6.13%，惟晶圓薄化製程所需之貴金屬成本較高，致整體營業成本增加 5.48%，故存貨週轉率微幅上升至 51.68 次；112 年前三季消費性電子終端需求仍趨緩，致營業收入及營業成本皆下降，存貨週轉率下降至 47.69 次，各期間存貨周轉率之週轉天數均約當 7 天，尚無重大差異之情形。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司存貨週轉率皆優於採樣公司及同業平均，尚無重大異常情事。

③ 不動產、廠房及設備週轉率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 1.09 次、0.92 次及 0.59 次。不動產、廠房及設備週轉率呈現逐年下降之趨勢，主係該公司於 111 年開始投入增建竹南廠廠房計畫案，又 111 年度及 112 年前三季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得營業收入減少，故不動產、廠房及設備週轉率呈現逐年下降之情形。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度之不動產、廠房及設備週轉率均介於採樣公司及同業平均之間，112 年前三季因該公司持續擴充產能增加設備之購置，以致低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

④總資產週轉率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之總資產週轉率分別為 0.68 次、0.58 次及 0.39 次。總資產週轉率呈現逐年下降之趨勢，111 年度之總資產週轉率較 110 年度下降，主係該公司於 111 年度開始投入增建竹南廠廠房計畫案，致總資產金額增加，且受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得營業收入減少，致總資產週轉率下降。112 年前三季因發放現金股利，致總資產金額減少，惟營業收入之減少幅度大於總資產減少幅度，致總資產週轉率下降至 0.39 次。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度之總資產週轉率均介於採樣公司及同業平均之間，112 年前三季總資產週轉率低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之經營能力應無重大異常。

(4)獲利能力

①資產報酬率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之資產報酬率分別為 14.23%、8.36%、及(3.13)%，資產報酬率呈現逐年下降之趨勢，主係 111 年度及 112 年前三季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之資產報酬率與採樣公司及同業平均間互有高低，經評估尚無重大異常之情事。

②權益報酬率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之權益報酬率分別為 26.47%、13.72%、及(5.78)%。權益報酬率呈現逐年下降趨勢，主係因 111 年度及 112 年前三季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司 110 年度之權益報酬率高於採樣公司及同業平均，111 年度之權益報酬率介於採樣公司及同業平均之間，112 年前三季則低於採樣公司，經評估尚無重大異常之情事。

③營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之營業利益占實收資本額比率分別為 50.86%、31.62%及(16.52)%，稅前純益占實收資本額比率分別為 52.87%、35.13%及(20.60)%，營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率呈現下滑之趨勢，主係因 111 年度及 112 年前三季受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得營業利益及稅前純益均較前一年度減少。

經與採樣公司相較，該公司最近二個會計年度之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均介於採樣公司之間，經評估尚無重大異常之情事。

④純益率及每股盈餘

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之純益率分別為 20.10%、13.72%及(8.88)%，每股盈餘分別為 4.31 元、2.70 元及(0.85)元。純益率及每股盈餘呈現下滑之趨勢，主係受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退，連帶影響獲利狀況。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之純益率與採樣公司及同業互有高低；最近二個會計年度之每股盈餘均介於採樣公司之間，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之獲利能力應無重大異常。

(5)現金流量

①現金流量比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之現金流量比率分別為 109.91%、104.46%及 58.02%，現金流量比率呈現下滑之趨勢。111

年度之現金流量比率較前一年度減少，主係產品組合調整，獲利能力較前一年度減少，致營業活動淨現金流入減少，112 年前三季之現金流量比率較前一年度減少，主係受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，營業活動淨現金流入減少所致。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之現金流量比率均介於採樣公司與同業平均之間，經評估尚無重大異常之情事。

②現金流量允當比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之現金流量允當比率分別為 109.90%、103.22%及 91.37%。此係衡量公司由營業活動所產生之現金，是否足以應付公司的業務成長以及支付現金股利之所需。現金流量比率呈現下滑之趨勢，111 年度及 112 年前三季之現金流量允當比率均較前期下降，主係該公司於 111 年度開始投入增建竹南廠廠房計畫案，包括擴建生產線及購置測試機器設備，資本支出不斷擴張，且 111 年度及 112 年前三季現金股利發放金額亦分別較前一年度增加所致。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度之現金流量比率高於採樣公司，112 年前三季介於採樣公司之間，經評估尚無重大異常之情事。

③現金再投資比率

該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之現金再投資比率分別為 21.64%、13.45%及 5.95%。111 年度之現金再投資比率較 110 年度下降，主係受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得營業收入下滑，亦致營業活動之淨現金流入減少約 77,962 千元，加上竹南廠廠房增建工程開始投入，不動產、廠房及設備總額增加 325,126 千元所致。112 年前三季之現金再投資比率較 111 年度下降，主係終端消費性需求仍持續低迷，使獲利能力仍較 111 年度下滑，致營業活動之淨現金流入較去年同期減少 56.51%。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之現金再投資比率均大於採樣公司及同業平均，經評估尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季之各項現金流量各項指標變化情形，尚屬合理，與採樣公司及同業平均比較，經評估尚無重大異常之情事。

(6)槓桿度

①營運槓桿度

該公司 110 年度、111 年度及 112 年前三季之營運槓桿度分別為 1.82 倍、2.44 倍及(1.80)倍，營業槓桿度呈現下滑之趨勢，主係受終端市場需求趨緩致客戶減少產品測試封裝服務，使得該公司營業收入衰退且營業利益減少所致。

經與採樣公司相較，該公司最近二個會計與採樣公司互有高低，112 年前三季低於採樣同業，係受終端市場需求趨緩，致營業收入減少所致，經評估尚無重大異常之情事。

②財務槓桿度

該公司 110 年度、111 年度及 112 年前三季之財務槓桿度分別為 1.03 倍、1.04 倍及 0.92 倍。該公司最近二個會計年度利息費用差異不大，112 年前三季因營業淨損，致財務槓桿度下降。

經與採樣公司及同業平均相較，該公司最近二個會計年度及 112 年前三季低於採樣同業，最近二個會計年度係利息費用占營業利益比例微小，112 年前三季係營業淨損致財務槓桿度低於採樣同業，經評估尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司最近二個年度及 112 年前三季之各項槓桿度指標變化情形，尚屬合理，與採樣公司及同業平均比較，經評估尚無重大異常之情事。

(二)發行人及其各子公司（包括母子公司間交易事項）最近期及最近二個會計年度背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性金融商品交易之情形及重大資產交易之情形，並評估其對公司財務狀況之影響

1. 背書保證情形

該公司依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂有「背書保證作業程序」作為其為他人背書或提供保證之依據，並經董事會通過及提報股東會同意後實施。經檢視該公司最近二個會計年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及截至目前為止之董事會與股東會議事錄、背書保證備查簿、公開資訊觀測站公告等資料等，該公司並無為他人背書保證之情事。

2. 重大承諾事項

經查閱該公司最近二個會計年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及檢視重大合約，其承諾事項主要係擴建廠房及採購機器設備之合約，係為配合營運活動及未來業務發展所產生，其性質及餘額並無重大異常之情事，對該公司財務狀況並無重大不利之影響。

單位:新台幣千元

項目/年度	110 年底	111 年底	112 年第三季
已簽約但尚未發生之資本支出	274,971	520,154	390,011

資料來源：經會計師查核簽證及核閱之財務報告。

3. 資金貸與他人之情形

該公司依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂有「資金貸與他人作業程序」作為其資金貸與他人之依據，並經董事會通過及提報股東會同意後實施。經檢視該公司最近二個會計年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及截至目前為止之董事會與股東會議事錄，並查詢公開資訊觀測站，該公司並無為他人資金貸與之情事。

4. 衍生性商品交易

該公司依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定「取得或處分資產處理程序」中訂有「衍生性金融商品之作業程序」，作為從事衍生性商品交易之依據，並經董事會通過及提報股東會同意後實施。經檢視該公司最近二個會計年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及截至目前為止之董事會與股東會議事錄，該公司並無從事衍生性商品交易之情事。

5. 重大資產交易

該公司依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂有「取得或處分資產處理程序」作為該公司從事相關交易之依據，並經董事會通過及提報股東會同意後實施。經參閱該公司最近二個會計年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及截至目前為止之董事會與股東會議事錄，並查詢公開資訊觀測站之重大訊息，該公司並無之重大資產交易情形。

(三)發行人最近期及最近二個會計年度資金募集及每股盈餘變化情形

1. 最近期及最近二年度資金募集及每股盈餘變化情形

單位：新台幣千元

項目 年度	110 年度	111 年度	112 年前三季
期初股本	610,000	610,000	646,600
現金增資	-	36,600	-
期末股本	610,000	646,600	646,600
營業收入	1,292,379	1,226,677	620,556
營業淨利	310,265	204,482	(80,100)
稅後淨利	259,823	168,338	(53,133)

項目	年度	110 年度	111 年度	112 年前三季
每股稅後盈餘(元)	追溯前(註 1)	4.31	2.70	(0.85)
	追溯後(註 2)	4.02	2.70	(0.85)

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告

註 1：係以當年度加權平均流通在外股數計算之基本每股稅後盈餘。

註 2：係以 112 年 9 月 30 日為基準往前追溯調整之基本每股稅後盈餘。

2. 評估所募集資金是否允當運用並產生合理效益

請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。

3. 對每股盈餘稀釋之影響

請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。

(四)本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益。前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債計劃實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形

1.本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源用途及預計效益。

該公司本次募集資金計畫係用於充實營運資金，經檢視該公司所編製 112 及 113 年度之現金收支預測表，該公司未來有資本支出合計之金額達本次募資金額百分之六十之情事，請參閱本評估報告「陸、三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性」之說明。

2.前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債計劃實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形。

該公司前各次現金增資計畫實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且其增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者為 111 年 6 月辦理現金增資發行新股案，該計畫已執行完畢，其相關計畫內容及執行情形請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形」之說明。

(五)發行人其他特殊財務狀況

經查閱該公司最近期及最近二個會計年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並無其他特殊財務狀況。

肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

本承銷商已依「中華民國證券商同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商報告之評估查核程序」規定查核完成，所獲致結論如下：

一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改善計畫

該公司截至評估報告出具日止，前各次募集與發行有價證券計畫均已執行完畢，尚無執行進度未達預計目標之情形，且該公司並無併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成之情事，故不適用本項評估。

二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益

該公司截至評估報告出具日止，該公司並無併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券之情事，且前次現金增資計畫已執行完畢，並無經重大變更且尚未完成者，故不適用本項評估。

三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響

該公司截至本評估報告出具日止，尚無併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價債券之情事，而前各次募集與發行有價證券計畫實際完成日距本次現金增資案申報日未逾三年者為 111 年 6 月辦理之現金增資，其計畫內容、執行情形及效益分析說明如下：

(一)增資計畫內容

1.目的事業主管機關核准日期及文號：民國 111 年 6 月 17 日證櫃新字第 1110005463 號。

2.計畫所需資金總額：新台幣 164,700 千元。

3.資金來源：現金增資發行普通股 3,660 仟股，每股面額新台幣 10 元，每股發行價格新台幣 45 元，募集總金額為新台幣 164,700 仟元。

4.計畫項目及資金運用進度

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預期完成日期	所需資金總額	預定資金運用情形
			111 年度第三季
償還銀行借款	111 年第三季	164,700	164,700

5.預計產生效益

該公司募集資金 164,700 仟元，全數用於償還銀行借款，以減少向銀行借款金額並降低所造成之利息負擔。此外，尚可改善本公司財務結構及提升償債能力各項指標，適度減輕財務負擔，以及降低對金融機構之依存度，對本公司整體營運發展及競爭力之提升將有所助益。

(二)執行情形

1.計畫執行情形

單位：新臺幣仟元

計畫項目	執行狀況(截至 111 年第三季)			進度超前或落後之原因及改善計畫
償還銀行借款	支用金額	預定	164,700	依照預定進度完成
		實際	164,700	
	執行進度(%)	預定	100%	
		實際	100%	

資料來源：該公司提供

(2)執行效益

單位：新臺幣千元；%；倍

項目		111年前二季(增資前)	111年度(增資後)
基本財務資料	流動資產	805,924	708,320
	流動負債	592,654	433,232
	負債總額	1,070,422	1,226,677
	利息支出	4,810	9,608
	營業收入	687,128	1,226,677
	每股盈餘(元)	2.03	2.7
財務結構	負債比率	48.52	38.01
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	122.72	126.28
償債能力	流動比率	135.98	163.49
	速動比率	130.95	156.95
	利息保障倍數	36.6	24.65

該公司此次辦理辦理現金增資共募集 164,700 千元，所募集資金已全數於 111 年第三季用以償還銀行借款，以減少向銀行借款金

額並降低所造成之利息負擔。此外，尚可改善財務結構及提升償債能力各項指標，適度減輕財務負擔，以及降低對金融機構之依存度，對該公司整體營運發展及競爭力之提升將有所助益。

四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近二個會計年度有無財務週轉困難情事

經參閱該公司最近期及最近二個會計年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、股東會議事錄及公開資訊觀測站資訊，截至評估報告出具日止，該公司未曾發行公司債；另該公司之長期借款均能如期還本付息，其長期借款合約對該公司目前財務、業務或其他事項並無重大影響，該公司最近期及最近二個會計年度亦無財務週轉困難之情事。

五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開

經參閱該公司最近二年度及 112 年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、股東會議事錄及公開資訊觀測站資訊，截至評估報告出具日止無辦理私募有價證券之情事，故不適用本項評估。

伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項性質依附表九之一中所列事項詳與評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行

該公司本次係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款之規定，辦理現金增資發行新股以供辦理初次上市前公開承銷之用，非屬同準則第六條第二項第一款或第四款所列發行新股之情事，故不適用同準則第十三條第一項第二款所列情事之評估。

二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事

(一)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條所列情事之承銷商審查意見

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
1. 簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告者。		√		經參閱該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並無出具無法表示意見或否定意見之查核報告，故無左列情事。
2. 簽證會計師出具保留意見之查核報告，其保留意見影響財務報告之允當表達者。		√		經參閱該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並無出具無法表示意見或否定意見之查核報告，故無左列情事。
3. 發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，顯示有違反法令或公司章程，致影響有價證券之募集與發行者。			√	該公司本次係辦理現金增資發行新股作為創新板初次上市前公開承銷之用，依法令規定無須檢附發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，，故不適用。
4. 律師出具之法律意見書，表示有違反法令，致影響有價證券之募集與發行者。		√		經參閱律師對本次現金增資發行新股出具之法律意見書及法律事項檢查表，並未發現該公司有違反法令，致影響有價證券募集與發行之情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
5. 證券承銷商出具之評估報告，未明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性者。		√		本承銷商已對本次募集與發行有價證券計畫明確表示計畫之可行性及合理性，另本次係辦理現金增資發行新股以供創新板初次上市前公開承銷之用，屬「發行人募集與發行有價證 券處理準則」第六條第二項第三款所列之案件，依同準則第八條第三項規定，得不適用關於募集資金計畫必要性之評估。綜上，本次募集與發行有價證券計畫並無左列情事，詳細內容請參閱評估報告「陸、本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性」說明。
6. 經金融監督管理委員會退回、撤銷、廢止或自行撤回其依「發行人募集與發行有價證券處理準則」申報(請)案件，發行人自接獲金管會通知即日起三個月內辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項規定之案件者。但本次辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，不在此限。		√		經檢視該公司董事會議事錄及與金管會往來函文，該公司最近三個月內並無經金融監督管理委員會退回、撤銷、廢止或自行撤回其依「發行人募集與發行有價證券處理準則」申報(請)案件之情事。
7. 申報現金增資或發行公司債案件，直接或間接赴大陸地區投資金額違反經濟部投資審議委員會規定者。但其資金用途係用於國內購置不動產、廠房及設備並承諾不再增加對大陸地區投資，不在此限。		√		經檢視該公司 110~111 年度及 112 年截至送件日止董事會議事錄及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，截至評估報告出具日止該公司並無直接或間接赴大陸地區投資，故無左列情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
8. 上市、上櫃公司或興櫃股票公司未依本法第十四條之六第一項規定設置薪資報酬委員會或未依相關法令規定辦理，情節重大者。		√		經檢視該公司董事會議事錄，並至公開資訊觀測站查詢該公司重大訊息公告，該公司已依法設置薪資報酬委員會，並依相關法令規定訂定組織規程及委任薪資報酬委員，並召開薪資報酬委員會，故無左列情事。
9. 未依公司法第一百七十七條之一第一項但書規定將電子方式列為表決權行使管道之一者。		√		經檢視該公司公司章程，該公司已依左列規定將電子方式列為表決權行使管道之一。
10. 違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項，情節重大者。		√		經檢視該公司申請股票創新板上市時之聲明書，並未發現該公司有違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項，情節重大之情事。
11. 經金管會發現有違反法令，情節重大者。		√		經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止之董事會及股東會議事錄、與主管機關往來函文、金管會證期局公告裁罰案件資訊及律師法律意見書，並無左列情事。

綜上評估，該公司並無「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條所列情事。

(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條所列情事之承銷商審查意見

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
1. 申報年度及前二年度公司董事變動達二分之一，且其股東取得股份有違反本法第四十三條之一者。但於申報日前已完成補正者，不在此限。		√		經檢視該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估報告日止之變更事項登記卡、董事會及股東會議事錄，該公司並無左列之情事。
2. 上市或上櫃公司有本法第一百五十六條各款情事之一者。但依本法第一百三十九條第二項規定限制其上市買賣者，不在此限。				
(1) 發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產。		√		經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、與主管機關往來函文，並參閱律師出具之法律意見書及該公司之聲明書，未發現該公司有訴訟或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產之情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(2) 發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更。		√		經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、現行有效之重大契約、向財團法人金融聯合徵信中心查詢該公司之企業綜合信用資訊、第一類票據信用資料查覆單，並參閱律師出具之法律意見書及該公司之聲明書，該公司並未遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大變更之情事。
(3) 發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格。		√		經檢視該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、主管機關往來函文、並參閱律師出具之法律意見書及該公司之聲明書，並未發現該公司有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格之情事。
(4) 該有價證券之市場價格，發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌。		√		經查詢櫃檯買賣中心網站所公告之興櫃股票股價異常達通知公告，該公司申報日前一個月間並無發生連續暴漲或暴跌之情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(5) 發行該有價證券之公司發生重大公害或食品藥物安全事件。		√		經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、主管機關往來函文，並參閱律師出具之法律意見書及該公司之聲明書，該公司並未有發生重大公害或食品藥物安全事件之情事。
(6) 其他重大情事。		√		經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、主管機關往來函文，並參閱律師出具之法律意見書及該公司之聲明書，尚未發現該公司有其他重大情事，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。
3. 本次募集與發行有價證券計畫不具可行性、必要性及合理性者。		√		該公司本次係辦理現金增資發行新股以供創新板初次上市前公開承銷之案件，屬「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款所列之案件，依同準則第八條第三項規定，得不適用關於募集資金計畫必要性之評估。另本次募集與發行有價證券之計畫確具可行性及合理性，請參閱本評估報告「陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性」之說明。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
4. 前各次募集與發行及私募有價證券計畫之執行有下列情事之一，迄未改善者：				
(1) 無正當理由執行進度嚴重落後，且尚未完成。		√		經查詢該公司前各次募資與發行有價證券計畫已執行完畢；另該公司並無私募有價證券，請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次募集與發行有價證券計畫之執行情形」之說明。
(2) 無正當理由計畫經重大變更者。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。		√		經查詢公開資訊觀測站，及查閱該公司董事會及股東會議事錄，該公司前各次募集與發行有價證券計畫，並無重大變更情形。
(3) 募集與發行有價證券計畫經重大變更，尚未提報股東會通過。		√		經檢視該公司董事會及股東會議事錄，前各次募集與發行有價證券並無募集與發行有價證券計畫經重大變更之情事，故不適用左列事項之評估。
(4) 最近一年內未確實依第九條第一項第四款至第九款及發行人募集與發行海外有價證券處理準則第十一條規定辦理。		√		經查閱該公司與主管機關往來函文、公開說明書、董事會及股東會議事錄，並查詢公開資訊觀測站之募資計畫執行專區，並未發現該公司最近一年內有未確實依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第四款至第九款之情事；且該公司最近一年內並無辦理募集與發行海外有價證券，故未有左列情事。
(5) 未確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理，情節重大。			√	經查閱該公司董事會及股東會議事錄、該公司出具之聲明書，參閱律師出具之法律意見書，並查詢公開資訊觀測站私募專區，該公司並無辦理私募有價證券之情事。
(6) 未能產生合理效益且無正當理由。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。		√		該公司並無前次募集與發行有價證券計畫之執行未能產生合理效益且無正當理由之情事，詳請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次募集與發行有價證券計畫之執行情形」之說明。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
5. 本次募集與發行有價證券計畫之重要內容(如發行辦法、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等)未經列成議案，依公司法及章程提董事會或股東會討論並決議通過者。		√		該公司本次辦理創新板上市前現金增資計劃之重要內容已列成議案，業經112 年 12 月 27 日之董事會討論並決議通過。
6. 非因公司間或與行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善，而辦理現金增資或發行公司債者。		√		經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估報告出具日止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄及股東會議事錄，並未發現該公司有非因公司間或行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善，而辦理現金增資或發行公司債者。
7. 有重大非常規交易，迄未改善者。		√		經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告及該公司之聲明書，截至評估日止，並未發現該公司有重大非常規交易之情事。
8. 持有具流動性質之金融資產投資、閒置性資產或投資性不動產而未有處分或積極開發計畫，達最近期經會計師查核簽證之財務報告歸屬於母公司業主之權益之百分之四十或本次申報現金增資或發行公司債募集總金額之百分之六十，而辦理現金增資或發行公司			√	該公司本次係依照「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款之規定，辦理現金增資發行新股供辦理創新板上市前公開承銷之用，依同準則第八條第四項規定，得不適用左列評估。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
債者。但所募得資金用途係用於購買不動產、廠房及設備或用於合併非以買賣有價證券為主要業務之公司，且有具體募資計畫佐證其募集資金之必要性，不在此限。				
9. 本次現金增資或發行公司債計畫之用途為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者。			√	經檢視該公司 112 年 12 月 27 日董事會議事錄，該公司本次現金增資計畫之資金用途係為充實營運資金，非為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者，故不適用左列事項之評估。
10. 不依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告，情節重大者。		√		經檢視該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司係依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告，並無發現左列情事。
11. 違反第五條第二項規定情事者。		√		經取具該公司之聲明書，該公司承諾將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條第二項規定辦理。
12. 內部控制制度之設計或執行有重大缺失者。		√		該公司業依規定委請會計師就內部控制制度之設計與實際運作情形進行專案審查，經取具會計師無保留意見之內部控制制度審查報告，其內部控制制度及內部稽核制度應已健全建立並有效執行，該公司內部控制制度之設計及執行尚無發現重大異常之情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
13. 申報日前一個月，其股價變化異常者。		√		經查詢櫃檯買賣中心網站所公告之興櫃股票股價異常達通知公告，該公司申報日前一個月間並無股價變化異常情事。
14. 公司全體董事或監察人持股有下列情形之一者：				
(1) 違反本法第二十六條規定，經通知補足持股尚未補足。		√		該公司業已設置審計委員會取代監察人，故不適用左列監察人持股規定，另經查閱最近一個月公開資訊觀測站「董監事持股餘額明細資料」、「董事、監察人持股不足法定成數彙總表」與主管機關之往來函文，該公司全體董事尚無持股不足或經金管會通知補足持股而尚未補足之情事。另經查閱該公司截至112 年 11 月底止，全體董事之持股總數為 17,208,986 股，占該公司實收資本額64,660,000 股之 26.61%，符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，故無左列情事。
(2) 加計本次申報發行股份後，未符本法第二十六條規定。但經全體董事或監察人承諾於募集完成時，補足持股，不在此限。		√		該公司已發行股數為 64,660,000 股，加計本次現金增資發行股數 4,042,000 股，預計增資後股數為 68,702,000 股；截至評估報告出具日止，全體董事持股總數為 17,208,986 股，增資後全體董事持股比率 25.05%，仍符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，尚無左列情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(3) 申報年度及前一年度公司全體董事或監察人未依承諾補足持股。			√	經檢視該公司 111 年度及 112 年截至評估報告日止，該公司與主管機關往來函文，並至公開資訊觀測站公司查詢董事、監察人持股不足法定成數彙總表資訊，未發現該公司有受主管機關通知應補足持股之情事，故不適用左列事項之評估。
15. 發行人或其現任董事長、總經理或實質負責人於最近三年內，因違反本法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法等工商管理法律，或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等違反誠信之罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。		√		經參閱律師出具之法律意見書、該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取具該公司及董事長暨總經理出具之聲明書，並無左列情事。
16. 因違反本法，經法院判決確定須負擔損害賠償義務，迄未依法履行者。		√		經參閱律師出具之法律意見書、該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取具該公司之聲明書，該公司並無左列情事。
17. 為他人借款提供擔保，違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第五條規定，情節重大，迄未改善者。		√		經參閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告及該公司之聲明書，該公司並無左列情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
18. 合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，而有下列情形之一： (1) 違反本會公開發行公司取得或處分資產處理準則第二章第五節之規定，情節重大。 (2) 受讓或併購之股份非為他公司新發行之股份、所持有非流動之股權投資或他公司股東持有之已發行股份。 (3) 受讓之股份或收購之營業或財產有限制買賣等權利受損或受限制之情事。 (4) 違反公司法第一百六十七條第三項及第四項之規定。 (5) 被合併公司最近一年度之財務報告非經會計師出具非無保留意見之查核報告。但經出具保留意見之查核報告，其資產負債表經出具無保留意見，不在此限。			√	該公司本次辦理現金增資發行新股，係供創新板初次上市前公開承銷之用，非屬合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，故不適用左列評估事項。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
19. 有第十三條第一項第二款第六目規定之情事，且有下列情形之一： (1) 申報現金發行新股，公司董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東未承諾將一定成數股份送交證券集中保管事業保管。 (2) 申報發行轉換公司債或附認股權公司債，未於發行辦法明定應募人應自前揭公司債發行日起將公司債及嗣後所轉換或認購之股份送交證券集中保管事業保管一年。			√	該公司本次係辦理現金增資發行新股，作為創新板初次上市前辦理公開承銷之股份來源，屬「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款募集與發行有價證券，非屬「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第一款或第四款，故不適用左列之評估。
20. 證券承銷商於發行人申報時最近一年內經金管會、證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及中華民國證券商業同業公會處記缺點累計達十點以上，且自被處記缺點累計達十點之日起未逾三個月。但發行人辦理現金發行新股為初次上市、上櫃公開銷售者，不在此限。			√	本證券承銷商於該公司申報時最近一年內並未經金融監督管理委員會、證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及中華民國證券商業同業公會處記缺點累計達十點以上之情事。且本案係屬興櫃股票公司辦理現金發行新股為創新板初次上市公開銷售者，故不適用左列之評估。
21. 其他本會為保護公益認為有必要者。		√		經檢視該公司與主管機關之往來函文，並未發現有左列情事。

綜上所述，該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件並無違反「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條各款所列之情事。

二之一、總括申報發行新股案件者，是否符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十九條之一及十九之二所列情事

截至本評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司，非為上市或上櫃公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供申請初次創新板上市公開承銷之用，故不適用本項評估。

三、是否符合中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定

茲就「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第壹章總則及第貳章現金增資普通股之相關條文評估說明如下：

條次	自律規則條款	說明
第一條	為推動有價證券之發行，並保障投資，除其他法令另有規定外，本公會承銷商會員輔導發行公司或外國發行人辦理募集與發行有價證券事宜時應遵守本自律規則。	本承銷商辦理該公司募集與發行有價證券相關事宜，謹遵守本自律規則辦理。
第二條	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券時，主辦承銷商與發行公司或外國發行人間不得有下列情事： 一、任何一方與其母公司、母公司之全部子公司，合計持有對方股份總額百分之十以上者。 二、任何一方與其子公司派任於對方之董事，超過對方董事總席次半數者。 三、任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人，或具有配偶、二親等以內親屬關係者。 四、任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。 五、任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。 六、任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。但證券承銷商為金融機構或金融控股公司之證券子公司時，如其母公司、母公司之全部子公司總計持有發行公司股份未逾發行公司已發行股份總額百分之十，且擔任發行公司董事或監察人席次分別未逾三分之一者，不在此限。	經查本承銷商與該公司間並無左列各款之情事，且雙方亦已出具聲明書，聲明並無左列情事，故符合左列條文之規定。

條次	自律規則條款	說明
	七、雙方依相關法令規定，應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。 八、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者，致有失其獨立性之情事者。 發行公司或外國發行人發行普通公司債及未涉及股權之金融債券，如銷售對象僅限於證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人，其主辦承銷商得不受前項規定之限制，發行公司或外國發行人如具證券承銷商之資格者，亦得擔任主辦承銷商。 本條所稱母公司及子公司，應依證券商財務報告編製準則規定認定之。	
第二條之一	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券應取得填報檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且不得與發行公司或外國發行人、會計師及證券商具有下列關係之聲明書： 一、財務會計準則公報第六號規定之關係人關係。 二、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。 依發行人募集與發行海外有價證券處理準則或外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定出具海外存託憑證、海外股票或海外公司債發行辦法與行政院金融監督管理委員會同意生效內容無重大差異意見書中文本之律師，亦應符合前項之規定。	經取得律師填報之檢查表及出具之法律意見書，並無左列各項之情事。
第三條	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券，應於向本公會申報承銷契約副本時，檢送有關承銷商與發行公司或外國發行人於向金管會或其委託之機構申報案件至繳款截止日止，其相關宣傳或資訊揭露應以公開說明書所載內容為限之聲明書；總括申報追補發行新股案件，前開聲明書之聲明期間為自承銷商出具評估總結意見之日起至繳款截止日止，承銷商並應複核發行公司或外國發行人有無違反前開規定。 前項聲明書之聲明事項，應增列有關不得對特定人或不特定人說明或發布除依金管會「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」辦理公告之財務預測資訊內容以外之其他財務業務預測性資訊。	本承銷商將依規定於向公會申報承銷契約副本時，檢送左列規定之聲明書。

條次	自律規則條款	說明
	經主管機關依證券交易法第二十二條第一項核定免向金管會申報生效者,第一項聲明書之聲明期間以向金管會申請案件至繳款截止日止。	
第四條	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券（員工認股權憑證除外），加計其前各次（含其所私募者）上述有價證券流通在外餘額依各別轉換（認購）價格設算轉換（認購）後所增加之股數，不得逾已發行股數之百分之五十。 發行公司或外國發行人以已發行之股份做為轉換（認購）之用者，其做為轉換（認購）用之已發行股份不列入前項增加股數之計算。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之一	承銷商輔導發行公司申報發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，以新發行之股份履行轉換義務或履約者,承銷商應加強輔導發行公司採取股票無實體發行之制度,惟自九十五年七月一日起，上市、上櫃及興櫃股票公司發行股票或公司債應採帳簿劃撥交付,不印製實體方式為之。 承銷商輔導外國發行人募集與發行有價證券之交付，除外國發行人註冊地國另有規定外，應以帳簿劃撥方式為之。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之二	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，應注意發行公司之發行與轉換（認購）辦法中應訂明「自發行公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日止,不得請求轉換（認購）」規定；另應注意避免現金增資認股停止過戶日前十五個營業日、股票變更面額之停止轉換(認購)起始日起暫停轉換（認購）期間與前各次具轉換（認股、交換）有價證券到期日前之停止轉換（認股、交換）期間接續，及已發行流通在外之轉換公司債其轉換股份時先交付股票再辦理變更登記者，如遇普通股除息、除權或現金增資認股時，應符合證交所「營業細則」及櫃檯中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第十條有關二階段公告規定。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。

條次	自律規則條款	說明
	前項變更面額之停止轉換(認購)起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換(認購)期間。	
第四條之三	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購、交換)權之各種有價證券，自發行日後屆滿一定期間起，除依法暫停過戶期間外，持有人得依發行人所定之發行及轉換(認股、交換）辦法請求轉換（認股、交換)；但發行公司或外國發行人為未上市（櫃)、未登錄興櫃之公開發行公司者，轉換(認股、交換）期間自發行日後屆滿一定期間至到期日前十日止為限。 前項所稱一定期間不得少於三個月，並應由發行人或外國發行人於轉換(認購、交換）辦法中訂定之。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之四	刪除	-
第四條之五	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，應就發行年期、發行價格、贖回時點、轉換溢價率、收益率、賣回時點、擔保狀況、分券狀況等因素綜合評估其發行條件訂定之合理性。 對於發行條件顯不相當者，承銷商應輔導發行公司或外國發行人於重新合理訂定發行條件後，再行送件。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之六	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行海外有價證券，其按發行價格計算之發行金額，應高於二千萬美元。但發行公司確有外幣需求或外國發行人確有特殊需求，且發行條件合理者，不受此限。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之七	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認購）辦法中應訂明發行公司或外國發行人依發行與轉換(認購)辦法所定反稀釋調整公式計算其調整後轉換價格時，其公式中之已發行股數應加計已私募股數。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。

條次	自律規則條款	說明
	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報（請）發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換(認購)辦法中應訂明發行公司或外國發行人發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券後，除發行公司或外國發行人所私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，發行公司或外國發行人遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，發行公司或外國發行人應比照該發行與轉換（認購）辦法所定於遇有已發行普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時之轉換價格調整公式，計算其調整後轉換價格（向下調整，向上則不予調整）並函請證交所或櫃檯買賣中心公告，於私募有價證券交付日調整之。 依第二項計算調整後轉換價格時，如須訂定每股時價，應以私募有價證券交付日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。	
第四條之八	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，公開說明書中應充分揭露當次發行有價證券之發行條件及該發行條件對股權稀釋、股東權益之影響。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之九	除上市（櫃）公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理案件外，發行公司或外國發行人得先行印製價格以區間方式揭露之公開說明書寄交投資人，並於該公開說明書封面顯著處註明提醒投資人上網查詢、參閱承銷商配售通知之實際承銷價格並依承銷商之通知繳交價款。 承銷商應注意交寄當日發行公司或外國發行人須將該公開說明書電子檔傳送至金管會指定之網站，另價格確定後二日內須將完整公開說明書電子檔傳送至金管會指定之網站。 第一項公開說明書上揭露之價格區間應與承銷商辦理詢價公告之預計承銷價格之可能範圍一致。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，本承銷商於辦理公開承銷時將依左列規定辦理。

條次	自律規則條款	說明
第四條之十	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有股權轉換(認購、交換)性質之各種有價證券，應注意發行與轉換（認購、交換）辦法中應訂明下列事項： 一、債券到期還本付息之款項支付日。 二、發行條件中包含債券持有人之賣回權者，應訂明行使賣回權之款項支付日。 三、發行條件中包含發行公司之收回權者，應訂明行使收回權利之款項或有價證券交付日。 四、發行條件中包含交換權者，應訂明投資人行使交換權之有價證券交付日。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之十一	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權性質之各種公司債，應注意發行公司或外國發行人應依財務會計準則公報第 34 及 36 號規定設算應負擔年息總額是否符合公司法第 249 條第 2 款及第 250 條第 2 款之規定。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之十二	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後三個月內不得買回該公司股份。 現金增資發行新股案件，前項承諾書應承諾自申報日起至股票掛牌後一個月內不得買回本公司股份。 總括申報發行新股案件，第一項承諾書應承諾首次發行自申報日起及各次追補發行自承銷商出具評估總結意見之日起，至股票掛牌後一個月內不得買回本公司股份。	該公司本次係創新板初次上市前現金增資發行普通股案，已出具承諾書承諾自申報 案件日起至該有價證券掛牌後一個月內不得買回該公司股份。
第四條之十三	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募集人民幣計價海外公司債時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書及到期償債資金來源之計畫，承諾海外募得人民幣資金係供海外營運實體使用，不以任何方式匯回臺灣。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，非屬申報募集以人民幣計價之海外公司債，故不適用左列規定。
第四條之十四	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於公開說明書記載發行公司、發行公司之董事、監察人、總經理、財務長以及與發行公司辦理募資案件有關之經理人、受僱人，絕無要求或收取承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予發行公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等之聲明書，並依「公司募集發行有價證券公	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，謹遵左列規定事項辦理。

條次	自律規則條款	說明
	開說明書應行記載事項準則」編製公開說明書及簡式公開說明書，且於申報募資案件及向本公會申報承銷契約前，檢核上傳之公開說明書電子檔已確實用印且內容具完整性。	
第四條之十五	承銷商輔導外國發行人辦理申報「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第一項第一款至第三款募資案件時，應於募集完成年度及其後二個會計年度，協助其遵循中華民國證券相關法令。 承銷商輔導有重要子公司位於中國大陸之外國發行人辦理申報募資案，應輔導外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾應將在臺所募資金存放於台資銀行或其海外子（分）行並依計劃支用。承銷商並應將前揭資金控管情形納入每季之募資計畫執行情形併予評估。 承銷商依前項輔導外國發行人申報在臺募集與發行公司債案件，擔保銀行及受託銀行限於在我國設有營業據點之銀行。	該公司非屬外國發行人，故不適用左列規定。
第四條之十六	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應就發行公司或外國發行人之財務業務狀況製作檢查表，並於發行公司或外國發行人向金管會申報案件前五個營業日，向證交所或櫃買中心申報。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。
第四條之十七	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購、交換)權之各種有價證券，若發行條件中訂有收回條款者，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認股、交換）辦法中應訂明債券持有人請求轉換（認股、交換）之最後期限為終止櫃檯買賣日後第二個營業日。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。
第四條之十八	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應將發行公司或外國發行人辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，並協助其依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。	該公司本次辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，本承銷商已將該公司 辦理永續發展相關事項納入輔導評估流 程，該公司業已依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。

條次	自律規則條款	說明
第四條之十九	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報募資案件時,應出具發行公司或外國發行人是否應依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」,向中國證券監督管理委員會辦理備案之意見。承銷商應取得發行公司之說明意見,且發行公司應出具說明內容無虛偽、隱匿之聲明。	該公司並未於中國境內設有子公司，故不適用左列之規定。
第貳章　現金增資普通股		
第五條	承銷商輔導上市（櫃）公司、創新板上市公司辦理現金增資發行普通股,應於申報案件時出具發行公司或外國發行人之子公司不得參與新股認購之承諾書,如屬總括申報發行新股案件,並應承諾不得參與首次發行及各次追補發行之新股認購。	該公司非為上市(櫃)公司，本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第五條之一	承銷商輔導上市（櫃）公司、創新板上市公司、興櫃公司、戰略板興櫃公司辦理現金增資發行普通股,如申請延長募集期間且其財務預測無重大變動者,應檢送由發行公司或外國發行人出具經會計師複核之財務預測仍屬有效性聲明書。	本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股案，並未公告財務預測，故不適用左列規定。

條次	自律規則條款	說明
第五條之二	承銷商輔導發行公司或外國發行人以現金增資發行普通股申請初次上市（櫃）案件、股票申請創新板初次上市案件，除另有規定外，向金管會或其委託之機構申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，如有興櫃交易者，暫定價格不得低於向金管會或其委託之機構申報案件前興櫃(或戰略新板興櫃公司)有成交之十個營業日其成交均價（或戰略新板興櫃公司收盤價）簡單算術平均數之七成;如經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，得採股數區間方式辦理申報，並敘明實際發行價格或股數如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。 以現金增資發行新股辦理股票初次上市、上櫃、股票申請創新板上市前之承銷案件，主辦承銷商應與發行公司或外國發行人約定，由發行公司或外國發行人協調股東按該次現金增資對外公開銷售之一定比例之已發行普通股股票，供主辦承銷商於承銷期間進行過額配售，並應依本公會「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」辦理。	該公司本次辦理現金增資發行普通股係供申請創新板初次上市公開承銷之用，謹遵守左列之規定。另本承銷商已與該公司簽訂過額配售協議書，並依「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」辦理相關作業。

條次	自律規則條款	說明
第六條	承銷商輔導上市（櫃）承銷商輔導上市（櫃）公司、創新板上市公司辦理現金增資發行普通股如採公開申購配售辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成。 承銷商輔導興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理承銷，其發行價格除不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值外，應參考向本公會報備承銷契約前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之均價，並應提出合理說明。 戰略新板興櫃公司現金增資發行普通股採公開申購配售辦理承銷，其發行價格準用前項規定，惟用以計算之價格採戰略新板興櫃公司股票之收盤價。 承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	該公司非為上市(櫃)公司，且本次辦理創新板上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。
第六條之一	承銷商輔導上市（櫃）公司、創新板上市公司、興櫃公司及戰略新板興櫃公司辦理現金增資發行普通股,如發行公司依證券交易法第二十八條之一第三項規定,決議提撥發行新股總額超過百分之十對外採公開申購配售辦理承銷,其發行價格訂定方式應提報公司股東會。	該公司非為上市(櫃)公司，且本次辦理創新板上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。

條次	自律規則條款	說明
第七條	承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，如採詢價圈購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成；如採競價拍賣方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理競價拍賣公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權） 及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導創新板上市公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權） 及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導戰略新板興櫃公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，其發行價格準用第六條第三項規定，惟用以計算之價格採戰略新板興櫃公司股票之收盤價。 承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	該公司非為上市(櫃)公司，且本次辦理創新板上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。

條次	自律規則條款	說明
第七條之一	承銷商輔導上櫃（市）公司申請轉上市（櫃）為達股權分散標準辦理現金增資發行新股之承銷案件經股東會決議原股東全數放棄優先認股，採公開申購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理公開申購公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導發行公司向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	該公司非為上市(櫃)公司，且本次辦理創新板上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。
第八條	採詢價圈購配售辦理之承銷案件，於承銷契約報本公會前，如發行價格偏離市場價格過大者，應重新辦理詢價，並於詢價後，隨即進行承銷作業。 承銷商於向本公會申報承銷契約時，應一併檢送下列資料： 一、詢價圈購之相關資料（含詢價期間、詢價範圍、各圈購價格及其圈購股數、詢價公告暫訂發行價格占詢價公告日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之成數等資料）。 二、配售原則及預計配售予自然人、法人及本公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十六條第一項第一款至第七款有關董事、監察人、大股東、關係人等之股數及配售比率。 承銷商於向本公會申報承銷契約後，應隨即辦理承銷公告及相關承銷事宜。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股案件，本承銷商係採競價拍賣方式辦理公開，故不適用左列規定辦理。
第八條之一	承銷商輔導上市(櫃)公司辦理總括申報發行新股案件，準用第六條、第六條之一、第七條及第八條規定。	該公司非為上市(櫃)公司，且本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股案，故不適用左列規定。

條次	自律規則條款	說明
第九條	承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，其發行價格之訂定方式及依公司法第二百六十七條第一項保留員、工承購股份於員、工未認購時之處理方式，均應列成議案經股東會討論並決議通過。 承銷商輔導上市（櫃）公司向金管會申報案件，暫訂發行價格不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之八成。 實際發行價格不得低於訂價日收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之八成。 前項實際發行價格低於九成者，海外存託憑證持有人不得於發行後三個月內請求兌回，承銷商並應輔導上市（櫃）公司於發行計畫及存託契約中載明。 創新板上市公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案件，前各項規定準用之。	該公司非為上市(櫃)公司及創新板上市公司，且本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股案，故不適用左列規定。

綜上所述，該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件符合「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定，本承銷商本次輔導該公司辦理現金增資發行新股亦將依自律規則之規定辦理。

四、法令之遵循及對公司營運影響

(一)發行人是否符合公司法第一百二十九條、第一百三十條、第一百五十六條第五項、第一百六十七條第三項及第四項、第二百四十六條、第二百四十七條及證券交易法第二十八條之四規定，且無公司法第二百四十九條及第二百五十條、第二百六十九條及第二百七十條規定之情事

有關之法令條款內容	是否符合規定	查核程序及結論
1.公司法第 129 條 發起人應以全體之同意訂立章程，載明下列各款事項，並簽名或蓋章： (1)公司名稱。 (2)所營事業。 (3)採行票面金額股者，股份總數及每股金額；採行無票面金額股者，股份總數。 (4)本公司所在地。 (5)董事及監察人之人數及任期。 (6)訂立章程之年、月、日。	是	經檢視該公司之公司章程，業已於章程明訂左列各款事項。
2.公司法第 130 條 下列各款事項，非經載明於章程者，不生效力： (1)分公司之設立。 (2)解散之事由。 (3)特別股之種類及其權利義務。 (4)發起人所得受之特別利益及受益者之姓名。 前項第四款發起人所得受之特別利益，股東會得修改或撤銷之。但不得侵及發起人既得之利益。	是	經檢視該公司之公司章程，業已載明公司法 130 條第一項第一款事項，且自該公司設立後，尚無解散、發行特別股與發起人所得受之特別利益，故無違反左列規定。
3.公司法第 156 條第 5 項 股東之出資，除現金外，得以對公司所有之貨幣債權、公司事業所需之財產或技術抵充之；其抵充之數額需經董事會決議。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，未以現金以外之出資抵充情形，故不適用左列規定。
4.公司法第 167 條第 3 項及第 4 項 被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，不得將控制公司之股份收買或收為質物。	是	經查閱該公司最近期股東名冊及 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，截至評估報告出具日止，該公司無持有已發行有表決權之股份總數或

有關之法令條款內容	是否符合規定	查核程序及結論
前項控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數者，他公司亦不得將控制公司及其從屬公司之股份收買或收為質物。		資本總額超過半數之從屬公司；且未有直接或間接持有已發行有表決權之股份總數超過半數之公司，故無違反左列規定。
5.公司法第 246 條 公司經董事會決議後，得募集公司債。但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。 前項決議，應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意行之。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
6.公司法第 247 條 公開發行股票公司之公司債總額，不得逾公司現有全部資產減去全部負債後之餘額。 無擔保公司債之總額，不得逾前項餘額二分之一。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
7.證券交易法第 28 條之 4 已依本法發行股票之公司，募集與發行公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，依下列規定辦理，不受公司法第二百四十七條規定之限制： (1)有擔保公司債、轉換公司債或附認股權公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百。 (2)前款以外之無擔保公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之二分之一。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
8.公司法第 249 條 公司有下列情形之一者，不得發行無擔保公司債： (1)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實已了結者，自了結之日起三年	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。

有關之法令條款內容	是否符合規定	查核程序及結論
內。 (2)最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利,未達原定發行之公司債,應負擔年息總額之百分之一百五十。		
9.公司法第 250 條 公司有下列情形之一者，不得發行公司債： (1)對於前已發行之公司債或其他債務有違約或遲延支付本息之事實,尚在繼續中者。 (2)最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利,未達原定發行之公司債應負擔年息總額之百分之一百者。但經銀行保證發行之公司債不受限制。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
10.公司法第 269 條 公司有下列情形之一者，不得公開發行具有優先權利之特別股： (1)最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，不足支付已發行及擬發行之特別股股息者。 (2)對於已發行之特別股約定股息，未能按期支付者。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
11.公司法第 270 條 公司有下列情形之一者，不得公開發行新股： (1)最近連續二年有虧損者。但依其事業性質，須有較長準備期間或具有健全之營業計畫，確能改善營利能力者，不在此限。 (2)資產不足抵償債務者。	是	經參閱該公司 110 及 111 年度經會計師查核簽證之財務報告，未有連續二年虧損之情事;另經檢視 112 年第三季經會計師核閱之財務報告，該公司尚無資產不足抵償債務之情事，故無違反左列之規定。

綜上，該公司對上述各項應遵循之法令並未有違反情事，故對該公司之營運及本次有價證券之募集與發行應無不利影響。

(二)發行人是否有證券交易法第一百五十六條第一項各款情事

請參閱本評估報告伍、二、(二)、2.之評估說明。

(三)發行人及其現任董事、監察人、持股比例達百分之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人與從屬公司最近二個會計年度至刊印日止繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、與主管機關之往來函文、公開說明書、經會計師查核簽證之財務報告，及參閱蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之法律意見書及法律事項檢查表並取得該公司出具之聲明書，該公司及其現行董事、持股比例達百分之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人最近二個會計年度至評估報告刊印日止，尚無繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件。

(四)發行人或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近二個會計年度至刊印日止是否經法院判決有期徒刑以上之罪者

經查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止與主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並參閱蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之法律意見書及法律事項檢查表，該公司發行人或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近二年度至本評估報告刊印日止，並無經法院判決有期徒刑以上之罪情事。

(五)發行人及其各子公司目前仍有效存續、最近一個會計年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約及其他足以影響投資人權益之重要契約

經取具該公司出具之聲明書，及參閱蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、檢視該公司存續有效或最近一個會計年度到期之契約列示如下，並詢問該公司相關人員，該公司目前有效存續之重要契約均屬於正常營運所需而簽訂，尚無對該公司營運有重大限制條款而影響投資人權益之情事。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
廠房增建工程	富泰營造(股)公司	自建管單位開工核准日起540日曆天	擴線需求	無
土地租賃	廣源電子(股)公司	109/12/01~119/12/31	員工停車場	無
中期擔保借款	合作金庫銀行	112/05/26-114/03/31	授信合約	機器設備
中期擔保借款	合作金庫銀行	110/10/05-115/10/05	授信合約	機器設備
中期擔保借款	合作金庫銀行	108/12/04-113/12/04	授信合約	機器設備
中長期借款	第一商業銀行	112/05/11-115/03/14	授信合約	無
長期擔保借款	台北富邦商業銀行	111/05/11-118/05/11	授信合約	土地、房屋及建築物

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
中期擔保借款	台北富邦商業銀行	112/07/25-113/07/25	授信合約	房屋及建築物
中長期借款	華南商業銀行	112/05/18-115/03/12	授信合約	無
中期擔保借款	兆豐國際商業商銀行	112/08/07-114/08/07	授信合約	土地

資料來源：該公司提供。

(六)發行人及其各子公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件

經取具該公司出具之聲明書，並查閱該公司 110~111 年度及 112 年度截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、與主管機關之往來函文，並參閱蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之法律意見書，最近二年度及申報年度截至評估報告出具日止，該公司除下述勞資糾紛及汙染環境外，目前尚無重大勞資糾紛或污染環境事件，而下述勞資糾紛及汙染環境案件經評估對該公司營運、財務、業務狀況、獲利情形及證券價格並無重大之影響，其事發緣由說明如下：

1. 勞資糾紛

林○○前員工，原任職於製程工程部，任職期間有加班事實，但未依該公司規定填報申請加班，109 年 8 月離職後於 110 年 3 月 8 日提出勞資爭議強制執行訴訟，請求給付加班費 137,872 元，惟該員尚積欠公司 164,108 元，公司於 110 年 5 月 3 日提請訴訟，申請兩造雙方債務互為抵銷，經抵銷後該員需返還該公司 26,236 元，經公司考量後不向該員請求返還。今以臺灣新竹地方法院 110 年 7 月 12 日判決確定撤銷強制執行後結案。因應此次訴訟案，已加強宣導同仁延遲下班應確實申報於公司系統，公司系統於月底以電子郵件提醒同仁申報加班。

2. 汙染環境

該公司於 110 年 1 月 8 日經苗栗縣政府環保局至竹南廠稽查，查獲未依規定每日確實記錄廢(汙)水(前)處理設施操作參數(加藥量)等資料，違反水污染防治法第 18 條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 16 條規定，經苗栗縣政府 110 年 4 月 13 日以府環水字第 1100022824 號函依違反之事項裁處 1 萬元罰鍰並依環境教育法規定接受環境講習。

綜上所述，該公司尚無重大勞資糾紛或污染環境事件而對該公司財務業務產生重大不利影響之情事。

(七)發行人之資金用途須經目的事業主管機關同意者，其核准之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券之情事

該公司本次辦理現金增資發行新股案件，其資金用途係充實營運資金，並無須事先取得目的事業主管機關同意函，故亦無其核准之附帶事項

對本次募集與發行有重大影響之情事。

(八)承銷商因前項之評估需要，若有洽請律師出具意見者，應說明事項。

本次並無洽請律師對前項評估出具意見，故不適用。

五、說明發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內是否曾受法務部律師懲戒委員會懲戒，且是否與發行公司、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有財務會計準則公報第六號規定之關係人關係或其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者

(一)於最近一年內曾受法務部律師懲戒委員會懲戒。

(二)與發行人、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有下列關係之一：

1. 依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係。
2. 其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。

經取具蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之聲明書，其於最近一年內未曾受法務部律師懲戒委員會懲戒，且未與該公司、最近期財務報告簽證會計師及本承銷商間具有財務會計準則公報第六號規定之關係人關係，或其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者之關係。

陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

本承銷商依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定查核，所獲致結論如下：

一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有合理性

(一)本次計畫內容

1.本次計畫所需資金總額：新台幣 141,470 千元。

2.本次計畫資金來源及募集資金不足時處理方式：

(1)現金增資發行新股 4,042 千股，每股面額新台幣 10 元，發行價格暫定為每股新台幣 35 元，預計募集金額為新台幣 141,470 千元。

(2)本次資金運用計畫擬以現金增資發行新股支應，如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，將減少本次計畫金額，若致募集資金增加，則增加之資金亦將用於充實營運資金。

3.計畫項目及預計資金運用進度

單位：新台幣千元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預計資金運用進度
			112 年第一季
充實營運資金	113 年第一季	141,470	141,470

資料來源：該公司提供

4.預計可能產生效益

該公司本次辦理現金增資所募得資金 141,470 千元，擬全數用於充實營運資金，將可提高自有資本比率及健全財務結構，對該公司業務成長及整體營運發展應有正面助益。

(二)本次計畫之可行性評估

1.法定程序之可行性

該公司本次辦理上市前現金增資發行新股，業經 111 年 6 月 24 日董事會及 111 年 8 月 2 日股東臨時會決議通過辦理初次上市前現金增資提撥公開承銷案，且於 112 年 12 月 27 日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫。經核閱本次計畫之內容及決議程序，均符合「公司法」、

「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令之規定，另參閱蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之法律意見書，本次計畫已符合相關法令之規定，故本次計畫於法定程序上應屬適法可行。

2.募集資金完成之可行性

該公司本次辦理現金增資發行新股 4,042 千股，除依公司法第 267 條規定，保留發行股數之 15%，計 606 千股由該公司員工認購外，其餘 3,436 千股則依證券交易法第 28 條之 1 規定，於 111 年 8 月 2 日股東臨時會決議通過原股東放棄優先認購權利，排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用。本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股採全數競價拍賣方式辦理，另員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應足以確保本次資金募集完成，故本次計畫募集完成應具可行性。

3.資金運用計畫之可行性

該公司本次現金增資募集金額 141,470 千元擬全數用於充實營運資金，可望提高自有資本比率及強化財務結構以因應日後營運成長所需，亦可提升資金調度之彈性，提升整體競爭力，故本次現金增資之募集計畫應具可行性。

綜上所述，該公司本次現金增資發行新股計畫，就其法定程序、資金取得及資金運用計畫等各方面評估均具可行性，故整體而言，其籌資計畫應屬可行。

(三)本次計畫之必要性評估

本次辦理現金增資發行新股係依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 11 條規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上市前公開承銷，故依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 8 條第 3 項規定，得不適用有關募集資金計畫必要性之規定。

(四)本次計畫之合理性評估

1.資金運用計畫及預計進度之合理性

該公司本次辦理現金增資發行新股係作為初次上市前公開承銷，預計募得資金總額新台幣 141,470 千元將用於充實營運資金，經考量主管

機關審查時間及募集資金所需之作業時程，預計於 113 年第一季完成資金募集作業後，即可依本次計畫挹注該公司營運所需之資金，故本次現金增資之資金運用計畫及預計進度應屬合理。

2.預計可能產生效益之合理性

項目/年度		112 年第三季(增資前)	增資後(預估數)
財務結構	負債占資產比率(%)	42.67	39.96
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	126.02	135.89
償債能力	流動比率(%)	215.38	265.45
	速動比率(%)	206.38	256.45

資料來源：該公司提供。

註：係以 112 年第三季經會計師核閱之財務數字設算籌資後之財務比率。

該公司本次辦理現金增資發行新股，預計募集金額 141,470 千元將用於充實營運資金，計畫完成後將可強化財務結構並提升償債能力，預計負債比率將由 42.67%降低至 39.96%，長期資金占不動產、廠房及設備比率自 126.02%提升至 135.89%，流動比率自 215.38%提升至 265.45%，速動比率自 206.38%提升至 256.45%，顯見該公司本次籌資計畫不僅得以強化財務結構並提升償債能力，亦能提升資金調度之彈性，提升整體競爭力，對於該公司未來發展具有正面助益，故其本次籌資計畫預計可能產生之效益尚屬合理。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資用以充實營運資金，其資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益應具合理性。

一之一、總括申報發行新股案件者，應另就下列事項提供評估說明

該公司本次係辦理初次上市前現金增資發行新股，故不適用本項評估。

二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估

該公司本次募資計畫係依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股辦理初次上市前之公開銷售作業，故僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估。該公司本次辦理現金增資發行新股 4,042 千股，占該公司增資後預計流通在外普通股股數 68,702 千股之 5.88%，考量該公司整體營運及獲利維持穩定成長，且本次辦理現金增資係用於充實營運資金，除可支應該公司營運成長所需資金外，亦能強化財務

結構及增加資金調度彈性，對於公司競爭力及整體營運發展具有正面助益，故本次發行新股對該公司當年度每股盈餘之稀釋之影響尚屬有限，應不致對現有股東權益產生重大不利之影響。

三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性

(一)本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資者之評估。

該公司本次募集與發行有價證券資金運用計畫並非用於轉投資，故不適用本項評估。

(二)本次募集與發行有價證券資金計畫如用於償債或用於充實營運資金者之評估。

1.查閱該公司最近一個會計年度財務報告暨申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表，以了解該公司之營業特性、應收帳款收款、應付帳款付款政策、資本支出計畫與前揭現金收支預測表編製基礎之合理性及與財務預測之關聯性，並分析本次增資計畫對該公司資金需求狀況、資金不足時點與原因相關影響之必要性及合理性。前述現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益。

(1)營業特性

該公司主要從事半導體測試、半導體封裝及晶圓薄化等服務，其中測試及封裝服務主要係功率半導體之電源管理 IC、MOSFET 產品及以 GaN 或 SiC 為基材之第三代半導體產品。另因應客戶之終端產品廣泛應用於消費性電子產品、通訊、伺服器、工業電腦及汽車等電子元件之低功耗及低導通電阻需求，該公司亦提供晶圓薄化服務以滿足 MOSFET 或第三代半導體產品特性之所需。

封裝測試為半導體產業鏈後段的核心，對最終晶片的品質與性能至關重要，依據工研院產科國際所研究報告，隨著全球人工智慧、物聯網、5G、高效能運算及車用等應用需求持續成長，預估 2023 年全球半導體封測產業市場規模為 362 億美元，半導體產業已逐步回升。整體而言在未來電子裝置對於電源效率日趨嚴格及節能低碳經濟推升電源控制管理相關產品之需求下，將推動功率半導體市場的成長，該公司於未來營運成長應屬可期。

以現金流量觀點，該公司主要現金流入為銷貨所產生之應收帳

款收現，主要現金流出則為採購機台設備、原料以及營業費用所產生之應付帳款及費用付現，依該公司所編製之 112 年及 113 年各月份預計現金收支預測表，112 年 1~11 月份之實際數，其餘係參考過往年度實際營運狀況、歷史銷售經驗、產業未來趨勢發展、預估接單狀況及公司收付款政策等因素，作為編製申報年度及預計未來一年度各月份之收入與支出之依據，故其編製基礎應尚屬合理。

(2)應收帳款收款及應付帳款付款政策

應收帳款收款政策方面，係考量客戶之信用情形、財務狀況及過往交易之經驗等因素而予以不同之授信條件，對銷售客戶之平均授信條件約為月結 30~90 天。其每月應收款項現數之編制基礎除 112 年 1~11 月份係實際金額外，餘係考量該公司未來預估之銷售情形，並依據上開授信政策，復斟酌過去之歷史往來紀錄，作為預估 112 年 12 月及 113 年度各月份現金收支預測表之預算基礎，其編製基礎假設尚屬合理。

應付帳款付款政策方面，主要係依各原物料性質、交易金額及供應商授信情形等因素而定，對供應商之付款條件為月結 30~120 天，其每月應付款項現數之編制基礎除 112 年 1~11 月份係實際金額外，餘係參考對主要供應商之付款條件為依據，並綜合考量未來各月之客戶訂單用料情形、原物料價格變化及各存貨備料情形作為預估基礎，故該公司 112 年 12 月及 113 年度各月份應付款項付現之編製基礎尚屬合理。

(3)資本支出計畫

該公司之資本支出計畫係依未來經營策略及營運發展而定，將視公司業務發展需要並審慎評估後，依公司核決權限執行。該公司 112 及 113 年度各月份現金收支預測表中，不動產、廠房及設備支出主要係用於產線所需之各式設備，以提升生產品質、生產效率及擴大生產產能，而前述增添之不動產、廠房及設備所需資金係以自有資金及銀行借款支應，與本次募集資金用途並無直接關聯，其估列應尚屬合理。

(4)現金收支預測表編製基礎之合理性及與財務預測之關聯性

經檢視該公司編製之 112 及 113 年度各月份現金收支預測表，112 年 1~11 月份為實際數，112 年 12 月份及 113 年度則為預估數，其預估數係考量產業未來發展趨勢、公司營運狀況、實際出貨情形、

應收帳款與應付帳款政策，以及配合未來銷售情形等因素編製而成，經核對 112 年 1 月之期初現金餘額與 111 年度經會計師查核簽證之財務報表之現金餘額相符，且本次籌資款項之預計現金流入、資金運用進度與本次籌資計畫一致。整體而言，該公司申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表編制基礎尚屬合理。

另該公司並無對外公佈 112 年度及 113 年度之財務預測，故不適用現金收支預測表與財務預測之關聯性評估。

(5)本次增資計畫對發行人資金需求狀況、資金不足時點與原因相關影響之必要性及合理性

就該公司編製之 112 及 113 年度各月份現金收支預測表觀之，該公司自有資金尚屬充足，並無明顯資金缺口，惟為配合承銷制度之規定，爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第四條及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定」第二條規定，以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理公開承銷，故該公司本次現金增資計畫有其必要性及合理性。另該公司本次現金增資募集資金用於充實營運資金，將可增加該公司營運資金調度之靈活度、強化整體財務結構、藉以提升競爭力及降低企業經營風險。

(6)現金收支預測中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

根據該公司編製之現金收支預測表，112 年及 113 年之資本支出金額分別為 358,735 千元及 477,000 千元，達本次募資金額百分之六十(84,882 千元)，茲就資本支出之資金來源、用途及預計效益評估如下：

A. 資金來源及用途

該公司以功率元件與電源管理 IC 測試封裝為核心，隨著客戶終端產品應用之多元需求，因應半導體市場對第三代半導體氮化鎵及碳化矽為基材之產品需求增加，該公司亦持續投入相關之產品測試及封裝，以維持長期競爭力。為因應第三代半導體產線，既有廠房空間已不敷使用，在考量公司之營運發展需求及未來整體長期經營規劃，於 110 年 12 月 17 日經董事會決議通過增建竹南廠廠房計畫案，同時申請根留臺灣企業加速投資行動方案，本

次擴建廠房及購置機器設備所需資金預計分別為 510,000 千元及 1,045,800 千元。

資金來源依據「根留臺灣企業加速投資行動方案」，向金融機構辦理融資八成，金額約 1,244,640 千元，自有資金兩成，金額約 311,160 千元，本方案金融機構實際核准之總額度為 1,314,000 千元，該公司依照工程驗收進度及機器安裝驗收進度逐一向金融機構申請動撥。經參閱會計師核閱之 112 年第三季財務報告並檢視該公司自有資金水位，其現金及約當現金餘額為 274,992 千元，來自營業活動淨現金流入為 163,941 千元，經評估該公司本次擴廠資金來源及用途應屬可行。

B. 預計效益

該公司於 103 年即切入 GaN 晶圓測試領域，累積豐富測試技術及經驗，然 112 年因終端市場需求仍舊低迷使得營收放緩，惟預期 112 下半年在下游庫存調整接近尾聲後景氣有望逐步復甦，故仍持續投入資金擴充產能。

本次除擴建廠房外，另增建應用於電源管理 IC 及功率元件（包含 MOSFET 及第三代半導體）之晶圓測試智能化生產線及晶圓薄化智能生產線，以進行整體數位化控管，提升生產品質、效率及擴大產能，整體而言將有助於公司強化接單能力、擴大營運規模及爭取獲利契機，以提升競爭力，對公司未來營運應具正面之效益。

112 年度各月份之現金收支預測表

單位：新台幣千元

項目＼月份	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額 1	334,482	390,562	361,585	357,810	335,543	315,643	234,518	352,717	308,074	274,992	316,742	319,654	334,482
加：非融資性收入 2 應收帳款收現	119,366	68,669	86,055	56,024	84,249	63,064	84,206	82,973	60,774	96,354	106,291	78,000	986,025
其他應收款	10	10	10	8	10	879	11	13	11	11	11	600	1,584
合計	119,376	68,679	86,065	56,032	84,259	63,943	84,217	82,986	60,785	96,365	106,302	78,600	987,609
減：非融資性支出 3 應付帳款付現	6,098	5,694	6,516	4,682	6,752	6,637	6,850	5,677	6,788	8,902	6,361	6,150	77,107
薪資付現	42,625	26,454	27,159	27,671	27,050	34,855	26,374	39,615	35,195	26,714	26,616	28,000	368,328
員工酬勞及董事酬勞	—	—	—	—	—	—	—	5,337	—	—	—	—	5,337
費用付現	22,613	24,691	19,194	22,976	22,962	25,499	26,485	21,613	23,522	25,887	28,046	24,850	288,338
稅捐	152	—	114	—	233	990	139	—	160	—	180	320	2,288
不動產、廠房及設備	62,698	27,932	17,904	7,789	30,923	61,803	78,146	16,103	1,788	30,297	3,352	20,000	358,735
合計	134,186	84,771	70,887	63,118	87,920	129,784	137,994	88,345	67,453	91,800	64,555	79,320	1,100,133
要求最低現金餘額 4	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
所需資金總額 5=3+4	414,186	364,771	350,887	343,118	367,920	409,784	417,994	368,345	347,453	371,800	344,555	359,320	1,380,133
融資前可供支用現金餘額(短絀)6=1+2-5	39,672	94,470	96,763	70,724	51,882	(30,198)	(99,259)	67,358	21,406	(443)	78,489	38,934	(58,042)
融資淨額 7 短期借款	10,000	—	—	—	90,000	—	100,000	—	—	40,000	—	—	240,000
長期借款	85,000	—	—	—	—	—	87,000	173,996	—	10,000	18,300	—	374,296
支付股利	—	—	—	—	—	—	—	(96,990)	—	—	—	—	(96,990)
短期借款還款	(10,000)	—	—	—	(90,000)	—	—	(100,000)	—	—	(40,000)	—	(240,000)
長期借款還款	(14,110)	(12,885)	(18,953)	(15,181)	(16,239)	(15,284)	(15,024)	(16,290)	(26,414)	(12,815)	(17,135)	(17,000)	(197,330)
合計	70,890	(12,885)	(18,953)	(15,181)	(16,239)	(15,284)	171,976	(39,284)	(26,414)	37,185	(38,835)	(17,000)	79,976
期末現金餘額 8=1+2-3+7	390,562	361,585	357,810	335,543	315,643	234,518	352,717	308,074	274,992	316,742	319,654	301,934	301,934

113 年度各月份之現金收支預測表

單位：新台幣千元

項目＼月份	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額 1	301,934	351,247	336,365	452,349	455,719	403,933	386,475	388,589	416,503	435,617	450,631	470,845	301,934
加：非融資性收入 2													
應收帳款收現	96,564	84,069	95,000	90,536	80,000	91,842	90,000	95,000	89,000	92,000	108,000	88,000	1,100,011
其他應收款	14	14	14	14	14	700	14	14	14	14	14	700	1,540
合計	96,578	84,083	95,014	90,550	80,014	92,542	90,014	95,014	89,014	92,014	108,014	88,700	1,101,551
減：非融資性支出 3													
應付帳款付現	6,500	6,500	6,400	6,400	6,500	6,500	6,510	6,510	6,510	6,500	6,500	6,500	77,830
薪資付現	28,000	49,500	28,000	28,480	28,000	40,000	28,000	28,000	40,000	28,000	28,000	28,000	381,980
員工酬勞及董事酬勞	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
費用付現	25,465	26,465	25,800	25,800	26,000	26,000	26,090	26,090	26,090	26,000	26,000	26,000	311,800
稅捐	800	—	800	—	800	1,000	800	—	800	—	800	350	6,150
不動產、廠房及設備	20,000	50,000	43,000	60,000	54,000	50,000	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	477,000
合計	80,765	132,465	104,000	120,680	115,300	123,500	101,400	100,600	103,400	90,500	91,300	90,850	1,254,760
要求最低現金餘額 4	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
所需資金總額 5=3+4	360,765	412,465	384,000	400,680	395,300	403,500	381,400	380,600	383,400	370,500	371,300	370,850	1,534,760
融資前可供支用現金餘額(短絀)6=1+2-5	37,747	22,865	47,379	142,219	140,433	92,975	95,089	103,003	122,117	157,131	187,345	188,695	(131,275)
融資淨額 7													
短期借款	50,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000
長期借款	—	50,000	—	50,000	—	30,000	30,000	50,000	50,000	30,000	20,000	20,000	330,000
發行新股	—	—	141,470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,470
短期借款還款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長期借款還款	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	(198,000)
合計	33,500	33,500	124,970	33,500	(16,500)	13,500	13,500	33,500	33,500	13,500	3,500	3,500	323,470
期末現金餘額 8=1+2-3+7	351,247	336,365	452,349	455,719	403,933	386,475	388,589	416,503	435,617	450,631	470,845	472,195	472,195

2.就該公司申報年度財務槓桿、負債比率(或自有資產與風險性資產比率)、營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋等相關影響，了解本次增資計畫之必要性及合理性

該公司本次係辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷案件，故不適用必要性之評估，僅針對合理性評估如下：

(1)財務槓桿及負債比率

項目＼年度	111 年度	112 年前三季
財務槓桿度(倍)	1.04	0.92
負債比率(%)	38.01	42.67

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

財務槓桿度係衡量公司舉債經營之財務風險，評估利息費用之變動對於營業利益之影響程度，若公司未舉債經營，則其財務槓桿度為 1，數值愈高代表公司所承擔之財務風險愈大。該公司 111 年度及 112 年前三季之財務槓桿度分別為 1.04 倍及 0.92 倍，預計本次辦理現金增資發行新股所募集之資金用於充實營運資金後，將可適時降低該公司對銀行融資需求之依存度，並可提升長期資金之穩定性，對該公司之財務槓桿度將可有正面之影響。

負債比率係用以衡量公司財務結構與財務風險，該公司 111 年度及 112 年前三季之負債比率分別為 38.01%及 42.67%，預計本次辦理現金增資發行新股用以充實營運資金後，除了降低負債比率外，亦能增加資金靈活調度之彈性，有益於強化該公司財務結構及降低營運風險。

(2)營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋

單位：新台幣千元

項目＼年度	111 年度	112 年前三季
營業收入	1,226,677	620,556
本期淨利(損)	168,338	(55,133)
每股盈餘(元)	2.70	(0.85)

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司本次資金用於充實營運資金，除可強化財務結構、提升自有資金比率及償債能力，降低公司經營風險，並維持公司正常營運所需資金靈活調度之彈性，是以本次現金增資計畫對營收成長應有正面之貢獻，此外，該公司本次辦理現金增資發行新股，預計於

113 年第一季募集完成，目前流通在外股數為 64,660 千股，本次擬發行 4,042 千股，合計 68,702 千股，股本增加比率為 6.25%，雖造成股本膨脹，惟此次所募集之款項用於充實營運資金，將對該公司業績之持續成長有所助益，預計其未來獲利能力尚不致因股本膨脹而對股東權益產生重大不利之影響，故本次辦理現金增資發行新股對該公司每股盈餘稀釋之影響尚屬有限。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資發行新股所募資金用以充實營運資金，對其財務槓桿、負債比率、營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋並無重大之不利影響，其募資計畫應具合理性。

(三)本次增資計畫如用於購買營建用地或支付營建工程款者，就預計自購置土地至營建個案銷售完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點與金額，評估可能產生效益是否具有合理性

該公司本次辦理現金增資發行新股之資金計畫係用於充實營運資金，並非用於購買營建用地或支付營建工程款，故不適用本項評估。

(四)本次增資計畫如用於購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應評估其賣方轉讓之理由、受讓價格之依據及其合理性，受讓過程是否適法及對契約相對人權利義務之影響

該公司本次辦理現金增資發行新股之資金計畫係用於充實營運資金，並非用於購買未完工程並承受賣方未履行契約之情事，故不適用本項評估。

三之一、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性

該公司本次辦理現金增資發行新股係採現金出資方式，故不適用本項評估。

四、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應評估其可行性與合理性

該公司本次增資計畫並未併同減資計畫辦理，故不適用本項評估。

五、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響

該公司本次增資計畫非以低於票面金額辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

六、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式者，應評估事項

(一)已上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股原股東未放棄優先認股，採公開申購配售方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性。

該公司本次係辦理現金增資發行新股以供初次上市公開承銷，故不適用本項評估。

(二)已上市(櫃)公司辦理現金增資，經股東會已決議原股東全數放棄優先認購，採全數詢價圈購或競價拍賣方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第七條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性。及暫定發行股數區間是否符合公司法第一百二十九條第三款規定之情事。

該公司本次係辦理現金增資發行新股以供初次上市公開承銷，故不適用本項評估。

(三)以現金增資發行普通股申請初次上市(櫃)案件向金管會申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，並敘明實際發行價格如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，其適法性及合理性

該公司於 112 年 12 月 27 日經董事會決議辦理現金增資發行普通股 4,042 千股，每股面額新台幣 10 元，暫定每股發行價格為新台幣 35 元，其係依一般市場承銷價格訂定方式，參考本益比法，以及該公司近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格。本次現金增資之重要內容，包括但不限於發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，已於 112 年 12 月 27 日董事會授權董事長全權處理，故本次現金增資於法定程序應屬可行。若每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，其差額將減少充實營運資金，惟若募集金額高於預計募集資金，增加之部分亦將用於充實營運資金，故其募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，皆具適法性及合理性。

(四)公司債未足額發行者，需就募集資金不足時之處理方式之合理性予以說明。

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上市案，故不適用本項評估。

七、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股，故不適用本項評估。

陸之一、是否確實依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，本承銷商已將該公司辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，該公司業已依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。

柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

捌、就本次公司債發行(及轉換)辦法之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

拾、就本次發行公司債債權確保情形(列明有無擔保、擔保品種類與價值等)蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

拾貳、就本次附認股權公司債、分離型認股權公司債射算理論價值之各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

無。

拾肆、於公開說明書刊印日期，如有重大期後事項，亦應查明本要點各相關事項並加以更新說明與評估。

無。

主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司

負責人：陳佩君

中　華　民　國　　１１２　　年　　１２　　月　　２８　　日

(註：本用印僅限於微矽電子股份有限公司一一二年度現金增資案件評估報告使用)

微矽電子股份有限公司

董事長：張秉堂